반기보고서	
【 대표이사 등의 확인 】	2
I. 회사의 개요	3
1. 회사의 개요	3
2. 회사의 연혁	11
3. 자본금 변동사항	17
4. 주식의 총수 등	17
5. 정관에 관한 사항	18
II. 사업의 내용	20
1. 사업의 개요	20
2. 주요 제품 및 서비스	22
3. 원재료 및 생산설비	23
4. 매출 및 수주상황	30
5. 위험관리 및 파생거래	35
6. 주요계약 및 연구개발활동	41
7. 기타 참고사항	46
III. 재무에 관한 사항	66
1. 요약재무정보	66
2. 연결재무제표	69
2-1. 연결 재무상태표	69
2-2. 연결 손익계산서	70
2-3. 연결 포괄손익계산서	71
2-4. 연결 자본변동표	71
2-5. 연결 현금흐름표	72
3. 연결재무제표 주석	73
1. 일반적 사항 (연결)	73
2. 중요한 회계처리방침 (연결)	81
3. 범주별 금융상품 (연결)	82
4. 공정가치금융자산 (연결)	84
5. 재고자산 (연결)	85
6. 관계기업 및 공동기업 투자 (연결)	86
7. 유형자산 (연결)	90
8. 무형자산 (연결)	92
9. 차입금 (연결)	92
10. 사채 (연결)	94
11. 순확정급여부채(자산) (연결)	95
12. 충당부채 (연결)	96
13. 우발부채와 약정사항 (연결)	98
14. 계약부채 (연결)	98
15. 자본금 (연결)	99
16. 연결이익잉여금 (연결)	100
17. 기타자본항목 (연결)	101
18. 비용의 성격별 분류 (연결)	102
19. 판매비와관리비 (연결)	103
20. 기타수익 및 기타비용 (연결)	

	21. 금융수익 및 금융비용 (연결)	105
	22. 법인세비용 (연결)	106
	23. 주당이익 (연결)	106
	24. 현금흐름표 (연결)	107
	25. 재무위험관리 (연결)	109
	26. 부문별 보고 (연결)	120
	27. 특수관계자와의 거래 (연결)	122
	28. 매각예정분류(처분자산집단) (연결)	129
4.	재무제표	130
	4-1. 재무상태표	130
	4-2. 손익계산서	131
	4-3. 포괄손익계산서	132
	4-4. 자본변동표	132
	4-5. 현금흐름표	133
5.	재무제표 주석	134
	1. 일반적 사항	134
	2. 중요한 회계처리방침	134
	3. 범주별 금융상품	135
	4. 공정가치금융자산	137
	5. 재고자산	138
	6. 관계기업 및 공동기업 투자	139
	7. 유형자산	140
	8. 무형자산	141
	9. 차입금	142
	10. 사채	144
	11. 순확정급여부채(자산)	144
	12. 충당부채	145
	13. 우발부채와 약정사항	147
	14. 계약부채	148
	15. 자본금	148
	16. 별도이익잉여금	149
	17. 기타자본항목	150
	18. 비용의 성격별 분류	151
	19. 판매비와관리비	152
	20. 기타수익 및 기타비용	153
	21. 금융수익 및 금융비용	154
	22. 법인세비용	155
	23. 주당이익	155
	24. 현금흐름표	156
	25. 재무위험관리	158
	26. 부문별 보고	167
	27. 특수관계자와의 거래	168
6.	배당에 관한 사항	191
7.	증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항	194
	7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적	194
	7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적	197
8.	기타 재무에 관한 사항	198

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견	223
V. 회계감사인의 감사의견 등	224
1. 외부감사에 관한 사항	224
2. 내부통제에 관한 사항	232
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항	233
1. 이사회에 관한 사항	233
2. 감사제도에 관한 사항	252
3. 주주총회 등에 관한 사항	258
VII. 주주에 관한 사항	262
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항	271
1. 임원 및 직원 등의 현황	271
2. 임원의 보수 등	323
IX. 계열회사 등에 관한 사항	333
X. 대주주 등과의 거래내용	356
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항	361
1. 공시내용 진행 및 변경사항	361
2. 우발부채 등에 관한 사항	361
3. 제재 등과 관련된 사항	365
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항	371
XII. 상세표	376
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)	376
2. 계열회사 현황(상세)	388
3. 타법인출자 현황(상세)	404
4. 연구개발실적(상세)	408
【 전문가의 확인 】	430
1. 전문가의 확인	430
2. 전문가와의 이해관계	430

반기보고서

(제 56 기)

2024년 01월 01일 부터 사업연도

2024년 06월 30일 까지

금융위원회

한국거래소 귀중 2024년 8월 14일

제출대상법인 유형: 주권상장법인 면제사유발생: 해당사항 없음

회 사 명: 삼성전자주식회사

대 표 이 사: 한 종 희

본 점 소 재 지: 경기도 수원시 영통구 삼성로 129(매탄동)

(전 화) 031-200-1114

(홈페이지) http://www.samsung.com/sec

작 성 책 임 자: (직 책) 재경팀장 (성 명) 김 동 욱

(전 화) 031-277-7218

【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당임원으로서 2024년 반기보고서의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인·검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 반기보고서에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제8조의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.

> 2024. 8. 14 삼성전자 주식회사

대표이사: 한 종 희

신고업무 담당임원: 박 학 규

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 회사의 법적 · 상업적 명칭

당사의 명칭은 삼성전자주식회사이고 영문명은 Samsung Electronics Co., Ltd. 입니다.

나. 설립일자

당사는 1969년 1월 13일에 삼성전자공업주식회사로 설립되었으며, 1975년 6월 11일 기업공개를 실시하였습니다. 당사는 1984년 2월 28일 정기주주총회 결의에 의거하여 상호를 삼성전자공업주식회사에서 삼성전자주식회사로 변경하였습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주소: 경기도 수원시 영통구 삼성로 129(매탄동)

전화번호: 031-200-1114

홈페이지: https://www.samsung.com/sec

라. 주요 사업의 내용

당사는 제품의 특성에 따라 DX(Device eXperience), DS(Device Solutions) 2개의 부문과 패널 사업을 영위하는 SDC(삼성디스플레이㈜ 및 그 종속기업), 전장부품사업 등을 영위하는 Harman(Harman International Industries, Inc. 및 그 종속기업)으로 나누어 경영을 하고 있습니다.

당사는 본사를 거점으로 한국과 DX 부문 산하 해외 9개 지역총괄, DS 부문 산하 해외 5개 지역총괄의 생산·판매법인 및 SDC, Harman 산하 종속기업 등 226개의 종속기업으로 구성된 글로벌 전자 기업입니다.

각 부문별 주요 제품은 다음과 같습니다.

부문	주 요 제 품	
DX 부문	TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 스마트폰, 네트워크시스템, 컴퓨터 등	
DS 부문	DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등	
SDC	스마트폰용 OLED 패널 등	
Harman	디지털 콕핏(Digital Cockpit),카오디오, 포터블스피커 등	

[DX 부문]

DX 부문은 TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨 및 스마트폰, 태블릿, 웨어러블(Wearable) 제품, 네트워크 시스템 등을 생산·판매하는 사업으로 구성되어 있습니다.

TV사업은 2006년 부터 2023년까지 18년 연속 판매 1위를 유지하고 있습니다. 업체간 경쟁이 심화되는 가운데, 당사는 초대형 TV를 선두로 하여, 주력제품에 AI신기술을 대폭 적용해경쟁사들과의 기술격차를 벌리고 있습니다. 또한, 가전사업은 소비자들의 다양한 요구에 맞춘 비스포크(BESPOKE)를 통해 차별화된 제품, 기술 및 디자인으로 글로벌 시장을 이끌고 있습니다.

모바일사업은 2011년부터 2023년까지 13년 연속 글로벌 출하량 1위를 유지하고 있습니다. '갤럭시(Galaxy)' 브랜드를 통해 프리미엄부터 보급형까지 다양하고 경쟁력 있는 스마트폰라인업과 태블릿, 웨어러블, 디지털 월렛 등을 활용하여 시장 상황에 최적화된 제품 포트폴리오를 운영하고 있습니다.

당사는 업계 최고 수준의 R&D 역량을 바탕으로 지속적인 기술 혁신 및 철저한 미래 준비를 통해 고객에게 새로운 가치를 끊임없이 제공하겠습니다. 제품과 서비스의 지속적인 발전을 통해 친환경 기술 혁신을 이어가고, 연구개발을 통해 시장 패러다임 변화를 선도해 나가겠습니다.

[DS 부문]

DS 부문은 DRAM, NAND Flash 등 제품을 생산·판매하는 메모리 반도체 사업과 모바일 AP, 카메라 센서칩 등을 설계·판매하는 System LSI 사업, 반도체 제조 위탁 생산을 하는 Foundry 사업 등으로 구성되어 있습니다.

메모리 반도체 사업은 DRAM, NAND Flash 제품 등에 선단 공정 기술을 적용하고, 고부가 솔루션 중심의 사업 포트폴리오 운영을 통해 제품을 차별화하고 원가 경쟁력을 제고 하는 등 질적 성장에 주력하여 전 세계 메모리 시장에서 선두 자리를 지속적으로 유지하고 있습니다.

System LSI 사업은 모바일용 반도체 사업에서 차량용 반도체 사업으로 확장을 추진 중이며, On-Device AI 적용, 고성능 IP 탑재 등 제품의 차별화를 통해 고객과 협력 강화 및 응용처를 다변화하여 시장 지배력을 확대하는 한편, 차세대 기술 개발도 지속 추진하고 있습니다.

Foundry 사업은 글로벌 시장 수요 회복 지연에 따른 부진 장기화 극복을 위해 Advanced 공정에서 지속적인 기술 경쟁력 강화를 통해 중장기 수요 확보에 집중하고 있으며, Mature 공정에서는 고객 중심의 디자인 인프라를 제공하고, 고수익 응용처 확대에 집중하고 있습니다.

[SDC]

SDC의 중소형 패널 사업은 차별화된 기술을 바탕으로 OLED 패널의 점유율을 확대하는 한 편 폴더블 · IT(태블릿/노트북) · Auto 등 다양한 응용처의 제품 출시를 통해 시장 영역을 넓혀 나가고 있습니다. 또한, 대형 패널 사업은 고화질, 초대형, 퀀텀닷(Quantum Dot) 등 프리미엄 제품 중심으로 사업을 특화하고, 기술 및 생산성 향상을 지속 추진하여 사업 경쟁력을 제고하고 있습니다.

[Harman]

Harman은 커넥티드카 제품 및 솔루션 등을 개발 및 공급하는 전장부품 사업과 일반 오디오 제품 및 프로페셔널 오디오 솔루션을 제공하는 라이프스타일 오디오 사업을 운영하고 있습니다.

전장부품 시장의 선두업체로서 완성차 업체들에게 경쟁력 있는 제품을 공급하고 있을 뿐 아니라, 오디오 시장에서도 혁신 제품 판매를 통해 일반 소비자들과 음악 애호가들 사이에서 명성을 쌓아왔습니다.

또한, 당사 타 제품군과의 협업 확대를 통해 차별화된 고객 경험을 제공하고 자체 개발 및 전략적 인수 등을 통해 각 사업 분야에서 경쟁력을 강화하고 있습니다.

☞ 사업부문별 자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참고하시기 바랍니다.

마. 연결대상 종속회사 현황(요약)

기업회계기준서(K-IFRS) 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배회사(최상위)인 당사의 연결 대상 종속기업은 2024년 반기말 현재 226개사입니다. 전년말 대비 1개 기업이 증가하고 7개 기업이 감소하였습니다.

(단위: 사)

구분	연결대상회사수				주요
十七	기초	증가	감소	기말	종속회사수
상장	_	_	_	_	_
비상장	232	1	7	226	142
합계	232	1	7	226	142

[※]상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

(당기 연결대상회사의 변동내용)

구 분	자회사	사 유
신규	Harman International (Thailand) Co., Ltd.	설립
연결	_	_
	Harman Financial Group LLC	청산
	Samsung Display Slovakia, s.r.o., v likvidacii (SDSK)	청산
O4 74	Samsung Electronics Overseas B.V. (SEO)	청산
연결 제외	DOWOOINSYS VINA COMPANY LIMITED	매각
NI JI	㈜도우인시스	매각
	지에프㈜	매각
	SVIC 48호 신기술투자조합	청산

바. 중소기업 해당 여부

당사는「중소기업기본법」제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

중소기업 해당 여부		미해당	
벤처기업 해당 여부		미해당	
중견기업 해당 여부		미해당	

사. 신용평가에 관한 사항

당사는 Moody's(미국) 및 S&P(미국)로부터 신용등급 평가를 받고 있습니다. 2024년 반기말 현재 Moody's의 당사 평가등급은 Aa2, 전망치는 안정적(Stable)이고, S&P의 당사 평가등급은 AA-, 전망치는 안정적(Stable)입니다.

평가대상 유가증권	평가일	평가대상 유가증권의 신용등급	평가회사	비고
	2022.08	AA-	S&P	정기평가
회사채	2022.09	Aa2	Moody's	정기평가
US\$ Bond ('97년 발행,	2023.07	AA-	S&P	정기평가
'27년 만기)	2023.08	Aa2	Moody's	정기평가
	2024.02	Aa2	Moody's	정기평가

※ 신용평가등급 범위: Moody's (Aaa~C), S&P (AAA~D)

구 분	Moody's		S&P		
十七	등 급	정 의	등급	정 의	
	Aaa 채무상환능력 최상, 신용위험 최소		AAA	채무상환능력이 극히 높음, 최고등급	
투자적격	Aa1/Aa2/Aa3	채무상환능력 높음, 신용위험 매우 낮음	AA+/AA/AA-	채무상환능력이 매우 높음	
등급	A1/A2/A3	채무상환능력 중상, 신용위험 낮음	A+/A/A-	채무상환능력은 충분하나 경제 상황 악화 및 변화에 다소 취약함	
00	Baa1/Baa2/	채무상환능력 중간, 신용위험 크지 않으나	BBB+/BBB/	채무상환능력은 충분하나 상위 등급에 비해 경제 상황 악화에	
	Baa3	투기적 요소가 있음	BBB-	좀 더 취약함	
	De1/De0/De0	트기저 서화 시요이침 사다하	00.1/00/00	가까운 장래에 채무불이행이 발생할 가능성은 비교적 낮으나	
	Bai/Baz/Bas	투기적 성향, 신용위험 상당함	BB+/BB/BB-	경영, 재무, 경제 상황 악화에 대한 불확실성이 큼	
	B1/B2/B3	투기적 성향, 신용위험 높음	B+/B/B-	경영, 재무, 경제 상황 악화에 좀 더 취약하나	
				현재로서는 채무상환능력이 있음	
	Caa	투기적 성향 높음, 신용위험 매우 높음	ccc	현재 채무불이행 가능성이 있으며 채무상환은 경영, 재무, 경제	
투기				상황이 호의적일 경우에만 가능함	
등급		투기적 성향 매우 높음, 가까운 시일 내		채무불이행 가능성이 높음, 부도 상태는 아니지만	
	Ca	부도발생 가능, 원리금 상환가능성 존재	CC	사실상 부도가 예상됨	
	0	부도 상태, 원리금 상환가능성 낮음	0	현재 채무불이행 가능성이 매우 높으며 최종 회수율은	
	С		С	상위등급 채무보다 낮게 추정됨	
			0	금융채무불이행 상태 혹은 묵시적 계약 (imputed promises) 파	
	D		U	기, 또는 파산 신청 혹은 이와 유사한 상태	

☞ 당사의 종속기업이 발행한 회사채 및 기업어음 등에 대한 신용등급 평가결과는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

아. 주권상장(또는 등록・지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

당사는 1975년 6월 11일 유가증권시장에 기업공개를 실시하였습니다.

	주권상장 (또는 등록·지정)일자	특례상장 유형
유가증권시장 상장	1975년 06월 11일	해당사항 없음

2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

당사의 본점소재지는 경기도 수원시 영통구 삼성로 129(매탄동)입니다. 공시대상기간 중 본점소재지의 변경 사항은 없습니다.

나. 경영진의 중요한 변동

당사의 이사회는 주주총회에서 선임한 이사로 구성되며 회사 업무의 중요사항을 결의합니다. 2024년 반기말 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인(한종희, 노태문, 박학규, 이정배), 사외이사 6인(김한조, 김준성, 허은녕, 유명희, 신제윤, 조혜경), 총 10인의 이사로 구성되어 있습니다.

당사의 대표이사는 이사회에서 선임하며 각자 회사를 대표합니다. 2024년 반기말 현재 당사의 대표이사는 한종희 사내이사(2022년 2월 선임, 2023년 3월 재선임)입니다. 경계현 대표이사는 2024년 5월 21일 대표이사직과 사내이사직을 사임하였습니다.

H = OLT	선임 주총종류			임기만료	
변동일자	수중공뉴	신규	재선임	또는 해임	
2020 02 10	정기주총	사내이사 한종희			
2020.03.18	0/170	사내이사 최윤호	_	_	
			사내이사 김기남		
				사내이사 김현석	
			사내이사 고동진		
2021.03.17	정기주총	-	사외이사 박병국	-	
			사외이사 김종훈		
			(감사위원회 위원이 되는)		
			사외이사 김선욱		
			대표이사 김기남		
2021.03.17	_	-	대표이사 김현석	-	
			대표이사 고동진		
2021.12.31	_	_	_	사내이사 최윤호(사임)	
				대표이사 김기남(사임)	
2022.02.15	_	대표이사 한종희	_	대표이사 김현석(사임)	
				대표이사 고동진(사임)	
		사내이사 경계현			
		사내이사 노태문		사내이사 김기남(사임)	
2022.03.16	정기주총	사내이사 박학규	사외이사 김한조	사내이사 김현석(사임)	
2022.00.10		사내이사 이정배	//되어서 급근도	사내이사 고동진(사임)	
		사외이사 한화진		기대에게 포용근(기급)	
		사외이사 김준성			
2022.03.16	-	대표이사 경계현	-	-	
2022.03.19	_	_	_	사외이사 박재완(임기만료)	
2022.00.13				사외이사 안규리(임기만료)	
2022.04.20	-	_	_	사외이사 한화진(사임)	
2022.05.17	_	-	_	사외이사 박병국(기타퇴임)	
2022.11.03	임시주총	사외이사 허은녕	_	_	
2022.11.03	1 1 N T 5	사외이사 유명희	_	_	
2023.03.15	정기주총	_	사내이사 한종희	_	
2023.03.15	-	-	대표이사 한종희	-	
		사외이사 신제윤			
2024.03.20	정기주총	(감사위원회 위원이 되는)	_	사외이사 김선욱(기타퇴임)	
		사외이사 조혜경			
2024.03.22	_	-	_	사외이사 김종훈(임기만료)	
0004.05.04				대표이사 및 사내이사 경계현(사임	
2024.05.21	_	_	_)	

 ^{※ 2024}년 3월 20일 주주총회에서 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인으로 조혜경 사외이사가 선임됨에 따라
 2021년 동일한 방식으로 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 선임된 김선욱 사외이사는 2024년 3월 20일 사임 형식으로

퇴임하게 되었습니다.

다. 최대주주의 변동

2021년 4월 29일에 기존 최대주주가 소유하던 당사 주식의 상속으로 인해 최대주주가 삼성 생명보험㈜으로 변동되었습니다.

(기준일: 2024년 06월 30일)

(단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비고
2021.04.29	삼성생명보험㈜	1,263,050,053	21.16%	변동전 최대주주의 피상속	_

※ 소유주식수 및 지분율은 최대주주 및 그 특수관계인의 합산 내역이며,의결권 있는 주식(기타 법률에 의해 의결권 행사가 제한된 주식도 포함) 기준입니다.

☞ 최대주주 관련 자세한 사항은 'VII. 주주에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

라. 상호의 변경

2021년 중에는 종속기업 Samsung Electronics Portuguesa S.A. (SEP) 사명이 Samsung Electronics Portuguesa, Unipessoal, Lda. (SEP)로 변경되었습니다.

2023년 중에는 종속기업 Emerald Intermediate, Inc. 사명이 Samsung Display America Holdings, Inc. (SDAH)로 변경되었습니다.

☞ 당사(지배기업) 및 주요 종속기업 기준으로 작성하였습니다. 주요 종속기업에 대한 사항은 'XII. 상세표'의 '1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 항목을 참고하시기 바랍니다.

마. 합병 등에 관한 사항

2021년 중 종속기업 Viv Labs, Inc.는 종속기업 Samsung Research America, Inc (SRA)에 합병되었습니다. 또한, 종속기업 Prismview, LLC는 종속기업 Samsung Electronics America, Inc. (SEA)에 합병되었습니다.

2023년 중 종속기업 Samsung Display America Holdings, Inc. (SDAH)는 eMagin Corporation 지분을 인수하였습니다.

☞ 당사(지배기업) 및 주요 종속기업 기준으로 작성하였습니다. 주요 종속기업에 대한 사항은 'XII. 상세표'의 '1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 항목을 참고하시기 바랍니다.

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

공시대상기간 중 해당사항 없습니다.

사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

(1) 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생

연도	내용
	'그랑데 AI' 인공지능 기반 세탁기 • 건조기 출시
2020	AI·차세대 슈퍼컴퓨터용 초고속 DRAM 출시
2020	'Galaxy Z 플립' 최초 폴더블폰 공개
	세계 최대 규모 평택 반도체 2라인 가동
	'Neo QLED TV' 공개
2021	전세계 반도체 업체 최초 전 사업장 '탄소/물/폐기물 저감' 인증
2021	업계 최선단 14나노 EUV DDR5 D램 양산
	미국 테일러市에 신규 파운드리 라인 투자 발표
	BESPOKE 인피니트 라인 공개
2022	세계 최초 3나노 GAA 파운드리 양산
2022	차세대 반도체 R&D단지 기공식
	1Tb 8세대 V낸드 양산
	초고화소 기술 집약된 2억 화소 이미지센서 '아이소셀 HP2' 출시
	업계 최선단 12나노급 D램 양산
2023	'Galaxy Z 폴드5', 'Galaxy Z 플립5' 공개
	현존 최대 용량 32Gb DDR5 D램 개발
	생성형 Al '삼성 가우스' 공개
	새로운 AI폰 'Galaxy S24 시리즈' 공개
	15년 연속 글로벌 상업용 디스플레이 시장 1위 달성
2024	업계 최고 속도 LPDDR5X 개발 성공
	업계 최초'9세대 V낸드' 양산
	BESPOKE 냉장고, 출시 5년만에 누적 판매 300만대 돌파

(2) 조직의 변경

당사는 2021년 12월 중 기존의 CE 부문과 IM 부문을 DX 부문으로 통합하였으며, 무선사업부의 명칭을 MX(Mobile eXperience)사업부로 변경하였습니다. 또한 내부 조직체 계에 맞추어 SDC를 DS 부문과 별도로 구분하였습니다.

[2021년 12월]

	변경전	변경후
사업	CE 부문 (영상디스플레이, 생활가전, 의료기기) IM 부문 (무선, 네트워크)	DX 부문 (영상디스플레이, 생활가전, 의료기기, Mobile eXperience, 네트워크)
조직	DS 부문 (메모리, System LSI, Foundry, 디스플레이 패널)	DS 부문 (메모리, System LSI, Foundry) SDC (디스플레이 패널)
	Harman 부문	Harman
지역	한국, 북미, 중남미, 구주, CIS, 서남아, 동남아, 중국, 중동, 아프리카	한국, 북미, 중남미, 구주, CIS, 서남아, 동남아, 중국, 중동, 아프리카
총괄	미주(DS), 구주(DS), 중국(DS), 동남아(DS), 일본(DS)	미주(DS), 구주(DS), 중국(DS), 동남아(DS), 일본(DS)

3. 자본금 변동사항

자본금 변동사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 반기보고서에 기재하지 않습니다. (사업보고서 등에 기재 예정)

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

2024년 반기말 현재 당사가 발행한 기명식 보통주식(이하 "보통주") 및 무의결권 기명식 우선주식(이하 "우선주")의 수는 각각 7,780,466,850주와 1,194,671,350주입니다. 당사는 2024년 반기말 현재까지 보통주 1,810,684,300주와 우선주 371,784,650주를 이사회 결의에 의거 이익으로 소각한 바 있습니다. 2024년 반기말 현재 유통주식수는 보통주 5,969,782,550주, 우선주 822,886,700주입니다.

(기준일: 2024년 06월 30일) (단위:주)

구 분		주식의 종류	ш¬		
		보통주	우선주	합계	비고
1. 빌	행할 주식의 총수	20,000,000,000	5,000,000,000	25,000,000,000	-
Ⅱ. 현	재까지 발행한 주식의 총수	7,780,466,850	1,194,671,350	8,975,138,200	_
Ⅲ. 현	재까지 감소한 주식의 총수	1,810,684,300	371,784,650	2,182,468,950	-
	1. 감자	1	-		_
	2. 이익소각	1,810,684,300	371,784,650	2,182,468,950	자사주소각
	3. 상환주식의 상환	_	-	_	_
	4. 기타	_	-	_	_
IV. 빌	·행주식의 총수 (II-III)	5,969,782,550	822,886,700	6,792,669,250	_
V. 자기주식수		-	-	_	_
VI. 유	통주식수 (IV-V)	5,969,782,550	822,886,700	6,792,669,250	_

5. 정관에 관한 사항

가. 정관 이력

당사는 제55기 정기주주총회(2024년 3월 20일)에서 정관 일부를 변경하였습니다.

☞ 정관변경에 대한 자세한 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 제55기 정기주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유
2024.03.20	제 55기 정기주주총회	 주권의 종류 삭제 명의개서대리인의 사무처리 내용 변경, 명의개서 대리인에 대한 주주정보 신고 조항 삭제, 소유자명세에 기반한 주주명부 작성 등 신설 주주명부 폐쇄 관련 사항 삭제 주식, 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록 근거조항 신설 이사회 산하 위원회로 보상위원회, 지속가능경영위원회, 내부거래위원회를 명시 이사회의 소집 통지기한을 '24시간 전'에서 '7일 전(단, 긴급시 24시간으로 단축 가능)'으로 변경 기타 조문 정비: 제38조(이익금의 처분), 제40조(내부거래 등의 승인) 	- 전자증권 관련 조문 정비 - 이사회 산하 설치되어 있는 위원회 종류 추가 - 이사회 소집통지 시점 변경

나. 사업 목적

[사업목적 현황]

구 분	사업목적	사업영위 여부
1	전자전기기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작, 판매, 수금대행 및 임대, 서비스 업	영위
2	통신기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작, 판매, 수금대행 및 임대, 서비스업	영위
3	의료기기의 제작 및 판매업	영위
4	광디스크 및 광원응용기계기구와 그 부품의 제작, 판매, 서비스업	영위
5	광섬유, 케이블 및 관련 기기의 제조, 판매, 임대, 서비스업	영위
6	전자계산조직 및 동 관련 제품의 제조, 판매, 수금대행 및 임대, 서비스업	영위
7	저작물, 컴퓨터 프로그램 등의 제작, 판매, 임대업	영위
8	노우하우, 기술의 판매, 임대업	영위
9	정보통신 시스템에 관련된 구성 및 운영과 역무의 제공	영위
10	자동제어기기 및 응용설비의 제작, 판매, 임대, 서비스업	영위
11	공작기계 및 부품의 제작, 판매, 임대, 서비스업	영위
12	반도체 및 관련 제품의 제조, 판매업	영위
13	반도체 제조 장치의 제조, 판매업	영위
14	반도체 제조를 위한 원부자재의 제조, 판매업	영위
15	기타기계기구의 제작 및 판매업	영위
16	합성수지의 제조, 가공 및 판매업	영위
17	금을 제외한 금속의 제련가공 및 판매업	영위
18	수출입업 및 동 대행업	영위
19	경제성 식물의 재배 및 판매업	미영위
20	부동산업	영위
21	물품 매도 확약서 발행업	영위
22	계량기, 측정기 등의 교정 검사업 및 제작, 판매업	영위
23	전 각항의 기술용역, 정보통신 공사업 및 전기공사업	영위
24	주택사업 임대 및 분양	영위
25	운동, 경기 및 기타 관련사업	영위
26	전동기, 발전기 및 전기변환장치 제조업	영위
27	전기공급 및 제어장치 제조업	영위
28	교육 서비스업 및 사업 관련 서비스업	영위
29	각 항에 관련된 부대사업 및 투자	영위

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 본사를 거점으로 한국과 DX 부문 산하 해외 9개 지역총괄 및 DS 부문 산하 해외 5개 지역총괄의 생산·판매법인, SDC 및 Harman 산하 종속기업 등 226개의 종속기업으로 구성된 글로벌 전자 기업입니다.

사업별로 보면, Set 사업은 DX(Device eXperience) 부문이 TV를 비롯하여 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 스마트폰, 네트워크시스템, 컴퓨터 등을 생산・판매하며, 부품 사업은 DS(Device Solutions) 부문에서 DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등의 제품을 생산・판매하고, SDC가 스마트폰용 OLED 패널 등을 생산・판매하고 있습니다. 또한, Harman에서는 디지털 콕핏(Digital Cockpit), 카오디오 등 전장제품과 포터블/사운드바 스피커 등 소비자오디오 제품 등을 생산・판매하고 있습니다.

☞ 부문별 사업에 관한 자세한 사항은 '7. 기타 참고사항'의 '다. 사업부문별 현황'과 '라. 사업부문별 요약 재무 현황' 항목을 참고하시기 바랍니다.

지역별로 보면, 국내에서는 DX 부문 및 DS 부문 등을 총괄하는 본사와 32개의 종속기업이 사업을 운영하고 있습니다. 본사는 수원, 구미, 광주, 기흥, 화성, 평택사업장 등으로 구성되어 있으며, 국내 종속기업은 디스플레이 패널을 생산하는 삼성디스플레이㈜와 국내 대리점 판매를 전담하는 삼성전자판매㈜, 제품 수리 서비스를 담당하는 삼성전자서비스㈜, 제품 운송을 담당하는 삼성전자로지텍㈜ 등 비상장 종속기업들로 구성되어 있습니다.

해외(미주, 유럽·CIS, 중동·아프리카, 아시아 등지)에서는 생산, 판매, 연구활동 등을 담당하는 194개의 비상장 종속기업이 운영되고 있습니다.

미주에는 TV, 스마트폰 등 Set 제품의 미국 판매를 담당하는 SEA(New Jersey, USA), TV 생산을 담당하는 SII(California, USA), 반도체 · 디스플레이 패널 판매를 담당하는 SSI(California, USA), 반도체 생산을 담당하는 SAS(Texas, USA), Set 제품 복합 생산법인 SEDA(Brazil), 전장부품사업 등을 담당하는 Harman(Connecticut, USA) 등을 포함하여 총 46개의 판매·생산 등을 담당하는 법인이 있습니다.

유럽·CIS에는 SEUK(UK), SEG(Germany), SEF(France), SEI(Italy) 등 Set 제품 판매법 인과 SEH(Hungary) 등 TV 생산법인, 가전제품 생산법인 SEPM(Poland) 등을 포함하여 총 66개의 법인이 운영되고 있습니다.

중동·아프리카에는 SGE(UAE), SSA(South Africa) 등 Set 제품 판매법인과 SEEG(Egypt), SSAP(South Africa) 등 TV 생산법인을 포함한 총 20개 법인이 운영되고 있습니다.

아시아(중국 제외)에는 SESP(Singapore), SEAU(Australia), SEPCO(Philippines), SME(Malaysia) 등 판매법인과 스마트폰 등 생산법인 SEV·SEVT(Vietnam), TV 등 생산법인 SEHC(Vietnam), 디스플레이 패널 생산법인 SDV(Vietnam), 복합 생산법인 SIEL(India) 등을 포함한 총 32개의 법인이 운영되고 있습니다.

중국에는 SCIC(Beijing), SEHK(Hong Kong) 등 Set 제품 판매법인과 SSS(Shanghai), SSCX(Xian) 등 반도체·디스플레이 패널 판매법인, SSEC(Suzhou) 등 Set 제품 생산법인, SCS(Xian) 등 반도체 생산법인을 포함하여 총 30개의 법인이 운영되고 있습니다.

2024년 반기 당사의 매출은 145조 9,839억원으로 전년 동기 대비 18.0% 증가하였으며, 주요 매출처로는 Apple, Deutsche Telekom, Hong Kong Techtronics, Supreme Electronics, Verizon 등(알파벳순)이 있습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 매출

당사는 TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 스마트폰 등 완제품과 DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등 반도체 부품 및 스마트폰용 OLED 패널 등을 생산·판매하고 있습니다. 아울러 Harman을 통해 디지털 콕핏, 카오디오, 포터블 스피커 등을 생산·판매하고 있습니다.

2024년 반기 매출은 DX 부문이 89조 3,636억원(61.2%), DS 부문이 51조 6,938억원(35.4%)이며, SDC가 13조 326억원(8.9%), Harman은 6조 8,193억원(4.7%)입니다.

(단위: 억원, %)

부 문	주요 제품	매출액	비중
DX 부문	TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 스마트폰, 네트워크시스템, 컴퓨터 등	893,636	61.2%
DS 부문	DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등	516,938	35.4%
SDC	스마트폰용 OLED패널 등	130,326	8.9%
Harman	디지털 콕핏, 카오디오, 포터블 스피커 등	68,193	4.7%
기타	부문간 내부거래 제거 등	△149,254	△10.2%
	총 계	1,459,839	100.0%

[※] 각 부문별 매출액은 부문 등 간 내부거래를 포함하고 있습니다.

[△는 부(-)의 값임]

나. 주요 제품 등의 가격 변동 현황

2024년 반기 TV의 평균 판매가격은 전년 연간 평균과 유사한 수준이며, 스마트폰은 전년 연간 평균 대비 약 7% 상승하였습니다. 그리고 메모리 평균 판매가격은 전년 연간 평균 대비약 60% 상승하였으며, 스마트폰용 OLED 패널은 약 32% 하락하였습니다. 한편 디지털 콕핏의 평균 판매가격은 전년 연간 평균과 유사한 수준입니다.

[※] 세부 제품별 매출은 '4. 매출 및 수주상황' 항목을 참고하시기 바랍니다.

3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 현황

당사의 주요 원재료로 DX 부문은 모바일AP 솔루션, Camera Module 등을 Qualcomm, 삼성전기㈜ 등에서 공급받고 있으며, TV·모니터용 디스플레이 패널 등을 CSOT 등으로부터 공급받고 있습니다. DS 부문은 Chemical, Wafer 등을 솔브레인㈜, SK실트론㈜ 등으로부터, SDC는 FPCA, Cover Glass 등을 ㈜비에이치, Apple 등으로부터 공급받고 있습니다. Harman은 MCU(Micro Controller Unit)를 포함한 SOC(System-On-Chip), 통신 모듈 등을 NVIDIA, WNC 등에서 공급받고 있습니다.

(단위: 억원, %)

부 문	품 목	구체적 용도	매입액	비중	주요 매입처
	모바일AP 솔루션	CPU	60,275	17.1%	Qualcomm, MediaTek 등
	디스플레이 패널	TV·모니터용 화면표시장치	38,310	10.9%	CSOT, SDP 등
DX 부문	Camera Module	스마트폰 카메라	29,797	8.5%	삼성전기, 파트론 등
	기타	_	223,896	63.5%	
	소	: 계	352,278	100.0%	
	Chemical	원판 가공	12,991	15.8%	솔브레인㈜, 동우화인켐㈜ 등
DS 부문	Wafer	반도체 원판	11,101	13.5%	SK실트론㈜, SILTRONIC 등
リンテモ	기타	_	58,307	70.7%	
	소 계		82,399	100.0%	
	FPCA	구동회로	11,058	19.0%	㈜비에이치, 영풍전자㈜ 등
SDC	Cover Glass	강화유리	6,996	12.0%	Apple, LENS 등
SDC	기타	_	40,143	69.0%	
	소	: 계	58,197	100.0%	
	SOC(System-On-Chip)	CPU	4,031	18.2%	NVIDIA, Intel 등
Harmon	통신 모듈	차량 통신	2,425	10.9%	WNC(Wistron NeWeb Corp.) 등
Harman	기타	_	15,750	70.9%	
	소	· - 계	22,206	100.0%	
기타	기타		194		
	총 계		515,274	_	

[※] 매입액은 부문 등 간의 내부거래를 포함하고 있지 않습니다.

[※] 비중은 각 부문의 원재료 총매입액 대비 각 품목의 매입액 비중입니다.

[※] 주요 매입처 중 삼성전기㈜는 계열회사입니다.

나. 주요 원재료 가격 변동 추이

DX 부문의 주요 원재료인 모바일AP 솔루션 가격과 Camera Module 가격은 각각 전년 연간 평균 대비 약 7% 상승하였습니다. TV·모니터용 디스플레이 패널 가격은 약 12% 상승하였습니다. DS 부문의 주요 원재료 중 반도체 Wafer 가격은 전년 대비 약 3% 하락하였으며, SDC의 FPCA 가격은 약 31% 하락, 강화유리용 Cover Glass 가격은 약 33% 하락하였습니다. Harman의 원재료 중 SOC(System-On-Chip) 가격은 약 5% 하락하였으며, 통신 모듈은 약 9% 하락하였습니다.

※ 원재료 가격은 부문 등 간의 내부거래를 포함하고 있습니다.

다. 생산능력, 생산실적, 가동률

(생산능력)

(단위:천대,천개)

부 문	품 목	제56기 반기	제55기	제54기
DX 부문	TV, 모니터 등	25,673	53,552	55,747
	스마트폰 등	133,200	284,700	332,170
DS 부문	메모리	1,156,923,805	1,926,651,546	1,905,731,836
SDC	디스플레이 패널	1,124	2,320	2,700
Harman	디지털 콕핏	4,588	10,912	11,257

[※] 생산능력은 주요 제품의 연결 기준입니다.

DX 부문의 주요 품목별 생산능력은 '평균 라인 수'×'시간당 평균 생산실적'×'일 평균 가동시간'×'표준 가동일수'로 산출하였으며, DS 부문의 메모리 생산능력은 1Gb환산 기준으로 환산생산실적(패키지OUT 기준)을 가동률로 나눠서 생산능력을 산출하고 있습니다. SDC의 경우라인별 생산 가능한 제품의 총 면적을 8세대 Glass(2,200×2,500mm)로 환산하고 있으며, Harman의 디지털 콕핏 생산능력은 '각 거래처・제품별 생산셀(조립, 테스트) 수'×'각 생산셀별 시간당 생산능력'×'1일 표준 생산시간'×'표준생산일수'로 산출하였습니다.

(생산실적)

2024년(제56기) 반기 DX 부문의 TV, 모니터 등 생산실적은 19,845천대이며 멕시코, 베트남, 브라질, 헝가리 등 세계 각 지역에서 생산되고 있습니다. 스마트폰 등 생산실적은 98,686천대이며 한국(구미), 베트남, 인도, 브라질 등 지역에서 생산되고 있습니다. DS 부문의 메모리 생산실적은 1,156,923백만개(1Gb 환산 기준)이며 한국(화성, 평택 등), 중국에서 생산하고 있습니다. SDC의 디스플레이 패널 생산실적은 830천개(8세대 Glass 환산 기준)이며 한국(천안, 아산) 등에서 생산 중입니다. Harman의 디지털 콕핏 생산실적은 3,449천개이며, 주로 멕시코, 헝가리, 중국 등에서 생산되고 있습니다.

(단위:천대,천개)

부 문	품 목	제56기 반기	제55기	제54기
DX 부문	TV, 모니터 등	19,845	40,085	41,802
	스마트폰 등	98,686	189,991	229,180
DS 부문	메모리	1,156,923,805	1,926,651,546	1,905,731,836
SDC	디스플레이 패널	830	1,407	2,008
Harman	디지털 콕핏	3,449	7,658	8,334

[※] 생산실적은 주요 제품의 연결 기준입니다.

(가동률)

당사 DX 부문의 2024년(제56기) 반기 가동률은 생산능력 대비 생산실적으로 산출하였으며, TV, 모니터 등은 77.3%, 스마트폰 등은 74.1%입니다.

(단위 : 천대)

부 문	품 목	제56기 반기			
十 正	古	생산능력 대수	실제 생산 대수	가동률	
DX 부문	TV, 모니터 등	25,673	19,845	77.3%	
ロハ ナモ	스마트폰 등	133,200	98,686	74.1%	

DS 부문의 메모리 사업과 SDC의 디스플레이 패널 사업은 24시간 3교대 작업을 실시하고 있으며, 2024년(제56기) 반기 가동일은 휴일을 포함하여 총 182일입니다. 가동률은 생산라인별 가동 가능시간 (가동일 ×생산라인 수 ×24시간) 대비 실제 가동 시간으로 산출하였습니다

(단위:시간)

부 문	금 품목		제56기 반기			
		가동 가능 시간	실제 가동 시간	가동률		
DS 부문	메모리	43,680	43,680	100.0%		
SDC	디스플레이 패널	21,840	21,840	100.0%		

Harman의 2024년(제56기) 반기 가동률은 생산능력 대비 생산실적으로 산출하였으며 75.2%입니다.

(단위:천개)

부문	품 목	제56기 반기		
十正 	古 今 	생산능력 개수	실제 생산 개수	가동률
Harman	디지털 콕핏	4,588	3,449	75.2%

라. 생산설비 및 투자 현황 등

(생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등)

당사는 수원사업장을 비롯하여 구미, 광주, 화성, 평택, 아산 등 국내사업장 및 북미, 구주(유럽), 중국 등 해외 DX 부문 산하 9개 지역총괄과 DS 부문 산하 5개 지역총괄,SDC 및 Harman 산하 종속기업 등에서 주요 제품의 생산, 개발, 마케팅, 영업 등의 사업 활동을 수행하고 있습니다.

[주요 사업장 현황]

지역	사업장	소재지		
	수원사업장	경기도 수원시 영통구 삼성로 129(매탄동)		
	서초사업장	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동)		
	우면사업장	서울특별시 서초구 성촌길 33(우면동)		
7.11	기흥사업장	경기도 용인시 기흥구 삼성로 1(농서동)		
국내	화성사업장	경기도 화성시 삼성전자로 1(반월동)		
(DX 부문,	평택사업장	경기도 평택시 삼성로 114(고덕동)		
DS 부문, SDC 산하	천안사업장	충청남도 천안시 서북구 번영로 465 (성성동)		
	온양사업장	충청남도 아산시 배방읍 배방로 158 (북수리)		
12개 사업장)	아산사업장	충청남도 아산시 탕정면 삼성로 181 (명암리)		
	구미1사업장	경상북도 구미시 1공단로 244(공단동)		
	구미2사업장	경상북도 구미시 3공단3로 302(임수동)		
	광주사업장	광주광역시 광산구 하남산단6번로 107(오선동)		
	북미 총괄	85 Challenger Rd., Ridgefield Park, New Jersey, USA		
	구주 총괄	2000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, UK		
	중국 총괄	No.31, Jinghui Street, Chaoyang, Beijing, China		
해외	동남아 총괄	30 Pasir Panjang Rd., Mapletree Business City, Singapore		
(DX 부문 산하	서남아 총괄	Two Horizon Centre, Golf Course RD, Gurgaon, Haryana, India		
9개 지역총괄)	CIS 총괄	31 Novinsky Boulevard, Moscow, Russia		
	중동 총괄	Butterfly Building A, Dubai Media City, Dubai, UAE		
	아프리카 총괄	2929 William Nicol Drive, Bryanston, Johannesburg, South Africa		
	중남미 총괄	Av. Dr. Chucri Zaidan, 1240 Diamond Tower, Sao Paulo, Brazil		
	미주 총괄	3655 N. 1st St. San Jose, California, USA		
해외	구주 총괄	Einsteinstrasse 174, 81677, Munich, Germany		
(DS 부문 산하	중국 총괄	3F, No.458, Fute North Rd., Shanghai, China		
5개 지역총괄)	동남아 총괄	3 Church Street, #26-01 Samsung Hub, Singapore		
	일본 총괄	Shinagawa Grand Central Tower, Konan, Minato, Tokyo, Japan		
	미국 HQ	400 Atlantic St., Stamford, Connecticut, USA		
	Harman Becker Automotive Systems,	20001 Cabat Driva Navi Mishigan USA		
Harman	Inc.	30001 Cabot Drive, Novi, Michigan, USA		
Harman	Harman Becker Automotive Systems GmbH	16 Becker Goering St., Karlsbad, Germany		
	Harman Consumer Nederland B.V.	16 Danzigerkade, 1013 AP, Amsterdam, Netherlands		

당사의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 건설중인자산 등이 있으며, 2024년 반기말 현재 장부금액은 194조 4,498억원으로 전년말 대비 7조 1,935억원 증가하였습니다.

(단위: 억원)

구 :	<u> </u>	토지	건물및구축물	기계장치	건설중인자산	기타유형자산	계
וכ	기초장부금액	99,994	432,381	833,092	467,203	39,893	1,872,563
초	- 취득원가	101,580	736,900	3,285,615	467,203	140,586	4,731,884
<u>x</u>	- 감가상각누계액(손상 포함)	△1,586	△304,519	△2,452,523	-	△100,693	△2,859,321
	일반취득 및 자본적지출	634	20,486	115,210	95,802	7,286	239,418
증	감가상각	△245	△20,765	△157,406	_	△7,656	△186,072
감	처분·폐기·손상	△36	△1,575	△212	-	△147	△1,970
	기타	310	8,777	6,257	4,380	835	20,559
וכ	기말장부금액	100,657	439,304	796,941	567,385	40,211	1,944,498
말	- 취득원가	102,422	767,255	3,435,782	567,385	148,210	5,021,054
	- 감가상각누계액(손상 포함)	△1,765	△327,951	△2,638,841	_	△107,999	△3,076,556

[※] 토지의 감가상각은 기업회계기준서 제1116호 '리스'에 따른 사용권자산의 감가상각비입니다.

[△는 부(-)의 값임]

(시설투자 현황)

2024년 반기 중 DS 부문 및 SDC 등의 첨단공정 증설·전환과 인프라 투자를 중심으로 23.4조원의 시설투자가 이루어졌습니다. 당사는 2024년 글로벌 시황 개선에 대비하여 차세대 기술 경쟁력 강화 및 중장기 수요 대비를 위한 투자를 지속 점검할 것이며, 투자 효율성제고를 통하여 내실을 다지는 활동도 병행할 계획입니다.

(단위: 억원)

구 분	내 용	투자기간	대상자산	투자액
DS 부문	신·증설, 보완 등	2024.01~2024.06	건물ㆍ설비 등	195,706
SDC	신ㆍ증설, 보완 등	2024.01~2024.06	건물ㆍ설비 등	29,125
기타	신ㆍ증설, 보완 등	2024.01~2024.06	건물ㆍ설비 등	9,253
	ਹੇ	À		234,084

[※] 기타는 환율변동에 의한 증감액 및 관련 정부보조금 차감 효과 등을 포함하고 있습니다.

[※] 주요 유형자산에 대한 시가는 객관적인 시가 판단이 어려워 기재를 생략했습니다.

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

2024년 반기 매출은 145조 9,839억원으로 전년 동기 대비 18% 증가하였습니다. 부문별로 보면 전년 동기 대비 DX 부문이 3.4%, DS 부문이 81.6% 증가하였고, SDC는 0.5% 감소하였으며, Harman은 2.4% 증가하였습니다.

(단위: 억원)

부 문	매출유형	품 목	제56기 반기	제55기	제54기
DX 부문	제·상품, 용역 및 기타매출	TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 스마트폰, 네트워크시스템, 컴퓨터 등	893,636	1,699,923	1,824,897
DS 부문	제·상품, 용역 및 기타매출	DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등	516,938	665,945	984,553
SDC	제·상품, 용역 및 기타매출	스마트폰용 OLED 패널 등	130,326	309,754	343,826
Harman	제·상품, 용역 및 기타매출	디지털 콕핏, 카오디오, 포터블 스피커 등	68,193	143,885	132,137
기 타	부문건	난 내부거래 제거 등	△149,254	△230,152	△263,099
	합 기	1	1,459,839	2,589,355	3,022,314

[※] 각 부문별 매출실적은 부문 등 간 내부거래를 포함하고 있습니다.

[△는 부(-)의 값임]

(1) 주요 제품별 매출실적

(단위: 억원)

구	분	제56기 반기	제55기	제54기
	TV, 모니터 등	147,775	303,752	332,795
	스마트폰 등	594,324	1,086,325	1,154,254
	메모리	392,321	441,254	685,349
	디스플레이 패널	130,326	309,754	343,826

[※] 각 제품별 매출실적은 부문 등 간 내부거래를 포함하고 있습니다.

(2) 매출유형별 매출실적

(단위: 억원)

구 분	제56기 반기	제55기	제54기
제・상품	1,403,851	2,461,380	2,903,461
용역 및 기타매출	55,988	127,975	118,853
Э	1,459,839	2,589,355	3,022,314

[※] 기타매출은 로열티수익 등으로 구성되어 있습니다.

(3) 주요 지역별 매출 현황

(단위 : 억원)

구 분		제56기 반기	제55기	제54기
내수	국내	111,616	205,196	221,799
	미주	293,349	510,934	659,617
수출	유럽	148,526	239,342	265,147
구절	아시아・아프리카	172,794	326,262	425,114
	중국	323,452	422,007	546,998
	계	1,049,737	1,703,741	2,118,675

[※] 별도 기준의 내수·수출 매출 현황입니다.

나. 판매경로 등

(1) 국내

판매자	판 매 경 로	소비자
	전속 대리점	소비자
생산 및	유통업체(양판점, 할인점, 백화점, 홈쇼핑, 온라인 등)	
매입	통신사업자(SK텔레콤㈜, ㈜케이티, ㈜LG유플러스)	조미사
	직접판매(B2B 및 온라인)	

(2) 해외

판매자	판 매 경 로							소비자
				Ret	tailer			
		Dealer		Retailer				
	판매법인	Distribu	utor		Dealer		Retailer	
생산법인 생산법인		통신사업자, Automotive OEM					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
생산합원		직접판매(B2B 및 온라인)				소비자		
		Retailer						
	물류법인	판매법인		Dealer		Retailer		
			Distri	butor	Dea	ler	Retailer	

(3) 판매경로별 매출액 비중

경 로	2	도매	소매	특직판	기타
	비중	17%	25%	49%	9%

다. 판매방법 및 조건

(1) 국내

구 분	판매경로	대금회수조건	부대비용 비용분담
전속	대리점	약정여신조건	사안별 상호 협의하에 일부 분담
유통업체	양판점, 할인점, 백화점, 홈쇼핑, 온라인 등	개별계약조건	사안별 상호 협의하에 일부 분담
통신사업자	SK텔레콤㈜, ㈜케이티, ㈜LG유플러스	개별계약조건	사안별 상호 협의하에 일부 분담 (공동마케팅)
B2B 및 온라인	일반기업체 등	개별계약조건	없 음

(2) 해외

구 분	판매경로	대금회수조건	부대비용 비용분담
Retailer	소매점	개별계약조건	사안별 상호 협의하에 일부 분담
Dealer	양판점, 할인점, 백화점	개별계약조건	사안별 상호 협의하에 일부 분담
Distributor	현지 거래처 직판 영업	개별계약조건	사안별 상호 협의하에 일부 분담
B2B 및 온라인	일반기업체 등	개별계약조건	없 음

라. 판매전략

- 프리미엄 제품을 중심으로 한 시장 우위 강화
- 브랜드, 제품, 서비스를 통해 고객에게 차별화된 가치 제공
- ·고객·시장 중심의 수요 촉발 마케팅 강화

마. 주요 매출처

2024년 반기 당사의 주요 매출처로는 Apple, Deutsche Telekom, Hong Kong Techtronics, Supreme Electronics, Verizon 등(알파벳순) 입니다. 당사의 주요 5대 매출처에 대한 매출비중은 전체 매출액 대비 약 14% 수준입니다.

바. 수주상황

2024년 반기말 현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주거래는 없습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

가. 재무위험관리정책

당사는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험, 유동성위험 등을 최소화하는데 중점을 두고 재무위험을 관리하고 있으며, 이를 위해 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링 및 대응하고 있습니다.

재무위험은 글로벌 재무관리기준을 수립하고 고객과 거래선에 대한 주기적인 재무위험 측정 , 환혯지 및 자금수지 점검 등을 통해 관리하고 있습니다.

한편, 해외 주요 권역별로 지역금융센터(미국, 영국, 싱가포르, 중국, 브라질, 러시아)에서 환율변동 모니터링 및 환거래 대행을 통해 환율변동위험을 관리하고 있으며, 권역내 자금을 통합운용하여 유동성위험에 대응하고 있습니다.

당사의 재무위험관리의 주요 대상인 자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 상각후원가금 융자산, 매출채권 등으로 구성되어 있으며, 부채는 매입채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다.

나. 주요 재무위험관리

(1) 시장위험

(환율변동위험)

당사는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 기능통화와 다른 통화로도 거래를 하고 있어 환율 변동위험에 노출되어 있습니다. 환율변동위험에 노출되는 주요 통화로는 USD, EUR 등이 있 습니다.

당사는 통화별 자산과 부채규모를 일치하는 수준으로 유지하여 환율변동 영향을 최소화하는 데 주력하고 있습니다. 이를 위해 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 금융거래 발생시기능통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시킴으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있으나, 일부 발생된 환포지션은 채권매각, 선물환 등을 활용하여 환변동영향을 축소하고 있습니다. 이는 당사가 노출된 환율변동위험을 감소시키지만 완전히 제거하지는 않을 수 있습니다. 또한, 당사는 효율적인 환율변동위험 관리를 위해 환위험을 주기적으로 모니터링및 평가하고 있으며 투기적 외환거래는 엄격히 금지하고 있습니다.

(이자율변동위험)

이자율변동위험은 시장금리 변동으로 인해 투자 및 재무 활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로서, 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯됩니다. 당사는 내부자금 공유를 통해 외부차입금을 최소화하여 이자율 변동으로 인한 금융비용과 불확실성을 최소화하고 있습니다.

(주가변동위험)

당사는 전략적 목적 등으로 기타포괄손익-공정가치금융자산 및 당기손익-공정가치금융자산 으로 분류된 지분상품에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직·간접적 투자수단을 이용하고 있습니다.

2024년 반기말 현재 지분상품(상장주식)의 주가가 1% 변동할 경우 기타포괄손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 66,935백만원(전반기: 81,526백만원)이며, 당기손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 1,351백만원(전반기: 4,309백만원)입니다.

(2) 신용위험

신용위험은 통상적인 거래 및 투자 활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소를 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정 · 관리하고 있습니다. 그리고 위험국가에 소재한 거래처의 매출채권은 보험한도 내에서 적절하게 위험이 관리되고 있습니다.

신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당 거래는 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 당사는 국제 신용등급이 높은 은행(S&P A 이상)에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규 거래는 해당 기관에 대한 건전성 평가 등을 거쳐 시행하고 있습니다. 당사가 체결하는 금융계약은 부채비율제한 조항, 담보제공, 차입금 회수 등의 제약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고 있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하고 있습니다.

당사의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 당사의 신용위험 최대노출액은 금융자산 장부금액과 동일합니다.

(3) 유동성위험

유동성위험이란 당사가 금융부채와 관련된 모든 의무를 이행하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 주요 유동성 공급원은 영업에서 창출한 현금 및 자본시장 및 금융기관에서 조달한 자금이며, 주요 유동성 수요는 생산, 연구개발을 위한 투자를 비롯해, 운전자본, 배당 등에 있습니다. 대규모 투자가 많은 당사의 사업 특성상 적정 유동성의 유지가 매우중요합니다. 당사는 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 산정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지·관리하고 있습니다.

당사는 권역별로 Cash Pooling을 구축하여 권역 내 개별 법인의 자금이 부족한 경우에도 유동성위험에 효율적으로 대응하고 있습니다. Cash Pooling은 자금 부족 회사와 자금 잉여 회사간 자금을 공유하는 시스템으로 개별회사의 유동성위험을 최소화하고 자금운용 부담을 경감시키며, 금융비용을 절감하는 등의 효과가 있습니다.

또한 대규모 유동성이 필요한 경우를 대비하여 본사의 지급보증을 통해 해외 종속기업이 활용할 수 있는 차입한도를 확보하고 있으며, 보고기간 종료일 현재 국제신용평가기관인 Moody's로부터 Aa2, S&P로부터 AA- 등 투자적격등급을 부여받고 있어, 필요시 자본시장을 통해 적기에 자금조달이 가능합니다.

(4) 자본위험

당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해관계자에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 건전한 자본구조를 유지하는 것입니다. 당사는 신용등급, 부 채비율 등의 지표를 이용하여 자본위험을 관리하고 있습니다.

보고기간종료일 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분	제56기 반기말	제55기말
부 채	102,231,027	92,228,115
자 본	383,526,671	363,677,865
부채비율	26.7%	25.4%

다. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

당사는 환율변동 위험관리 목적상 장부 통화가 아닌 외화 포지션에 대하여 통화선도 (Currency Forward) 상품을 매매하여 헷지하고 있습니다. 통화선도 상품은 매매목적 및 위험회피목적으로 은행을 통하여 매수 또는 매도하고 있습니다.

2024년 반기말 현재 당사는 USD, EUR 등 총 32개 통화에 대하여 3,770건의 통화선도 거래를 체결하고 있으며, 자산·부채 장부금액 및 관련손익은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분	자산	부채	이익	손실
통화선도	104,987	72,295	426,311	333,785

그리고 당사는 레인보우로보틱스㈜ 및 그 최대주주 등과 체결한 주주간 계약에 따라, 일정 기간 동안 최대주주 등에게 최대주주 등이 보유하는 주식의 전부 또는 일부를 당사 또 는 당사가 지정한 제3자에게 매도할 것을 청구할 권리를 보유하고 있습니다. 또한 레인보우 로보틱스㈜의 최대주주 등은 일정한 사유가 발생할 경우, 당사가 보유한 레인보우로보틱스 ㈜ 지분의 전부 또는 일부를 최대주주 등에게 매도할 것을 청구할 권리를 보유하고 있습니다. 2024년 반기말 현재 해당 콜옵션의 공정가치는 안진회계법인이 평가하였습니다.

또한, 종속회사인 삼성디스플레이㈜는 Corning Incorporated와 2021년 4월 8일 실행된 주식매매계약에 따라, 보유 중인 Corning 지분증권 일부를 Corning에게 매각할수 있는 풋옵션을 보유하고 있으며, TCL Technology Group Corporation (TCL) 및 TCL China Star Optoelectronics Technology Co. Ltd. (CSOT)와 2021년 4월 1일 실행된 주주간 계약에 따라 CSOT가 상장기한 내 비상장 시, 삼성디스플레이㈜가 보유 중인 CSOT 지분증권 전부 또는 일부를 TCL에게 매각할 수 있는 풋옵션을 보유하고 있습니다. 2024년 반기말 현재 상기 풋옵션들 공정가치는 한영회계법인이 평가하였습니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요 계약 등

계약 상대방	항 목	내 용
	계약 유형	상호 특허 사용 계약
Coogle	체결시기	2014.01.25
Google	목적 및 내용	상호 특허 라이선스 계약 체결을 통한 사업 자유도 확보
	기타 주요내용	영구 라이선스 계약 (향후 10년간 출원될 특허까지 포함)
	계약 유형	공정 기술 라이선스 계약
GlobalFoundries	체결시기	2014.02.28
	목적 및 내용	14nm 공정의 고객기반 확대
	계약 유형	EMADA
	체결시기 및 기간	2019.02.27~2024.12.31(연장)
Google		유럽 32개국(EEA) 대상으로 Play Store, YouTube 등 구글 앱 사용에
	목적 및 내용	대한
		라이선스 계약
	계약 유형	상호 특허 사용 계약
Ericsson	체결시기	2021.05.07
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스 계약 체결을 통한 사업 자유도 확보
	계약 유형	상호 특허 사용 계약
Qualcomm	체결시기	2022.07.06
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스·부제소를 통한 사업 자유도 확보
	계약 유형	상호 특허 사용 계약
Huawei	체결시기	2022.07.13
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스 계약 체결을 통한 사업 자유도 확보
	계약 유형	상호 특허 사용 계약
Nokia	체결시기	2023.01.19
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스 계약 체결을 통한 사업 자유도 확보

[※] 기타 영업기밀에 해당하는 사항은 기재하지 않았습니다.

나. 연구개발활동의 개요 및 연구개발비용

당사는 고객의 요구를 먼저 파악하고 발상의 전환을 통해 창조적이고 혁신적인 제품,미래를 선도하는 기술을 지속적으로 창출하여 세계 시장을 선도해 나가고 있습니다. 또한, 세계 IT업계에서의 위상을 더욱 굳건히 하기 위해 차세대 기술과 원천기술을 확보하여 세계 산업 기술을 이끄는 진정한 선도 기업(Leading Company)이 되도록 최선을 다하고 있습니다.

2024년(제56기) 반기 당사의 연구개발비용은 15조 8,695억원이며, 이 중 정부보조금으로 차감되거나 자산화된 연구개발비를 제외하고 15조 8,692억원을 당기비용으로 회계처리하였 습니다.

[연구개발비용] (단위: 백만원, %)

과 목		제56기 반기	제55기	제54기
	연구개발비용 총계	15,869,480	28,352,769	24,929,171
	(정부보조금)	△327	△13,045	△9,973
	연구개발비용 계	15,869,153	28,339,724	24,919,198
회계	개발비 자산화(무형자산)	_	-	_
처리	연구개발비(비용)	15,869,153	28,339,724	24,919,198
	구개발비 / 매출액 비율 바발비용 총계÷당기매출액×100]	10.9%	10.9%	8.2%

[※] 연결 누계기준입니다.

[※] 비율은 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출 [△는 부(-)의 값임]총액을 기준으로 산정하였습니다.

다. 연구개발 조직 및 운영

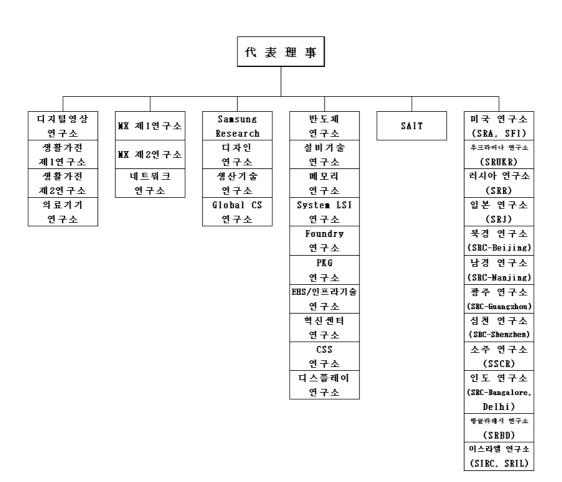
(국내)

당사는 연구개발 조직을 기술 상용화 시기에 따라 3단계로 체계화하여 운영하고 있습니다.

향후 1~2년 내 시장에 선보일 상품화 기술은 각 부문 산하 사업부 개발팀에서 개발하고 있으며, 3~5년 내 중장기 미래 유망 기술은 Samsung Research, 반도체연구소 등의 각 부문 연구소에서 개발하고 있습니다. 또한, 미래 성장엔진에 필요한 핵심 요소 기술은 당사의 종합 연구소인 SAIT에서 선행 개발하고 있습니다. SAIT는 전사 차원에서 유망 성장 분야에 대한 연구개발 방향 제시와 주력 사업의 기술 경쟁력 강화, 창의적 R&D 체제를 구축하기 위한 연구개발 활동을 수행하고 있습니다.

(해외)

미국(SRA, SFI), 우크라이나(SRUKR), 러시아(SRR), 일본(SRJ), 중국(SRC-Beijing, SRC-Nanjing, SRC-Guangzhou, SRC-Shenzhen, SSCR), 인도(SRI-Bangalore, SRI-Delhi), 방글라데시(SRBD), 이스라엘(SIRC, SRIL) 등의 지역에 연구개발 조직을 운영하고 있으며 제품 개발 및 기초 기술 연구 등을 진행하고 있습니다.



라. 연구개발실적

2024년 반기 중 당사의 각 부문별 주요 연구개발 실적은 다음과 같습니다.

부문	연구과제 등	연구결과 및 기대효과 등
	Galaxy S24	· Galaxy S24·S24+·S24 Ultra 출시
		· Galaxy A55 5G 출시
	Galaxy A	· Galaxy A35 5G 출시
	Galaxy A	· Galaxy A25 5G 출시
		・Galaxy A15 LTE・5G 출시
		· Galaxy Book4 Ultra 출시
	Galaxy북	・Galaxy Book4 Pro 360 출시
DX 부문	Galaxy -	· Galaxy Book4 Pro 출시
		· Galaxy Book4 Edge 출시
	Neo QLED 8K	・Mini LED 기반 초고화질 & 슬림 8K TV 출시
	Neo QLED 4K	· Mini LED 기반 3개 시리즈, 7개 사이즈 출시
	냉장고	• Peltier 적용 에너지효율 초절전 BESPOKE AI 하이브리드 냉장고 출시
	세탁기	・세탁건조기 BESPOKE AI 콤보 출시
	청소기	· 한국향 건습식 로봇청소기 BESPOKE AI 스팀 출시
	RAN S/W Package	·업계 최초 vRAN 기반 5G RedCap Energy-saving 기술 기능시험 완료
	НВМ	· 업계 최초 36GB HBM3E 12H D램 개발
	SSD	·성능과 범용성 모두 갖춘 소비자용 SSD '990 EVO'출시
DS 부문	NAND	・업계 최초 '9세대 V낸드' 양산
	엑시노스	・최신 기술 적용 모바일 AP '엑시노스 1480' 공개
	이미지센서	·업계 최초 망원용 2억화소 모바일 이미지 센서 'HP9' 공개
		· Galaxy S24 AMOLED 개발
000	OLED	· BMW Mini 13.4" Round OLED Display 적용
SDC		· Surface Pro 10 출시
	QD-Display	・31.5"UHD, 27"QHD, QD-OLED 개발

[※]상세 현황은 '상세표-4. 연구개발실적(상세)' 참조

7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 관련

당사는 R&D 활동의 지적재산화에도 집중하여 1984년 최초로 미국에 특허를 등록한이래 현재 세계적으로 총 255,612건의 특허를 보유하고 있으며, 특히 미국에서의 분쟁에 효과적으로 대응하고자 미국에서 가장 많은 특허를 보유하고 있습니다.

[국가별 등록 건수(2024년 반기말 현재, 연결 기준)]

(단위 : 건)

구분	한국	미국	유럽	중국	일본	기타국가	계
등록건수	59,718	96,015	46,396	26,178	8,891	18,414	255,612

2024년 반기 중 총 15.9조원의 R&D투자를 통해 국내 특허 3,776건, 미국 특허 4,641건 등을 등록하였습니다.

[주요 국가 연도별 특허등록 건수]

(단위 : 건)

구 분	2024년 반기	2023년	2022년
한 국	3,776	8,909	9,136
미국	4,641	8,952	8,490

이 지적재산권은 대부분 스마트폰, 스마트 TV, 메모리, System LSI 등에 관한 특허로써 당사 전략사업 제품에 쓰이거나 향후 활용될 예정이며, 사업 보호의 역할뿐만 아니라 유사 기술·특허가 난립하는 상황에서 경쟁사 견제의 역할도 하고 있습니다. 또한, 미래 신기술 관련선행 특허 확보를 통하여 향후 신규 사업 진출 시 사업 보호의 역할이 기대되고 있습니다. 당사는 Google(2014.01.체결), Ericsson(2021.05.), Qualcomm(2022.07.), Huawei(2022.07.), Nokia(2023.01.) 등과의 특허 라이선스 체결을 통하여, 모바일, 반도체등 당사 주력사업 및 신사업 분야에서 광범위한 특허 보호망을 확보하고 있습니다.

당사는 상기 특허뿐만 아니라 스마트폰, 스마트 TV 등에 적용된 당사 고유 디자인을보호하고자 디자인특허 확보도 강화하여, 2024년 반기 중 미국에서 261건의 디자인특허(Design Patent)를 취득하였습니다.

나. 환경 관련 규제사항

당사는 법률에서 정하고 있는 각종 제품환경 규제와 사업장관리 환경규제를 철저하게 준수하고 있습니다. 특히 정부의 저탄소 녹색성장 정책에 부응하여 관련 법규에서요구하는 사업장에서 발생하는 온실가스 배출량과 에너지 사용량을 정부에 신고하고지속가능보고서 등을통하여 이해관계자에게 관련 정보를 투명하게 제공하고 있습니다.

(제품 환경규제 준수)

전자제품은 일반적으로 소비자가 직접 휴대하거나, 가정에 설치하여 사용하고 있어 사용자건강과 안전에 직·간접적인 영향을 미칠 수 있기 때문에 관련 환경규제가 강화되고 있습니다. 이에 대해 당사는 부품 및 제품의 개발단계부터 제조, 유통, 사용, 폐기 등 제품의 전 과정 (Life Cycle)에 걸쳐 환경영향을 최소화하기 위한 활동을 하고있습니다. 유해물질을 제거한 부품 공급을 위해 협력회사 에코파트너 인증 제도를 운영하고 개발단계에서 제품의 친환경요소(자원 사용 절감, 에너지 절약, 유해 물질 저감, 친환경소재 적용 등)를 제품에 반영하기위해 에코디자인 평가 제도를 운영하며, 제품 사용 후 발생하는 폐전자제품을 회수하여 재활용하는 폐제품 회수·재활용시스템을 유럽, 북미, 한국, 인도 등 각국에서 운영하고 있습니다. 이러한 활동은 전기·전자 제품 관련 국내외 환경 법규를 준수할 뿐만 아니라 회사와 제품의 차별화 요소로 기여하고 있습니다.

각국 관련 법률은 다음과 같습니다.

- 1. 폐제품 회수 · 재활용법 (예: EU WEEE Directive)
- 2. 유해물질 사용 제한 (예: EU RoHS Directive, REACH Regulation)
- 3. 제품 에너지 소비효율 규정 (예: EU ErP Directive)

(사업장관리 환경규제 준수)

제품생산과정에서 발생되는 오염물질의 배출을 최소화하기 위하여 대기오염방지시설, 수질 오염방지시설, 폐기물처리시설과 같은 환경오염방지 시설을 설치하여 운영함으로써 주변 환 경에 대한 영향을 최소화 하고 있습니다. 이러한 사업장의 환경관리는 관련 부처, 지방자치단 체의 관리감독을 받고 있으며, 국내 및 글로벌 전 생산 사업장은 국제 환경안전보건경영시스 템 인증(ISO 14001, ISO 45001)을 취득하여 법규준수 및 자율관리 체제를 강화하고 있습니다.

주요한 관련 법률은 다음과 같습니다.

- 1. 환경오염물질 배출 규제: 「물환경보전법」「대기환경보전법」「폐기물관리법」「소음·진동관리법」「환경영향평가법」등
- 2. 온실가스 배출 관리: 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」 「기후위기대응을 위한 탄소중립·녹색성장기본법」등
- 3. 기타 사업장환경관리법: 「화학물질관리법」 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」 「악취방지법」「토양환경보전법」등

(온실가스 배출량 및 에너지 사용량 관리)

당사는 국내에서 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장기본법」제27조(관리업체의 온실가스 목표관리)에 따른 온실가스 에너지 목표관리업체에 해당됩니다. 따라서 동법 제27조 3항 및 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 제24조(배출량의 보고 및 검증)에 따라 제3자 검증을 마친 당사의 온실가스 배출량과 에너지 사용량을 2011년 5월부터 정부 당국에 신고하고 이해관계자에게 공개하고 있습니다.

정부에 신고된 당사의 국내 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

(단위:tCO2-eq,TJ)

구 분	2023년	2022년	2021년
온실가스(tCO2-eq)	17,339,317	19,285,537	19,267,217
에너지(TJ)	301,616	290,024	274,297

- ※ 정부에 신고된 본사 및 자회사 포함 기준입니다.
- ※ 대상은 국내 제조사업장, 사옥, 당사 소유 건물, 임차 건물 등입니다.
- ※ 온실가스 사용실적은 오존파괴물질(ODS) 제외된 기준입니다.
- ※ 배출량 및 에너지사용량은 정부의 적합성 평가 등에 따라 변동될 수 있습니다.

당사는 2015년부터 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」제8조(할당대상업체의 지정 및 지정취소)에 따라 온실가스 배출권 할당 대상업체에 해당합니다.

다. 사업부문별 현황

[DX 부문]

(산업의 특성 등)

1) TV산업

TV 산업은 1926년 흑백 TV, 1954년 컬러 TV 등장 이후 지금까지, 평면 TV(LCD),스마트 TV, 초대형 TV(OLED/QLED/Neo QLED/8K), 마이크로 LED 등으로 발전하면서 최고 화질을 제공하기 위한 혁신활동들이 지속적으로 일어나는 분야입니다.

TV에는 칩 설계, 회로개발, 화질/신호처리, AI 화질 기술 뿐만 아니라, 플랫폼과 어플리케이션이 잘 작동되도록 하는 운영체계(Operating System)와 각종 S/W 기술들이 적용됩니다. 최근들어 IoT 기술 발전으로 TV를 통해 제어할 수 있는 가정 내 전자기기들이 증가하고 있어서 스크린 허브 기능이 더욱 부각되고 있습니다.

TV업계는 마이크로 LED, Neo QLED, OLED 기술을 적용하여 최고 화질을 구현하는 제품 경쟁을 치열하게 하고 있습니다. 과거 55~65인치대가 주력이던 TV 시장은 이제 75인치 이상 98인치까지 초대형 제품들이 성장을 주도합니다. 4K 화질을 넘어서 8K 화질을 갖춘 제품이 새로운 시장을 열어가고 있으며, HD, FHD급 기존 화질을 고화질로 자동 업스케일하는 기술도 제품에 적용되고 있습니다.

TV업계는 AI 기술도 대거 채택하여 미래형 TV의 모습을 만들어 나가고 있습니다. 업체들마다 AI 관련 기술을 제품에 접목하기 위해 AI 반도체(System on Chip)는 물론 화질과 음질을 최적화하고, AI 기술을 활용하여 저화질 콘텐츠를 고화질로 업스케일링하는 기능도 더욱 강화하고 있습니다. 이러한 기술력을 통해 TV는 집안내 가전 제품들을 연결하고 실시간으로 모니터링할 뿐만 아니라, 전력사용 최적화나 긴급상황 발생시 알림 서비스 등 새로운 서비스들을 제공하게 됩니다.

한편 TV 사용자들의 인식도 지난 수년간의 팬더믹 시기를 거치면서 크게 변화하고 있습니다. 사용자들은 TV를 통해 영화를 보고 뉴스를 시청하는 것 뿐만 아니라, 전세계 미술관의 예술작품들을 다운로드받아서 감상한다거나, 게임과 헬스케어, 화상회의와 온라인 교육과 같은 새로운 서비스를 체험하는데 긍정적인 반응을 보이고 있습니다. 자기만의 개성을 추구하는 구매자들을 위해 디자인과 이동설치성, 주변기기들과의 연동성을 강조한 라이프스타일 제품군도 매년 새롭게 출시되면서 틈새 시장이 빠르게 확대되고 있습니다.

2) 모바일 산업

모바일 산업은 1980년대 초 음성통화만 가능했던 1세대 아날로그 방식으로 시작하여 음성 및 문자 메시지 전송이 가능한 CDMA와 GSM의 2세대 디지털 방식을 거쳐, 음성 데이터뿐만 아니라, 사진, 동영상과 같은 멀티미디어 데이터까지 전송 가능한 WCDMA 등의 3세대 이동 통신으로 발전하였습니다. 이후 대용량 데이터의 초고속 전송이 가능한 4세대 LTE 서비스가 전 세계로 확산되었으며, 2019년 초 5세대 이동통신 5G 서비스가 한국과 미국을 시작으로 글로벌 상용화되었습니다. 5G 스마트폰은 2020년 2.7억대에서 2024년에는 8.6억대로 판매가 확대될 전망입니다. 이러한 5G의 확산은 AI·XR·자율주행 등 5G 융합 서비스 및 기반 산업의 생태계 조성을 가속화하고 있습니다(출처: TechInsights 2024.06).

스마트폰 시장은 2007년 이후 큰 폭으로 성장하여 2024년 전체 휴대폰 판매량 중 스마트폰의 비중은 87% 수준, 피처폰의 비중은 일부 신흥 시장에서의 수요로 인해 13% 수준으로 전망됩니다. 또한 스마트폰 보급률은 2023년 52.5%에서 2024년 53.1%로 소폭 증가할 것으로 전망됩니다(출처: TechInsights 2024.06).

스마트폰 시장이 성숙함에 따라 고성능 AP, 고화질 Display, 폴더블 폼팩터, 멀티카메라, 센서, 방수·방진, 생체 인식 등과 같은 하드웨어뿐만 아니라 플랫폼기반의 Application, UX, Game, Media, Digital Wallet, AI, 보안 등 전반적인 소프트웨어 기반 경험 경쟁력의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다.

(국내외 시장여건 등)

1) TV산업

TV 시장 수요는 글로벌 경기 불확실성에 따른 소비심리 악화 영향으로 2022년 2억 328만대에서 2023년 2억 139만대 수준으로 소폭 감소하였습니다. 2024년은 파리올림픽 등 스포츠 이벤트에 따른 수요 확대 기대감으로 전년비 1.5% 성장한 2억 441만대를 기록할 것으로 전망됩니다. (출처: Omdia 2024.06)

< TV 시장점유율 추이 >

제 품	2024년 반기	2023년	2022년
TV	29.2%	30.1%	29.7%

[※] 시장점유율은 외부조사기관인 Omdia의 세계시장점유율 자료(금액 기준)를 활용하였습니다. (2024년 반기 시장점유율은 당사 추정치입니다.)

2) 모바일 산업

스마트폰 시장은 경기 회복 기대에 따른 소비심리 상승과 AI제품·서비스 확대 등으로 인해 2023년 11.5억대에서 2024년 12억대 수준으로 증가할 것으로 예상됩니다.태블릿 시장은 코로나19(COVID-19)의 영향에 따른 비대면 수요 증가로 2021년 1.8억대로 성장한 후, 교체 수요 감소 등으로 2023년 1.4억대 수준으로 역성장 하였으나 2024년에는 교체 주기 도래에 따라 수요가 1.5억대 수준으로 회복될 전망입니다(출처: TechInsights 2024.06).

< 스마트폰 시장점유율 추이 >

제 품	2024년 반기	2023년	2022년
스마트폰	19.5%	19.7%	21.7%

[※] 시장점유율은 외부조사기관인 TechInsights의 세계시장점유율 자료(수량 기준)를 활용하였습니다.

(영업의 개황 등)

1) TV산업

당사는 2006년 이후 2023년까지 18년 연속으로 TV 판매 1위를 달성하고 있습니다. 이 기간 동안 전세계 TV 시장을 살펴보면, 249백만대를 기록한 2011년까지는 지속성장했으나, 2012년(233백만대)부터 2023년(201백만대) 까지 지속적으로 감소 추세입니다. 반면, 당사는 신제품의 적기 출시 및 마케팅 경쟁력 강화를 통해 전세계 시장점유율을 2006년 14.2%에서 2023년 30.1%로 확대했습니다.

올해 TV 시장은 75인치 이상 초대형 TV와 1,500불 이상 프리미엄 TV군이 성장을 주도하고 있습니다. 특히 북미와 유럽, 한국, 동남아, 중국 등지에서 강세를 보이고 있는데, 업체들간 경쟁이 점점 더 치열해 지고 있고, 패널가격 상승세도 지속 중이어서 수익성 확보에 어려움이 가중되고 있습니다.

당사는 이러한 위기를 기회요인으로 판단하고, 8K해상도의 98인치 초대형 TV를 선두로 해서, Neo QLED, OLED, QLED 주력제품과 라이프스타일 TV, 사운드바 등 사업군에 AI 신기술을 대거 적용, 경쟁사와의 기술격차를 크게 벌려 나가고 있습니다.

24년형 Neo QLED 8K TV에 탑재된 '8K AI 업스케일링 프로(8K Upscaling Pro)'는삼성 반도체와 AI기술을 사용하여 SD/HD/Full HD 등과 같은 저해상도 영상을 8K급으로 향상시킵니다. 음질 부분에서도 AI 기술을 적극 도입하여, 영화내 대화를 인식해 소음과 분리한 후 화자의 목소리를 또렷하게 조정하거나, 물체의 움직임에 따라 입체적 사운드를 구현하는 기능들이 가능하게 되었습니다.

또한, AI TV는 휴대폰, 사운드바를 비롯한 집안의 다양한 가전기기들과 손쉽게 연결되어 TV만의 서비스가 아니라 새로운 가치와 경험들도 선사합니다. TV와 연결된전자기기들의 에너지 사용량을 제어하여 최적화할 수도 있고, 부착된 카메라와 센서 등을 통해 집안의 상황을 파악하여, 외부에 있는 주인에게 알려줄 수도 있습니다. 이런 상황에서 모든 개인정보와 기기보안은 회사 보안 솔루션인 녹스(Knox)를 통해 철저히 보호됩니다.

회사는 AI 핵심 기술채용과 함께, 초대형 TV 시장 확대에 필요한 제품 라인업도 더욱 탄탄하게 구축하고 있습니다. 90인치 대 이상 성장 시장 주도를 위해, 98인치 라인업을 Neo QLED 8K/4K, QLED에 이어 UHD급으로 확대하는 한편, 85인치 Neo QLED, 83인치 및 77인치 OLED 라인업도 글로벌로 강화했습니다.

미래 기술인 차세대 마이크로 LED 제품도 89인치, 101인치에 이어 114인치로 확대하고 있으며, AI와 광학 문자인식 기술을 활용하여 자막을 실시간으로 음성 변환시키는 '들리는 자막' 기술을 실용화하고, 화면 윤곽선과 색상을 저시력자 맞춤형으로 재조정해 주는 '릴루미노모드(Relumino Mode)'기능도 향상시켜 '모두를 위한 TV' 공급에도 최선의 노력을 하고 있습니다.

2) 모바일 산업

당사는 주력 사업인 스마트폰 시장에서 2011년 이후 13년 연속 글로벌 출하량 1위를 유지하고 있습니다(출처: TechInsights 2024.08). 또한, 스마트폰 뿐만 아니라 전체 모바일 시장에서의 사업 위상을 강화하기 위해 태블릿과 웨어러블(스마트워치, 무선이어폰 등), 액세서리 등의 제품과 함께 Digital Health, Digital Wallet 등 컨텐츠와 서비스 부문에서도 사업 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다.

당사는 프리미엄에서 보급형까지 다양하고 경쟁력 있는 스마트폰 라인업을 활용하여지역별시장 상황과 경쟁 환경에 최적화된 제품 포트폴리오를 운영하고 있습니다. 특히 프리미엄 스마트폰은 대화면 Infinity Display에 더해 Dynamic AMOLED 2X(120Hz) 지원, UWB(Ultra Wideband)를 활용한 디지털키 및 콘텐츠 공유, 방수・방진, 고속 유・무선 충전, 초음파 방식의 온스크린 지문 인식, 야간 촬영・8K 동영상 특화 카메라 기능, 생성형 AI를 적용한 검색・실시간 통번역・자동 내용 요약・사진 편집 등 고객의 필요로 하는 차별화된 기능을 지속해서 선보이고 있습니다.

2019년에는 세계 최초 5G 스마트폰 출시로 5G 시장 리더십을 선점하고 폴더블 디스플레이를 탑재한 'Galaxy Z 폴드'로 신규 시장을 개척한 데 이어, 2020년에는 상하로 접히는 'Galaxy Z 플립'을 출시하였습니다. Galaxy Z 플립 시리즈는 아이코닉하고 젊은 감성의 디자인으로, 여성과 젊은 세대의 Galaxy 선호도를 높이는 데 기여하고 있습니다. 이후 당사만의 기술 리더십과 소비자 가치 중심의 사용성을 기반으로 폴더블 특화 경험을 지속 강화한 4세대, 5세대 Galaxy Z 시리즈를 출시하며 폴더블 시장을 주도해 왔습니다.

2024년 1월 출시한 Galaxy S24 시리즈는 당사 최초로 'Galaxy AI'를 탑재하였습니다. Galaxy AI는 사용자가 세상을 경험하는 방식을 바꾸고 무한한 잠재력을 발휘할 수 있도록 완전히 새로워진 검색, 창의적인 사진 편집, 실시간 번역, 편리한 텍스트 요약 등의 경험을 제공하고 있습니다. 또한 보다 강력한 보안성을 바탕으로 초연결 사회에서 소비자에게 안전한 AI 및 멀티 디바이스 사용 환경을 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

스마트폰 외에도 대화면 디스플레이와 S Pen으로 노트 필기와 영상회의, 멀티태스킹등 생산적인 경험을 제공하는 태블릿, 생체 센서 기술을 적용하여 더욱 고도화된 피트니스 및 웰니스 기능을 제공하는 스마트 워치와 풍부하고 뛰어난 사운드 경험을 제공하는 무선 이어폰이 포함된 웨어러블 제품 등 다양한 Galaxy Ecosystem 제품군을 통해 당사 스마트폰을 사용하는 고객에게 더욱 풍부한 모바일 경험을 제공하고 있습니다.

당사는 제품과 더불어 그동안 Samsung Wallet(舊 Samsung Pay), Samsung Health, Bixby 등의 실용적이고 가치 있는 서비스를 제공해 왔습니다. Samsung Wallet은 결제 외에도 신분 증, 티켓 등의 다양한 기능을 제공하여 실물 지갑을 대체할 수 있는 서비스로 발전시켜 나가고 있으며, Samsung Health는 새로운 폼팩터와 AI 기능 적용을 통해 통합 건강관리 플랫폼으로서의 위상을 더욱 강화해 나가고자 합니다

또한, Ecosystem 확장을 위한 전략적 파트너십도 강화하고 있으며, SmartThings, Bixby, Cloud를 활용하고 당사의 방대한 글로벌 Installed-base 기반 서비스 사업 강화를 통해 수익 구조를 다변화하기 위해 노력하고 있습니다.

뿐만 아니라 제품에 재활용 소재 적용을 확대하는 등, 친환경 기술 혁신도 지속하고 있습니다. 대표적으로 플라스틱 폐기물 중 하나인 폐어망을 재활용해 만든 소재를 Galaxy S22 시리즈 이후 많은 과제에 사용하고 있습니다. 'Galaxy Z 폴드5' 및 'Galaxy Z 플립5'에는 플라스틱 이외에도 재활용 글라스와 알루미늄을 적용하였으며, Galaxy S24 시리즈에는 재활용 코발트와 희토류를 추가 적용하였습니다.

추가로, 당사는 2023년 5월 '자가 수리 프로그램'을 도입하고 대상 모델과 국가를 확대해 가는 등, e-waste를 최소화하여 환경에도 도움이 되고자 하였습니다.

당사는 앞으로도 업계 최고 수준의 R&D 역량을 바탕으로 지속적인 기술 혁신 및 철저한 미래 준비를 통해 고객에게 새로운 가치를 끊임없이 제공하겠습니다.

[DS 부문]

(산업의 특성 등)

반도체는 일반적으로 정보를 저장하고 기억하는 메모리 반도체와 연산과 추론 등 논리적인 정보처리 기능을 하는 System LSI(비메모리 반도체)로 구분됩니다.

메모리 반도체는 읽고 쓸 수 있는 램(RAM, Random Access Memory) 제품과 읽기만 할 수 있는 롬(ROM, Read Only Memory) 제품으로 구분됩니다. 램(RAM)은 전원이 꺼지면 기억된 내용은 지워져 휘발성 메모리(Volatile Memory)라고 하며, 컴퓨터의 주기억 장치, 응용프로그램의 일시적 로딩(Loading), 데이터의 일시적 저장 등에 사용됩니다. 롬(ROM)은 전원이 꺼져도 데이터가 지워지지 않는 비휘발성 메모리로, 대표적으로 입출력 시스템이나 IC카드 등에 사용됩니다.

System LSI 제품은 응용처에 따라 종류가 다양하며, 중앙처리 장치인 CPU(Central Processing Unit), 그래픽 처리 장치인 GPU(Graphics Processing Unit), ISP(Image Signal Processor), Modem(Modulator-Demodulator) 등을 내장한 모바일 기기용 SOC(System-On-Chip)가 가장 대표적인 제품입니다. 당사는 스마트폰, 태블릿 등 모바일용 AP 제품과 이미지 센서 등을 공급하고 있습니다.

Foundry 사업은 팹리스(Fabless) 업체가 설계한 반도체를 위탁 생산해서 공급해 주는 사업으로, 일반 제조업의 OEM 공급과 비슷한 개념의 '수탁 반도체 제조 사업'입니다. 반도체 공정 기술의 고도화와 투자 부담의 증가로 많은 IDM(Integrated Device Manufacturer)업체가 생산 시설을 보유하지 않은 팹리스(Fabless) 업체로 전환하였습니다. 이에 따라 대규모 Capa를 보유 중인 5개 내외의 소수업체가 전체 파운드리 시장의 대부분을 영위하고 있습니다.

(국내외 시장여건 등)

메모리 시장은 서버에서 Cloud 서비스 업체의 AI향 투자 확대와 더불어 기업향 On-premise 서버 시장에서도 AI 서버 수요가 확대 되었습니다. 이에, HBM 뿐만 아니라 서버향 Conventional DRAM 및 SSD 또한 견조한 수요를 나타냈습니다. PC는 Sell-Out 부진으로 수요가 상대적으로 약세를 보였지만, 모바일은 중화 OEM 고객사들의 해외 수출 확대와 메모리 가격 상승 전망에 따른 일부 재고 비축 기조로 견조한 수요가 유지 되었습니다. 서버 응용 중심의 수요 강세 속에서, 당사는 Generative AI향 고부가가치 제품 수요 적극 대응과 전반적인 시장 가격 개선에 힘입어 HBM 및 서버향 DDR5 및 SSD 제품의 매출을 확대하였습니다.

Foundry 시장은 모바일, Automotive 등의 응용처 수요 회복은 제한적이었으나 Advanced 공정을 사용하는 인공지능(AI)과 산업용 고성능 컴퓨터(HPC)의 반도체 수요 증가로 성장세를 보였습니다. 2024년 하반기는 AI/HPC와 더불어 모바일 고객사의 수요 증가와 함께 최첨단 Advanced 공정이 지속적으로 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 중장기는 모바일 AP(Application Processor), 전장향 반도체 수요 증가와 함께 응용처 전반적으로 지속적인 성장세가 전망됩니다.

< DRAM 시장점유율 추이 >

제 품	2024년 반기	2023년	2022년
DRAM	42.7%	42.2%	43.1%

[※] 시장점유율은 외부조사기관인 DRAMeXchange의 세계시장점유율 자료(금액 기준)를 활용하였습니다.

(2024년 반기 시장점유율은 당사 추정치입니다.)

(영업의 개황 등)

메모리의 서버 시장은 주요 Cloud 서비스 기업체들에서의 AI향 투자가 확대됨에 따라 서버수요 강세가 지속될 것으로 예상됩니다. PC 및 모바일은 On-device AI 지원 모델 확대에 따른 탑재량 증가와 계절적 성수기 효과로 수요 모멘텀은 존재하나, 상반기 고객사 부품 재고증가를 감안하면 하반기 수요 성장이 제한적일 가능성도 있습니다. 다만, 업계 공급 관점에서는 AI 서버향 수요 대응으로 HBM, 서버향 DRAM 및 서버향 SSD로 Capa가 집중됨에 따라PC 및 모바일 응용에서 선단 공정 제품들의 Conventional Bit 공급 제약은 지속될 것으로예상됩니다. 서버 중심의 수요 견조세 속에서 당사는 AI향 고부가가치 제품 수요에 적극 대응할 계획입니다. 특히 HBM3E 및 고용량 DDR5 시장에서의 경쟁력을 더욱 제고할 예정이며, 서버향 SSD에 대해서도 공급을 강화하여 판매를 더욱 확대할 계획입니다.

System LSI는 주력 시장인 글로벌 스마트폰 시장이 중국 OEM 중심으로 전년대비 소폭 성장할 것으로 전망하며, On-device AI 적용 확산에 따른 저전력/고성능 프로세서 및 고화소이미지센서 등의 수요 확대에 적극 대응하고 있습니다. SOC는 업계 최초로 3나노 공정을 적용한 스마트 워치향 제품을 출시하였으며, On-device AI 및 Game 성능 강화한 모바일향 SOC 제품 라인업을 확대하고 전장, Data-Center향 제품 등 차세대 기술 개발 및 고객과 협력을 강화하고 있습니다. 이미지 센서는 당사 우위 미세 픽셀 활용도 향상을 위해 망원 카메라에 2억 화소를 업계 최초 적용하여 양산하였고, 카메라 해상도 및 줌 성능 차별화를 선도하고 있으며 미래 성장 동력 확보를 위한 차량, 증강현실, 드론용 고객 발굴도 지속하고 있습니다. LSI 제품 스마트폰향 OLED mDDI는 선단 공정 경쟁력을 바탕으로 주요 고객사의 신제품 양산에 성공하였으며, pDDI는 OLED향과 TCON(터치컨트롤러) 사업을 본격 확대하고 있습니다. PMIC(전력관리 IC)는 모바일향 매출 확대 및 고객 다변화를 추진하고, 메모리향 제품 Portfolio를 확대 중이며, Security는 스마트폰향 보안 니즈 증가에 맞춰 고사양 제품 출시 등으로 매출 확대를 추진 하고 있습니다.

Foundry는 시장변화에 맞춰 노드 및 응용별 전략을 구체화 함과 동시에 기술개발, 제조, 비즈니스 역량에 대한 경쟁력 강화를 추진하고 있습니다. Advanced 노드는 GAA를 적용한 3 나노 공정을 2022년부터 양산하였으며, 축적된 경험과 노하우를 3나노 2세대에 반영하여, 2024년 상반기에는 웨어러블향 양산을 시작하였습니다. 2024년 하반기에는 모바일향을 계획에 맞춰 양산 출하할 예정입니다. 한편, Advanced 노드의 지속적인 기술경쟁력 확보를 위해, 2나노 공정 적기 개발을 추진함과 동시에 고객 확대에 집중할 계획입니다. Mature 노드는 고객 수요에 대응하기 위하여 Specialty 공정에 대한 꾸준한 투자 및 개발로 수익성 개선과 노드 장기 활용이 동시에 이뤄질 수 있는 전략을 마련하고 있습니다. 또한, 개발부터 양산까지의 사업화를 고려한 최적 라인 운영 및 공급 능력 확대도 지속 준비하고 있습니다.

[SDC]

(산업의 특성 등)

디스플레이(Display)는 각종 전자기기에 사용되는 화면표시장치를 지칭합니다. 표시방식 측면에서 표시 소자가 능동적으로 구동되는(Active Matrix) 방식이 주류이며, OLED(Organic Light Emitting Diode)와 QD-OLED(Quantum Dot-Organic Light Emitting Diode), TFT-LCD(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display) 등이 이에 해당합니다.

OLED는 스스로 빛을 내는 유기물질을 이용한 화면표시장치로, 명암비와 색 일치율이 높고 색 재현 범위가 넓으며 응답 속도가 빠르다는 장점이 있습니다. 이러한 장점을 바탕으로 OLED 디스플레이는 멀티미디어 콘텐츠, 인터넷 사용 등 디스플레이의 성능이 중시되는 스마트폰 시장에서 채용이 빠르게 증가하고 있습니다. 과거에는 OLED로 고해상도의 장수명 패널을 구현하는 것에 대해 시장의 큰 우려가 있었으나, 당사는 기술적 한계를 극복하여 시장을 발전시켜 왔습니다. OLED는 LCD의 단점을 극복할 뿐만 아니라, 앞으로 폴더블, IT(태블릿/노트북), Auto 등 다양한 응용처로 확대 적용이 가능하며 앞으로 시장이 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. QD-OLED는 수

나노 미터의 반도체 결정인 퀀텀닷(Quantum Dot)을 패널에 내재화해 색 재현력과 시야각을 극대화한 자발광 디스플레이로, 향후 프리미엄급 TV 및 모니터 시장을 주도할 차세대 디스플레이로 주목받고 있습니다.

(국내외 시장여건 등)

스마트폰용 디스플레이 패널 시장은 2023년 14.4억대에서 2024년 14.3억대로 소폭 감소될 것으로 전망됩니다. 스마트폰용 OLED 디스플레이 패널의 경우 2023년 6.1억대에서 2024년 8억대로 증가할 전망이며, 전체 스마트폰 디스플레이 패널에서 차지하는 비중은 2023년 42.7%에서 2024년 55.8%로 증가할 것으로 전망됩니다(출처: Omdia 2024.07).

또한, 대형 디스플레이 패널 시장은 2023년 8.1억대에서 2024년 8.6억대로 시장이 성장할 것으로 전망됩니다(출처: Omdia 2024.06).

< 스마트폰 패널 시장점유율 추이 >

제 품	2024년 반기	2023년	2022년
스마트폰 패널	41.5%	50.1%	56.7%

※ 시장점유율은 외부조사기관인 Omdia의 세계시장점유율 자료(금액 기준)를 활용하였습니다. (2024년 반기 시장점유율은 외부조사기관의 예측치 입니다.)

(영업의 개황 등)

당사는 2007년 세계 최초로 OLED 제품의 상용화에 성공한 이후 현재까지 중소형 OLED 시장에서 독보적인 점유율을 유지하고 있습니다. 또한 스마트폰 외에도 폴더블,태블릿, 워치, 노트북, AUTO 등으로 제품군을 다각화하여 명실상부한 OLED 디스플레이의 선도 기업으로 자리매김하였습니다.

당사는 Flexible OLED와 Rigid OLED 패널을 통해 프리미엄부터 보급형 제품까지 최적의 제품 포트폴리오를 구축하여 소비자의 고도화되는 요구에 적극 대응하고 있습니다. 또한 차별화된 기능과 디자인의 폴더블·IT(태블릿/노트북) 제품을 지속적으로 출시하여 시장으로 부터 업계 최고의 기술력을 인정받고 있습니다.

2024년 스마트폰 디스플레이 시장은 패널 업체간 경쟁이 심화될 것으로 예상됩니다. 당사는 선도 기술을 통한 제품 차별화로 하이엔드 주도권을 지속 유지하며 판매 확대에 주력할 계획입니다.

또한, 8.6G IT OLED라인을 건설하는 등 스마트폰에 편중된 중소형 패널 사업을 다각화하여 IT, Gaming, AUTO 제품 등으로 제품 포트폴리오를 확대하고 사업 리더십을 더욱 견고히 할 계획입니다.

대형 디스플레이 사업은 프리미엄 TV 및 모니터 제품 중심으로 역량을 집중하고 수율 향상, Loss절감 등 내실을 다져서 사업 경쟁력을 강화할 계획입니다.

[Harman]

(산업의 특성 등)

Harman은 전장부품(Automotive)과 라이프스타일 오디오(Lifestyle Audio) 산업에서경쟁하고 있습니다. 이중 전장부문이 Harman 사업의 가장 큰 비중을 차지하고 있으며 디지털 콕핏, 카 오디오, 텔레매틱스 등 분야에 진출해 있습니다.

요즘 소비자들은 차량을 선택할 때 단순 이동수단 기능보다 이동시에 즐길 수 있는 차량내 경험(In-Cabin Experience)을 중요시하는 추세입니다. 이러한 소비자 니즈를 충족시키기 위해 자동차 제조사들은 Harman의 전장부품(디지털 콕핏, 카 오디오 등)을 활용하여 보다 편리하고 개인화된 맞춤경험을 제공하여 차별화하는데 주력하고 있습니다.

특히, 차량의 IT 기기화에 따른 SDV(Software Defined Vehicle)로의 변화로 인해, 자동차 제조사들은 중앙집중형 아키텍쳐의 도입을 시도하고 SW 기능을 강화하는 등 많은 변화를 추진 중입니다. 이에 따라, 전장 부품업체들의 공급제품에도 빠른 기술적 변화가 진행되고 있어, 기술 변화에 따른 업체간 경쟁은 치열할 것으로 예상됩니다.

라이프스타일 오디오 산업은 소비자 오디오와 프로페셔널 오디오 솔루션으로 구분됩니다. 고객에게 더욱 큰 오디오 경험을 주기 위해 2023년 4분기 Roon Labs LLC를 인수했습니다. 소비자 오디오 제품(True Wireless Stereo, Portable Speaker, Headphone 등)은 과거에 음원 재생 기기에 국한되었으나, 최근 무선 연결기술이 적용되고 AI가 탑재되어 기술 중심의 IT 기기로 진화하는 추세입니다. 이러한 변화에 따라, 사운드 재생 기술을 보유한 전통적인 오디오 업체들로 구성된 소비자 오디오 시장에 IT 업체들이 진입하여 경쟁하고 있습니다.

소비자 오디오 시장은 TWS 헤드폰과 Wifi Home 스피커 및 게이밍 스피커 분야에서 고성장이 예상되며, 특히 휴대폰 제조사가 높은 시장점유율을 차지하고 있는 TWS 분야는 가장 성장률이 높을 것으로 예상됩니다.

프로페셔널 오디오 솔루션(상업용·대규모 공연장 등에서의 오디오, 특수조명, 영상컨트롤 솔루션 등) 산업은 제품 종류에 따라 세분화되어 있고 제품의 응용 방식에 따라 다양한 업체가 경쟁하고 있습니다.

(국내외 시장여건 등)

세계 자동차 공급망의 불안, 고금리와 높은 인플레이션은 점진적으로 안정화되는 추세입니다. 그러나 유럽과 중동의 지정학적 이슈로 인한 원자재 가격 상승, 주요 국가들의 긴축 정책지속 등의 불확실성은 여전히 상존합니다. 이러한 요소들을 고려해봤을 때 2024 년 전세계자동차 생산량은 전년대비 1% 역성장 할 것으로 예상됩니다(출처: S&P Global Light Vehicle Production Forecast 2024.06).

< 디지털 콕핏 시장점유율 추이 >

제 품	2024년 반기	2023년	2022년
디지털 콕핏	14.0%	16.5%	17.9%

[※] 디지털 콕핏은 인포테인먼트 시스템 등을 통해 안전한 운전 환경을 제공하는 디지털 전장부품입 니다.

[※] 시장점유율은 외부조사기관인 Techinsights의 자료(금액기준)를 활용하였습니다. (2024년 반기 시장점유율은 당사 추정치 입니다.)

(영업의 개황 등)

Harman은 전장부품 시장에서 차량내 경험의 중심이 되는 디지털 콕핏, 카 오디오 분야에서 선도적 시장 입지를 유지하고 있습니다. 당사는 Harman의 선두 위상을 강화하기 위해 Harman의 전장사업에 당사의 무선통신, 디스플레이 등 IT 기술을 지속 접목시켜 차량의 IT기기화에 적극 대응해 나갈 계획입니다.

Harman은 차량의 SDV(Software Defined Vehicle)화 변화에 대응하기 위해 차별화된 기술 개발을 통해 끊임없는 혁신을 추구함으로써 소비자들의 차량내 경험이 한층 업그레이드되도록 노력해 나갈 것입니다.

자동차 시장에서의 여러 성공 요인은 소비자 오디오 및 프로페셔널 오디오 솔루션 시장에서 도 유사하게 적용될 것입니다. 그래미상 3회, 아카데미상 2회 등을 수상한 바와 같이 여러 Harman 브랜드는 일상적인 소비자와 음악 애호가 사이에서 명성을 쌓아왔습니다. 무선 스마트 스피커와 같은 전도 유망한 분야에서 신제품을 제공하는 것은 신규 고객을 Harman으로 유인함과 동시에 브랜드 평판을 강화하는데 지속적으로 도움이 될 것입니다.

라. 사업부문별 요약 재무 현황

2024년(제56기) 반기 매출은 DX 부문이 89조 3,636억원(61.2%), DS 부문이 51조 6,938억원(35.4%)이며, SDC가 13조 326억원(8.9%), Harman은 6조 8,193억원(4.7%)입니다.

2024년(제56기) 반기 영업이익은 DX 부문이 6조 7,974억원, DS 부문이 8조 3,650억원, SDC가 1조 3,508억원, 그리고 Harman은 5,609억원입니다.

(단위: 억원, %)

шО	구 분	제56기 반기		제55기		제54기	
부문	T T	금액	비중	금액	비중	금액	비중
	매출액	893,636	61.2%	1,699,923	65.7%	1,824,897	60.4%
DX 부문	영업이익	67,974	39.9%	143,847	219.0%	127,461	29.4%
	총자산	2,520,955	37.1%	2,342,534	37.2%	2,279,669	38.6%
	매출액	516,938	35.4%	665,945	25.7%	984,553	32.6%
DS 부문	영업이익	83,650	49.1%	△148,795	△226.6%	238,158	54.9%
	총자산	3,197,814	47.0%	2,871,411	45.6%	2,620,558	44.3%
	매출액	130,326	8.9%	309,754	12.0%	343,826	11.4%
SDC	영업이익	13,508	7.9%	55,665	84.8%	59,530	13.7%
	총자산	774,734	11.4%	792,752	12.6%	737,798	12.5%
	매출액	68,193	4.7%	143,885	5.6%	132,137	4.4%
Harman	영업이익	5,609	3.3%	11,737	17.9%	8,805	2.0%
	총자산	192,794	2.8%	179,566	2.9%	171,023	2.9%

[※] 각 사업부문별 요약 재무 현황은 부문 등 간 내부거래를 포함하고 있습니다.

(공통 판매비와 관리비 및 자산의 합리적 배부 기준 적용)

- · 공통 판매비와 관리비의 경우 각 제품 · 모델별 귀속이 확실한 직접비용(위임성 경비)은 각 제품 · 모델부문에 직접 귀속시키고 귀속여부가 불분명한 공통경비는 각 배부 기준(매출액비, 인원수비 등)에 의거 적절히 배부하고 있습니다.
- · 공통자산의 경우 직접귀속이 가능한 자산(재고자산, 고정자산, 투자자산 등)은 해당 부서에 직접 귀속되나, 전사 공통관리가 필요한 자산 및 자산귀속이 불분명한 자산은 필요한 경우 합리적인 배부 기준(매출액비, 세전이익비 등)에 의거 각 부문에 배부하고 있습니다.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제56기 반기	제55기	제54기	
	2024년 6월말	2023년 12월말	2022년 12월말	
[유동자산]	217,858,103	195,936,557	218,470,581	
• 현금및현금성자산	49,844,405	69,080,893	49,680,710	
· 단기금융상품	50,921,350	22,690,924	65,102,886	
· 기타유동금융자산	29,758	635,393	443,690	
· 매출채권	43,660,885	36,647,393	35,721,563	
· 재고자산	55,566,613	51,625,874	52,187,866	
• 기타	17,835,092	15,256,080	15,333,866	
[비유동자산]	267,899,595	259,969,423	229,953,926	
· 기타비유동금융자산	10,562,120	8,912,691	12,802,480	
·관계기업 및 공동기업 투자	12,176,730	11,767,444	10,893,869	
· 유형자산	194,449,826	187,256,262	168,045,388	
· 무형자산	23,623,280	22,741,862	20,217,754	
• 기타	27,087,639	29,291,164	17,994,435	
자산총계	485,757,698	455,905,980	448,424,507	
[유동부채]	84,354,935	75,719,452	78,344,852	
[비유동부채]	17,876,092	16,508,663	15,330,051	
부채총계	102,231,027	92,228,115	93,674,903	
[지배기업 소유주지분]	373,669,562	353,233,775	345,186,142	
· 자본금	897,514	897,514	897,514	
· 주식발행초과금	4,403,893	4,403,893	4,403,893	
• 이익잉여금	358,035,802	346,652,238	337,946,407	
• 기타	10,332,353	1,280,130	1,938,328	
[비지배지분]	9,857,109	10,444,090	9,563,462	
자본총계	383,526,671	363,677,865	354,749,604	
	2024년 1월~6월	2023년 1월~12월	2022년 1월~12월	
매출액	145,983,903	258,935,494	302,231,360	
영업이익	17,049,887	6,566,976	43,376,630	
연결총당기순이익	16,596,053	15,487,100	55,654,077	
• 지배기업 소유주지분	16,263,683	14,473,401	54,730,018	
· 비지배지분	332,370	1,013,699	924,059	
기본주당순이익(단위 : 원)	2,394	2,131	8,057	
희석주당순이익(단위 : 원)	2,394	2,131	8,057	
연결에 포함된 회사수	227개	233개	233개	

[※] 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

[△는 부(-)의 값임]

※ 기본주당이익(보통주) 산출근거는제54기~제55기 연결감사보고서 및 제56기 반기 연결검토보고서 주석사항을 참고하시기 바랍니다.	

나.요약별도재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제56기 반기	제55기	제54기
	2024년 6월말	2023년 12월말	2022년 12월말
[유동자산]	85,822,049	68,548,442	59,062,658
· 현금및현금성자산	7,818,179	6,061,451	3,921,593
· 단기금융상품	3,819,491	50,071	137
• 매출채권	35,819,815	27,363,016	20,503,223
• 재고자산	31,861,509	29,338,151	27,990,007
• 기타	6,503,055	5,735,753	6,647,698
[비유동자산]	231,813,389	228,308,847	201,021,092
• 기타비유동금융자산	2,189,910	1,854,504	1,364,608
• 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자	57,551,517	57,392,438	57,397,249
• 유형자산	143,072,339	140,579,161	123,266,986
• 무형자산	10,834,063	10,440,211	8,561,424
• 기타	18,165,560	18,042,533	10,430,825
자산총계	317,635,438	296,857,289	260,083,750
[유동부채]	50,124,508	41,775,101	46,086,047
[비유동부채]	30,640,186	30,294,414	4,581,512
부채총계	80,764,694	72,069,515	50,667,559
[자본금]	897,514	897,514	897,514
[주식발행초과금]	4,403,893	4,403,893	4,403,893
[이익잉여금]	231,894,075	219,963,351	204,388,016
[기타]	△324,738	△476,984	△273,232
자본총계	236,870,744	224,787,774	209,416,191
종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방 법	원가법	원가법	원가법
	2024년 1월~6월	2023년 1월~12월	2022년 1월~12월
매출액	104,973,735	170,374,090	211,867,483
영업이익(손실)	9,229,871	△11,526,297	25,319,329
당기순이익	16,835,854	25,397,099	25,418,778
기본주당순이익(단위 : 원)	2,479	3,739	3,742
희석주당순이익(단위 : 원)	2,479	3,739	3,742

[※] 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

[△는 부(-)의 값임]

[※] 기본주당이익(보통주) 산출근거는 제54기∼제55기 감사보고서 및 제56기 반기 검토보고서 주석사항을 참고하시기 바랍니다.

2. 연결재무제표

2-1. 연결 재무상태표 연결 재무상태표

제 56 기 반기말 2024.06.30 현재 제 55 기말 2023.12.31 현재

(단위:백만원)

	제 56 기 반기말	제 55 기말
자산	제 50 기 단기를	NI 33 71 E
유동자산	217,858,103	195,936,557
현금및현금성자산 (주3,25)	49,844,405	69,080,893
단기금융상품 (주3,25)	50,921,350	22,690,924
단기상각후원가금융자산 (주3,25)	0 750	608,281
단기당기손익-공정가치금융자산 (주3,4,25)	29,758	27,112
매출채권 (주3,25)	43,660,885	36,647,393
미수금 (주3,25)	7,729,562	6,633,248
선급비용	3,769,456	3,366,130
재고자산 (주5)	55,566,613	51,625,874
기타유동자산 (주3,25)	6,336,074	
매각예정분류자산 (주28)	0	217,864
비유동자산	267,899,595	259,969,423
기타포괄손익-공정가치금융자산 (주3,4,25)	9,202,104	7,481,297
당기손익-공정가치금융자산 (주3,4,25)	1,360,016	1,431,394
관계기업 및 공동기업 투자 (주6)	12,176,730	11,767,444
유형자산 (주7)	194,449,826	187,256,262
무형자산 (주8)	23,623,280	22,741,862
순확정급여자산 (주11)	4,258,721	4,905,219
이연법인세자산	12,230,605	10,211,797
기타비유동자산 (주3,25)	10,598,313	14,174,148
자산총계	485,757,698	455,905,980
부채		
유동부채	84,354,935	75,719,452
매입채무 (주3,25)	13,113,267	11,319,824
단기차입금 (주3,9,25)	10,626,592	7,114,601
미지급금 (주3,25)	14,496,801	15,324,119
선수금 (주14)	1,427,722	1,492,602
예수금 (주3,25)	934,763	892,441
미지급비용 (주3,14,25)	27,115,302	26,013,273
당기법인세부채	5,103,229	3,358,715
유동성장기부채 (주3,9,10,25)	2,114,833	1,308,875
충당부채 (주12)	7,436,605	6,524,876
기타 유동부채 (주3,14,25)	1,985,821	2,308,472

매각예정분류부채 (주28)	0	61,654
비유동부채	17,876,092	16,508,663
사채 (주3,10,25)	20,573	537,618
장기차입금 (주3,9,25)	3,719,386	3,724,850
장기미지급금 (주3,25)	5,401,940	5,488,283
순확정급여부채 (주11)	497,929	456,557
이연법인세부채	623,074	620,549
장기충당부채 (주12)	3,353,124	2,878,450
기타 비유동 부채 (주3,14,25)	4,260,066	2,802,356
부채총계	102,231,027	92,228,115
자본		
지배기업 소유주지분	373,669,562	353,233,775
자본금 (주15)	897,514	897,514
우선주자본금	119,467	119,467
보통주자본금	778,047	778,047
주식발행초과금	4,403,893	4,403,893
이익잉여금 (주16)	358,035,802	346,652,238
기타자본항목 (주17)	10,332,353	1,280,130
비지배지분	9,857,109	10,444,090
자본총계	383,526,671	363,677,865
자본과부채총계	485,757,698	455,905,980

2-2. 연결 손익계산서 연결 손익계산서

제 56 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지 제 55 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지

(단위:백만원)

	제 56 기 반기		제 55 기 반기		
	3개월	누적	3개월	누적	
매출액 (주26)	74,068,302	145,983,903	60,005,533	123,750,904	
매출원가 (주18)	44,312,026	90,198,358	41,647,190	87,654,283	
매출총이익	29,756,276	55,785,545	18,358,343	36,096,621	
판매비와관리비 (주18,19)	19,312,398	38,735,658	17,689,796	34,787,896	
영업이익 (주26)	10,443,878	17,049,887	668,547	1,308,725	
기타수익 (주20)	318,501	763,782	201,176	705,471	
기타비용 (주20)	245,496	626,889	169,057	373,039	
지분법이익 (주6)	198,514	413,347	199,941	413,782	
금융수익 (주21)	3,616,184	7,071,247	4,056,928	8,684,977	
금융비용 (주21)	2,736,237	5,369,307	3,244,540	7,200,541	
법인세비용차감전순이익(손실)	11,595,344	19,302,067	1,712,995	3,539,375	
법인세비용(수익) (주22)	1,753,999	2,706,014	(10,576)	241,204	

9,841,345	16,596,053	1,723,571	3,298,171
9,841,345	16,596,053	1,723,571	3,298,171
9,642,653	16,263,683	1,547,018	2,948,270
198,692	332,370	176,553	349,901
1,419	2,394	228	434
1,419	2,394	228	434
	9,841,345 9,642,653 198,692 1,419	9,841,345 16,596,053 9,642,653 16,263,683 198,692 332,370 1,419 2,394	9,841,345 16,596,053 1,723,571 9,642,653 16,263,683 1,547,018 198,692 332,370 176,553 1,419 2,394 228

2-3. 연결 포괄손익계산서 연결 포괄손익계산서

제 56 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지 제 55 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지

(단위:백만원)

	제 56 기 반기		제 55 기 반기	
	3개월	누적	3개월	누적
반기순이익	9,841,345	16,596,053	1,723,571	3,298,171
기타포괄손익	4,289,382	9,284,334	(83,744)	5,895,756
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	730,718	1,147,136	364,891	1,143,636
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (주17)	766,674	1,278,153	475,009	1,471,490
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 (주17)	(7,498)	(20,316)	(7,191)	22,697
순확정급여부채(자산) 재측정요소 (주17)	(28,458)	(110,701)	(102,927)	(350,551)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	3,558,664	8,137,198	(448,635)	4,752,120
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 (주17)	79,547	132,174	(50,332)	85,428
해외사업장환산외환차이 (주17)	3,516,464	8,031,444	(403,003)	4,653,884
현금흐름위험회피파생상품평가손익 (주17)	(37,347)	(26,420)	4,700	12,808
반기총포괄손익	14,130,727	25,880,387	1,639,827	9,193,927
포괄손익의 귀속				
지배기업 소유주지분	13,806,646	25,340,917	1,474,638	8,761,401
비지배지분	324,081	539,470	165,189	432,526

2-4. 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 56 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지 제 55 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지

	자본	본					
	지배기업 소유주지분						
	자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업 소유주	비지배지분	자본 합계
	V.C.0	十つ 2 8 全 4 6	0148046		지분 합계		
2023.01.01 (기초자본)	897,514	4,403,893	337,946,407	1,938,328	345,186,142	9,563,462	354,749,604
반기순이익	0	0	2,948,270	0	2,948,270	349,901	3,298,171
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (주17)	0	0	2,321,108	(897,106)	1,424,002	47,488	1,471,490
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 (주17)	0	0	0	104,471	104,471	3,654	108,125

해외사업장환산외환차이 (주17)	0	0	0	4,622,266	4,622,266	31,618	4,653,884
순확정급여부채(자산) 재측정요소 (주17)	0	0	0	(350,415)	(350,415)	(136)	(350,551)
현금흐름위험회피파생상품평가손익 (주17)	0	0	0	12,807	12,807	1	12,808
배당	0	0	(4,905,130)	0	(4,905,130)	(61,116)	(4,966,246)
연결실체내 자본거래 등	0	0	0	0	0	(825)	(825)
연결실체의 변동							
기타	0	0	0	0	0	(834)	(834)
2023.06.30 (기말자본)	897,514	4,403,893	338,310,655	5,430,351	349,042,413	9,933,213	358,975,626
2024.01.01 (기초자본)	897,514	4,403,893	346,652,238	1,280,130	353,233,775	10,444,090	363,677,865
반기순이익	0	0	16,263,683	0	16,263,683	332,370	16,596,053
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (주17)	0	0	25,011	1,113,660	1,138,671	139,482	1,278,153
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 (주17)	0	0	0	118,196	118,196	(6,338)	111,858
해외사업장환산외환차이 (주17)	0	0	0	7,958,021	7,958,021	73,423	8,031,444
순확정급여부채(자산) 재측정요소 (주17)	0	0	0	(111,234)	(111,234)	533	(110,701)
현금흐름위험회피파생상품평가손익 (주17)	0	0	0	(26,420)	(26,420)	0	(26,420)
배당	0	0	(4,905,130)	0	(4,905,130)	(1,083,758)	(5,988,888)
연결실체내 자본거래 등	0	0	0	0	0	(4,489)	(4,489)
연결실체의 변동	0	0	0	0	0	(38,204)	(38,204)
기타							
2024.06.30 (기말자본)	897,514	4,403,893	358,035,802	10,332,353	373,669,562	9,857,109	383,526,671

2-5. 연결 현금흐름표 연결 현금흐름표

제 56 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지 제 55 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지

(단위:백만원)

	제 56 기 반기	제 55 기 반기
영업활동현금흐름	28,761,716	14,461,689
영업에서 창출된 현금흐름	31,136,167	16,982,831
반기순이익	16,596,053	3,298,171
조정 (주24)	18,787,796	21,958,025
영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (주24)	(4,247,682)	(8,273,365)
이자의 수취	1,884,668	2,429,443
이자의 지급	(321,567)	(441,850)
배당금 수입	199,143	52,618
법인세 납부액	(4,136,695)	(4,561,353)
투자활동현금흐름	(48,130,985)	21,022,564
단기금융상품의 순감소(증가)	(26,295,541)	43,879,546
단기상각후원가금융자산의 순감소(증가)	620,858	416,095
단기당기손익-공정가치금융자산의 순감소(증가)	(2,629)	3,770
장기금융상품의 처분	4,100,008	4,491,705
장기금융상품의 취득	(129,053)	(534)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분	176,068	3,750,752
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득	(131,218)	(20,013)
당기손익-공정가치금융자산의 처분	185,029	38,818

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(30,459)	(69,368)
관계기업 및 공동기업 투자의 처분	18,965	17,839
관계기업 및 공동기업 투자의 취득	(9,342)	(65,182)
유형자산의 처분	46,452	67,844
유형자산의 취득	(25,362,271)	(29,373,990)
무형자산의 처분	15,869	11,253
무형자산의 취득	(1,382,199)	(1,620,300)
매각예정분류자산 처분으로 인한 현금유입액	101,563	0
기타투자활동으로 인한 현금유출입액	(53,085)	(505,671)
재무활동현금흐름	(2,837,616)	(6,760,720)
단기차입금의 순증가(감소)	3,499,218	(1,503,980)
장기차입금의 차입	336,764	193,279
사채 및 장기차입금의 상환	(693,360)	(543,400)
배당금의지급	(5,975,749)	(4,905,792)
비지배지분의 증감	(4,489)	(827)
외화환산으로 인한 현금의 변동	2,970,397	1,515,532
현금및현금성자산의 증가(감소)	(19,236,488)	30,239,065
기초현금및현금성자산	69,080,893	49,680,710
기말현금및현금성자산	49,844,405	79,919,775

3. 연결재무제표 주석

1. 일반적 사항 (연결)

가. 연결회사의 개요

삼성전자주식회사(이하 "회사")는 1969년 대한민국에서 설립되어 1975년에 대한민국의 증권거래소에 상장하였습니다. 회사 및 종속기업(이하 삼성전자주식회사와 그 종속기업을 일괄하여 "연결회사")의 사업은 DX 부문, DS 부문, SDC, Harman으로 구성되어 있습니다. DX(Device eXperience) 부문은 TV, 냉장고, 스마트폰, 네트워크시스템 등의 사업으로 구성되어 있으며, DS(Device Solutions) 부문은 메모리, Foundry, System LSI 등으로 구성되어 있습니다. SDC는 디스플레이 패널 사업을 영위하며, Harman은 전장부품사업 등을 영위하고 있습니다. 회사의 본점 소재지는 경기도 수원시입니다.

기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배회사인 회사는 삼성디스플레이㈜ 및 Samsung Electronics America, Inc. (SEA) 등 226개의 종속기업을 연결대상으로 하고, 삼성전기㈜ 등 37개 관계기업과 공동기업을 지분법적용대상으로 하여 연결재무제표를 작성하였습니다.

나. 종속기업 현황

당반기말 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
	Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	전자제품 판매	100.0
미주	Samsung International, Inc. (SII)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Mexicana S.A. de C.V (SAMEX)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Home Appliances America, LLC (SEHA)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Research America, Inc (SRA)	R&D	100.0

SAMSUNG NEXT LLC (SNX)	해외자회사 관리	100.0
SAMSUNG NEXT FUND LLC (SNXF)	신기술사업자, 벤처기업 투자	100.0
NeuroLogica Corp.	의료기기 생산 및 판매	100.0
Samsung HVAC America, LLC	에어컨공조 판매	100.0
Joyent, Inc.	클라우드서비스	100.0
SmartThings, Inc.	스마트홈 플랫폼	100.0
TeleWorld Solutions, Inc. (TWS)	네트워크장비 설치 및 최적화	100.0
Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	반도체ㆍ디스플레이 패널 판매	100.0
Samsung Federal, Inc. (SFI)	R&D	100.0
Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	반도체 생산	100.0
Samsung Oak Holdings, Inc. (SHI)	해외자회사 관리	100.0
SEMES America, Inc.	반도체 장비 서비스	100.0
Samsung Display America Holdings, Inc. (SDAH)	해외자회사 관리	100.0
eMagin Corporation	디스플레이 패널 개발 및 생산	100.0
Samsung Electronics Canada, Inc. (SECA)	전자제품 판매	100.0
AdGear Technologies Inc.	디지털광고 플랫폼	100.0

지역	기업명	업종	지분율
N S	768	100	(%)(*)
	Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Digital Appliance Mexico, SA de CV	가전제품 생산	100.0
	(SEDAM)		
	Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A. (SELA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Latinoamerica Miami, Inc. (SEMI)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronica Colombia S.A. (SAMCOL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Argentina S.A. (SEASA)	마케팅 및 서비스	100.0
	Samsung Electronics Chile Limitada (SECH)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Peru S.A.C. (SEPR)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Venezuela, C.A. (SEVEN)	마케팅 및 서비스	100.0
	Samsung Electronics Panama. S.A. (SEPA)	컨설팅	100.0
미주	Harman International Industries, Inc.	해외자회사 관리	100.0
UI T	Harman Becker Automotive Systems, Inc.	오디오제품 생산, 판매, R&D	100.0
	Harman Connected Services, Inc.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services Engineering Corp.	Connected Service Provider	100.0
	Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	오디오제품 생산, 판매	100.0
	Harman de Mexico, S. de R.L. de C.V.	오디오제품 생산	100.0
	Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman International Industries Canada Ltd.	오디오제품 판매	100.0
	Harman International Mexico, S. de R.L. de C.V.	오디오제품 판매	100.0
	Harman KG Holding, LLC	해외자회사 관리	100.0
	Harman Professional, Inc.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Roon Labs, LLC.	오디오제품 판매	100.0
	Beijing Integrated Circuit Industry International Fund, L.P	벤처기업 투자	61.4
	China Materialia New Materials 2016 Limited Partnership	벤처기업 투자	99.0

TICH	JOHN	OL Z	지분율
지역	기업명	업종	(%)(*)

	Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Ltd. (SEL)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Semiconductor Europe Limited (SSEL)	반도체ㆍ디스플레이 패널 판매	100.0
	Samsung Electronics GmbH (SEG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Holding GmbH (SEHG)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Semiconductor Europe GmbH (SSEG)	반도체ㆍ디스플레이 패널 판매	100.0
	Samsung Electronics France S.A.S (SEF)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Italia S.P.A. (SEI)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Iberia, S.A. (SESA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Portuguesa, Unipessoal, Lda. (SEP)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd. (SEH)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	물류	100.0
	Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Electronics Nordic Aktiebolag (SENA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Slovakia s.r.o (SESK)	TV·모니터 생산	100.0
	Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o (SEPOL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Zo.o (SEPM)	가전제품 생산	100.0
유럽·	Samsung Electronics Romania LLC (SEROM)	전자제품 판매	100.0
CIS	Samsung Electronics Austria GmbH (SEAG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Switzerland GmbH (SESG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o. (SECZ)	전자제품 판매	100.0
	SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS SIA (SEB)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Greece S.M.S.A (SEGR)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. (SEACE)	에어컨공조 판매	100.0
	Samsung Nanoradio Design Center (SNDC)	R&D	100.0
	Samsung Denmark Research Center ApS (SDRC)	R&D	100.0
	Samsung Cambridge Solution Centre Limited (SCSC)	R&D	100.0
	SAMSUNG Zhilabs, S.L.	네트워크Solution 개발, 판매	100.0
	FOODIENT LTD.	R&D	100.0
	Samsung Electronics Rus Company LLC (SERC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Rus Kaluga LLC (SERK)	TV 생산	100.0
	Samsung Electronics Ukraine Company LLC (SEUC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung R&D Institute Ukraine (SRUKR)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Central Eurasia LLP (SECE)	전자제품 판매	100.0
	Samsung R&D Institute Rus LLC (SRR)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Caucasus Co. Ltd (SECC)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Uzbekistan Ltd. (SEUZ)	마케팅	100.0

TIG	21010	OL 조	지분율
지역	기업명	업종	(%)(*)
	AKG Acoustics Gmbh	오디오제품 생산, 판매	100.0
	Apostera UA, LLC	Connected Service Provider	100.0
	Harman Audio Iberia Espana Sociedad Limitada	오디오제품 판매	100.0
유럽·	Harman Becker Automotive Systems GmbH	오디오제품 생산, 판매, R&D	100.0
CIS	Harman Becker Automotive Systems Italy S.R.L.	r Automotive Systems Italy S.R.L. 오디오제품 판매	
	Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	오디오제품 생산, R&D	100.0
	Harman Belgium SA	오디오제품 판매	100.0
	Harman Connected Services AB.	Connected Service Provider	100.0

Harman Finland Oy	Connected Service Provider	100.0
Harman Connected Services GmbH	Connected Service Provider	100.0
Harman Connected Services Poland Sp.zoo	Connected Service Provider	100.0
Harman Connected Services UK Ltd.	Connected Service Provider	100.0
Harman Consumer Nederland B.V.	오디오제품 판매	100.0
Harman Deutschland GmbH	오디오제품 판매	100.0
Harman France SNC	오디오제품 판매	100.0
Harman Holding Gmbh & Co. KG	Management Company	100.0
Harman Hungary Financing Ltd.	Financing Company	100.0
Harman Inc. & Co. KG	해외자회사 관리	100.0
Harman International Estonia OU	R&D	100.0
Harman International Industries Limited	오디오제품 판매, R&D	100.0
Harman International Romania SRL	R&D	100.0
Harman Management Gmbh	해외자회사 관리	100.0
Harman Professional Kft	오디오제품 생산, R&D	100.0
Harman Professional Denmark ApS	오디오제품 판매, R&D	100.0
Red Bend Software SAS	소프트웨어 디자인	100.0
Studer Professional Audio GmbH	오디오제품 판매, R&D	100.0
Harman Connected Services OOO	Connected Service Provider	100.0
Harman RUS CIS LLC	오디오제품 판매	100.0

TIC	31040	OL T	지분율
지역	기업명	업종	(%)(*)
	Samsung Gulf Electronics Co., Ltd. (SGE)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Turkiye (SETK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Industry and Commerce Ltd. (SETK-P)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Levant Co., Ltd. (SELV)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Maghreb Arab (SEMAG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Egypt S.A.E (SEEG)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Israel Ltd. (SEIL)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L (SETN)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Pakistan(Private) Ltd. (SEPAK)	마케팅	100.0
중동•	Samsung Electronics Saudi Arabia Ltd. (SESAR)	전자제품 판매	100.0
아프리카	Samsung Semiconductor Israel R&D Center, Ltd. (SIRC)	R&D	100.0
	Corephotonics Ltd.	R&D	100.0
	Samsung Electronics South Africa(Pty) Ltd. (SSA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics South Africa Production (pty) Ltd. (SSAP)	TV·모니터 생산	100.0
	Samsung Electronics West Africa Ltd. (SEWA)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics East Africa Ltd. (SEEA)	마케팅	100.0
	Global Symphony Technology Group Private Ltd.	해외자회사 관리	100.0
	Harman Connected Services Morocco	Connected Service Provider	100.0
	Harman Industries Holdings Mauritius Ltd.	해외자회사 관리	100.0
	Red Bend Ltd.	오디오제품 생산	100.0

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
아시아	Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	해외자회사 관리	100.0
(중국	Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd. (SESP)	전자제품 판매	100.0

Samsung Malaysia Electronics (SME) Sdn. Bhd. (SME)	전자제품 판매	100.0
Samsung Electronics Display (M) Sdn. Bhd. (SDMA)	전자제품 생산	100.0
Samsung Electronics (M) Sdn. Bhd. (SEMA)	가전제품 생산	100.0
Samsung Vina Electronics Co., Ltd. (SAVINA)	전자제품 판매	100.0
Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	전자제품 생산	100.0
Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	통신제품 생산	100.0
Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	전자제품 생산 및 판매	100.0
Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	디스플레이 패널 생산	100.0
PT Samsung Electronics Indonesia (SEIN)	전자제품 생산 및 판매	100.0
PT Samsung Telecommunications Indonesia (STIN)	전자제품 판매 및 서비스	100.0
Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	전자제품 생산 및 판매	91.8
Laos Samsung Electronics Sole Co., Ltd (LSE)	마케팅	100.0
Samsung Electronics Philippines Corporation (SEPCO)	전자제품 판매	100.0
Samsung Electronics Australia Pty. Ltd. (SEAU)	전자제품 판매	100.0
Samsung Electronics New Zealand Limited (SENZ)	전자제품 판매	100.0
Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	전자제품 생산 및 판매	100.0
Red Brick Lane Marketing Solutions Pvt. Ltd.	마케팅	100.0
Samsung Display Noida Private Limited (SDN)	디스플레이 패널 생산	100.0
Samsung R&D Institute India-Bangalore Private Limited	R&D	100.0
(SRI-Bangalore)	Hau	100.0
Samsung R&D Institute BanglaDesh Limited (SRBD)	R&D	100.0
Samsung Nepal Services Pvt, Ltd (SNSL)	서비스	100.0
Samsung Japan Corporation (SJC)	반도체ㆍ디스플레이 패널 판매	100.0
Samsung R&D Institute Japan Co. Ltd. (SRJ)	R&D	100.0
Samsung Electronics Japan Co., Ltd. (SEJ)	전자제품 판매	100.0
Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd.	Connected Service Provider	100.0
Harman International (India) Private Limited	오디오제품 판매, R&D	100.0
Harman International Industries PTY Ltd.	해외자회사 관리	100.0
Harman International (Thailand) Co., Ltd.	오디오제품 생산, 판매	100.0
Harman International Japan Co., Ltd.	오디오제품 판매, R&D	100.0
Harman Singapore Pte. Ltd.	오디오제품 판매	100.0
I		L

지역	21010	업종	지분율
시작	기업명	1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(%)(*)
	Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd. (SEHK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET)	전자제품 판매	100.0
	Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd. (TSEC)	TV · 모니터 생산	91.2
	Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd. (SSEC)	가전제품 생산	88.3
	Samsung Suzhou Electronics Export Co., Ltd. (SSEC-E)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd. (SESC)	R&D	100.0
중국	Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (TSTC)	통신제품 생산	90.0
	Beijing Samsung Telecom R&D Center (SRC-Beijing)	R&D	100.0
	Samsung Electronics China R&D Center (SRC-Nanjing)	R&D	100.0
	Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou	000	100.0
	(SRC-Guangzhou)	R&D	100.0
	Samsung R&D Institute China-Shenzhen (SRC-Shenzhen)	R&D	100.0
	Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	반도체ㆍ디스플레이 패널 판매	100.0

Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	반도체 생산	100.0
Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd. (SSCX)	반도체ㆍ디스플레이 패널 판매	100.0
Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd. (SESS)	반도체 임가공	100.0
Tianjin Samsung LED Co., Ltd. (TSLED)	LED 생산	100.0
Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd. (SSCR)	R&D	100.0
Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD)	디스플레이 패널 생산	100.0
Samsung Display Tianjin Co., Ltd. (SDT)	디스플레이 패널 생산	95.0
SEMES (XIAN) Co., Ltd.	반도체·FPD 장비 서비스	100.0
Samsung Semiconductor Investment L.P. I	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
Harman (China) Technologies Co., Ltd.	오디오제품 생산	100.0
Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems Co., Ltd.	오디오제품 판매	100.0
Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd.	오디오제품 생산, R&D	100.0
Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd.	오디오제품 판매	100.0
Harman Connected Services Solutions (Chengdu) Co., Ltd.	Connected Service Provider	100.0
Harman Holding Limited	오디오제품 판매	100.0
Harman International (China) Holdings Co., Ltd.	오디오제품 판매, R&D	100.0
Harman Technology (Shenzhen) Co., Ltd.	오디오제품 판매, R&D	100.0

T. 0.	NO C	0.17	지분율
지역	기업명	업종	(%)(*)
	삼성디스플레이㈜	디스플레이 패널 생산 및 판매	84.8
	에스유머티리얼스㈜	디스플레이 패널 부품 생산	50.0
	스테코㈜	반도체 부품 생산	70.0
	세메스㈜	반도체 • FPD 장비 생산, 판매	91.5
	삼성전자서비스㈜	전자제품 수리 서비스	99.3
	삼성전자서비스씨에스㈜	고객상담서비스	100.0
	삼성전자판매㈜	전자제품 판매	100.0
	삼성전자로지텍㈜	종합물류대행	100.0
	삼성메디슨㈜	의료기기 생산 및 판매	68.5
	㈜희망별숲	식품 제조 가공	100.0
	㈜미래로시스템	반도체 소프트웨어 개발 및 공급	99.9
	㈜하만인터내셔널코리아	소프트웨어 개발 및 공급	100.0
	SVIC 21호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 22호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
국내	SVIC 26호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 28호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 29호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 32호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	
	SVIC 33호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 37호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 40호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 42호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 43호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 45호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 52호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 55호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 56호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 57호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 62호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0

	반도체성장 전문투자형 사모 투자신탁	반도체산업 투자	66.7
	시스템반도체 상생 전문투자형 사모 투자신탁	반도체산업 투자	62.5
	반도체 생태계 일반 사모 투자신탁	반도체산업 투자	66.7

^(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

다. 당반기 및 전기의 주요 연결대상 종속기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.

(1) 당반기

	당반기말		당반기			
기업명(*1)			3개월		누 적	
	자산	부채	매출액	분기순이익	매출액	반기순이익
삼성디스플레이㈜	62,704,147	7,140,090	6,659,416	1,247,039	11,076,185	3,235,781
Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	46,575,075	17,470,901	9,258,155	13,281	20,060,311	333,976
Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	28,774,139	314,506	-	347,682	-	4,615,718
Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	22,565,941	12,687,683	1,126,761	118,704	2,174,154	256,455
Harman과 그 종속기업(*2)	19,279,412	6,245,351	3,610,314	222,058	6,798,739	403,492
Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd.						
(SCS)	17,266,621	880,604	2,958,754	366,322	6,021,423	644,438
Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	16,180,890	8,949,907	10,840,038	129,864	17,726,774	201,202
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.				(15)		
(SCIC)	13,415,739	12,878,393	615,345	(45,111)	1,439,698	11,616
Samsung Electronics Vietnam						
THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	11,805,327	3,220,541	7,453,338	563,088	18,488,988	1,518,320
Samsung India Electronics Private Ltd.						
(SIEL)	8,882,136	3,412,625	4,428,545	274,906	8,902,510	760,005
Samsung Electronics Europe Holding						
Cooperatief U.A. (SEEH)	8,615,408	3,201,747	_	46,942	_	121,277
Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd.						
(SEV)	7,786,353	2,881,368	5,267,889	522,739	10,950,270	927,552
Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	7,508,214	2,522,498	5,529,521	211,865	9,109,742	379,724
Shanghai Samsung Semiconductor Co.,						
Ltd. (SSS)	7,426,792	6,874,774	8,632,773	119,339	15,877,961	232,228
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda.						
(SEDA)	5,047,383	1,652,704	2,053,934	61,806	4,181,008	213,082
Samsung Electronics HCMC CE Complex						
Co., Ltd. (SEHC)	4,482,413	917,382	1,782,722	59,062	3,468,330	114,139
Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	2,971,962	1,969,743	1,392,604	(29,123)	3,055,309	15,459
Samsung Electronics Europe Logistics B.V.	0.700.004	1 007 001	4 0 44 000	070.040	0.550.540	700.000
(SELS)	2,766,924	1,807,201	4,241,830	272,349	8,552,516	738,262
Samsung International, Inc. (SII)	2,722,724	754,830	1,981,732	216,043	3,639,536	360,842
Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	2,369,807	619,525	1,107,584	1,442	2,353,788	31,929
세메스㈜	2,225,131	620,360	669,179	40,077	1,245,234	77,044
Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd.	0.004.700			7.005	0 000 505	50.040
(SET)	2,224,736	1,494,356	1,400,362	7,395	2,893,505	59,848
Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V.	0.440.045	1 010 757	1 000 055	(4.4.005)	0.404.765	00.475
(SEM)	2,143,918	1,013,797	1,090,802	(14,602)	2,184,702	26,176
Samsung Electronics GmbH (SEG)	2,093,728	2,084,945	1,507,625	(83,026)	3,311,558	(58,863)

Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	1,873,216	715,850	662,554	(38,487)	1,510,062	31,517

^(*1) 상기 요약 재무정보는 각 종속기업의 별도재무제표 기준입니다.

(2) 전기

	전기말		전반기			
기업명(*1)			3개월		누 적	
2183(1)	자산	부채	매출액	분기순이익	' ' 매출액	반기순이익
삼성디스플레이㈜	65,328,568	7,266,213	5,444,771	871,621	11,035,413	2,404,779
Samsung Electronics America, Inc. (SEA)		15,322,780	9,157,280		19,977,552	294,772
Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	22,234,942	282,614	_	333,661	-	6,966,849
Harman과 그 종속기업(*2)	17,956,557	6,009,675	3,488,999	205,076	6,651,475	285,899
Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	16,714,945	7,791,914	1,136,235	148,327	2,091,445	252,445
Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd.	15,808,283	870,453	2,440,992	203,913	5,011,167	530,735
(SCS)		-		·		
Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	12,796,440	6,276,293	5,113,436	55,475	10,076,971	182,461
Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	12,554,481	3,593,527	6,729,383	870,408	15,346,957	1,166,442
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	10,222,557	8,797,991	702,653	12,754	1,574,264	177,969
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	9,660,481	4,585,806	_	23,610	_	32,085
Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	7,738,259	3,373,730	3,499,445	235,083	7,313,363	568,363
Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	7,383,485	1,570,459	5,025,494	120,439	10,213,581	570,535
Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd.	7,301,860	2,215,062	4,337,615	447,372	10,033,911	910,213
(SEV) Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	5,542,627	1,587,911	1,738,745	32,413	3,654,447	164,645
Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	5,262,086	4,552,030	3,669,230	50,856	6,589,203	114,934
Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	4,043,677	843,736	1,598,461	153,715	3,095,852	352,241
Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	3,039,379	640,512	1,183,524	96,887	2,402,275	185,939
Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	2,902,722	1,976,067	1,323,540	14	2,850,876	72,364
세메스㈜	2,187,919	659,607	683,383	58,675	1,409,736	82,958
Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM)	2,153,032	1,038,115	909,620	23,765	1,752,163	83,052
Samsung Electronics GmbH (SEG)	2,097,706	2,033,152	1,407,255	(5,306)	3,049,199	54,982
Samsung International, Inc. (SII)	1,879,442	383,763	1,912,341	403,181	3,668,330	768,771
Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd.	1,797,627	1,139,056	933,647	(746)	1,879,459	1,453
(SET) Sameung Floctropics Bandlux B.V. (SEBN)	1 704 550	630 120	630 222	26 155	1 462 029	120 670
Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN) Samsung Electronics Europe Logistics B.V.	1,794,552	1,443,005	630,333 3,802,880	26,455 42,336	1,462,038 8,045,329	132,672 226,763

^(*1) 상기 요약 재무정보는 각 종속기업의 별도재무제표 기준입니다.

^(*2) Harman International Industries, Inc. 및 그 종속기업이 포함된 중간지배기업의 연결재무정보입니다.

^(*2) Harman International Industries, Inc. 및 그 종속기업이 포함된 중간지배기업의 연결재무정보입니다.

라. 연결대상범위의 변동

당반기 중 연결재무제표 작성대상범위의 변동 내용은 다음과 같습니다.

구분	지역	기업명	사유
신규연결	아시아(중국제외)	Harman International (Thailand) Co., Ltd.	설립
	미주	Harman Financial Group LLC	청산
	유럽 · CIS	Samsung Display Slovakia, s.r.o., v likvidacii (SDSK)	청산
	#g.CI2	Samsung Electronics Overseas B.V. (SEO)	청산
연결제외	아시아(중국제외)	DOWOOINSYS VINA COMPANY LIMITED	매각
		㈜도우인시스	매각
	국내	지에프㈜	매각
		SVIC 48호 신기술투자조합	청산

2. 중요한 회계처리방침 (연결)

2.1. 재무제표 작성기준

연결회사의 2024년 6월 30일로 종료하는 6개월 보고기간에 대한 반기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 반기연결재무제표는 보고기간종료일인 2024년 6월 30일 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

가. 연결회사가 채택한 제 · 개정 기준서

연결회사는 2024년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 주요 제·개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.

- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정

보고기간종료일 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 부채가 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 중간연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정

기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하여 판매로 회계처리 되는 판매후리스에 대하여 후속측정 요구사항을 추가하였습니다. 동 개정사항은 리스개시일 후에 판매자-리스이용자가 계속 보유하는 사용권에 대해서는 판매자-리스이용자가 어떠한 차손익도 인식하지 않는 방식으로 '리스료'나 '수정 리스료'를 산정하도록 요구합니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 중간연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표' 및 제1107호 '금융상품 공시' 개정

동 개정사항은 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표'의 공시 목적에 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 한다는 점을 추가합니다. 또한 기업회계기준서 제1107호 '금융상품 공시'를 개정하여 유동성위험 집중도에 대한 익스포저와 관련한 정보를 공시하도록 하는 요구사항의 예로 공급자금융약정을 추가하였습니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 중간연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

나. 연결회사가 적용하지 않은 제 • 개정 기준서

제정 또는 공표됐으나 2024년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 않았고, 연결회사가 조기 적용하지 않은 주요 제·개정 기준서는 다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과' 개정

외환시장이 정상적으로 작동하지 않을 때 기능통화에 의한 외화거래 보고와 해외사업장의 기능통화를 지배기업의 표시통화로 환산하는 규정을 명확히 하기 위해 두 통화간 교환가능성을 평가하는 규정을 추가합니다. 또한, 두 통화간 교환이 가능한지를 평가하여 교환가능성이 결여되었다고 판단한경우, 적용할 현물환율을 추정하는 규정을 추가하였습니다. 동 개정사항은 2025년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기 적용할 수 있습니다.

2.2. 회계정책

반기연결재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책과 계산방법은 주석 2.1에서 설명하는 제·개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 2023년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해 글로벌최저한세를 고려하여 추정한 가중평균연간 법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

2.3. 중요한 회계추정 및 가정

반기연결재무제표 작성시 연결회사의 경영진은 회계정책의 적용과 보고되는 자산・부채의 장부금액 및 이익・비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.

반기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 2023년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

3. 범주별 금융상품 (연결)

급용자산의 범주병 공시

(단위:백만8

	긍용자산, 병주							
	상각후원가 측정 금융자산		기타포理손익-공정가치 측정 금융자산		당기손익-공정가치측정 긍륭자산		기타긍용자산	
Ī	공용자산, 문류	금융자	금용자산, 문류	금융자	금융자산, 문류	금융자	금융자산, 분류	금융자

			단기상	단기당		기타포	당기손					단기상	단기당		기타포	당기손					단기상	단기당		기타포	당기손					단기상	단기당		기타포	당기손		
	변급및			기손익	明泰林		익=꽁		산. 분	흥리맞			기손익		괄손역	익=꽁		산. 분				기손역		골손익	이-R		산. 문				기손익	매출채	관선	어-핑		산. 문
	현금성			-공정			정가치	기타	11 80	현금성			-공정	매출채	-광정	정가치	기타	# 80	현금성			-광정	매출채	-공정	정가치	기타	111	현금성			-공정			정가치	기타	# 80
	자산		가금융	가치금	퀀	가치금	금융자		Я	자산	용상품		가치금	퀀	가치금	금융자		Я	자산		가금융	가치금	권	가치금	금융자		Я	자산	용상품		가치금	권	가치금	금융자		Я
			자산	용자산		용자산	či.					자산	용자산		용자산	산					자산	용자산		용자산	산					자산	음자산		용자산	산		
									154,2																											
금융자	49,84	50,92	0	0	43,66	0	0	9,824,	51,29	0	0	0	0	0	9,202,	0	0	9,202,	0	0	0	29,75	0	0	1,360,	448,6	1,838,	0	0	0	0	0	0	0	44,80	44,80
산	4,405	1,350			0,885			650	0						104			104				8			016	68	442								9	9
									U																							ш				

전기원 (대학: 백인당

	금융자신	, 병주																																		
	상각후원	가 측정 등	응하산							기타포공	re의-공경	엄가치 측정	경 금융자신	ŧ					당기손익	-공정가#	비촉정 급원	하자산						기타금원	자산							
	금융자신	. E#								금융자신	ł. E#								금융자신	. E#								금융자신	. E#							
			단기상	단기당		기타포	당기손		금융자			단기상	단기당		기타포	당기손		금융자			단기상	단기당		기타포	당기손		금융자			단기상	단기당		기타포	당기손		금융자
	현급및			기손익			익=꽁		산. 분	현금및			기손익			익=꽁		산. 문				기손익	매출채	팔손익	어-핑		산. 문	현급및			기손익	매출채	골손익	약=평		산. 문
	현금성			-공정			정가치	기타	# 80	현금성			-공정			정가치	기타	# 80	현금성			-공정			정가치	기타	# 85	현금성			-공정			정가치	기타	# 8t
	자산					가치금	금융자		Я	자산			가치금		가치금	금융자		Я	자산			가치금		가치금	금융자		Я	자산			가치금		가치금	금융자		Я
				용자산		용자산	산					l	용자산		용자산	산						용자산		용자산	산						용자산		용자산	산		
금융자	69,08	22,69	608,2	0	36,64	0		14,29	143,3		۰			0	7,481,	۰		7,481,	0	0		27,11	۰		1,431,	475,2	1,933,	۰							70,77	70,77
산	0,893	0,924	81	0	7,393	0		4,254	l		0		0		297			297	0	0	0	2		0	394	44	750	0	0	0	0		0	0	7	7

금융자산의 범주별 공시, 합계

당반기말 (단위:백만원)

	현금및현금성자산	단기금융상품	단기상각후원가금융		매출채권	기타포괄손익-공정	당기손익-공정가치	기타	금융자산, 분류 합
			자산	가치금융자산		가치금융자산	금융자산		Я
금융자산	49,844,405	50,921,350	0	29,758	43,660,885	9,202,104	1,360,016	10,318,127	165,336,645

전기말 (단위:백만원)

	현금및현금성자산	단기금융상품	단기상각후원가금융		매출채권	기타포괄손익-공정	당기손익-공정가치	기타	금융자산, 분류 합
	20%20846	27688E	자산	가치금융자산		가치금융자산	금융자산	ЛU	계
금융자산	69,080,893	22,690,924	608,281	27,112	36,647,393	7,481,297	1,431,394	14,840,275	152,807,569

당기 및 전기 기타금융자산에 대한 각주

기타금융자산은 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

금융부채의 범주별 공시

당한기원 (단위 : 박건물)

	금융부채, 병	경주																									
	상각후뭔가	측정 금융부:	я							당기손익-공	공정가치측정:	금융부채							기타금융부:	ij.							
	금융부채. 등	Z#							금융부채.	금융부채, 등	E#							금융부채.	금융부채, 등	===							금융부채.
	매임채무	단기차임	단기미지	유동성장	사채		장기미지	기타		매임채무	단기차임		유통성장 기부채	사채		장기미지	기타		매임채무	단기차임		유동성장	사재	장기차임		기타	E # 80
	13,113,2		13,131,7	1,070,94			4,812,13	12,242,1	利 44,641,7									Я		10,375,6		1,043,88		3,719,38			78 15,169,6
금융부채	67	250,948	06	7	20,573	0	2	63	36	0	0	0	0	0	0	0	41,625	41,625	0	44	0	6	0	6	0	30,708	24

경기암

	금융부채, 병	경주																									
	상각후뭔가	측정 긍융부치	H							당기손익	명정가치측정:	금융부채							기타금융부	ij							
	금융부채, 등	문류							긍융부채.	긍융부채.	문류							금융부채,	금융부채, 등	===							긍융부채.
	매임채무	단기차임	단기미지	유통성장	사채	장기차임	장기미지	ЛE	문류 항	매임채무	단기차임	단기미지	유동성장	사채	장기차임	장기미지	ЛEI	문류 참	매임채무	단기차임	단기미지	유동성장	사재	장기차임		기타	E # 80
		10	킁킁	기부채		₽	공공		Я		₽	공공	기부채		₽	콩콩		Я		ΠĐ	큥킁	기부채		ПО	큥큥		Я
금융부채	11,319,8	504,552	13,996,3	310,436	537,618	0	4,907,87	11,330,5	42,907,2	0	0	0	0	0	0	0	49,904	49,904	0	6,610,04	0	998,439	0	3,724,85	0	33,559	11,366,8

금융부채의 범주별 공시, 합계

당반기말 (단위: 백만원)

	매입채무	단기차입금	단기미지급금	유동성장기부채	사채	장기차입금	장기미지급금	기타	금융부채, 분류 합
									Л
금융부채	13,113,267	10,626,592	13,131,706	2,114,833	20,573	3,719,386	4,812,132	12,314,496	59,852,985

전기말 (단위: 백만원)

									금융부채, 분류 합
	매입채무	단기차입금	단기미지급금	유동성장기부채	사채	장기차입금	장기미지급금	기타	Л
금융부채	11,319,824	7,114,601	13,996,395	1,308,875	537,618	3,724,850	4,907,875	11,414,008	54,324,046

당기 및 전기 기타금융부채에 대한 각주

기타금융부채는 담보부차입금과 위험회피수단인 파생상품, 기업회계기준서 제1109호의 금융부채의 범주로 분류되지 않는 리스부채 등을 포함하고 있습니다.

4. 공정가치금융자산 (연결)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 구성내역

당반기말 (단위: 백만원)

	금융자산, 범주
	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
	지분상품
기타포괄손익-공정가치금융자산	9,202,104

전기말 (단위: 백만원)

	금융자산, 범주
	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
	지분상품
기타포괄손익-공정가치금융자산	7,481,297

당기손익-공정가치측정금융자산의 공시

당반기말 (단위: 백만원)

	금융자산, 범주		
	당기손익인식금융자산	금융자산, 범주 합계	
	채무상품	지분상품	
유동 당기손익인식금융 자산	29,758		29,758
비유동 당기손익인식금 융자산	670,911	689,105	1,360,016

당기손익인식금융자산		1 200 774
합계		1,389,774

전기말 (단위: 백만원)

	금융자산, 범주		
	당기손익인식금융자산	금융자산, 범주 합계	
	채무상품	지분상품	
유동 당기손익인식금융 자산	27,112		27,112
비유동 당기손익인식금 융자산	619,036	812,358	1,431,394
당기손익인식금융자산 합계			1,458,506

공정가치금융자산 중 상장주식 세부내역에 대한 공시

당반기발

당반기말																		(단위 : 벽만원)
	긍용자산, 문류	급용자신: 문류																
	공경기치로 측정하는 공령자산																	
	상장주식																	
	삼성종공업㈜		예호텔신라		例아이마켓코리아		㈜원익홀딩스		㈜원익아이피에스	:	Wacom Co., Ltd.		Corning Incorpor	ated	기타		함계	
	측정 전체																	
		장부금액(시장		장부금액(시장		장부금액(시장		장부금액(시장		장부금액(시장		장부금액(시장		장부금액(시장		장부금액(시장		장부금액(시장
	총장부금역	가치)	총장부금역	가치)	총장부금역	가치)	총장부금역	가치)	총장부금역	가치)	총장부금역	가치)	총장부금역	가치)	총장부금역	가치)	총장부금액	가치)
금융자산	932,158	1,253,155	13,957	107,453	324	5,625	30,821	11,998	32,428	128,825	62,013	54,804	3,831,362	4,155,722	547,311	1,111,030	5,450,374	6,828,612
보유주식수		134,027,281		2,004,717		647,320		3,518,342		3,701,872		8,398,400		77,000,000				
지문율		0.152		0.051		0.019		0.046		0.075		0.055		0.090				
																		총발행보통주식
지문율에 대한																		수 기준 지문율
설명																		
																		입니다.

전기점 (단위: 백만원)

	긍용자산, 분류	\$A6. 光序																
	공정가치로 측정하	37차로 측명하는 응용자산																
	상장주식	성원주석																
	삼성종공업㈜		위호텔신라		㈜아이마첫코리아		㈜원익홀딩스		㈜원익아이피에스	:	Wacom Co., Ltd.		Corning Incorpor	ated	기타		함계	
	측정 전체																	
		장부급액(시장		장부금맥(시장		장부금액(시장		장부금액(시장		장부금액(시장		장부급액(시장		장부급액(시장		장부급액(시장		장부금액(시장
	총장부금액		총장부금맥		총장부금맥		총장부금맥		총장부금맥		총장부금맥		총장부금맥		총장부금맥		총장부금액	
		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)
금융자산		1,038,711		131,108		5,560		11,857		125,679		50,358		3,140,978		1,093,963		5,598,214
보유주식수																		
지문율																		
지문율에 대한																		
설명																		

5. 재고자산 (연결)

재고자산 세부내역

당반기말 (단위: 백만원)

	평가전금액	재고자산 평가충당금	장부금액 합계
제품 및 상품	15,352,148	(986,462)	14,365,686
반제품 및 재공품	24,763,317	(1,379,982)	23,383,335

원재료 및 저장품	17,917,565	(1,633,053)	16,284,512
미착품	1,533,080	0	1,533,080
재고자산 계	59,566,110	(3,999,497)	55,566,613

전기말 (단위: 백만원)

	평가전금액	재고자산 평가충당금	장부금액 합계
제품 및 상품	16,120,367	(1,567,353)	14,553,014
반제품 및 재공품	26,501,664	(4,303,216)	22,198,448
원재료 및 저장품	15,222,937	(1,525,583)	13,697,354
미착품	1,177,058	0	1,177,058
재고자산 계	59,022,026	(7,396,152)	51,625,874

6. 관계기업 및 공동기업 투자 (연결)

가. 당반기 및 전반기 중 관계기업 및 공동기업 투자의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당반기	전반기
기초	11,767,444	10,893,869
취득	9,342	65,182
처분	(18,995)	(18,357)
이익 중 지분해당액	413,347	413,782
기타(*)	5,592	(19,777)
반기말	12,176,730	11,334,699

^(*) 기타는 배당, 손상, 계정재분류 등으로 구성되어 있습니다.

나. 보고기간종료일 현재 주요 관계기업 및 공동기업 투자 현황은 다음과 같습니다.

(1) 관계기업 투자

기업명	관계의 성격	지분율(%)(*1)	주사업장	결산월	
사성거기(조)	수동소자, 회로부품, 모듈 등	00.7	āl 🗆	108	
삼성전기㈜	전자부품의 생산 및 공급	23.7	한국	12월	
사선에 쓰디에 쓰(조)	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합·관리 등	22.6	한국	12월	
삼성에스디에스㈜ 	IT 서비스 및 물류서비스 제공	22.0	인독	144	
삼성바이오로직스	신사업 투자	31.2	한국	12월	
㈜	선사업 구사	31.2	24	122	
삼성SDI㈜(*2)	2차전지 등 전자부품의 생산 및 공급	19.6	한국	12월	
㈜제일기획	광고 대행업	25.2	한국	12월	

^(*1) 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.

(*2) 유통보통주식수 기준 지분율은 20.6%입니다.

(2) 공동기업 투자

기업명	관계의 성격	지분율(%)(*)	주사업장	결산월
삼성코닝어드밴스드글라스(유)	기타 산업용 유리제품 생산 및 공	50.0	한국	12월

			1
			1
	급		1
)		ĺ

- (*) 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.
- 다. 보고기간종료일 현재 관계기업 및 공동기업 투자 내역은 다음과 같습니다.

(1) 관계기업 투자

(단위 : 백만원)

	당반기말			전기말			
기 업 명	취득원가	순자산가액 (*)	장부금액	취득원가	순자산가액 (*)	장부금액	
삼성전기㈜	359,237	1,939,430	1,944,994	359,237	1,837,925	1,841,393	
삼성에스디에스㈜	147,963	2,019,494	2,030,863	147,963	1,955,699	1,966,206	
삼성바이오로직스㈜	1,424,358	3,224,036	3,228,596	1,424,358	3,068,636	3,073,595	
삼성SDI㈜	1,242,605	3,916,963	2,989,443	1,242,605	3,726,675	2,912,564	
㈜제일기획	506,162	379,596	680,107	506,162	368,875	669,363	
기타	686,567	841,530	1,089,617	690,481	844,645	1,093,799	
Э	4,366,892	12,321,049	11,963,620	4,370,806	11,802,455	11,556,920	

(*) 순자산가액은 지분해당액 기준입니다.

(2) 공동기업 투자

(단위 : 백만원)

	당반기말			전기말			
기 업 명	취득원가	순자산가액	장부금액	취득원가	순자산가액	자ㅂ그애	
	뒤득전기	(*)	;;; ;;;	뒤득전기	(*)	장부금액	
삼성코닝어드밴스드글라	215 000	120 100	138,405	215,000	138,939	138,938	
스(유)	215,000	138,408	130,400	215,000	130,939	130,930	
기타	259,994	74,128	74,705	259,994	72,215	71,586	
Э	474,994	212,536	213,110	474,994	211,154	210,524	

- (*) 순자산가액은 지분해당액 기준입니다.
- 라. 당반기 및 전반기 중 지분법평가 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당반기

		지분법평가 내의	지분법평가 내역				
기 업 명	기초	지분법손익	지분법자본변 동	기타증감액(*)	반기말		
삼성전기㈜	1,841,393	85,364	38,584	(20,347)	1,944,994		
삼성에스디에스㈜	1,966,206	88,396	23,436	(47,175)	2,030,863		
삼성바이오로직스㈜	3,073,595	155,807	(806)	-	3,228,596		
삼성SDI㈜	2,912,564	50,694	39,648	(13,463)	2,989,443		
㈜제일기획	669,363	30,809	12,167	(32,232)	680,107		
삼성코닝어드밴스드글라스 (유)	138,938	(533)	_	_	138,405		
기타	1,165,385	2,810	(1,171)	(2,702)	1,164,322		

계 11,767,444	413,347	111,858	(115,919)	12,176,730
--------------	---------	---------	-----------	------------

(*) 기타증감액은 취득, 처분, 배당 등으로 구성되어 있습니다.

(2) 전반기

(단위 : 백만원)

		지분법평가 내의	지분법평가 내역				
기 업 명	기초	지분법손익	지분법자본변 동	기타증감액(*)	반기말		
삼성전기㈜	1,764,249	56,192	6,258	(37,155)	1,789,544		
삼성에스디에스㈜	1,870,338	84,939	19,059	(55,910)	1,918,426		
삼성바이오로직스㈜	2,808,673	102,673	(32)	ı	2,911,314		
삼성SDI㈜	2,691,223	101,539	37,340	(13,868)	2,816,234		
㈜제일기획	649,161	29,823	4,567	(33,394)	650,157		
삼성코닝어드밴스드글라스 (유)	137,745	(1,448)	_	l	136,297		
기타	972,480	40,064	40,933	59,250	1,112,727		
계	10,893,869	413,782	108,125	(81,077)	11,334,699		

(*) 기타증감액은 취득, 처분, 배당 등으로 구성되어 있습니다.

마. 주요 관계기업 및 공동기업 투자의 요약 재무정보 등은 다음과 같습니다.

(1) 주요 관계기업

(단위 : 백만원)

	당반기						
구 분	사선됩기(조)	삼성에스디에스	삼성바이오로직	かれの()(本)	(X) TII OI 71 51		
	삼성전기㈜	(A)	스㈜	삼성SDI㈜	㈜제일기획		
1 . 요약 재무정보(연류	결재무제표 기준)						
요약 재무상태표:							
유동자산	6,057,580	8,436,909	5,431,353	9,968,558	2,253,613		
비유동자산	6,686,875	4,245,463	10,911,498	27,814,168	523,289		
유동부채	3,406,462	2,410,841	4,034,077	10,609,204	1,213,266		
비유동부채	854,951	996,141	1,980,450	5,983,949	226,913		
비지배지분	201,919	334,958	_	1,732,989	12,770		
요약 포괄손익계산서:							
매출	5,204,421	6,616,222	2,103,808	9,581,028	2,107,457		
계속영업손익(*)	357,063	387,513	497,354	547,602	107,420		
세후중단영업손익(*)	(1,521)	ı	-	-	I		
기타포괄손익(*)	164,890	103,755	478	416,030	42,394		
총포괄손익(*)	520,432	491,268	497,832	963,632	149,814		
Ⅱ. 배당							
배당	20,347	47,175	_	13,463	32,232		

(*) 지배기업의 소유주에 귀속될 손익입니다.

구	분	전기		

	삼성전기㈜	삼성에스디에스 ㈜	삼성바이오로직 스㈜	삼성SDI㈜	㈜제일기획
1 . 요약 재무정보(연	결재무제표 기준)				
요약 재무상태표(전기	말):				
유동자산	5,208,418	8,160,300	5,521,988	9,187,029	2,372,420
비유동자산	6,449,453	4,160,724	10,524,209	24,851,831	517,085
유동부채	2,900,460	2,391,861	4,157,861	8,518,933	1,375,034
비유동부채	727,087	953,592	2,057,844	5,612,677	216,707
비지배지분	182,613	317,562	-	1,395,877	11,206
요약 포괄손익계산서(전반기):				
매출	4,242,286	6,691,688	1,587,107	11,195,427	1,913,000
계속영업손익(*)	232,469	375,102	326,641	899,767	104,081
세후중단영업손익(*)	(8,472)	_	1	_	_
기타포괄손익(*)	38,283	84,377	(91)	271,927	19,952
총포괄손익(*)	262,280	459,479	326,550	1,171,694	124,033
Ⅱ. 배당(전반기)					
배당	37,155	55,911	_	13,867	33,394

^(*) 지배기업의 소유주에 귀속될 손익입니다.

(2) 주요 공동기업

(단위 : 백만원)

ר ש	삼성코닝어드밴스드글라스(유)	
구 분	당반기	전기
Ⅰ. 요약 재무정보		
요약 재무상태표:		
유동자산	118,300	116,372
비유동자산	188,879	185,100
유동부채	29,372	22,684
비유동부채	992	911
요약 포괄손익계산서(*):		
매출	72,395	50,320
계속영업손익	(1,063)	(2,896)
세후중단영업손익	-	-
기타포괄손익	-	-
총포괄손익	(1,063)	(2,896)
11. 배당		
배당	_	_

^(*) 반기 6개월 기준 금액입니다.

(3) 개별적으로 중요하지 않은 관계기업과 공동기업의 손익 중 연결회사의 지분 해당액은 다음과 같습니다.

	당반기		전반기		
구 분	관계기업	공동기업	관계기업	공동기업	
반기순손익	1,445	1,365	38,861	1,203	
기타포괄손익	267	(1,438)	40,789	144	
총포괄손익	1,712	(73)	79,650	1,347	

바, 보고기간종료일 현재 시장성 있는 주요 관계기업 투자주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 백만원)

기 업 명	당반기말		전기말
л а в	주식수(주)	시장가치	시장가치
삼성전기㈜	17,693,084	2,795,507	2,710,580
삼성에스디에스㈜	17,472,110	2,594,608	2,970,259
삼성바이오로직스㈜	22,217,309	16,151,984	16,885,155
삼성SDI㈜	13,462,673	4,765,786	6,354,382
㈜제일기획	29,038,075	534,301	552,595

사. 기타사항

증권선물위원회는 연결회사의 관계기업인 삼성바이오로직스㈜가 Biogen Therapeutics Inc.와 합작 투자한 삼성바이오에피스㈜ 지분에 대한 회계처리와 관련하여, 합작계약 약정사항의 재무제표 주석 미기재를 이유로 담당임원 해임권고, 검찰 고발, 감사인 지정 등의 조치 (이하 "1차 처분")를 2018년 7월 12일에 의결하였으며, 연결대상 범위 회계처리 오류 등 회계기준 위반을 이유로 과징금 80억원 부과, 대표이사 해임권고, 재무제표 재작성, 검찰 고발 등의 조치(이하 "2차 처분")를 2018년 11월 14일 의결하였습니다.

이에 대하여 삼성바이오로직스㈜는 회계처리의 정당성을 입증하기 위하여 위 처분의취소를 구하는 소송(이하 "본안 소송")을 서울행정법원에 제기하였고, 현재 소송을 진행 중입니다. 1차 처분의 취소를 구하는 소송과 관련하여, 서울행정법원은 2020년 9월 24일 증권선물위원회가 부과한 행정 처분을 취소한다고 판결하고, 항소심 판결 선고 시까지 위 처분의 효력을 정지하는 결정을 하였습니다. 이에 증권선물위원회는 2020년 10월 16일 항소하여 현재 서울고등법원에서 소송을 진행 중입니다. 또한, 삼성바이오로직스㈜는 위 처분에 대한 효력정지신청서를 서울행정법원에 제출하였으며, 법원은 2019년 1월 22일(2차 처분)과 2019년 2월 19일(1차 처분)에 본안 소송의 판결 시까지처분의 효력을 정지하는 결정을 선고하였습니다. 이에 증권선물위원회는 위 집행정지 결정에 대하여 즉시항고하였으며, 서울고등법원은 2019년 5월 13일(2차 처분), 2019년 5월 24일(1차 처분) 항고를 기각하였습니다. 이에 증권선물위원회는 2019년 5월 23일(2차 처분), 2019년 6월 10일(1차 처분) 재항고하였으며, 대법원은 2019년 9월 6일(2차 처분), 2019년 10월 11일(1차 처분) 재항고를 기각하여 효력정지 결정이 확정되었습니다.

향후 행정소송의 결과를 예측하기 어려우나 소송 결과에 따라 삼성바이오로직스㈜가 삼성바이오에피스㈜ 지분에 관한 과거 회계처리를 수정하여 재무제표를 재작성하게 될 경우, 이로 인해 연결회사의 2015년부터 2022년까지 보고기간의 지분법평가손익, 관계기업투자주식, 이익잉여금과 2016년 일부 지분 처분이익 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 다만, 현재로서는 삼성바이오로직스㈜와 증권선물위원회 간의 행정소송에 대한 종결 시기와 그 결과를 예측할 수 없으므로, 연결회사의 당반기 재무제표에 이를 반영하기 어렵습니다.

7. 유형자산 (연결)

유형자산에 대한 세부 정보 공시

	공시금액
기초 장부금액	187,256,262
일반취득 및 자본적지출	23,941,766
감가상각비, 유형자산	(18,607,158)
처분・폐기・손상	(196,972)
기타	2,055,928

반기말 장부금액	194,449,826
----------	-------------

전반기 (단위: 백만원)

	공시금액
기초 장부금액	168,045,388
일반취득 및 자본적지출	26,299,312
감가상각비, 유형자산	(17,568,639)
처분·폐기·손상	(209,921)
기타	1,303,802
반기말 장부금액	177,869,942

기타 변동에 대한 각주, 유형자산

기타는 환율변동에 의한 증감액, 정부보조금 차감 효과 등을 포함하고 있습니다.

감가상각비의 기능별 배분

당반기 (단위: 백만원)

	매출원가	판매비와관리비 등	기능별 항목 합계
감가상각비, 유형자산	16,505,434	2,101,724	18,607,158

전반기 (단위: 백만원)

	매출원가	판매비와관리비 등	기능별 항목 합계
감가상각비, 유형자산	15,643,321	1,925,318	17,568,639

사용권자산에 대한 양적 정보 공시

당반기말 (단위: 백만원)

	공시금액
사용권자산	5,434,792

전기말 (단위: 백만원)

	공시금액
사용권자산	5,449,032

사용권자산 변동에 대한 공시

당반기 (단위: 백만원)

	공시금액
사용권자산의 추가	533,366
감가상각비, 사용권자산	597,325

	공시금액
--	------

사용권자산의 추가	1,040,012
감가상각비, 사용권자산	589,402

8. 무형자산 (연결)

무형자산 및 영업권의 변동내역에 대한 공시

당반기 (단위: 백만원)

	공시금액
기초장부금액	22,741,862
개별취득	1,669,514
상각	(1,465,554)
처분·폐기·손상	(35,351)
기타	712,809
반기말장부금액	23,623,280

전반기 (단위: 백만원)

	공시금액
기초장부금액	20,217,754
개별취득	4,324,670
상각	(1,576,451)
처분・폐기・손상	(25,652)
기타	489,913
반기말장부금액	23,430,234

기타 변동에 대한 각주, 무형자산

기타는 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.

무형자산상각비의 기능별 배분

당반기 (단위: 백만원)

	매출원가	판매비와관리비 등	기능별 항목 합계
무형자산상각비	994,161	471,393	1,465,554

전반기 (단위: 백만원)

	매출원가	판매비와관리비 등	기능별 항목 합계
무형자산상각비	1,109,423	467,028	1,576,451

9. 차입금 (연결)

단기차입금에 대한 세부 정보

당반기말 (단위: 백만원)

차입금명칭						
단기차입금						
담보부차입금-우리은행 등	무담보차입금-씨티은행 등				차입금명칭 합계	
범위	범위 합계	범위 범위		범위 합계		

	하위범위	가중범위	상위범위		하위범위	가중범위	상위범위		
연이자율	0.000		0.136		0.000		0.539		
단기차입금				10,375,644				250,948	10,626,592
				담보부차입금과 관					
				련하여 매출채권을					
차입금에 대한 기술				담보로 제공하였습					
				니다.					

전기말 (단위:백만원)

	차입금명칭								
	단기차임금								
	당보부차입금-우리은행 등 무당보차입금-씨티은행 등								차입금명칭 합계
	범위					범위			
	하위범위	가중범위	상위범위	범위 합계	하위범위	가중범위	상위범위	범위 합계	
연이자율									
단기차입금				6,610,049				504,552	7,114,601
차입금에 대한 기술									

유동성장기차입금에 대한 세부 정보

당반기말 (단위:백만원)

	차입금명칭								
	유동성장기차임금								
	은행차입금-BNP 등 리스부채-CSSD 등_1							차입금명칭 합계	
	범위					범위			
	하위범위	가중범위	상위범위	범위 합계	하위범위	가중범위	상위범위	범위 합계	
연이자율	0.361		0.553			0.046			
유동성장기차입금				506,839				1,043,886	1,550,725

전기말 (단위:백만원)

	차임금명칭								
유동성장기차입금									
	은행차입금-BNP 등 리스부채-CSSD 등_1								차입금명칭 합계
	범위				범위			HIOI SLINI	
	하위범위	가중범위	상위범위	범위 합계	하위범위	가중범위	상위범위	범위 합계	
연이자율									
유동성장기차입금				304,082				998,439	1,302,521

장기차입금에 대한 세부 정보

당반기말 (단위: 백만원)

	차입금명칭
	장기 차입금
	리스부채-CSSD 등_2
연이자율	0.046
장기차입금	3,719,386

차입금명칭
장기 차입금

	리스부채-CSSD 등_2
연이자율	
장기차입금	3,724,850

리스부채 이자비용에 대한 공시

당반기 (단위: 백만원)

	공시금액
	리스부채의 연이자율은 가중평균증분차입이자율
리스부채 이자비용에 대한 설명	이며 당반기 중 발생한 이자비용은 108,570백만
	원(전반기: 94,075백만원)입니다.
리스부채에 대한 이자비용	108,570

전반기 (단위: 백만원)

	공시금액
리스부채 이자비용에 대한 설명	리스부채의 연이자율은 가중평균증분차입이자율 이며 당반기 중 발생한 이자비용은 108,570백만 원(전반기: 94,075백만원)입니다.
리스부채에 대한 이자비용	94,075

10. 사채 (연결)

사채에 대한 세부 정보 공시

당반기말 (단위: 백만원)

	US\$ denominated Straight Bonds	US\$ denominated Debenture Bonds	차입금명칭 합계
발행일	1997-10-02	2015-05-11	
만기상환일	2027-10-01	2025-05-15	
연이자율	0.077	0.042	
명목금액	27,784	555,680	583,464
명목금액, 외화금액	US\$ 20,000천	US\$ 400,000천	
사채할인발행차금			(344)
사채할증발행차금			1,561
Л			584,681
차감: 유동성사채			(564,108)
비유동성사채			20,573
사채에 대한 기술	10년 거치 20년 분할상 환되며 이자는 6개월마 다 후급됩니다.	종속기업 Harman International Industries, Inc.에서 발 행하였고, 10년 만기 일 시상환되며 이자는 6개 월마다 후급됩니다.	

전기말 (단위: 백만원)

	US\$ denominated Straight Bonds	US\$ denominated Debenture Bonds	차입금명칭 합계
발행일	1997-10-02	2015-05-11	
만기상환일	2027-10-01	2025-05-15	
연이자율	0.077	0.042	
명목금액	25,788	515,760	541,548
명목금액, 외화금액	US\$ 20,000천	US\$ 400,000천	
사채할인발행차금			(370)
사채할증발행차금			2,794
계			543,972
차감: 유동성사채			(6,354)
비유동성사채			537,618
사채에 대한 기술	10년 거치 20년 분할상 환되며 이자는 6개월마 다 후급됩니다.	종속기업 Harman International Industries, Inc.에서 발 행하였고, 10년 만기 일 시상환되며 이자는 6개 월마다 후급됩니다.	

11. 순확정급여부채(자산) (연결)

확정급여제도에 대한 공시

당반기말 (단위: 백만원)

	전부 또는 부분적으로 기금이 적립되는 확정급 여제도	전부 기금이 적립되지 않는 확정급여제도	확정급여제도의 기금적 립약정 합계
확정급여채무, 현재가치	15,927,219	304,907	16,232,126
사외적립자산의 공정가 치			(19,992,918)
순확정급여부채(자산) 계			(3,760,792)

	기금() 석립되는 활성급	전부 기금이 적립되지 않는 확정급여제도	확정급여제도의 기금적 립약정 합계
확정급여채무, 현재가치	15,403,976	319,689	15,723,665
사외적립자산의 공정가 치			(20,172,327)

순확정급여부채(자산)		(4.440.660)
계		(4,448,662)

당기손익에 포함되는 퇴직급여비용에 대한 공시 당반기

	매출원가	판매비와 일반관리비	기능별 항목 합계
당기근무원가, 확정급여 제도			699,746
순이자비용(수익), 확정 급여제도			(129,384)
과거근무원가, 확정급여 제도			(273)
기타 비용, 확정급여제 도			11,864
퇴직급여비용 합계, 확 정급여제도	232,457	349,496	581,953

전반기 (단위: 백만원)

	매출원가	판매비와 일반관리비	기능별 항목 합계
당기근무원가, 확정급여 제도			634,643
순이자비용(수익), 확정 급여제도			(176,734)
과거근무원가, 확정급여 제도			(581)
기타 비용, 확정급여제 도			15,865
퇴직급여비용 합계, 확 정급여제도	189,349	283,844	473,193

12. 충당부채 (연결)

기타충당부채에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	판매보증	기술사용료	장기성과급	기타	기타충당부채 합계
기초	2,540,212	1,838,052	993,751	4,031,311	9,403,326
순전입(환입)	1,006,577	638,975	114,499	1,730,408	3,490,459
사용	(903,447)	(471,073)	(195,635)	(733,650)	(2,303,805)
기타(*)	81,921	52,559	8,155	57,114	199,749
반기말	2,725,263	2,058,513	920,770	5,085,183	10,789,729

				연결회사는 생산 및	
				판매 중단한 제품에	
연결회사는 출고한 제		연결회사는 임원을 대	대하여 향후 부담할		
	문을되지는 출고한 제 품에 대한 품질보증,	연결회사는 협상 진행		것으로 예상되는 비용	
	교환, 하자보수 및 그	[전필회자는 합당 전명 중인 기술사용계약과	항으로 무어진도를 모 함한 향후 3년간의 경	등을 추정하여 충당부	
	에 따른 사후서비스	장면하여 향후 지급이		채로 계상하고 있습니	
	등으로 인하여 향후		을 지급하는 장기성과	다.	
충당부채의 성격에 대	부담할 것으로 예상되	를 추정하여 충당부채		연결회사는 온실가스	
한 기술	는 비용을 보증기간	로 계상하고 있습니다		배출과 관련하여 해당	
및 과	및 과거 경험률 등을	. 지급시기 및 금액은	상되는 금액의 경과	이행연도분 배출권의	
	기초로 추정하여 충당			장부금액과 이를 초과	
	부채로 설정하고 있습	 될 수 있습니다.	채로 계상하고 있습니	하는 배출량에 대해	
	니다.		다.	향후 부담할 것으로	
				예상되는 비용을 추정	
				하여 충당부채로 계상	
				하고 있습니다.	

기타충당부채에 대한 기술

(*) 기타는 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.

무상할당배출권과 배출량 추정치에 대한 공시

	배출량
무상할당 배출권	1,630만톤(tCO2-eq)
배출량 추정치	1,811만톤(tCO2-eq)

배출권 변동내역에 대한 공시

당반기 (단위: 백만원)

	공시금액
기초	3,137
증가	0
사용	0
반기말	3,137

	공시금액
기초	19,567
증가	1,272
사용	(225)
반기말	20,614

당반기 (단위: 백만원)

	공시금액
기초	137
순전입(환입)	70
사용	0
반기말	207

전반기 (단위: 백만원)

	공시금액
기초	32,838
순전입(환입)	0
사용	(14)
반기말	32,824

13. 우발부채와 약정사항 (연결)

우발부채에 대한 공시

	법적소송우발부채			
의무의 성격에 대한 기술, 우발부채	가. 소송 등			
	당반기말 현재 연결회사는 다수의 회사 등과 정상 적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기			
	관의 조사 등이 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 연결회사의			
	경영진은 이러한 소송 등의 결과가 연결회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단			
	하고 있습니다.			

약정에 대한 공시

(단위:백만원)

발생하지 않은 유·무형자산의 취득을 위한 약정	
14,903,033	
나. 기타 약정사항	
당반기말 현재 발생하지 않은 유·무형자산의 취득을 위한 약정액은 14,903,033백만원입니다.	

14. 계약부채 (연결)

계약부채에 대한 공시

당반기말 (단위: 백만원)

	공시금액
계약부채	12,662,537

전기말 (단위: 백만원)

	공시금액
계약부채	13,327,724

계약부채에 대한 기술

계약부채는 선수금, 미지급비용, 기타유동부채 등에 포함되어 있습니다.

15. 자본금 (연결)

주식의 분류에 대한 공시

(단위:백만원)

	보통주	우선주	주식 합계	
회사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수(주)			25,000,000,000	
주당 액면가액(원)			100	
발행주식수(주)	5,969,782,550	822,886,700		
유통주식수(주)	5,969,782,550	822,886,700		
발행주식 액면 총액(백 만원)	596,978	82,289	679,267	
납입자본금(백만원)			897,514	

보고기간종료일 현재 회 사의 정관에 의한 발행 할 주식의 총수는 250억 주(1주의 액면금액: 100원)이며, 회사에는 보통주 외 비누적적 우 선주가 있습니다. 이 우 선주는 의결권이 없고 액면금액을 기준으로 보 통주의 배당보다 연 1%의 금전배당을 추가 로 받을 수 있습니다. 보 고기간종료일 현재 회사 가 발행한 보통주 및 우 선주의 수(소각 주식수 자본에 대한 설명 제외)는 각각 5,969,782,550주와 822,886,700주입니다. 또한, 보고기간종료일 현재 유통주식수는 상기 발행주식의 수와 동일하 며, 당반기 및 전기 중 변동사항은 없습니다. 한편, 발행주식의 액면 총액은 679.267백만원 (보통주 596,978백만원, 우선주 82,289백만원)으로 이익소각으로 인 하여 납입자본금 897,514백만원과 상이 합니다.

16. 연결이익잉여금 (연결)

이익잉여금에 대한 공시

당반기말 (단위: 백만원)

	공시금액
임의적립금 등	208,843,803
연결미처분이익잉여금	149,191,999
Л	358,035,802

	공시금액
임의적립금 등	208,198,003

연결미처분이익잉여금	138,454,235
Л	346,652,238

배당금에 대한 공시

당반기 (단위: 백만원)

	범위					
	1분기		2분기			
	주식			주식		조시 하게
	보통주	우선주	주식 합계	보통주	우선주	주식 합계
배당기준일			2024-03-31			2024-06-30
배당받을 주식(주)	5,969,782,550	822,886,700		5,969,782,550	822,886,700	
보통주 주당 배당률	3.61			3.61		
(액면가 기준)				3.01		
우선주 주당 배당률		3.61			0.01	
(액면가 기준)					3.61	
배당금액	2,155,092	297,062	2,452,154	2,155,092	297,062	2,452,154

전반기 (단위: 백만원)

	범위					
	1분기		2분기			
	주식		주식 합계	주식		·주식 합계
	보통주	우선주	구역 합계	보통주	우선주	구역 합계
배당기준일			2023-03-31			2023-06-30
배당받을 주식(주)	5,969,782,550	822,886,700		5,969,782,550	822,886,700	
보통주 주당 배당률	0.01			0.01		
(액면가 기준)	3.61			3.61		
우선주 주당 배당률		2.61			2.61	
(액면가 기준)		3.61			3.61	
배당금액	2,155,092	297,062	2,452,154	2,155,092	297,062	2,452,154

17. 기타자본항목 (연결)

기타자본구성요소

당반기말 (단위: 백만원)

		공시금액
기타자본구성요소		10,332,353
	기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	1,308,079
	관계기업 및 공동기업의 기타포 괄손익누계액에 대한 지분	303,340
기타자본구성요소	해외사업장환산외환차이	11,609,133
	순확정급여부채(자산) 재측정요 소	(2,960,760)
	기타	72,561

		공시금액
기타자본구성요소		1,280,130
	기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	194,419
	관계기업 및 공동기업의 기타포 괄손익누계액에 대한 지분	185,144
기타자본구성요소 	해외사업장환산외환차이	3,651,112
	순확정급여부채(자산) 재측정요 소	(2,849,526)
	기타	98,981

18. 비용의 성격별 분류 (연결)

비용의 성격별 분류 공시

당반기 (단위: 백만원)

	장부금액	
	공시금액	
	3개월	누적
제품 및 재공품 등의 변동	(595,106)	(994,371)
원재료 등의 사용액 및 상품 매 입액 등	22,856,760	47,155,223
급여	8,153,699	16,228,699
퇴직급여	367,126	714,936
감가상각비	9,375,848	18,607,158
무형자산상각비	746,072	1,465,554
복리후생비	1,676,331	3,400,809
유틸리티비	1,970,174	3,993,356
외주용역비	1,996,545	3,767,051
광고선전비	1,323,745	2,758,671
판매촉진비	1,779,434	3,616,828
기타 비용	13,973,796	28,220,102
성격별 비용 합계	63,624,424	128,934,016

	장부금액	
	공시금액	
	3개월	누적
제품 및 재공품 등의 변동	(935,654)	(3,152,414)
원재료 등의 사용액 및 상품 매 입액 등	21,190,339	48,387,259
급여	8,090,473	15,991,639

퇴직급여	273,221	551,510
감가상각비	8,767,744	17,568,639
무형자산상각비	790,853	1,576,451
복리후생비	1,740,173	3,281,449
유틸리티비	1,771,378	3,632,488
외주용역비	1,729,937	3,410,856
광고선전비	1,073,439	2,218,782
판매촉진비	1,568,835	3,241,787
기타 비용	13,276,248	25,733,733
성격별 비용 합계	59,336,986	122,442,179

성격별 비용에 대한 공시

연결손익계산서 상 매출원가와 판매비와관리비를 합한 금액입니다.

19. 판매비와관리비 (연결)

판매비와관리비에 대한 공시

당반기 (단위: 백만원)

	장부금액	
	공시금액	
	3개월	누적
급여	2,182,296	4,361,506
퇴직급여	113,674	191,265
지급수수료	2,197,695	4,281,199
감가상각비	418,377	831,374
무형자산상각비	176,923	351,970
광고선전비	1,323,745	2,758,671
판매촉진비	1,779,434	3,616,828
운반비	647,009	1,361,544
서비스비	782,082	2,023,641
기타판매비와관리비	1,642,050	3,088,507
소계	11,263,285	22,866,505
경상연구개발비-연구개발 총지 출액	8,049,113	15,869,153
Л	19,312,398	38,735,658

	장부금액	
	공시금액	
	3개월	누적
급여	2,102,067	4,174,476

퇴직급여	70,645	140,157
지급수수료	2,070,654	4,174,578
감가상각비	419,353	822,999
무형자산상각비	172,647	341,586
광고선전비	1,073,439	2,218,782
판매촉진비	1,568,835	3,241,787
운반비	420,198	834,603
서비스비	1,088,395	2,110,131
기타판매비와관리비	1,505,008	2,951,508
소계	10,491,241	21,010,607
경상연구개발비-연구개발 총지 출액	7,198,555	13,777,289
Я	17,689,796	34,787,896

20. 기타수익 및 기타비용 (연결)

기타수익 및 기타비용

당반기 (단위: 백만원)

	장부금액	
	공시금액	
	3개월	누적
배당금수익	33,059	72,516
임대료수익	38,805	77,719
유형자산처분이익	19,022	28,357
기타	227,615	585,190
기타수익 계	318,501	763,782
유형자산처분손실	5,189	31,237
기부금	27,908	105,384
기타	212,399	490,268
기타비용 계	245,496	626,889

	장부금액	
	공시금액	
	3개월	누적
배당금수익	48,894	96,788
임대료수익	36,963	74,905
유형자산처분이익	20,598	55,047
기타	94,721	478,731
기타수익 계	201,176	705,471
유형자산처분손실	10,611	20,003

기부금	29,710	102,793
기타	128,736	250,243
기타비용 계	169,057	373,039

21. 금융수익 및 금융비용 (연결)

금융수익 및 금융비용

당반기 (단위: 백만원)

		장부금액	
		공시금액	
		3개월	누적
이자수익(금융수익)		1,178,096	2,350,281
이자수익(금융수익)	상각후원가로 측정하는 금융자산의 이자수익	1,178,045	2,350,197
	당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 이 자수익	51	84
외환차이		2,198,384	4,319,313
파생상품관련이익		239,704	401,653
금융수익 합계		3,616,184	7,071,247
이자비용		194,748	437,520
이자비용	상각후원가 측정 금융부 채 이자비용	27,081	94,008
	기타 금융부채 이자비용	167,667	343,512
외환차이		2,312,487	4,552,548
파생상품관련손실		229,002	379,239
금융비용 합계		2,736,237	5,369,307

		장부금액	
		공시금액	
		3개월	누적
이자수익(금융수익)		1,152,273	2,212,719
이자수익(금융수익)	상각후원가로 측정하는 금융자산의 이자수익	1,152,212	2,212,592
	당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 이 자수익	61	127
외환차이		2,758,603	5,878,615
파생상품관련이익		146,052	593,643
금융수익 합계		4,056,928	8,684,977
이자비용		286,893	578,570

이자비용	상각후원가 측정 금융부 채 이자비용	176,050	327,906
	기타 금융부채 이자비용	110,843	250,664
외환차이		2,556,359	5,932,237
파생상품관련손실		401,288	689,734
금융비용 합계		3,244,540	7,200,541

금융수익 및 금융비용에 대한 기술

연결회사는 외화거래 및 환산으로 발생한 외환차이를 금융수익 및 금융비용으로 인식하고 있습니다

22. 법인세비용 (연결)

법인세에 대한 반기별 공시

	내용
법인세에 대한 반기별 공시에 대한 설명	법인세비용은 전체 회계연도에 대해 글로벌최저한세를 고려하여 추정한 최선의 가중평균연간법인세율로 인식하였습니다. 당반기말 현재 2024년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상평균 연간법인세율은 14.0%입니다.
2024년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상 평균 연간법인세율	0.140

23. 주당이익 (연결)

주당이익

	주식	주식						
	보통주		우선주					
	3개월	누적	3개월	누적				
지배회사지분 반기 순이익	9,642,65	16,263,683	9,642,653	16,263,683				
지배기업의 보통주 에 귀속되는 반기 순이익(손실)	8,474,51	0 14,293,446						
가중평균유통보통 주식수(천주)	5,969,78	5,969,783						
기본 보통주 주당 이익(원)	1,41	9 2,394						

지배기업의 우선주 에 귀속되는 반기 순이익(손실)		1,168,143	1,970,237
가중평균유통우선 주식수(천주)		822,887	822,887
기본 우선주 주당 이익(원)		1,419	2,394

	주식					
	보통주		우선주			
	3개월	누적	3개월	누적		
지배회사지분 반기 순이익	1,547,018	2,948,270	1,547,018	2,948,270		
지배기업의 보통주 에 귀속되는 반기 순이익(손실)	1,359,607	2,591,107				
가중평균유통보통 주식수(천주)	5,969,783	5,969,783				
기본 보통주 주당 이익(원)	228	434				
지배기업의 우선주 에 귀속되는 반기 순이익(손실)			187,411	357,163		
가중평균유통우선 주식수(천주)			822,887	822,887		
기본 우선주 주당 이익(원)			228	434		

희석주당이익에 대한 기술

회사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주는 없으며, 당반기 및 전반기의 기본주당이익과 희석주 당이익은 동일합니다.

24. 현금흐름표 (연결)

현금흐름의 회계정책에 대한 기술

연결회사는 영업활동 현금흐름을 간접법으로 작성하였습니다. 당반기 및 전반기 중 영업활동 현금 흐름 관련 조정 내역 및 영업활동으로 인한 자산부채의 변동은 다음과 같습니다.

영업활동현금흐름

	공시금액
조정내역 계	18,787,796

	법인세비용	2,706,014
	금융수익	(3,582,400)
	금융비용	2,161,371
	퇴직급여	714,936
	감가상각비	18,607,158
	무형자산상각비	1,465,554
조정내역 계	대손상각비(환입)	(20,386)
	배당금수익	(72,516)
	지분법이익	(413,347)
	유형자산처분이익	(28,357)
	유형자산처분손실	31,237
	재고자산평가손실(환입) 등	(2,777,967)
	기타	(3,501)
영업활동으로 인한 자산 부채의	· 변동	(4,247,682)
	매출채권의 감소(증가)	(4,814,802)
	미수금의 감소(증가)	269,310
	장단기선급비용의 감소(증가)	(4,706)
	재고자산의 감소(증가)	68,248
	매입채무의 증가(감소)	(196,504)
영업활동으로 인한 자산 부채의	장단기미지급금의 증가(감소)	176,912
변동	선수금의 증가(감소)	(117,196)
	예수금의 증가(감소)	16,828
	미지급비용의 증가(감소)	261,533
	장단기충당부채의 증가(감소)	1,186,654
	퇴직금의 지급	(567,124)
	11 10 1 N 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

		공시금액
조정내역 계		21,958,025
	법인세비용	241,205
	금융수익	(3,619,551)
	금융비용	2,601,229
	퇴직급여	551,510
 조정내역 계	감가상각비	17,568,639
1	무형자산상각비	1,576,451
	대손상각비(환입)	76,054
	배당금수익	(96,788)
	지분법이익	(413,782)
	유형자산처분이익	(55,047)

	유형자산처분손실	20,003
	재고자산평가손실(환입) 등	3,569,456
	기타	(61,354)
영업활동으로 인한 자산 부채의 법	변동	(8,273,365)
	매출채권의 감소(증가)	727,124
	미수금의 감소(증가)	990,666
	장단기선급비용의 감소(증가)	(449,776)
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	재고자산의 감소(증가)	(5,846,100)
	매입채무의 증가(감소)	635,101
	장단기미지급금의 증가(감소)	589,905
	선수금의 증가(감소)	(181,346)
	예수금의 증가(감소)	(562,980)
	미지급비용의 증가(감소)	(4,485,803)
	장단기충당부채의 증가(감소)	1,223,152
	퇴직금의 지급	(323,060)
	기타	(590,248)

리스 현금유출

당반기 (단위: 백만원)

	공시금액
리스부채에 대한 원금 상환, 재무활동에서 생기는 현금유출	588,341
리스부채에 대한 이자비용, 업업활동에서 생기는 현금유출	108,570

전반기 (단위: 백만원)

	공시금액
리스부채에 대한 원금 상환, 재무활동에서 생기는 현금유출	538,783
리스부채에 대한 이자비용, 업업활동에서 생기는	94,075
현금유출	94,073

25. 재무위험관리 (연결)

금융상품에서 발생하는 위험의 성격과 정도에 대한 공시

	위험						
	시장위험			신용위험	유동성위험	자본위험	위험 합계
	환위험	이자율위험	지분가격위험	신용귀염	посла	자근케임	
위험에 대한 노출정	연결회사는 글로벌	이자율변동위험은 시	당반기말 현재 지분	연결회사의 금융자산			
도에 대한 기술	영업활동을 수행함에	장금리 변동으로 인	상품(상장주식)의 주	장부금액은 손상차손			

		가가 1% 변동할 경우			
		기타포괄손익(법인세			
따라 기능통화와 다	해 투자 및 재무활동	효과 반영 전)에 미치			
른 통화로도 거래를	으로부터 발생하는	는 영향은 66,935백	차감 후 금액으로 연		
하고 있어 환율변동	이자수익, 비용의 현	만원(전반기:	결회사의 신용위험		
위험에 노출되어 있		81,526백만원)이며,	최대노출액은 금융자		
습니다. 환율변동위	험으로서, 주로 예금	당기손익(법인세효과	산 장부금액과 동일		
험에 노출되는 주요					
통화로는 USD, EUR	및 변동금리부 차입		합니다.		
등이 있습니다.	금에서 비롯됩니다.	향은 1,351백만원(전			
		반기: 4,309백만원			
)입니다.			

			1				<u> </u>
				신용위험은 통상적인	유동성위험이란 연결		
				거래 및 투자 활동에	회사가 금융부채와		연결회사는 영업활동
				서 발생하며 고객 또	관련된 모든 의무를		에서 파생되는 시장
				는 거래상대방이 계	이행하는 데 어려움		위험, 신용위험, 유동
				약조건상 의무사항을	을 겪게 될 위험을 의		성위험 등을 최소화
				지키지 못하였을 때	미합니다. 연결회사		하는데 중점을 두고
				발생합니다. 이러한	의 주요 유동성 공급		재무위험을 관리하고
				신용위험을 관리하기	원은 영업에서 창출		
	연결회사는 통화별			위하여 고객과 거래	한 현금 및 자본시장		있으며, 이를 위해 각
	자산과 부채규모를			상대방의 재무상태와	및 금융기관에서 조		각의 위험요인에 대
	일치하는 수준으로			과거 경험 및 기타 요	달한 자금이며, 주요		해 면밀하게 모니터
	유지하여 환율변동			소를 고려하여 주기	유동성 수요는 생산,		링 및 대응하고 있습
	영향을최소화하는데			적으로 재무신용도를	연구개발을 위한 투		니다.
	주력하고 있습니다.			평가하고 있으며, 고	자를 비롯해, 운전자		
	이를 위해 수출입 등			객과 거래상대방 각	본, 배당 등에 있습니		재무위험은 글로벌
	의 경상거래 및 예금,			각에 대한 신용한도	다. 대규모 투자가 많		재무관리기준을 수립
	차입 등의 금융거래			를 설정·관리하고	은 연결회사의 사업		하고 고객과 거래선
	발생시 기능통화로			있습니다. 그리고 위	특성상 적정 유동성	연결회사의 자본관리	에 대한 주기적인 재
	거래하거나 입금 및						무위험 측정, 환헷지
	지출 통화를 일치시		연결회사는 전략적	형국가에 소재한 거	의 유지가 매우 중요	목적은 계속기업으로	및 자금수지 점검 등
	킴으로써 환포지션		목적 등으로 기타포	래처의 매출채권은	합니다. 연결회사는	서 주주 및 이해관계	을 통해 관리하고 있
	발생을 최대한 억제	연결회사는 내부자금	괄손익-공정가치금융	보험한도 내에서 적	주기적인 자금수지	자에게 이익을 지속	습니다.
	하고 있으나, 일부 발	공유를 통해 외부차	자산 및 당기손익-공	절하게 위험이 관리	예측, 필요 현금수준	적으로 제공할 수 있	
위험관리의 목적, 정	생된 환포지션은 채	입금을 최소화하여	정가치금융자산으로	되고 있습니다. 	산정 및 수입, 지출 	는 능력을 보호하고	한편, 해외 주요 권역
책 및 절차에 대한 기	권매각, 선물환 등을	이자율 변동으로 인	분류된 지분상품에		관리 등을 통하여 적	건전한 자본구조를	별로 지역금융센터
술	활용하여 환변동영향	한 금융비용과 불확	투자하고 있습니다.	신용위험은 금융기관	정 유동성을 유지ㆍ	유지하는 것입니다.	(미국, 영국, 싱가포
	을 축소하고 있습니	실성을 최소화하고	이를 위하여 직・간	과의 거래에서도 발	관리하고 있습니다.	연결회사는 신용등급	르, 중국, 브라질, 러
	다. 이는 연결회사가	있습니다.	접적 투자수단을 이	생할 수 있으며 해당		, 부채비율 등의 지표	시아)에서 환율변동
	노출된 환율변동위험		용하고 있습니다.	거래는 현금및현금성	연결회사는 권역별로	를 이용하여 자본위	모니터링 및 환거래
	을 감소시키지만 완			자산, 각종 예금 그리	Cash Pooling을 구축	험을 관리하고 있습	대행을 통해 환율변
	전히 제거하지는 않			고 파생금융상품 등	하여 권역 내 개별 법	니다.	동위험을 관리하고
	을 수 있습니다. 또한			의 금융상품 거래를	인의 자금이 부족한		있으며, 권역내 자금
				포함합니다. 이러한	경우에도 유동성위험		
	, 연결회사는 효율적			위험을 줄이기 위해,	에 효율적으로 대응		을 통합운용하여 유
	인 환율변동위험 관			연결회사는 국제 신	하고 있습니다. Cash		동성위험에 대응하고
	리를 위해 환위험을			용등급이 높은 은행	Pooling은 자금 부족		있습니다.
	주기적으로 모니터링			(S&P A 이상)에 대해	회사와 자금 잉여 회		
	및 평가하고 있으며			서만 거래를 하는 것	사간 자금을 공유하		연결회사의 재무위험
	투기적 외환거래는			을 원칙으로 하고 있	는 시스템으로 개별		관리의 주요 대상인
	엄격히 금지하고 있			으며, 기존에 거래가	회사의 유동성위험을		자산은 현금및현금성
	습니다.			없는 금융기관과의	최소화하고 자금운용		자산, 단기금융상품,
				신규 거래는 해당 기	부담을 경감시키며,		상각후원가금융자산,
							매출채권 등으로 구
				관에 대한 건전성 평	금융비용을 절감하는		성되어 있으며, 부채
				가 등을 거쳐 시행하	등의 효과가 있습니		는 매입채무, 차입금
				고 있습니다. 연결회	다.		등으로 구성되어 있
				사가 체결하는 금융			습니다.
				계약은 부채비율 제	또한 대규모 유동성		
				한 조항, 담보제공,	이 필요한 경우를 대		

				비하여 본사의 지급	
				보증을 통해 해외 종	
				속기업이 활용할 수	
				있는 차입한도를 확	
			차입금 회수 등의 제	보하고 있으며, 보고	
			약조건이 없는 계약	기간종료일 현재 국	
			을 위주로 체결하고	제신용평가기관인	
			있으며, 기타의 경우	Moody's로부터 Aa2,	
			별도의 승인을 받아	S&P로부터 AA- 등	
			거래하고 있습니다.	투자적격등급을 부여	
				받고 있어, 필요시 자	
				본시장을 통해 적기	
				에 자금조달이 가능	
				합니다.	
지분상품(상장주식					
)의 주가가 1% 변동		22.225			
할 경우 기타포괄손		66,935			
익에 미치는 영향					
지분상품(상장주식					
)의 주가가 1% 변동		1.051			
할 경우 당기손익에		1,351			
미치는 영향					

	위험	8									
	시장위험			신용위험	유동성위험	자본위험	위험 합계				
	환위험	이자율위험	지분가격위험	(USTS	750718	사는케임					
위험에 대한 노출정											
도에 대한 기술											
위험관리의 목적, 정											
책 및 절차에 대한 기											
술											
지분상품(상장주식											
)의 주가가 1% 변동											
할 경우 기타포괄손			81,526								
익에 미치는 영향											
지분상품(상장주식											
)의 주가가 1% 변동			4.000								
할 경우 당기손익에			4,309								
미치는 영향											

부채비율에 대한 공시

	총장부금액
부채	102,231,027
자본	383,526,671

0.267

	총장부금액
부채	92,228,115
자본	363,677,865
부채비율	0.254

공정가치 측정, 금융자산

당반기말 (단위:백만원)

	현금및현금성자산	단기금융상품	단기상각후원가금융	단기당기손익-공정	매출채권	기타포괄손익-공정	당기손익-공정가치	기타	금융자산, 분류 합
	202200112		자산	가치금융자산	-112-112	가치금융자산	금융자산	.,.,	Э
장부금액	49,844,405	50,921,350	0	29,758	43,660,885	9,202,104	1,360,016	10,318,127	165,336,645
공정가치			0	29,758		9,202,104	1,360,016	493,477	
장부금액이 공정가									
치의 합리적인 근사								9,824,650	
치로서 공정가치 공								3,024,030	
시 제외된 금융자산									
								장부금액이 공정가	
								치의 합리적인 근사	
								치이므로 일부 금융	
								자산 9,824,650백만	
	장부금액이 공정가	장부금액이 공정가			장부금액이 공정가			원(전기말:	
공정가치 공시 제외	치의 합리적인 근사	치의 합리적인 근사			치의 합리적인 근사			14,294,254백만원)	
사유에 대한 기술	치이므로 공정가치	치이므로 공정가치			치이므로 공정가치			및 금융부채	
자류에 대한 기술	공시대상에서 제외	공시대상에서 제외			공시대상에서 제외			12,242,163백만원	
	하였습니다.	하였습니다.			하였습니다.			(전기말:	
								11,330,545백만원	
)은 공정가치 공시대	
								상에서 제외하였습	
								니다.	

전기말 (단위: 백만원)

	현금및현금성자산	단기금융상품	단기상각후원가금융		매출채권	기타포괄손익-공정	당기손익-공정가치	기타	금융자산, 분류 합
	CORCOONE	2/10000	자산	가치금융자산		가치금융자산	금융자산	7IU	계
장부금액	69,080,893	22,690,924	608,281	27,112	36,647,393	7,481,297	1,431,394	14,840,275	152,807,569
공정가치				27,112		7,481,297	1,431,394	546,021	
장부금액이 공정가									
치의 합리적인 근사								14.294.254	
치로서 공정가치 공								14,294,254	
시 제외된 금융자산									

						장부금액이 공정가	
						치의 합리적인 근사	
						치이므로 일부 금융	
						자산 9,824,650백만	
	장부금액이 공정가	장부금액이 공정가	장부금액이 공정가	장부금액이 공정가		원(전기말:	
7777777777	치의 합리적인 근사	치의 합리적인 근사	치의 합리적인 근사	치의 합리적인 근사		14,294,254백만원)	
공정가치 공시 제외	치이므로 공정가치	치이므로 공정가치	치이므로 공정가치	치이므로 공정가치		및 금융부채	
사유에 대한 기술	공시대상에서 제외	공시대상에서 제외 공시대상	공시대상에서 제외	공시대상에서 제외		12,242,163백만원	
	하였습니다.	하였습니다.	하였습니다.	하였습니다.		(전기말:	
						11,330,545백만원	
)은 공정가치 공시대	
						상에서 제외하였습	
						니다.	

공정가치 측정, 금융부채

당반기말 (단위: 백만원)

	매입채무	단기차입금	미지급공	유동성장기부채	유동성장기차입금	유동성사채	사채	장기차입금	장기미지급금	기타	금융부채, 분류 합 계
장부금액	13,113,267	10,626,592	13,131,706	2,114,833	1,550,725	564,108	20,573	3,719,386	4,812,132	12,314,496	59,852,985
공정가치				557,099		557,099	23,873			72,333	
장부금액이 공정가											
치의 합리적인 근사										12.242.163	
치로서 공정가치 공										12,242,103	
시 제외된 금융부채											
										장부금액이 공정가	
					장부금액이 공정가			장부금액이 공정가		치의 합리적인 근사	
					치의 합리적인 근사			치의 합리적인 근사		치이므로 일부 금융	
					치이므로 공정가치			치이므로 공정가치		자산 9,824,650백만	
	장부금액이 공정가	장부금액이 공정가	장부금액이 공정가		공시대상에서 제외			공시대상에서 제외	장부금액이 공정가	원(전기말:	
공정가치 공시 제외	치의 합리적인 근사	치의 합리적인 근사	치의 합리적인 근사		하였습니다.			하였습니다.	치의 합리적인 근사	14,294,254백만원)	
사유에 대한 기술	치이므로 공정가치	치이므로 공정가치	치이므로 공정가치		리스부채는 기업회			리스부채는 기업회	치이므로 공정가치	및 금융부채	
A A Williams	공시대상에서 제외	공시대상에서 제외	공시대상에서 제외		계기준서 제1107호			계기준서 제1107호	공시대상에서 제외	12,242,163백만원	
	하였습니다.	하였습니다.	하였습니다.		'금융상품: 공시'에			'금융상품: 공시'에	하였습니다.	(전기말:	
					따라 공정가치 공시			따라 공정가치 공시		11,330,545백만원	
					대상에서 제외하였			대상에서 제외하였)은 공정가치 공시대	
					습니다.			습니다.		상에서 제외하였습	
										니다.	

전기말 (단위:백만원)

	매입채무	단기차입금	미지급공	유동성장기부채	유동성장기차입금	유동성사채	사채	장기차입금	장기미지급금	기타	금융부채, 분류 합 계
장부금액	11,319,824	7,114,601	13,996,395	1,308,875	1,302,521	6,354	537,618	3,724,850	4,907,875	11,414,008	54,324,046
공정가치				6,757		6,757	529,254			83,463	
장부금액이 공정가											
치의 합리적인 근사										11,330,545	
치로서 공정가치 공										,	
시 제외된 금융부채											

								장부금액이 공정가	
				장부금액이 공정가		장부금액이 공정가		치의 합리적인 근사	
				치의 합리적인 근사		치의 합리적인 근사		치이므로 일부 금융	
				치이므로 공정가치		치이므로 공정가치		자산 9,824,650백만	
	장부금액이 공정가	장부금액이 공정가	장부금액이 공정가	공시대상에서 제외		공시대상에서 제외	장부금액이 공정가	원(전기말:	
77776 74 70	치의 합리적인 근사	치의 합리적인 근사	치의 합리적인 근사	하였습니다.		하였습니다.	치의 합리적인 근사	14,294,254백만원)	
공정가치 공시 제외	치이므로 공정가치	치이므로 공정가치	치이므로 공정가치	리스부채는 기업회		리스부채는 기업회	치이므로 공정가치	및 금융부채	
사유에 대한 기술	공시태상에서 제외	공시대상에서 제외	공시대상에서 제외	계기준서 제1107호		계기준서 제1107호	공시대상에서 제외	12,242,163백만원	
	하였습니다.	하였습니다.	하였습니다.	'금융상품: 공시'에		'금융상품: 공시'에	하였습니다.	(전기말:	
				따라 공정가치 공시		따라 공정가치 공시		11,330,545백만원	
				대상에서 제외하였		대상에서 제외하였)은 공정가치 공시대	
				습니다.		습니다.		상에서 제외하였습	
								니다.	

급용상품의 공정가치 서말체계에 따른 수준별 공시

당반개발

	측정 전체																											
	공정가치	高發力和																										
	35 d 8																											
	단기당기슨박-공경기치금융자산 기단포군은박-공경기치금융자산 당기슨박-공경기치금융자산 기단금융자산 위동성사재 시재 기단금융부제																											
	공정가치 서	너맨체계의 도	는 수준	공정가치	공정가치 사	너맨체계의 도	는 수준	공정가치	공정가치 서	1명체계의 모	는 수준	공정가치	공정가치 사	너밀체계의 모	든 수준	공정가치	공정가치 서	서밀체계의 도	은 수준	공정가치	공정가치 서	1명체계의 모	든 수준	공정가치	공정가치 서	1일체계의 모	는 수준	공정가치
	수준 1	수준 2	수문 3	서앤체계 의 모든 수준 항 계	수준 1	수준 2	수문 3	서앤체계 의 모든 수준 항 계	수 년 -	수준 2	中臣 3	서열체계 의 모든 수준 항 계	수준 1	수준 2	수준 3	서명체계 의 모든 수준 함 계	수준 1	수준 2	全是3	서열제계 의 모든 수준 항 계	수준 1	수준 2	수준 3	서명체계 의 모든 수준 항 계	수준 1	수준 2	◆是3	서명체계 의 모든 수준 항 계
금융자산	0	29,758	0	29,758	6,693,49	0	2,508,61	9,202,10	135,120	0	1,224,89	1,360,01	0	117,757	375,720	493,477												
금융부채																	0	557,099	0	557,099	0	23,873	0	23,873	0	72,333	0	72,333

전기점 (단위: 백단원)

	측정 전체																											
	공정가치																											
	단기당기슨익-공경기치급병자산 기단포관슨역-공경기치급형자산 당기슨역-공경기치급형자산 기단급용자산 위통성사책 시채 기단급용부제																											
	공정가치 서	너맨체계의 모	는 수준	공정가치	공정가치 사	서열체계의 도	은 수준	공정가치	공정가치 서	서열체계의 모	는 수준	공정가치	공정가치 사	서밀체계의 모	든 수준	공정가치	공정가치 /	서열체계의 도	은 수준	공정가치	공정가치 서	너멸체계의 모	!든 수준	공정가치	공정가치 서	너말체계의 모		공정가치
	수준 1	수준 2	수준 3	서열체계 의 모든 수준 항 계	수준 1	수준 2	수준 3	서열체계 의 모든 수준 함 계	全世 1	수준 2	中臣 3	서열체계 의 모든 수준 항 계	수준 1	수준 2	◆是 3	서열체계 의 모든 수준 항 계	수준 1	수준 2	中준 3	서열체계 의 모든 수준 왕 계	中 臣 1	수준 2	◆ē3	서밀체계 의 모든 수준 항 계	수준 1	수준 2	◆준 3	서열체계 의 모든 수준 참 계
금융자산	0	27,112	0	27,112	5,250,99	0		7,481,29	347,221	0	1,084,17	1,431,39	0	130,364	415,657	546,021												
금융부채																	0	6,757	0	6,757	0	529,254	0	529,254	0	83,463	0	83,463

금융상품의 공정가치측정에 대한 공시

공정가치	서열체계 수	준	공정가치	서열체계	수준	공정가치	서열체계	수준
1		1	2			3		

공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 자산	동일한 자산에 대한 시 장 공시가격	시장에서 관측가능한 투 입변수를 활용한 공정가 치 (단, '수준 1'에 포함 된 공시가격은 제외)	
공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 부채	동일한 부채에 대한 시 장 공시가격	시장에서 관측가능한 투 입변수를 활용한 공정가 치 (단, '수준 1'에 포함 된 공시가격은 제외)	관측가능하지 않은 투입 변수를 활용한 공정가치

평가기법 및 투입변수에 대한 기술

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품은 '수준 1'에 포함됩니다. '수준 1'에 포함된 상품은 대부분 기타포괄손익-공정가치금융자산으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다.

활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 가치평가기법을 사용하여 측정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용됩니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 '수준 2'에 포함됩니다. '수준 2'에포함된 상품은 파생상품, 사채 등이 있습니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 '수준 3'에 포함됩니다.

연결회사는 '수준 3'으로 분류되는 공정가치 측정을 포함하여 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있습니다. 재무보고 일정에 맞추어 공정가치 평가 과정 및 그 결과에 대해 협의하고 있고, 공정가치 '수준' 간 이동을 발생시키는 사건이나 상황의 변동이 일어난 보고기간종료일에 '수준' 변동을 인식하고 있습니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.

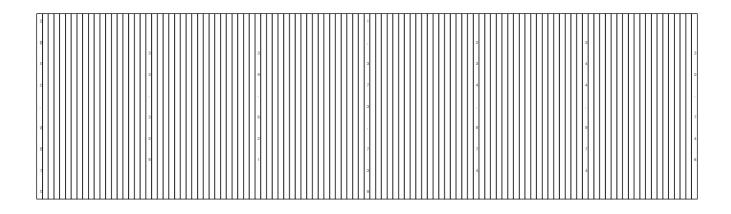
- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격
- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정

나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법, 이항분포 모형 등의 기타 가치평가기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.

연결회사는 공정가치 서열체계에서 '수준 2'로 분류되는 회사채, 국공채, 금융채 등에 대하여 미래현 금흐름을 적정이자율로 할인하는 현재가치법을 사용하고 있습니다.

보고기간종료일 현재 '수준 3'으로 분류된 주요 금융상품에 대하여 사용된 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.

			1	t	ŀ	
	7 전 등 번 수 150 위 성 우 12 우		기타	38	_	
0 1 0 0	==		포괄(상품	_	
	마종 전 보는 이 등 등 전 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이	자중	익-;		_	
0 . 1 6 0 0	1 1 2 2 2		공정		_	
	무위 이 이 2월 수 두 두 번 수 두 두 부 후 후 후 후 후 후 후 후 후 후 후 후 후 후 후 후 후	변수	마치금) 모든 수준 3	
	2 2		:8x		_	
	19 전		산		_	
	선					
	1, 정					
	가 변 성 즉 두 변 병 명 이 후 부 부 후					
	2,					
2 2	00 0		1			
	7 전 등 번 수 150 위 6 우 12 우	(취미 관측				
0 0 0 0		코세i 할 수				
	가 중 경간 본 영 중 이 일 상 수 이 이 위 1일 무					
0 0 1 1 1 1 0 0						
	무유 원 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 8 8 9 9 9 8 9	임변				
	OI BY					
	정 자 2.					
	축 투 번					
	6					
	구격 등 11. 7경 임임 수 : II 은 우 밥 무					
	4 4					
	가격 전용 2. 전쟁 인강 수 40 개 이 무 150 무					
	数 2 年 年 8 8 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	T				
	00 00 00	Ŧ	Ττ			
	구구 경장 두 두 발전 h	DSO [*]	CL C			
0 . 0 0 0	7 E	_	hina			
	가 등 경 전 전 경 경 전 수 등 기 이 수 무 150 무	없는	Sta			
0 0 7 7 0		투원	r On			
	무 30 자 1. 전 25 수 35 위 3 수 5 분 후	변수	toek			
	1	,	ectro			
	무우 왕 () 전 3 2 2 2 3 3 2 2 5 5 6 7 7 8 2 5 7 7 8 2 7 7 7 8 2 7 7 7 8 2 7 7 7 8 2 7 7 7 8 2 7 7 7 8 2 7 7 7 8 2 7 7 7 8 2 7 7 7 8 2 7 7 7 8 2 7 7 7 8 2 7 7 7 8 2 7 7 7 8 2 7 7 7 8 2 7 7 7 8 2 7 7 7 8 2 7 7 7 8 2 7 7 7 8 2 7 7 7 8 2 7 7 8 2 7 7 8 2 7 7 8 2 7 7 8 2 7 7 8 2 7 7 8 2 7 7 8 2 7 7 8 2 7 7 8 2 7 8		nics			
	DI E		Tec			
	77 E 80 45 F E 15 15 F F F F F F F F F F F F F F F F F		chno			
	등 1. 정 일 수		logy			
	50 AT F		Co			
	건 용 2. 전 임 수 역 위 본 위		Ltd			
OF THE						
	명 정 해 라 수 첫 뒤 이 다 게 다		Chi			
0 0 0	9 =	_	na S			
	가 등 경 자 자 비비 축 무 전 등 위 위 이 무 비 무	-	tar C			
0 0 7 0	P1 A1 A5 20 20	Ltd 는 두	ntoe			
	中 20 以 1. 20 25 中 30 中 第 中 </td <td>_</td> <td>electr</td> <td></td> <td></td> <td></td>	_	electr			
	이 후 후 투	OSD"	ronic			
	X)	T)	-× S#			
	축 무 번		emic			
	6		ondi			
	전 전 등 1. 경 등 일 수 등 기 수 두 보 두		uctor			
			r Dist			
	가격 경		nlav			
0 8		T				
	8		71			
	. =		Eł			
	평 자 비 축 무	음선 수 8				
	용. 정 입 수	t는 5				
	Į.	임반				
4 4 4	이 85 축 투	10				
	XI 2,					
	Q					
	4 4					
	가격 경동 1. 점점 안입 수 당 각 수 무 없 무					
0 . 6 6 6 0						
	가격 등 2. 전 일 수 등 등 위 3 우 15 우					
	27 6 77					
	00 0	1	T			
	구 25 M 및 15 수 15 위 0 우 15 무	지문				
	가 50 자 보 8 50 CB 수 50 위 60 우 15 우					
		· = 6				
0 0 0 0 0 0 0 0 0	무위 20 자 1.1 전 25 전 수 35 위 전 위 전 위 전 위	일번수				
	H	,				
	무두 점					
0 1 7 0	- The The Late					
	가 한 성 작 부 한 천 청 위 이 무 설 무					
0 . 2 1 1 4 0	1. 20					
	가 가 한 전 성 성 상 수 하 수 있 전 수 있 수 있 수 있 수 있 수 있 수 있 수 있 수 있 수					
0	10 CZ 20 20					
				1	+	
						ı



자산의 공정가치측정에 대한 공시

당반기 (단위: 백만원)

	수준 3
기초금융자산	3,730,134
매입	160,771
매도	(13,928)
당기손익으로 인식된 손익	(5,233)
기타포괄손익으로 인식된 손익	104,246
기타	133,237
반기말금융자산	4,109,227

전반기 (단위: 백만원)

	수준 3
기초금융자산	3,303,227
매입	120,995
매도	(3,216,022)
당기손익으로 인식된 손익	248,191
기타포괄손익으로 인식된 손익	3,124,848
기타	(88,555)
반기말금융자산	3,492,684

부채의 공정가치측정에 대한 공시

당반기 (단위: 백만원)

	공정가치 서열체계 수준 3
기초금융부채	0
당기손익으로 인식된 손익	0
반기말금융부채	0

공정가치 서열체계 수준 3

기초금융부채	7,404
당기손익으로 인식된 손익	0
반기말금융부채	7,404

관측할 수 없는 투입변수의 변동으로 인한 공정가치측정의 민감도분석 공시, 자산

	공정가치 서열체계의	모든 수준									
	공정가치 서열체계 수	준 3									
	자산										
	기타포괄손익-공정가	치금융자산				기타					
	관측할 수 없는 투입년	1	Г	ı	관측할 수 없는 투입	관측할 수 없는 투입변		관측할 수 없는 투입	자산 합계		
	영구성장률, 투입변	가중평균자본비용.	기초 자산 가격, 측	가격 변동성	변수 합계	영구성장률, 투입변	가중평균자본비용.	기초 자산 가격, 측	가격 변동성	변수 합계	
	수	측정 투입변수	정 투입변수		CT 6/1	수	측정 투입변수	정 투입변수		CT 6/1	
											금융상품의 민감도
											분석은 통계적 기법
											을 이용한 관측 불가
											능한 투입변수의 변
											동에 따른 금융상품
											의 가치 변동에 기초
											하여 유리한 변동과
											물리한 변동으로 구
											분하여 이루어집니
	주요 관측물가능한	주요 관측물가능한						주요 관측불가능한	주요 관측불가능한		다. 그리고 공정가치
관측가능하지 않은	투입변수인 영구성	투입변수인 영구성						투입변수인 기초자	투입변수인 기초자		가 두 개 이상의 투
투입변수의 변동으		장률 및 가중평균자						산 가격(20%) 및 가	산 가격(20%) 및 가		입변수에 영향을 받
로 인한 공정가치축	본비용을 1% 증가	본비용을 1% 증가						격 변동성(10%)을	격 변동성(10%)을		는 경우에는 가장 유
정치의 민감도에 대	또는 감소시킴으로	또는 감소시킴으로						증가 또는 감소시킴	증가 또는 감소시킴		리하거나 또는 가장
한 기술, 자산		써 공정가치 변동을						으로써 공정가치 변	으로써 공정가치 변		불리한 금액을 바탕
	산출하였습니다.	산출하였습니다.						동을 산출하였습니	동을 산출하였습니		으로 산출됩니다.
								다.	다.		
											당반기말 현재 '수준
											3'으로 분류되는 주
											요 금융상품의 투입
											변수의 변동에 따른
											손익효과(자본은 법
											인세효과 반영 전 효
											과)에 대한 민감도분
											석 결과는 다음과 같
											습니다.
관측할 수 없는 투입											
변수의 가능성이 어	0.01	0.01						0.20	0.10		
느 정도 있는 증가율											
. 자산											
관측할 수 없는 투입											
변수의 가능성이 어	0.01	0.01						0.20	0.10		
느 정도 있는 감소율											
, 자산											

당기손익(세전)으로							
인식된, 가능성이 어							
느 정도 있고 대체할							
수 있는 가정을 반영							
하기 위한 하나 이상			0			97,165	
의 관측할 수 없는							
투입변수의 변동으							
로 인한 공정가치 측							
정치의 증가, 자산							
당기손익(세전)으로							
인식된, 가능성이 어							
느 정도 있고 대체함							
수 있는 가정을 반영							
하기 위한 하나 이상			0			(91,127)	
의 관측할 수 없는							
투입변수의 변동으							
로 인한 공정가치 축							
정치의 감소, 자산							
기타포괄손익(세전							
)으로 인식된, 가능							
성이 어느 정도 있고							
대체할 수 있는 가정							
을 반영하기 위한 하			400.000				
나 이상의 관측할 수			192,922			0	
없는 투입변수의 변							
동으로 인한 공정가							
치 측정치의 증가.							
자산							
기타포괄손익(세전		 			 		
)으로 인식된, 가능							
성이 어느 정도 있고							
대체할 수 있는 가정							
을 반영하기 위한 하			(128,149)			0	
나 이상의 관측할 수			(120,149)				
없는 투입변수의 변							
동으로 인한 공정가							
치 측정치의 감소,							
자산							

26. 부문별 보고 (연결)

영업부문에 통합기준을 적용하면서 이루어진 경영진의 판단에 대한 설명

가. 부문별 정보

연결회사는 전략적 의사결정을 수립하는 경영진(경영위원회)에게 보고되는 사업 단위를 기준으로 보고부문을 결정하고 있습니다. 경영위원회는 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 부문의 영업이익을 기준으로 검토하고 있습니다.

매출은 대부분 재화의 매출로 구성되어 있습니다. 연결회사의 보고부문은 조직 및 수익을 창출하는 제품의 유형을 기준으로 식별되었으며, 보고기간종료일 현재 보고부문은 DX 부문, DS 부문, SDC, Harman 등으로 구성되어 있습니다.

당반기와 전반기의 보고부문의 부문별 정보는 감가상각비, 무형자산상각비, 영업이익의 내부거래조정이 배분된 후로 작성되었으며, 보고부문별 자산과 부채는 경영위원회에 정기적으로 제공되지 않아 포함하지 않았습니다.

영업부문에 대한 공시

당반기 (단위:백만환)

	기업 전체 총계											
	영업부문										기업 전체 총계 합계	
	DX 부문 DS부문 SDC Harman							내부거래 조정 등				
	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적
매출액	42,070,812	89,363,554	28,556,551	51,693,841	7,646,160	13,032,578	3,619,094	6,819,344	(7,824,315)	(14,925,414)	74,068,302	145,983,903
감가상각비	642,611	1,282,358	7,997,543	15,846,606	600,870	1,208,284	88,150	173,547	0	0	9,375,848	18,607,158
무형자산상각비	406,325	808,861	172,900	325,346	58,090	114,475	55,240	108,492	0	0	746,072	1,465,554
영업이익	2,722,479	6,797,370	6,450,960	8,364,975	1,010,107	1,350,791	320,086	560,925	0	0	10,443,878	17,049,887
											기타는 별도로 표	기타는 별도로 표
보고부문에 대한											시하지 않았습니다	시하지 않았습니다
기술												

전반기

	기업 전체 총계											
	영업부문								내부거래 조정 등		기업 전체 총계 합계	
	DX 부문 SDC Harman							내무기대 소영 등				
	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적
매출액	40,206,174	86,428,687	14,729,264	28,463,739	6,483,066	13,097,217	3,495,745	6,661,642	(4,908,716)	(10,900,381)	60,005,533	123,750,904
감가상각비	640,513	1,255,917	7,188,749	14,411,510	804,766	1,637,600	83,040	163,068	0	0	8,767,744	17,568,639
무형자산상각비	433,138	850,496	192,575	399,184	55,624	110,647	50,578	99,681	0	0	790,853	1,576,451
영업이익	3,829,380	8,038,140	(4,361,844)	(8,943,698)	843,069	1,619,085	251,381	380,330	0	0	668,547	1,308,725
											기타는 별도로 표	기타는 별도로 표
보고부문에 대한											시하지 않았습니다	시하지 않았습니다
기술												
												-

제품과 용역에 대한 공시

당반기 (단위: 백만원)

	제품과 용역								→ 제품과 용역 합계			
	TV, 모니터 등	모니터 등 이모리 다스플레이 패널								NOW 07 87		
	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적		
매출액	7,543,535	14,777,506	26,641,045	59,432,418	21,737,835	39,232,102	7,646,160	13,032,578	74,068,302	145,983,903		
주요 제품별 매출액에									기타는 별도로 표시하	기타는 별도로 표시하		
대한 기술									지 않았습니다.	지 않았습니다.		

전반기 (단위 : 백만원)

제품과 용역	제품과 용역 합계			

	TV, 모니터 등		스마트폰 등		메모리		디스플레이 패널				
	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	
매출액	7,245,758	14,680,693	24,608,693	55,353,244	8,967,359	17,884,356	6,483,066	13,097,217	60,005,533	123,750,904	
주요 제품별 매출액에									기타는 별도로 표시하	기타는 별도로 표시하	
대한 기술									지 않았습니다.	지 않았습니다.	

지역에 대한 공시

영명 (연위 : 역명원)

	지역													
	국내		외국								연결실체 내 내부거래?	- 74	지역 함계	
	독대		미주		유럽		아시아 및 아프리카	아시아 및 아프리카		중국		28		
	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적
순매출액	9,716,061	19,129,508	28,106,541	53,495,384	11,950,985	25,170,012	11,964,076	24,643,389	12,330,639	23,545,610	0	0	74,068,302	145,983,903
비유동자산	168,415,310	168,415,310	24,771,439	24,771,439	6,530,006	6,530,006	9,323,143	9,323,143	11,223,820	11,223,820	(2,190,612)	(2,190,612)	218,073,106	218,073,106
													금융상품, 이연범인세	금융상품, 이연범인세
비유동자산에 대한 기													자산, 관계기업 및 공	자산, 관계기업 및 공
金													동기업 투자 등이 제	동기업 투자 등이 제
													외된 금액입니다.	외된 금액입니다.

단위: 백간명

	지역													
	ищ		외국								연결실체 내 내부거래:	E 24	지역 항계	
	독대		미주		유럽		아시아 및 아프리카	아시아 및 아프리카		중국		28		
	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적
순대출액	10,269,812	21,570,240	21,321,961	44,084,412	11,064,655	23,647,578	11,012,989	22,547,328	6,336,116	11,901,346	0	0	60,005,533	123,750,904
비유동자산	156,560,136	156,560,136	16,470,864	16,470,864	6,132,379	6,132,379	9,199,292	9,199,292	13,857,391	13,857,391	(919,886)	(919,886)	201,300,176	201,300,176
													금융상품, 이연범인세	금융상품, 이연범인세
비유동자산에 대한 기													자산, 관계기업 및 공	자산, 관계기업 및 공
ż													동기업 투자 등이 제	동기업 투자 등이 제
													외된 금액입니다.	외된 금액임니다.

27. 특수관계자와의 거래 (연결)

특수관계자거래에 대한 공시

	전체 특수관계자	특수관계자										
	특수관계자											
	관계기업 및 공동기업					그 밖의 특수관계자		당해 기업이나 당해 기				
	삼성에스디에스㈜	삼성전기㈜	삼성SDI㈜	㈜제일기획	기타 관계기업 및 공동	삼성물산㈜	기타 그 밖의 특수관계	업의 지배기업의 주요				
	06W_UW_M	000/167	8 8 0 D (#)		기업	002011	자	경영진				
매출 등, 특수관계자거	7, 0,0			00.700	550.500		0.45.000					
래	71,213	34,642	60,213	33,769	556,539	15,182	345,332					
비유동자산 처분, 특수			0		100	_						
관계자거래	0	0	0	0	122	0	0					
매입 등, 특수관계자거	1,003,700	646,831	324,582	475,811	5,977,736	120,875	728,388					
래	1,000,700	040,001	524,502	473,011	3,811,100	120,013	720,000					
비유동자산 매입, 특수	127,410	0	14,420	11,582	134,914	3,064,307	2,394,910					
관계자거래	127,410	0	14,420	11,502	134,914	3,064,307	2,394,910					
단기급여								4,832				
퇴직급여								336				
기타 장기급여								4,424				

| ſ | | 연결회사와 특수관계 | |
|---|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 에 있는 개별회사와의 | |
| | 한 기술 | 거래 금액입니다. | |

	전체 특수관계자							
	특수관계자							
	관계기업 및 공동기업					그 밖의 특수관계자		당해 기업이나 당해 기
	삼성에스디에스㈜	삼성전기㈜	삼성SDI㈜	㈜제일기획	기타 관계기업 및 공동	삼성물산㈜	기타 그 밖의 특수관계	업의 지배기업의 주요
					기업		자	경영진
매출 등, 특수관계자거		51.100						
래	101,310	51,439	69,556	36,039	466,197	27,964	262,577	
비유동자산 처분, 특수	0	0	0	0	0	70	0	
관계자거래	0		٥	0	0	70	0	
매입 등, 특수관계자거	070.000	040.000	000.005	440.000	0.070.005	400 400	054.000	
래	970,023	610,203	363,305	440,390	6,373,995	133,436	951,690	
비유동자산 매입, 특수	152,478		16,983	76	51,275	4 004 000	1,548,222	
관계자거래	152,476	60	10,903	/6	51,275	1,994,302	1,540,222	
단기급여								5,154
퇴직급여								279
기타 장기급여								3,917
	연결회사와 특수관계	연결회사와 특수관계	연결회사와 특수관계					
특수관계자거래에 대	에 있는 개별회사와의	에 있는 개별회사와의	에 있는 개별회사와의					
한 기술	거래 금액입니다.	거래 금액입니다.	거래 금액입니다.					

특수관계자거래에 대한 공시, 합계

	전체 특수관계자		
	특수관계자		전체 특수관계자 합계
	관계기업 및 공동기업	그 밖의 특수관계자	
매출 등, 특수관계자거 래	756,376	360,514	
비유동자산 처분, 특수 관계자거래	122	0	
매입 등, 특수관계자거 래	8,428,660	849,263	
비유동자산 매입, 특수 관계자거래	288,326	5,459,217	
출자, 특수관계자거래	9,342		
출자금 회수, 특수관계 자거래	18,965		
지급결의한 배당금, 특 수관계자거래			813,272
리스 이용 계약, 특수관 계자거래			23,691

리스이용자로서 리스,		15.004
특수관계자거래		15,334

	전체 특수관계자		
	특수관계자	전체 특수관계자 합계	
	관계기업 및 공동기업 그 밖의 특수관계자		
매출 등, 특수관계자거 래	724,541	290,541	
비유동자산 처분, 특수 관계자거래	0	70	
매입 등, 특수관계자거 래	8,757,916	1,085,126	
비유동자산 매입, 특수 관계자거래	220,872	3,542,524	
출자, 특수관계자거래	65,182		
출자금 회수, 특수관계 자거래	17,839		
지급결의한 배당금, 특 수관계자거래			825,850
리스 이용 계약, 특수관 계자거래			1,762
리스이용자로서 리스, 특수관계자거래			10,259

대규모기업집단 소속회사 거래에 대한 공시

	거래상대방			
	대규모기업집단 소득	속회사		 거래상대방 합계
	삼성이앤에이㈜	㈜에스원	기타 대규모기업집 단 소속회사	7410410 671
매출 등, 대규모기 업집단 소속회사 거래	375	3,800	117,724	121,899
비유동자산 처분, 대규모기업집단 소 속회사 거래	0	0	0	0
매입 등, 대규모기 업집단 소속회사 거래	29,732	264,196	151,299	445,227

비유동자산 매입, 대규모기업집단 소 속회사 거래	1,554,928	9,630	490,573	2,055,131
지급결의한 배당금 , 대규모기업집단 소속회사 거래				64,116
대규모기업집단 소 속회사 거래에 대 한 기술	연결회사와 특수관 계에 있는 개별회 사와의 거래 금액 입니다.	연결회사와 특수관 계에 있는 개별회 사와의 거래 금액 입니다.	연결회사와 특수관 계에 있는 개별회 사와의 거래 금액 입니다.	
대규모기업집단 소 속회사 관계의 성 격에 대한 기술		기업회계기준서 제 1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나「독점규제 및 공정거래에 관 한 법률」에 따른 동일한 대규모기업 집단 소속회사입니다.	기업회계기준서 제 1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나「독점규제 및 공정거래에 관 한 법률」에 따른 동일한 대규모기업 집단 소속회사입니 다.	

	거래상대방			
	대규모기업집단 소득		거래상대방 합계	
	삼성이앤에이㈜	㈜에스원	기타 대규모기업집 단 소속회사	7410410 11
매출 등, 대규모기 업집단 소속회사 거래	761	5,381	96,497	102,639
비유동자산 처분, 대규모기업집단 소 속회사 거래	0	0	0	0
매입 등, 대규모기 업집단 소속회사 거래	15,319	261,314	387,511	664,144
비유동자산 매입, 대규모기업집단 소 속회사 거래	1,400,444	23,155	196,225	1,619,824
지급결의한 배당금 , 대규모기업집단 소속회사 거래				64,116
대규모기업집단 소 속회사 거래에 대 한 기술	연결회사와 특수관 계에 있는 개별회 사와의 거래 금액 입니다.	연결회사와 특수관 계에 있는 개별회 사와의 거래 금액 입니다.	연결회사와 특수관 계에 있는 개별회 사와의 거래 금액 입니다.	

	기업회계기준서 제	기업회계기준서 제	기업회계기준서 제	
	1024호 특수관계자	1024호 특수관계자	1024호 특수관계자	
	범위에 포함되지	범위에 포함되지	범위에 포함되지	
대규모기업집단 소	않으나「독점규제	않으나「독점규제	않으나「독점규제	
속회사 관계의 성	및 공정거래에 관	및 공정거래에 관	및 공정거래에 관	
격에 대한 기술	한 법률」에 따른	한 법률」에 따른	한 법률」에 따른	
	동일한 대규모기업	동일한 대규모기업	동일한 대규모기업	
	집단 소속회사입니	집단 소속회사입니	집단 소속회사입니	
	다.	다.	다.	

특수관계자에 대한 채권 채무에 대한 공시

당반기말 (단위:백만원)

	전체 특수관계자							
	특수관계자	특수관계자						
	관계기업 및 공동기업					그 밖의 특수관계자		
		4447777			기타 관계기업 및 공		기타 그 밖의 특수관	
	삼성에스디에스㈜	삼성전기㈜	삼성SDI㈜	㈜제일기획	동기업	삼성물산㈜	계자	
채권 등, 특수관계자	5.727	1.550	101.070	93	250 142	211 722	27.405	
거래	5,727	1,550	121,972	93	259,143	211,722	37,485	
채무 등, 특수관계자	504.744	150,000	54.070	200 200		504.040	0.40.400	
거래	564,714	153,366	54,670	298,329	1,119,180	584,318	342,430	
	연결회사와 특수관계	연결회사와 특수관계	연결회사와 특수관계	연결회사와 특수관계	연결회사와 특수관계	연결회사와 특수관계	연결회사와 특수관계	
	에 있는 개별회사에	에 있는 개별회사에	에 있는 개별회사에	에 있는 개별회사에	에 있는 개별회사에	에 있는 개별회사에	에 있는 개별회사에	
	대한 채권ㆍ채무 금	대한 채권·채무 금	대한 채권ㆍ채무 금	대한 채권ㆍ채무 금	대한 채권·채무 금	대한 채권ㆍ채무 금	대한 채권ㆍ채무 금	
특수관계자 채권채무	액입니다.	액입니다.	액입니다.	액입니다.	액입니다.	액입니다.	액입니다.	
에 대한 기술	채무 등은 리스부채	채무 등은 리스부채	채무 등은 리스부채	채무 등은 리스부채	채무 등은 리스부채	채무 등은 리스부채	채무 등은 리스부채	
	가 포함된 금액입니	가 포함된 금액입니	가 포함된 금액입니	가 포함된 금액입니	가 포함된 금액입니	가 포함된 금액입니	가 포함된 금액입니	
	다.	다.	다.	다.	다.	다.	다.	

전기말 (단위: 백만원)

	전체 특수관계자								
	특수관계자	특수관계자							
	관계기업 및 공동기업					그 밖의 특수관계자			
	삼성에스디에스㈜	삼성전기㈜	삼성SDI㈜	㈜제일기획	기타 관계기업 및 공	삼성물산㈜	기타 그 밖의 특수관		
					동기업		계자		
채권 등, 특수관계자	84.747	1,894	117,690	137	310,708	213,538	23,155		
거래	01,717	1,001	117,000	107	010,700	210,300	20,100		
채무 등, 특수관계자	458.723	138,405	92,854	440,414	1,268,131	1,955,976	318,355		
거래	430,723	130,403	32,004	440,414	1,200,101	1,933,970	310,033		
	연결회사와 특수관계	연결회사와 특수관계	연결회사와 특수관계	연결회사와 특수관계	연결회사와 특수관계	연결회사와 특수관계	연결회사와 특수관계		
	에 있는 개별회사에	에 있는 개별회사에	에 있는 개별회사에	에 있는 개별회사에	에 있는 개별회사에	에 있는 개별회사에	에 있는 개별회사에		
	대한 채권·채무 금	대한 채권·채무 금	대한 채권·채무 금	대한 채권·채무 금	대한 채권·채무 금	대한 채권·채무 금	대한 채권ㆍ채무 금		
특수관계자 채권채무 에 대한 기술	액입니다.	액입니다.	액입니다.	액입니다.	액입니다.	액입니다.	액입니다.		
에 대한 기술	채무 등은 리스부채	채무 등은 리스부채	채무 등은 리스부채	채무 등은 리스부채	채무 등은 리스부채	채무 등은 리스부채	채무 등은 리스부채		
	가 포함된 금액입니	가 포함된 금액입니	가 포함된 금액입니	가 포함된 금액입니	가 포함된 금액입니	가 포함된 금액입니	가 포함된 금액입니		
	다.	다.	다.	다.	다.	다.	다.		

	전체 특수관계자		
	특수관계자	전체 특수관계자 합계	
	관계기업 및 공동기업		
채권 등, 특수관계자거 래	388,485	249,207	
채무 등, 특수관계자거 래	2,190,259	926,748	
미지급 배당금, 특수관 계자거래			0

전반기 (단위: 백만원)

	전체 특수관계자		
	특수관계자	전체 특수관계자 합계	
	관계기업 및 공동기업		
채권 등, 특수관계자거 래	515,176	236,693	
채무 등, 특수관계자거 래	2,398,527	2,274,331	
미지급 배당금, 특수관 계자거래			0

대규모기업집단 소속회사에 대한 채권 채무에 대한 공시

	거래상대방			
	대규모기업집단 소득	속회사		거래상대방 합계
	삼성이앤에이㈜	㈜에스원	기타 대규모기업집 단 소속회사	71410410 1171
수취채권, 대규모 기업집단 소속회사 거래	248	1,428	14,067	15,743
채무액, 대규모기 업집단 소속회사 거래	1,208,907	49,469	145,716	1,404,092
미지급 배당금, 대 규모기업집단 소속 회사 거래				0

대규모기업집단 소 속회사 거래에 대 한 기술	연결회사와 특수관 계에 있는 개별회 사에 대한 채권 · 채무 금액입니다. 채무 등은 리스부 채가 포함된 금액 입니다.	연결회사와 특수관 계에 있는 개별회 사에 대한 채권· 채무 금액입니다. 채무 등은 리스부 채가 포함된 금액 입니다.	연결회사와 특수관 계에 있는 개별회 사에 대한 채권· 채무 금액입니다. 채무 등은 리스부 채가 포함된 금액 입니다.	
대규모기업집단 소 속회사 관계의 성 격에 대한 기술	범위에 포함되지 않으나「독점규제 및 공정거래에 관	기업회계기준서 제 1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나「독점규제 및 공정거래에 관 한 법률」에 따른 동일한 대규모기업 집단 소속회사입니다.	기업회계기준서 제 1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나「독점규제 및 공정거래에 관 한 법률」에 따른 동일한 대규모기업 집단 소속회사입니다.	

	거래상대방			
	대규모기업집단 소득	 거래상대방 합계		
	삼성이앤에이㈜	㈜에스원	기타 대규모기업집 단 소속회사	7410410 11
수취채권, 대규모 기업집단 소속회사 거래	305	1,289	16,096	17,690
채무액, 대규모기 업집단 소속회사 거래	807,098	49,955	390,073	1,247,126
미지급 배당금, 대 규모기업집단 소속 회사 거래				0
대규모기업집단 소 속회사 거래에 대 한 기술	연결회사와 특수관 계에 있는 개별회 사에 대한 채권 • 채무 금액입니다. 채무 등은 리스부 채가 포함된 금액 입니다.	연결회사와 특수관 계에 있는 개별회 사에 대한 채권 • 채무 금액입니다. 채무 등은 리스부 채가 포함된 금액 입니다.	연결회사와 특수관 계에 있는 개별회 사에 대한 채권 · 채무 금액입니다. 채무 등은 리스부 채가 포함된 금액 입니다.	

	기업회계기준서 제	기업회계기준서 제	기업회계기준서 제	
	1024호 특수관계자	1024호 특수관계자	1024호 특수관계자	
	범위에 포함되지	범위에 포함되지	범위에 포함되지	
대규모기업집단 소	않으나「독점규제	않으나「독점규제	않으나「독점규제	
속회사 관계의 성	및 공정거래에 관	및 공정거래에 관	및 공정거래에 관	
격에 대한 기술	한 법률」에 따른	한 법률」에 따른	한 법률」에 따른	
	동일한 대규모기업	동일한 대규모기업	동일한 대규모기업	
	집단 소속회사입니	집단 소속회사입니	집단 소속회사입니	
	다.	다.	다.	

28. 매각예정분류(처분자산집단) (연결)

매각예정비유동자산, 부채, 및 자본에 대한 공시

당반기말 (단위: 백만원)

	매각예정 비유동자산
현금및현금성자산	
매출채권	
유동재고자산	
기타유동자산	
유형자산 및 무형자산	
기타비유동자산	
매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집 단	
유동부채	
비유동부채	
매각예정으로 분류된 처분자산집단에 포함된 부 채	
해외사업장환산외환차이	
매각예정 지분율	
계약체결일자	
처분 또는 재분류된 매각예정으로 분류된 비유동 자산이나 처분자산집단에 대한 기술	

전기말 (단위: 백만원)

	매각예정 비유동자산
현금및현금성자산	14,153
매출채권	1,316
유동재고자산	4,697
기타유동자산	13,134
유형자산 및 무형자산	181,251
기타비유동자산	3,313

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집 단	217,864
유동부채	27,608
비유동부채	34,046
매각예정으로 분류된 처분자산집단에 포함된 부 채	61,654
해외사업장환산외환차이	(217)
매각예정 지분율	0.568
계약체결일자	2023-12-07
처분 또는 재분류된 매각예정으로 분류된 비유동 자산이나 처분자산집단에 대한 기술	전기 중 연결회사의 경영진은 ㈜도우인시스 지분 56.8%를 ㈜뉴파워프라즈마 등 3개사에게 매각하기로 결정하였습니다. 2023년 12월 7일 계약이체결되었으며, 2024년 1월 31일 매각이 완료되었습니다.

4. 재무제표

4-1. 재무상태표 재무상태표

제 56 기 반기말 2024.06.30 현재 제 55 기말 2023.12.31 현재

	제 56 기 반기말	제 55 기말
자산		
유동자산	85,822,049	68,548,442
현금및현금성자산 (주3,25)	7,818,179	6,061,451
단기금융상품 (주3,25)	3,819,491	50,071
매출채권 (주3,25)	35,819,815	27,363,016
미수금 (주3,25)	1,584,303	1,910,054
선급비용	1,484,079	1,349,755
재고자산 (주5)	31,861,509	29,338,151
기타유동자산 (주3,25)	3,434,673	2,475,944
비유동자산	231,813,389	228,308,847
기타포괄손익-공정가치금융자산 (주3,4,25)	2,189,910	1,854,503
당기손익-공정가치금융자산 (주3,4,25)	0	1
종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자 (주6)	57,551,517	57,392,438
유형자산 (주7)	143,072,339	140,579,161
무형자산 (주8)	10,834,063	10,440,211
순확정급여자산 (주11)	3,210,908	3,745,697
이연법인세자산	11,081,141	9,931,358
기타비유동자산 (주3,25)	3,873,511	4,365,478
자산총계	317,635,438	296,857,289

부채		
유동부채	50,124,508	41,775,101
매입채무 (주3,25)	11,513,195	7,943,834
단기차입금 (주3,9,25)	9,676,020	5,625,163
미지급금 (주3,25)	11,248,820	15,256,046
선수금 (주14)	259,924	302,589
예수금 (주3,25)	553,955	445,470
미지급비용 (주3,14,25)	7,956,782	6,931,991
당기법인세부채	2,764,859	0
유동성장기부채 (주3,9,10,25)	265,348	228,491
충당부채 (주12)	5,519,628	4,540,702
기타 유동부채 (주14)	365,977	500,815
비유동부채	30,640,186	30,294,414
사채 (주3,10,25)	20,573	19,064
장기차입금 (주3,9,25)	22,869,831	22,902,035
장기미지급금 (주3,25)	4,858,973	4,942,826
장기충당부채 (주12)	2,876,425	2,413,133
기타 비유동 부채	14,384	17,356
부채총계	80,764,694	72,069,515
자본		
자본금 (주15)	897,514	897,514
우선주자본금	119,467	119,467
보통주자본금	778,047	778,047
주식발행초과금	4,403,893	4,403,893
이익잉여금 (주16)	231,894,075	219,963,351
기타자본항목 (주17)	(324,738)	(476,984)
자본총계	236,870,744	224,787,774
자본과부채총계	317,635,438	296,857,289

4-2. 손익계산서 **손익계산서**

제 56 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지 제 55 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지

	제 56 기 반기		제 55 기 반기		
	3개월	누적	3개월	누적	
매출액 (주26)	53,734,118	104,973,735	39,729,088	81,897,767	
매출원가 (주18)	36,181,464	74,954,314	33,808,570	70,922,059	
매출총이익	17,552,654	30,019,421	5,920,518	10,975,708	
판매비와관리비 (주18,19)	10,330,163	20,789,550	9,618,621	18,582,572	

영업이익 (주26)	7,222,491	9,229,871	(3,698,103)	(7,606,864)
기타수익 (주20)	1,348,850	9,597,968	13,533,358	22,103,342
기타비용 (주20)	85,299	356,386	39,191	131,431
금융수익 (주21)	1,660,458	3,071,282	1,829,316	3,982,674
금융비용 (주21)	1,692,067	3,103,005	2,156,852	4,477,000
법인세비용차감전순이익(손실)	8,454,433	18,439,730	9,468,528	13,870,721
법인세비용(수익) (주22)	1,356,016	1,603,876	(116,105)	127,993
계속영업이익(손실)	7,098,417	16,835,854	9,584,633	13,742,728
반기순이익	7,098,417	16,835,854	9,584,633	13,742,728
주당이익 (주23)				
기본주당이익 (단위 : 원)	1,045	2,479	1,411	2,023
희석주당이익 (단위 : 원)	1,045	2,479	1,411	2,023

4-3. 포괄손익계산서 포괄손익계산서

제 56 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지 제 55 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지

(단위:백만원)

	제 56 기 반기		제 55 기 반기	
	3개월	누적	3개월	누적
반기순이익	7,098,417	16,835,854	9,584,633	13,742,728
기타포괄손익	85,027	152,246	87,808	(64,997)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손 익	85,027	152,246	87,808	(64,997)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (주17)	103,200	246,859	182,793	270,112
순확정급여부채(자산) 재측정요소 (주17)	(18,173)	(94,613)	(94,985)	(335,109)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	0	0	0	0
반기총포괄손익	7,183,444	16,988,100	9,672,441	13,677,731

4-4. 자본변동표 자본변동표

제 56 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지 제 55 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지

	자본					
	자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계	
2023.01.01 (기초자본)	897,514	4,403,893	204,388,016	(273,232)	209,416,191	
반기순이익	0	0	13,742,728	0	13,742,728	
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (주17)	0	0	0	270,112	270,112	
순확정급여부채(자산) 재측정요소 (주17)	0	0	0	(335,109)	(335,109)	
배당	0	0	(4,905,130)	0	(4,905,130)	

2023.06.30 (기말자본)	897,514	4,403,893	213,225,614	(338,229)	218,188,792
2024.01.01 (기초자본)	897,514	4,403,893	219,963,351	(476,984)	224,787,774
반기순이익	0	0	16,835,854	0	16,835,854
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (주17)	0	0	0	246,859	246,859
순확정급여부채(자산) 재측정요소 (주17)	0	0	0	(94,613)	(94,613)
배당	0	0	(4,905,130)	0	(4,905,130)
2024.06.30 (기말자본)	897,514	4,403,893	231,894,075	(324,738)	236,870,744

4-5. 현금흐름표 현금흐름표

제 56 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지 제 55 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지

	제 56 기 반기	제 55 기 반기
영업활동현금흐름	26,030,140	17,642,788
영업에서 창출된 현금	17,008,300	(2,004,178)
반기순이익	16,835,854	13,742,728
조정 (주24)	5,345,859	(3,908,556)
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 (주24)	(5,173,413)	(11,838,350)
이자의 수취	125,249	124,568
이자의 지급	(249,790)	(184,726)
배당금 수입	9,369,762	22,160,138
법인세 납부액	(223,381)	(2,453,014)
투자활동현금흐름	(23,306,487)	(25,934,522)
단기금융상품의 순감소(증가)	(3,263,880)	(1,266)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분	0	22
당기손익-공정가치금융자산의 처분	1	222
종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 처분	105,730	107,710
종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 취득	(298,433)	(69,514)
유형자산의 처분	40,647	97,006
유형자산의 취득	(18,568,179)	(24,524,605)
무형자산의 처분	13,041	11,380
무형자산의 취득	(1,267,923)	(1,499,642)
기타투자활동으로 인한 현금유출입액	(67,491)	(55,835)
재무활동현금흐름	(967,276)	17,272,858
단기차입금의 순증가(감소)	4,043,477	268,775
사채 및 장기차입금의 차입	0	21,990,000
사채 및 장기차입금의 상환	(105,934)	(80,125)
배당금의 지급	(4,904,819)	(4,905,792)
외화환산으로 인한 현금의 변동	351	(10,247)
현금및현금성자산의 증가(감소)	1,756,728	8,970,877
기초현금및현금성자산	6,061,451	3,921,593

5. 재무제표 주석

1. 일반적 사항

삼성전자주식회사(이하 "회사")는 1969년 대한민국에서 설립되어 1975년에 대한민국의 증권거래소에 상장하였습니다. 회사의 사업은 DX 부문, DS 부문으로 구성되어 있습니다. DX(Device eXperience) 부문은 TV, 냉장고, 스마트폰, 네트워크시스템 등의 사업으로 구성되어 있으며, DS(Device Solutions) 부문은 메모리, Foundry, System LSI 등으로 구성되어 있습니다. 회사의 본점 소재지는 경기도 수원시입니다.

회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다.

2. 중요한 회계처리방침

2.1. 재무제표 작성기준

회사의 2024년 6월 30일로 종료하는 6개월 보고기간에 대한 반기재무제표는 기업회계기준서 제 1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 반기재무제표는 보고기간종료일인 2024년 6월 30일 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

가. 회사가 채택한 제 • 개정 기준서

회사는 2024년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 주요 제·개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.

- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정

보고기간종료일 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 부채가 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 중간재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정

기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하여 판매로 회계처리 되는 판매후리스에 대하여 후속측정 요구사항을 추가하였습니다. 동 개정사항은 리스개시일 후에 판매자-리스이용자가 계속 보유하는 사용권에 대해서는 판매자-리스이용자가 어떠한 차손익도 인식하지 않는 방식으로 '리스료'나 '수정 리스료'를 산정하도록 요구합니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 중간 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표' 및 제1107호 '금융상품 공시' 개정

동 개정사항은 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표'의 공시 목적에 재무제표이용자가 공급자금융

약정이 기업의 부채와 현금흐름에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 한다는 점을 추가합니다. 또한, 기업회계기준서 제1107호 '금융상품 공시'를 개정하여 유동성위험 집중도에 대한 익스포저와 관련한 정보를 공시하도록 하는 요구사항의 예로 공급자금융약정을 추가하였습니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 중간재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

나. 회사가 적용하지 않은 제 • 개정 기준서

제정 또는 공표됐으나 2024년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 않았고, 회사가 조기 적용하지 않은 주요 제·개정 기준서는 다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과' 개정

외환시장이 정상적으로 작동하지 않을 때 기능통화에 의한 외화거래 보고를 명확히 하기 위해 두 통화간 교환가능성을 평가하는 규정을 추가합니다. 또한, 두 통화간 교환이 가능한지를 평가하여 교환가능성이 결여되었다고 판단한 경우, 적용할 현물환율을 추정하는 규정을 추가하였습니다. 동 개정사항은 2025년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기 적용할 수 있습니다.

2.2. 회계정책

반기재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책과 계산방법은 주석 2.1에서 설명하는 제·개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 2023년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해 글로벌최저한세를 고려하여 추정한 가중평균연간 법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

2.3. 중요한 회계추정 및 가정

반기재무제표 작성시 회사의 경영진은 회계정책의 적용과 보고되는 자산·부채의 장부금액 및 이익·비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.

반기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 2023년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회 계추정 및 가정과 동일합니다.

3. 범주별 금융상품

급용자산의 범주뿐 공시

금융자산, 범주																			
상각후원가 측정	영 금융자산						기타포괄손약-	공정가치 측정 금	용자산					당기손익-공정	가치측정 금융자	산			
금융자산, 분류							금융자산, 분류	경자선, 문류 공용자선, 문류											
현금및현금성			기타포괄손익	당기손먹-공		금융자산, 분	현금및현금성			기타포괄손익			금융자산, 문	현금및현금성			기타포괄손익		금융자산, 분
자산	단기금융상품	매출채권	-굉정가치로	정가치금융자	기타	류 함계	자산	단기금융상품	매출채권	-굉정가치로	정가치금융자	기타	류 함계	자산	단기금융상품	매출채권	-공정가치로	정가치금융자	류 함계

전략으로 전혀 등 전략으로 전략으로 전혀 등 전략으로 전략으로 전혀 등 전혀 등 전략으로 전혀 등 전혀																						
Marie Mar																						
변경 전	l l				측정하는 공						측정하								측정하는 급	ė.		
### 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						-																
변경 : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	용자산	7,818,179	3,819,491	35,819,8	115	0	4,968,597	52,426,082	0	0	0 2,18	39,910	0	0	2,189,910	0	0	0			0 344,97	4 344,97
변경 등 1 전 2 전 2 전 2 전 2 전 2 전 2 전 2 전 2 전 2 전	기말																					(단위 : 백만문
변경 등 전 등 전 등 전 등 전 등 전 등 전 등 전 등 전 등 전 등																						
### 1978										정가치 측정 금융자	산						마치측정 금융자	<u>.</u>				
					기타포괄손			1			기타포				-				기타포괄손익			
변경에 변경을 받는 경험을 받을 받는 경험을 받는 경험을 받는 경험을 받는 경험을 받는 경험을 받는					-공정가치로			금융자산, 분	현금및현금성		-광정기		손약-공		금융자산, 문	현금및현금성			-공정가치로			금융자산. 등
### 1997 전 199			단기금융상품	매출채권	측정하는 공		기타	# 함계		단기금융상품 매용			치금융자	71E)	# 87	자산	단기금융상품	매출채권	측정하는 급	정가치금융7	기타	류 참계
응용자산의 병주별 공시. 항계 당반기말 (단위 : 한글및현금성자산 단기금융상품 매출채권 기타포괄스익-공정가 기타 금융자산, 분위 자산 기타포괄스익-공정가 기타 금융자산, 분위 자산 기타포괄스익-공정가 기타 금융자산, 분위 전기망 (단위 : 전기망 (단위 : 전기망 기타포괄스익-공정가 기타 금융자산, 분위 자고 축정하는 금융 자산 기타포괄스익-공정가 기타 금융자산, 분위 공자산 기타포괄스익-공정가 기타 금융자산, 분위 공장사산 보기 기타 금융자산, 분위 공장사산 기타포괄스익-공정가 기타 금융자산, 분위 공장사산 기타포괄스익-공정가 기타 금융자산, 분위 공장사산 기타포괄스익-공정가 기타 금융자산, 분위 공장사산 기타포괄스익-공정가 기타포괄스익-공직의 기타포괄스익-공직의 기타포괄스익-공직의 기타포괄스익-공직의 기타포괄스익-공직의 기타포괄스익-공직의 기타포괄스익-공직의 기타포괄스익-공직의 기타포괄스익-공					용자산	산					용자산								용자산	산		
응한기일 (단위 :	응자산	6,081,451	50,071	27,363,0	116	0	0 4,972,284	38,446,822	0	0	0 1,8	54,503	0	0	1,854,503	0	0	0			1 393,23	5 393,23
현급및현급성자산 단기급용상품 매출채권 지원 전기원임 전기원임임 전기원임임임 전기원임임임 전기원임임임임임임임임임임임임임임임임임임임임임임임임임임임임임임임임임임임임			별 공시	, 합계							ΣIE	나포괄손	- 익 – 공	무정가							(단위	: 백만원
전기일 전기일 전기일 전기일 전기일 전기일 전기일 전기일			i	현금및현	현금성자(산 단	기금융상	품	매출채	권	치료	르 측정히		- 금융		-공정가치		H		금융	자산, 분	류 합계
경우 전 등 전 등 전 등 전 등 전 등 전 등 전 등 전 등 전 등 전	글융자산	<u></u>			7,818	3,179	;	3,819,49	1	35,819	9,815		2,18	9,910			0	į.	5,313,5	71	54	960,966
	^덴 기말																				(단위	: 백만원
급경부체의 법수별 경시 경건기원 								품	애출채	권				5	당기손익-	-공정가치		ı				
경기 경				현금및현	현금성자(· 단	기금융상						ort a		융자산			-1		금융	사산, 문	류 합계
대응체우 단기차원공 단기자리공 RS성경기부제 사제 당기차원공 당기이지금을 기단 용계 대응체우 단기차원공 단기이지금을 RS성경기부제 사제 당기차원공 경기이지금을 기단	글융자신	<u>.</u>		현금및현			기금융상	50,07			자신	ŀ		4	B자산				5,365,5			
6.4	:종부채의 범주	주별 공시 금융부채, 범리 상각후쮣가 즉	주 즉정 급용부표	현금및현			기금융상	50,07			자산	기타금종부	1,85·	4	당자산 -				5,365,5			694,56 · (단위: 백만원
音音学者 11,313,199 U 11,310,019 b,867 20,573 21,990,000 4,403,185 4,781,062 53,732,900 0 9,676,000 0 256,481 0 679,631 0 0	:종부채의 범주	급등부제, 법의 성격주문가 즉 급용부제, 군의	주 작정 금융부제 무		6,061	,451			1	27,363	자산	기타급등부 금융부제, 한	1,85·	4,503			1			19	40	694,56 · (단위 : 백만원
艺力要	평두채의 범주	공사 공사 공부제, 명국 공부제, 명국 공부제, 명국 공부제, 문국 메일째로	주 측정 급용부제 문 단기자원		6,061	,451	АЯ	창기자왕급	장기미지금급	27,363	자신 3,016	기타급등부 금융부제, 한	1,85	4,503	단기미자랑군		1	공기자임	원급 경기	19 미자공공 :	40	694,56 (단위 : 백단원 금융부채, 문화
급용부제, 방주	공동부채의 범주 당반기말	공사 공사 공부제, 명국 공부제, 명국 공부제, 명국 공부제, 문국 메일째로	주 측정 급용부제 문 단기자원		6,061	,451	АЯ	창기자왕급	장기미지금급	27,363	자신 3,016	기타급등부 금융부제, 한	1,85	4,503	단기미자랑군		1	공기자임	원급 경기	19 미자공공 :	40	694,56 (단위 : 백만원 금융부채, 문류 항계
성국후리가 측한 리면부져 기타급 분부져 기타고	공동부채의 범주 당반기말	공사 공사 공사 공유부표, 법적 유명가 즉 공유부표, 법적 유명가 즉 공유부표, 근대 메일제무 11.513.1	주 즉정 급용부표 무 단기자인		6,061	,451	АЯ	창기자왕급	장기미지금급	27,363	자신 3,016	기타급등부 금융부제, 한	1,85	4,503	단기미자랑군		1	공기자임	원급 경기	19 미자공공 :	40	694,56 (단위 : 백만원 금융부채, 문류 항계
10040 73403 730133 0000 73403 0010133 000 00133 001	공동부채의 범주 당반기말	공부제, 발 공시	주 주 주 주 주 주 주 주 주 주 주 주 주 주 주 주 주 주 주		6,061	,451	АЯ	창기자왕급	장기미지금급	27,363	자신 3,016 - 교급부제, 문류 용계 2 2 53,732,900	기타공공부 - 기타공	1,85	4,503	단기미자랑군		1	공기자임	원급 경기	19 미자공공 :	40	694,56 (단위: 백만원 공출부제, 본류 8개 10,814,33 (단위: 백만원
명원부부 단기자리급 단기자리급 위증성경기부및 사용 경기자리급 기단 함께 명원부부 단기자리급 단기자리급 위증성경기부및 사용 경기자리급 기단 공급부표 7.943,834 0 15.015.578 6.354 19.064 21.990,000 4.486.390 3.652.599 53.114.159 0 5.625.163 0 222.137 0 912.035 0 0	공동부채의 범주 당반기말	주변 검사 - 급류부제, 법** - 성각주원기 축 급류부제, 문** - 미입제무 - 11.513.1 - 급류부제, 법** - 성각주원기 축 성각수	주 주 주 주 주 주 주 주 주 주 주 주 주 주 주 주 주 주 주	13 0:	6,061	.451	AJAS 20,573	경기자임급 21,990,000	970IX88 4.403.18	27,363 218 3 4,789,063	자신 3,016 	기타공공부 공용부표 : 6 대한지구 기타공공부 공용부표 : 6	和	9.676.000	단기미지클급	258,48	1 AAR	\$7132 0	3기 879.831	0	40	694,56 (단위: 백단원 교육부표, 분류 함계 10.814.33
	대로 바까요 변경 보고 한 대로 보고	공사 공사 공무 교육	주 유한 급등부표 문 건가제한 유한 금등부표 문 문 구 제한 금등부표 문 문 문 문 문 문 문 문 문 문 문 문 문 문 문 문 문 문 문	0	6,061 PIOINAR 9 11,010,018	, 451 등성장기부제 6,967	AN 20,573	평가지링글 21,990,000	중기미지금글 4.403.18 중기미지금글	27,360 7IE 5 4,789,060	ストと 3,016 - 高野学科、世界 参別 - 2 53,732,600	기타공공부 - 기타공	1,85-	9.676.000	단기미지급급 0 단기미지급급	258,41	1 AAM	공기처원 0 :	373.831	0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	40 1E	694,56 (단위: 백만원 글중부채, 문류

금융부채의 범주별 공시, 합계

당반기말 (단위 : 백만원)

	매입채무	단기차입금	단기미지급금	유동성장기부채	사채	장기차입금	장기미지급금	기타	금융부채, 분류 합
금융부채	11,513,195	9,676,020	11,010,018	265,348	20,573	22,869,831	4,403,185	4,789,062	64,547,232

전기말 (단위:백만원)

	매입채무	단기차입금	단기미지급금	유동성장기부채	사채	장기차입금	장기미지급금	기타	금융부채, 분류 합
									Л
금융부채	7,943,834	5,625,163	15,015,578	228,491	19,064	22,902,035	4,486,390	3,652,969	59,873,524

당기 및 전기 기타금융부채에 대한 각주

기타금융부채는 담보부차입금과 기업회계기준서 제1109호의 금융부채의 범주로 분류되지 않는 리스부채 등을 포함하고 있습니다.

4. 공정가치금융자산

기타포괄손익-공정가치금융자산의 구성내역

당반기말 (단위: 백만원)

	금융자산, 범주
	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
	지분상품
기타포괄손익-공정가치금융자산	2,189,910

전기말 (단위: 백만원)

	금융자산, 범주
	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
	지분상품
기타포괄손익-공정가치금융자산	1,854,503

당기손익-공정가치측정금융자산의 공시

당반기말 (단위: 백만원)

	금융자산, 범주
	당기손익인식금융자산
	채무상품
당기손익-공정가치금융자산	0

전기말 (단위: 백만원)

	금융자산, 범주
	당기손익인식금융자산
	채무상품
당기손익-공정가치금융자산	1

공정가치금향자산 중 상장주식 세부내역에 대한 공시

(단위:백안전)

금융자산, 분류																		
공정가치로 측정:	하는 금융자산																	
상장주식																		
삼성행공업㈜	(위호텔신라	(明케이티스카 이라이프	모나용평위	(위에이테크숍 루션	(취원익홀딩스	(위원역아이피 (에스	[위용진쎼미집	솔브레인㈜	RF에스앤에스 텍	(하와이씨	위케이씨텍	위열오티베큠	위뉴파워프라 즈마	위에프에스티	위디 엔 에프	Technology.	SoundHound Al, Inc.	함계
측정 전체																		

		장부		장부		장부		장부		장부		장부		장부		장부		장부		장부		장부		장부		장부		장부		장부		장부		장부		장부		장부		장부
	취득	급역	취득	급액	취득	급액	취득	급력	취득	급액	취득	급역	취득	라	취득	급액	취득	향	취득	향	취득	향	취득	급액	취득	급액	취득	급액	취득	뺭	취득	급택	취득	급액	취득	급액	취득	명	취득	급역
	원가	(시장	원가	(시장	원가	(시장	원가	(시장	원가	(시장	원가	(시장	원가	(시장	원가	(시장	원가	(시장	원가	(시장	뭔가	(시장	뭔가	(시장	원가	(시장	원가	(시장	뭔가	(시장	원가	(시장	원가	(시장	원가	(시장	원가	(시장	원가	(시장
		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)
100	932,1	1,253	13,95	107,4		5.625	3 344	1,246	1 869		1	13,08	15,41	5,999	l	64,41	48,27	98,83	40,38	127,0	65,93	61,26	47,33	167,1	20,72	46,35	18,99	19,77	12,73	13,59	43,00	58,55	20,96	14,90	11,70	16,82		9,345	1,353	2,085
자산	58	,155	7	53				.,=			1	6	0		ı	3	7	9	2	47	3	5	6	64	0	7	0	6	9	5	9	8	4	5	5	5	l		,398	,992
보유		134,0		2,004		647,3		240,0		400,0		1,592		1,759		1,850		2,467		437,3		1,716		9,601		1,022		1,267		2,140		1,522		810,0		173,1		1,702		
주식		27,28		,717		20		00		00		,000		,171		,936		.894		39		,116		,617		,216		.668		.939		.975		30		87		.957		
÷		1		,717		20		00		00		,000		,171		,530		,054		35		,110		,017		,210		,000		,535		,875		30		67		,007		
지문		0.152		0.051		0.019		0.005		0.008		0.159		0.023		0.038		0.048		0.056		0.080		0.117		0.049		0.071		0.049		0.070		0.070		0.000		0.005		
8																																								
																																								卷號
																																								행보
지문																																								동주
整例																																								식수
대한																																								기준
설명																																								지문
																																								휼입
																																								ut.

전기명

선기별																																							(단위:	100)
	금융자	살, 문류																																						
	공정가:	치로 측정	하는 공원	용자산																																				
	상장주	4																																						
	삼성종	공업(위)	위호텔:	신라	(N) (N)	마켓코	(위케이) 이라이		모나용	평㈜	(전에이 루션	田크金	(취원익	홀딩스	(위원익) 에스	DI OI III	종진	베미컴	송브레	인종)	(위에스 (택		(4) SE(49)	M	((9)34 01	씨댁	㈜열오!	ामह	위뉴파9 즈마		중에프	메스티	㈜디엔	ΝΞ	Marvell Techno	logy.	Soundle Al, Inc.		함계	
	측정 전	체 장부		장부		장부		I		I	1	장부		장부		장부		장부		장부				장부	ı .	장부	ı	장부				장부		장부						장부
					45		취득	장부	취득	장부	NS.		취득		45		A S		A S			장부					취득			장부			취득		45	장부 금앤	취득	장부 그앤		
	원가																																							
		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)		가치)
38		1,038		131,1		5,560		1,421		1,220		17,24		5,928		62,83		95,50		132,9		77,74		47,86		27,39		25,54		11,24		37,54		19,40		13,46		4,655		1,757
자산		.712		08								- 1				9		8		52		0		4		5		4		0		1		0		8				.336
보유																																								
주식																																								
÷																																								
지문																																								
22																																								
지문																																								
용에																																								
대한																																								
설명																																								

5. 재고자산

재고자산 세부내역

	총장부금액	재고자산 평가충당금	장부금액 합계
제품 및 상품	7,303,948	(667,741)	6,636,207
반제품 및 재공품	20,630,686	(897,823)	19,732,863

원재료 및 저장품	5,976,495	(908,190)	5,068,305
미착품	424,134	0	424,134
재고자산 계	34,335,263	(2,473,754)	31,861,509

	총장부금액	재고자산 평가충당금	장부금액 합계
제품 및 상품	7,914,117	(1,203,662)	6,710,455
반제품 및 재공품	21,866,523	(3,863,881)	18,002,642
원재료 및 저장품	4,910,170	(861,821)	4,048,349
미착품	576,705	0	576,705
재고자산 계	35,267,515	(5,929,364)	29,338,151

6. 관계기업 및 공동기업 투자

가. 당반기 및 전반기 중 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분	당반기	전반기
기초	57,392,438	57,397,249
취득	298,433	69,514
처분	(139,354)	(107,735)
반기말	57,551,517	57,359,028

나. 보고기간종료일 현재 주요 관계기업 투자 현황은 다음과 같습니다.

(종속기업 현황은 주석 27 참조)

기업명	관계의 성격	지분율 (%)(*1)	주사업장	결산월
삼성전기㈜	수동소자, 회로부품, 모듈 등 전자부품의 생산 및 공급	23.7	한국	12월
삼성에스디에스 ㈜	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 · 관리 등 IT 서비스 및 물류서비스 제공	22.6	한국	12월
삼성바이오로직 스㈜	신사업 투자	31.2	한국	12월
삼성SDI㈜(*2)	2차전지 등 전자부품의 생산 및 공 급	19.6	한국	12월
㈜제일기획	광고 대행업	25.2	한국	12월

- (*1) 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.
- (*2) 유통보통주식수 기준 지분율은 20.6%입니다.

다. 보고기간종료일 현재 시장성 있는 관계기업 투자주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 백만원)

ユ	ы	당반기말		전기말			
7	正	주식수	시장가치	장부금액	시장가치	장부금액	

삼성전기㈜	17,693,084	2,795,507	445,244	2,710,580	445,244
삼성에스디에스 ㈜	17,472,110	2,594,608	560,827	2,970,259	560,827
삼성바이오로직 스㈜	22,217,309	16,151,984	1,595,892	16,885,155	1,595,892
삼성SDI㈜	13,462,673	4,765,786	1,242,605	6,354,382	1,242,605
㈜제일기획	29,038,075	534,301	491,599	552,595	491,599

7. 유형자산

유형자산에 대한 세부 정보 공시

당반기 (단위: 백만원)

	공시금액
기초 장부금액	140,579,161
일반취득 및 자본적지출	16,485,664
감가상각비, 유형자산	(13,946,056)
처분・폐기・손상	(43,273)
기타	(3,157)
반기말 장부금액	143,072,339

전반기 (단위: 백만원)

	공시금액
기초 장부금액	123,266,986
일반취득 및 자본적지출	21,892,460
감가상각비, 유형자산	(12,502,893)
처분・폐기・손상	(51,823)
기타	(1,316)
반기말 장부금액	132,603,414

감가상각비의 기능별 배분

당반기 (단위: 백만원)

	매출원가	판매비와관리비 등	기능별 항목 합계
감가상각비, 유형자산	12,801,327	1,144,729	13,946,056

전반기 (단위: 백만원)

	매출원가	판매비와관리비 등	기능별 항목 합계
감가상각비, 유형자산	11,513,134	989,759	12,502,893

사용권자산에 대한 양적 정보 공시

당반기말 (단위: 백만원)

	공시금액
사용권자산	1,831,460

전기말 (단위:백만원)

	공시금액
사용권자산	1,840,913

사용권자산 변동에 대한 공시

당반기 (단위: 백만원)

	공시금액
사용권자산의 추가	144,538
감가상각비, 사용권자산	151,517

전반기 (단위: 백만원)

	공시금액
사용권자산의 추가	665,017
감가상각비, 사용권자산	107,382

8. 무형자산

무형자산 및 영업권의 변동내역에 대한 공시

당반기 (단위: 백만원)

	공시금액
기초장부금액	10,440,211
개별취득	1,607,898
상각	(1,197,385)
처분·폐기·손상	(31,620)
기타	14,959
반기말장부금액	10,834,063

	공시금액
기초장부금액	8,561,424
개별취득	3,930,568
상각	(1,317,524)
처분·폐기·손상	(25,042)
기타	19,297
반기말장부금액	11,168,723

당반기 (단위: 백만원)

	매출원가	판매비와관리비 등	기능별 항목 합계
무형자산상각비	904,036	293,349	1,197,385

전반기 (단위: 백만원)

	매출원가	판매비와관리비 등	기능별 항목 합계
무형자산상각비	1,018,232	299,292	1,317,524

9. 차입금

단기차입금에 대한 세부 정보

당반기말 (단위: 백만원)

	차입금명칭		
	단기차입금		
	담보부차입금-우리은행 등		
	범위		·범위 합계
	하위범위	상위범위	김기 합계
연이자율	0.001	0.136	
단기차입금			9,676,020
차입금에 대한 기술			담보부차입금과 관련하 여 매출채권을 담보로 제공하였습니다.

전기말 (단위:백만원)

	차입금명칭			
	단기차입금			
	담보부차입금-우리은행 등			
	범위			
	하위범위	상위범위	범위 합계	
연이자율				
단기차입금				5,625,163
차입금에 대한 기술				

유동성장기차입금에 대한 세부 정보

당반기말 (단위: 백만원)

	차입금명칭
	유동성장기차입금
	리스부채
연이자율	0.029

258,481

전기말 (단위: 백만원)

	차입금명칭
	유동성장기차입금
	리스부채
연이자율	
유동성장기차입금	222,137

장기차입금에 대한 세부 정보

당반기말 (단위: 백만원)

	차입금명칭			
	장기 차입금		, ,차입금명칭 합계	
	리스부채	무담보차입금-삼성디스 플레이㈜		
만기일		2025.08.16		
연이자율	0.029	0.046		
장기차입금	879,831	21,990,000	22,869	,831

전기말 (단위: 백만원)

	차입금명칭			
	장기 차입금		차입금명칭 i	하게
	리스부채	무담보차입금-삼성디스 플레이㈜	N 6 6 6	
만기일				
연이자율				
장기차입금	912,035	21,990,000	2	22,902,035

리스부채 이자비용에 대한 공시

당반기 (단위: 백만원)

	공시금액
	리스부채와 관련하여 연이자율은 가중평균증분차
리스부채 이자비용에 대한 설명	입이자율이며, 당반기 중 발생한 이자비용은
	16,518백만원(전반기: 11,552백만원)입니다.
리스부채에 대한 이자비용	16,518

공시금액

	리스부채와 관련하여 연이자율은 가중평균증분차
리스부채 이자비용에 대한 설명	입이자율이며, 당반기 중 발생한 이자비용은
	16,518백만원(전반기: 11,552백만원)입니다.
리스부채에 대한 이자비용	11,552

10. 사채

사채에 대한 세부 정보 공시

당반기말 (단위: 백만원)

	US\$ denominated Straight Bonds	차입금명칭 합계
발행일	1997-10-02	
만기상환일	2027-10-01	
연이자율	0.077	
명목금액	27,784	27,784
명목금액, 외화금액	US\$ 20,000천	
사채할인발행차금		(344)
계		27,440
차감: 유동성사채		(6,867)
비유동성사채		20,573
사채에 대한 기술	10년 거치 20년 분할상환되며 이 자는 6개월마다 후급됩니다.	

전기말 (단위: 백만원)

	US\$ denominated Straight Bonds	차입금명칭 합계
발행일	1997-10-02	
만기상환일	2027-10-01	
연이자율	0.077	
명목금액	25,788	25,788
명목금액, 외화금액	US\$ 20,000천	
사채할인발행차금		(370)
Л		25,418
차감: 유동성사채		(6,354)
비유동성사채		19,064
사채에 대한 기술	10년 거치 20년 분할상환되며 이 자는 6개월마다 후급됩니다.	

11. 순확정급여부채(자산)

확정급여제도에 대한 공시

당반기말 (단위: 백만원)

	기금() 석립되는 활성급	전부 기금이 적립되지 않는 확정급여제도	확정급여제도의 기금적 립약정 합계
확정급여채무, 현재가치	12,434,781	23,572	12,458,353
사외적립자산의 공정가 치			(15,669,261)
순확정급여부채(자산) 계			(3,210,908)

전기말 (단위: 백만원)

	전부 또는 부분적으로 기금이 적립되는 확정급 여제도	전부 기금이 적립되지 않는 확정급여제도	확정급여제도의 기금적 립약정 합계
확정급여채무, 현재가치	11,959,655	22,672	11,982,327
사외적립자산의 공정가 치			(15,728,024)
순확정급여부채(자산) 계			(3,745,697)

당기손익에 포함되는 퇴직급여비용에 대한 공시

당반기 (단위: 백만원)

	매출원가	판매비와 일반관리비	기능별 항목 합계
당기근무원가, 확정급여 제도			526,791
순이자비용(수익), 확정 급여제도			(107,822)
퇴직급여비용 합계, 확 정급여제도	166,206	252,763	418,969

	매출원가	판매비와 일반관리비	기능별 항목 합계
당기근무원가, 확정급여 제도			481,183
순이자비용(수익), 확정 급여제도			(137,623)
퇴직급여비용 합계, 확 정급여제도	137,491	206,069	343,560

12. 충당부채

(단위 : 백만원)

	판매보증	기술사용료	장기성과급	기타	기타충당부채 합계
기초	673,951	1,815,938	713,719	3,750,227	6,953,835
순전입(환입)	435,647	652,544	101,421	1,688,611	2,878,223
사용	(345,007)	(471,073)	0	(723,126)	(1,539,206)
기타	0	52,559	0	50,642	103,201
반기말	764,591	2,049,968	815,140	4,766,354	8,396,053
				회사는 생산 및 판매	
				중단한 제품에 대하여	
	회사는 출고한 제품에		회사는 임원을 대상으	향후 부담할 것으로	
		회사는 협상 진행 중	로 부여연도를 포함한	예상되는 비용 등을	
	대한 품질보증, 교환,	인 기술사용계약과 관	향후 3년간의 경영실	추정하여 충당부채로	
	하자보수 및 그에 따	련하여 향후 지급이	적에 따라 성과급을	계상하고 있습니다.	
	른 사후서비스 등으로	예상되는 기술사용료	지급하는 장기성과 인	회사는 온실가스 배출	
충당부채의 성격에 대	인하여 향후 부담할	를 추정하여 충당부채	센티브를 부여하였는	과 관련하여 해당 이	
한 기술	것으로 예상되는 비용	로 계상하고 있습니다.	 바, 향후 지급이 예상	행연도분 배출권의 장	
	을 보증기간 및 과거	 . 지급시기 및 금액은	되는 금액의 경과 기	 부금액과 이를 초과하	
	경험률 등을 기초로	협상결과에 따라 변동	간 해당분을 충당부채	는 배출량에 대해 향	
	추정하여 충당부채로	될 수 있습니다.	로 계상하고 있습니다	후 부담할 것으로 예	
	설정하고 있습니다.		1	ㅜ ㅜㅁᆯ ᆺㅡㅗ 에 상되는 비용을 추정하	
				여 충당부채로 계상하	
				고 있습니다.	

무상할당배출권과 배출량 추정치에 대한 공시

	배출량
무상할당 배출권	1,117만톤(tCO2-eq)
배출량 추정치	1,378만톤(tCO2-eq)

배출권 변동내역에 대한 공시

당반기 (단위: 백만원)

	공시금액
기초	3,137
증가	0
사용	0
반기말	3,137

	공시금액
기초	19,567

증가	1,265
사용	(217)
반기말	20,615

배출부채 변동내역에 대한 공시

당반기 (단위: 백만원)

	공시금액
기초	0
순전입	0
사용	0
반기말	0

전반기 (단위: 백만원)

	공시금액
기초	32,825
순전입	0
사용	0
반기말	32,825

13. 우발부채와 약정사항

약정에 대한 공시

(단위:백만원)

	제공받는 담보 및 지급 보증	분할 전 채무에 대한 연 대채무	발생하지 않은 유·무형 자산의 취득을 위한 약 정
총 약정금액	0		12,740,899
약정에 대한 설명	당반기말 현재 회사가 특수관계자로부터 제공 받고 있는 담보 및 지급 보증은 없습니다.	회사와 삼성디스플레이 ㈜ 등은 분할된 삼성디 스플레이㈜ 등의 분할 전 채무에 관하여 연대 하여 변제할 책임이 있 습니다.	당반기말 현재 발생하지 않은 유·무형자산의 취 득을 위한 약정액은 12,740,899백만원입니 다.

우발부채에 대한 공시

	우발부채				
	보증 관련 우발부채	·법적소송우발부채			
	채무지급보증 - SETK	채무지급보증 - 기타	채무지급보증 - 계	계약이행지급보증	[답역소승구발투제
해외종속기업, 차입기	SETK	기타			

업					
보증처	BNP 외	기타			
보증종료일	2025-06-13				
관련 차입금	689,616	0	689,616		
관련 차입금, 외화			US\$ 496,458천		
총 약정금액	1,315,572	9,932,130	11,247,702	510,858	
총 약정금액, 외화			US\$ 8,096,532천		
의무의 성격에 대한 기술, 우발부채				당반기말 현재 회사가 해외종속기업의 계약 이행을 위하여 제공하 고 있는 지급보증 한 도액은 510,858백만 원입니다.	당반기말 현재 회사는 다수의 회사 등과 정 상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등이 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유 출금액 및 시기는 불 확실하며 회사의 경영 진은 이러한 소송 등 의 결과가 회사의 재 무상태에 중요한 영향 을 미치지 않을 것으 로 판단하고 있습니다.

14. 계약부채

계약부채에 대한 공시

당반기말 (단위: 백만원)

	공시금액
계약부채	1,452,763

전기말 (단위: 백만원)

	공시금액
계약부채	1,491,085

계약부채에 대한 기술

계약부채는 선수금, 미지급비용, 기타유동부채 등에 포함되어 있습니다.

15. 자본금

주식의 분류에 대한 공시

(단위:백만원)

	보통주	우선주	주식 합계
--	-----	-----	-------

회사의 정관에 의한 발 행할 주식의 총수(주)			25,000,000,000
주당 액면가액(원)			100
발행주식수(주)	5,969,782,550	822,886,700	
유통주식수(주)	5,969,782,550	822,886,700	
발행주식 액면 총액(백 만원)	596,978	82,289	679,267
납입자본금(백만원)			897,514
자본에 대한 설명			보고기간종료일 현재 회사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 250억주(1주의 액면금액: 100원)이며, 회사에는 보통주 외 비누적적 우선주가 있습니다. 이 우선주는 의결권이 없고액면금액을 기준으로 보통주의 배당보다 연1%의 금전배당을 추가로 받을 수 있습니다. 보고기간종료일 현재 회사가발행한 보통주 및 우선주의 수(소각 주식수제외)는 각각 5,969,782,550주와 822,886,700주입니다. 또한, 보고기간종료일 현재 유통주식수는 상기발행주식의 수와 동일하며, 당반기 및 전기중병 변동사항은 없습니다.한편, 발행주식의 액면총액은 679,267백만원(보통주 596,978백만원)으로 이익소각으로 인하여 납입자본금 897,514백만원과 상이합니다.

16. 별도이익잉여금

이익잉여금에 대한 공시 당반기말

전자공시시스템 dart.fss.or.kr

	공시금액
법정적립금	450,789
임의적립금 등	231,443,286
Л	231,894,075

전기말 (단위: 백만원)

	공시금액
법정적립금	450,789
임의적립금 등	219,512,562
Я	219,963,351

배당금에 대한 공시

당반기 (단위: 백만원)

	범위					
	1분기			2분기		
	주식			주식		
	보통주	우선주	주식 합계	보통주	우선주	주식 합계
배당기준일			2024-03-31			2024-06-30
배당받을 주식(주)	5,969,782,550	822,886,700		5,969,782,550	822,886,700	
보통주 주당 배당률	0.01			2.01		
(액면가 기준)	3.61			3.61		
우선주 주당 배당률		0.01			0.01	
(액면가 기준)		3.61			3.61	
배당금액	2,155,092	297,062	2,452,154	2,155,092	297,062	2,452,154

전반기 (단위: 백만원)

	범위					
	1분기 :			2분기		
	주식			주식		T 11 -1 71
	보통주	우선주	주식 합계	보통주	우선주	주식 합계
배당기준일			2023-03-31			2023-06-30
배당받을 주식(주)	5,969,782,550	822,886,700		5,969,782,550	822,886,700	
보통주 주당 배당률	2.01			2.01		
(액면가 기준)	3.61			3.61		
우선주 주당 배당률		2.61			2.61	
(액면가 기준)		3.61			3.61	
배당금액	2,155,092	297,062	2,452,154	2,155,092	297,062	2,452,154

17. 기타자본항목

기타자본구성요소

당반기말 (단위: 백만원)

		공시금액
기타자본구성요소		(324,738)
기타자본구성요소	기타포괄손익-공정가치금융자산	493,014

평가손익	
순확정급여부채(자산) 재측정요 소	(2,578,160)
기타	1,760,408

전기말 (단위: 백만원)

		공시금액
기타자본구성요소		(476,984)
	기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	246,155
	순확정급여부채(자산) 재측정요 소	(2,483,547)
	기타	1,760,408

18. 비용의 성격별 분류

비용의 성격별 분류 공시

당반기 (단위:백만원)

	장부금액	
	공시금액	
	3개월	누적
제품 및 재공품 등의 변동	(600,930)	(1,655,973)
원재료 등의 사용액 및 상품 매 입액 등	21,524,147	46,029,412
급여	3,731,782	7,603,029
퇴직급여	211,139	421,748
감가상각비	7,038,174	13,946,056
무형자산상각비	610,446	1,197,385
복리후생비	796,960	1,675,971
유틸리티비	1,340,588	2,732,064
외주용역비	1,242,776	2,193,988
광고선전비	443,013	813,564
판매촉진비	388,002	698,304
기타 비용	9,785,530	20,088,316
성격별 비용 합계	46,511,627	95,743,864

	장부금액	
	공시금액	
	3개월	누적
제품 및 재공품 등의 변동	(1,921,558)	(4,458,251)

원재료 등의 사용액 및 상품 매 입액 등	21,586,066	47,300,307
급여	3,973,830	8,056,082
퇴직급여	174,390	348,059
감가상각비	6,224,767	12,502,893
무형자산상각비	660,403	1,317,524
복리후생비	902,204	1,666,756
유틸리티비	1,183,576	2,411,748
외주용역비	927,790	1,859,249
광고선전비	382,376	655,398
판매촉진비	320,547	612,671
기타 비용	9,012,800	17,232,195
성격별 비용 합계	43,427,191	89,504,631

성격별 비용에 대한 공시

손익계산서 상 매출원가와 판매비와관리비를 합한 금액입니다.

19. 판매비와관리비

판매비와관리비에 대한 공시

당반기 (단위: 백만원)

	장부금액	
	공시금액	
	3개월	누적
급여	599,907	1,355,501
퇴직급여	36,878	73,815
지급수수료	840,089	1,560,874
감가상각비	119,662	238,243
무형자산상각비	98,306	196,539
광고선전비	443,013	813,564
판매촉진비	388,002	698,304
운반비	181,735	408,796
서비스비	227,109	814,879
기타판매비와관리비	598,417	1,107,495
소계	3,533,118	7,268,010
경상연구개발비-연구개발 총지 출액	6,797,045	13,521,540
계	10,330,163	20,789,550

장부금액
공시금액

	3개월	누적
급여	648,380	1,384,662
퇴직급여	31,629	62,604
지급수수료	814,025	1,715,912
감가상각비	115,774	228,549
무형자산상각비	97,537	193,249
광고선전비	382,376	655,398
판매촉진비	320,547	612,671
운반비	135,377	271,208
서비스비	377,408	651,168
기타판매비와관리비	582,925	1,079,247
소계	3,505,978	6,854,668
경상연구개발비-연구개발 총지 출액	6,112,643	11,727,904
계	9,618,621	18,582,572

20. 기타수익 및 기타비용

기타수익 및 기타비용

당반기 (단위: 백만원)

	장부금액	
	공시금액	
	3개월	누적
배당금수익	1,220,105	9,369,762
임대료수익	46,058	92,580
유형자산처분이익	13,372	23,000
기타	69,315	112,626
기타수익 계	1,348,850	9,597,968
유형자산처분손실	1,745	23,009
기부금	15,280	79,864
기타	68,274	253,513
기타비용 계	85,299	356,386

	장부금액	
	공시금액	
	3개월	누적
배당금수익	13,405,935	21,845,780
임대료수익	44,502	90,399
유형자산처분이익	37,373	69,275
기타	45,548	97,888

기타수익 계	13,533,358	22,103,342
유형자산처분손실	2,172	5,338
기부금	20,292	77,639
기타	16,727	48,454
기타비용 계	39,191	131,431

21. 금융수익 및 금융비용

금융수익 및 금융비용

당반기 (단위: 백만원)

		장부금액	
		공시금액	
		3개월	누적
이자수익(금융수익)		87,582	148,073
이자수익(금융수익)	상각후원가로 측정하는 금융자산의 이자수익	87,582	148,073
외환차이	•	1,572,876	2,923,209
파생상품관련이익		0	0
금융수익 합계		1,660,458	3,071,282
이자비용		127,814	328,757
이자비용	상각후원가 측정 금융부 채 이자비용	14,627	87,300
	기타 금융부채 이자비용	113,187	241,457
외환차이		1,486,551	2,725,987
파생상품관련손실		77,702	48,261
금융비용 합계		1,692,067	3,103,005

		장부금액	
		공시금액	
		3개월	누적
이자수익(금융수익)		88,806	150,581
이자수익(금융수익)	상각후원가로 측정하는 금융자산의 이자수익	88,806	150,581
외환차이		1,740,510	3,596,340
파생상품관련이익		0	235,753
금융수익 합계		1,829,316	3,982,674
이자비용		316,475	477,978
이자비용	상각후원가 측정 금융부 채 이자비용	254,760	333,472
	기타 금융부채 이자비용	61,715	144,506

외환차이	1,746,798	3,905,443
파생상품관련손실	93,579	93,579
금융비용 합계	2,156,852	4,477,000

금융수익 및 금융비용에 대한 기술

회사는 외화거래 및 환산으로 발생한 외환차이를 금융수익 및 금융비용으로 인식하고 있습니다.

22. 법인세비용

법인세에 대한 반기별 공시

	내용
법인세에 대한 반기별 공시에 대한 설명	법인세비용은 전체 회계연도에 대해 글로벌최저한세를 고려하여 추정한 최선의 가중평균연간법인세율로 인식하였습니다. 당반기말 현재 2024년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상평균연간법인세율은 8.7%입니다.
2024년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상 평균 연간법인세율	0.087

23. 주당이익

주당이익

당반기 (단위: 백만원)

	주식			
	보통주		우선주	
	3개월	누적	3개월	누적
반기순이익(손실)	7,098,417	16,835,854	7,098,417	16,835,854
보통주에 귀속되는 반기순이익(손실)	6,238,491	14,796,302		
가중평균유통보통 주식수(천주)	5,969,783	5,969,783		
기본 보통주 주당 이익(원)	1,045	2,479		
우선주에 귀속되는 반기순이익(손실)			859,926	2,039,552
가중평균유통우선 주식수(천주)			822,887	822,887
기본 우선주 주당 이익(원)			1,045	2,479

	주식			
	보통주		우선주	
	3개월	누적	3개월	누적
반기순이익(손실)	9,584,633	13,742,728	9,584,633	13,742,728
보통주에 귀속되는 반기순이익(손실)	8,423,518	12,077,888		
가중평균유통보통 주식수(천주)	5,969,783	5,969,783		
기본 보통주 주당 이익(원)	1,411	2,023		
우선주에 귀속되는 반기순이익(손실)			1,161,115	1,664,840
가중평균유통우선 주식수(천주)			822,887	822,887
기본 우선주 주당 이익(원)			1,411	2,023

희석주당이익에 대한 기술

회사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주는 없으며, 당반기 및 전반기의 기본주당이익과 희석주당이익은 동일합니다.

24. 현금흐름표

현금흐름의 회계정책에 대한 기술

회사는 영업활동 현금흐름을 간접법으로 작성하였습니다. 당반기 및 전반기 중 영업활동 현금흐름 관련 조정 내역 및 영업활동으로 인한 자산부채의 변동은 다음과 같습니다.

영업활동현금흐름

		공시금액
조정내역 계	조정내역 계	
	법인세비용	1,603,876
	금융수익	(598,313)
	금융비용	1,214,005
	퇴직급여	421,748
	감가상각비	13,946,056
조정내역 계	무형자산상각비	1,197,385
	대손상각비(환입)	4,151
	배당금수익	(9,369,762)
	유형자산처분이익	(23,000)
	유형자산처분손실	23,009
	재고자산평가손실(환입) 등	(3,138,015)

	기타	64,719
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동		(5,173,413)
	매출채권의 감소(증가)	(8,186,215)
	미수금의 감소(증가)	347,172
	장단기선급비용의 감소(증가)	(36,579)
	재고자산의 감소(증가)	629,265
	매입채무의 증가(감소)	3,471,000
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	장단기미지급금의 증가(감소)	(2,527,261)
	선수금의 증가(감소)	(42,665)
	예수금의 증가(감소)	108,484
	미지급비용의 증가(감소)	969,230
	장단기충당부채의 증가(감소)	1,339,017
	퇴직금의 지급	(382,872)
	기타	(861,989)

		공시금액
조정내역 계		(3,908,556)
	법인세비용	127,993
	금융수익	(712,113)
	금융비용	1,504,324
	퇴직급여	348,059
	감가상각비	12,502,893
	무형자산상각비	1,317,524
조정내역 계	대손상각비(환입)	7,777
	배당금수익	(21,845,780)
	유형자산처분이익	(69,275)
	유형자산처분손실	5,338
	재고자산평가손실(환입) 등	2,890,936
	기타	13,768
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동		(11,838,350)
	매출채권의 감소(증가)	(1,433,395)
	미수금의 감소(증가)	575,435
	장단기선급비용의 감소(증가)	(173,745)
어어하드 ㅇ글 이런 피시 버펜이	재고자산의 감소(증가)	(7,416,523)
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	매입채무의 증가(감소)	707,640
	장단기미지급금의 증가(감소)	(2,880,364)
	선수금의 증가(감소)	(82,392)
	예수금의 증가(감소)	(107,177)
	미지급비용의 증가(감소)	(1,635,068)

장단기충당부채의 증가(감소)	1,164,499
퇴직금의 지급	(202,846)
기타	(354,414)

리스 현금유출

당반기 (단위: 백만원)

	공시금액
리스부채에 대한 원금 상환, 재무활동에서 생기는 현금유출	105,934
리스부채에 대한 이자비용, 업업활동에서 생기는 현금유출	16,518

전반기 (단위: 백만원)

	공시금액
리스부채에 대한 원금 상환, 재무활동에서 생기는 현금유출	80,125
리스부채에 대한 이자비용, 업업활동에서 생기는 현금유출	11,552

25. 재무위험관리

금융상품에서 발생하는 위험의 성격과 정도에 대한 공시

당반기 (단위:백만원)

	위험						
	시장위험			신용위험	유동성위험	자본위험	위험 합계
	환위험	이자율위험	지분가격위험	2016 2016	π531B	사는게임	
위험에 대한 노출정 도에 대한 기술	회사는 글로벌 영업 활동을 수행함에 따 라 기능통화와 다른 통화로도 거래를 하 고 있어 환율변동위 함에 노출되어 있습 니다. 환율변동위함 에 노출되는 주요 통 화로는 USD, EUR 등	이자율변동위형은 시 장금리 변동으로 인 해 투자 및 재무활동 으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현 금흐름이 변동될 위 형으로서, 주로 예금 및 변동금리부 차입 금에서 비롯됩니다.	보고기간종료일 현재 지분상품(상장주식)의 주가가 1% 변동 할 경우 기타포괄손 익 (법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 20.860백만원(전반기 : 16.142백만원)입니 다.	회사의 금융자산 장 부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 회 사의 신용위험 최대 노출액은 금융자산 장부금액과 동일합니 다.			
	이 있습니다.	음에서 이웃답니다.	ч.				

	r		1		1	1	
				신용위험은 통상적인	유동성위험이란 회사		
				거래 및 투자 활동에	가 금융부채와 관련		회사는 영업활동에서
				서 발생하며 고객 또	된 모든 의무를 이행		파생되는 시장위험,
				는 거래상대방이 계	하는 데 어려움을 겪		신용위험, 유동성위
				약조건상 의무사항을	게 될 위험을 의미합		험 등을 최소화하는
				지키지 못하였을 때	니다. 회사의 주요 유		데 중점을 두고 재무
				발생합니다. 이러한	동성 공급원은 영업		
				신용위험을 관리하기	에서 창출한 현금 및		위험을 관리하고 있
	회사는 통화별 자산			위하여 고객과 거래	자본시장 및 금융기		으며, 이를 위해 각각
	과 부채규모를 일치			상대방의 재무상태와	관에서 조달한 자금		의 위험요인에 대해
	하는 수준으로 유지			과거 경험 및 기타 요	이며, 주요 유동성 수		면밀하게 모니터링
	하여 환율변동 영향			소를 고려하여 주기	요는 생산, 연구개발		및 대응하고 있습니
	을 최소화하는데 주			적으로 재무신용도를	을 위한 투자를 비롯		다.
	력하고 있습니다. 이			평가하고 있으며, 고	해, 운전자본, 배당		
	를 위해 수출입 등의			객과 거래상대방 각	등에 있습니다. 대규		재무위험은 글로벌
	경상거래 및 예금, 차			각에 대한 신용한도	모 투자가 많은 회사		재무관리기준을 수립
	입 등의 금융거래 발			를 설정·관리하고	사업 특성상적정 유		하고 고객과 거래선
	생시 기능통화로 거			있습니다. 그리고 위	동성의 유지가 매우		에 대한 주기적인 재
	래하거나 입금 및 지			험국가에 소재한 거	중요합니다. 회사는	회사의 자본관리 목	무위험 측정, 환헷지
	출 통화를 일치시킴			래처의 매출채권은	주기적인 자금수지	적은 계속기업으로서	및 자금수지 점검 등
	으로써 환포지션 발	회사는 내부자금 공	회사는 전략적 목적	보험한도 내에서 적	예측, 필요 현금수준	주주 및 이해관계자	을 통해 관리하고 있
	생을 최대한 억제하	유를 통해 외부차입	등으로 기타포괄손익	절하게 위험이 관리	산정 및 수입, 지출	에게 이익을 지속적	습니다.
위험관리의 목적, 정	고 있으나, 일부 발생	금을 최소화하여 이	-공정가치금융자산으	되고 있습니다.	관리 등을 통하여 적	으로 제공할 수 있는	
			로 분류된 지분상품	되고 있답니다.		능력을 보호하고 건	한편, 해외 주요 권역
책 및 절차에 대한 기	된 환포지션은 채권 매각, 선물환 등을 활	자율 변동으로 인한	에 투자하고 있습니	신용위험은 금융기관	정 유동성을 유지 •	전한 자본구조를 유	별로 지역금융센터
全		금융비용과 불확실성 을 최소화하고 있습	다. 이를 위하여 직ㆍ		관리하고 있습니다.	지하는 것입니다. 회	(미국, 영국, 싱가포
	용하여 환변동영향을		간접적 투자수단을	과의 거래에서도 발	키기드 기어버크	사는 신용등급, 부채	르, 중국, 브라질, 러
	축소하고 있습니다.	니다.	이용하고 있습니다.	생할 수 있으며 해당	회사는 권역별로	비율 등의 지표를 이	시아)에서 환율변동
	이는 회사가 노출된				Cash Pooling을 구축	용하여 자본위험을	모니터링 및 환거래
	환율변동위험을 감소			자산, 각종 예금 그리	하여 권역 내 개별 법	관리하고 있습니다.	대행을 통해 환율변
	시키지만 완전히 제			고 파생금융상품 등	인의 자금이 부족한		동위험을 관리하고
	거하지는 않을 수 있			의 금융상품 거래를	경우에도 유동성 위		있으며, 권역내 자금
	습니다. 또한, 회사는			포함합니다. 이러한	험에 효율적으로 대		을 통합운용하여 유
	효율적인 환율변동위			위험을 줄이기 위해,	응하고 있습니다.		동성위험에 대응하고
	험 관리를 위해 환위			회사는 국제 신용등	Cash Pooling은 자금		있습니다.
	험을 주기적으로 모			급이 높은 은행(S&P	부족 회사와 자금 잉		
	니터링 및 평가하고			A 이상)에 대해서만	여 회사간 자금을 공		회사의 재무위험관리
	있으며 투기적 외환			거래를 하는 것을 원	유하는 시스템으로		의 주요 대상인 자산
	거래는 엄격히 금지			칙으로 하고 있으며,	개별회사의 유동성		은 현금및현금성자산
	하고 있습니다.			기존에 거래가 없는	위험을 최소화하고		, 단기금융상품, 상각
				금융기관과의 신규	자금운용부담을 경감		후원가금융자산, 매
				거래는 해당 기관에	시키며, 금융비용을		
				대한 건전성 평가 등	절감하는 등의 효과		출채권 등으로 구성
				을 거쳐 시행하고 있	가 있습니다.		되어 있으며, 부채는
				습니다. 회사가 체결			매입채무, 차입금 등
				하는 금융계약은 부	또한, 대규모 유동성		으로 구성되어 있습
				채비율 제한 조항, 담	이 필요한 경우에 대		니다.
				보제공, 차입금 회수	비하여 본사의 지급		
	<u> </u>	<u> </u>	l .	<u> </u>	I	I .	<u> </u>

			등의 제약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고 있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하고 있습니다.	보증을 통해 해외 종 속기업이 활용할 수 있는 차입한도를 확 보하고 있으며, 보고 기간종료일 현재 국 제신용평가기관인 Moody's로부터 Aa2, S&P로부터 AA- 등 투자적격등급을 부여 받고 있어, 필요시 자 본시장을 통해 적기 에 자금조달이 가능 합니다.	
지분상품(상장주식)의 주가가 1% 변동 할 경우 기타포괄손 익에 미치는 영향		20,860			

전반기 (단위:백만원)

	위험						
	시장위험			신용위험	유동성위험	자본위험	위험 합계
	환위험	이자율위험	지분가격위험	ਦਿਲਜ਼ ਹਵਾਸ਼ਤ	#501B	사는게임	
위험에 대한 노출정							
도에 대한 기술							
위험관리의 목적, 정							
책 및 절차에 대한 기							
술							
지분상품(상장주식							
)의 주가가 1% 변동							
할 경우 기타포괄손			16,142				
익에 미치는 영향							

부채비율에 대한 공시

당반기말 (단위: 백만원)

	총장부금액
부채	80,764,694
자본	236,870,744
부채비율	0.341

	총장부금액
부채	72,069,515
자본	224,787,774
부채비율	0.321

공정가치 측정, 금융자산

당반기말 (단위: 백만원)

	현금및현금성자산	단기금융상품	매출채권	기타포괄손익-공정가 치금융자산	당기손익-공정가치금 융자산	기타	금융자산, 분류 합계
장부금액	7,818,179	3,819,491	35,819,815	2,189,910	0	5,313,571	54,960,966
공정가치				2,189,910	0	344,974	
장부금액이 공정가치							
의 합리적인 근사치							
로서 공정가치 공시						4,968,597	
제외된 금융자산							
						장부금액이 공정가치	
	장부금액이 공정가치	장부금액이 공정가치	장부금액이 공정가치			의 합리적인 근사치	
						로 금융자산	
공정가치 공시 제외	의 합리적인 근사치	의 합리적인 근사치	의 합리적인 근사치			4,968,597백만원(전	
사유에 대한 기술	이므로 공정가치 공	이므로 공정가치 공	이므로 공정가치 공			기말: 4,972,284백만	
	시대상에서 제외하였	시대상에서 제외하였	시대상에서 제외하였			원)은 공정가치 공시	
	습니다.	습니다.	습니다.			에서 제외하였습니다	

전기말 (단위: 백만원)

	현금및현금성자산	단기금융상품	매출채권	기타포괄손익-공정가 치금융자산	당기손익-공정가치금 융자산	기타	금융자산, 분류 합계
장부금액	6,061,451	50,071	27,363,016	1,854,503	1	5,365,519	40,694,561
공정가치				1,854,503	1	393,235	
장부금액이 공정가치							
의 합리적인 근사치							
로서 공정가치 공시						4,972,284	
제외된 금융자산							
						장부금액이 공정가치	
	장부금액이 공정가치	장부금액이 공정가치	장부금액이 공정가치			의 합리적인 근사치	
	의 합리적인 근사치	의 합리적인 근사치	의 합리적인 근사치			로 금융자산	
공정가치 공시 제외	이므로 공정가치 공	이므로 공정가치 공	이므로 공정가치 공			4,968,597백만원(전	
사유에 대한 기술						기말: 4,972,284백만	
	시대상에서 제외하였	시대상에서 제외하였	시대상에서 제외하였			원)은 공정가치 공시	
	습니다.	습니다.	습니다.			에서 제외하였습니다	

공정가치 측정, 금융부채

당반기말 (단위:백만원)

		매입채무	단기차입금	미지급공	유동성장기부채	유동성장기차입금	유동성사채	유동성사재 사재 진		장기미지급금	기타	금융부채, 분류 합 계
3	당부금액	11,513,195	9,676,020	11,010,018	265,348	258,481	6,867	20,573	22,869,831	4,403,185	4,789,062	64,547,232
ž	공정가치				7,415		7,415	23,873				

						장부금액이 공정가			
						치의 합리적인 근사			
						치이므로 공정가치			
				리스부채는 기업회					
	장부금맥이 공정가	장부금맥이 공정가	장부금액이 공정가			공시대상에서 제외	장부금액이 공정가	장부금액이 공정가	
				계기준서 제1107호					
	치의 합리적인 근사	치의 합리적인 근사	치의 합리적인 근사			하였습니다.	치의 합리적인 근사	치의 합리적인 근사	
공정가치 공시 제외				'금융상품: 공시'에					
사유에 대한 기술	치이므로 공정가치	치이므로 공정가치	치이므로 공정가치	따라 공정가치 공시		리스부채는 기업회	치이므로 공정가치	치이므로 공정가치	
자류에 대한 기울	공시대상에서 제외	공시대상에서 제외	공시대상에서 제외	따다 중앙가지 중시		계기준서 제1107호	공시대상에서 제외	공시대상에서 제외	
	8/10/8/01/1/1/12	8/14/8/41/1/14/14	8/14/8/4/1/1/4/14	대상에서 제외하였		게기간지 제1107호	8/14/8/11/1/14/14	8/14/8/W// AIM	
	하였습니다.	하였습니다.	하였습니다.	GIOWA ALMOM		'금융상품: 공시'에	하였습니다.	하였습니다.	
				습니다.					
						따라 공정가치 공시			
						대상에서 제외하였			
						습니다.			

전기말 (단위: 백만원)

	매입채무	단기차입금	미지급공	유동성장기부채	유동성장기차입금	유동성사채	사채	장기차입금	장기미지급금	기타	금융부채, 분류 합 계
장부금액	7,943,834	5,625,163	15,015,578	228,491	222,137	6,354	19,064	22,902,035	4,486,390	3,652,969	59,873,524
공정가치				6,757		6,757	21,695				
								장부금액이 공정가			
								치의 합리적인 근사			
					리스부채는 기업회			치이므로 공정가치			
	장부금액이 공정가	장부금액이 공정가	장부금액이 공정가					공시대상에서 제외	장부금액이 공정가	장부금액이 공정가	
	치의 합리적인 근사	치의 합리적인 근사	치의 합리적인 근사		계기준서 제1107호			하였습니다.	치의 합리적인 근사	치의 합리적인 근사	
공정가치 공시 제외	치이므로 공정가치	치이므로 공정가치	치이므로 공정가치		'금융상품: 공시'에			리스부채는 기업회	치이므로 공정가치	차이므로 공정가치	
사유에 대한 기술	공시대상에서 제외	공시대상에서 제외	공시대상에서 제외		따라 공정가치 공시			계기준서 제1107호	공시대상에서 제외	공시대상에서 제외	
	하였습니다.	하였습니다.	하였습니다.		대상에서 제외하였			'금융상품: 공시'에	하였습니다.	하였습니다.	
					습니다.			따라 공정가치 공시			
								대상에서 제외하였			
								습니다.			

긍용상품의 공정기치 서말체계에 따른 수준별 공시

당만가말 (단위: 박만원)

	측정 전체																			
	공정가치																			
	금융상품																			
	기타포괄손익-공	할수익-공경가치금향자산 기타금향자산 기타금향자산										유통성사재 사채								
	공경가치 서열체계의 모든 수준 공경가치 서열체계의 모든 수준				공정가치 서열	공정가치 서열치	공정가치 서명체계의 모든 수준 공정가치 서원			공정가치 서면체계의 모든 수준 공정가치 /			공정가치 서열	공정가치 서열체계의 모든 수준 공정기			공정가치 서원			
	수준 1	수준 2	수준 3	체계의 모든 수준 함계	수준 1	수준 2	수준 3	체계의 모든 수준 함계	수준 1	수준 2	수준 3	체계의 모든 수준 함계	수준 1	수준 2	수준 3	체계의 모든 수준 함계	수준 1	수준 2	수준 3	체계의 모든 수준 함계
금융자산	2,085,992	0	103,918	2,189,910	0	0	0	0	0	0	344,974	344,974								
금융부채													0	7,415	0	7,415	0	23,873	0	23,873

전기명 (단취: 백단원)

	측정 전체																			
	공정가치																			
	금융상품																			
	기타포괄손익-공	기타포괄슨악-공정가치금융자산 당기슨익-공정가치금융자산						기타금융자산				유동성사제				A/III				
	공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치			공정가치 서열	공정가치 서말체계의 모든 수준 공정가치 서말		공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열			공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열			공정가치 서울체계의 모든 수준 공정가치 서			공정가치 서면				
	◆문 1	수준 2	수준 3	체계의 모든	수준 1	수준 2	◆준 3	체계의 모든	 ◆⊕ 1	수준 2	수준 3	체계의 모든	수준 1	수준 2	中 준 3	체계의 모든	수준 1	中臣 2	수준 3	체계의 모든
				수준 함계				수준 함계				수준 함계				수준 함계				수준 함계
금융자산	1,757,336	0	97,167	1,854,503	0	0	1	1	0	0	393,235	393,235								
금융부채									·				0	6,757	0	6,757	0	21,695	0	21,695

금융상품의 공정가치측정에 대한 공시

	공정가치 서열체계 수준	공정가치 서열체계 수준	공정가치 서열체계 수준
	1	2	3
공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 자산	동일한 자산에 대한 시 장 공시가격	시장에서 관측가능한 투 입변수를 활용한 공정가 치 (단, '수준 1'에 포함 된 공시가격은 제외)	관측가능하지 않은 투입 변수를 활용한 공정가치
공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 부채	동일한 부채에 대한 시 장 공시가격	시장에서 관측가능한 투 입변수를 활용한 공정가 치 (단, '수준 1'에 포함 된 공시가격은 제외)	관측가능하지 않은 투입 변수를 활용한 공정가치

평가기법 및 투입변수에 대한 기술

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품은 '수준 1'에 포함됩니다. '수준 1'에 포함된 상품은 기타포괄손익-공정가치금융자산으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다.

활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 가치평가기법을 사용하여 측정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 '수준 2'에 포함됩니다. '수준 2'에포함된 상품은 사채 등이 있습니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 '수준 3'에 포함됩니다.

회사는 '수준 3'으로 분류되는 공정가치 측정을 포함하여 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있습니다. 재무보고 일정에 맞추어 공정가치 평가 과정 및 그 결과에 대해 협의하고 있고, 공정가치 '수준' 간 이동을 발생시키는 사건이나 상황의 변동이 일어난 보고기간종료일에 '수준' 변동을 인식하고 있습니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.

- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격
- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정

나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법, 이항분포 모형 등의 기타 가치평가기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.

회사는 공정가치 서열체계에서 '수준 2'로 분류되는 회사채, 국공채, 금융채 등에 대하여 미래현금호름을 적정이자율로 할인하는 현재가치법을 사용하고 있습니다.

보고기간종료일 현재 '수준 3'으로 분류된 주요 금융상품에 대하여 사용된 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.

자산의 공정가치측정에 사용된 균촉가능하지 않은 투임변수에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	공정가치 서면체계의	모든 수준													
	공정가치 서울체계 수	₹ 3													
	금융상품														
	기타포괄손익-공정가	으억~공정기치금향자산									7IEI				
	삼성변처투자㈜					쮜미코세라믹스					지문 졸옵션				
	관측할 수 없는 투입병	관측할 수 없는 투양변수 관측할 수 없는				관측할 수 없는 투입병	10			관측할 수 없는 무	관측할 수 없는 투입된	변수		관측할 수 없는 무	
	영구성장률, 투입번	가중평균자본비용,	무위점 이자율, 측	가격 변동성, 측정		영구성장률, 투입번	가중평균자본비용.	무위점 이자율, 측	가격 변동성, 측정		영구성장률, 투입번	가중평균자본비용.	무위형 이자율, 축	가격 변동성, 측정	C45 + 9C +
	÷	측정 투입변수	정 투입변수	투입변수	임변수 함계	+	측정 투입변수	정 투임변수	투입변수	임변수 함계	+	측정 투입변수	정 투임변수	투입변수	임변수 참계
가치평가기법					현금호통합인병					현금호통할인법 등					이랑모형
유의적이지만 관측															
할 수 없는 투임번	0.010	0.160				0.000	0.171						0.033	0.666	
수. 자산															
금융자산, 공정가치					33,309					39,621					344,974

자산의 공정가치측정에 대한 공시

당반기 (단위: 백만원)

	수준 3
기초금융자산	490,403
매입	0
매도	0
당기손익으로 인식된 손익	(48,261)
기타포괄손익으로 인식된 손익	6,750
반기말금융자산	448,892

전반기 (단위: 백만원)

	수준 3
기초금융자산	116,726
매입	27,784
매도	(283)
당기손익으로 인식된 손익	141,062
기타포괄손익으로 인식된 손익	1,526
반기말금융자산	286,815

관측할 수 없는 투입변수의 변동으로 인한 공정가치측정의 민감도분석 공시, 자산

(단위 : 백만원)

	공정가치 서열체계의	모든 수준									
	공정가치 서열체계 수	준 3									
	자산										
	기타포괄손익-공정가	치금융자산				기타					
	관측할 수 없는 투입번	년수 -			관측할 수 없는 투입	관측할 수 없는 투입변	변수 -			관측할 수 없는 투입	자산 합계
	영구성장률, 투입변	가중평균자본비용,	기초 자산 가격, 측	가격 변동성		영구성장률, 투입변	가중평균자본비용.	기초 자산 가격, 측	가격 변동성		
	수	측정 투입변수	정 투입변수	74 288	변수 합계	수	측정 투입변수	정 투입변수	74 558	변수 합계	
											금융상품의 민감도
											분석은 통계적 기법
											을 이용한 관측 불가
								주요 관측불가능한	주요 관측물가능한		능한 투입변수의 변
	주요 관측물가능한	주요 관측물가능한									동에 따른 금융상품
관측가능하지 않은	투입변수인 영구성	투입변수인 영구성						투입변수인 기초자	투입변수인 기초자		의 가치 변동에 기초
투입변수의 변동으	장률 및 가중평균자	장률 및 가중평균자						산 가격(20%) 및 가	산 가격(20%) 및 가		하여 유리한 변동과
로 인한 공정가치측	본비용을 1% 증가	본비용을 1% 증가						격 변동성(10%)을	격 변동성(10%)을		불리한 변동으로 구
정치의 민감도에 대	또는 감소시킴으로	또는 감소시킴으로						증가 또는 감소시킴	증가 또는 감소시킴		분하여 이루어집니
한 기술, 자산	써 공정가치 변동을	써 공정가치 변동을							으로써 공정가치 변		다. 그리고 공정가치
	산출하였습니다.	산출하였습니다.						동을 산출하였습니	동을 산출하였습니		가 두 개 이상의 투
								다.	다.		입변수에 영향을 받
											는 경우에는 가장 유
											리하거나 또는 가장
											불리한 금액을 바탕

									으로 산출됩니다.
									Ceedaa.
									당반기말 현재 '수준
									3'으로 분류되는 주
									요 금융상품의 투입
									변수의 변동에 따른
									손익효과(자본은 법
									인세효과 반영 전)에
									대한 민감도분석 결
									과는 다음과 같습니
									다.
관측할 수 없는 투입									
변수의 가능성이 어	0.01	0.01				0.20	0.10		
느 정도 있는 증가율	0.01	0.01				0.20	0.10		
. 자산									
관측할 수 없는 투입									7
변수의 가능성이 어	0.01	0.01				0.20	0.10		
느 정도 있는 감소율	0.01	0.01				0.20	0.10		
. 자산									
당기손익(세전)으로									
인식된, 가능성이 어									
느 정도 있고 대체할									
수 있는 가정을 반영									
하기 위한 하나 이상				0				87,629	
의 관측할 수 없는									
투입변수의 변동으									
로 인한 공정가치 측									
정치의 증가, 자산									
당기손익(세전)으로									
인식된, 가능성이 어									
느 정도 있고 대체할									
수 있는 가정을 반영									
하기 위한 하나 이상				0				(87,307)	
의 관측할 수 없는									
투입변수의 변동으									
로 인한 공정가치 축									
정치의 감소, 자산 기타포괄손익(세전									
)으로 인식된, 가능									
성이 어느 정도 있고									
대체할 수 있는 가정									
을 반영하기 위한 하				2,643				0	
나 이상의 관측할 수									
없는 투입변수의 변									
동으로 인한 공정가									
치 측정치의 증가,									
자산									

기타포괄손익(세전							
)으로 인식된, 가능							
성이 어느 정도 있고							
대체할 수 있는 가정							
을 반영하기 위한 하			(2,695)			0	
나 이상의 관측할 수			(2,033)				
없는 투입변수의 변							
동으로 인한 공정가							
치 측정치의 감소,							
자산							

26. 부문별 보고

영업부문에 통합기준을 적용하면서 이루어진 경영진의 판단에 대한 설명

회사는 전략적 의사결정을 수립하는 경영진(경영위원회)에게 보고되는 사업 단위를 기준으로 보고 부문을 결정하고 있습니다. 경영위원회는 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과 를 평가하기 위하여 부문의 영업이익을 기준으로 검토하고 있습니다.

매출은 대부분 재화의 매출로 구성되어 있습니다. 회사의 보고부문은 조직 및 수익을창출하는 제품의 유형을 기준으로 식별되었으며, 보고기간종료일 현재 보고부문은 DX 부문, DS 부문 등으로 구성되어 있습니다.

보고부문별 자산과 부채는 경영위원회에 정기적으로 제공되지 않아 포함하지 않았습니다.

영업부문에 대한 공시

당반기 (단위: 백만원)

	기업 전체 총계						
	영업부문		기업 전체 총계 합계				
	DX 부문		DS 부문				
	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	
매출액	28,238,893	58,820,343	28,093,113	50,922,486	53,734,118	104,973,735	
감가상각비	136,163	269,907	6,851,689	13,575,097	7,038,174	13,946,056	
무형자산상각비	396,828	790,089	156,254	292,440	610,446	1,197,385	
영업이익	1,667,732	2,606,630	5,554,284	6,621,286	7,222,491	9,229,871	
보고부문에 대한 기					기타는 별도로 표시	기타는 별도로 표시	
술					하지 않았습니다.	하지 않았습니다.	

	기업 전체 총계						
	영업부문				기업 전체 총계 합계		
	DX 부문		DS 부문				
	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	
매출액	25,539,424	54,775,598	14,511,343	27,855,964	39,729,088	81,897,767	
감가상각비	134,701	270,034	6,039,304	12,132,145	6,224,767	12,502,893	
무형자산상각비	423,127	830,016	178,340	371,066	660,403	1,317,524	
영업이익	1,035,370	2,257,012	(4,885,030)	(9,867,407)	(3,698,103)	(7,606,864)	
보고부문에 대한 기					기타는 별도로 표시	기타는 별도로 표시	
술					하지 않았습니다.	하지 않았습니다.	

종속기업 현황

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
	Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung International, Inc. (SII)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Mexicana S.A. de C.V (SAMEX)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Home Appliances America, LLC (SEHA)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Research America, Inc (SRA)	R&D	100.0
	SAMSUNG NEXT LLC (SNX)	해외자회사 관리	100.0
	SAMSUNG NEXT FUND LLC (SNXF)	신기술사업자, 벤처기 업 투자	100.0
	NeuroLogica Corp.	의료기기 생산 및 판매	100.0
	Samsung HVAC America, LLC	에어컨공조 판매	100.0
	Joyent, Inc.	클라우드서비스	100.0
	SmartThings, Inc.	스마트홈 플랫폼	100.0
미주	TeleWorld Solutions, Inc. (TWS)	네트워크장비 설치 및 최적화	100.0
	Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	반도체·디스플레이 패널 판매	100.0
	Samsung Federal, Inc. (SFI)	R&D	100.0
	Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	반도체 생산	100.0
	Samsung Oak Holdings, Inc. (SHI)	해외자회사 관리	100.0
	SEMES America, Inc.	반도체 장비 서비스	100.0
	Samsung Display America Holdings, Inc. (SDAH)	해외자회사 관리	100.0
	eMagin Corporation	디스플레이 패널 개발 및 생산	100.0
	Samsung Electronics Canada, Inc. (SECA)	전자제품 판매	100.0
	AdGear Technologies Inc.	디지털광고 플랫폼	100.0

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
	Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	전자제품 생산 및 판매	100.0
미주	Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Digital Appliance Mexico, SA de CV (SEDAM)	가전제품 생산	100.0

Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A. (SELA)	전자제품 판매	100.0
Samsung Electronics Latinoamerica Miami, Inc. (SEMI)	전자제품 판매	100.0
Samsung Electronica Colombia S.A. (SAMCOL)	전자제품 판매	100.0
Samsung Electronics Argentina S.A. (SEASA)	마케팅 및 서비스	100.0
Samsung Electronics Chile Limitada (SECH)	전자제품 판매	100.0
Samsung Electronics Peru S.A.C. (SEPR)	전자제품 판매	100.0
Samsung Electronics Venezuela, C.A. (SEVEN)	마케팅 및 서비스	100.0
Samsung Electronics Panama. S.A. (SEPA)	컨설팅	100.0
Harman International Industries, Inc.	해외자회사 관리	100.0
Harman Becker Automotive Systems, Inc.	오디오제품 생산, 판매 , R&D	100.0
Harman Connected Services, Inc.	Connected Service Provider	100.0
Harman Connected Services Engineering	Connected Service Provider	100.0
Corp.	Provider	
Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	오디오제품 생산, 판매	100.0
Harman de Mexico, S. de R.L. de C.V.	오디오제품 생산	100.0
Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	오디오제품 판매, R&D	100.0
Harman International Industries Canada Ltd.	오디오제품 판매	100.0
Harman International Mexico, S. de R.L. de C.V.	오디오제품 판매	100.0
Harman KG Holding, LLC	해외자회사 관리	100.0
Harman Professional, Inc.	오디오제품 판매, R&D	100.0
Roon Labs, LLC.	오디오제품 판매	100.0
Beijing Integrated Circuit Industry International Fund, L.P	벤처기업 투자	61.4
China Materialia New Materials 2016 Limited Partnership	벤처기업 투자	99.0

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
	Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	전자제품 판매	100.0
유럽 •	Samsung Electronics Ltd. (SEL)	해외자회사 관리	100.0
CIS	Samsung Semiconductor Europe Limited (SSEL)	반도체·디스플레이 패널 판매	100.0

Samsung Electronics GmbH (SEG)	전자제품 판매	100.0
Samsung Electronics Holding GmbH (SEHG)	해외자회사 관리	100.0
Samsung Semiconductor Europe GmbH (SSEG)	반도체·디스플레이 패널 판매	100.0
Samsung Electronics France S.A.S (SEF)	전자제품 판매	100.0
Samsung Electronics Italia S.P.A. (SEI)	전자제품 판매	100.0
Samsung Electronics Iberia, S.A. (SESA)	전자제품 판매	100.0
Samsung Electronics Portuguesa, Unipessoal, Lda. (SEP)	전자제품 판매	100.0
Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd. (SEH)	전자제품 생산 및 판매	100.0
Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	물류	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	전자제품 판매	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	해외자회사 관리	100.0
Samsung Electronics Nordic Aktiebolag (SENA)	전자제품 판매	100.0
Samsung Electronics Slovakia s.r.o (SESK)	TV·모니터 생산	100.0
Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o (SEPOL)	전자제품 판매	100.0
Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Zo.o (SEPM)	가전제품 생산	100.0
Samsung Electronics Romania LLC (SEROM)	전자제품 판매	100.0
Samsung Electronics Austria GmbH (SEAG)	전자제품 판매	100.0
Samsung Electronics Switzerland GmbH (SESG)	전자제품 판매	100.0
Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o. (SECZ)	전자제품 판매	100.0
SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS SIA (SEB)	전자제품 판매	100.0
Samsung Electronics Greece S.M.S.A (SEGR)	전자제품 판매	100.0
Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. (SEACE)	에어컨공조 판매	100.0
Samsung Nanoradio Design Center (SNDC)	R&D	100.0
Samsung Denmark Research Center ApS (SDRC)	R&D	100.0
Samsung Cambridge Solution Centre Limited (SCSC)	R&D	100.0
SAMSUNG Zhilabs, S.L.	네트워크Solution 개발	100.0
-1	1	

	, 판매	
FOODIENT LTD.	R&D	100.0
Samsung Electronics Rus Company LLC (SERC)	전자제품 판매	100.0
Samsung Electronics Rus Kaluga LLC (SERK)	TV 생산	100.0
Samsung Electronics Ukraine Company LLC (SEUC)	전자제품 판매	100.0
Samsung R&D Institute Ukraine (SRUKR)	R&D	100.0
Samsung Electronics Central Eurasia LLP (SECE)	전자제품 판매	100.0
Samsung R&D Institute Rus LLC (SRR)	R&D	100.0
Samsung Electronics Caucasus Co. Ltd (SECC)	마케팅	100.0
Samsung Electronics Uzbekistan Ltd. (SEUZ)	마케팅	100.0

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
	AKG Acoustics Gmbh	오디오제품 생산, 판매	100.0
	Apostera UA, LLC	Connected Service Provider	100.0
	Harman Audio Iberia Espana Sociedad Limitada	오디오제품 판매	100.0
	Harman Becker Automotive Systems GmbH	오디오제품 생산, 판매 , R&D	100.0
	Harman Becker Automotive Systems Italy S.R.L.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	오디오제품 생산, R&D	100.0
유럽ㆍ	Harman Belgium SA	오디오제품 판매	100.0
CIS	Harman Connected Services AB.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Finland Oy	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services GmbH	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services Poland Sp.zoo	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services UK Ltd.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Consumer Nederland B.V.	오디오제품 판매	100.0

Harman Deutschland GmbH	오디오제품 판매	100.0
Harman France SNC	오디오제품 판매	100.0
Harman Holding Gmbh & Co. KG	Management	100.0
	Company	
Harman Hungary Financing Ltd.	Financing Company	100.0
Harman Inc. & Co. KG	해외자회사 관리	100.0
Harman International Estonia OU	R&D	100.0
Harman International Industries Limited	오디오제품 판매, R&D	100.0
Harman International Romania SRL	R&D	100.0
Harman Management Gmbh	해외자회사 관리	100.0
Harman Professional Kft	오디오제품 생산, R&D	100.0
Harman Professional Denmark ApS	오디오제품 판매, R&D	100.0
Red Bend Software SAS	소프트웨어 디자인	100.0
Studer Professional Audio GmbH	오디오제품 판매, R&D	100.0
Harman Connected Services OOO	Connected Service	100.0
I laman connected services ooo	Provider	100.0
Harman RUS CIS LLC	오디오제품 판매	100.0

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
	Samsung Gulf Electronics Co., Ltd. (SGE)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Turkiye (SETK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Industry and Commerce Ltd. (SETK-P)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Levant Co., Ltd. (SELV)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Maghreb Arab (SEMAG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Egypt S.A.E (SEEG)	전자제품 생산 및 판 매	100.0
중동•	Samsung Electronics Israel Ltd. (SEIL)	마케팅	100.0
아프리 카	Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L (SETN)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Pakistan(Private) Ltd. (SEPAK)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Saudi Arabia Ltd. (SESAR)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Semiconductor Israel R&D Center, Ltd. (SIRC)	R&D	100.0
	Corephotonics Ltd.	R&D	100.0
	Samsung Electronics South Africa(Pty) Ltd. (SSA)	전자제품 판매	100.0

Samsung Electronics South Africa Production (pty) Ltd. (SSAP)	TV·모니터 생산	100.0
Samsung Electronics West Africa Ltd. (SEWA)	마케팅	100.0
Samsung Electronics East Africa Ltd. (SEEA)	마케팅	100.0
Global Symphony Technology Group Private Ltd.	해외자회사 관리	100.0
Harman Connected Services Morocco	Connected Service Provider	100.0
Harman Industries Holdings Mauritius Ltd.	해외자회사 관리	100.0
Red Bend Ltd.	오디오제품 생산	100.0

지역	기업명	업종	지분 율
	0		(%)(*)
	Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd. (SESP)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Malaysia Electronics (SME) Sdn. Bhd. (SME)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Display (M) Sdn. Bhd. (SDMA)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics (M) Sdn. Bhd. (SEMA)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Vina Electronics Co., Ltd. (SAVINA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	전자제품 생산	100.0
아시아 (중국	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	통신제품 생산	100.0
제외)	Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	디스플레이 패널 생산	100.0
	PT Samsung Electronics Indonesia (SEIN)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	PT Samsung Telecommunications Indonesia (STIN)	전자제품 판매 및 서비 스	100.0
	Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	전자제품 생산 및 판매	91.8
	Laos Samsung Electronics Sole Co., Ltd (LSE)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Philippines Corporation (SEPCO)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Australia Pty. Ltd.	전자제품 판매	100.0

(SEAU)		
Samsung Electronics New Zealand Limited (SENZ)	전자제품 판매	100.0
Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	전자제품 생산 및 판매	100.0
Red Brick Lane Marketing Solutions Pvt. Ltd.	마케팅	100.0
Samsung Display Noida Private Limited (SDN)	디스플레이 패널 생산	100.0
Samsung R&D Institute India-Bangalore Private Limited (SRI-Bangalore)	R&D	100.0
Samsung R&D Institute BanglaDesh Limited (SRBD)	R&D	100.0
Samsung Nepal Services Pvt, Ltd (SNSL)	서비스	100.0
Samsung Japan Corporation (SJC)	반도체·디스플레이 패 널 판매	100.0
Samsung R&D Institute Japan Co. Ltd. (SRJ)	R&D	100.0
Samsung Electronics Japan Co., Ltd. (SEJ)	전자제품 판매	100.0
Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd.	Connected Service Provider	100.0
Harman International (India) Private Limited	오디오제품 판매, R&D	100.0
Harman International Industries PTY Ltd.	해외자회사 관리	100.0
Harman International (Thailand) Co., Ltd.	오디오제품 생산, 판매	100.0
Harman International Japan Co., Ltd.	오디오제품 판매, R&D	100.0
Harman Singapore Pte. Ltd.	오디오제품 판매	100.0
-	-	

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
	Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd. (SEHK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET)	전자제품 판매	100.0
중국	Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd. (TSEC)	TV·모니터 생산	91.2
	Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd. (SSEC)	가전제품 생산	88.3
	Samsung Suzhou Electronics Export Co., Ltd. (SSEC-E)	가전제품 생산	100.0

Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd. (SESC)	R&D	100
Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (TSTC)	통신제품 생산	90
Beijing Samsung Telecom R&D Center (SRC-Beijing)	R&D	100
Samsung Electronics China R&D Center (SRC-Nanjing)	R&D	100
Samsung Mobile R&D Center China- Guangzhou (SRC-Guangzhou)	R&D	100
Samsung R&D Institute China-Shenzhen (SRC-Shenzhen)	R&D	100
Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	반도체·디스플레이 패널 판매	100
Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	반도체 생산	100
Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd. (SSCX)	반도체·디스플레이 패널 판매	100
Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd. (SESS)	반도체 임가공	100
Tianjin Samsung LED Co., Ltd. (TSLED)	LED 생산	100
Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd. (SSCR)	R&D	100
Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD)	디스플레이 패널 생산	100
Samsung Display Tianjin Co., Ltd. (SDT)	디스플레이 패널 생산	95
SEMES (XIAN) Co., Ltd.	반도체·FPD 장비 서 비스	100
Samsung Semiconductor Investment L.P. I	신기술사업자, 벤처기 업 투자	99
Harman (China) Technologies Co., Ltd.	오디오제품 생산	100
Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems Co., Ltd.	오디오제품 판매	100
Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd.	오디오제품 생산, R&D	100
Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd.	오디오제품 판매	100
Harman Connected Services Solutions (Chengdu) Co., Ltd.	Connected Service Provider	100
Harman Holding Limited	오디오제품 판매	100
Harman International (China) Holdings Co., Ltd.	오디오제품 판매, R&D	100
Harman Technology (Shenzhen) Co., Ltd.	오디오제품 판매, R&D	100

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)			
	삼성디스플레이㈜	디스플레이 패널 생산 및 판매	84.8			
	에스유머티리얼스㈜	디스플레이 패널 부품 생 산	50.0			
	스테코㈜	반도체 부품 생산	70.0			
	세메스㈜	반도체·FPD 장비 생산, 판매	91.5			
	삼성전자서비스㈜	전자제품 수리 서비스	99.3			
	삼성전자서비스씨에스㈜	고객상담서비스	100.0			
	삼성전자판매㈜	전자제품 판매	100.0			
	삼성전자로지텍㈜	종합물류대행	100.0			
	삼성메디슨㈜	의료기기 생산 및 판매	68.5			
	㈜희망별숲	식품 제조 가공	100.0			
	㈜미래로시스템	반도체 소프트웨어 개발 및 공급	99.9			
	㈜하만인터내셔널코리아	소프트웨어 개발 및 공급	100.0			
	SVIC 21호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0			
국내	SVIC 22호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0			
	SVIC 26호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0			
	SVIC 28호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0			
	SVIC 29호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0			
	SVIC 32호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0			
	SVIC 33호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0			
	SVIC 37호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0			
	SVIC 40호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0			
	SVIC 42호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0			
	SVIC 43호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0			
	SVIC 45호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업	99.0			

		투자	
SVIC 52호 신기	l ムモエスか	신기술사업자, 벤처기업	99.0
[SVIC 52호 전기	I 골 구 시 소입	투자	99.0
OVIO 555 AID	しくモリスか	신기술사업자, 벤처기업	00.0
SVIC 55호 신기	I돌구사소입	투자	99.0
SVIC 56호 신기	ムモエスか	신기술사업자, 벤처기업	99.0
[3시(0.30호 전기	I 골 구 시 소입	투자	99.0
SVIC 57호 신기	ムモエスか	신기술사업자, 벤처기업	00.0
[SVIC 57호 전기	I 골 구 시 소입	투자	99.0
SVIC 62호 신기	l ムモエスか	신기술사업자, 벤처기업	99.0
3시(62보 선기	I 골 구 시 소 입	투자	99.0
반도체성장 전문	문투자형 사모 투자신탁	반도체산업 투자	66.7
시스템반도체 성	상생 전문투자형 사모 투자	반도체산업 투자	60.5
신탁		[진도세산집 무사 	62.5
반도체 생태계	일반 사모 투자신탁	반도체산업 투자	66.7

특수관계자거래에 대한 공시

당반기 (단위:백만당

	전체 특석	·관계자																																	
	목수관계	자																																	
	· 泰辛刘俊																					관계기인	그 밖의 목수관계												
	삼성디 소용겐 이중		Samsu ng Asia Pte. Ltd. (SAPL)	Semic onduct	Harma nai 그 중속기 명	Semic	ng Semic onduct or,	(CHIN A) Invest ment Co.,	electro nics Vietna m THAIN GUYE N Co	ng India Electro nics Private Ltd.	Samsu ng Electro nics Europ e Holdin g Coope ratief U.A. (SEEH	ng Electro nics Vietna m Co.,	Samsu ng Displa y Vietna m Co.,	hail Samsu ng Semic onduct or Co.,	eletro nica da Amazo nia Ltda. (SEDA	Electro nics HCMC CE Compl ex Co.,	Samsu ng Electro nics (UK) Ltd. (SEUK	Electro nics Europ e	ng Interna tional, Inc. (Sii)	ng Electro	相明点	ng Electro nics Tahwa n Co., Ltd. (SET)	ng Electro nics Mexic o S.A. De C.V. (SEM)	Samsu ng Electro nics GmbH (SEG)	Samsu ng Electro	Dongg		합성에 소디에 소유위	<i>살성전</i> 기위	합성 SDIRR	(위재일 기획	기타 관계기 업 및 공동기 업	삼성분 산위	그 밖 의록 수관계 자.기 타	아 기 나 해 집 지 집 주 경
· 투 관계	5,865,	15,220	24	17	720	l		2,008,	1,425,		0	924,61			1,605,	318,37			143,67	1,627,	3,801	2,439,	1,658,	1,938,	552,82		27,709	70,614	31,920	42,831	33,542	308,66	11,192	281,36	

비위호 지난 치문. 목수근 개괴가 라 대답 등, 목 수관계 지기대 비위당 지난 대답 대답 대답 대답 대답 대답 대답 대답 대답 대답	942.98	115,67	7,588	2.174,	28,509	6.021.	423,72	7,439	12,454	3,283,	0	7.314,	0	0	2,756	764	58,963	653	712	1,112,	984,34	554	5,276	3,171	449	6,800, 353	912,22	430.12	162,68	441.78	122 439.11 7	60,814	334,83	
독수군 계자거 래에 대한 기술	사와의	특수관 계에 있는 개별회 사와의 거래 등역임		투수관 기에 있는 개별회 사와의 거래	Industr ies, Inc. 및 그 종	사와의 거래 공액당	사와의 거래 공액임	목수관 계에 있는 개별회 사외의 거래		계에 있는 개발회 사와의 거래 금액임	사와의 거래 공액임	사와의 거래 공액당	목수관 계에 있는 개발회 사와의 거래 공약임	특수관 계에 있는 개별회 사와의 거래 금액임	특수관 계예 있는 개별회 사와의 거래 공액당	계에 있는 개별회 사와의 거래 공약양	투수관 계에 있는 개별회 사원의 거래 공약임	특수관 계에 있는 개편회 사와의 거래 공액당	특수관 계에 있는 개별회 사와의 거래 금액임	특수관 계에 있는 개별회 사원의 기계 공학임	특수관 계에 있는 개변회 사와의 거래 금액임	특수관 계에 있는 개별회 사와의 거래 공액양	특수관 계에 있는 개별회 사와의 거래 금액임	특수관 계에 있는 개편회 사와의 거래 공액당	특수관 계에 있는 개별회 사와의 거래 공약임	사와의 거래 공액임	사와의 거래 공액임	사와의 거래 공맥임	사와의 거래 공액임	투수관 기에 있는 개별회 사와의 거래	회사와 특수관 계에 있는 계별회 사와의 구거래 금백임 나다.	특수관 계예 있는 개별회 사와의 거래 공액당	특수관 계에 있는 개별회 사와의 거래 공약임	4,832
여 기타 장기금 여																																		4,424

전반기 (단위: 백만당

																																			_
	전체 목*																																		_
	특수관계	I.V.																															그 밖의 5	목수관계	Π
	종속기원	;																										관계기원	및 공동기	업			D)		
											Samsu				Г																		~		
						Samsu			Samsu		ng			Shang	Samsu	Samsu		Samsu																	당하
		Samsu	Samsu	Samsu		ng (China	Samsu	Samsu	ng Electro	Samsu	Electro	Samsu	Samsu	hai Samsu	ng Eletro	Electro	Samsu	ng Electro	Samsu	Thai Samsu		Samsu	Samsu	Samsu	Samsu	Samsu									기업
	삼성티	ng Electro	ng Asia	Austin	Harma n⊒⊧ ⊐) Semic	ng Semic	(CHIN	nics Vietna	India Electro	Europ	Electro	Displa	ng Semic	nica da	HCMC	Electro	nics Europ	ng Interna	ng Electro	세메스	Electro	Electro	ng Electro	Electro	Displa y	기타	삼성에	삼성전	삼성	㈜제일	기타 관계기	삼성물	다 바 이	해 2
	스플레	nics Americ	Pte.	onduct	총속기	onduct	onduct	Invest	m THAIN	nics	Holdin	Vietna	Vietna	onduct	Amazo	Compl	(UK)	e	tional.	nics	(R)	Taiwa	Mexic o S.A.	nics	Benelu	Dongg	총속기 업	스티에	71(89)	SDIR	기획	업 및 공동기	산위	수관계 자,기	지비
		a, Inc.	Ltd.	or LLC.	δ0	or Co.,	Inc.	Co.,	GUYE	Private Ltd.	Coope	m Co.,	m Co.,	Co.,	nia Ltda.	ex Co.,	Ltd.	Logisti	Inc.	Co., Ltd.		n Co., Ltd.	De C.V.	GmbH (SEG)	x B.V.	Co.,						δ0		E	平 5
				(SAS)		Ltd. (SCS)		(SCIC)	Ltd. (SEVT)	(SIEL)	U.A. (SEEH	(SEV)	(SDV)	Ltd. (SSS)	(SEDA	Ltd. (SEHC)	B.V. (SELS)		(TSE)		(SET)	(SEM))	(SDD)									
-88)																								
. 특 관계	137,14	14,863 ,612	37	1,135	0	51,078	9,097.	3,861, 951	1,947. 849	1,569.	0	1,200,	631,35	5,606,	676,92 2		1,114,	2,494, 493	123,09	1,413, 307	4,380		1,297,	1,680,	1,164, 819	58,882	.854	100,60	49,539	41,079	34,644	278,09	13,016	207,88	
거래 유동																																			H
الا الا																																			
P 관	0	0	0	0	0	30,686	0	0	196	118	0	0	0	0	0	965	0	0	51	0	0		0	0	0	0	2,717	0	0	0	0	0	70	0	
2																																			
III	738,87	105,37	14,289	2,091,	30,015	5,008,	331,87	5,270	10,352	2,195,	0	6,675,	0	0	12,630	2,617,	56,462	4,298		1,226,	1,243,		3,041	3,457	685	0		871,96	441,31	198,08	419,22	425,72	24,997	449,28	
관계 거래 유동	7	9		445		994	4		,523	873		894				708			194	275	475						608	8	9	5	0	5		3	
21																																			
. ₽	0	0	0	1,058	0	10,575	0	0	263	0	0	767	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	1,964	148,50		16,901	76	3,003	1,874, 820	118,06	
Η																																			

					회사와																													
					특수관																													
					ян																													
					있는																													
					개분회																													
					사와의																													
					거래																													
					급백입																													
					un.																													
	회사와	회사와	회사와	회사와	Harma	회사와	회사와	회사와	회사와	회사와	회사와	회사와	회사와	회사와	회사와	회사와	회사와	회사와	회사와	회사와	회사와	회사와	회사와	회사와	회사와	회사와	회사와	회사와	회사와	회사와	회사와	회사와	회사와	
	특수관	특수관	특수관	특수관	n	특수관	특수관	특수관	특수관	특수관	특수관	특수관	특수관	특수관	특수관	특수관	특수관	특수관	특수관	특수관	특수관	특수관	특수관	특수관	특수관	특수관	특수관	특수관	특수관	특수관	특수관	특수관	특수관	
목수관	ЯM	ЯH	ЯМ	ЯM	Interna	সালা	ЯМ	ЯМ	ЯM	ЯМ	ЯМ	সালা	ЯМ	ЯМ	ЯOI	ЯМ	ЯМ	সালা	ЯМ	ЯМ	ЯM	ЯМ	সালা	ЯМ	ЯН	ЯOI	ЯМ	ЯН	সালা	ям	ЯМ	ЯOI	ям	
계자거	있는	있는	있는	있는	tional	있는	있는	있는	있는	있는	있는	있는	있는	있는	있는	있는	있는	있는	있는	있는	있는	있는	있는	있는	있는	있는	있는	있는	있는	있는	있는	있는	있는	
래에	개변회	개변회	개변회	개변회	Industr	개변회	개변회	개별회	개변회	개변회	개별회	개변회	개본회	개별회	개변회	개변회	개별회	개변회	개변회	개별회	개변회	개별회	개변회	개본회	개본회	개변회	개본회	개본회	개변회	개변회	개별회	개변회	개변회	
대한	사와의	사와의	사와의	사와의	industr	사와의	사와의	사와의	사와의	사와의	사와의	사와의	사와의	사와의	사와의	사와의	사와의	사와의	사와의	사와의	사와의	사와의	사와의	사와의	사와의	사와의	사와의	사와의	사와의	사와의	사와의	사와의	사와의	
기술	거래	ЭВ	거래	거래	ies,	거래	거래	거래	거래	거래	거래	거래	거래	거래	거래	거래	거래	거래	거래	거래	거래	거래	거래	거래	거래	거래	거래	거래	거래	거래	거래	거래	거래	
	금액입	급맥입	급액입	금액입	Inc. 및	급액입	급액입	급맥입	급액입	급액입	급맥입	급액입	급액임	급력입	급액입	급액입	급맥입	급액입	급액입	급맥입	급액입	급맥입	급액입	급액임	급택입	급액입	급액임	급택입	급액입	급액입	급맥입	급액입	급액입	
	UD.	UD.	ue.	UD.	⊒ #	ue.	니다.	ua.	UD.	us.	ua.	ue.	니다.	UG.	ue.	니다.	ua.	ue.	us.	UD.	UD.	ua.	uв.	니다.	UD.	UE.	니다.	UD.	uв.	니다.	ua.	UE.	니다.	
					속기업																													
					이 포																													
					88 EE																													
					중간지																													
					배기업																													
					과의																													
					거래																													
					급역입																													
51313					UD.																													
단기급																																		5,154
퇴직금																																		\vdash
OI																																		279
기타																																		
장기급																																		3,917
Ol																																		

특수관계자거래에 대한 공시, 합계 당반기

전체 특수관계자 특수관계자 전체 특수관계자 합계 관계기업 및 공동 그 밖의 특수관계 종속기업 기업 자 매출 등, 특수관계 101,690,080 487,576 292,555 자거래 비유동자산 처분, 19,092 122 0 특수관계자거래

(단위:백만원)

매입 등, 특수관계 자거래	48,230,269	2,385,930	395,650	
비유동자산 매입, 특수관계자거래	6,770	136,104	2,219,829	
특수관계자에게 대 여한 내역	0	0		
특수관계자로부터 차입한 내역	0	0		
출자, 특수관계자 거래	298,433	0		
출자금 회수, 특수 관계자거래	151,458	0		
지급결의한 배당금 , 특수관계자거래				813,272
리스 이용 계약, 특 수관계자거래				21,752
리스이용자로서 리 스, 특수관계자거 래				32,051
특수관계자거래의 채권,채무에 대하 여 제공하거나 제 공받은 보증의 상 세 내역에 대한 설 명				회사는 보고기간종 료일 현재 특수관 계자의 채무에 대 하여 채무보증을 제공하고 있습니다 (주석 13 참조).

전반기 (단위: 백만원)

	전체 특수관계자			
	특수관계자			전체 특수관계자
	종속기업	관계기업 및 공동 기업	그 밖의 특수관계 자	합계
매출 등, 특수관계 자거래	77,027,215	503,960	220,898	
비유동자산 처분, 특수관계자거래	34,733	0	70	
매입 등, 특수관계 자거래	42,999,266	2,356,317	474,280	
비유동자산 매입, 특수관계자거래	14,627	168,483	1,992,880	
특수관계자에게 대 여한 내역	0	0		
특수관계자로부터 차입한 내역	21,990,000	0		

출자, 특수관계자 거래	10,532	58,982	
출자금 회수, 특수 관계자거래	107,217	518	
지급결의한 배당금 , 특수관계자거래			825,850
리스 이용 계약, 특 수관계자거래			0
리스이용자로서 리 스, 특수관계자거 래			9,963
특수관계자거래의 채권,채무에 대하 여 제공하거나 제 공받은 보증의 상 세 내역에 대한 설 명			

대규모기업집단 소속회사 거래에 대한 공시

당반기 (단위:백만원)

	거래상대방			
	대규모기업집단 소득	속회사		 거래상대방 합계
	 삼성이앤에이㈜	(주)에스원	기타 대규모기업집 단 소속회사	71410410 1171
매출 등, 대규모기 업집단 소속회사 거래	281	1,905	98,345	100,531
비유동자산 처분, 대규모기업집단 소 속회사 거래	0	0	0	0
매입 등, 대규모기 업집단 소속회사 거래	29,688	225,336	76,863	331,887
비유동자산 매입, 대규모기업집단 소 속회사 거래	1,501,585	8,696	298,502	1,808,783
지급결의한 배당금 , 대규모기업집단 소속회사 거래				64,116
대규모기업집단 소 속회사 거래에 대 한 기술	회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.	회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.	회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.	

	기업회계기준서 제	기업회계기준서 제	기업회계기준서 제	
	1024호 특수관계자	1024호 특수관계자	1024호 특수관계자	
	범위에 포함되지	범위에 포함되지	범위에 포함되지	
대규모기업집단 소	않으나 「독점규제	않으나 「독점규제	않으나 「독점규제	
속회사 관계의 성	및 공정거래에 관	및 공정거래에 관	및 공정거래에 관	
격에 대한 기술	한 법률」에 따른	한 법률」에 따른	한 법률」에 따른	
	동일한 대규모기업	동일한 대규모기업	동일한 대규모기업	
	집단 소속회사입니	집단 소속회사입니	집단 소속회사입니	
	다.	다.	다.	

전반기 (단위: 백만원)

	거래상대방			
	대규모기업집단 소득	속회사) 거래상대방 합계
	삼성이앤에이㈜	㈜에스원	기타 대규모기업집 단 소속회사	7410410 11
매출 등, 대규모기 업집단 소속회사 거래	680	2,606	77,658	80,944
비유동자산 처분, 대규모기업집단 소 속회사 거래	0	0	0	0
매입 등, 대규모기 업집단 소속회사 거래	15,188	222,138	101,852	339,178
비유동자산 매입, 대규모기업집단 소 속회사 거래	1,359,554	7,432	147,800	1,514,786
지급결의한 배당금 , 대규모기업집단 소속회사 거래				64,116
대규모기업집단 소 속회사 거래에 대 한 기술	회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.	회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.	회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.	
대규모기업집단 소 속회사 관계의 성 격에 대한 기술	기업회계기준서 제 1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관 한 법률」에 따른 동일한 대규모기업 집단 소속회사입니 다.	기업회계기준서 제 1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관 한 법률」에 따른 동일한 대규모기업 집단 소속회사입니 다.	기업회계기준서 제 1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관 한 법률」에 따른 동일한 대규모기업 집단 소속회사입니 다.	

목수관계자에 대한 채권 채무에 대한 공시

(단위:백만원

	전체 목수	관계자																															
	목수관계	자																															
	총속기업																										관계기업	및 공동기(걸			그 밖의 :	특수관계
		1					1							1							1									ı	1	자	
									Samsu		Samsu					Samsu																	
						Samsu		Samsu	ng	Samsu	ng	Samsu		Shang	Samsu	ng		Samsu		Thai		Samsu	Samsu										
		Samsu		Samsu				ng	Electro		Electro		Samsu	hai			Samsu						ng		Samsu								
			Camaii			ng	Samsu	(CHINA	nics	ng	nics	ng		Camari	ng	Electro		ng	Samsu	Samsu		ng	Electro	Samsu									
		ng	Samsu	ng	Harma	(China)	ng	CHINA	nics	India	nics	Electro	ng	Samsu	Eletroni	nics	ng	Electro	ng	ng		Electro	Electro	ng	ng						기타 관		그 밖의
	삼성디	Electro	ng Asia	Austin)	Vietna		Europe		Display	ng			Electro						nics		Electro		삼성에						
	스플레	nics	Pte.	Semico	n⊒⊦⊐	Semico	Semico	Invest	m	Electro	Holdin	nics	Vietna	Semico	ca da	HCMC	nics	nics	Internat	Electro	세메스	nics	Mexico	Electro	nics	기타 총	스디에	삼성전	삼성	㈜제일	계기업	삼성물	특수관
					총속기	nducto	nducto			nics		Vietna			Amazo	CE		Europe	ional,	nics	(49)	Taiwan		nics		속기업		71(9)	SDIM	기획	및 공동	산(주)	계자.
	01(69)	Americ	Ltd.	nducto	Qi Qi	r Co.,	r, Inc.	ment	THAIN	Private	g	m Co.,	m Co.,	nducto	nia	Compl	(UK)	Logisti	Inc.	Co.,		Co.,	S.A.	GmbH	Benelu		스(위)				기업		기타
		a, Inc.	(SAPL)	r LLC.				Co.,	GUYEN		Cooper		Ltd.	r Co.,			Ltd.						De		x B.V.								
		(SEA)		(SAS)		Ltd.	(SSI)	Ltd.	Co.,	Ltd.	atief	Ltd.	(SDV)	Ltd.	Ltda.	ex Co.,	(SEUK)	cs B.V.	(SII)	Ltd.		Ltd.	C.V.	(SEG)	(SEBN)								
						(SCS)				(SIEL)		(SEV)			(SEDA)	Ltd.		(SELS)		(TSE)		(SET)											
								(SCIC)	Ltd.		U.A.			(SSS)		(SEHC)							(SEM)										
									(SEVT)		(SEEH)																						
채권 등																																	
. = 4		5,248,					7,688,	145,69	788,42	839,26		649,60	194,51	6,309,	315,35	115,58	107,90	553,69	160,84	216,65		446,71	186,96	124,46		7,811.			117,67		123,38	188,86	
	26,243		2,414	9,451	1,832	67,137					2,166										46,216				39,082		5,518	475		15			23,161
관계자		703					494	3	4	4		1	7	328	1	5	0	6	3	5		0	5	9		385			7		7	6	
거래																																	
채무 등																																	
. = 4	237,77	198,84		361,93		1,083,	240,44		3,354,	568,62		2,447,				506,47			299,64	186,66	736,65					1,685,	517,29	103,45		285,90	118,73	510,14	259,30
관계자			1,335		4,539	464		2,285	579		0	800	0	28	1,478		56,601	251			8	47,269	1,282	15,222	5,103	003	8	0	34,046				
관계사	7	6		0		464	0		5/9	1		602				4			0	4	8					003	8	0		3	1	3	3
거래																																	

					회사와																												
					특수관																												
					계에 있																												
					는 개별																												
					회사에																												
					대한 채																												
					권ㆍ채																												
	회사와	회사와	회사와	회사와	무 공역	회사와	회사와	회사와	회사와	회사와	회사와	회사와	회사와	회사와	회사와	회사와	회사와	회사와	회사와	회사와	회사와	회사와	회사와	회사와	회사와	회사와							
	특수관	특수관	특수관	특수관	입니다.	특수관	특수관	특수관	특수관	특수관	특수관	특수관	특수관	특수관	특수관	특수관	특수관	특수관	특수관	특수관	특수관	특수관	특수관	특수관	특수관	특수관							
	계에 있				총속기	계에 있	계에 있	계에 있	계에 있	계에 있	계에 있	계에 있				계에있				계에 있	계에 있		계에 있	ମାଡା ଅ									
					업 채권																												
	는 개별	는 개별	는 개별	는 개별	OH EHRI	는 개별	는 개별	는 개별	는 개별	는 개별	는개별	는개별	는 개별	는 개별	는 개별	는개병	는 개별		는 개별	는 개별	는 개별	는개별	는 개별	는 개별	는 개별	는 개별							
	회사에	회사에	회사에	회사에	여 인식	회사에	회사에	회사에	회사에	회사에	회사에	회사에	회사에	회사에	회사에	회사에	회사에	회사에	회사에	회사에	회사에	회사에	회사에	회사에	회사에	회사에	회사와						
	대한 채	대한 채	대한 채	대한 채	된 손실	대한 채	대한 채	대한 채	대한 채	대한 채	대한 채	대한 채	대한 채	대한 채	대한 채	대한 채	대한 채	대한 채	대한 채	대한 채	대한 채	대한 채	대한 채	대한 채	대한 채	대한 채	특수관	특수관	특수관	특수관	특수관	특수관	목수관
	권·채	권·채	권·채	권·채	충당급	권ㆍ채	권·채	권·채	권ㆍ채	권·채	권·채	권·채	권·채	권·채	권ㆍ채	권ㆍ채	권ㆍ채	권·채	권·채	권·채	권·채	권・채	권·채	권·채	권·채	권·채	계에 있	게에 있					
	무 금액	무 금맥	무 공역	무 공역	다. 다. 다.	무급액	무공역	무공맥	무 금액	무 공역	무공액	무급력	무공역	무급액	무급액	무급액	무공액	무 공액	무급력	무공역	무공액	무 금액	무공액	무 금맥	무 금맥	무 공역	는개별	는개별	는개별	는 개별	는개별	는 개병	는 개별
	입니다.	입니다.	입니다.	입니다.	UG.	입니다.	입니다.	입니다.	입니다.	입니다.	입니다.	입니다.	입니다.	입니다.	입니다.	입니다.	입니다.	입니다.	입니다.	입니다.	입니다.	입니다.	입니다.	입니다.	입니다.	입니다.	회사에						
특수관	총속기	종속기	홍속기	종속기		총속기	총속기	총속기	총속기	종속기	홍속기	총속기	총속기	홍속기	홍속기	총속기	총속기	종속기	홍속기	총속기	홍속기	총속기	총속기	총속기	총속기	종속기	대한 채						
계자 채	엄 채권	엄 채권	엄 채권	엄 채권	채무 등	업 채권	업 채권	업 채권	엄 채권	엄 채권	엄 채권	업 채권	업 채권	엄 채권	엄 채권	업 채권	업 채권	업 채권	엄 채권	업 채권	업 채권	업 채권	업 채권	업 채권	엄 채권	엄 채권	권·채						
권채무	OH EH 81	OII CH 81	OH CH8+	OH CH8+	은 리스	에 대하	01 (18)	01 (18)	예대하	OH CH8+	OH CHAH	01 EH8)	01 (18)	에 대하	에 대하	에 대하	예대하	OII CII SI	01 (18)	01 (18)	01 EH8)	예대하	01 (188)	에 대하	OII CH88	에 대하	무금액	무급액	무급액	무급액	무급역	무급액	무공액
예대한	여 인식	여 인식	여 인식	여 인식	부채가	여 인식	여 인식	여 인식	여 인식	여 인식	여 인식	여 인식	여 인식	여 인식	여 인식	여 인식	여 인식	여 인식	여 인식	여 인식	여 인식	여 인식	여 인식	여 인식	여 인식	여 인식	입니다.						
기술	된 손실	된손실	된손실	된손실	포함된	된 손실	된 손실	된 손실	된 손실	된손실	된손실	된손실	된손실	된 손실	된 손실	된 손실	된손실	된손실	된 손실	된손실	된 손실	된 손실	된 손실	된 손실	된 손실	된 손실	채무 등						
	800	충당급	충당급	800	급액입	000 010	충당급	총당급	\$G3	충당급	90 00 01	\$000 010	충당급	총당급	\$00 000 000	\$00 B	200 E	885	50 TE	충당급	\$G1	*655	충당급	총당급	총당급	883	은 리스						
	은 Q(습	은 없습	은 없습	은 없습 은 없습	UD.	(1) (1) (1)	은 없습 은 없습	Q 05台	E 85 fb	은 없습 은 없습	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	10 20 03 03	전 전 전	은 없습 은 없습	은 없습 은 없	60 60 61	은 없습	은 없습		은 없습 은 없습	2000 台	2. 双台	은 없습	은 없습 은 없습	2 St 6	은 없습	부채가	부채가	부채가	부채가	부채가	부채가	무재가
	UEL.	UG.	UG.	uo.	Harma	UD.	uc.	UEL.	UD.	uo.	UD.	UD.	UD.	UD.	uo.		UD.	UG.	UEI.	UEI.	ua.	UG.	UD.	UEL.	UG.	uo.	포함된						
					n																												
	채무 등				Internat		채무 등									채무 등			채무 등						채무 등			급액입	급액입	급액입	급액입	급맥입	급백입
	은 리스	은 리스	은 리스	은 리스	ional	은 리스	은 리스	은 리스	은 리스	은 리스	은 리스	은 리스	은 리스	은 리스	은 리스	은 리스	은 리스	은 리스	은 리스	은 리스	은 리스	은 리스	은 리스	은 리스	은 리스	은 리스	UG.	UD.	UD.	UD.	UEI.	UD.	UD.
	부채가	부채가	부채가	부채가	Industri	부채가	부채가	부채가	부채가	부채가	부채가	부채가	부채가	부채가	부채가	부채가	부채가	부채가	부채가	부채가	부채가	부채가	부채가	부채가	부채가	부채가							
	포함된	포함된	포함된	포장된	es, Inc.	포함된	포함된	포함된	포함된	포장된	포함된	포함된	포함된	포함된	포함된	포함된	포함된	포함된	포함된	포함된	포함된	포함된	포함된	포함된	포함된	포함된							
	급액입	금액임	금맥임	금맥입	및그	30 and	금액입	급액입	급력입	금맥입	300	급액입	급액입	금맥입	금맥입	급백입	급액입	급액업	급액입	급액입	급력입	급액입	급액입	급액임	급액입	금맥임							
	UEI.	UG.	UD.	UD.	총속기	UD.	UD.	UE.	UD.	UD.	ut.	UD.	UD.	UD.	UD.	ua.	UD.	ив.	ua.	UD.	UD.	us.	UD.	UD.	UEI.	UD.							
					엄이 포																												
					합된 중																												
					간지배																												
					기업과																												
					외거래																												
					급액입																												
					니다.																												

크기판 (연위:백단환)

전체 목수근계자		
찍수군개자		
응속기업	관계기업 및 광동기업	그 밖의 목수관계 자

									Samsu		Samsu																						
								Samsu	ng		ng			Shang		Samsu							Samsu										
		Samsu		Samsu		Samsu		ng	Electro	Samsu	Electro	Samsu	Samsu		Samsu	ng	Samsu	Samsu		Thai		Samsu	ng		Samsu								
						ng	Samsu			ng		ng			ng	Electro		ng	Samsu	Samsu		ng		Samsu									
		ng	Samsu					(CHINA	nics		nics		ng	Samsu			ng						Electro		ng								
	삼성디	Electro	ng Asia			(China))		India	Europe	Electro	Display		Eletroni	nics	Electro	Electro	ng	ng		Electro	nics	ng	Electro		삼성에				기타 관		그 밖의
						Semico	Semico			Electro		nics			ca da	нсмс			Internat	Electro	세메스	nics		Electro		기타 종		삼성전	삼성	㈜제일	계기업	삼성물	독수관
	스플레	nics	Pte.					Invest	m		Holdin		Vietna	Semico			nics						Mexico		nics		스디에						
	0(69	Americ	Ltd.			nducto	nducto	ment	THAIN	nics	g	Vietna	m Co	nducto		CE	(UK)	Europe	ional,	nics	(49)	Taiwan	S.A.	nics	Benelu	속기업	스위	71(9)	SDIM	기획	및 공동	산(주)	계자.
	-11.7					r Co.,	r, Inc.			Private		m Co.,	,			Compl		Logisti	Inc.	Co.,		Co.,		GmbH			_,,,				기업		기타
		a, Inc.	(SAPL)	r LLC.				Co.,	GUYEN		Cooper		Ltd.	r Co.,			Ltd.						De		x B.V.								
		(SEA)		(SAS)		Ltd.		Ltd	Co.,	Ltd.	atief	Ltd.	(90)()	Ltd.		ex Co.,	(SEUK)		(SII)	Ltd.		Ltd.	C.V.	(SEG)	(SEBN)								
		(00)		(0/10)		(SCS)		Liu.		(SIEL)		(SEV)				Ltd.		(SELS)		(TSE)		(SET)			(OLDIV)								
								(SCIC)	Ltd.		U.A.			(SSS)									(SEM)										
									(SEVT)		(SEEH)					(SEHC)																	
채권 등									(0211)		(GEET)																						
. =+		3,841,						181,78	925,41	922,63		502,41		l	256,93	148,85			129,17	280,68	1	362,73	l			6,556.			114,10			190,44	1 1
관계자	74,259	560	2,091	9,575	5,179	68,251		5	0		2,760	0	90,305	968	6		64,642	1	8	2	68,340	7	l	l	52,172	255		1,857	3		8	3	13,835
C.M.A.		500					4.4							500		,						,	ľ			233							
거래																																	
채무 등																																1	
=.	196,68	1 110		303,20		887.41	209,78	201.00	2 324	207.62		1,377,				367,00				287.85	917,70					2 607	418,78			420.42	183 81	1,876,	149,58
. ===	100,00	1,118.	1,147		9,659		200,10	201,00	2,324,	201,02	0			281				415	54,694		1		2,021	4,448	6,266		+10,70		50,149		103,01	1,070,	140,00
관계자	6	907		3		0	9	6	691	8		493				7				9	7					878	7			5	3	745	5
ЭZH																																	
2101																																<u> </u>	

		1			회사와		l								l	i				l					l	l							
					특수관																												
					계에 있																												
					는개별																												
					회사에																												
					대한채																												
					권·채																												
					무공액																												
	회사와	회사와	회사와	회사와		회사와	회사와	회사와	회사와	회사와	회사와	회사와	회사와	회사와	회사와	회사와	회사와	회사와	"회사와	회사와	회사와	회사와	회사와	회사와	회사와	회사와							
	특수관	특수관	특수관	목수관	입니다.	특수관	특수관	특수관	특수관	특수관	특수관	특수관	특수관	특수관	목수관	특수관	특수관	특수관	특수관	특수관	목수관	특수관	특수관	특수관	특수관	목수관							
	계에 있	계에 있	계에 있	계에있	홍속기	계에있	계에있	계에 있	계에 있	계에 있	계에 있	계에있	계에 있	계에 있	계에 있	계에있	계에 있	계에있	계에 있	계에있	계에 있	계에있	계에있	계에있	계에있	계에있							
	는 개별	는 개별	는개별	는개별	업 채권	는개별	는개별	는 개별	는 개별	는개별	는개별	는개별	는 개별	는 개별	는개별	는개별	는 개별	는개별	는 개별	는개별	는 개별	는 개별	는개별	는 개별	는개별	는개별							
	회사에	회사에	회사에	회사에	OII CIEST	회사에	회사에	회사에	회사에	회사에	회사에	회사에	회사에	회사에		회사에	회사에	회사에	회사에	회사에	회사에	회사에	회사에	회사에	회사에	회사에	회사와						
					여 인식																												
	대한 채	대한 채	대한 채	대한 채	된 손실	대한 채	대한 채	대한 채	대한 채	대한 채	대한 채	대한 채	대한 채	대한 채	대한 채	대한 채	대한 채	대한 채	대한 채	대한 채	대한 채	대한 채	대한 채	대한 채	대한 채	대한 채	특수관						
	권·채	권·채	권ㆍ채	권·채	충당금	권・채	권·채	권·채	권·채	권·채	권·채	권・채	권·채	권・채	권·채	권ㆍ채	권·채	권・채	권·채	권·채	권·채	권ㆍ채	권・채	권·채	권·채	권·채	계에 있						
	무급역	무금맥	무 금액	무 금액	은 없습	무 금액	무 금액	무급력	무 급액	무급역	무급액	무 금액	무금액	무 금액	무금액	무금액	무 금액	무 금액	무급액	무 금맥	무 금액	무 금액	무 금액	무 금맥	무 금액	무 금액	는개별	는개별	는 개별	는개별	는 개별	는 개별	는 개별
	입니다.	입니다.	입니다.	입니다.	UG.	입니다.	입니다.	입니다.	입니다.	입니다.	입니다.	입니다.	입니다.	입니다.	입니다.	입니다.	입니다.	입니다.	입니다.	입니다.	입니다.	입니다.	입니다.	입니다.	입니다.	입니다.	회사에						
특수관	총속기	종속기	종속기	종속기		총속기	총속기	종속기	홍속기	홍속기	홍속기	총속기	총속기	종속기	홍속기	총속기	총속기	총속기	총속기	총속기	홍속기	총속기	총속기	종속기	총속기	종속기	대한 채						
계자 채	업 채권	엄 채권	엄 채권	엄 채권	채무 등	업 채권	엄 채권	엄 채권	엄 채권	엄 채권	업 채권	업 채권	엄 채권	엄 채권	업 채권	업 채권	업 채권	업 채권	엄 채권	업 채권	엄 채권	업 채권	업 채권	업 채권	엄 채권	엄 채권	권·채	권·채	권ㆍ채	권·채	권·채	권·채	권ㆍ채
권채무	OII EH 81-	OII EH 8)	OH CHOI	OH CHOI	은 리스	OH CHOI	01 CH8)	OI EH8)	예대하	메태하	예대하	OH CHOI	예대하	메대하	01 CH8+	OH EH SI	예대하	OH EHRI	예대하	01 CH8)	예대하	OII CHISH	OH CHOI	OH CH8)	01 CH8)	OH CHOI	무급액	무공액	무공맥	무 공맥	무급액	무 금액	무공역
예대한	여 인식	여 인식	여 인식	여 인식	부채가	여 인식	여 인식	여 인식	여 인식	여 인식	여 인식	여 인식	여 인식	여 인식	여 인식	며 인식	여 인식	여 인식	여 인식	며 인식	여 인식	여 인식	여 인식	여 인식	여 인식	여 인식	입니다.						
기술	된 손실		된손실	된손실	포함된	된 손실	된 손실		된 손실	된 손실	된손실	된 손실				된 손실		된 손실			된 손실		된 손실	된 손실	된 손실		채무 등			채무 등	채무 등		채무 등
//E					급액입																												
	충당급	충당급	충당급	충당급	ue.	충당급	충당급	90 CC CC CC	충당급	\$00 E	86 CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD	충당급	충당급	800	총당급	충당급	총당급	충당급	충당급	충당급	800	중당급	충당급	충당급	충당급	충당급	은 리스						
	은 없습	은 없습	은 없습	은 없습	Harma	은 없습	은 없습	CC CC	C 00 da	00 00 00 00 00	CC 당성	은 없습	은 없습	은 없습	은 없습	은 없습	은 없습	은 없습	은 없습	은 없습	은 없습	은 없습	은 없습	은 없습	은 없습	은 없습	부채가						
	UEI.	UEI.	UD.	UD.	n	UE).	UD.	UEI.	UD.	UD.	ut.	UE).	UEI.	UD.	ua.	un.	UD.	UE).	UEI.	UG.	ua.	UD.	UE).	uc.	UD.	UD.	포함된						
	채무 등	채무 등	채무 등	채무 등		채무 등	채무 등	채무 등	채무 등	채무 등	채무 등	채무 등	채무 등	채무 등	채무 등	채무 등	채무 등	채무 등	채무 등	채무 등	채무 등	채무 등	채무 등	채무 등	채무 등	채무 등	급맥입	급액입	급액입	금액임	급액입	급맥입	급맥입
	은 리스	은 리스	은 리스	은 리스	Internat	은 리스	은 리스	은 리스	은 리스	은 리스	은 리스	은 리스	은 리스	은 리스	은 리스	은 리스	은 리스	은 리스	은 리스	은 리스	은 리스	은 리스	은 리스	은 리스	은 리스	은 리스	un.	UG.	UD.	UD.	UEI.	UEI.	UG.
	부채가	부채가	부채가	부채가	ional	부채가	부채가	부채가	부채가	부채가	부채가	부채가	부채가	부채가	부채가	부채가	부채가	부채가	부채가	부채가	부채가	부채가	부채가	부채가	부채가	부채가							
	포함된	포함된	포함된	포함된	Industri	포함된	포함된	포함된	포함된	포함된	포함된	포함된	포함된	포함된	포함된	포함된	포함된	포함된	포함된	포함된	포함된	포함된	포함된	포함된	포함된	포함된							
	금액임	금액임	급력임	금맥임	es, Inc.	급액입	금액임	금액임	급맥입	급택임	급액입	급액입	급액임	급백임	급액임	급액임	급액입	급액입	급액임	급액임	급택임	금액임	급액입	급액임	금액임	금맥임							
	UEI.	UEI.	ua.	UD.	및그	UD.	uc.	UD.	UD.		UD.	UD.	UEI.	UD.	ua.	ua.	UD.	UD.	UEL."	uc.	ua.	ua.	UD.	UD.	UG.	UD.							
	uu.	uu.	uu.	uu.	총속기	uu.	uu.	uu.	uu.	uu.	uu.	uu.	uu.	uu.	uu.	uu.	uu.	uu.	uu.	uu.	uu.	uu.	uu.	uu.	uu.	uu.							
					업이 포																												
					항된 항																												
					간지배																												
					기업과																												
					외거래																												
					급액입																												
					UD.																												

특수관계자에 대한 채권 채무에 대한 공시, 합계 당반기

 전체 특수관계자

 전체 특수관계자

 존속기업

 관계기업 및 공동 기업
 그 밖의 특수관계 자

 자

(단위:백만원)

채권 등, 특수관계 자거래	32,098,124	247,072	212,027	
채무 등, 특수관계 자거래	12,043,091	1,059,428	769,446	
미지급 배당금, 특 수관계자거래				0
특수관계자 채권채 무에 대한 기술	종속기업 채권에 대하여 인식된 손 실충당금은 없습니 다.			

전반기 (단위: 백만원)

	전체 특수관계자			
	특수관계자			전체 특수관계자
	종속기업	관계기업 및 공동 기업	그 밖의 특수관계 자	합계
채권 등, 특수관계 자거래	24,463,048	364,610	204,278	
채무 등, 특수관계 자거래	11,087,063	1,168,350	2,026,330	
미지급 배당금, 특 수관계자거래				0
특수관계자 채권채 무에 대한 기술	종속기업 채권에 대하여 인식된 손 실충당금은 없습니 다.			

대규모기업집단 소속회사에 대한 채권 채무에 대한 공시 당반기말

	거래상대방					
	대규모기업집단 소득	속회사			거래상대방	하게
	삼성이앤에이㈜	㈜에스원		기타 대규모기업집 단 소속회사	71410410	
수취채권, 대규모 기업집단 소속회사 거래	211		1,136	3,870		5,217
채무액, 대규모기 업집단 소속회사 거래	1,196,253		39,513	117,976	1,35	53,742
미지급 배당금, 대 규모기업집단 소속 회사 거래						0

(단위 : 백만원)

대규모기업집단 소 속회사 거래에 대 한 기술	회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. 채무 등은 리스부 채가 포함된 금액 입니다.		회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. 채무 등은 리스부 채가 포함된 금액 입니다.	
대규모기업집단 소 속회사 관계의 성 격에 대한 기술	범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관 한 법률」에 따른	1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관 한 법률」에 따른	기업회계기준서 제 1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관 한 법률」에 따른 동일한 대규모기업 집단 소속회사입니다.	

전기말 (단위: 백만원)

	거래상대방			
	대규모기업집단 소득	속회사] 거래상대방 합계
	삼성이앤에이㈜	㈜에스원	기타 대규모기업집 단 소속회사	71410410 671
수취채권, 대규모 기업집단 소속회사 거래	269	598	4,342	5,209
채무액, 대규모기 업집단 소속회사 거래	766,329	39,223	265,721	1,071,273
미지급 배당금, 대 규모기업집단 소속 회사 거래				0
대규모기업집단 소 속회사 거래에 대 한 기술	회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. 채무 등은 리스부 채가 포함된 금액 입니다.	회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. 채무 등은 리스부 채가 포함된 금액 입니다.	회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다. 채무 등은 리스부 채가 포함된 금액 입니다.	

	기업회계기준서 제	기업회계기준서 제	기업회계기준서 제	
	1024호 특수관계자	1024호 특수관계자	1024호 특수관계자	
	범위에 포함되지	범위에 포함되지	범위에 포함되지	
대규모기업집단 소	않으나 「독점규제	않으나 「독점규제	않으나 「독점규제	
속회사 관계의 성	및 공정거래에 관	및 공정거래에 관	및 공정거래에 관	
격에 대한 기술	한 법률」에 따른	한 법률」에 따른	한 법률」에 따른	
	동일한 대규모기업	동일한 대규모기업	동일한 대규모기업	
	집단 소속회사입니	집단 소속회사입니	집단 소속회사입니	
	다.	다.	다.	

6. 배당에 관한 사항

당사는 제품 및 사업 경쟁력 강화와 함께 주주환원을 통하여 주주가치를 제고할 수 있도록 지속적으로 노력하고 있습니다. 당사는 2021~2023년의 주주환원 정책에 따라 3년간 잉여 현금흐름(Free Cash Flow)의 50%를 재원으로 활용하여 정규 배당을 연간 총 9.8조원 수준으로 실시하였습니다. 한편, 당사는 2024년 1월에 2024~2026년의 주주환원 정책을 발표하였습니다. 이에 따라 당사는 2024년부터 2026년까지 3년간 발생하는 잉여현금흐름의 50%를 재원으로 활용하여 연간 9.8조원 수준의 정규배당을 유지하되, 정규배당 이후에도 잔여 재원이 발생하는 경우에 추가로 환원할 계획입니다. 또한, 당사는 2024년부터 2026년까지의 주주환원 정책 대상 기간 종료 이전이라도 M&A 추진, 현금규모 등을 감안하여 탄력적으로 새로운 주주화원 정책을 발표하고 시행할 수 있습니다.

[주요 배당지표] (단위 : 원, 백만원, %, 주)

л ш	포시이 조금	당기	전기	전전기
구 분	주식의 종류	제56기 반기	제55기	제54기
주당액면가	백(원)	100	100	100
(연결)당기순이의	익(백만원)	16,263,683	14,473,401	54,730,018
(별도)당기순이의	익(백만원)	16,835,854	25,397,099	25,418,778
(연결)주당순(미익(원)	2,394	2,131	8,057
현금배당금총액	(백만원)	4,904,308	9,809,438	9,809,438
주식배당금총액	(백만원)	-	-	_
(연결)현금배당	성향(%)	30.2	67.8	17.9
현금배당수익률(%)	보통주	0.9	1.9	2.5
원급배당구작활(%)	우선주	1.1	2.4	2.7
주식배당수익률(%)	보통주	_	_	_
구역매당구의절(%)	우선주	_	_	_
ㅈ다 취그베다그/이\	보통주	722	1,444	1,444
주당 현금배당금(원)	우선주	722	1,445	1,445
주당 주식배당(주)	보통주	_	_	_
	우선주			

- ※ (연결)당기순이익은 연결당기순이익의 지배기업 소유주지분 귀속분입니다.
- ※ (연결)주당순이익은 보통주 기본주당이익입니다. 기본주당이익 산출근거는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 중 '주당이익' 항목을 참고하시기 바랍니다.
- ※ 현금배당금총액의 자세한 내용은 'III. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 중 '연결이익잉여금' 항목을 참고하시기 바랍니다. 분기 배당금은 제56기 1분기 2,452,154백만원(주당 361원), 2분기 2,452,154백만원(주당 361원)이며,

제55기 1분기 2,452,154백만원(주당 361원), 2분기 2,452,154백만원(주당 361원), 3분기 2,452,154백만원(주당 361원)이고,

제54기 1분기 2,452,154백만원(주당 361원), 2분기 2,452,154백만원(주당 361원), 3분기 2,452,154백만원(주당 361원)입니다.

[배당 이력]

(단위: 회, %)

연속 배당횟수		평균 배당수익률	
분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간
41	43	2.1	2.5

- ※ 연속 배당횟수는 당기 분기배당 및 최근사업연도 결산배당을 포함하고 있습니다.
- ※ 중간배당은 1999년(제31기)부터 연속 배당 시작하였고, 분기배당은 2017년(제49기)부터 연속 배당중이며, 결산배당은 1981년(제13기)부터 연속 배당 중입니다.
- ※ 평균 배당수익률은 보통주 배당수익률입니다. 우선주에 대한 최근 3년간 평균 배당수익률은 2.4%, 최근 5년간 평균 배당수익률은 2.9%입니다.
- 최근 3년간은 2021년(제53기)부터 2023년(제55기)까지 기간이며, 최근 5년간은 2019년(제51기)부터 2023년(제55기)까지 기간입니다. 2024년(제56기) 반기 배당수익률은 상기 '주요 배당지표'를 참고하시기 바랍니다(보통주 0.9%, 우선주 1.1%).

7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

당사는 공시대상기간 중 지분증권의 발행 실적이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일: 2024년 06월 30일) (단위: 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급 (평가기관)	만기일	상환 여부	주관회사
삼성전자㈜	회사채	공모	1997.10.02	138,920	7.7%	Aa2 (Moody's), AA- (S&P)	2027.10.01	일부상환	Goldman Sachs 등
Harman International Industries, Inc	회사채	공모	2015.05.11	555,680	4.2%	A (S&P)	2025.05.15	미상환	J.P. Morgan 등
합 계	-	-	-	694,600	-	-	-	-	-

나. 기업어음증권 미상환 잔액

해당사항 없습니다.

(기준일: 2024년 06월 30일) (단위:백만원)

잔여만기		10일 이하		30일초과 90일이하				2년초과 3년이하	3년 초과	합계
UIVIEL	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	_
미상환 · 잔액	사모	-	-	-	-	-	-	_	_	_
신액	합계	_	_	_	_	_	_	_	_	-

다. 전자단기사채 미상환 잔액

해당사항 없습니다.

(기준일: 2024년 06월 30일)

잔여만기		10일 이하		30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	합계	발행 한도	잔여 한도
미사들	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
미상환 자액	사모	_	-	-	-	-	-	_	_
25	합계	-	-	-	-	-	-	-	_

라. 회사채 미상환 잔액

(기준일: 2024년 06월 30일)

잔여만기	여만기 1년 이하					4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합계
	공모	562,626	6,946	6,946	6,946	-	-	-	583,464
미상환 잔액	사모	-	-	_	-	_	-	_	-
25	합계	562,626	6,946	6,946	6,946	ı	_	ı	583,464

- 삼성전자㈜

(기준일: 2024년 06월 30일)

잔여만기		1년 이하					5년초과 10년이하	10년초과	합계
미사하	공모	6,946	6,946	6,946	6,946	_	_	-	27,784
미상환 자액	사모	-	-	_	-	_	_	_	_
(A)	합계	6,946	6,946	6,946	6,946	-	-	_	27,784

- Harman International Industries, Inc.와 그 종속기업

(기준일: 2024년 06월 30일)

잔여만기		1년 이하				4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미사회	공모	555,680	-	-	-	-	_	-	555,680
미상환 잔액	사모	_	-	_	_	-	-	-	-
	합계	555,680	_	_	_	_	_	-	555,680

[※] 미상환잔액은 기준일 환율을 적용하였습니다.

(단위:백만원)

(단위:백만원)

(단위:백만원)

(단위:백만원)

마. 신종자본증권 미상환 잔액

해당사항 없습니다.

(기준일: 2024년 06월 30일)

잔여만기 1년 이형		1년 이하		5년초과 10년이하			20년초과 30년이하	30년초과	합계
미사희	공모	_	_	-	-	-	_	-	-
미상환 잔액	사모	_	_	_	_	-	_	_	-
25	합계	_	_	_	_	_	_	_	_

바. 조건부자본증권 미상환 잔액

해당사항 없습니다.

(기준일: 2024년 06월 30일) (단위: 백만원)

잔여만기	1	1년 이하							20년초과 30년이하	30년초과	합계
미상환	공모	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_
잔액	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(단위:백만원)

사. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등(삼성전자)

(작성기준일: 2024년 06월 30일) (단위: 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사
US\$ 100,000,000	1997.10.02	2027.10.01	138.920	1997.10.02	The Bank of New York Mellon
7.7% Debenture	1997.10.02	2027.10.01	130,920	1997.10.02	Trust Company, N.A.

(이행현황기준일: 2024년 06월 30일)

재무비율 유지현황	계약내용	해당사항 없음
제구비설 규사연성	이행현황	해당사항 없음
다비긔셔져 제하취하	계약내용	순유형자산의 10% 미만
담보권설정 제한현황	이행현황	계약내용 이행 중 (해당 자산에 대해 담보권 설정 없음)
	계약내용	(보증인이) 자산의 전부 또는 대부분을 처분하려면
자산처분 제한현황	게극대공	본채권에 대한 의무사항 승계 등 조건을 충족시켜야 함
	이행현황	계약내용 이행 중 (2024년 반기 중 처분 자산은 전체의 0.0%)
지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항 없음
지배구도단당 제인연광	이행현황	해당사항 없음
이행상황보고서 제출현황	이행현황	해당사항 없음

[※] 발행액은 기준일 환율을 적용하였습니다.

Fiscal Agent의 지위에 있습니다.

- ※ 담보권설정 제한자산인 순유형자산은 생산설비 및 본사 보유주식입니다.
- ※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근 재무제표의 작성기준일입니다.
- ※ 지배구조변경 제한현황은 공시서류 작성기준일입니다.

7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

공시대상기간 중 공시대상인 자금조달 실적이 없습니다.

[※] 사채관리계약 체결일은 Fiscal Agency Agreement 체결일로서, The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.는

8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항

(1) 재무제표 재작성

해당사항 없습니다.

(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항

(eMagin Corporation 지분인수)

종속기업 Samsung Display America Holdings, Inc. (SDAH)는 Micro Display 기술 경쟁력을 확보를 위해 2023년 10월 18일자로 eMagin Corporation (대표자: Andrew Sculley, 소 재지: New York, USA) 지분 100%를 인수하였습니다.

(㈜도우인시스 지분매각)

종속기업 삼성디스플레이㈜는 OLED 산업 내 경쟁구도가 갈수록 심화되고 있는 상황에서 본연의 사업과 R&D에 집중하기 위해 2024년 1월 31일자로 SVIC 29호 신기술투자조합 및 SVIC 48호 신기술투자조합이 보유한 ㈜도우인시스 지분 69.0% 중 56.8%를 ㈜뉴파워프라즈마 등 3개사에 매각하였습니다.

(3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항

(자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리)

해당사항 없습니다.

(중요한 소송사건)

당사는 다수의 회사 등과 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등이 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 당사의 경영진은이러한 소송 등의 결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

(채무보증 내역)

1) 국내채무보증

해당사항 없습니다.

2) 해외채무보증

(단위 : 천US\$, %)

법인명							채무보증한도		채무금액			
(채무자)	관계	채권자	내용	목적	보증시작일	보증종료일	기초	기말	기초	증감	기말	이자율
,					2023-11-	2025-06-						
SEA	계열회사	BOA 등	지급보증	운영자금	09	13	1,278,000	1,278,000	-	-	_	
0511	31104 =1.11	2014	778	0017	2023-08-	2025-06-	745.000	745.000				
SEM	계열회사	BBVA 등	지급보증	운영자금	20	13	715,000	715,000	_	_	_	
SAMCOL	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2023-11-	2025-06-	210,000	210,000	_	_	_	
0/ WIGGE	712471	Olliburii 8	MBIS	20/10	09	13	210,000	210,000				
SEDA	계열회사	BRADESCO 등	지급보증	운영자금	2023-10-	2025-06-	329,000	329,000	_	_	_	
					01	13						
SECH	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2023-12-	2025-06-	62,000	64,000	-	_	_	
					17 2023-12-	13 2025-06-						
SEPR	계열회사	BBVA 등	지급보증	운영자금		13	150,000	150,000	-	-	-	
					17 2023-11-	2025-06-						
SSA	계열회사	SCB 등	지급보증	운영자금	09	13	318,000	318,000	-	-	-	
					2023-11-	2024-12-						
SEMAG	계열회사	SocGen 등	지급보증	운영자금	09	16	96,000	96,000	8,065	△8,065	-	
					2023-11-	2025-06-						
SETK	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	09	13	917,000	947,000	320,893	175,565	496,458	47.0%
SETK-P	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2023-11-	2024-12-	70,000	70,000				
JEIN I	게르되시	DIVI 6	VIRTO	T 0 V D	09	16	70,000	70,000				
SECE	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2023-12-	2024-12-	114,000	114,000	_	_	_	
					17	16						
SEEG	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2024-06-	2025-06-	85,000	85,000	_	-	_	
					14	13						
SEIN	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2023-11-	2025-06-	70,000	70,000	-	-	-	
					09 2023-11-	13						
SJC	계열회사	Mizuho Bank 등	지급보증	운영자금	09	31	835,508	802,532	-	-	-	
					2023-11-	2025-06-						
SEUC	계열회사	Credit Agricole 등	지급보증	운영자금	09	13	125,000	125,000	-	-	_	
					2023-11-	2025-06-						
SEDAM	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	09	13	537,000	537,000	-	-	_	
2504	All Od = L L L	DC.4	TI 7 H 5	ONITIT	2023-11-	2024-11-	70.000	70.000				
SECA	계열회사	BOA	지급보증	운영자금	09	08	70,000	70,000			_	
SELA	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2023-12-	2024-12-	60,000	60,000				
5227	711 2 2 7 7 1	Sitibalik	VIB-10	23710	17	16	30,000	30,000				
SEEH	계열회사	HSBC 등	지급보증	운영자금	2023-09-	2025-06-	888,400	856,400	_	_	_	
					06	13	<u> </u>					

					2023-12-	2024-12-						
SELV	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금			10,000	10,000	-	-	-	
					17	16						
SEIL	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2023-12-	2024-12-	15,600	15,600	_	_	_	
					17	16						
SAPL	계열회사	BOA 등	지급보증	운영자금	2023-11-	2025-06-	404,000	404,000	_	_	_	
0/11/2	712471	BO/1 8	NB 18	20/10	09	13	101,000	10 1,000				
0.41//14/4	71104 - 111	1000	71745	6 M TI T	2024-06-	2025-06-	F1 000	F1 000				
SAVINA	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	14	13	51,000	51,000	_	_	_	
					2023-12-	2025-06-						
SCIC	계열회사	HSBC 등	지급보증	운영자금	17	13	270,000	270,000	_	_	_	
					2023-11-	2024-11-						
SESP	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	09	08	30,000	30,000	_	_	_	
					2023-11-	2024-11-						
SME	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	09	08	110,000	110,000	_	_	_	
					2023-12-	2024-12-						
SAMEX	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	17	16	5,000	5,000	_	-	-	
					2023-12-	2024-12-						
SEASA	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	17	16	2,000	2,000	_	-	-	
					2023-11-	2024-11-						
SSAP	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	09	08	35,000	35,000	-	-	_	
					2024-06-	2025-06-						
SEPM	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	14	13	35,000	35,000	-	-	-	
					2024-06-	2025-06-						
SESAR	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	14	13	20,000	20,000	-	_	-	
					2023-12-	2024-12-						
SEUZ	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	17	16	10,000	10,000	-	-	-	
					17	10						

법인명	ווב וכ	=11.71.71			L T L T O	L T T D O	채무보증한	Ī	채무금액			ALTIES
(채무자)	관계	채권자	내용	목적	모승시삭일	보증종료일	기초	기말	기초	증감	기말	이자율
AdGear Technologies Inc.	계열회사	воа	지급보증	운영자금	2023.11.0	2024.11.0	2,000	2,000	-	-	-	
Harman International	계열회사	JP Morgan	지급보증	운영자금	2023.06.1	2024.06.1	100,000	100,000	-	-	-	
Harman International Japan Co., Ltd.	계열회사	MUFG	지급보증	운영자금	2023.11.0	2024.11.0	25,000	25,000	I	_	ı	
Harman Holding Limited	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2023.06.1	2024.06.1	30,000	30,000	ı	_	-	
Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	계열회사											
Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	계열회사	SocGen	지급보증	운영자금	9	8	15,000	15,000	-	-	-	
Harman International	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2023.06.1	2024.06.1	30,000	30,000	ı	_	-	
SDN	계열회사	SIEL	지급보증	운영자금 등	2021.11.2	2026.02.1	601,149	599,118	510,977	△1,727	509,250	8.1%
SAS	계열회사	Epcor	지급보증	운영자금 등	2022.04.2	채무소멸시	340,000	340,000	_	-	_	
		합 계					9,070,657	9,035,650	839,935	165,773	1,005,708	

※연결 기준입니다. SDN 건은 삼성디스플레이㈜, SAS 건은 SEA가 각각 채무보증인입니다.

[△는 부(-)의 값임]

- * 건별 채무보증금액이 자기자본의 0.1% 이상 2.5% 미만인 경우 경영위원회, 2.5% 이상인 경우 이사회 의결을 통해 결정됩니다. 또한 종속기업인 삼성디스플레이㈜의 경우 건별 채무보증금액이 100억원 이상인 경우 이사회 의결을 통해 결정됩니다.
- ※ 당사는 종속기업별 채무보증 만기, 일반적인 신용공여 조건의 이율 등을 감안하여 산정된 채무보증 수수료를 수취하고 있습니다

당사는 2023년 중 US\$2,141천의 수수료를 청구하였으며, 2024년 중 수취하였습니다.

한편, 삼성디스플레이㈜는 SDN에게 2023년 중 US\$3,066천의 수수료를 청구하였으며, 2024년 중 수취하였습니다.

☞ 우발채무 등에 관한 사항은 'III. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다.

(4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항

(감사보고서상 강조사항과 핵심감사사항)

구 분	강조사항 등	핵심감사사항
제56기 반기	해당사항 없음	해당사항 없음
제55기	해당사항 없음	(연결재무제표) 1. 메모리 반도체 재고자산 순실현가치 평가 2. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감의 정확성과 완전성 (별도재무제표) 1. 메모리 반도체 재고자산 순실현가치 평가 2. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감의 정확성과 완전성
제54기	해당사항 없음	(연결재무제표) 1. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감 (별도재무제표) 1. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감

나. 대손충당금(손실충당금) 설정 현황

(1) 계정과목별 대손충당금(손실충당금) 설정내역

(단위:백만원,%)

구 분	계정과목	채권 금액	대손충당금 (손실충당금)	대손충당 설정률
	매출채권	43,999,540	338,655	0.8%
TH. T. O. D.	단기대여금	21,088	199	0.9%
	미수금	7,813,373	83,811	1.1%
	선급금	1,209,389	3,769	0.3%
제56기 반기말	장기매출채권	26,464	_	0.0%
2/12	장기미수금	933,790	194	0.0%
	장기선급금	5,526,359	8,036	0.1%
	장기대여금	236,362	90,095	38.1%
	합 계	59,766,365	524,759	0.9%
	매출채권	37,002,849	355,456	1.0%
	단기대여금	21,279	204	1.0%
	미수금	6,715,263	82,015	1.2%
	선급금	994,525	3,316	0.3%
제55기말	장기매출채권	23,889	_	0.0%
	장기미수금	759,704	209	0.0%
	장기선급금	4,964,481	9,255	0.2%
	장기대여금	239,149	77,608	32.5%
	합 계	50,721,139	528,063	1.0%
	매출채권	36,033,784	312,221	0.9%
	단기대여금	22,403	215	1.0%
제54기말	미수금	6,227,068	77,859	1.3%
	선급금	1,741,031	3,965	0.2%
	장기매출채권	204,248	_	0.0%
	장기미수금	824,468	242	0.0%
	장기선급금	2,382,711	10,969	0.5%
	장기대여금	225,983	1,206	0.5%
	합 계	47,661,696	406,677	0.9%

[※] 연결 기준입니다.

[※] 채권 금액은 현재가치할인차금 차감 후 금액입니다.

(2) 대손충당금(손실충당금) 변동 현황

(단위:백만원)

구 분	제56기 반기	제55기	제54기
기초 대손충당금(손실충당금)	528,063	406,677	397,525
순대손처리액(①-②+③)	△14,123	14,647	16,658
① 대손처리액(상각채권액) 등	3,765	19,179	9,711
② 상각채권회수액	_	4	_
③ 기타증감액	△17,888	△4,528	6,947
대손상각비 계상(환입)액	△17,427	136,033	25,810
기말 대손충당금(손실충당금)	524,759	528,063	406,677

※ 연결 기준입니다.

[△는 부(-)의 값임]

(3) 매출채권 관련 대손충당금(손실충당금) 설정 방침

(설정방침)

• 매출채권과 기타채권 잔액에 대하여 과거의 대손경험률과 장래의 대손예상액을 고려하는 기대신용손실모형을 적용하여 대손충당금(손실충당금) 설정

(대손경험률 및 대손예상액 산정근거)

- 대손경험률: 과거 3개년 평균 채권잔액에 대한 신용손실 경험 등을 근거로 연령별 대손경험률을 산정하여 설정
- 대손예상액: 채무자의 파산, 강제집행, 사망, 실종 등으로 회수가 불투명한 채권의 경우 회수가능성, 담보설정여부 등과 채무자의 신용정보 및 미래 전망을 고려하여 합리적인 대손예상액 설정

[대손 설정 기준]

상 황	설정률
분 쟁	25 %
수금의뢰	50 %
소 송	75 %
부 도	100 %

(대손 처리 기준)

매출채권 등에 대해 다음과 같은 사유 발생 시 실대손처리

- 파산, 부도, 강제집행, 사업의 폐지, 채무자의 사망, 실종 등으로 인해 채권의 회수 불능이 객관적으로 입증된 경우
- 소송에 패소하였거나 법적 청구권이 소멸한 경우
- 외부 채권회수 전문기관이 회수가 불가능하다고 통지한 경우
- 담보설정 부실채권, 보험Cover 채권은 담보물을 처분하거나 보험사로부터 보험금을 수령한 경우
- 회수에 따른 비용이 채권금액을 초과하는 경우

(4) 경과기간별 매출채권 잔액 현황

(기준일: 2024년 06월 30일) (단위: 백만원, %)

구	분		6월 이하	6월 초과 1년 이하	1년 초과 3년 이하	3년 초과	계
	己	액	43,784,454	33,294	99,144	109,112	44,026,004
	구성	비율	99.5%	0.1%	0.2%	0.2%	100.0%

- ※ 연결 기준입니다.
- ※ 매출채권 잔액은 현재가치할인차금 차감 후 금액입니다.

다. 재고자산 현황

(1) 사업부문별 재고자산의 보유 현황

(단위:백만원, %, 회)

부문	계정과목	제56기 반기말	제55기말	제54기말
	제품 및 상품	6,910,674	7,229,898	7,712,885
	반제품 및 재공품	1,021,544	967,513	1,013,606
DX 부문	원재료 및 저장품	11,681,323	9,608,619	10,520,293
	미착품	1,331,370	1,014,420	943,322
	소 계	20,944,911	18,820,450	20,190,106
	제품 및 상품	6,426,376	6,476,768	6,601,087
	반제품 및 재공품	22,017,799	20,961,730	18,756,104
DS 부문	원재료 및 저장품	3,821,265	3,484,046	3,639,061
	미착품	65,403	76,226	61,352
	소 계	32,330,843	30,998,770	29,057,604
	제품 및 상품	137,312	284,394	811,518
	반제품 및 재공품	423,680	296,788	542,473
SDC	원재료 및 저장품	805,136	564,573	788,521
	미착품	27,974	6,509	23,626
	소 계	1,394,102	1,152,264	2,166,138
	제품 및 상품	831,393	725,484	799,919
	반제품 및 재공품	115,501	104,514	119,890
Harman	원재료 및 저장품	724,732	700,011	913,085
	미착품	480,454	319,785	269,715
	소 계	2,152,080	1,849,794	2,102,609
	제품 및 상품	14,365,686	14,553,014	16,032,226
	반제품 및 재공품	23,383,335	22,198,448	20,077,519
총 계	원재료 및 저장품	16,284,512	13,697,354	14,979,280
	미착품	1,533,080	1,177,058	1,098,841
	소 계	55,566,613	51,625,874	52,187,866
총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계÷기말자산총계×100]		11.4%	11.3%	11.6%
재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}]		3.4회	3.5회	4.1회

[※] 당사 연결 기준입니다.

(2) 재고자산의 실사내역 등

(실사내역)

- 5월말 및 11월말 기준으로 매년 2회 재고자산 실사 실시
- · 재고조사 시점과 기말시점의 재고자산 변동내역은 해당 기간 전체 재고의 입출고 내역을 확인하여 재무상태표일 기준 재고자산의 실재성을 확인

(실사방법)

- · 사내보관재고: 폐창식 전수조사 실시 ※ 반도체 및 디스플레이 패널 라인 재고 및 자동화창고보관 SVC자재는 표본조사
- · 사외보관재고: 제3자 보관재고, 운송 중인 재고는 전수로 물품보유확인서 또는 장치보관확인서 징구 및 표본조사 병행
- · 외부감사인은 당사의 기말 재고실사에 입회 · 확인하고 일부 항목은 표본 추출하여 그 실재성 및 완전성 확인
- ※ 당사는 2024년 5월 31일부터 6월 3일까지 상반기 재고실사를 실시하였으며, 종속기업들도 동일기준(5월말)으로 상반기 재고실사를 진행하였습니다.

(장기체화재고 등 내역)

재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우 저가법 등을 사용하여 재고자산의 장부금액을 결정하고 있으며, 2024년 반기말 현재 재고자산에 대한 평가내역은 다음과 같습니다.

(기준일: 2024년 06월 30일)

계정과목	취득원가	보유금액	평가충당금	기말잔액
제품 및 상품	15,352,148	15,352,148	△986,462	14,365,686
반제품 및 재공품	24,763,317	24,763,317	△1,379,982	23,383,335
원재료 및 저장품	17,917,565	17,917,565	△1,633,053	16,284,512
미착품	1,533,080	1,533,080	_	1,533,080
합 계	59,566,110	59,566,110	△3,999,497	55,566,613

[※] 당사 연결 기준입니다.

[△는 부(-)의 값임]

(단위:백만원)

라. 수주계약 현황

2024년 반기말 현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주거래는 없습니다.

마. 공정가치평가 내역

(1) 금융상품의 공정가치평가 방법

[금융자산]

(분류)

당사는 금융자산을 공정가치 측정 금융자산(기타포괄손익 또는 당기손익에 공정가치 변동인식), 상각후원가 측정 금융자산으로 분류합니다.

금융자산은 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에근거하여 분류합니다.

공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 채무 상품에 대한 투자는 해당 자산을 보유하는 사업모형에 따라 당기손익 또는 기타포괄손익으 로 인식합니다. 당사는 금융자산을 관리하는 사업모형을 변경하는 경우에만 채무상품을 재 분류합니다.

단기매매항목이 아닌 지분상품에 대한 투자는 최초 인식시점에 후속적인 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 지정하는 취소불가능한 선택을 할 수 있습니다. 지정되지 않은 지분상품에 대한 투자의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식합니다.

(측정)

당사는 최초 인식시점에 금융자산을 공정가치로 측정하며, 당기손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 경우에 해당 금융자산의 취득이나 해당 금융부채의 발행과 직접 관련되는 거래원 가는 공정가치에 가산합니다. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 거래원가는 당기손익으로 비용처리합니다.

내재파생상품을 포함하는 복합계약은 계약상 현금흐름이 원금과 이자로만 구성되어 있는지를 결정할 때 해당 복합계약 전체를 고려합니다.

1) 채무상품

금융자산의 후속적인 측정은 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상현금호름 특성에 근거합니다. 당사는 채무상품을 다음의 세 범주로 분류합니다.

① 상각후원가 측정 금융자산

사업모형이 계약상 현금흐름을 수취하기 위해 보유하는 것이고, 계약상 현금흐름이 원리금 만으로 구성되어 있는 경우, 금융자산은 상각후원가로 측정합니다. 상각후원가로 측정하는 금융자산으로서 위험회피관계의 적용 대상이 아닌 금융자산의 손익은해당 금융자산을 제거하거나 손상할 때 당기손익으로 인식합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익'에 포함됩니다.

② 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

사업모형이 계약상 현금흐름의 수취와 금융자산의 매도 둘 모두를 위해 보유하는 것이고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 경우, 금융자산은 기타포괄손익-공정가치로 측정합니다. 손상차손(환입)과 이자수익 및 외환손익을 제외하고는, 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 기타포괄손익으로 인식합니다. 금융자산을 제거할 때에는 인식한 기타포괄손익누계액을 자본에서 당기손익으로재분류합니다. 유효이자율법에 따라인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익'에 포함됩니다. 외환손익은 '금융수익' 또는 '금융비용'으로 표시하고 손상차손은 '기타비용'으로 표시합니다.

③ 당기손익-공정가치 측정 금융자산

상기 상각후원가 측정이나 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 채무상품은 당기 손익-공정가치로 측정됩니다. 위험회피관계가 적용되지 않는 당기손익-공정가치 측정 채무 상품의 손익은 당기손익으로 인식하고 발생한 기간에 손익계산서에 '기타수익' 또는 '기타비용'으로 표시합니다.

2) 지분상품

당사는 모든 지분상품에 대한 투자를 후속적으로, 공정가치로 측정합니다. 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 선택한 지분상품에 대해 기타포괄손익으로 인식한 금액은 해당 지분상품을 제거할 때에도 당기손익으로 재분류하지 않고 제거되는 시점에 자본에 누적된 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익을 이익잉여금으로 대체합니다. 이러한 지분상품에 대한 배당수익은 당사가 배당을 받을 권리가 확정된 때에 손익계산서에 '기타수익'으로인식합니다.

당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 공정가치 변동은 손익계산서에 '기타수익' 또는 '기타비용'으로 표시합니다.

(손상)

당사는 미래전망정보에 근거하여, 상각후원가로 측정하거나 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 기대신용손실을 평가합니다. 손상 방식은 신용위험의 유의적인 증가여부에 따라 결정됩니다. 단, 매출채권에 대해 당사는 채권의 최초 인식시점부터 전체기간 기대신용손실을 인식하는 간편법을 적용합니다.

(인식과 제거)

금융자산의 정형화된 매입 또는 매도는 매매일에 인식하거나 제거합니다. 금융자산은 현금 흐름에 대한 계약상 권리가 소멸하거나 금융자산을 양도하고 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전한 경우에 제거됩니다. 당사가 금융자산을 양도한 경우라도 채무자의 채무불이 행시의 소구권 등으로 양도한 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 당사가 보유하는 경우에는 이를 제거하지 않고 그 양도자산 전체를 계속하여 인식하되, 수취한 대가를 금융부채로 인식합니다. 해당 금융부채는 재무상태표에 '차입금'으로 분류하고 있습니다.

(금융상품의 상계)

금융자산과 부채는 인식한 자산과 부채에 대해 법적으로 집행가능한 상계권리를 현재 보유하고 있고, 순액으로 결제하거나 자산을 실현하는 동시에 부채를 결제할 의도를 가지고 있을때 상계하여 재무상태표에 순액으로 표시합니다. 법적으로 집행가능한 상계권리는 미래사건에 좌우되지 않으며, 정상적인 사업과정의 경우와 채무불이행의 경우 및 지급불능이나 파산의 경우에도 집행가능한 것을 의미합니다.

[금융부채]

(분류 및 측정)

모든 금융부채는 다음을 제외하고는 후속적으로 상각후원가로 측정되도록 분류합니다.

- 1) 당기손익-공정가치 측정 금융부채 파생상품부채를 포함한 이러한 부채는 후속적으로 공정가치로 측정합니다.
- 2) 금융자산의 양도가 제거 조건을 충족하지 못하거나 지속적 관여 접근법이 적용되는 경우에 생기는 금융부채이러한 금융부채는 상기 금융자산의 내용을 적용하여 측정합니다.
- 3) 금융보증계약
 - 최초 인식 시 공정가치로 측정되며, 이후에 이러한 계약의 발행자는 해당 계약을 후속적으로 다음 중 큰 금액으로 측정합니다.
 - 기대신용손실에 따라 산정한 손실충당금
 - 최초 인식금액에서 기준서 제1115호에 따라 인식한 이익누계액을 차감한 금액
- 4) 시장이자율보다 낮은 이자율로 대출하기로 한 약정
 - 최초 인식 후에 이러한 약정의 발행자는 후속적으로 해당 약정을 다음 중 큰 금액으로 측정합니다.
 - 기대신용손실에 따라 산정한 손실충당금
 - 최초 인식금액에서 기준서 제1115호에 따라 인식한 이익누계액을 차감한 금액
- 5) 기준서 제1103호를 적용하는 사업결합에서 취득자가 인식하는 조건부 대가이러한 조건부 대가는 후속적으로 당기손익-공정가치로 측정합니다.

(제거)

금융부채는 계약상 의무가 이행, 취소 또는 만료되어 소멸되거나 기존 금융부채의 조건이 실질적으로 변경된 경우에 재무상태표에서 제거됩니다. 소멸하거나 제3자에게 양도한 금융부채의 장부금액과 지급한 대가(양도한 비현금자산이나 부담한 부채를 포함)의 차액은 당기손 익으로 인식합니다.

[파생상품]

당사는 파생상품의 계약에 따라 발생된 권리와 의무를 공정가액으로 평가하여 자산과 부채로 계상하고, 동 계약으로부터 발생한 손익은 발생시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다. 다만, 요건을 충족한 현금흐름위험회피와 해외사업장에 대한 순투자에 대한 위험회피금액은 자본항목으로 이연하고 있습니다.

당사는 재고자산의 가격 변동 위험 등을 회피하기 위한 현금흐름 위험회피회계를 적용하고 있습니다. 현금흐름위험회피 대상으로 지정되어 적용요건을 충족하는 파생상품의 공정가치 변동 중 위험회피에 효과적인 부분은 기타포괄손익으로 인식하고, 비효과적인 부분은 '금융 수익' 또는 '금융비용'으로 인식하고 있습니다.

(2) 범주별 금융상품 내역

1) 제56기 반기말

(단위 : 백만원)

707111	상각후원가	기타포괄손익-공정	당기손익-공정가치	31CL 3 Q TL 11/. \	all all
금융자산	측정 금융자산	가치 측정 금융자산	측정 금융자산	기타금융자산(*) 	Л
현금및현금성자산	49,844,405	-	-	-	49,844,405
단기금융상품	50,921,350	-	-	-	50,921,350
단기상각후원가금융자산	-	-	-	-	-
단기당기손익-공정가치금융자산	-	-	29,758	-	29,758
매출채권	43,660,885	-	-	-	43,660,885
기타포괄손익-공정가치금융자산	-	9,202,104	-	-	9,202,104
당기손익-공정가치금융자산	-	-	1,360,016	-	1,360,016
기타	9,824,650	-	448,668	44,809	10,318,127
Я	154,251,290	9,202,104	1,838,442	44,809	165,336,645

(*) 기타금융자산은 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

금융부채		당기손익-공정가치 측정 금융부채	기타금융부채(*)	Я
매입채무	13,113,267	_	_	13,113,267
단기차입금	250,948	-	10,375,644	10,626,592
미지급금	13,131,706	-	-	13,131,706
유동성장기부채	1,070,947	-	1,043,886	2,114,833
사채	20,573	-	-	20,573
장기차입금	-	-	3,719,386	3,719,386
장기미지급금	4,812,132	-	-	4,812,132
기타	12,242,163	41,625	30,708	12,314,496
Я	44,641,736	41,625	15,169,624	59,852,985

(*) 기타금융부채는 담보부차입금과 위험회피수단인 파생상품, 기업회계기준서 제1109호의 금융부채의 범주로 분류되지 않는 리스부채 등을

포함하고 있습니다.

2) 제55기말

(단위 : 백만원)

	상각후원가	기타포괄손익-공정	당기손익-공정가치	JICI 7071 AI/.\	all all	
금융자산	측정 금융자산	가치 측정 금융자산	측정 금융자산	기타금융자산(*)	Л	
현금및현금성자산	69,080,893	-	-	-	69,080,893	
단기금융상품	22,690,924	-	-	-	22,690,924	
단기상각후원가금융자산	608,281	-	-	-	608,281	
단기당기손익-공정가치금융자산	-	-	27,112	-	27,112	
매출채권	36,647,393	-	-	-	36,647,393	
기타포괄손익-공정가치금융자산	-	7,481,297	_	-	7,481,297	
당기손익-공정가치금융자산	-	-	1,431,394	-	1,431,394	
기타	14,294,254	-	475,244	70,777	14,840,275	
Л	143,321,745	7,481,297	1,933,750	70,777	152,807,569	

(*) 기타금융자산은 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

70日刊	상각후원가	당기손익-공정가치	기디그오버웨/.)	الد
금융부채	측정 금융부채	측정 금융부채	기타금융부채(*)	계
매입채무	11,319,824	_	_	11,319,824
단기차입금	504,552	-	6,610,049	7,114,601
미지급금	13,996,395	-	-	13,996,395
유동성장기부채	310,436	-	998,439	1,308,875
사채	537,618	-	-	537,618
장기차입금	-	-	3,724,850	3,724,850
장기미지급금	4,907,875	-	-	4,907,875
기타	11,330,545	49,904	33,559	11,414,008
Э	42,907,245	49,904	11,366,897	54,324,046

(*) 기타금융부채는 담보부차입금과 위험회피수단인 파생상품, 기업회계기준서 제1109호의 금융부채의 범주로 분류되지 않는 리스부채 등을

포함하고 있습니다.

(3) 금융상품의 공정가치 측정내역

(금융상품의 장부금액과 공정가치)

(단위:백만원)

_ H	제56기 반기말		제55기말	제55기말		
구 분	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치		
금융자산:						
현금및현금성자산	49,844,405	(*1)	69,080,893	(*1)		
단기금융상품	50,921,350	(*1)	22,690,924	(*1)		
단기상각후원가금융자산	_	_	608,281	(*1)		
단기당기손익-공정가치금융자산	29,758	29,758	27,112	27,112		
매출채권	43,660,885	(*1)	36,647,393	(*1)		
기타포괄손익-공정가치금융자산	9,202,104	9,202,104	7,481,297	7,481,297		
당기손익-공정가치금융자산	1,360,016	1,360,016	1,431,394	1,431,394		
기타(*2)	10,318,127	493,477	14,840,275	546,021		
Э	165,336,645		152,807,569			
금융부채:						
매입채무	13,113,267	(*1)	11,319,824	(*1)		
단기차입금	10,626,592	(*1)	7,114,601	(*1)		
미지급금	13,131,706	(*1)	13,996,395	(*1)		
유동성장기부채	2,114,833	557,099	1,308,875	6,757		
- 유동성장기차입금	1,550,725	(*1)(*3)	1,302,521	(*1)(*3)		
- 유동성사채	564,108	557,099	6,354	6,757		
사채	20,573	23,873	537,618	529,254		
장기차입금	3,719,386	(*1)(*3)	3,724,850	(*1)(*3)		
장기미지급금	4,812,132	(*1)	4,907,875	(*1)		
기타(*2)	12,314,496	72,333	11,414,008	83,463		
계	59,852,985		54,324,046			

^(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

및 금융부채 12,242,163백만원(전기말: 11,330,545백만원)은 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

(*3) 리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

^(*2) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 일부 금융자산 9,824,650백만원(전기말: 14,294,254백 만원)

(공정가치로 측정 및 공시되는 금융상품의 공정가치 서열체계)

(단위:백만원)

구 분	제56기 반기말					
구 분	수준 1	수준 2	수준 3	계		
금융자산:						
단기당기손익-공정가치금융자산	_	29,758	_	29,758		
기타포괄손익-공정가치금융자산	6,693,493	_	2,508,611	9,202,104		
당기손익-공정가치금융자산	135,120	_	1,224,896	1,360,016		
기타	_	117,757	375,720	493,477		
금융부채:						
유동성사채	_	557,099	_	557,099		
사채	_	23,873	_	23,873		
기타	_	72,333	_	72,333		

(단위:백만원)

¬ =	제55기말					
구 분	수준 1	수준 2	수준 3	계		
금융자산:						
단기당기손익-공정가치금융자산	_	27,112	ı	27,112		
기타포괄손익-공정가치금융자산	5,250,993		2,230,304	7,481,297		
당기손익-공정가치금융자산	347,221	_	1,084,173	1,431,394		
기타	_	130,364	415,657	546,021		
금융부채:						
유동성사채	_	6,757	ı	6,757		
사채	_	529,254	_	529,254		
기타	_	83,463	_	83,463		

공정가치 측정의 투입변수 특징에 따른 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.

- · '수준 1': 동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격
- · '수준 2': 시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치 (단, '수준 1'에 포함된 공시가격은 제외)
- '수준 3': 관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품은 '수준 1'에 포함됩니다. '수준 1'에 포함된 상품은 대부분 기타포괄손익-공정가치금융자산으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다.

활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 가치평가기법을 사용하여 측정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용됩니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 '수준 2'에 포함됩니다. '수준 2'에 포함된 상품은 파생상품, 사채등이 있습니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 '수준 3'에 포함됩니다.

당사는 '수준 3'으로 분류되는 공정가치 측정을 포함하여 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있습니다. 재무보고 일정에 맞추어 공정가치 평가 과정 및 그 결과에 대해 협의하고 있고, 공정가치 '수준' 간 이동을 발생시키는 사건이나 상황의 변동이 일어난 보고기간종료일에 '수준' 변동을 인식하고 있습니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.

- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격
- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정

나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법, 이항분포 모형 등의 기타 가치평가기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부금액을 공정가치의합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.

(가치평가기법 및 투입변수)

당사는 공정가치 서열체계에서 '수준 2'로 분류되는 회사채, 국공채, 금융채 등에 대하여 미래현금흐름을 적정이자율로 할인하는 현재가치법을 사용하고 있습니다.

2024년 반기말 현재 '수준 3'으로 분류된 주요 금융상품에 대하여 사용된 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.

(단위:백만원,%)

구 분	공정가치	가치평가기법	'수준 3' 투입변수	투입변수 범위
기타포괄손익-공정가치금융자산:				
삼성벤처투자㈜	22 200	청그동론하이버	영구성장률	1.0%
[삼성 엔서 구사[년]	33,309	현금흐름할인법	가중평균자본비용	16.0%
	20 601	청그동론하이버 드	영구성장률	0.0%
㈜미코세라믹스	39,621	현금흐름할인법 등	가중평균자본비용	17.1%
TCL China Star Optoelectronics	1 272 720	현금흐름할인법	영구성장률	0.0%
Technology Co. Ltd. (CSOT)	1,373,739		가중평균자본비용	9.7%
China Star Optoelectronics		현금흐름할인법	영구성장률	0.0%
Semiconductor Display	234,974		가중평균자본비용 	9.7%
Technology Ltd (CSOSDT)			78827508	9.7 %
기타:				
지분 콜옵션	344,974	이항모형	무위험 이자율	3.3%
시간 교육선	344,974	0.0 7.0	가격 변동성	66.6%
지분 풋옵션	30,746	이항모형	무위험 이자율	3.9%~5.2%, 1.7%
시간 大百인	30,746	NSTS	가격 변동성	21.4%, 31.5%

[△는 부(-)의 값임]

('수준 3'에 해당하는 금융상품의 변동내역)

(단위:백만원)

금융자산	제56기 반기	제55기 반기
기초	3,730,134	3,303,227
매입	160,771	120,995
매도	△13,928	△3,216,022
당기손익으로 인식된 손익	△5,233	248,191
기타포괄손익으로 인식된 손익	104,246	3,124,848
기타	133,237	△88,555
기말	4,109,227	3,492,684

[△는 부(-)의 값임]

(단위 : 백만원)

금융부채	제56기 반기	제55기 반기
기초	_	7,404
당기손익으로 인식된 손익	-	-
기말	-	7,404

[△는 부(-)의 값임]

('수준 3'으로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도분석)

금융상품의 민감도분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장유리하거나 또는 가장불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다.

2024년 반기말 현재 '수준 3'으로 분류되는 주요 금융상품의 투입변수의 변동에 따른 손익효과(자본은 법인세효과 반영전)에 대한 민감도분석 결과는 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분	유리한 변동 효	과	불리한 변동 효과	
구 · 판	당기손익	자본	당기손익	자본
기타포괄손익-공정가치금융자산	_	192,922	_	△128,149
기타	97,165	ı	△91,127	_

※ 지분상품은 주요 관측불가능한 투입변수인 영구성장률 및 가중평균자본비용을 1% 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.

[△는 부(-)의 값임]

※ 기타는 주요 관측불가능한 투입변수인 기초자산 가격(20%) 및 가격 변동성(10%)을 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.

(4) 유형자산 재평가내역

당사는 공시대상기간 중 유형자산 재평가내역이 없습니다.

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

이사의 경영진단 및 분석의견은 기업공시서식 작성기준에 따라 분·반기보고서에 기재하지 않습니다.(사업보고서에 기재 예정)

V. 회계감사인의 감사의견 등

1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 감사의견 등

삼정회계법인은 당사의 제55기 감사 및 제56기 반기 검토를 수행하였고, 제55기 감사 결과 감사의견은 적정이며, 제56기 반기 검토 결과 재무제표에 한국채택국제회계기준 제1034호 (중간재무보고)에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 않았습니다.

그리고 안진회계법인은 당사의 제54기 감사를 수행하였고 감사의견은 적정입니다. 한편, 당사의 감사 대상 종속기업은 공시대상기간 중 모두 적정의견을 받았습니다.

[회계감사인의 명칭 및 감사의견]

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항
제56기 반기 (당반기)	삼정회계법인	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
(82)				(연결재무제표)
			1. 메모리 반도체 재고자산 순실현가치 평가	
파토드기(저기)	사저히게버이	N 74 -	해당사항 없음	2. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감의 정확성과 완전성
제55기(전기)	삼정회계법인 적정	i i i i i i		(별도재무제표)
				1. 메모리 반도체 재고자산 순실현가치 평가
				2. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감의 정확성과 완전성
				(연결재무제표)
제54기(전전기) 안진회계법인	적정	해당사항 없음	1. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감	
	70	애당사임 땄무	(별도재무제표)	
				1. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감

[※] 감사의견은 별도·연결 재무제표에 대한 감사의견입니다.

[감사용역 체결 현황] (단위: 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내	역	실제수행내역		
사립인도	18715	내 등	보수 시간		보수	시간	
제56기 반기		분・반기 재무제표 검토					
	삼정회계법인	별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	7,800	78,000	3,085	30,849	
(당반기)		별도 및 연결 내부회계관리제도 감사					
	삼정회계법인	분・반기 재무제표 검토		85,700	7,800		
제55기(전기)		별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	7,800			85,036	
		별도 및 연결 내부회계관리제도 감사					
		분・반기 재무제표 검토					
제54기(전전기)	안진회계법인	별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	8,424	78,000	8,424	78,146	
		내부회계관리제도 감사					

(제56기 반기 일정)

구 분	일 정	
제56기 1분기	사전검토	2024.03.11 ~ 2024.03.29
제30기 1분기	본검토	2024.04.08 ~ 2024.05.14
TII.567 2⊟7	사전검토	2024.06.10 ~ 2024.06.27
제56기 2분기	본검토	2024.07.08 ~ 2024.08.13

[※] 별도·연결 재무제표 검토에 대한 일정입니다.

[비**감사용역 체결 현황**] (단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고
제56기 반기 (당반기)	2017.02	세무자문업무(해외종속기업)	2024.01~2024.06	43	
	2018.09	세무자문업무(해외종속기업)	2024.01~2024.05	-	삼정회계법인
	2019.05	세무자문업무(해외종속기업)	2024.01~2024.06	73	
	2017.02	세무자문업무(해외종속기업)	2023.01~2023.12	202	
TUE E DI / 전 DI)	2018.09	세무자문업무(해외종속기업)	2023.01~2023.12	27	삼정회계법인
제55기(전기)	2019.05	세무자문업무(해외종속기업)	2023.01~2023.12	79	삼성외계합인
	2023.05	ESG인증업무(국내종속기업)	2023.05~2023.07	25	
제54기(전전기)	_	-	_	_	-

[내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과]

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용
		· 감사위원회: 위원 3명		• 연간 회계감사 진행 상황
1 20	2024.01.29	·회사: 감사팀장	대면회의	•핵심 감사사항 등 중점 감사사항
'	2024.01.29	· 감사인: 업무수행이사 외	내번외의	· 내부회계관리제도 감사 진행 상황
		5명		· 기타 감사종료단계 필수 커뮤니케이션 사항
		· 감사위원회: 위원 3명		・분기 검토 경과 보고
2	2024.04.26	·회사: 감사팀장		
	2024.04.20	·감사인: 업무수행이사 외	네근외크	
		5명		・기타 감사계획단계 필수 커뮤니케이션 사항
		· 감사위원회: 위원 3명		• 연간 회계감사 진행 상황
3	2024.07.29	·회사: 감사팀장	디마 등!이	· 핵심 감사사항 선정 계획
3	2024.07.29	·감사인: 업무수행이사 외	대면회의	・분기 중점 검토사항 및 기타 필수 커뮤니케이션
		5명		사항

[조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보]

해당사항 없습니다.

나. 회계감사인의 변경

제56기 반기말(당반기말) 현재 당사의 종속기업은 226개이며, 당반기 중 해외 종속기업 중 Harman International Industires, Inc. 외 9개 종속기업은 PwC에서 KPMG로 회계감사인을 변경하였으며, 국내 종속기업 중 ㈜하만인터내셔널코리아는 삼일회계법인(PwC)에서 삼정회계법인(KPMG)으로 회계감사인을 변경하였습니다. 또한, 전기 중 신규 인수한 eMagin Corporation은 삼정회계법인(KPMG)을 회계감사인으로 신규 선임하였고, 전기 중 설립된 종속기업 Samsung Federal Inc.는 KPMG를 회계감사인으로 신규 선임하였습니다. 종속기업의 회계감사인 변경 및 신규 선임은 각 회사의 결정에 의한 것입니다.

[제56기 종속기업의 회계감사인 변경 현황]

종속기업명	변경전 회계감사인	변경후 회계감사인
㈜하만인터내셔널코리아	삼일회계법인(PwC)	삼정회계법인(KPMG)
Harman International Industires, Inc.	PwC	KPMG
Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd.	PwC	KPMG
Harman International (China) Holdings Co., Ltd.	PwC	KPMG
Harman Becker Automotive Systems GmbH	PwC	KPMG
Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	PwC	KPMG
Harman Connected Services GmbH	PwC	KPMG
Harman Deutschland GmbH	PwC	KPMG
Harman Holding Gmbh & Co. KG	PwC	KPMG
Harman Hungary Financing Ltd.	PwC	KPMG
Harman Professional Kft	PwC	KPMG

당사는 제55기(전기)부터 회계감사인을 안진회계법인(Deloitte)에서 삼정회계법인 (KPMG)으로 변경하였습니다. 이는 지정감사인이었던 안진회계법인(Deloitte)과의 계약이 2022년말 기간 만료로 종료됨에 따라 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제10조 제1항 및 제3항, 제4항에 의거하여 감사위원회가 선정한 결과로, 삼정회계법인(KPMG)을 2023년부터 2025년까지 3개년의 회계감사인으로 신규 선임하였습니다.

제55기말(전기말) 현재 당사의 종속기업은 232개이며, 전기 중 국내 종속기업 가운데 삼성 디스플레이㈜ 등 8개는 안진회계법인(Deloitte)에서 삼정회계법인(KPMG)으로, 에스유머티리얼스㈜는 한영회계법인(E&Y)에서 삼정회계법인(KPMG)으로 회계감사인을 변경하였습니다. 또한, 해외 종속기업 중 Samsung Electronics America, Inc. (SEA) 등 30개사는 Deloitte에서 KPMG로, Samsung Japan Corporation (SJC)등 65개사는 PwC에서 KPMG로, Samsung Electronics Iberia, S.A. (SESA) 등 6개사는 E&Y에서 KPMG로, Laos Samsung Electronics Sole Co.,Ltd (LSE)는 KPP Co., Ltd에서 KPMG로 회계감사인을 변경하였습니다. 한편, 전기 중 설립된 종속기업 SVIC 62호 신기술투자조합은 삼정회계법인 (KPMG)을 신규 선임하였고, 전전기 중 설립된 종속기업 ㈜희망별숲은 삼정회계법인 (KPMG)을, Samsung Electronics Uzbekistan FC LLC (SEUZ), DOWOOINSYS VINA COMPANY LIMITED는 KPMG를 회계감사인으로 신규 선임하였습니다. 해당 종속기업들은 당사(지배회사)의 회계감사인 변경에 따라 연결감사 업무 효율화 등을 위해 회계감사인을 변경 및 신규 선임하였으며, 이는 각 회사의 결정에 의한 것입니다.

[제55기 종속기업의 회계감사인 변경 현황]

종속기업명	변경전 회계감사인	변경후 회계감사인
삼성디스플레이㈜	안진회계법인(Deloitte)	삼정회계법인(KPMG)
삼성전자서비스㈜	안진회계법인(Deloitte)	삼정회계법인(KPMG)
삼성전자서비스씨에스㈜	안진회계법인(Deloitte)	삼정회계법인(KPMG)
삼성전자판매㈜	안진회계법인(Deloitte)	삼정회계법인(KPMG)
삼성전자로지텍㈜	안진회계법인(Deloitte)	삼정회계법인(KPMG)
㈜도우인시스	안진회계법인(Deloitte)	삼정회계법인(KPMG)
지에프㈜	안진회계법인(Deloitte)	삼정회계법인(KPMG)
㈜미래로시스템	안진회계법인(Deloitte)	삼정회계법인(KPMG)
에스유머티리얼스㈜	한영회계법인(E&Y)	삼정회계법인(KPMG)
Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	Deloitte	KPMG
Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	Deloitte	KPMG
Samsung Mexicana S.A. de C.V (SAMEX)	Deloitte	KPMG
Samsung International, Inc. (SII)	Deloitte	KPMG
Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics Holding GmbH (SEHG)	Deloitte	KPMG
Samsung Semiconductor Europe GmbH (SSEG)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics GmbH (SEG)	Deloitte	KPMG
Samsung Semiconductor Europe Limited (SSEL)	Deloitte	KPMG
Samsung Vina Electronics Co., Ltd. (SAVINA)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd. (SESP)	Deloitte	KPMG
Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics Australia Pty. Ltd. (SEAU)	Deloitte	KPMG
Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	Deloitte	KPMG
Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	Deloitte	KPMG
Samsung R&D Institute BanglaDesh Limited (SRBD)	Deloitte	KPMG

Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	Deloitte	KPMG
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET)	Deloitte	KPMG
Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	Deloitte	KPMG
Samsung Gulf Electronics Co., Ltd. (SGE)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics Saudi Arabia Ltd. (SESAR)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics South Africa(Pty) Ltd. (SSA)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics Turkiye (SETK)	Deloitte	KPMG
Samsung Electronics Industry and Commerce Ltd. (SETK-P)	Deloitte	KPMG
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	Deloitte	KPMG
Samsung Japan Corporation (SJC)	PwC	KPMG
Samsung R&D Institute Japan Co. Ltd. (SRJ)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Japan Co., Ltd. (SEJ)	PwC	KPMG
Samsung Oak Holdings, Inc. (SHI)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Canada, Inc. (SECA)	PwC	KPMG
Samsung Research America, Inc (SRA)	PwC	KPMG
SAMSUNG NEXT LLC (SNX)	PwC	KPMG
SAMSUNG NEXT FUND LLC (SNXF)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Home Appliances America, LLC (SEHA)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Digital Appliance Mexico, SA de CV (SEDAM)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Latinoamerica Miami, Inc. (SEMI)	PwC	KPMG
Samsung Electronics France S.A.S (SEF)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd. (SEH)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o. (SECZ)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Italia S.P.A. (SEI)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Romania LLC (SEROM)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Overseas B.V. (SEO)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o (SEPOL)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Nordic Aktiebolag (SENA)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Austria GmbH (SEAG)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Switzerland GmbH (SESG)	PwC	KPMG
SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS SIA (SEB)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Zo.o (SEPM)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Greece S.M.S.A (SEGR)	PwC	KPMG
Samsung Nanoradio Design Center (SNDC)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. (SEACE)	PwC	KPMG
Samsung Denmark Research Center ApS (SDRC)	PwC	KPMG
Samsung Cambridge Solution Centre Limited (SCSC)	PwC	KPMG
i		i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

Samsung Electronics New Zealand Limited (SENZ)	PwC	KPMG
PT Samsung Electronics Indonesia (SEIN)	PwC	KPMG
PT Samsung Telecommunications Indonesia (STIN)	PwC	KPMG
Samsung Display Noida Private Limited (SDN)	PwC	KPMG
Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD)	PwC	KPMG
Samsung Display Tianjin Co., Ltd. (SDT)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd. (SEHK)	PwC	KPMG
Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd. (SSEC)	PwC	KPMG
Samsung Suzhou Electronics Export Co., Ltd. (SSEC-E)	PwC	KPMG
Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou (SRC-Guangzhou)	PwC	KPMG
Samsung R&D Institute China-Shenzhen (SRC-Shenzhen)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd. (SESS)	PwC	KPMG
SEMES (XIAN) Co., Ltd.	PwC	KPMG
Beijing Samsung Telecom R&D Center (SRC-Beijing)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd. (SESC)	PwC	KPMG
Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd. (SSCR)	PwC	KPMG
Samsung Electronics China R&D Center (SRC-Nanjing)	PwC	KPMG
Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	PwC	KPMG
Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd. (SSCX)	PwC	KPMG
Samsung Electronics West Africa Ltd. (SEWA)	PwC	KPMG
Samsung Electronics East Africa Ltd. (SEEA)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Israel Ltd. (SEIL)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L (SETN)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Pakistan(Private) Ltd. (SEPAK)	PwC	KPMG
Samsung Electronics South Africa Production (pty) Ltd. (SSAP)	PwC	KPMG
Samsung Semiconductor Israel R&D Center, Ltd. (SIRC)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Maghreb Arab (SEMAG)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A. (SELA)	PwC	KPMG
Samsung Electronica Colombia S.A. (SAMCOL)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Chile Limitada (SECH)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Peru S.A.C. (SEPR)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Ukraine Company LLC (SEUC)	PwC	KPMG
Samsung R&D Institute Ukraine (SRUKR)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Central Eurasia LLP (SECE)	PwC	KPMG
Samsung Electronics Iberia, S.A. (SESA)	E&Y	KPMG
Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	E&Y	KPMG
Samsung Electronics Portuguesa, Unipessoal, Lda. (SEP)	E&Y	KPMG
Samsung Electronics Philippines Corporation (SEPCO)	E&Y	KPMG
Samsung Electronics Levant Co.,Ltd. (SELV)	E&Y	KPMG
Samsung Electronics Caucasus Co. Ltd (SECC)	E&Y	KPMG
Laos Samsung Electronics Sole Co., Ltd (LSE)	KPP Co., Ltd	KPMG

또한, 제54기말(전전기) 현재 당사의 종속기업은 232개이며, 종속기업 Samsung R&D

Institute Ukraine (SRUKR)이 PwC를, SVIC 52호 신기술투자조합과 SVIC 55호 신기술투자조합, SVIC 56호 신기술투자조합, SVIC 57호 신기술투자조합은 삼정회계법인(KPMG)을 회계감사인으로 신규 선임하였습니다. 종속기업의 회계감사인 신규 선임은 각 회사의 결정에 의한 것입니다.

2. 내부통제에 관한 사항

[회계감사인의 내부회계관리제도 감사의견]

사업연도	감사인	감사의견	지적사항
제56기 반기 (당반기)	삼정회계법인	해당사항 없음	해당사항 없음
제55기 (전기)	삼정회계법인	(별도 내부회계관리제도) 회사의 내부회계관리제도는 2023년 12월 31일 현재「내부 회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관 점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다. (연결 내부회계관리제도) 회사의 연결내부회계관리제도는 2023년 12월 31일 현재「 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성 의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	해당사항 없음
제54기 (전전기)	안진회계법인	회사의 내부회계관리제도는 2022년 12월 31일 현재「내부 회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관 점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	해당사항 없음

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

당사의 이사회는 2024년 반기말 현재 사내이사 4인(한종희, 노태문, 박학규, 이정배)과 사외이사 6인(김한조, 김준성, 허은녕, 유명희, 신제윤, 조혜경), 총 10인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 이사회의 독립성과 투명성 제고를 위하여 이사회 의장을 대표이사와 분리하여, 김한조 사외이사를 이사 간 의견 조율과 이사회 활동을 총괄하는 적임자로 판단해 의장으로 선임하였습니다. 이사회내 위원회로는 경영위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회, 보상위원회, 지속가능경영위원회가 설치되어 운영 중입니다.

(기준일: 2024년 06월 30일)

구 분	구 성	소속 이사명	의장·위원장	주요 역할
이사회	사내이사 4명, 사외이사 6명	한종희, 노태문, 박학규, 이정배, 김한조, 김준성, 허은녕, 유명희, 신제윤, 조혜경	김한조 (사외이사)	• 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결 • 경영진의 업무집행 감독
경영위원회	사내이사 4명	한종희, 노태문, 박학규, 이정배	한종희 (사내이사)	· 경영 일반, 재무 관련 사항 및 이사회가 위임한 사안을 심의 · 결의
감사위원회	사외이사 3명	김한조, 유명희, 조혜경	김한조 (사외이사)	· 재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사
사외이사 후보추천위원회	사외이사 3명	허은녕, 유명희, 신제윤	-	· 사외이사 후보의 독립성, 다양성, 역량 등을 검증하여 추천
내부거래위원회	사외이사 3명	허은녕, 김한조, 유명희	허은녕 (사외이사)	· 자율적인 공정거래 준수를 통해 회사 경영의 투명성을 제고
보상위원회	사외이사 3명	김한조, 김준성, 신제윤	-	• 이사 보수 결정 과정의 객관성과 투명성을 확보
지속가능경영위원회	사외이사 6명	김한조, 김준성, 허은녕,유 명희, 신제윤, 조혜경	김한조 (사외이사)	・환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance) 등 영역에서 지속가능경영을 추진하고 주주가치를 제고

- ☞ 이사회 구성원별 선임에 대한 자세한 사항은 'Ⅰ. 회사의 개요'의 '2. 회사의 연혁'을 참고하시기 바랍니다.
- ※ 2022년 3월 16일 이사회를 통해 김한조 사외이사가 이사회 의장, 보상위원회 위원으로 선임되었고, 김준성 이사는 보상위원회 위원, 지속가능경영위원회 위원으로, 사내이사 전원이 경영위원회 위원으로 선임되었습니다.
- ※ 2022년 4월 26일 김한조 사외이사가 감사위원회 위원장으로 선임되었습니다.
- ※ 2022년 4월 28일 김한조 사외이사가 지속가능경영위원회 위원장으로 선임되었습니다.
- ※ 2022년 11월 3일 임시주주총회에서 신규 사외이사로 선임된 허은녕, 유명희 사외이사가 당일 개최된 이사회를 통해 지속가능경영위원회 위원으로 선임되었습니다.
- ※ 2023년 3월 15일 이사회를 통해 한종희 사내이사가 경영위원회 위원으로, 허은녕, 유명희 사외이사가 사외이사 후보추천위원회 위원으로 선임되었습니다.
- ※ 2023년 4월 27일 한종희 사내이사가 경영위원회 위원장으로 선임되었습니다.
- ※ 2024년 3월 20일 주주총회에서 신제윤 사외이사, 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 조혜경 사외이사가 신규 선임되었으며, 유명희 사외이사가 감사위원회 위원으로 선임되었습니다.

당일 개최된 이사회를 통해 허은녕 사외이사와 유명희 사외이사가 내부거래위원회 위원으로 선임되었고,

신제윤 이사는 사외이사 후보추천위원회 위원, 보상위원회 위원, 지속가능경영위원회 위원으로 선임되었으며,

조혜경 사외이사는 지속가능경영위원회 위원으로 선임되었습니다.

- ※ 2024년 4월 26일 허은녕 사외이사가 내부거래위원회 위원장으로 선임되었습니다.
- ※ 2024년 5월 21일 경계현 사내이사가 사임하였습니다.
- ※ 사외이사 후보추천위원회와 보상위원회 위원장은 차기 위원회 개최시 선임 예정입니다.

[사외이사 및 그 변동 현황]

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황					
	[사회이자 구 	선임	해임	중도퇴임			
10	6	2	_	1			

나. 중요의결사항 등

		이사의 성명													
				사내이사 사외이사											
		가결	한종희	경계현	노태문	박학규	이정배	김한조	김선욱	김종훈	김준성	허은녕	유명희	신제윤	조혜경
개최일자	의 안 내 용	여부	(출석률	(출석률	(출석률	(출석률	(출석률	(출석률	(출석률	(출석률	(출석률	(출석률	(출석률	(출석률	(출석률
			:100%)	:100%)	:100%)	:100%)	:100%)	:100%)	:100%)	:100%)	:100%)	:100%)	:100%)	:100%)	:100%)
			찬 반 여	부								<u> </u>	1		
	1. 2023년(제55기) 재무제표 및 영업보고서														
	승인의 건	가결	찬성												
	2. '24~'26 주주환원 정책 승인의 건														
	3. 삼성 준법감시위원회 위원 위촉의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		
104.01.01	4. 삼성메디슨㈜ 삼성CI 상표 사용료	가결	찬성												
24.01.31	수취의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	반대	찬성	찬성		
(1차)	※ 보고사항			찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		
	① 2023년 내부회계관리제도 운영실태			찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		
	보고의 건														
	② 2023년 내부회계관리제도 운영실태														
	평가 보고의 건														
	1. 제55기 정기주주총회 소집 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		
	2. 제55기 정기주주총회 회의 목적사항	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		
	결정의 건														해당
	□ 보고사항:														사항
	① 감사보고 ② 영업보고													해당	없음
	③ 내부회계관리제도 운영실태 보고													사항	(신규선
	□ 제1호: 제55기(2023.1.1~2023.12.31)													없음	임)
	재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금													(신규선	
	처분계산서 등 재무제표 승인의 건													임)	
'24.02.20	□ 제2호: 사외이사 신제윤 선임의 건														
(2차)	□ 제3호: 감사위원회 위원이 되는														
	사외이사 조혜경 선임의 건														
	□ 제4호: 감사위원회 위원 유명희 선임의 건														
	□ 제5호: 이사 보수한도 승인의 건														
	□ 제6호: 정관 일부 변경의 건														
	3. 학교법인 충남삼성학원 후원금 출연의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		
	4. 2024년 사회공헌 매칭기금 운영계획	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		
	승인의 건														
	5. 2024년 안전 및 보건에 관한 계획 수립의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		
	건	.,_													
	1. 이사회내 위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성	찬성		찬성
'24.03.20	2. 이사 보수 책정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성	찬성		찬성
(3차)	3. 서초 전자사옥 부동산 임대차계약	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당	찬성	찬성	찬성	찬성		찬성
	체결의 건								사항						
104 04 00	1. 2024년 1분기 보고서 및 분기배당	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	없음	해당사	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
(4=1)	승인의 건								(사임)	항없음					
(4차)	2. 삼성바이오로직스㈜/에피스㈜ 삼성CI 상	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		(임기만	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

	 	 i		 			 	i
T								
-								
					료)			
11 (0.311.0) =11.34.01.31					_,			
사용계약 체결의 건								

^{**} 김준성 사외이사는 '24년 제1차 이사회에서 부의된 '24~'26년 주주환원 정책 승인의 건에 대하여 고정적 배당은 유연성이 부족할 수 있다는 점을 근거로 반대의견을 제시하였습니다.

[※] 신제윤 사외이사는 2024년 3월 29일에 사외이사 임기가 시작되어 4차 이사회부터 의결에 참여하였습니다.

다. 이사회내의 위원회

(1) 이사회내의 위원회 구성 현황

(기준일: 2024년 06월 30일)

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고		
경영위원회	사내이사 4명	한종희(위원장), 노태문,	하단 기재내용 참조	. 하조히 내내이내 이의자 서이/'22 04 27\		
당하게전외	사대에사 48	박학규, 이정배	이런 기재대용 삼조	· 한종희 사내이사 위원장 선임('23.04.27)		
내부거래위원회	사외이사 3명	허은녕(위원장), 김한조, 유명희	하단 기재내용 참조	· 허은녕 사외이사 위원장 선임('24.04.26)		
보상위원회	사외이사 3명	김한조, 김준성, 신제윤	하단 기재내용 참조	_		
지속가능경영위원회	TIOIVITI CUI	김한조(위원장), 김준성, 허은녕,	하단 기재내용 참조	기하다 사이이나 이의자 서이/22 04 20)		
시속가증성성귀전외	사외이사 6명	유명희, 신제윤, 조혜경	이런 기재대용 참조	· 김한조 사외이사 위원장 선임('22.04.28)		

- ※ 감사위원회와 사외이사 후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.
- ※ 경영위원회 등 이사회내 위원회의 위원장은 해당 이사회내 위원회에서 선임합니다.
- ※ 보상위원회 위원장은 차기 위원회 개최시 선임 예정입니다.

(경영위원회)

- 설치목적: 경영위원회는 이사회 규정 및 결의에 따라 그 업무를 수행해야 하며, 그 외 수시로 이사회가 위임한 사항에 관하여 심의하고 결의한다. 경영위원회 구성, 운영 등에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정한다.
- 권한사항: 경영위원회는 다음 사안에 대해 심의하고 결의함
 - 1. 경영일반에 관한 사항
 - 1) 회사의 연간 또는 중장기 경영방침 및 전략
 - 2) 주요 경영전략
 - 3) 사업계획 · 사업구조 조정 추진
 - 4) 해외 지점 · 법인의 설치, 이전 및 철수
 - 5) 해외업체와의 전략적 제휴 등 협력추진
 - 6) 국내외 주요 자회사 매입 또는 매각(자기자본 0.1% 이상인 경우에 한함)
 - 7) 기타 주요 경영현황
 - 8) 지점, 사업장의 설치 및 이전, 폐지
 - 9) 지배인의 선임 또는 해임
 - 10) 최근사업연도 생산액의 5%이상 생산중단, 폐업
 - 11) 자기자본 0.5%이상 기술도입계약 체결 및 기술이전, 제휴
 - 12) 자기자본 0.5%이상 신물질, 신기술 관련 특허권 취득, 양수, 양도계약
 - 13) 최근사업연도 매출액의 5%이상 상당 제품수거, 파기
 - 14) 최근사업연도 매출액의 5%이상 상당 단일계약 체결
 - 15) 최근사업연도 매출액의 5%이상 상당 단일판매 대행 또는 공급계약 체결 또는 해지
 - 16) 조직의 운영에 관한 기본원칙
 - 17) 급여체계, 상여 및 후생제도의 기본원칙의 결정 및 변경
 - 18) 명의개서 대리인의 선임, 해임 및 변경
 - 19) 주주명부폐쇄 및 기준일 설정에 관한 사항
 - 20) 업무추진 및 경영상 필요한 세칙의 제정

- 2. 재무 등에 관한 사항
 - 1) 자기자본 0.1%이상 2.5%미만 상당 타법인 출자, 처분
 - 2) 자기자본 0.1%이상 2.5%미만 상당 해외 직접투자
 - 3) 자기자본 0.1%이상 2.5%미만 상당 신규 담보제공 또는 신규 채무보증(기간 연장은 제외함)
 - 담보: 타인을 위하여 담보를 제공하는 경우에 한함
 - 채무보증: 입찰, 계약, 하자, 차액보증 등의 이행보증과 납세보증은 제외
 - 4) 자기자본 0.1%이상 5%미만 상당 신규 차입계약 체결 (기간 연장은 제외함)
 - 5) 내부거래의 승인

내부거래라 함은 독점규제 및 공정거래에 관한 법령상 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위하여 30억원 이상 독점규제 및 공정거래에 관한 법령상 대규모 내부거래 기준 금액 미만 상당의 자금(가지급금, 대여금 등), 유가증권(주식, 회사채 등) 또는 자산(부동산, 무체재산권 등)을 제공하거나 거래하는 행위 (기존 계약을 중대한 변경 없이 갱신하는 경우는 제외함)

- 6) 사채발행
- 7) 자기자본 0.1% 이상의 부동산 취득 및 처분. 단, 제3자와의 거래로 인한 경우에 한함
- 8) 주요 시설투자 등 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항
- 3. 기타 이사회에서 위임한 사항 또는 이사회의 권한에 속하는 사항 중이사회 규정에 따라 이사회에 부의할 사항으로 명시된 사항과다른 위원회에 위임한 사항을 제외한 일체의 사항

(내부거래위워회)

- 설치목적: 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의 투명성을 제고하기 위함
- 권한사항
 - 내부거래 보고 청취권: 계열사와의 내부거래 현황에 대해 보고받을 수 있음
- ※ 독점규제 및 공정거래에 관한 법령상 대규모 내부거래를 하고자 하는 경우에는 사전 심의하고 그 이외의 거래에 있어서도 중요한 거래라고 판단하는
 - 거래는 심의 및 의결할 수 있음
 - 내부거래 직권조사 명령권
 - 내부거래 시정조치 건의권

(보상위원회)

- 설치목적: 이사보수 결정과정의 객관성, 투명성 확보를 제고하기 위함
- 권한사항
 - 주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도
 - · 등기이사에 대한 보상체계
 - •기타 이사회에서 위임한 사항

(지속가능경영위원회)

- 설치목적: 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance) 등 영역에서 지속가능경영을 추진하고 주주가치를 제고하기 위함
- 권한사항
 - 회사의 지속가능경영과 관련된 사항
 - 1) 주요 지속가능경영 전략 및 정책
 - 2) 환경, 사회, 지배구조 등 지속가능경영 관련 주요 활동 보고
 - 3) 지속가능경영보고서 발간 계획
 - 주주가치 제고와 관련된 사항
 - 1) 주주환원 정책 사전 심의
 - 2) 주주권익 관련 주요 사안 보고
 - · 기타 지속가능경영 및 주주가치에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항으로 위원회가 부의가 필요하다고 판단한 사항
 - 위원회 산하 연구회, 협의회 등 조직의 설치, 구성, 운영과 관련된 사항
 - 기타 이사회에서 위임한 사항

(2) 이사회내의 위원회 활동내역

(경영위원회)

				이사의 성명				
			가결	한종희	경계현	노태문	박학규	이정배
위원회명	개최일자	의 안 내 용	. –	(출석률:	(출석률:	(출석률:	(출석률:	(출석률:
			여부	100%)	75%)	100%)	100%)	100%)
				찬 반 여 부				
	'24.02.06	1. 임대차 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		1. 메모리 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	'24.03.07	2. Foundry(평택) 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		3. Foundry(화성) 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	'24.03.19	1. GPU 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		1. 메모리 투자의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성
		2. 삼성 SDI와 임대차 계약 체결의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성
34000=	'24.04.12	3. 생산물 배상책임 보험 가입의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성
경영위원회		4. 상표 사용 계약 체결의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성
		5. 서초 전자사옥 임대차 계약 체결의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성
		1. 메모리 투자의 건	가결	찬성		찬성	찬성	찬성
		2. 메모리(평택) 기존 FAB 마감 공사의 건	가결	찬성	해당	찬성	찬성	찬성
	'24.05.30	3. 메모리(평택) 신규 FAB 기초 공사의 건	가결	찬성	사항	찬성	찬성	찬성
		4. AVP 투자의 건	가결	찬성	없음	찬성	찬성	찬성
		5. 해외법인 설립의 건	가결	찬성	(사임)	찬성	찬성	찬성
	'24.06.26	1. 해외법인 청산의 건	가결	찬성		찬성	찬성	찬성

(내부거래위원회)

				이사의 성명				
		의 안 내 용		김선욱	김한조	김종훈	허은녕	유명희
위원회명	개최일자			(출석률:	(출석률:	(출석률:	(출석률:	(출석률:
				100%)	100%)	100%)	100%)	100%)
				찬 반 여 부				
		1. 대규모 내부거래에 대한 사전 심의	-	-	-	-	해당	해당
	'24.01.29	① 삼성메디슨㈜ 삼성 이 상표 사용료 수취 건					사항	사항
		2. 2023년 4분기 내부거래 현황 보고	-	-	-	-	없음	없음
	10.4.00.40	1. 대규모 내부거래에 대한 사전 심의						
내부거래	'24.03.18	① 서초 전자사옥 부동산 임대차계약 체결의 건	_	_	_	_	(신규선임)	(신규선임)
위원회		1. 내부거래위원회 위원장 선임의 건	가결	해당	찬성	해당	찬성	찬성
		2. 대규모 내부거래에 대한 사전 심의	-		-		-	-
	'24.04.26	① 삼성바이오로직스㈜/에피스㈜ 삼성 CI 상표		사항		사항		
		사용 계약 체결의 건		없음		없음		
		3. 2024년 1분기 내부거래 현황 보고	-	(사임)	_	(임기만료)	_	-

(보상위원회)

				이사의 성명					
			가결	김종훈	김한조	김준성	신제윤		
위원회명	개최일자	의 안 내 용	여부	(출석률:	(출석률:	(출석률:	(출석률:		
			l I	100%)	100%)	100%)	-%)		
				찬 반 여 부					
		1. 2024년 사내이사 개별 보수체계 및 고정연봉 심의							
보상	'24.02.19	 의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음		
위원회	21.52.15		가결	찬성	찬성	찬성	(신규선임)		
		2. 2024년 이사보수 한도 심의의 건							

(지속가능경영위원회)

				이사의 성	명						
			가결	김한조	김선욱	김종훈	김준성	허은녕	유명희	신제윤	조혜경
위원회명	개최일자	의 안 내 용		(출석률:	(출석률:	(출석률:	(출석률:	(출석률:	(출석률:	(출석률:	(출석률:
			여부	100%)	100%)	100%)	100%)	100%)	100%)	100%)	100%)
				찬 반 여 부	7						
		① ESG 이해관계자 대응 고도화 방안					_			해당	해당
	104 4 00									사항	사항
	'24.1.29	② '24년 지속가능경영보고서 발간 계획	_	_	_	_	_	_	_	없음	없음
	(1차)	③ IR동향	-	-	-	-	_	-	-	(신규	(신규 선
지속가능		④ '24~'26년 주주환원정책 사전심의	가결	찬성	찬성	찬성	반대	찬성	찬성	선임)	임)
경영위원회		① IR동향	-	-		해당	-	-	-	-	-
		② '24년 중대성 평가 결과	_	-	해당	사항	_	_	_	_	_
	'24.4.26	③ EU 이해관계자 인게이지먼트 결과	_	_	사항	없음	_	_	_	_	_
	(2차)	④ 자회사형 장애인 표준사업장(희망별숲)	_	_	없음	(임기	_	_	_	_	_
					(사임)						
	'24.4.26 (2차)	③ EU 이해관계자 인게이지먼트 결과	-	_ _ _	없음	없음	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _	-

라. 이사의 독립성

(1) 이사의 선임

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보 중 사내이사는 이사회에서 추천하고 사외이사 후보는 사외이사후보추천위원회에서 추천하여, 이사회가 이를 검토해서 주주총회의 회의목적 사항으로 확정합니다.

이사 선임에 있어서는 관련 법령과 정관에 정한 요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 상시 관리하는 후보군 중 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 전자 산업에 대한 이해와 재무, 법률, IT(로봇, AI), ESG, 금융, 투자, 환경, 에너지, 국제통상, Risk 관리 등 전문 분야에 대한 경력이 풍부하고, 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다.

각 이사의 주요경력은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

이사의 선임에 대하여 관련 법규에 따른 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일: 2024년 06월 30일)

직 명	성 명	임 기 (연임여부/횟수)	선 임 배 경	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의	최대주주 또는 주요주주와의 관 계
사내이사	한종희	'20.03~'26.03 (1호)	디스플레이 제품 분야의 최고 개발 전문가로서 당사가 글로벌 TV 1위를 지속 달성하는데 주도적인 역할을 하였으며, DX부문장으로서 탁월한 경영역량을 발휘하여 경쟁이 심화되고 있는 시장을 주도하여 리더십을 더욱 공고히 하는데 기여할 것으로 판단	이사회	DX부문 경영전반 총괄	해당사항 없음	특수관계인
사내이사	노태문		MX사업부의 주요 핵심보직을 두루 경험하였고, '21년에는 Galaxy S21, 폴더블 등을 통해 매출 104조원을 달성하여 '14년 이후 최고 실적을 창출하였음. 또한, 사업운영 개선을 통해 수익성을 강화하고 사업체질을 공고화하는 등 기업체질 변화에 크게 기여할 것으로 판단	이사회	MX사업부 경영전반 총괄	해당사항 없음	특수관계인
사내이사	박학규		주요 사업부들의 경영관리 보직들을 거치며 경영 리스크 관리역량을 입증하였고, 폭넓은 안목으로 사업 혁신을 성공적으로 이끌었음. 현재는 DX부문 경영 지원실장으로서,사업 성과창출을 위해 핵심 스탭 기능과 진단 및 리스크 관리역할까지 담당하고 있으며 전사 경영 이슈를 조율하는데 크게 기여	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	특수관계인
사내이사	이정배	'22.03~'25.03 (해당사항 없음)	메모리사업부의 개발, 품질, 전략 등 주요 보직들을 두루 경험한 전문가로 제품 경쟁력 확보를 통해 DRAM 30년 연속 매출 1위를 달성하였고, '21년에는 세계 반도 체 매출 1위를 재탈환하는 등 DS부문 사업에 대한 풍부한 경험과 뛰어난 역량을 보유한 것으로 판단	이사회	메모리사업부 경영전반 총괄	해당사항 없음	특수관계인
사외이사	김한조	'19.03~'25.03 (1회)	은행장을 역임한 재무전문가이자 전문 경영인이며 현재 사회공헌 재단을 맡고 있어 경영 전반에 대한 조언 외에 재무 전문성 및 상생·나눔경영 역량을 발휘하여 회사 발전에 기여할 것으로 판단	사외이사 후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음
사외이사	김준성	'22.03~'25.03 (해당사항 없음)	글로벌 선진 금융시장에서 주식시장 분석과 투자 경험을 쌓은 국제경제 및 투자 전문가로서, 해외시장과 외국 투자자들의 입장을 잘 대변하고, 글로벌 네크워킹을 활용하여 트렌디한 투자 전략 수립에 큰기여를 할 것으로 판단	사외이사 후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음
사외이사	허은녕	'22.11~'25.11 (해당사항 없음)	에너지·자원·환경 관련 경제 및 정책 분야 전문가 이자 세계적으로도 손꼽히는 석학으로 당사 해당 분 야의 경영 강화에 기여하는 한편, 이사회에 실질적 인 조언을 해줄 것으로 판단		전사 경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음

			통상교섭본부장을 역임한 국제 통상전문가로 외교				
사외이사	유명희	'22.11~'25.11	적 소통 노하우, 글로벌 인적 네트워크를 바탕으로	사외이사	전사 경영전반에	해당사항	해당사항 없음
사되어사	# 6 A	(해당사항 없음)	회사의 주요 투자자 및 이해 관계자들과 긴밀히 소	후보추천위원회	대한 업무	없음	M3718 ME
			통할 수 있을 것으로 판단				
		'24.03~'27.03	제4대 금융위원회 위원장을 역임한 금융·재정 전문	사외이사	전사 경영전반에	해당사항	
사외이사	신제윤	(해당사항 없음)	가로서 회사의 자금 운용 및 글로벌 전략 등 다양한	기 되어서 후보추천위원회	대한 업무	없음	해당사항 없음
		(010/10 10)	방면에서 전문적인 조언을 해줄 것으로 판단	구고구선되면회	대한 납구	<u> </u>	
			한국로봇학회 19대 회장을 역임한 로봇공학 및 로				
사외이사	조혜경	'24.03~'27.03	봇 소프트웨어 분야의 전문가이며 국내 로봇 연계	사외이사	전사 경영전반에	해당사항	해당사항 없음
사되어사	고메S	(해당사항 없음)	교육에도 앞장서 왔음. 당사의 관련 사업에 대해 실	후보추천위원회	대한 업무	없음	M3/18 MB
			질적 조언을 해줄 것으로 판단				

[※] 최대주주 또는 주요주주와의 관계는「상법」제542조의8에 기재되어 있는 관계를 참고하여 작성하였습니다.

(2) 사외이사 후보추천위원회

주주총회에서 선임하는 사외이사의 후보자를 추천하기 위한 사외이사 후보추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 작성기준일(2024년 6월 30일) 현재 위원회는 사외이사 3인(허은녕, 유명희, 신제윤)으로 구성되어 있어 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하도록 하는 상법 규정을 충족하고 있습니다.

사외이사 후보추천위원회는 사외이사 후보군(사외이사 추천인, 대외기관 추천인 등 포함) 중에서 이사회 구성, 임기만료 예정인 사외이사의 경력과 이사회내 위원회 활동 등 제반 사항을 종합적으로 살펴 적임자를 선정해 최종 사외이사 후보로 추천하고 있습니다.

				이사의 성명					
위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결	김선욱	허은녕	유명희	신제윤		
귀전외당	개최될사	의 한 내 용	여부	(출석률:100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: -%)		
				찬 반 여 부					
	'24.01.29	① 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성			
사외이사	(1차)	② 사외이사 후보추천일 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음		
	'24.02.19 (2차)	① 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	(신규 선임)		
	(2/1)	② 사외이사 후보추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성			

(3) 사외이사의 전문성

1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

(기준일: 2024년 06월 30일)

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수 / 지원업무 담당기간)	주요 활동내역
이사회 사무국	4	 부사장 1명(19년 5개월 / 1년 7개월), 직원(Principal Professional) 2명 (평균 17년 7개월 / 평균 2년 8개월) 직원(Professional) 1명 (7년 5개월 / 1년 4개월) 	주주총회, 이사회, 이사회내 위원회 운영 지원 사외이사 교육 및 직무수행 지원 이사 후보군 데이터베이스 구축 각 이사에게 안건에 관련된 정보 제공 회의 진행을 위한 실무 지원 이사회 및 위원회의 회의내용 기록

2) 경영이해도 제고를 위한 사외이사 내부교육 실시 현황

① 국내외 경영현장 점검

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용
2022.04.28	MX사업부	김한조, 김선욱, 박병국, 김종훈, 김준성	해당사항 없음	· 사업부 경영현황 및 전략제품 소개 등
2022.07.28	Memory 사업부	김한조, 김선욱, 김종훈, 김준성	해당사항 없음	・사업부 경영현황 및 생산라인 소개 등
2022.08	SEUK, SRUK,	김한조, 김선욱, 김종훈	코로나19 감염	• 경영현황 보고 및 주요 현안 질의
2022.00	SEF, SENA, SEH	음인소, 음선국, 음송훈	(김준성 이사)	·TV 생산라인 및 영업 현장 방문 등
2022.11.30	Foundry 사업부	김한조, 김선욱, 김종훈, 김준성, 허은녕, 유명희	해당사항 없음	ㆍ사업부 경영현황 파악 및 현장 답사
2023.01.31	Samsung Research,	김한조, 김선욱, 김종훈,	해당사항 없음	・DX부문 R&D 현황 보고 및 CTO 간담회 등
	디자인경영센터	김준성, 허은녕, 유명희	77 00	
2023.04.27	생활가전 사업부	김한조, 김선욱, 김종훈, 허은녕, 유명희	겸직 업무 (김준성 이사)	· 광주사업장 운영 현황 보고 및 현장 답사
2023.07.27	S.LSI 사업부	김한조, 김선욱, 김종훈, 김준성, 허은녕, 유명희	해당사항 없음	· 사업부 경영현황 및 중장기 사업전략 보고 등
2023.08	SEDA, SECH,			· 경영현황 보고 및 주요 현안 질의, 내부통제활동 평 가
	SELA, SEM	허은녕, 유명희	(김준성 이사)	· 생산라인 및 마케팅 현장 방문, 임직원 간담회
2023.10.31	VD 사업부	김한조, 김선욱, 김종훈, 허은녕, 유명희	겸직 업무 (김준성 이사)	· 사업부 경영현황 및 사업전략 보고 등
2024.01.31	MX 사업부	김한조, 김선욱, 김종훈, 김준성, 허은녕, 유명희	해당사항 없음	· 사업부 미래 준비현황 및 전략제품 소개 등
2024.04.30	Memory 사업부	김한조, 김준성, 허은녕, 유명희, 신제윤, 조혜경	해당사항 없음	· 사업부 경영현황 및 평택사업장 현장 방문
2024.05	인력개발원	김한조, 허은녕, 유명희, 신제윤, 조혜경	겸직 업무 (김준성 이사)	• 대구삼성창조캠퍼스 및 영덕연수원 방문

[※] 사외이사의 현업 일정 등으로 회사가 준비한 사업부나 법인 방문, 교육 등의 프로그램에 현장 참석이 어려운 경우 교육자료 등을 제공

하고 있습니다.

② 신임 사외이사 오리엔테이션

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용
2022.04.27	경영지원실	김준성	해당사항 없음	· 이사회 활동 및 회사경영 관련 주요사항
2022.11.28	경영지원실	허은녕, 유명희	해당사항 없음	· 이사회 활동 및 회사경영 관련 주요사항
2024.03.20	경영지원실	신제윤, 조혜경	해당사항 없음	· 이사회 활동 및 회사경영 관련 주요사항
2024.04.26	인력개발원	신제윤, 조혜경	해당사항 없음	· 삼성 역사와 경영철학

[※] 교육 참석 대상은 신임 사외이사입니다.

③ 사외이사 공통 교육

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용
2023.03.15	인력개발원	김한조, 김선욱, 김종훈,	해당사항 없음	·회사 역사, 경영철학 등 회사경영 관련 주요사항
2023.03.13	인약개발권	김준성, 허은녕, 유명희	애당사당 값금	• 외자 작자, 성성철역 등 외자성성 전년 구표자성
2023.04.25	글로벌마케팅실	김한조, 김선욱, 김종훈,	겸직 업무	·마케팅 활동의 이해
2023.04.25	글로벌EHS센터	허은녕, 유명희	(김준성 이사)	· EHS 관리 현황 및 환경 경영의 이해
	사회공헌단	기하자 기서의 기조하	경지 어디	·희망디딤돌 등 CSR 활동의 이해
2023.10.27	청년S/W아카데미			· SSAFY 프로그램 소개
	창의개발센터	허은녕, 유명희	(김준성 이사)	·C-Lab 소개 및 활동 소개
2024.05.23	경영지원실	김한조, 김준성, 허은녕,	해당사항 없음	· 이사회 워크샵 실시, 주요 현안 이슈 논의
2024.05.25	이 이 시 전 열	유명희, 신제윤, 조혜경	WIS NIS EXT	· 에시와 켜그룹 글시, 구표 원인 이유 본의

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

당사는 2024년 반기말 현재 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다. 동 위원회 위원 중 재무전문가는 김한조 위원이며, 관련 법령의 경력 요건을 충족하고 있습니다.

нп	사외이사	на	회계ㆍ재무전문가 관련			
성명	여부	경력	해당 여부	전문가 유형	관련 경력	
		・하나금융나눔재단 이사장('22~현재)			· ㈜하나금융지주 부회장('15~'16)	
		・하나금융공익재단 이사장('19~'21)		4등 0취	·㈜한국외환은행 은행장('14~'15)	
김한조	OII	・하나금융나눔재단 이사장('15~'19)	ØI	4호 유형 (금융기관·정부·	· 외환캐피탈㈜ 사장('13~'14)	
김연소	Ч	·㈜하나금융지주 부회장('15~'16)	МІ	(금융기관·정구· 증권유관기관 등 경력자)	· ㈜한국외환은행	
		·㈜한국외환은행 은행장('14~'15)		궁전유전기전 궁 정역자) 	- 기업사업그룹장('12~'13)	
		· 외환캐피탈㈜ 사장('13~'14)			- 지점장('99~'02, '04~'05)	
		· 서울대 국제대학원 객원교수('22~현재)				
		·외교부 경제통상대사('21~'22)		-		
		· 산업통상자원부 통상교섭본부 본부장,	-			
		Minister of Trade (차관급)('19~'21)				
유명희	예	・산업통상자원부 통상교섭실 실장('18~'19)			-	
		・산업통상자원부 통상정책국 국장('17~'18)				
		• 산업통상자원부 자유무역협정교섭관 겸				
		자유무역협정추진 기획단장('15~'17)				
		·대통령비서실 홍보수석실 외신대변인('14~'15)				
		• 한국공학한림원 정회원('23~현재)				
		・한국로봇학회 회장('22)				
		·국가과학기술자문회의(심의회의)				
조혜경	예	기계소재전문위원회 위원('21~'22)		_		
고에당	Ч	・제어로봇시스템학회 부회장('20~'21)	_	_		
		· 대한전기학회 이사('14~'17)				
		• 한국로봇산업진흥원 이사(의장)('12~'15)				
		· 한성대학교 AI응용학과 교수('96~현재)				

[※] 전문가 유형은 기업공시서식 작성기준 및「상법 시행령」제37조 제2항에 따른 회계·재무전문가 유형입니다.

^{· 4}호 유형: 금융기관·정부·증권유관기관 등에서 회계·재무 관련 업무 또는 이에 대한 감독업무를 수행한 경력이 모두 5년 이상인지 여부

나. 감사위원회 위원의 독립성

당사는 관련 법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한·책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사위원회 위원 전원은 이사회 및 사외이사 후보추천위원회의 추천을 받고 주주총회의 결의를 통해 선임한 재무전문가(김한조 위원)와 타 상장법인의 감사위원(유명희 위원, 조혜경위원)으로 구성되어 있습니다. 동 위원회 위원은 당사, 당사의 최대주주 또는 주요주주와 감사위원회 활동의 독립성을 저해할 어떠한 관계도 없습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족 여부	관련 법령 등
3명의 이사로 구성	충족(3명)	「상법」제415조의2 제2항,
사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)	당사 감사위원회 규정 제2조
위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(김한조 위원)	「상법」제542조의11 제2항,
감사위원회의 대표는 사외이사	충족(김한조 위원)	당사 감사위원회 규정 제3조
그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	「상법」제542조의11 제3항

성 명	감사위원회 위원 임기 (연임여부/횟수)	선 임 배 경	추천인	회사와의 관계	최대주주 또는 주요주주와의 관계	타회사 겸직 현황
김한조	'19.03~'25.03 (1회)	재무전문가로서 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 경 영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사위 원회 활동을 수행할 것으로 판단	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	-
유명희	'24.03~'25.11 (신규선임)	국제 통상전문가로서 30여 년 공직생활 경험을 바탕으로, 독립적이고 객관적인 시각에서 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	-
조혜경	'24.03~'27.03 (신규선임)	공학전문가로서 대내외에서 인정받은 높은 전문성을 바탕으로 엄격하고 공정하게 감사위원회 활동을 수행 할 것으로 판단	사외이사후보 추천위원회	해당사항 없음	해당사항 없음	-

[※] 회사와의 관계, 최대주주 또는 주요주주와의 관계는「상법」제542조의8에 기재되어 있는 관계를 참고하여 작성하였습니다.

감사위원회는 회계감사를 위해서 재무제표 등 회계 관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감 사결과를 검토하고, 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련 서류에 대 한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는

신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한, 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의 심의내 용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보 완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용합니다.

다. 감사위원회 주요 활동 내역

				이사의 성명				
			가결	김한조	김선욱	김종훈	유명희	조혜경
위원회명	개최일자	의안내용		(출석률:	(출석률:	(출석률:	(출석률:	(출석률:
			여부	100%)	100%)	100%)	100%)	100%)
				찬 반 여 부				
		1. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	-	-		
		2. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	-	-	_	-		
		3. 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션	-	-	-	-		
	'24.01.29	4. 2023년(제55기) 재무제표 및 영업보고서 보고의 건	-	-	-	-	해당사항	해당사항
		5. 2023년 4분기 비감사업무 수행 검토 보고의 건(*)	-	-	-	-	없음	없음
		6. 2023년 4분기 대외후원금 현황 보고의 건	-	_	_	-	(신규선임)	(신규선임)
		7. 2023년 감사실적 보고의 건	-	_	_	-		
감사	'24.02.19	1. 제55기 정기주주총회 회의 목적사항 심의의 건	-	-	-	-		
	24.02.19	2. 2023년 내부감시장치 가동현황 보고의 건	-	-	-	-		
위원회		1. 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션	-	-			-	-
		2. 2023년 외부감사 이행 평가 보고의 건	_	_			-	-
		3. 2024년 1분기 보고서 보고의 건	_	-	-II FL II GL	-IICL II eL	-	-
	104.04.00	4. 2024년 1분기 비감사업무 수행 검토 보고의 건(*)	-	-	해당사항	해당사항	-	-
	'24.04.26	5. 외부감사인과의 감사계약조건 결정의 건	가결	찬성	없음	없음	찬성	찬성
		6. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고의 건	_	_	(사임)	(임기만료)	-	-
		7. 2024년 1분기 대외 후원금 현황 보고의 건	_	_			_	-
		8. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가계획 보고의 건	-	_			-	-

[※] 당사 외부감사인이 감사위원회 승인 대상 비감사용역을 수행하지 않았음을 검토하여 보고한 안건으로,

감사위원회는 감사위원 간 논의를 거쳐 승인 대상 비감사용역을 수행하지 않았음을 최종 확인하였습니다.

라. 감사위원회 교육 실시 계획

당사는 내부회계관리제도 업무지침에 따라 연 1회 이상 감사위원의 전문성 확보 등을 위해 외부전문가, 재경팀 및 감사팀 등이 주체가 되어 내부통제 변화사항, 내부회계관리제도 등에 대하여 별도의 교육을 실시하고 있습니다.

마. 감사위원회 교육 실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용
2022.05.25	재경팀, 외부전문가	김종훈	해당사항 없음	내부회계관리제도와 감사위원회의 역할
2022.07.26	재경팀, 외부전문가	김한조 김선욱 김종훈	해당사항 없음	내부회계관리제도 조직운영 관련 해외 선진 사례
2023.10.27	재경팀, 외부전문가	김한조 김선욱 김종훈	해당사항 없음	내부회계관리제도 생성형 AI 활용 등 고도화 방안
2024.04.23	외부전문가, 감사팀, 내부회계평가지원그룹	유명희 조혜경	해당사항 없음	감사위원회 기본 개요, 역할과 책임 등
2024.05.21	외부전문가	조혜경	해당사항 없음	기업지배구조 및 감사위원회 제도, 운영, 활동방안 등

바. 감사위원회 지원조직 현황

(기준일: 2024년 06월 30일)

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역
		부사장 1명(6개월),	
감사팀	3	직원(Principal Professional) 1명(6년 6개월),	감사위원회 지원
		직원(Senior Professional) 1명(2년 6개월)	
		부사장 1명(5년 6개월),	
내부회계	4	변호사 1명(3년 3개월)	내부회계관리제도
평가지원그룹	4	직원(Principal Professional) 1명(1년 1개월),	운영실태 평가 지원
		직원(Senior Professional) 1명(1년 1개월)	

[※] 근속연수는 지원업무 담당 기간 기준입니다.

사. 준법지원인에 관한 사항

구 분		내 용
	성명	박정호
	출생연월	1971.09
	성별	남
	담당업무	삼성전자㈜ Compliance팀장('22.12~현재)
] 1. 인적사항 및		'22.12 : 삼성전자㈜ Compliance팀장 부사장대우
주요경력		'20.01 : 삼성전자㈜ Compliance팀 상무대우
	주요경력	'18.03 : 삼성전자㈜ DS부문 법무지원팀 상무대우
		'14.12 : 삼성전자㈜ 법무실 법무팀 상무대우
		'04.05 : 삼성전자㈜ 경영지원실 인사팀 변호사
	=L ⊃+	서울대 법학(학사)
	학력	미시간주립대 대학원 노사관계학(석사)
2. 이사회 결의일		2022.12.20
3. 결격요건		해당사항 없음
4. 기타		해당사항 없음

[※] 준법지원인은 관련 법령「상법」제542조의13 제5항의 요건(변호사 자격)을 충족하고 있습니다.

아. 준법지원인 등의 주요 활동 내역 및 그 처리 결과

당사는 국내외 사업장에서 정기·비정기적으로 준법 점검 활동을 수행하고 있으며, 점검 결과를 바탕으로 개선이 필요한 사안은 경영 활동에 반영하여 회사 및 임직원이제반 법규를 준수할 수 있도록 효과적인 준법 지원 활동을 하고 있습니다.

점검일시		점검내용	점검분야	점검 및 처리 결과
'24.1분기 '2	'24.03.	특허출원 프로세스 점검	영업비밀, 기술유용 등	
24.1군기	24.03.	국내외 제3자 생산 거래선 준법 점검	기술유출, 제조물책임 등	
	'24.04.	온라인 판매 사이트 준법 점검	소비자보호, 다크패턴	
	'24.05.	국내 영업조직 준법 점검	공정거래, 영업비밀 등	전반적으로 양호하며,
		해외법인 자율 준법 점검	컴플라이언스 프로그램 운영 현황	일부 개선 필요사항은
'24.2분기		국내 개발조직 준법 점검	영업비밀	사내 정책 등에 따라 보완함
	'24.06	해외 판매법인 준법 점검	공정거래, 영업비밀 등	
		온라인 판매 사이트 준법 점검	소비자보호, 그린워싱	
		국내외 제3자 생산 거래선 준법 점검	기술유출, 제조물책임 등	

[※] 점검시기는 각 분기별 종료월 기준입니다.

자. 준법지원인 지원 조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역
		상무 2명(평균 7년 1개월),	
		직원(Principal Professional) 21명(평균 9년),	
Compliance팀 등	65	변호사 11명(평균 5년 9개월),	준법지원인 주요 활동 지원
		직원(Senior Professional) 27명(평균 5년 8개월),	
		직원(Professional) 4명(평균 1년 7개월)	

[※] 근속연수는 지원업무 담당 기간 기준입니다.

[※] 각 점검은 일부 점검대상 조직을 선정하여 실시하였습니다.

3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도

당사는 2024년 반기말 현재 집중투표제와 서면투표제를 도입하지 않았으며, 2024년 3월 20일 제55기 정기주주총회에서 전자투표제를 실시하였습니다. 당사 이사회는 2020년 1월 30일 의결권 행사에 있어 주주의 편의를 제고하기 위하여「상법」제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제를 채택하였으며, 당사는 2020년 3월 18일에 개최한 제51기 정기주주총회부터 전자투표제를 시행하고 있습니다. 당사는 주주총회 소집공고시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하고 있으며, 매결산기 최종일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회에 직접 참석하지 않고 한국예탁결제원에서제공하는 전자투표시스템을 통하여 주주총회 10일 전부터 주주총회일 전날까지 의결권을 행사할 수 있습니다.

(기준일: 2024년 06월 30일)

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제
도입여부	배제	미도입	도입
실시여부	_	_	제55기('23년도) 정기주주총회

※ 당사는 작성기준일 현재 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있으며, 피권유자에게 직접 권유, 우편 또는 전자우편을 통한 송부, 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시 등의 방법을 통하여 의결권 위임을 실시하고 있습니다.

나. 의결권 현황

2024년 반기말 현재 당사의 발행주식총수는 보통주 5,969,782,550주, 우선주 822,886,700주입니다. 이 중 우선주는 의결권이 없으며, 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식(603,795,585주)을 제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 5,365,986,965주입니다.

(기준일: 2024년 06월 30일) (단위:주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고
바해조시초스(A)	보통주	5,969,782,550	_
발행주식총수(A)	우선주	822,886,700	_
의결권없는 주식수(B)	보통주	_	-
의달전하는 구역구(D)	우선주	_	_
정관에 의하여 의결권 행사가 배제	보통주	_	_
된 주식수(C)	우선주	822,886,700	_
기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	603,324,100	「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 의한 제한 (삼성생명보험㈜ 508,157,148주, 삼성화재해상보험㈜ 88,802,052주, 삼성복지재단 4,484,150주, 삼성문화재단 1,880,750주)
	보통주	471,485	「보험업법」에 의한 제한 (삼성생명보험㈜ 특별계정 일부)
이겨리이 법하던 조사스(다)	보통주	_	_
의결권이 부활된 주식수(E)	우선주	_	_
의결권을 행사할 수 있는 주식수	보통주	5,365,986,965	_
(F = A - B - C - D + E)	우선주	_	-

[※] 단, '기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수'에서, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 의해 제한된 주식(603,324,100주) 중 일부는 임원의 선임 또는 해임 및 정관변경 등과 관련하여 의결권 행사가 가능합니다.

다. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	주요 논의내용
	제1호 의안		• 55기 영업성과 및 배당 관련 설명
	 : 제55기 재무상태표, 손익계산서 및	가결	· 주주가치 제고 방안 질의응답
	이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건		ㆍ사업경쟁력 관련 질의응답
	제2호 의안		
	: 사외이사 신제윤 선임의 건	가결	· 금융/재정 전문가 등 후보 추천사유 설명
	THO = 0101		・다양한 조직에서의 감사경력 등 후보 추천사유 설명
THEEDI	제3호 의안	7174	· 감사위원이 되는 사외이사 후보의 IT 전문성 및
제55기	: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조혜경 선임의	가결	회계/재무 전문성 관련 의견 등 후보선정에 관한
정기주주총회	 		질의응답
(2024.03.20)	TILA = OLOL		·국제통상 및 법률전문가 등 후보 추천사유 설명
	제4호 의안 : 감사위원회 위원 유명희 선임의 건	가결	· 감사위원 후보의 회계/재무 전문성 및 감사위원회의
	· 음사기전의 기전 규정의 선음의 선		다양성 측면 의견 등 후보선정에 관한 질의응답
	제5호 의안	가결	· 이사보수 한도 검토 절차 및 구성내역 설명
	: 이사 보수한도 승인의 건	기글	· 이시고구 전고 a도 a시 및 구성내의 결정
	제6호 의안	가결	· 관계법령 및 이사회 산하 위원회 활동 반영 등
	: 정관 일부 변경의 건		정관변경 배경 및 내용 설명
	제1호 의안		• 54기 영업성과 및 배당 관련 설명
	: 제54기 재무상태표, 손익계산서 및	가결	• 주주가치 제고 방안 질의응답
제54기	이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건		· 사업경쟁력 관련 질의응답
정기주주총회	제2호 의안	가결	• 완제품 사업 전반에 대한 리더십 등
(2023.03.15)	: 사내이사 한종희 선임의 건	716	후보 추천사유 설명
	제3호 의안	기결 기결	· 이사보수 한도 검토 절차 및 구성내역 설명
	: 이사 보수한도 승인의 건	- ' -	**************************************
제54기	제1호 의안		・임시주총 개최 사유 관련 질의응답
임시주주총회	: 사외이사 선임의 건		・에너지/환경 분야 및 통상분야 전문성 등
(2022.11.03)	1-1호: 사외이사 허은녕 선임의 건	가결	후보 추천사유 설명
(2022111100)	1-2호: 사외이사 유명희 선임의 건	가결	
	제1호 의안		• 53기 영업성과 및 배당 관련 설명
	: 제53기 재무상태표, 손익계산서 및	가결	• 주주가치 제고 방안 질의응답
	이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건		· 사업경쟁력 관련 질의응답
	제2호 의안		
	: 이사 선임의 건		
	2-1호: 사외이사 선임의 건		・금융 및 회계/재무 전문가 등 후보 추천사유 설명
제53기	2-1-1호: 사외이사 김한조 선임의 건	가결	
정기주주총회	2-1-2호: 사외이사 한화진 선임의 건	가결	
(2022.03.16)	2-1-3호: 사외이사 김준성 선임의 건	가결	
	2-2호: 사내이사 선임의 건		· 비즈니스 리더십 및 사업/재무 전문성 등
	2-2-1호: 사내이사 경계현 선임의 건	가결	후보 추천사유 설명
	2-2-2호: 사내이사 노태문 선임의 건	가결	
	2-2-3호: 사내이사 박학규 선임의 건	가결	
	2-2-4호: 사내이사 이정배 선임의 건	가결	
	2-3호: 감사위원회 위원 선임의 건		• 글로벌 경영능력 등 후보 추천사유 설명

2-	-3-1호: 감사위원회 위원 김한조 선임의 건	가결			
2-	-3-2호: 감사위원회 위원 김종훈 선임의 건	가결			
제3호	제3호 의안		이 나타스 하는 거든 저희 미 그성내의 성대		
: 017	사 보수한도 승인의 건	가결	• 이사보수 한도 검토 절차 및 구성내역 설명		

VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일: 2024년 06월 30일) (단위: 주, %)

		T 1101	소유주식수 및 지				
성 명	관 계	주식의	기 초		기 말		비고
		종류	주식수	지분율	주식수	지분율	
삼성생명보험㈜	최대주주 본인	보통주	508,157,148	8.51	508,157,148	8.51	-
삼성생명보험㈜	최대주주 본인	우선주	43,950	0.01	43,950	0.01	-
삼성생명보험㈜(특별계정)	최대주주 본인	보통주	8,097,938	0.14	6,373,251	0.11	장내 매매
삼성생명보험㈜(특별계정)	최대주주 본인	우선주	417,085	0.06	413,124	0.05	장내 매매
삼성물산㈜	계열회사	보통주	298,818,100	5.01	298,818,100	5.01	-
삼성화재해상보험㈜	계열회사	보통주	88,802,052	1.49	88,802,052	1.49	-
삼성복지재단	출연 재단	보통주	4,484,150	0.08	4,484,150	0.08	_
삼성문화재단	출연 재단	보통주	1,880,750	0.03	1,880,750	0.03	-
홍라희	최대주주의 특수관계인	보통주	117,302,806	1.96	97,978,700	1.64	장외 매매
홍라희	최대주주의 특수관계인	우선주	206,633	0.03	206,633	0.03	-
이재용	최대주주의 특수관계인	보통주	97,414,196	1.63	97,414,196	1.63	-
이재용	최대주주의 특수관계인	우선주	137,757	0.02	137,757	0.02	_
이부진	계열회사 임원	보통주	55,394,044	0.93	47,745,681	0.80	장외 매매
이부진	계열회사 임원	우선주	137,755	0.02	137,755	0.02	-
이서현	계열회사 임원	보통주	55,394,044	0.93	47,290,190	0.79	장외 매매
이서현	계열회사 임원	우선주	137,755	0.02	137,755	0.02	-
한종희	계열회사 임원	보통주	15,000	0.00	15,000	0.00	-
경계현	계열회사 임원	보통주	21,050	0.00	0	0.00	이사 사임
노태문	계열회사 임원	보통주	13,000	0.00	18,000	0.00	장내 매매
박학규	계열회사 임원	보통주	22,500	0.00	28,000	0.00	장내 매매
이정배	계열회사 임원	보통주	15,000	0.00	18,800	0.00	장내 매매
김한조	계열회사 임원	보통주	3,655	0.00	3,655	0.00	-
조혜경	계열회사 임원	보통주	0	0.00	500	0.00	신규 선임
וער		보통주	1,235,835,433	20.70	1,199,028,173	20.08	-
계		우선주	1,080,935	0.13	1,076,974	0.13	-

[※] 관계는「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」제3조 제1항에 기재되어 있는 관계를 참고하여 기재하였습니다.

[※] 보통주는 의결권이 있으며, 우선주는 의결권이 없습니다. (단, 보통주 일부는 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한되어 있습니다.

자세한 현황은 'VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항' 중 '3. 주주총회 등에 관한 사항'의 '라. 의결권 현황'을 참고하시기 바랍니다.)

^{** 2024}년 6월 30일 기준입니다. 작성기준일 이후 변동은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)의 '주식등의대량보유상활보고서(일반)' 등을 참고하시기 바랍니다.

2. 최대주주 관련 사항

가. 최대주주의 개요

(1) 최대주주(삼성생명보험㈜)의 기본정보

1) 법적・상업적 명칭: 삼성생명보험㈜ (Samsung Life Insurance Co., Ltd.)

2) 설립일자: 1957년 4월 24일

3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주소: 서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동)

전화번호: 1588-3114

홈페이지: www.samsunglife.com

4) 최대주주(삼성생명보험㈜)의 대표이사·업무집행자·최대주주

(단위:명,%)

명 칭	출자자수					최대주주 (최대출자자)	
	(명)	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
삼성생명보험㈜	명보험㈜ 71,822	홍원학	0.00	_		삼성물산㈜	19.34
	71,022	-	-	_	_	-	_

※ 2024년 6월 30일 보통주 기준입니다.

5) 최대주주(삼성생명보험㈜)의 대표이사 · 업무집행자 · 최대주주의 변동내역

		대표이사		업무집행자		최대주주	
변동일		(대표조합원)		(업무집행조합원	일)	(최대출자자)	
	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)	
	2024.03.21	홍원학	0.00	_	_	-	_

※ 2024년 3월 21일 전영묵 대표이사가 사임하고, 홍원학 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다.

(2) 최대주주(삼성생명보험㈜)의 최근 결산기 재무현황

(단위:백만원)

구 분	
법인 또는 단체의 명칭	삼성생명보험㈜
자산총계	319,799,739
부채총계	278,285,654
자본총계	41,514,085
매출액	17,216,153
영업이익	1,651,840
당기순이익	1,452,130

[※] 재무현황은 2024년 6월 30일, 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준입니다.

(3) 최대주주(삼성생명보험㈜)의 사업현황 등

삼성생명보험㈜은 인보험 및 그와 관련된 재보험계약 등을 주요 영업목적으로 하는 생명보험회사로, 보험업법 및 기타 법령 등에 근거하여 사업을 영위하고 있습니다. 또한, 주요 종속기업인 삼성카드㈜는 여신전문금융업(신용카드업·시설대여업·할부금융업등)을 영위하는 여신전문금융회사로, 여신전문금융업법 및 기타 관계법령에 근거하여 사업을 영위하고 있습니다.

최대주주에 대한 자세한 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 삼성생명보험㈜의 사업(분・반기)보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래

해당사항 없습니다.

다. 최대주주의 최대주주의 개요

(1) 최대주주의 최대주주(삼성물산㈜)의 기본정보

1) 법적·상업적 명칭: 삼성물산㈜ (Samsung C&T Corporation)

2) 설립일자 및 존속기간

1963년 12월 23일에 동화부동산주식회사로 시작하여, 2014년 7월 제일모직주식회사로 사명을 변경하였습니다. 또한 1938년 3월 1일 설립된 삼성상회를 모태로 1951년 1월에 설립된 삼성물산주식회사와의 합병을 통하여 2015년 9월 2일(합병등기일) 삼성물산주식회사로 사명을 변경하였습니다.

3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주소: 서울특별시 강동구 상일로6길 26(상일동)

전화번호: 02-2145-5114

홈페이지: www.samsungcnt.com

4) 최대주주의 최대주주(삼성물산㈜)의 대표이사・업무집행자・최대주주

(단위:명,%)

명 칭	출자자수	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)	
	(명)	성명	지분(%)	성명 지분(%)		성명	지분(%)
삼성물산㈜	116,852	오세철	0.00	_	_	이재용	19.06
		정해린	0.00	_	_	_	_
		이재언	0.00	_	_	_	_

※ 2024년 6월 30일, 보통주 기준입니다.

5) 최대주주의 최대주주(삼성물산㈜)의 대표이사・업무집행자・최대주주의 변동내역

(단위:%)

	대표이사		업무집행자		최대주주		
변동일	(대표조합원)		(업무집행조합원	<u>의</u>)	(최대출자자)	(최대출자자)	
	성명 지분(%)		성명	지분(%)	성명	지분(%)	
2023.03.17	한승환	_	_	_	_	_	
2023.03.17	정해린	0.00	_	_	_	_	
2023.04.21	_	_	_	_	이재용	18.26	
2024.03.15	고정석	_	_	_	_	_	
2024.03.15	이재언	0.00	_	_	_	_	
2024.04.19	_	_	_	_	이재용	19.06	

- ※ 2023년 3월 17일 한승환 대표이사가 사임하고, 정해린 대표이사가 선임되었습니다.
- ※ 2023년 4월 21일 자기주식 소각(보통주 1,295,411)으로 인하여 최대주주의 지분율(보통주)이 변동(18.13%→18.26%)되었습니다.
- ※ 2024년 3월 15일 고정석 대표이사가 사임하고, 이재언 대표이사가 선임되었습니다.
- ※ 2024년 4월 19일 자기주식 소각(보통주 7,807,563)으로 인하여 최대주주의 지분율(보통주)이 변동(18.26%→19.06%)되었습니다

(2) 최대주주의 최대주주(삼성물산㈜)의 최근 결산기 재무현황

(단위:백만원)

구 분	
법인 또는 단체의 명칭	삼성물산㈜
자산총계	68,291,225
부채총계	26,034,483
자본총계	42,256,742
매출액	21,800,608
영업이익	1,612,683
당기순이익	1,556,175

[※] 재무현황은 2024년 6월 30일, 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준입니다.

(3) 최대주주의 최대주주(삼성물산㈜)의 사업현황 등

삼성물산㈜은 국내외의 건축, 토목, 플랜트, 주택 분야의 사업을 영위하고 있는 건설부문과 자원개발, 철강, 화학, 산업소재, 섬유 등 다양한 방면에서 국제무역을 하고 있는 상사부문, 의류 수입 및 판매사업을 하는 패션부문, 조경사업과 에버랜드(드라이파크), 캐리비안베이(워터파크), 골프장 및 전문급식, 식자재유통사업(삼성웰스토리)을 영위 운영하는 리조트부문, 바이오의약품 위탁생산사업 및 바이오시밀러 사업으로 구성되어 있습니다.

화대주주의 최대주주에 대한 자세한 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss. or.kr)에 공시된 삼성물산㈜의 사업(분・반기)보고서를 참조하시기 바랍니다.

3. 최대주주 변동현황

공시대상기간 중 최대주주의 변동 사항이 없습니다.

4. 주식의 소유현황

(기준일: 2024년 06월 30일) (단위:주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고
5% 이상 주주	삼성생명보험㈜	514,530,399	8.62	특별계정 포함
	국민연금공단	426,513,027	7.14	_
	BlackRock Fund Advisors	300,391,061	5.03	2019년 1월 28일 기준
	삼성물산㈜	298,818,100	5.01	-
우리사주조합		_	_	_

※ 5% 이상 주주는 의결권 있는 주식(기타 법률에 의해 의결권 행사가 제한된 주식도 포함) 기준입니다. 자세한 현황은 'VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항' 중 '3. 주주총회 등에 관한 사항'의 '나. 의결권 현황 '을

참고하시기 바랍니다.

※ BlackRock Fund Advisors의 소유주식수 및 지분율은 2019년 2월 7일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에

공시된 '주식등의 대량보유상황보고서' 기준입니다.

나. 소액주주 현황

(기준일: 2024년 06월 30일) (단위:주)

	주주			소유주식			
구 분	소액	전체	비율	소액	총발행	비율	비고
	주주수	주주수	(%)	주식수	주식수	(%)	
소액주주	4,247,611	4,247,701	99.99	4,039,288,913	5,969,782,550	67.66	_

- ※ 소유주식은 의결권 있는 주식(기타 법률에 의해 의결권 행사가 제한된 주식도 포함) 기준입니다.
- ※ 소액주주는 총발행주식수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주 기준입니다.

5. 주가 및 주식거래실적

가. 국내증권시장

(단위 : 원, 주)

종 류			'24.01월	'24.02월	'24.03월	'24.04월	'24.05월	'24.06월
		최 고	79,600	75,200	82,400	85,300	81,300	81,600
	주가	최 저	71,000	72,800	72,200	75,500	73,500	75,200
보통주		평 균	74,455	73,684	75,760	80,595	77,780	78,832
エるエ		최고(일)	57,691,266	21,966,745	50,106,297	37,077,944	43,825,202	33,763,804
	거래량	최저(일)	11,088,724	11,503,495	9,740,504	12,755,629	11,763,992	9,455,929
		월 간	397,638,759	298,955,484	448,361,736	484,342,028	421,088,782	351,896,233
		최 고	63,000	63,800	68,000	69,900	66,900	64,700
	주가	최 저	58,300	59,700	61,800	63,500	60,300	61,100
우선주		평 균	60,264	62,168	64,200	66,833	64,000	63,089
구선구		최고(일)	1,682,843	3,190,357	3,638,838	2,831,703	3,418,709	2,242,841
	거래량	최저(일)	453,959	847,453	821,960	655,555	489,182	841,534
		월 간	24,243,206	26,406,891	33,140,673	28,000,028	24,613,973	27,930,121

[※] 주가는 해당 일자의 종가 기준입니다.

나. 해외증권시장

[증권거래소명: 런던 증권거래소(보통주)]

종 류				'24.01월	'24.02월	'24.03월	'24.04월	'24.05월	'24.06월
		뒨그	US\$	1,498.00	1,431.00	1,488.00	1,592.00	1,507.00	1,492.00
		최고	₩환산	1,931,521	1,896,504	1,991,986	2,147,767	2,057,356	2,059,706
	주가	최저	US\$	1,308.00	1,360.00	1,354.00	1,384.00	1,339.00	1,359.00
	ナバ	4 시	₩환산	1,738,332	1,810,568	1,783,083	1,916,840	1,843,134	1,872,566
보통주		평균	US\$	1,401.27	1,381.38	1,411.70	1,471.29	1,431.00	1,435.35
		10	₩환산	1,854,680	1,838,789	1,877,639	2,012,901	1,954,787	1,980,467
		최그	고(일)	28,217	21,720	20,594	31,925	21,811	23,210
	거래량	최기	더(일)	5,106	5,730	6,292	7,472	6,069	6,852
		월 간		245,477	242,993	209,457	284,567	245,426	262,272

- ※ 주가는 해당 일자의 종가 기준입니다.
- ※ 최고·최저 주가의 원화 환산은 해당 일자의 종가 원/달러 환율 기준이며, 평균 주가의 원화 환산은 월평균 원/달러 환율 기준입니다.
- ※ DR 1주당 원주 25주입니다.

[증권거래소명: 룩셈부르크 증권거래소(우선주)]

종 류				'24.01월	'24.02월	'24.03월	'24.04월	'24.05월	'24.06월
		최고	US\$	1,180.00	1,186.00	1,256.00	1,294.00	1,228.00	1,168.00
		쇠고	₩환산	1,521,492	1,571,806	1,690,325	1,745,735	1,676,466	1,622,469
	주가	최저	US\$	1,072.00	1,112.00	1,162.00	1,148.00	1,088.00	1,102.00
	T)		₩환산	1,424,688	1,482,852	1,548,946	1,589,980	1,497,632	1,518,446
우선주		ᇜ그	US\$	1,130.45	1,162.00	1,200.70	1,216.19	1,174.29	1,142.20
		평균	₩환산	1,496,234	1,546,766	1,596,997	1,663,899	1,604,108	1,575,985
		최그	고(일)	8,406	5,746	2,227	3,036	2,282	3,474
	거래량	최기	데(일)	273	426	164	358	150	200
		월	! 간	29,600	31,929	18,916	21,216	20,850	22,724

- ※ 주가는 해당 일자의 종가 기준입니다.
- ※ 최고·최저 주가의 원화 환산은 해당 일자의 종가 원/달러 환율 기준이며, 평균 주가의 원화 환산은 월평균 원/달러 환율 기준입니다.
- ※ DR 1주당 원주 25주입니다.

(단위: US\$, 원, DR)

(단위: US\$, 원, DR)

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 등기임원

(기준일: 2024년 06월 30일) (단위:주)

				E 71				소유주식	수	A10177		
		- III.40	T. O.	등기	상근	담당		의결권	의결권	최대주주		임기
성명	성별	출생년월	직위	임원	여부	업무	주요경력	있는 주	없는 주	와의	재직기간	만료일
				여부				식	식	관계		
한종희	남	1962.03	부회장	사내	상근	대표이사	• 인하대 전자공학 학사	15,000	_	계열회사	52개월	2028.03.17
5.03	0	1902.03	구최 G	아사	0 L	(DX부문 경영전반 총괄)	· 삼성전자 DX부문장	13,000		임원	JZ/II j	2020.03.17
노태문	남	1968.09	사장	사내	상근	MX사업부장	• 포항공대 전자전기공학 박사	13,000	_	계열회사	28개월	2025.03.15
		1000.00	,,,,	아사	0.		· 삼성전자 MX사업부장	10,000		임원	207112	2020.00.10
박학규	남	1964.11	사장	사내	상근	CFO	· KAIST 경영학 석사	22,500	_	계열회사	28개월	2025.03.15
				이사			· 삼성전자 경영지원실장	,		임원		
이정배	남	1967.02	사장	사내	상근	메모리사업부장	· 서울대 전자공학 박사	15,000	_	계열회사	28개월	2025.03.15
				아사			· 삼성전자 메모리사업부장	·		임원		
김한조	计	1956.07	이사	사외 이사	비상근	이사회 의장 감사위원회 위원장 내부거래위원회 위원 보상위원회 위원 지속가능경영위원회 위원장	• 연세대 불어불문학 학사 • 하나금융지주 부회장	3,655	-	계열회사 임원	64개월	2025.03.19
김준성	남	1967.10	이사	사외 이사	비상근	보상위원회 위원 지속가능경영위원회 위원	· Carnegie Mellon대 경제학/산업공학 학사 · 싱가포르 투자청 토탈리턴그룹 이사	-	-	계열회사 임원	28개월	2025.03.15
허은녕	남	1964.08	이사	사외 이사	비상근	내부거래위원회 위원장 사외이사 후보추천위원회 위원 지속가능경영위원회 위원	· Pennsylvania State대 자원경제학 박사 · 서울대 공과대학 교수	-	_	계열회사 임원	20개월	2025.11.02
유명희	Ф	1967.06	이사	사외 이사	비상근	강사위원회 위원 내부거래위원회 위원 사외이사 후보추천위원회 위원 지속가능경영위원회 위원	· Vanderbilt대 법학 박사 · 산업통상자원부 통상교섭본부 본부장	-	-	계열회사 임원	20개월	2025.11.02
신제윤	to	1958.03	이사	사외 이사	비상근	사외이사 후보추천위원회 위원 보상위원회 위원 지속가능경영위원회 위원	· 서울대 경제학 학사 · 금융위원회 위원장	-	-	계열회사 임원	4개월	2027.03.28
조혜경	여	1964.07	1410	사외 이사	비상근	감사위원회 위원 지속가능경영위원회 위원	・서울대 로봇공학 박사 ・한성대 AI응용학과 교수	500	-	계열회사 임원	4개월	2027.03.19

- ※ 최대주주와의 관계는「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」제3조 제1항에 기재되어 있는 관계를 참고하여 기재하였습니다.
- ※ 등기임원 소유주식수는 작성기준일 현재 기준이며, 작성기준일 이후 변동은 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)의 '임원・주요주주 특정증권등 소유상황보고서' 등을 참고하시기 바랍니다.
- ※ 2024년 3월 20일 정기주주총회에서 신제윤 사외이사, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조혜경 이사가 신규 선임되었으며,

유명희 사외이사가 감사위원회 위원으로 선임되었습니다. 당일 개최된 이사회를 통해 허은녕 사외이사와 유명희 사외이사가 내부거래위원회 위원으로 선임되었고,

신제윤 이사는 사외이사 후보추천위원회 위원, 보상위원회 위원, 지속가능경영위원회 위원으로 선임되었으며,

조혜경 사외이사는 지속가능경영위원회 위원으로 선임되었습니다.

- ※ 2024년 3월 20일 김선욱 사외이사가 퇴임하였습니다.
- ※ 2024년 3월 22일 김종훈 사외이사의 임기가 만료되었습니다.
- ※ 2024년 4월 26일 허은녕 사외이사가 내부거래위원회 위원장으로 선임되었습니다.
- ※ 2024년 5월 21일 경계현 사내이사가 사임하였습니다.

나. 등기임원의 타회사 임원겸직 현황

(기준일: 2024년 06월 30일)

겸 직 자		겸 직 회 사	결 직 회 사					
성 명	직 위	기업명	직 위	재임 기간				
유명희	사외이사	HD현대건설기계	사외이사	2022년~현재				
조혜경	사외이사	현대건설	사외이사	2021년~현재				

다. 미등기임원 현황

(기준일: 2024년 6월 30일) (단위:개월)

성명	성별	출생 연월	직위	상근 여부	담당업무	주요경력	학력	최대주주 와의 관계	재직 기간
이재용	남	1968.06	회장	상근	회장	coo	Harvard Univ.(박사수료)	최대주주의 특수관	
전영현	남	1960.12	부회장	상근	DS부문장	미래사업기획단장	한국과학기술원(박사)	계인 계열회사 임원	7
정현호	남	1960.03	부회장	상근	사업지원T/F장	디지털이미징사업부장	Harvard Univ.(석사)	계열회사 임원	
경계현	남	1963.03	사장	상근	미래사업기획단장	DS부문장	서울대(박사)	계열회사 임원	19
김수목	남	1964.05	사장	상근	법무실장	법무실 송무팀장	서울대(학사)	계열회사 임원	46
김우준	늄	1968.05	사장	상근	네트워크사업부장	네트워크 전략마케팅팀 담당임 원	서울대(박사)	계열회사 임원	
김원경	남	1967.08	사장	상근	Global Public Affairs실장	북미총괄 대외협력팀장	The Johns Hopkins Univ.(석사)	계열회사 임원	
남석우	남	1966.03	사장	상근	제조&기술담당	글로벌인프라총괄	연세대(박사)	계열회사 임원	

박승희	남	1964.08	사장	상근	Corporate Relations담당	삼성물산, 건설부문 커뮤니케이 션팀장	건국대(석사)	계열회사 임원	19
						200		계열회사	
박용인	남	1964.04	사장	상근	System LSI사업부장	System LSI 전략마케팅실장	연세대(석사)	게 글 외 사	
백수현	남	1963.01	사장	상근	커뮤니케이션팀장	커뮤니케이션팀 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	
송재혁	남	1967.08	사장	상근	DS부문 CTO	메모리 Flash개발실장	서울대(박사)	계열회사 임원	
안중현	남	1963.03	사장	상근	경영지원실 담당임원	SGR, 미래산업연구본부장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	3
양걸	남	1962.10	사장	상근	중국전략협력실장	DS부문 중국총괄	서강대(석사)	계열회사 임원	
엄대현	남	1966.03	사장	상근	법무실 담당임원	법무실 송무팀장	한양대(학사)	계열회사 임원	
용석우	남	1970.09	사장	상근	영상디스플레이사업부장	영상디스플레이 담당임원	Polytechnic Univ. of NY(석 사)	계열회사 임원	
이영희	여	1964.11	사장	상근	글로벌마케팅실장	무선 마케팅팀장	Northwestern Univ.(석사)	계열회사 임원	
전경훈	남	1962.12	사장	상근	DX부문 CTO	네트워크사업부장	Univ. of Michigan, Ann Arbor(박사)	계열회사 임원	
최경식	남	1962.03	사장	상근	북미총괄	무선 전략마케팅실장	한양대(석사)	계열회사 임원	
최시영	남	1964.01	사장	상근	Foundry사업부장	글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터장	The Ohio State Univ.(박사)	계열회사 임원	
한승환	남	1964.07	사장	상근	의료사업일류화추진단장	삼성물산, 리조트부문 대표이사	서울대(학사)	계열회사 임원	19
강동구	남	1976.12	부사장	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	
강동훈	남	1970.12	부사장	상근	법무실 담당임원	DS부문 법무지원팀 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	
310.4		4000.00	J		AVO LLOISITI	Foundry Corporate Planning실	Univ. of Illinois, Urbana-	계열회사	
강문수	남	1969.08	무사상	상근	AVP사업팀장	담당임원	Champaign(박사)	임원	
강석채	남	1971.06	부사장	상근	Foundry Corporate Planning실 담당임원	DS부문 DSA 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박 사)	계열회사 임원	
강성철	남	1967.08	부사장	상근	생산기술연구소 담당임원	Samsung Research Robot센 터장	서울대(박사)	계열회사 임원	
강신봉	남	1970.01	부사장	상근	글로벌마케팅실 D2C센터장	위대한상상, CEO	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	18
강태우	남	1973.10	부사장	상근	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	고려대(학사)	계열회사 임원	
계종욱	남	1966.10	부사장	상근	Foundry Design Platform개발 실장	Foundry Design Platform개발 실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
고대곤	남	1965.03	부사장	상근	SEPM법인장	SIEL-P(C)법인장	아주대(학사)	계열회사 임원	
고봉준	남	1972.01	부사장	상근	영상디스플레이 Service Business팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 담당임 원	Columbia Univ.(박사)	계열회사 임원	52
고승환	남	1962.09	부사장	상근	생활가전 구매팀장	영상디스플레이 구매팀장	인하대(학사)	계열회사 임원	

						1			
고재윤	남	1973.01	부사장	상근	지원팀 담당임원	경영혁신팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
고재필	남	1970.03	부사장	상근	제조&기술담당 Foundry제조기 술센터 담당임원	메모리 인사팀장	Purdue Univ.(석사)	계열회사 임원	
고형종	남	1970.11	부사장	상근	메모리 Design Platform개발실 장	메모리 Design Platform개발실 담당임원	Univ. of Florida(박사)	계열회사 임원	
곽연봉	남	1967.03	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프 라기술센터장	글로벌인프라총괄 인프라기술 센터 담당임원	광운대(학사)	계열회사 임원	
구본영	남	1967.05	부사장	상근	SAS법인장	글로벌인프라총괄 Foundry제조 기술센터 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
구자흠	남	1968.01	부사장	상근	Foundry 기술개발실장	Foundry 기술개발실 담당임원	North Carolina State Univ.(박사)	계열회사 임원	
권상덕	남	1967.03	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 담 당임원	반도체연구소 Logic TD실장	서울대(박사)	계열회사 임원	
권태훈	남	1968.02	부사장	상근	재경팀 담당임원	DS부문 일본총괄 담당임원	Univ. of North Carolina, Chapel Hill(석사)	계열회사 임원	
김강태	뱌	1972.10	부사장	상근	Samsung Research 기술전략 팀장	Samsung Research SE팀장	중앙대(박사)	계열회사 임원	
김경환	냠	1970.06	부사장	상근	법무실 송무팀장	법무실 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	56
김경희	여	1969.07	부사장	상근	글로벌마케팅실 글로벌브랜드 센터 담당임원	글로벌마케팅실 D2C센터 담당 임원	Yale Univ.(석사)	계열회사 임원	
김기훈	뱌	1968.05	부사장	상근	지원팀 담당임원	구주총괄 지원팀장	Univ. of Baltimore(석사)	계열회사 임원	
김대주	남	1969.10	부사장	상근	영상디스플레이 지원팀장	영상디스플레이 지원팀 담당임 원	Univ. of Illinois, Urbana- Champaign(석사)	계열회사 임원	
김대현	남	1974.06	부사장	상근	Samsung Research Global AI센터장	Samsung Research Global AI센터 담당임원	Cornell Univ.(박사)	계열회사 임원	
김동관	남	1969.10	부사장	상근	DS부문 정보보호센터장	삼성SDS 정보보호센터장	한양대(학사)	계열회사 임원	31
김동욱	남	1968.10	부사장	상근	재경팀장	재경팀 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
김동욱	남	1969.06	부사장	상근	AVP사업팀 AVP개발실 담당임 원	Test&Package센터 담당임원	Univ. of California, Irvine(박사)	계열회사 임원	
김두일	남	1971.07	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	Samsung Research Platform팀장	경북대(학사)	계열회사 임원	
김만영	남	1969.07	부사장	상근	SEG법인장	무선 전략마케팅실 담당임원	Boston Univ.(학사)	계열회사 임원	
김명철	남	1968.09	부사장	상근	제조&기술담당 Foundry제조기 술센터 담당임원	반도체연구소 공정개발실 담당 임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
김민구	뱌	1964.08	부사장	상근	System LSI SOC사업팀 담당임 원	System LSI SOC개발실 담당임 원	서울대(박사)	계열회사 임원	
김병도	남	1967.03	부사장	상근	글로벌마케팅실 글로벌브랜드 센터 당당임원	글로벌마케팅실 D2C센터 담당 임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
김보현	냠	1973.02	부사장	상근	DS부문 People팀 담당임원	메모리 People팀장	서강대(석사)	계열회사 임원	
김상우	남	1971.01	부사장	상근	DS부문 법무지원팀장	법무실 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	5

		1							
김성욱	남	1968.06	부사장	상근	한국총괄 D2C팀장	인사팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
김성윤	남	1966.10	부사장	상근	법무실 IP센터 담당임원	IP센터 책임변호사	Harvard Univ.(석사)	계열회사 임원	
김성은	늄	1970.05	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	무선 개발실 수석	경북대(학사)	계열회사 임원	54
김성한	남	1970.05	부사장	상근	Foundry Corporate Planning실 담당임원	Foundry 전략마케팅실 담당임 원	서울대(석사)	계열회사 임원	
김세윤	남	1973.06	부사장	상근	TSE-S법인장	생활가전 전략마케팅팀 담당임 원	고려대(석사)	계열회사 임원	
김세호	남	1967.10	부사장	상근	SEI법인장	영상디스플레이 영상전략마케 팅팀 담당임원	동국대(학사)	계열회사 임원	
김수진	여	1969.08	부사장	상근	지속가능경영추진센터장	Global Public Affairs팀 담당임 원	Univ. of Pennsylvania(박사	계열회사 임원	
김연성	남	1966.05	부사장	상근	생활가전 지원팀장	한국총괄 지원팀장	MIT(석사)	계열회사 임원	
김영집	남	1971.03	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	Mobile eXperience 모바일플랫 폼센터 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
김영호	남	1964.12	부사장	상근	수원지원센터장	생활가전 지원팀 담당임원	Tulane Univ.(석사)	계열회사 임원	
김용관	남	1963.12	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	의료기기사업부장	Thunderbird(석사)	계열회사 임원	
김용국	늄	1968.01	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	삼성바이오에피스, 생산본부 담 당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	36
김용수	뱌	1971.07	부사장	상근	영상디스플레이 Service Business팀장	Google, VP	Stanford Univ.(석사)	계열회사 임원	7
김용재	남	1972.03	부사장	상근	영상디스플레이 개발팀장	영상디스플레이 개발팀 담당임 원	서강대(석사)	계열회사 임원	
김용주	뱌	1970.08	부사장	상근	Foundry 지원팀장	삼성SDI 중대형사업부 지원팀 장	성균관대(석사)	계열회사 임원	31
김우평	남	1970.05	부사장	상근	DSRA-AVP 연구소장	TSP총괄 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박 사)	계열회사 임원	24
김유석	남	1965.04	부사장	상근	법무실 IP센터장	법무실 IP센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
김은중	남	1965.06	부사장	상근	AVP사업팀 Corporate Planning실 담당임원	TSP총괄 GPO팀장	성균관대(학사)	계열회사 임원	
김이수	남	1973.03	부사장	상근	SIEL-P(N)공장장	Mobile eXperience Global제조 센터 담당임원	아주대(학사)	계열회사 임원	
김인식	남	1967.09	부사장	상근	재경팀 담당임원	삼성SDS, 전략기획담당 담당임 원	Univ. of Michigan, Ann Arbor(석사)	계열회사 임원	
김일룡	남	1974.02	부사장	상근	System LSI Global Operation실 담당임원	System LSI 기반설계실 담당임 원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
김장경	남	1973.05	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	영상디스플레이 지원팀 담당임 원	홍익대(학사)	계열회사 임원	
김재열	남	1965.07	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프 라기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라기술 센터 당당임원	중앙대(학사)	계열회사 임원	
김재준	남	1968.01	부사장	상근	메모리 전략마케팅실장	DS부문 미주총괄 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	

						T		1 1	
김재훈	남	1967.01	부사장	상근	SEIB법인장	영상디스플레이 영상전략마케	서울대(석사)	계열회사	
						팅팀 담당임원		임원	
김정식	남	1970.08	부사장	상근	Mobile eXperience CX실 담당	Mobile eXperience 개발실 담	한양대(석사)	계열회사	
)	1010.00	7	J	임원	당임원	2091(1717)	임원	
21.71.71		1075.00	U 11 F		Mobile eXperience CX실 담당		¬ ¬ (((+)))	계열회사	
김정현	남	1975.06	무사상	상근	임원	무선 기획팀 담당임원	고려대(학사)	임원	
					글로벌 제조&인프라총괄			계열회사	
김종헌	남	1966.08	부사장	상근	People팀장	Foundry 인사팀장	육사(학사)	임원	
					Mobile eXperience 품질혁신센	Mobile eXperience 개발실 담		계열회사	
김주년	남	1969.12	부사장	상근		·	성균관대(석사)		
					터장	당임원		임원	
김준석	남	1969.04	부사장	상근	System LSI SOC사업팀 담당임	System LSI SOC개발실 담당임	Stanford Univ.(박사)	계열회사	
			–		원	원		임원	
71.55.13		1070 11	нит		제조&기술담당 Common	제조&기술담당 메모리제조기술	± .1. 1 /H1 .11\	계열회사	
김중정	남	1973.11	무사상	상근	Tech센터 담당임원	센터 담당임원	東北大(박사)	임원	
								계열회사	
김진수	남	1971.10	부사장	상근	디자인경영센터 담당임원	무선 디자인팀 담당임원	국민대(학사)	임원	
						Mobile eXperience 전략마케팅		계열회사	
김창업	남	1969.08	부사장	상근	SEDA-S판매부문장	·	한양대(학사)		
						실 담당임원		임원	
김철기	남	1968.03	부사장	상근	영상디스플레이 영상전략마케	Mobile eXperience 전략마케팅	경북대(학사)	계열회사	
					팅팀장	실 담당임원		임원	
21015	1.4	1000.04	ᆸᆈᅑ	상근	제조&기술담당 메모리제조기술	글로벌인프라총괄 메모리제조	11011/4111	계열회사	
김태훈	남	1969.04	구사성	8 L	센터 담당임원	기술센터 담당임원	서울대(박사)	임원	
								계열회사	
김평진	남	1973.12	부사장	상근	법무실 담당임원	법무실 수석변호사	연세대(학사)	임원	
					Mobile eXperience 개발실 담		Univ. of Massachusetts,	계열회사	
김학상	남	1966.09	부사장	상근	당임원	무선 개발2실 담당임원	Lowell(박사)	임원	
						그글버이프기호교 이프기기스	Lowell(¬NI)		
김한석	남	1968.07	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프	글로벌인프라총괄 인프라기술	인하대(학사)	계열회사	
					라기술센터 담당임원	센터 담당임원		임원	
김현도	남	1966.04	부사장	상근	Mobile eXperience 구미지원센	생활가전 광주지원센터장	연세대(석사)	계열회사	
)	1000.01	7	J	터장	SETTE STATELAND	Constitution (1747)	임원	
71-10		1070.00	J		DS부문 CTO 반도체연구소 기	반도체연구소 공정개발실 담당		계열회사	
김현우	남	1970.02	무사상	상근	술기획팀장	임원	한국과학기술원(박사)	임원	
								계열회사	
김형로	남	1973.01	부사장	상근	영상디스플레이 People팀장	인사팀 담당임원	고려대(학사)	임원	31
								계열회사	
김홍경	남	1965.11	부사장	상근	DS부문 경영지원실장	DS부문 경영지원실 담당임원	한국과학기술원(석사)		
								임원	
김홍식	남	1969.09	부사장	상근	제조&기술담당 Foundry제조기	글로벌 제조&인프라총괄 메모	인하대(학사)	계열회사	
					술센터 담당임원	리제조기술센터 담당임원	,,	임원	
11718		1000 00	нить	, L ¬	D	011151 [[[[0]]]	¬¬¬ (/≈ ,)	계열회사	
나기홍	남	1966.03	무사상	상근	People팀장	인사팀 담당임원	고려대(학사)	임원	
								계열회사	
노원일	남	1967.08	부사장	상근	SRA연구소장	네트워크 상품전략팀장	Stanford Univ.(박사)	임원	
							The Johns Hopkins	계열회사	
다니엘오	남	1974.03	부사장	상근	IR팀장	IR팀 담당임원	·		29
							Univ.(석사)	임원	
더못라이	남	1962.09	부사장	상근	DS부문 DSE총괄	DS부문 구주총괄 담당임원	Limerick Regional	계열회사	
언							Technical Coll.(학사)	임원	
데이브다	남	1075.00	ᆸᄱᅑ	At コ	오트시 다다이의	SEIBH 01 자	Northwestern Unit (MU)	계열회사	
스	10	1975.06	무사(성	상근	SEA 담당임원	SEIB법인장	Northwestern Univ.(석사)	임원	
		l	I	<u> </u>	1	ı	1		

								게여하니	
데이빗리	남	1969.07	부사장	상근	Samsung NEXT장	Refactor Capital, Co-founder	New York Univ.(석사)	계열회사 임원	41
도현호	남	1967.10	부사장	상근	DS부문 CTO 설비기술연구소 설비개발실 담당임원	Applied Materials, Managing Director	서울대(박사)	계열회사 임원	28
디페쉬	żo	1969.06	부사장	상근	SRI-Bangalore연구소장	SRI-Bangalore 副연구소장	Indian Inst. of Management, Bangalore(석사)	계열회사 임원	
류경동	늄	1970.01	부사장	상근	SAIT System Research Center장	SAIT 담당임원	Univ. of Maryland, College Park(박사)	계열회사 임원	10
린준청	'n	1970.07	부사장	상근	AVP사업팀 AVP개발실 담당임 원	Skytech, CEO	NTUST(박사)	계열회사 임원	18
HIPE40 크	山	1973.02	부사장	상근	북미총괄 대외협력팀장	YouTube, APAC 대외협력총괄	Stanford Univ.(석사)	계열회사 임원	28
메노	남	1968.06	부사장	상근	SEF법인장	SEBN법인장	Haarlem Business School(학사)	계열회사 임원	
명호석	남	1967.04	부사장	상근	SEA 담당임원	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원	중앙대(학사)	계열회사 임원	
문성우	남	1971.12	부사장	상근	경영혁신센터장	경영혁신센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
문성훈	남	1974.09	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	무선 개발실 담당부장	경북대(박사)	계열회사 임원	
문승도	남	1968.10	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	무선 개발1실 담당임원	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	
문종승	남	1971.08	부사장	상근	생활가전 개발팀장	생산기술연구소장	Georgia Inst. of Tech.(박 사)	계열회사 임원	
문준	남	1974.06	부사장	상근	네트워크 개발팀장	네트워크 개발팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
문창록	남	1971.01	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 CIS TD팀장	System LSI Sensor사업팀 담당 임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
문희동	남	1971.07	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	종합기술원 인사팀장	한양대(학사)	계열회사 임원	
민종술	남	1968.03	부사장	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임 원	영상디스플레이 Micro LED팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
바우만	남	1966.05	부사장	상근	Mobile eXperience 전략마케팅 실 담당임원	SEUK법인장	Univ. of Bath(석사)	계열회사 임원	
박건태	남	1969.09	부사장	상근	Mobile eXperience 구매팀 담 당임원	감사팀 담당부장	Univ. of Colorado, Boulder(석사)	계열회사 임원	
박문호	남	1965.01	부사장	상근	People팀 담당임원	경영진단팀 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
박상권	남	1971.07	부사장	상근	DS부문 커뮤니케이션팀장	커뮤니케이션팀 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	40
박성욱	남	1972.04	부사장	상근	SCS법인장	글로벌 제조&인프라총괄 메모 리제조기술센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
박성준	남	1971.01	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공 정개발실 담당임원	종합기술원 Material연구센터 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
박성호	남	1968.09	부사장	상근	SEVT법인장	SIEL-P(N)공장장	경북대(석사)	계열회사 임원	

							1		
박세근	남	1974.01	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 DRAM TD실 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당임원	성균관대(박사)	계열회사 임원	54
박수남	沾	1970.10	부사장	상근	DS부문 CTO 설비기술연구소 설비개발실장	설비기술연구소 설비개발실 담 당임원	Univ. of Minnesota, Minneapolis(박사)	계열회사 임원	
박순철	뱌	1966.07	부사장	상근	지원팀장	Mobile eXperience 지원팀장	연세대(학사)	계열회사 임원	
박정민	남	1972.03	부사장	상근	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀장	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	42
박정호	뱌	1971.09	부사장	상근	Compliance팀장	Compliance팀 담당임원	Michigan State Univ.(석사)	계열회사 임원	
박정훈	뱌	1969.10	부사장	상근	Samsung Research Visual Technology팀장	Samsung Research Media Research팀장	한양대(석사)	계열회사 임원	
박제민	남	1971.12	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소	글로벌 제조&인프라총괄 메모 리제조기술센터 당당임원	Univ. of California, Berkeley(박사)	계열회사 임원	
박종범	남	1969.02	부사장	상근	서남아총괄	SIEL-S 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
박지선	남	1974.09	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	SRA 담당임원	Univ. of Texas, Austin(박 사)	계열회사 임원	
박진영	여	1971.11	부사장	상근	DS부문 경영지원실 담당임원	DS부문 구매팀 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	
박찬우	남	1973.05	부사장	상근	한국총괄 B2B통합오퍼링센터 담당임원	생활가전 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
박찬훈	남	1962.04	부사장	상근	제조&기술담당 Foundry제조기 술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 담당 임원	電氣通信大學(박사)	계열회사 임원	
박철우	남	1971.10	부사장	상근	영상디스플레이 Customer Marketing팀장	Mattel, SVP	Harvard Univ.(석사)	계열회사 임원	59
박태상	남	1975.01	부사장	상근	SEVT 담당임원	생산기술연구소 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
박현정	남	1969.12	부사장	상근	DS부문 경영지원실 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	
박형원	남	1966.09	부사장	상근	System LSI Global Operation실장	System LSI 품질팀장	한양대(석사)	계열회사 임원	
반효동	남	1967.06	부사장	상근	제조&기술담당 메모리제조기술 센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
발라지	남	1969.09	부사장	상근	SSIR연구소장	SSIR VP	Birla Institute of Technology and Science, Pilani(석사)	계열회사 임원	
배광진	남	1968.02	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	무선 개발2실 담당임원	금오공대(학사)	계열회사 임원	
배상우	남	1970.10	부사장	상근	메모리 품질실장	메모리 품질보증실 담당임원	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	
배용철	남	1970.05	부사장	상근	메모리 상품기획실장	메모리 전략마케팅실 담당임원	Harvard Univ.(박사수료)	계열회사 임원	
배일환	남	1970.07	부사장	상근	People팀 담당임원	인사팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
백종수	뱌	1971.01	부사장	상근	신사업T/F장	지원팀 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	

서보철	남	1972.01	부사장	상근	Mobile eXperience Global운영	Mobile eXperience Global제조	동국대(학사)	계열회사												
W.T.5	0	1372.01	0	J	팀장	센터 담당임원	0 7 41(7 71)	임원												
иогт		1070.07	нин		00H [105] T	00HU 01T 771 V0	0. ((81.11)	계열회사	40											
서원주	남	1976.07	무사상	상근	DS부문 IP팀장	DS부문 미주총괄 VP	Stanford Univ.(박사)	임원	43											
					Mobile eXperience 전략마케팅		George Washington	계열회사												
서한석	남	1968.02	부사장	상근	실 담당임원	SEA 담당임원	Univ.(석사)	임원												
							S(1747)	계열회사												
서행룡	남	1967.09	부사장	상근	혁신센터 담당임원	DIT센터 담당임원	부산대(학사)													
								임원												
서형석	남	1968.02	부사장	상근	DS부문 DSC총괄	메모리 전략마케팅실 담당임원	연세대(석사)	계열회사												
								임원												
성덕용	남	1973.09	부사장	상근	DS부문 CTO 설비기술연구소	생산기술연구소 담당임원	Carnegie Mellon Univ.(박사	계열회사												
					담당임원)	임원												
성일경	남	1964.01	부사장	상근	구주총괄	영상디스플레이 영상전략마케	연세대(학사)	계열회사												
020		1304.01	T/110	0 _	T T G Z	팅팀장	전세대(독시)	임원												
							0	계열회사												
손성원	남	1969.02	부사장	상근	Mobile eXperience 지원팀장	북미총괄 지원팀장	연세대(석사)	임원												
					메모리 Design Platform개발실			계열회사												
손영수	남	1974.02	부사장	상근	- 장	메모리 DRAM개발실 담당임원	포항공대(박사)	임원												
					영상디스플레이 개발팀 담당임			계열회사												
손태용	남	1972.08	부사장	상근		영상디스플레이 Micro LED팀장	연세대(석사)													
					원			임원												
송기환	남	1970.07	부사장	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	서울대(박사)	계열회사												
								임원												
송두근	남	1968.07	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄	글로벌 제조&인프라총괄 글로	아주대(박사수료)	계열회사												
					EHS센터장	벌환경안전/인프라센터장	, , , , , , ,	임원												
송명주	여	1970.02	브사자	디지다	디시자	디시자	비시자	니시자	브사자	부사작	부사장	부사장	부사장	부사장	상근	글로벌마케팅실 글로벌브랜드	TSE-S법인장	서강대(석사)	계열회사	
00T	ч	1970.02	T/110	0 _	센터 담당임원	100 0000	Nou(\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)	임원												
					Foundry Corporate Planning실			계열회사												
송병무	남	1973.08	부사상	상근	- 담당임원	Intel, Yield Group Manager	Cornell Univ.(박사)	임원												
					제조&기술담당 AVP제조기술센			계열회사												
송승엽	남	1968.08	부사장	상근	 터장	TSP총괄 TP센터장	성균관대(학사)	임원												
						메모리 Solution개발실 담당임	Univ. of Southern	계열회사												
송용호	남	1967.04	부사장	상근	메모리 Solution개발실장	원														
							California(박사)	임원												
송철섭	남	1967.12	부사장	상근	DS부문 DSC 담당임원	Foundry Corporate Planning실	인하대(학사)	계열회사												
						담당임원		임원												
송호건	남	1966.01	부사장	상근	TSP총괄 Package개발실장	TSP총괄 TP센터 담당임원	Univ. of California,	계열회사												
					<u> </u>		Berkeley(박사)	임원												
신경섭	남	1968.09	부사장	상근	제조&기술담당 메모리제조기술	제조담당 메모리제조기술센터	Univ. of California,	계열회사												
		1000.03	1 /110	5 _	센터장	담당임원	Berkeley(박사)	임원												
UM-		1005.01	нит		HIDALELOO	HIDEL CLCIOLO	O-hardin III (IIII)	계열회사												
신명훈	남	1965.01	부사장	상근	법무실 담당임원	법무팀 담당임원	Columbia Univ.(석사)	임원												
						Mobile eXperience 개발실 담		계열회사												
신승원	남	1974.09	부사장	상근	디바이스플랫폼센터 담당임원	당임원	Texas A&M Univ.(박사)	임원	42											
						Foundry Corporate Planning실		계열회사												
신승철	남	1973.04	부사장	상근	DS부문 DSSEA총괄	담당임원	연세대(학사)	임원												
					Mobile oversees 711H-ALCL		Polytochnia Univ. of NIV/HL													
신승혁	남	1968.01	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담	Samsung Research IP출원팀	Polytechnic Univ. of NY(박	계열회사												
					당임원	장	사)	임원												
신영주	남	1969.09	부사장	상근	DS부문 경영지원실 담당임원	메모리제조기술센터 담당임원	Purdue Univ.(박사)	계열회사												
								임원												

신유균	남	1965.02	부사장	상근	DS부문 CTO 담당임원	반도체연구소 차세대연ㄱ누실 장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
신정규	남	1969.12	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄	글로벌 제조&인프라총괄 인프	Technical Univ. of	계열회사	10
					EHS/인프라기술연구소장	라기술센터 담당임원	Munich(박사)	임원	
신종신	남	1973.12	부사장	상근	Foundry Design Platform개발 실 담당임원	Foundry 기술개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
신현진	남	1971.01	부사장	상근	Mobile eXperience People팀 장	영상디스플레이 People팀장	경북대(학사)	계열회사 임원	
심상필	남	1965.05	부사장	상근	Foundry Corporate Planning실 장	Foundry 전략마케팅실장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
심재현	남	1972.01	부사장	상근	지원팀 담당임원	Mobile eXperience 지원팀 담 당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	
안길준	남	1969.01	부사장	상근	Mobile eXperience 담당임원	무선 개발실 담당임원	George Mason Univ.(박사)	계열회사 임원	
안상호	남	1965.03	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 TP센 터장	SESS법인장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
안수진	여	1969.12	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 차 세대연구실장	메모리 Flash개발실 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	
안유정	여	1974.08	부사장	상근	디자인경영센터 담당임원	Waymo, Head of Design	Illinois Inst. of Tech.(석사)	계열회사 임원	8
안재용	남	1968.08	부사장	상근	DS부문 감사팀 담당임원	DS부문 상생협력센터 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
안정착	뱌	1970.12	부사장	상근	DS부문 People팀 담당임원	System LSI Sensor사업팀 담당 임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	
양병덕	남	1971.03	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	Apple, Principal Engineer	연세대(박사)	계열회사 임원	
양세영	뱌	1975.08	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	Apple, Engineering Manager	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
양장규	남	1963.09	부사장	상근	DS부문 CTO 설비기술연구소장	생산기술연구소장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
양준호	남	1971.02	부사장	상근	생활가전 디자인팀장	Mobile eXperience CX실 담당 임원	세종대(학사)	계열회사 임원	
양혜순	여	1968.02	부사장	상근	생활가전 Global CS팀장	생활가전 상품전략팀장	Michigan State Univ.(박사)	계열회사 임원	
엄재훈	诒	1966.06	부사장	상근	상생협력센터장	DS부문 DS대외협력팀장	서강대(석사)	계열회사 임원	
여명구	남	1970.10	부사장	상근	DS부문 People팀 담당임원	조직문화개선T/F 담당임원	아주대(석사)	계열회사 임원	
여태정	남	1970.06	부사장	상근	전장사업팀 담당임원	전장사업팀 담당부장	서울대(박사)	계열회사 임원	
여형민	남	1971.06	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	삼성SDS, 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	
오문욱	남	1974.02	부사장	상근	혁신센터장	메모리 Solution개발실 담당임 원	서울대(석사)	계열회사 임원	
오재균	남	1972.02	부사장	상근	DS부문 지원팀장	System LSI 지원팀장	Univ. of Iowa(석사)	계열회사 임원	
오정석	남	1970.03	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	TSP총괄 지원팀장	淸華大(석사)	계열회사 임원	

						,			
오종훈	남	1969.10	부사장	상근	System LSI 지원팀장	메모리 지원팀장	Purdue Univ.(석사)	계열회사 임원	
오치오	남	1967.01	부사장	상근	한국총괄 B2B팀장	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	건국대(석사)	계열회사 임원	
오태영	남	1974.10	부사장	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사	
오화석	남	1972.02	부사장	상근	메모리 Solution개발실 담당임	메모리 Solution개발실 담당임	서강대(석사)	임원 계열회사	
					원	원		임원 계열회사	
왕통	남	1962.06	부사장	상근	중국전략협력실 담당임원	SCIC 담당임원	北京郵電大(학사)	임원	
우영돈	남	1974.01	부사장	상근	법무실 개인정보보호팀장	법무실 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	
원성근	남	1968.05	부사장	상근	제조&기술담당 Foundry제조기 술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 평택사업장 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	
원순재	남	1972.01	부사장	상근	메모리 Solution개발실 담당임 원	메모리 Solution개발실 수석	고려대(석사)	계열회사 임원	
원종현	남	1967.05	부사장	상근	감사팀장	영상디스플레이 지원팀장	성균관대(학사)	계열회사 임원	
위훈	남	1970.04	부사장	상근	생활가전 선행개발팀장	생활가전 개발팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
유규태	남	1975.02	부사장	상근	의료기기사업부장	의료기기 전략마케팅팀장	Cornell Univ.(박사)	계열회사 임원	19
유미영	여	1968.07	부사장	상근	생활가전 S/W개발팀장	영상디스플레이 개발팀 담당임 원	포항공대(석사)	계열회사 임원	
유병길	남	1970.09	부사장	상근	SEA 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅 실 담당임원	Univ. of Virginia(석사)	계열회사 임원	
유창식	남	1969.12	부사장	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	한양대, 교수	서울대(박사)	계열회사 임원	44
육근성	남	1968.08	부사장	상근	한국총괄 지원팀장	한국총괄 지원팀 담당임원	Indiana Univ., Bloomington(석사)	계열회사 임원	
윤석민	남	1971.02	부사장	상근	제조&기술담당 Foundry제조기 술센터 담당임원	설비기술연구소 설비개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	27
윤세승	남	1965.12	부사장	상근	Foundry Design Platform개발 실 담당임원	Qualcomm, Senior Director	연세대(학사)	계열회사 임원	26
윤영조	남	1975.02	부사장	상근	Global Public Affairs실 담당임 원	IR팀 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	51
윤인수	남	1974.11	부사장	상근	법무실 담당임원	법무팀 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	
윤장현	남	1968.12	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	무선 서비스사업실 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박 사)	계열회사 임원	
윤종덕	남	1969.04	부사장	상근	커뮤니케이션팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당부장	고려대(석사)	계열회사 임원	
윤주한	남	1970.05	부사장	상근	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	Univ. of California, Berkeley(석사)	계열회사 임원	
윤준오	남	1967.06	부사장	상근	전장사업팀장	기획팀 담당임원	건국대(학사)	계열회사 임원	
윤태양	남	1968.12	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄, CSO	글로벌 제조&인프라총괄 메모 리제조기술센터장	고려대(석사)	계열회사 임원	
						9/11/12/10		0.2	

						T	1		
윤하룡	妆	1971.12	부사장	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
					Mahila ayaarianaa 711HtAL Et				
이경우	늄	1969.04	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	무선 개발2실 수석	한양대(박사)	계열회사 임원	
								계열회사	
이계성	<u> 10</u>	1967.11	부사장	상근	법무실 해외법무팀장	구주총괄 대외협력팀장	St. Louis Univ.(석사)	임원	
0.1 7.1 7.1							-101511/-111	계열회사	
이광렬	늄	1969.02	부사장	상근	영상디스플레이 Global CS팀장	Global CS센터 담당임원	한양대(학사)	임원	
0170		1000.05	U 11 F1		T00 = 7	T00 = 71 T0	=1 > 511/=1 11)	계열회사	
이규열	妆	1966.05	부사장	상근	TSP총괄	TSP총괄 TP센터장	항공대(학사)	임원	
017.=		1070.00	нит		₹ 1 HICL CLCI QI QI	DIT HIEL ELELOLOI	ə 그 기 된 기 스 O / U . I . I	계열회사	
이근호	늄	1970.02	부사장	상근	혁신센터 담당임원	DIT센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	임원	
0.7.7	O.	1071 00	нит		DS부문 CTO 반도체연구소 공	반도체연구소 메모리 TD실 담	Z () (1) (1)	계열회사	
이금주	Й	1971.09	무사상	상근	정개발실 담당임원	당임원	중앙대(석사)	임원	
								계열회사	
이동근	늄	1971.08	부사장	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	한양대(박사)	임원	
							Univ. of California, San	계열회사	
이동기	늄	1969.05	부사장	상근	DS부문 People팀 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임원		임원	
							Diego(박사)		
이동우	늄	1967.06	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	메모리 지원팀장	경북대(학사)	계열회사	
								임원	
이무형	남	1970.02	부사장	상근	생활가전 CX팀장	생활가전 개발팀장	Purdue Univ.(박사)	계열회사	
VI T B	0	1370.02	T/110	0 _	8일기선 아이 8	경찰기단 개발급경	I didde oniv.(¬/i)	임원	
					Mobile eXperience Global제조			계열회사	
이병국	남	1965.11	부사장	상근	센터장	SEVT법인장	부산대(학사)	임원	
							Indiana Univ.,	계열회사	
이병원	남	1972.05	부사장	상근	IR팀 담당임원	기획재정부, 부이사관	Bloomington(석사)	임원	8
					영상디스플레이 영상전략마케	생활가전 전략마케팅팀 담당임	City Univ. of New York(석	계열회사	
이상도	ì	1969.03	부사장	상근	팅팀 담당임원	원	AF)	임원	
								계열회사	
이상우	남	1972.11	부사장	상근	법무실 담당임원	법무팀 담당임원	연세대(학사)	임원	
						영상디스플레이 지원팀 담당임		계열회사	
이상원	남	1971.07	부사장	상근	서남아총괄 지원팀장	원	Georgetown Univ.(석사)	임원	
						2			
이상주	山	1970.09	부사장	상근	구주총괄 대외협력팀장	법무실 담당임원	Harvard Univ.(석사)	계열회사	
								임원	
이상훈	남	1973.04	부사작	상근	제조&기술담당 Foundry제조기	Intel, Sr. Principal Engineer	Univ. of California,	계열회사	23
2 0 F			1 /1 0	5	술센터 담당임원		Berkeley(박사)	임원	
01.1.	, .	10==			DS부문 CTO 설비기술연구소			계열회사	
이석원	남	1970.07	부사장	상근	담당임원	생산기술연구소 담당임원 	서울대(박사)	임원	
								계열회사	
이석준	늄	1965.07	부사장	상근	System LSI 담당임원	System LSI AP개발실장	한국과학기술원(박사)		
								임원	
이승구	山	1969.08	부사장	상근	People팀 담당임원	SEG 담당임원	성균관대(학사)	계열회사	
								임원	
미스며	나	1069.00	브시자	사그	아프리카총괄	SEINI—S버이자	선송대(화사)	계열회사	
이승엽	Ť0	1968.08	부사장	상근	VI 그니기중필	SEIN-S법인장	서울대(학사)	임원	
								계열회사	
이승재	남	1974.08	부사장	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 담당임원	서울대(석사)	임원	
					Mobile eXperience 개발실 담			계열회사	
이시영	남	1972.04	부사장	상근	·	무선 개발실 담당임원	Univ. of Sussex(석사)		
					당임원			임원	

		1				1	1		
이양우	남	1972.02	부사장	상근	영상디스플레이 담당임원	KNOWCK, 공동대표	Univ. of Colorado, Boulder(석사)	계열회사 임원	40
이영수	남	1972.01	부사장	상근	생산기술연구소장	SEVT 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
이영웅	남	1969.07	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프 라기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 담당 임원	MIT(박사)	계열회사 임원	15
이영호	남	1967.07	부사장	상근	중국사업혁신팀장	무선 전략마케팅실 담당임원	Univ. of Maryland, College Park(석사)	계열회사 임원	
이왕익	남	1963.07	부사장	상근	재경팀 담당임원	삼성생명, 지원팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
이우섭	남	1966.05	부사장	상근	Mobile eXperience 구매팀장	무선 구매팀 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
이원준	남	1970.02	부사장	상근	재경팀 담당임원	중동총괄 지원팀장	연세대(학사)	계열회사 임원	
이일환	남	1973.09	부사장	상근	Mobile eXperience CX실 담당 임원	Mercedez-Benz, CDO of China	Art Center College Of Design(학사)	계열회사 임원	19
이재범	남	1970.10	부사장	상근	생활가전 기획팀장	영상디스플레이 기획팀장	홍익대(학사)	계열회사 임원	
이재열	남	1970.01	부사장	상근	System LSI LSI사업팀장	System LSI LSI개발실장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
이정삼	남	1967.06	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 TP센 터 담당임원	TSP총괄 Global운영팀장	인하대(학사)	계열회사 임원	
이정원	남	1977.04	부사장	상근	System LSI SOC사업팀 담당임 원	System LSI SOC개발실 담당임 원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	42
이정환	남	1971.05	부사장	상근	DS부문 법무실장	DS부문 법무지원팀장	서울대(학사)	계열회사 임원	18
이제석	남	1969.01	부사장	상근	System LSI Sensor사업팀 담당 임원	System LSI Sensor사업팀 담당 임원	연세대(석사)	계열회사 임원	9
이제현	남	1970.04	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	삼성디스플레이 경영지원실 담 당임원	광운대(학사)	계열회사 임원	
이종명	남	1970.03	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공 정개발실장	반도체연구소 공정개발실 담당 임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
이종민	남	1971.09	부사장	상근	글로벌마케팅실 CX·MDE센터 장	디바이스플랫폼센터 담당임원	Illinois Inst. of Tech.(석사)	계열회사 임원	
이종열	남	1970.02	부사장	상근	System LSI SOC사업팀장	혁신센터장	서울대(박사)	계열회사 임원	
이종호	남	1968.01	부사장	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조 기술센터 당당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
이주영	남	1966.07	부사장	상근	메모리 담당임원	메모리 DRAM개발실장	Univ. of California, LA(박 사)	계열회사 임원	
이주형	남	1972.08	부사장	상근	Samsung Research Global AI센터 담당임원	Samsung Research AI센터 담 당임원	Univ. of Texas, Austin(박 사)	계열회사 임원	58
이준현	남	1965.05	부사장	상근	Samsung Research Life Solution팀장	Samsung Research 차세대가 전연구팀장	Univ. of Cincinnati(박사)	계열회사 임원	
이준화	남	1972.03	부사장	상근	Global EHS실장	생활가전 CX팀장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
이준희	남	1969.03	부사장	상근	네트워크 전략마케팅팀장	네트워크 개발팀장	MIT(박사)	계열회사 임원	

이지별	남	1971.03	부사장	상근	글로벌마케팅실 글로벌브랜드	Meta, Creative Director	Parsons School of	계열회사	23
			, , o		센터 담당임원		Design(학사)	임원	
이진엽	남	1970.02	보사장	상근	DS부문 감사팀장	메모리 Flash개발실 담당임원	서강대(석사)	계열회사	
VI C B		1070.02	1710	0	0012 07100	5/125/ Na5///22 0300	NOGI(INI)	임원	
01 71 4		1071 07	нит	, L _			거 된 대/문니)	계열회사	
이창수	남	1971.07	부사장	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원 	메모리 전략마케팅팀 담당임원 	경희대(학사)	임원	
						Mobile eXperience 전략마케팅		계열회사	
이청용	남	1968.12	부사장	상근	SAVINA-S법인장 	실 담당임원	MIT(석사)	임원	
						영상디스플레이 영상전략마케		계열회사	
이충순	남	1967.09	부사장	상근	CIS총괄	팅팀 담당임원	고려대(학사)	임원	
							George Washington	계열회사	
이태관	남	1971.12	부사장	상근	법무실 담당임원	삼성물산, 법무팀 담당임원	Univ.(석사)	임원	
							Offiv.(¬∧r)	계열회사	
이학민	남	1972.04	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	네트워크 지원팀장	서울대(석사)		
								임원	
이한관	남	1971.09	부사장	상근	SRA 담당임원	TSP총괄 인사팀장	성균관대(석사)	계열회사	
								임원	
이해창	남	1975.10	부사장	상근	System LSI Sensor사업팀 담당	Google, Sensor Team Lead	Stanford Univ.(박사)	계열회사	45
					임원	-		임원	
이헌	남	1969.02	부사장	상근	SEIN-S법인장	영상디스플레이 영상전략마케	Syracuse Univ.(석사)	계열회사	
VI C		1505.02	1 / 10	J	OLIN OBLIS	팅팀 담당임원	Gyraedse oniv.(¬/ii)	임원	
01=1		1071 01	HIIH	, L _	Mobile eXperience 전략마케팅	055 51510101	Dules 11-1: (H 11)	계열회사	
이헌	남	1971.01	부사장	상근	실 담당임원	SEF 담당임원	Duke Univ.(석사)	임원	
						Global Public Affairs팀 담당임	Univ. of Texas, Austin(석	계열회사	
이형우	남	1970.03	부사장	상근	북미총괄 담당임원 	원	At)	임원	
					DS부문 CTO 반도체연구소	DS부문 CTO 반도체연구소		계열회사	
임건	남	1970.03	부사장	상근	Logic TD실 담당임원	Logic TD실 담당임원	Stanford Univ.(박사)	임원	52
								계열회사	
임병일	남	1970.01	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	삼성증권, 기업금융1본부장	Univ. of Chicago(석사)	임원	31
						System LSI 기반설계실 담당임		계열회사	
임석환	남	1974.11	부사장	상근	DSRA-S.LSI 연구소장	원	Stanford Univ.(박사)	임원	
								계열회사	
임성택	남	1966.06	부사장	상근	한국총괄	중동총괄	연세대(학사)		
								임원	
임성택	남	1970.10	부사장	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 C&M사업팀장	서울대(박사)	계열회사	
								임원	
임용식	남	1971.01	부사장	상근	제조&기술담당 메모리제조기술 	메모리 Flash개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사	
					센터 담당임원			임원	
장상익	남	1968.07	부사장	상근	영상디스플레이 구매팀장	영상디스플레이 구매팀 담당임	경북대(학사)	계열회사	
		, 555.07	, , , 0)	339-297 19100	원	5 191(1717)	임원	
장성환	남	1071 07	ᆸᇨᅑ	상근	Mobile eXperience 마케팅팀	Interpublic Croup, EVP	Columbia Univ (MU)	계열회사	1
긍정환	10	1971.07	무시(성	づご	담당임원	Interpublic Group, EVP	Columbia Univ.(석사)	임원	'
TLUI C		1000.01	нит	41.	JI SI FI TL	JISIEI ELELOLOI	Case Western Reserve	계열회사	10
장세명	남	1968.01	부사장	상근	기획팀장 	기획팀 담당임원	Univ.(박사)	임원	19
						무선 차세대플랫폼센터 담당임	Univ. of California,	계열회사	
장우승	남	1970.02	부사장	상근	Big Data센터장	원	Berkeley(박사)	임원	
					DS부문 CTO 반도체연구소	반도체연구소 메모리 TD실 담		계열회사	
장재훈	남	1969.07	부사장	상근	Flash TD실장	당임원	한국과학기술원(박사)	임원	
						네트워크 Global운영팀 담당임		계열회사	
장호영	남	1968.01	부사장	상근	네트워크 구매팀장		경북대(학사)	임원	
						원		김전	

		1			T	T	T		1
장호진	тo	1970.09	부사장	상근	법무실 IP센터 담당임원	법무실 IP센터 책임변호사	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	
전경빈	남	1966.12	부사장	상근	Global CS센터장	로봇사업팀장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
전상욱	남	1971.01	부사장	상근	Mobile eXperience 전략기획팀 장	삼성글로벌리서치, 글로벌전략 실 담당임원	Washington, Seattle(석사)	계열회사 임원	19
전신애	여	1973.08	부사장	상근	SAIT Material Research Center장	SAIT Material Research Center 담당Master	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	7
전필규	늄	1968.11	부사장	상근	창의개발센터장	삼성경제연구소, 리더십팀장	Helsinki Sch. Of Economics & Business Administration(석사)	계열회사 임원	7
정기봉	남	1970.01	부사장	상근	DS부문 DSA 담당임원	Foundry Corporate Planning실 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	43
정기태	남	1965.09	부사장	상근	Foundry 담당임원	Foundry CTO	서울대(박사)	계열회사 임원	
정상섭	남	1966.11	부사장	상근	제조&기술담당 Foundry제조기 술센터장	SAS법인장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
정성택	남	1976.09	부사장	상근	미래사업기획단 담당임원	신사업T/F장	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	23
정용준	남	1969.10	부사장	상근	Foundry 품질팀장	Foundry Corporate Planning실 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
정윤	남	1967.05	부사장	상근	Mobile eXperience 전략마케팅 실장	SEA 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
정재연	여	1974.09	부사장	상근	디바이스플랫폼센터 담당임원	Mobile eXperience 모바일플랫 폼센터 담당임원	MIT(박사)	계열회사 임원	
정재욱	남	1976.07	부사장	상근	Samsung Research Global AI센터 담당임원	Apple, Sr. Engineering Mgr	Univ. of Waterloo(박사)	계열회사 임원	20
정진국	남	1975.10	부사장	상근	Samsung Research 차세대통 신연구센터 담당임원	Samsung Research 차세대통 신연구센터 담당임원	서강대(박사)	계열회사 임원	
정진민	남	1972.12	부사장	상근	Samsung Research S/W혁신 센터장	Samsung Research Platform팀장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
정혁준	남	1972.05	부사장	상근	System LSI SOC사업팀 담당임 원	System LSI SOC개발실 담당임 원	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	43
정현준	남	1964.06	부사장	상근	생활가전 Global제조팀장	영상디스플레이 Micro LED팀장	한양대(학사)	계열회사 임원	
정혜순	여	1975.12	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	무선 개발1실 수석	부산대(학사)	계열회사 임원	
정호진	남	1971.05	부사장	상근	한국총괄 MX팀장	한국총괄 CE영업팀장	Rutgers Univ.(석사)	계열회사 임원	
정훈	Ì0	1969.01	부사장	상근	영상디스플레이 Enterprise Business팀장	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	홍익대(학사)	계열회사 임원	
조기열	ÌO	1971.03	부사장	상근	법무실 법무팀장	삼성디스플레이, 법무실장	경찰대(학사)	계열회사 임원	7
조기재	남	1967.01	부사장	상근	메모리 지원팀장	DS부문 지원팀장	Babson College(석사)	계열회사 임원	
조명호	남	1969.05	부사장	상근	영상디스플레이 기획팀장	영상디스플레이 개발팀 담당임 원	연세대(석사)	계열회사 임원	

조상연	心	1971.12	부사장	상근	DS부문 DSA 담당임원	메모리 Solution개발실 담당임	Univ. of Minnesota, Twin	계열회사	
						원	Cities(박사)	임원	
조상호	남	1965.02	부사장	상근	동남아총괄	구주총괄	경희대(학사)	계열회사 임원	
조성대	남	1969.06	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	무선 개발1실 담당임원	RPI(박사)	계열회사 임원	
						Mobile eXperience 전략마케팅	Univ. of California,	계열회사	
조성혁	남	1970.05	부사장	상근	중동총괄	실 담당임원	Berkeley(석사)	임원	
조성훈	남	1970.11	부사장	상근	SEA 담당임원	경영혁신센터 담당임원	건국대(박사)	계열회사 임원	
조시정	남	1969.11	부사장	상근	People팀 담당임원	Mobile eXperience 인사팀장	경희대(학사)	계열회사 임원	
조영준	뱌	1971.05	부사장	상근	북미총괄 People팀장	네트워크 인사팀장	성균관대(학사)	계열회사 임원	
조웅	남	1972.08	부사장	상근	법무실 담당임원	삼성SDI, 법무팀장	한양대(학사)	계열회사 임원	27
조인하	여	1974.02	부사장	상근	SEUK법인장	SENA법인장	서강대(석사)	계열회사 임원	
조필주	남	1971.07	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 지원 팀장	종합기술원 기획지원팀장	서울대(박사)	계열회사 임원	
조학주	남	1969.03	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 Logic TD실 담당임원	Foundry 기술개발실 담당임원	Univ. of Texas, Austin(박 사)	계열회사 임원	
조홍상	남	1966.06	부사장	상근	중남미총괄	SEF법인장	연세대(학사)	계열회사 임원	
주영수	남	1965.08	부사장	상근	성균관대(파견)	삼성생명서비스, 고객지원실 담 당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	54
주창훈	남	1970.10	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	인사팀 담당임원	아주대(석사)	계열회사 임원	
지현기	남	1968.01	부사장	상근	DS부문 상생협력센터장	메모리 기획팀장	Univ. of Illinois, Urbana- Champaign(석사)	계열회사 임원	
짐엘리엇	남	1970.11	부사장	상근	DS부문 DSA 담당임원	미주총괄 VP	California Polytechnic State Univ.(학사)	계열회사 임원	
차경환	남	1972.04	부사장	상근	영상디스플레이 영상전략마케 팅팀 담당임원	SEAU법인장	Univ. of California, Berkeley(석사)	계열회사 임원	
차병석	늄	1968.11	부사장	상근	커뮤니케이션팀 담당임원	삼성경제연구소, 연구조정실 담 당임원	Helsinki Sch. Of Economics & Business Administration(석사)	계열회사 임원	34
채원철	남	1966.05	부사장	상근	Mobile eXperience Digital Wallet팀장	Mobile eXperience CX실 담당 임원	광운대(학사)	계열회사 임원	
최경세	남	1969.04	부사장	상근	AVP사업팀 AVP개발실장	TSP총괄 Package개발실장	서울대(박사)	계열회사 임원	
최광보	남	1971.03	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	북미총괄 지원팀장	부산대(학사)	계열회사 임원	
최동준	남	1972.05	부사장	상근	글로벌마케팅실 D2C센터 담당 임원	글로벌마케팅센터 담당임원	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	
최성현	남	1970.05	부사장	상근	 네트워크 선행개발팀장	Samsung Research 차세대통	Univ. of Michigan, Ann	계열회사	58

		I						1	ı
최순	남	1970.10	부사장	상근	SIEL-S 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅	Duke Univ.(석사)	계열회사	
						실 담당임원		임원	
최승범	남	1964.12	부사장	상근	- - - 디바이스플랫폼센터장	Samsung Research 기술전략	한국과학기술원(석사)	계열회사	
400		1001.12	1740	J	4444	팀장	C 131 151 E C (101)	임원	
=1.4.11		1000 01	I		조그 주 괴		¬ ¬ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;	계열회사	
최승식	남	1966.01	부사장	상근	중국총괄	무선 전략마케팅실 담당임원	고려대(학사)	임원	
								계열회사	
최승은	여	1969.07	부사장	상근	Mobile eXperience 마케팅팀장	무선 GDC센터 담당임원	서강대(석사)	임원	
								계열회사	
최승훈	남	1970.10	부사장	상근	상생협력센터 담당임원	삼성생명, 기획팀장	성균관대(석사)		19
								임원	
최완우	남	1965.02	부사장	상근	DS부문 People팀장	메모리 인사팀장	서강대(학사)	계열회사	
								임원	
최용원	남	1968.05	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프	DS부문 CTO 설비기술연구소	고려대(석사)	계열회사	
400		1300.03	1 / 10	0 _	라설비자동화T/F장	설비개발실장	포이대(국사)	임원	
- 0 -						영상디스플레이 Global운영팀	= 2150/-1112	계열회사	
최용훈	남	1969.07	부사장	상근	영상디스플레이 담당임원	장	고려대(학사)	임원	
						Mobile eXperience 개발실 담		계열회사	
최원준	남	1970.09	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실장	당임원	Stanford Univ.(박사)	임원	
						000		계열회사	
최윤준	남	1967.09	부사장	상근	CSS사업팀장	LED사업팀 담당임원	MIT(박사)		
								임원	
최익수	남	1967.05	부사장	상근	생활가전 전략마케팅팀장	SESA법인장	Univ. of Illinois, Urbana-	계열회사	
							Champaign(석사)	임원	
뒨ᄌᇹ	남	1062.02	비니자	A1-7	베트나보하다기자	무선이사티자	이즈데(성 니)	계열회사	
최주호	ji	1963.03	무사성	상근	베트남복합단지장 	무선 인사팀장	아주대(석사)	임원	
								계열회사	
최진원	남	1966.09	부사장	상근	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	서울대(학사)	임원	
					DS부문 CTO 설비기술연구소			계열회사	
최진한	남	1973.05	부사장	상근	설비개발실 담당임원	AMAT, Managing Director	Univ. of Arizona(박사수료)	임원	20
최진혁	남	1967.02	부사장	상근	DSRA-Memory 연구소장	메모리 Solution개발실장	서울대(박사)	계열회사	
								임원	
최창규	남	1970.03	부사장	상근	SAIT AI Research Center장	종합기술원 AI&SW연구센터장	한국과학기술원(박사)	계열회사	
			, . , 0			30,120,120,121,0		임원	
패트릭쇼	남	1064.05	비니자	A1-7	Mahila aynarianaa OVALTI	무선 서비스사업실 담당임원	Institut d administration	계열회사	
메	10	1964.05	구사성	상근	Mobile eXperience CX실장	구선 서비스사업을 임성임권	des entreprises(석사)	임원	
							Univ. of Texas, Austin(박	계열회사	
편정우	남	1970.10	부사장	상근	메모리 품질실 담당임원	메모리 품질보증실 수석	۸ ۱)	임원	
						System LSI 전략마케팅실 담당		계열회사	
피재걸	남	1964.04	부사장	상근	System LSI 전략마케팅실장	임원	서울대(석사)	임원	
					Mobile oversiones IIIII				
한상숙	여	1966.07	부사장	상근	Mobile eXperience 서비스	영상디스플레이 Service	Northwestern Univ.(석사)	계열회사	
					Biz팀장	Business팀 담당임원		임원	
한진만	남	1966.10	부사장	상근	DS부문 DSA총괄	메모리 전략마케팅실장	서울대(학사)	계열회사	
			0					임원	
들기대		1005.00	шлт	,¬		סט דוואפן רגרוטיטי	이즈대(성 사)	계열회사	
허길영	남	1965.08	누사상	상근	DS부문 재경팀장	DS부문 재경팀 담당임원	아주대(석사)	임원	
								계열회사	
허석	남	1973.10	부사장	상근	DS부문 People팀 담당임원	DS부문 기획팀장	Stanford Univ.(박사)	임원	
								계열회사	
허성회	남	1969.01	부사장	상근	메모리 Flash개발실장	메모리 Flash개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)		
								임원	

					1				
현상진	남	1972.02	부사장	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 차	DS부문 CTO 반도체연구소 공	서울대(박사)	계열회사	
		1012.02	1 / 10	J	세대공정개발실장	정개발실 담당임원	Near(¬N)	임원	
홍경선	남	1970.08	H 11 74	상근	커뮤니케이션팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당부장	하그게하기스의(서 티)	계열회사	
동경신	10	1970.06	구사성	77 T	기류니케이신암 음양암권	기류니케이신임 임성구성	한국과학기술원(석사) 	임원	
							=101511(=1.11)	계열회사	
홍기채	남	1969.06	무사상	상근	법무실 담당임원	법무법인 다전, 변호사	한양대(학사)	임원	36
					한국총괄 B2B통합오퍼링센터			계열회사	
홍범석	남	1968.06	부사장	상근	장	아프리카총괄	중앙대(학사)	임원	
								계열회사	
홍석준	남	1970.07	부사장	상근	CSS사업팀 담당임원	DS부문 담당임원	서울대(석사)	임원	13
							Univ. of Texas, Austin(석	계열회사	
홍성민	남	1969.06	부사장	상근	Foundry People팀장	글로벌인프라총괄 인사팀장	At)	임원	
							\(\frac{1}{2}\)	계열회사	
홍성희	남	1966.02	부사장	상근	DS부문 구매팀 담당임원	DS부문 일본총괄 담당임원	서강대(학사)		
						W.C. = 10.7		임원	
홍승완	남	1971.06	부사장	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	반도체연구소 메모리 TD실 담	서울대(석사)	계열회사	
						당임원		임원	
홍영기	남	1970.03	부사장	상근	제조&기술담당 Foundry제조기	Foundry 기술개발실 담당임원	Imperial College(박사)	계열회사	
					술센터 담당임원			임원	
홍유진	여	1972.05	부사장	상근	디자인경영센터 담당임원	Mobile eXperience CX실 담당	Univ. of California, LA(석	계열회사	
						임원	٨t)	임원	
황경순	남	1968.08	부사장	상근	SAIT Air Science Research	UT Austin, 교수	Caltech(박사)	계열회사	13
802		1000.00	1710	J	Center장	or Addin, in t	Saltson (1747)	임원	-
황기현	남	1967.06	ᆸᆡ자	상근	제조&기술담당 Common	제조담당 제조시너지팀장	서울대(박사)	계열회사	
8/10		1307.00	T/10	0 _	Tech센터장	제포함증 제포시디자함증	시설대(국제)	임원	
히시즈		1070.01	нит	417			¬ → c /HL /)	계열회사	
황상준	남	1972.01	부사장	상근	메모리 DRAM개발실장	메모리 전략마케팅실 담당임원	고려대(박사)	임원	
51.01.7					제조&기술담당 Foundry제조기		(5 ()	계열회사	
황완구	남	1972.02	무사상	상근	술센터 담당임원	삼성바이오로직스 담당임원	서울대(박사)	임원	31
					Mobile eXperience 개발실 담	Mobile eXperience 모바일플랫		계열회사	
황인철	남	1977.11	부사장	상근	당임원	품센터 담당임원 	한국과학기술원(박사)	임원	
								계열회사	
황태환	남	1968.04	부사장	상근	한국총괄 CE팀장	한국총괄 CE영업팀장	경희대(학사)	임원	
						제조&기술담당 메모리제조기술		계열회사	
황하섭	남	1964.03	부사장	상근	제조&기술담당 평택단지장	센터장	인하대(학사)	임원	
					DS부문 CTO 반도체연구소 공	반도체연구소 메모리 TD실 담		계열회사	
황희돈	남	1974.01	부사장	상근	정개발실 담당임원	당임원	서울대(박사)	임원	54
						System LSI 기반설계실 담당임		계열회사	
강건혁	남	1978.11	상무	상근	System LSI Design Platform개		Purdue Univ.(박사)		34
					발실 담당임원	원		임원	
강도희	남	1974.12	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담	무선 품질혁신센터 담당임원	경북대(석사)	계열회사	
					당임원			임원	
강동우	남	1971.04	상무	상근	제조&기술담당 AVP제조기술센	글로벌 제조&인프라총괄	한양대(석사)	계열회사	54
					터 담당임원	AVP제조기술센터장		임원	
강명진	남	1977.02	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	Foundry 기술개발실 수석	연세대(박사)	계열회사	19
			- '		.,		,,	임원	
강민석	남	1976.10	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당	무선 CX실 담당부장	서울대(석사)	계열회사	31
007		1070.10	9 F	9	임원	1 2 3/10 10	MEGIC 1/11/	임원	51
강병욱	남	1967.02	상무	상근	한국총괄 CE팀 담당임원	한국총괄 CE영업팀 담당부장	고려대(학사)	계열회사	54
001		1507.02	0 T	0 _			그의데(기시)	임원	J+
		•	•		•	•	•	•	

					1				
강보경	여	1976.12	상무	상근	System LSI Design Platform개 발실 담당임원	System LSI Design Platform개 발팀 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	19
강상용	to	1972.09	상무	상근	생활가전 지원팀 담당임원	전장사업팀 담당임원	Univ. of Pennsylvania(석사)	계열회사 임원	
강성욱	남	1971.05	상무	상근	지원팀 담당임원	SEUK 담당부장	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	54
강신광	남	1968.08	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 EHS센터 담당임원	글로벌인프라총괄 환경안전센 터 담당임원	아주대(석사)	계열회사 임원	39
강연호	남	1979.11	상무	상근	재경팀 담당임원	관세청, 부이사관	Univ. of York(석사)	계열회사 임원	12
강윤경	여	1968.12	상무	상근	People팀 담당임원	Samsung Research 창의개발 센터 담당임원	Univ. of Michigan, Ann Arbor(석사)	계열회사 임원	
강은경	여	1972.08	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임 원	영상디스플레이 개발팀 수석	성균관대(석사)	계열회사 임원	31
강정대	남	1970.09	상무	상근	재경팀 담당임원	상생협력센터 담당부장	한국방송통신대(학사)	계열회사 임원	
강진선	뱌	1975.09	상무	상근	한국총괄 CE팀 담당임원	한국총괄 CE영업팀 담당부장	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	31
강태형	뱌	1976.05	상무	상근	영상디스플레이 Customer Marketing팀 담당임원	Dell, Director	Univ. of Virginia(석사)	계열회사 임원	11
강혁	뱌	1984.10	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	생산기술연구소 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	19
강희성	남	1970.08	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조 기술센터 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	
고경민	남	1975.03	상무	상근	System LSI Sensor사업팀 담당 임원	System LSI LSI개발실 담당임 원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
고광현	남	1968.08	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	Intel, Senior Technical Staff	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
고상원	남	1979.11	상무	상근	영상디스플레이 구매팀 담당임 원	Flex, Sr. Director	Stanford Univ.(석사)	계열회사 임원	19
고승범	뱌	1971.07	상무	상근	메모리 품질실 담당임원	메모리 Design Platform개발실 담당임원	아주대(학사)	계열회사 임원	
고얄시드	남	1977.12	상무	상근	글로벌마케팅실 D2C센터 담당 임원	Accenture, Mng. Director	Univ. of Sydney(석사)	계열회사 임원	47
고영관	남	1972.06	상무	상근	TSP총괄 Package개발실 담당 임원	삼성전기 중앙연구소 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
고의중	남	1972.02	상무	상근	Compliance팀 담당임원	법무실 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	31
고정욱	남	1976.02	상무	상근	한국총괄 MX팀 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅 실 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	54
고주현	남	1974.08	상무	상근	System LSI Sensor사업팀 담당 임원	System LSI Sensor사업팀 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	43
고택균	남	1971.05	상무	상근	DS부문 DSC 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임원	서강대(학사)	계열회사 임원	43
고현목	남	1980.02	상무	상근	Samsung Research Global AI센터 담당임원	Samsung Research Global AI센터 수석	포항공대(박사)	계열회사 임원	7
고형석	남	1972.09	상무	상근	People팀 담당임원	SEA 담당임원	Case Western Reserve Univ.(석사)	계열회사 임원	

공병진	남	1971.09	상무	상근	SEM-P법인장	SIEL-P(C)공장장	항공대(학사)	계열회사 임원	43
곽원근	남	1973.07	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	Mobile eXperience 개발실 수	연세대(석사)	계열회사 임원	7
구관본	남	1975.01	상무	상근	System LSI LSI사업팀 담당임 원	System LSI LSI개발실 담당임 원	한국과학기술원(박사)	계열회사	36
구봉진	여	1971.05	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 차 세대공정개발실 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 공 정개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	43
구윤본	남	1970.02	상무	상근	제조&기술담당 담당임원	메모리 제조기술센터 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	
구자천	남	1981.04	상무	상근	사업지원T/F 담당임원	System LSI 기획팀장	Northwestern Univ.(박사)	계열회사 임원	57
권기덕	남	1972.07	상무	상근	제조&기술담당 메모리제조기술 센터 담당임원	SCS 담당임원	경북대(석사)	계열회사	
권기덕	여	1974.10	상무	상근	기획팀 담당임원	기획팀 담당부장	한국과학기술원(석사)	계열회사	43
권기덕	남	1977.10	상무	상근	법무실 담당임원	DS부문 법무지원팀 수석변호사	서울대(학사)	계열회사 임원	43
권기록	남	1974.07	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임 원	메모리 Solution개발실 수석	성균관대(박사)	계열회사 임원	8
권기성	남	1975.01	상무	상근	메모리 품질실 담당임원	메모리 품질실실 수석	인하대(학사)	계열회사 임원	8
권상욱	남	1968.08	상무	상근	Samsung Research Life Solution팀 담당임원	Samsung Research 차세대가 전연구팀 담당임원	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	
권순범	남	1976.09	상무	상근	법무실 담당임원	법무실 수석변호사	연세대(석사)	계열회사 임원	54
권영재	남	1972.05	상무	상근	Mobile eXperience 품질혁신센 터 담당임원	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	한양대(석사)	계열회사 임원	43
권영훈	남	1972.02	상무	상근	SEA 담당임원	네트워크 개발팀 당당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	36
권오겸	남	1977.08	상무	상근	제조&기술담당 Foundry제조기 술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조 기술센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	43
권욱	남	1978.07	상무	상근	글로벌마케팅실 D2C센터 담당 임원	Lazada, CMO	서울대(석사)	계열회사 임원	25
권정현	남	1980.03	상무	상근	Samsung Research Robot센 터 담당임원	NVIDIA, Senior S/W Engineering Manager	서울대(박사)	계열회사 임원	17
권춘기	남	1969.04	상무	상근	SEHC법인장	생활가전 Global제조팀 담당임 원	포항공대(학사)	계열회사 임원	43
권태훈	남	1971.02	상무	상근	SEA 담당임원	경영혁신센터 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	43
권혁만	뱌	1973.06	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임 원	System LSI 전략마케팅실 담당 임원	서울대(석사)	계열회사 임원	54
권혁우	늄	1973.07	상무	강	DX부문 Global Public Affair실 담당임원	산업통상자원부 과장	The Johns Hopkins Univ.(석사)	계열회사 임원	24
권형석	남	1973.02	상무	상근	System LSI 전략마케팅실 담당 임원	메모리 전략마케팅실 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	

				ı	1	ı	1		
권호범	남	1975.12	상무	상근	Samsung Research Platform팀장	Samsung Research Platform팀 담당임원	New York Univ., Tandon School of Engineering(석 사)	계열회사 임원	43
김강수	남	1966.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 EHS센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라QA팀 장	성균관대(학사)	계열회사 임원	
김건우	남	1976.01	상무	상근	SESK 담당임원	SEH-P 담당임원	MIT(석사)	계열회사 임원	31
김경륜	남	1983.02	상무	상근	메모리 상품기획실 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	31
김경준	남	1969.01	상무	상근	DS부문 DSA 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임원	광운대(학사)	계열회사 임원	
김경태	妆	1973.12	상무	상근	제조&기술담당 메모리제조기술 센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터 담당임원	부산대(학사)	계열회사 임원	43
김경태	남	1973.07	상무	상근	한국총괄 마케팅팀 담당임원	한국총괄 IMC팀 담당부장	성균관대(학사)	계열회사 임원	19
김경택	남	1975.05	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당 임원	Mobile eXperience CX실 수석	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	7
김광익	남	1974.09	상무	상근	DS부문 지원팀 담당임원	글로벌인프라총괄 평택사업장 담당부장	한양대(학사)	계열회사 임원	31
김광훈	남	1975.02	상무	상근	SEDA-P(C)공장장	Mobile eXperience Global제조 센터 담당부장	인하대(학사)	계열회사 임원	19
김구영	남	1975.03	상무	상근	AVP사업팀 AVP개발실 담당임 원	TSP총괄 Package개발실 수석	연세대(석사)	계열회사 임원	31
김기수	남	1970.02	상무	상근	제조&기술담당 평택단지 담당 임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조 기술센터 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
김기수	남	1976.05	상무	상근	제조&기술담당 Foundry제조기 술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	19
김기언	남	1972.06	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	DS부문 DSC 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	19
김기환	남	1975.03	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	NVIDIA, Principal Research Scientist	Georgia Inst. of Tech.(박 사)	계열회사 임원	51
김대신	남	1970.03	상무	상근	혁신센터 담당임원	DIT센터 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박 사)	계열회사 임원	
김대우	남	1970.03	상무	상근	AVP사업팀 AVP개발실 담당임 원	반도체연구소 Package개발팀 담당임원	연세대(박사)	계열회사 임원	
김대현	남	1974.08	상무	상근	SME법인장	Mobile eXperience 전략마케팅 실 담당부장	경북대(학사)	계열회사 임원	19
김덕헌	남	1975.06	상무	상근	상생협력센터 담당임원	메타볼라이트, Co-Founder	고려대(학사)	계열회사 임원	53
김덕호	남	1970.11	상무	상근	생활가전 S/W개발팀 담당임원	SRI-Delhi연구소장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	54
김도기	남	1975.05	상무	상근	DS부문 CTO People팀장	DS부문 CTO 반도체연구소 People팀장	숭실대(학사)	계열회사 임원	19
김동근	남	1976.07	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임 원	System LSI SOC개발실 수석	Univ. of Maryland, College Park(박사)	계열회사 임원	31
김동수	남	1975.10	상무	상근	DS부문 People팀 담당임원	DS부문 인사팀 담당부장	Univ. of Maryland, College Park(석사)	계열회사 임원	31

					,		1		
김동준	남	1973.05	상무	상근	제조&기술담당 담당임원	TSLED법인장	광주과학기술원(박사)	계열회사 임원	
김래훈	뱌	1975.07	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임 원	System LSI 기반설계실 담당임 원	Univ. of Illinois, Urbana- Champaign(박사)	계열회사 임원	39
김륭	뱌	1971.12	상무	상근	생활가전 People팀장	People팀 담당임원	중앙대(학사)	계열회사 임원	43
김명오	남	1972.09	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	연세대(석사)	계열회사 임원	43
김무성	뱌	1975.12	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	포항공대(석사)	계열회사 임원	31
김문수	뱌	1977.12	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임 원	SRI-Delhi연구소장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	43
김민우	ţ0	1978.06	상무	상근	TSE-S 담당임원	SESP법인장	한양대(학사)	계열회사 임원	43
김범준	남	1977.03	상무	상근	동남아총괄 지원팀장	사업지원T/F 담당부장	Univ. of California, LA(석 사)	계열회사 임원	7
김범진	남	1975.02	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅 실 담당임원	SEAU 담당임원	Southern Illinois Univ.(석사)	계열회사 임원	
김병승	남	1976.11	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임 원	메모리 품질실실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	8
김보성	남	1974.04	상무	상근	Samsung Research 담당임원	Awair, CDO	Royal Collge of Art(석사)	계열회사 임원	28
김보창	남	1977.09	상무	상근	제조&기술담당 메모리제조기술 센터 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	고려대(석사)	계열회사 임원	19
김봉수	남	1971.06	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 DRAM TD실 담당임원	반도체연구소 메모리 TD실 담 당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	43
김상윤	남	1972.01	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임 원	SECE법인장	인하대(학사)	계열회사 임원	43
김상현	남	1978.10	상무	상근	SEI 담당임원	SEB법인장	Univ. of Michigan, Ann Arbor(석사)	계열회사 임원	7
김석영	남	1973.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프 라기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 인프 라기술센터 수석	한양대(석사)	계열회사 임원	8
김석희	남	1971.11	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프 라기술센터 담당임원	제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원	부산대(석사)	계열회사 임원	43
김선기	남	1973.11	상무	상근	혁신센터 담당임원	월마트랩, Pr.Data Scientist	Virginia Tech(박사)	계열회사 임원	4
김선길	남	1974.11	상무	상근	생활가전 Global CS팀 담당임 원	생활가전 Global CS팀 담당부 장	전남대(학사)	계열회사 임원	19
김선정	남	1973.02	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공 정개발실 담당임원	제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원	National Univ. of Singapore(박사)	계열회사 임원	31
김성권	남	1971.02	상무	상근	디자인경영센터 담당임원	디자인경영센터 수석	홍익대(학사)	계열회사 임원	
김성민	남	1976.03	상무	상근	네트워크 지원팀장	영상디스플레이 지원팀 담당임 원	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	31
김성은	남	1968.11	상무	상근	Mobile eXperience 구매팀 담 당임원	무선 기술전략팀 담당임원	항공대(학사)	계열회사 임원	
김세진	여	1973.07	상무	상근	Mobile eXperience 마케팅팀 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅 실 담당부장	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	19

					Ī	T	<u> </u>	1	
김세훈	남	1975.01	상무	강	커뮤니케이션팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당부장	중앙대(학사)	계열회사 임원	19
김수연	Й	1977.09	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	Mobile eXperience 개발실 수	Univ. of York(석사)	계열회사 임원	7
김수형	남	1972.08	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임 원	영상디스플레이 Micro LED팀 담당임원	MIT(박사)	계열회사 임원	
김수홍	남	1972.11	상무	상근	DS부문 CTO 설비기술연구소 설비개발실 담당임원	생산기술연구소 설비개발실 담 당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
김승연	여	1975.04	상무	상근	Mobile eXperience 마케팅팀 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅 실 담당임원	인하대(학사)	계열회사	54
김승일	남	1970.07	상무	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임 원	네트워크 전략마케팅팀 담당부 장	단국대(학사)	계열회사임원	
김시우	남	1972.10	상무	상근	System LSI LSI사업팀 담당임 원	System LSI LSI개발실 수석	단국대(석사)	계열회사임원	43
김신	남	1971.12	상무	상근	생활가전 선행개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사	31
김연정	남	1975.12	상무	상근	SEV 담당임원	Mobile eXperience 구매팀 담 당임원	연세대(석사)	계열회사	
김영대	남	1968.10	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	Foundry 제품기술팀장	동국대(석사)	계열회사임원	
김영무	남	1976.09	상무	상근	SEA 담당임원	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	The Johns Hopkins Univ.(석사)	계열회사임원	31
김영우	남	1972.12	상무	상근	DS부문 기획팀 담당임원	삼성글로벌리서치, 담당임원	Columbia Univ.(석사)	계열회사임원	13
김영일	남	1974.12	상무	상근	DS부문 DSA 담당임원	DS부문 미주총괄 담당부장	고려대(학사)	계열회사	19
김영정	남	1972.03	상무	상근	제조&기술담당 메모리제조기술 센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터 수석	서울대(박사)	계열회사	31
김영주	남	1973.07	상무	상근	제조&기술담당 메모리제조기술 센터 담당임원		한양대(석사)	계열회사 임원	31
김영집	남	1979.05	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	19
김용관	남	1976.04	상무	상근	DS부문 구매팀 담당임원	Apple, Manager	Univ. of Illinois, Urbana- Champaign(박사)	계열회사 임원	53
김용상	남	1972.08	상무	상근	DS부문 DSA 담당임원	Foundry 전략마케팅실 담당임 원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	43
김용성	남	1973.09	상무	상근	SAIT Device Research Center장	종합기술원 Material연구센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	54
김용완	남	1970.04	상무	상근	TSP총괄 Global운영팀장	메모리 Global운영팀장	연세대(학사)	계열회사 임원	54
김용찬	남	1969.03	상무	상근	제조&기술담당 메모리제조기술 센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터 담당임원	경희대(학사)	계열회사 임원	
김용한	남	1976.02	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 선행개발팀 담당임원	고려대(박사)	계열회사 임원	31
김용훈	남	1972.11	상무	상근	한국총괄 CE팀 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당임 원	한양대(학사)	계열회사 임원	43
김우년	남	1970.09	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	Qualcomm, Principal Engineer	포항공대(박사)	계열회사 임원	

		1				I	ı		
김원국	뱌	1975.11	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	경북대(석사)	계열회사 임원	31
김원우	늄	1970.03	상무	상근	영상디스플레이 영상전략마케 팅팀 담당임원	SEDA-S 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	54
김원희	남	1971.04	상무	상근	SEAU법인장	SEAU 담당임원	Mcgill Univ.(석사)	계열회사 임원	
김유나	여	1979.01	상무	상근	Samsung Research 기술전략 팀 담당임원	SRPOL연구소장	포항공대(박사)	계열회사 임원	31
김유승	남	1978.02	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	Intuitive, Staff Engineer	Carnegie Mellon Univ.(박사)	계열회사 임원	6
김윤재	뱌	1973.02	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공 정개발실 담당임원	반도체연구소 메모리 TD실 담 당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	43
김윤호	남	1974.11	상무	상근	법무실 담당임원	법무실 담당임원	연세대(학사)	계열회사 임원	5
김은경	여	1974.04	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	단국대(학사)	계열회사 임원	
김은용	남	1979.02	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	19
김은하	여	1971.05	상무	상근	법무실 IP센터 담당임원	법무실 IP센터 수석	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	43
김이태	남	1971.01	상무	상근	System LSI Sensor사업팀 담당 임원	System LSI Sensor사업팀 수석	포항공대(석사)	계열회사 임원	
김인범	남	1973.05	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임 원	영상디스플레이 Micro LED팀 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	19
김인철	남	1973.12	상무	상근	DS부문 경영지원실 담당임원	DX부문 경영지원실 담당부장	고려대(석사)	계열회사 임원	8
김인형	남	1973.12	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임 원	System LSI SOC개발실 담당임 원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
김재관	냥	1976.01	상무	상근	SRA 담당임원	지원팀 담당부장	경북대(학사)	계열회사 임원	7
김재성	남	1972.04	상무	상근	SEA 담당임원	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	54
김재윤	남	1970.07	상무	상근	전장사업팀 담당임원	경영혁신센터 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	
김재진	남	1969.11	상무	상근	People팀 담당임원	인사팀 담당임원	항공대(학사)	계열회사 임원	43
김재홍	남	1973.03	상무	상근	지원팀 담당임원	무선 지원팀 담당부장	성균관대(석사)	계열회사 임원	43
김재환	남	1969.07	상무	상근	법무실 IP센터 담당임원	법무실 IP센터 수석변호사	The Ohio State Univ.(박사)	계열회사 임원	19
김재훈	남	1974.12	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	Facebook, S/W Engineer	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	33
김정봉	남	1965.07	상무	상근	육상연맹(파견)	SSC 담당임원	부산대(학사)	계열회사 임원	
김정수	남	1983.09	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임 원	Qualcomm, Principal	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	6
김정헌	남	1972.12	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프 라기술센터 담당임원	DL E&C, 전무	경희대(석사)	계열회사 임원	20

김정호	남	1972.01	상무	상근	생활가전 지원팀 담당임원	기획팀 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	
김종균	남	1966.08	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	정보전략팀 담당부장	경상대(학사)	계열회사 임원	
김종민	남	1968.03	상무	상근	SSC 담당임원	전장사업팀 담당임원	Univ. of Pennsylvania(석사)	계열회사 임원	
김종현	남	1975.11	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임 원	영상디스플레이 개발팀 수석	연세대(석사)	계열회사 임원	7
김종현	남	1972.12	상무	상근	중동총괄 담당임원	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당부장	세종대(학사)	계열회사 임원	7
김종훈	남	1969.12	상무	상근	메모리 품질실 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당임원	중앙대(학사)	계열회사 임원	
김종희	남	1974.01	상무	상근	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원	NXP, Principal	포항공대(박사)	계열회사 임원	8
김주연	남	1974.12	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	Foundry 기술개발실 수석	한양대(박사)	계열회사 임원	19
김준석	남	1972.10	상무	상근	System LSI Project Management팀장	System LSI SOC개발실 담당임 원	연세대(박사)	계열회사 임원	
김준성	남	1975.08	상무	상근	DS부문 DSA 담당임원	Foundry Corporate Planning실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	19
김준연	남	1973.11	상무	상근	CSS사업팀 담당임원	삼성디스플레이, 디스플레이연 구소 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	3
김준엽	남	1969.10	상무	상근	SERK법인장	SEHC 담당임원	경기대(학사)	계열회사 임원	
					제조&기술담당 메모리제조기술	반도체연구소 메모리TD실 담당	Univ. of California, LA(박	계열회사	
김지영	남	1970.04	상무	상근	센터 담당임원	임원	\h\)	임원	
김지용	남	1975.06	상무	상근	SEA 담당임원	SEA 담당부장	Syracuse Univ.(석사)	계열회사 임원	19
김지윤	여	1975.02	상무	상근	People팀 담당임원	인사팀 담당임원	Cornell Univ.(석사)	계열회사 임원	
김지훈	남	1971.08	상무	상근	한국총괄 B2B통합오퍼링센터 담당임원	한국총괄 B2B팀 담당임원	서강대(박사수료)	계열회사 임원	31
김진교	남	1973.05	상무	상근	상생협력센터 담당임원	베트남복합단지 담당부장	경찰대(학사)	계열회사 임원	31
김진기	남	1972.01	상무	상근	제조&기술담당 평택단지 담당 임원	글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터 수석	인하대(학사)	계열회사 임원	31
김진성	남	1971.02	상무	상근	SEVT 담당임원	지원팀 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	54
김진주	남	1969.05	상무	상근	제조&기술담당 평택단지 담당임원	글로벌인프라총괄 평택사업장 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
김진호	남	1977.01	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 담당 임원	글로벌 제조&인프라총괄 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	19
김찬호	남	1975.06	상무	상근	SEIB 담당임원	영상디스플레이 지원팀 담당임 원	Univ. of Illinois, Urbana- Champaign(석사)	계열회사 임원	43
김창용	남	1973.04	상무	상근	DS부문 People팀 담당임원	SAIT People팀장	고려대(석사)	계열회사 임원	31
김창태	남	1972.01	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	무선 개발실 수석	금오공대(학사)	계열회사 임원	

	1				1				ı
김철주	油	1976.07	상무	상근	SRUK연구소장	SRR연구소장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	19
김태경	남	1971.03	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 Flash TD실 담당임원	Intel, Principal Engineer	서울대(박사)	계열회사 임원	14
김태균	남	1976.02	상무	상근	제조&기술담당 Foundry제조기 술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조 기술센터 수석	RPI(박사)	계열회사 임원	31
김태수	남	1985.03	상무	상근	Samsung Research Security & Privacy팀 담당임원	Samsung Research Security팀 담당임원	MIT(박사)	계열회사 임원	38
김태영	남	1976.03	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	Foundry 기술개발실 수석	Kanazawa Univ.(박사)	계열회사 임원	8
김태우	남	1971.05	상무	상근	메모리 기획팀장	메모리 기획팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
김태정	남	1972.12	상무	상근	제조&기술담당 Foundry제조기 술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조 기술센터 담당임원	충북대(학사)	계열회사 임원	43
김태중	남	1971.05	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당 임원	무선 디자인팀 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	
김태훈	남	1970.10	상무	상근	제조&기술담당 평택단지 담당 임원	글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	
김태훈	남	1973.01	상무	상근	상생협력센터 담당임원	감사팀 담당임원	단국대(학사)	계열회사 임원	43
김한조	'n	1973.09	상무	상근	의료기기 지원팀장	SEA 담당부장	Univ. of California, Irvine(석사)	계열회사 임원	7
김향희	여	1972.07	상무	상근	SEROM법인장	SEH-S법인장	고려대(학사)	계열회사 임원	31
김현	늄	1968.07	상무	상근	People팀 담당임원	서남아총괄 대외협력팀장	서강대(석사)	계열회사 임원	
김현근	남	1973.07	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당부장	경희대(학사)	계열회사 임원	31
김현기	늄	1973.01	상무	상근	제조&기술담당 Foundry제조기 술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 수석	광운대(학사)	계열회사 임원	19
김현덕	늄	1981.06	상무	상근	혁신센터 담당임원	Meta, Software Engineer	Univ. of Illinois, Urbana- Champaign(박사)	계열회사 임원	18
김현석	남	1976.10	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 Flash TD실 담당임원	반도체연구소 메모리 TD실 담 당임원	고려대(박사)	계열회사 임원	31
김현수	남	1970.09	상무	상근	SAIT 미래기술육성센터장	SR 기술전략팀 담당임원	성균관대(박사)	계열회사 임원	
김현종	ъ	1977.11	상무	상근	법무실 담당임원	법무실 수석변호사	Columbia Univ.(석사)	계열회사 임원	43
김현중	늄	1969.05	상무	상근	한국총괄 e-Commerce팀장	한국총괄 CE영업팀 담당임원	Thunderbird(석사)	계열회사 임원	
김현철	남	1969.05	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 CIS TD팀 담당임원	반도체연구소 CIS TD팀 수석	Texas A&M Univ.(박사)	계열회사 임원	54
김형섭	남	1970.12	상무	상근	상생협력센터 담당임원	상생협력센터 담당부장	중앙대(학사)	계열회사 임원	54
김형옥	늄	1979.04	상무	상근	Foundry Design Platform개발 실 담당임원	Foundry Design Platform개발 실 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	8
김형재	남	1970.12	상무	상근	SEM-S법인장	영상디스플레이 영상전략마케 팅팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	_

김형준	늄	1972.05	상무	상근	생활가전 담당임원	생활가전 개발팀 담당임원	숭실대(석사)	계열회사 임원	31
김호균	±o	1968.12	상무	상근	중남미총괄 대외협력팀장	Samsung Research 인사팀장	연세대(석사)	계열회사 임원	
김홍민	to	1971.10	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당 임원	무선 디자인팀 담당임원	SAIC(석사)	계열회사 임원	58
김후성	'n	1972.01	상무	상근	System LSI Global Operation실 담당임원	메모리 품질보증실 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
김훈식	뱌	1981.07	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	Apple, Engineering Manager	Univ. of Illinois, Urbana- Champaign(박사)	계열회사 임원	8
김희승	뱌	1970.09	상무	상근	System LSI People팀장	DS부문 People팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	54
김희열	늄	1975.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 TP센 터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 TP센 터 수석	고려대(석사)	계열회사 임원	8
나원만	늄	1975.06	상무	상근	SEM-P 담당임원	SEM-P 담당부장	영남대(학사)	계열회사 임원	7
나현수	늄	1971.06	상무	상근	중국총괄 지원팀장	한국총괄 지원팀 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	54
남경인	诒	1973.03	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	SELS법인장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
남덕우	to	1974.11	상무	상근	제조&기술담당 Foundry제조기 술센터 담당임원	제조&기술담당 Foundry제조기 술센터 담당부장	동국대(학사)	계열회사 임원	8
남정만	늄	1967.06	상무	상근	SEHC 담당임원	생활가전 Global제조팀 담당임 원	전남기계공고(고교)	계열회사 임원	
남태호	늄	1969.03	상무	상근	DS부문 경영지원실 담당임원	한국토지주택공사, 부장	경북대(박사수료)	계열회사 임원	12
노경래	тo	1976.12	상무	상근	영상디스플레이 영상전략마케 팅팀 담당임원	SEM-S 담당임원	서강대(학사)	계열회사 임원	
노경윤	Ťo	1972.09	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	Intel, Director	MIT(박사)	계열회사 임원	34
노미정	여	1971.04	상무	상근	DS부문 DSA 담당임원	Foundry Corporate Planning실 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	54
노수혁	to	1970.04	상무	상근	생활가전 담당임원	생활가전 개발팀 담당임원	연세대(박사)	계열회사 임원	43
노승남	тo	1973.04	상무	상근	메모리 지원팀 담당임원	사업지원T/F 담당부장	연세대(석사)	계열회사 임원	43
노태현	тo	1969.09	상무	상근	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원	무선 서비스사업실 담당임원	George Washington Univ.(석사)	계열회사 임원	
다니엘아 라우조	山	1981.08	상무	상근	Mobile eXperience 전략기획팀 담당임원	사업지원T/F 담당부장	Univ. Of Pennsylvania(석사)	계열회사 임원	19
드미트리	站	1972.07	상무	상근	SERC 담당임원	SERC VP	Moscow Institute of Physics and Technology(석사)	계열회사 임원	43
라병주	남	1972.05	상무	상근	전장사업팀 담당임원	전장사업팀 담당부장	서울대(석사)	계열회사 임원	43
류일곤	诒	1968.07	상무	상근	SEVT 담당임원	인사팀 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	

					Foundry Design Platform개발			계열회사	
류효겸	남	1980.10	상무	상근	실 담당임원	Broadcom, Principal Engineer	Univ. of Michigan(박사)	임원	44
마띠유	남	1981.10	상무	상근	기획팀 담당임원	사업지원T/F 담당부장	MIT(석사)	계열회사 임원	54
명관주	남	1972.10	상무	상근	생활가전 Global CS팀 담당임 원	생활가전 개발팀 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	54
명승일	남	1976.11	상무	상근	지원팀 담당임원	북미총괄 지원팀 담당부장	Vanderbilt Univ.(석사)	계열회사 임원	7
모한	남	1973.07	상무	상근	SRI-Bangalore 담당임원	SRI-Bangalore VP	Acharya Nagarjuna Univ.(학사)	계열회사 임원	54
목진호	남	1968.09	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	글로벌기술센터 담당임원	연세대(박사)	계열회사 임원	
문석진	늄	1974.06	상무	상근	Foundry 지원팀 담당임원	DS부문 지원팀 담당부장	계명대(학사)	계열회사 임원	8
문준기	늄	1975.02	상무	상근	SEA 담당임원	SEA 담당부장	성균관대(석사)	계열회사 임원	7
문진옥	남	1971.12	상무	상근	제조&기술담당 메모리제조기술 센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터 담당임원	한양대(박사)	계열회사 임원	54
문태호	남	1974.11	상무	상근	AVP사업팀 품질팀장	AVP사업팀 품질팀 수석	동아대(학사)	계열회사 임원	8
민병기	남	1963.02	상무	상근	상생협력센터 담당임원	에스원, 커뮤니케이션팀 담당임 원	연세대(석사)	계열회사 임원	31
민재호	남	1976.09	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공 정개발실 담당임원	반도체연구소 공정개발실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	31
민현진	남	1974.06	상무	상근	DS부문 CTO 설비기술연구소 설비개발실 담당임원	설비기술연구소 설비개발실 수 석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	19
박동욱	남	1974.01	상무	상근	System LSI 기획팀장	DS부문 기획팀 담당부장	한양대(석사)	계열회사 임원	43
박두건	남	1981.01	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	Mobile eXperience 모바일플랫 폼센터 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	20
박래순	남	1969.05	상무	상근	중국전략협력실 담당임원	삼성전기, 인사지원그룹장	Peking Univ.(석사)	계열회사 임원	23
박민규	남	1976.09	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	무선 개발실 수석	연세대(박사)	계열회사 임원	43
박민철	남	1972.09	상무	상근	제조&기술담당 메모리제조기술 센터 담당임원	메모리 Flash개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
박병수	남	1972.12	상무	상근	한국총괄 B2B팀 담당임원	한국총괄 B2B팀 담당부장	한양대(학사)	계열회사 임원	19
박봉일	남	1972.02	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임 원	System LSI Custom SOC사업 팀 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	43
박봉태	남	1974.10	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	SCS 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	54
박상교	남	1972.03	상무	상근	중국전략협력실 담당임원	중국본사 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
박상도	남	1973.12	상무	상근	People팀 담당임원	북미총괄 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	54
박상영	남	1976.01	상무	상근	Mobile eXperience People팀 담당임원	Samsung Research People팀 담당부장	아주대(석사)	계열회사 임원	7

박상욱	泊	1978.05	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 차	DS부문 CTO 반도체연구소 차	한국과학기술원(박사)	계열회사	8
					세대공정개발실 담당임원	세대공정개발실 수석		임원	
박상훈	늄	1978.02	상무	상근	Foundry Design Platform개발 실 담당임원	Foundry Design Platform개발 실 수석	포항공대(박사)	계열회사 임원	31
박상훈	妆	1969.09	상무	상근	Mobile eXperience 지원팀 담당임원	법무실 담당임원	Syracuse Univ.(석사)	계열회사 임원	
박석민	뱌	1970.12	상무	상근	생활가전 Global운영팀 담당임 원	경영혁신센터 담당임원	Univ. of Texas, Austin(박 사)	계열회사임원	
박성범	늄	1984.10	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임 원	System LSI SOC개발실 수석	Stanford Univ.(박사)	계열회사	31
박성우	늄	1976.04	상무	상근	커뮤니케이션팀 담당임원	중앙일보, 법조팀장	Univ. Of Chicago(석사)	계열회사	7
박성철	山	1972.10	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	19
박영민	늄	1975.12	상무	상근	SCIC 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당부	Emory Univ.(석사)	계열회사	7
박은중	늄	1976.05	상무	상근	SEA 담당임원	Mobile eXperience 지원팀 담 당부장	Univ. of North Carolina, Chapel Hill(석사)	계열회사 임원	7
박장용	늄	1979.01	상무	상근	법무실 담당임원	법무실 수석변호사	서울대(학사)	계열회사 임원	43
박재범	ţ0	1977.08	상무	상근	메모리 People팀장	DS부문 People팀 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	31
박재성	to	1971.02	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프 라기술센터 담당임원	TSP총괄 TP센터 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	
박재식	山	1976.08	상무	상근	생활가전 구매팀 담당임원	생활가전 구매팀 담당부장	경희대(학사)	계열회사 임원	19
박재현	늄	1970.07	상무	상근	글로벌마케팅실 담당임원	글로벌마케팅실 글로벌브랜드 센터 담당임원	한양대(석사)	계열회사 임원	43
박정대	늄	1976.12	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 EHS센터 담당임원	글로벌인프라총괄 분석기술팀 장	포항공대(박사)	계열회사 임원	
박정미	Й	1968.07	상무	상근	Mobile eXperience 마케팅팀 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅 팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
박정재	to	1974.01	상무	상근	DS부문 재경팀 담당임원	DS부문 일본총괄 담당부장	Univ. of Texas, Austin(석 사)	계열회사 임원	54
박정호	山	1974.11	상무	상근	Samsung Research 차세대통 신연구센터 담당임원	네트워크 개발팀 담당임원	연세대(박사)	계열회사 임원	54
박제영	诒	1969.09	상무	상근	제조&기술담당 Foundry제조기 술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
박제임스	如	1973.06	상무	상근	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원	무선 Global Mobile B2B팀 담 당부장	California Polytechnic State Univ.(학사)	계열회사 임원	
박종만	żo	1971.11	상무	상근	디바이스플랫폼센터 담당임원	Mobile eXperience 모바일플랫 폼센터 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	31
박종민	邙	1968.08	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	Western Digital, Director	한국과학기술원(학사)	계열회사 임원	6
박종우	山	1972.02	상무	상근	한국총괄 B2B팀 담당임원	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	서울시립대(학사)	계열회사 임원	31
박준수	山	1967.08	상무	상근	제조&기술담당 Foundry제조기 술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	22

박준영	뱌	1974.10	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임 원	Mobile eXperience 마케팅팀 담당임원	Univ. of Paris 11(석사)	계열회사 임원	43
박준호	남	1972.05	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당 임원	무선 전략마케팅실 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	
박진표	남	1972.11	상무	상근	DS부문 DSA 담당임원	System LSI AP개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
박찬형	늄	1973.06	상무	상근	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당부장	City Univ. of New York(석 사)	계열회사 임원	19
박창서	to	1980.06	상무	상근	혁신센터 담당임원	DIT센터 담당임원	Univ. of California, Berkeley(박사)	계열회사 임원	40
박창진	to	1967.01	상무	상근	네트워크 Global CS팀장	네트워크 개발팀 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	
박철민	남	1971.01	상무	상근	AVP사업팀 Corporate Planning실 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	53
박철범	남	1966.03	상무	상근	상생협력센터 담당임원	상생협력센터 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	
박철웅	남	1973.01	상무	상근	Mobile eXperience 담당임원	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	연세대(학사)	계열회사 임원	31
박충신	남	1973.09	상무	상근	People팀 담당임원	의료기기 People팀장	경북대(석사)	계열회사 임원	43
박태호	남	1969.03	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	SEAG법인장	Univ. of Pittsburgh(석사)	계열회사 임원	
박태훈	남	1974.11	상무	상근	제조&기술담당 메모리제조기술 센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터 수석	연세대(석사)	계열회사 임원	31
박현근	남	1973.01	상무	상근	Foundry 기획팀장	DS부문 기획팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	54
박현준	남	1978.01	상무	상근	구주총괄 People팀장	사업지원T/F 담당부장	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	19
박형민	남	1977.03	상무	상근	SEA 담당임원	SEAD법인장	서울대(학사)	계열회사 임원	43
박형신	여	1977.02	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당 임원	Mobile eXperience CX실 수석	제주대(학사)	계열회사 임원	7
박호우	남	1971.03	상무	상근	System LSI Sensor사업팀 담당 임원	제조담당 Foundry제조기술센터 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	31
박환홍	남	1973.10	상무	상근	지원팀 담당임원	Mobile eXperience 지원팀 담당부장	연세대(석사)	계열회사 임원	7
박훈철	to	1974.05	상무	상근	SEHC 담당임원	생활가전 지원팀 담당임원	광운대(학사)	계열회사 임원	31
반수형	ţ0	1972.06	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	생활가전 개발팀 담당임원	아주대(학사)	계열회사 임원	19
반일승	뱌	1974.11	상무	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임 원	SEJ 담당부장	경희대(학사)	계열회사 임원	54
방지훈	ţ0	1973.11	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임 원	System LSI 기반설계실 담당임 원	Carnegie Mellon Univ.(석사)	계열회사 임원	
배범희	남	1985.09	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	생산기술연구소 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	19
배상기	뱌	1974.04	상무	상근	메모리 지원팀 담당임원	SAS 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	54

배승준	ÌO	1976.03	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	
배윤수	남	1974.12	상무	상근	재경팀 담당임원	기획팀 담당부장	Harvard Univ.(석사)	계열회사 임원	7
배희선	여	1974.02	상무	상근	SCIC 담당임원	영상디스플레이 영상전략마케 팅팀 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	43
백기열	뱌	1967.07	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	삼성SDS, 품질팀장	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	19
백아론	늄	1979.10	상무	상근	Samsung Research Life Solution팀 담당임원	Samsung Research 차세대가 전연구팀 담당임원	Stanford Univ.(석사)	계열회사 임원	31
백피터	늄	1971.06	상무	상근	DS부문 IP팀 담당임원	법무실 IP센터 책임변호사	Univ. of Minnesota, Minneapolis(석사)	계열회사 임원	54
백혜성	Й	1980.02	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임 원	생활가전 전략마케팅팀 담당부 장	연세대(학사)	계열회사 임원	7
변준호	남	1972.07	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	무선 개발2실 담당임원	Southern Illinois Univ.(박사)	계열회사 임원	
부민혁	남	1973.06	상무	상근	Mobile eXperience사업부 CX실 담당임원	생활가전 디자인팀장	제주대(학사)	계열회사 임원	
서경헌	남	1970.05	상무	상근	People팀 담당임원	인사팀 담당임원	광운대(학사)	계열회사 임원	31
서상원	남	1979.06	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임 원	Apple, Engineer/Manager	Univ. of Michigan(박사)	계열회사 임원	20
서성기	남	1972.12	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프 라기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라기술 센터 담당임원	건국대(학사)	계열회사 임원	54
서영진	남	1969.05	상무	상근	Global EHS실 담당임원	Global CS센터 담당임원	Insa De Lyon(박사)	계열회사 임원	
서정아	여	1971.05	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅 실 담당임원	Mobile eXperience 온라인 Biz센터 담당임원	Columbia Univ.(석사)	계열회사 임원	
서정혁	남	1972.07	상무	상근	Samsung Research People팀 장	네트워크 인사팀장	건국대(학사)	계열회사 임원	31
서정현	남	1974.04	상무	상근	SCS 담당임원	DS부문 지원팀 담당임원	Univ. of Wisconsin, Madison(석사)	계열회사 임원	54
서창우	남	1974.06	상무	상근	SEF 담당임원	SEBN 담당부장	Manchester(석사)	계열회사 임원	19
서치영	남	1974.12	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	Mobile eXperience 모바일플랫 폼센터 담당임원	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	28
서현석	남	1974.06	상무	상근	감사팀 담당임원	감사팀 담당부장	Univ. of California, Berkeley(석사)	계열회사 임원	7
서현정	여	1978.02	상무	상근	DS부문 상생협력센터 담당임원	ERM 코리아, 대표	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	32
선동석	남	1974.04	상무	상근	혁신센터 담당임원	DIT센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	43
선종우	남	1974.06	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공 정개발실 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 공 정개발실 수석	고려대(박사)	계열회사 임원	8
설지윤	남	1974.12	상무	상근	네트워크 상품전략팀장	네트워크 개발팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	54
설훈	남	1970.03	상무	상근	SEG 담당임원	SEROM법인장	고려대(학사)	계열회사 임원	

					T	Ι	T		ı
성낙희	남	1973.03	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임	System LSI SOC개발실 담당임	Georgia Inst. of Tech.(박	계열회사	
					원	원	사)	임원	
성백민	남	1971.05	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프	글로벌인프라총괄 인프라기술	한양공고(고교)	계열회사	31
072		1971.03	0 +	0 _	라기술센터 담당임원	센터 수석	[ESOT(TT)	임원	01
					Samsung Research Life			계열회사	
소재민	남	1983.04	상무	상근	Solution팀 담당임원	생산기술연구소 담당임원 	한국과학기술원(박사)	임원	31
							Georgia Inst. of Tech.(박	계열회사	
손석제	남	1973.08	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	Nike, Director	사)		2
							Λ()	임원	
손석준	남	1974.07	상무	상근	생활가전 Global제조팀 담당임	생활가전 개발팀 담당임원	전남대(석사)	계열회사	43
					원			임원	
손성민	남	1973.06	상무	상근	Mobile eXperience 구매팀 담	SEV 담당부장	 성균관대(석사)	계열회사	31
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			당임원		32231(1747)	임원	
A 04 01	O.	1070.05			생활가전 전략마케팅팀 담당임		¬ ¬, c /÷ ,)	계열회사	4.0
손영아	여	1973.05	상무	상근	원	SELA 담당부장	고려대(학사)	임원	19
						DS부문 CTO 반도체연구소		계열회사	
손영웅	남	1970.10	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	DRAM TD실 담당임원	성균관대(석사)	임원	54
					Mobile eXperience 개발실 담	Mobile eXperience 개발실 수		계열회사	
손왕익	남	1984.03	상무	상근			한국과학기술원(박사)		7
					당임원	석		임원	
손용우	남	1968.09	상무	상근	생활가전 지원팀 담당임원	SEDA-P(M) 담당임원	경희대(학사)	계열회사	
								임원	
손용훈	남	1973.03	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공	반도체연구소 메모리 TD실 담	서울대(박사)	계열회사	31
		1370.00	0 1	0 _	정개발실 담당임원	당임원	Mean(-M)	임원	01
					Mobile eXperience 지원팀 담	Mobile eXperience 지원팀 담		계열회사	
손준호	남	1976.08	상무	상근	당임원	당부장	Emory Univ.(석사)	임원	19
							State Univ. of New York,	계열회사	
손한구	남	1969.06	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당임원	Stony Brook(석사)	임원	
								계열회사	
손현석	남	1976.03	상무	상근	SEH-P법인장	SEH-P 담당부장	홍익대(학사)	임원	19
					77.7.4.0.0.0	제품 이기스타다 에트리제품 기스			
손호민	남	1969.02	상무	상근	제조&기술담당 Common	제조&기술담당 메모리제조기술	한양대(석사)	계열회사	54
					Tech센터 담당임원	센터 담당임원		임원	
손호성	남	1968.04	상무	상근	생활가전 Global제조팀 담당임	생활가전 개발팀 담당임원	경북대(학사)	계열회사	
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			원	02,12,112,000,000	3 1-11(1/-1/	임원	
소기제	1.4	1970.04	사ㅁ	A1-7	글로벌 제조&인프라총괄 TP센	TSP총괄 TP센터 담당임원	2r O CII/HF 11/	계열회사	40
송기재	남	1970.04	상무	상근	터 담당임원	107공일 IP센터 음성옵션	광운대(박사)	임원	43
					영상디스플레이 Customer			계열회사	
송명숙	여	1972.11	상무	상근	Marketing팀 담당임원	글로벌마케팅센터 담당임원	성균관대(학사)	임원	
					글로벌마케팅실 D2C센터 담당	글로벌마케팅실 D2C센터 담당		계열회사	
송문경	여	1977.08	상무	상근	임원	부장	한동대(학사)	임원	7
							Liniu of Illinoin Lighton		
송방영	남	1974.10	상무	상근	사업지원T/F 담당임원	Mobile eXperience 지원팀 담	Univ. of Illinois, Urbana-	계열회사	
						당임원	Champaign(석사)	임원	
송보영	여	1976.10	상무	상근	제조&기술담당 메모리제조기술	글로벌 제조&인프라총괄 메모	포항공대(석사)	계열회사	19
					센터 담당임원	리제조기술센터 수석	55-11 1717	임원	
A 11 =1		1070.00	A. C.		Mobile eXperience 서비스	Madaga Madi Gurana	Univ. of Maryland, College	계열회사	40
송상철	남	1973.09	상무	상근	Biz팀 담당임원	Verizon Media, Chief Architect	Park(박사)	임원	40
					글로벌 제조&인프라총괄			계열회사	
송영근	남	1970.01	상무	상근	AVP제조기술센터 담당임원	Intel, Principal Engineer	건국대(학사)	임원	18
					22 3332			계열회사	
송우창	남	1968.01	상무	상근	한국총괄 B2B팀 담당임원	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	한국과학기술원(석사)		
								임원	

송원철	남	1976.01	상무	상근	SAMEX 담당임원	지원팀 담당부장	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	19
송윤종	남	1971.10	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 차 세대연구실 담당임원	반도체연구소 차세대TD팀장	Virginia Tech(박사)	계열회사 임원	
송인강	남	1971.07	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	무선 기술전략팀 담당부장	Vanderbilt Univ.(석사)	계열회사 임원	
송정우	남	1977.12	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	State Univ. of New York, Buffalo(박사)	계열회사 임원	19
송태중	남	1971.04	상무	상근	Foundry Corporate Planning실 담당임원	Foundry Design Platform개발 실 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박 사)	계열회사 임원	
송택상	남	1978.03	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	Rambus, Technical Director	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	5
송호영	남	1972.12	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	54
쉐인힉비	남	1972.05	상무	상근	SEA 담당임원	SEA VP	Fairleigh Dickinson Univ.(석사)	계열회사 임원	
신규범	남	1972.06	상무	상근	Mobile eXperience 품질혁신센 터 담당임원	무선 Global CS팀 담당부장	부산대(학사)	계열회사 임원	43
신대중	남	1971.11	상무	상근	Mobile eXperience Global제조 센터 담당임원	SEDA-P(C)공장장	경북대(학사)	계열회사 임원	54
신문선	남	1975.04	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 수석	한국해양대(학사)	계열회사 임원	19
신민호	남	1970.03	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임 원	System LSI SOC개발실 수석	연세대(박사)	계열회사 임원	43
신병무	뱌	1970.08	상무	상근	SEEG-S법인장	SEGR법인장	연세대(학사)	계열회사 임원	7
신상용	뱌	1973.05	상무	상근	제조&기술담당 평택단지 담당 임원	글로벌 제조&인프라총괄 메모 리제조기술센터 수석	홍익대(학사)	계열회사 임원	19
신승주	남	1972.04	상무	상근	SEASA법인장	Mobile eXperience 전략마케팅 실 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	54
신용우	남	1974.12	상무	상근	DS부문 기획팀 담당임원	DS부문 기획팀 담당부장	서울대(석사)	계열회사 임원	31
신원화	남	1976.11	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	성균관대(박사)	계열회사 임원	19
신의창	남	1971.05	상무	상근	People팀 담당임원	인사팀 담당부장	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	16
신인철	남	1974.06	상무	상근	TSP총괄 People팀장	DS부문 인사팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	43
신현석	뱌	1969.05	상무	상근	신사업T/F 담당임원	Samsung Research Intelligent Machine센터장	서강대(석사)	계열회사 임원	
심승환	남	1974.04	상무	상근	글로벌마케팅실 D2C센터 담당 임원	Apple, Sr. Development Manager	Stanford Univ.(석사)	계열회사 임원	13
심우철	남	1982.06	상무	상근	SRPOL연구소장	Samsung Research Security & Privacy팀 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	31
심재혁	뱌	1978.04	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프 라기술센터 담당임원	Dupont Korea, 상무	서강대(학사)	계열회사 임원	21
심호준	뱌	1977.12	상무	상근	DS부문 상품기획실 담당임원	DS부문 DSC 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	54

						1			
심황윤	남	1971.01	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	무선 개발실 수석	연세대(석사)	계열회사 임원	31
아라이	沾	1968.08	상무	상근	DS부문 DSJ총괄	DS부문 일본총괄 VP	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	43
안대현	뱌	1972.02	상무	상근	한국총괄 CE팀 담당임원	한국총괄 CE영업팀 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	43
안성준	뱌	1975.01	상무	상근	System LSI S/W Engineering팀장	System LSI S/W Architecture팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
안승환	뱌	1970.10	상무	상근	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	SEA 담당임원	연세대(학사)	계열회사 임원	
안신헌	뱌	1972.09	상무	상근	제조&기술담당 메모리제조기술 센터 담당임원	글로벌인프라총괄 평택사업장 수석	한양대(학사)	계열회사 임원	31
안영모	남	1973.10	상무	상근	상생협력센터 담당임원	상생협력센터 담당부장	경북대(학사)	계열회사 임원	7
안용석	남	1974.11	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 DRAM TD실 담당임원	반도체연구소 DRAM TD실 수 석	서울대(석사)	계열회사 임원	19
안재용	남	1977.02	상무	상근	디바이스플랫폼센터 담당임원	감사팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	19
안주원	여	1977.03	상무	상근	생활가전 기획팀 담당임원	기획팀 담당부장	서강대(학사)	계열회사 임원	19
안준	남	1978.02	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	AWS, S/W Engineer	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	33
안진우	남	1969.11	상무	상근	Compliance팀 담당임원	법무실 담당임원	동아대(학사)	계열회사 임원	
안치용	남	1975.12	상무	상근	메모리 품질실 담당임원	메모리 품질실 수석	성균관대(학사)	계열회사 임원	19
안희영	여	1976.12	상무	상근	영상디스플레이 Service Business팀 담당임원	영상디스플레이 Service Business팀 담당부장	연세대(석사)	계열회사 임원	19
양시준	남	1974.01	상무	상근	네트워크 지원팀 담당임원	무선 지원팀 담당부장	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	43
양익준	남	1969.11	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	아프리카총괄 지원팀장	성균관대(학사)	계열회사 임원	
양종훈	남	1974.05	상무	상근	DS부문 구매팀 담당임원	DS부문 구매팀 담당부장	서울대(석사)	계열회사 임원	19
양준철	남	1972.06	상무	상근	생활가전 구매팀 담당임원	영상디스플레이 구매팀 담당임 원	성균관대(석사)	계열회사 임원	54
양진기	남	1971.05	상무	상근	SRA 담당임원	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
양택진	남	1971.08	상무	상근	Samsung Research 기술전략 팀 담당임원	Samsung Research 기술전략 팀 담당부장	연세대(학사)	계열회사 임원	
양희철	남	1975.07	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당 임원	무선 UX혁신팀 수석	포항공대(박사)	계열회사 임원	54
연지현	여	1974.10	상무	상근	System LSI 전략마케팅실 담당 임원	System LSI 전략마케팅실 담당 부장	연세대(석사)	계열회사 임원	31
염강수	남	1972.08	상무	상근	커뮤니케이션팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당부장	서울대(학사)	계열회사 임원	43
염부호	남	1972.04	상무	상근	글로벌마케팅실 D2C센터 담당 임원	Mobile eXperience 온라인 Biz센터 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	31

염종범	남	1977.06	상무	상근	Mobile eXperience People팀 담당임원	DS부문 중국총괄 담당부장	고려대(학사)	계열회사 임원	19
엄	여	1977.02	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	고려대(박사)	계열회사 임원	31
오상진	남	1977.11	상무	상근	DS부문 지원팀 담당임원	사업지원T/F 담당임원	MIT(석사)	계열회사 임원	31
오석민	여	1974.07	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당 임원	디자인경영센터 담당임원	New York Univ.(석사)	계열회사 임원	54
오승훈	남	1968.03	상무	상근	생활가전 Global CS팀 담당임 원	SRI-Noida연구소장	Aachen Univ. of Tech.(박 사)	계열회사 임원	
오영기	남	1973.01	상무	상근	인재개발원 담당임원	인재개발원 담당부장	충남대(학사)	계열회사 임원	19
오용찬	남	1972.10	상무	상근	SIEL-S 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당부 장	홍익대(학사)	계열회사 임원	19
오정환	남	1973.12	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공 정개발실 담당임원	반도체연구소 공정개발실 수석	연세대(석사)	계열회사 임원	19
오준영	남	1969.02	상무	상근	TSP총괄 Package개발실 담당 임원	메모리 Solution개발실 수석	The Ohio State Univ.(박사)	계열회사 임원	
오창호	남	1971.03	상무	상근	Mobile eXperience 구매팀 담 당임원	SEV 담당임원	동아대(학사)	계열회사 임원	43
오혁상	남	1969.06	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 TP센 터 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조 기술센터 담당임원	부산대(석사)	계열회사 임원	54
오형석	남	1970.09	상무	상근	TSP총괄 구매팀장	TSP총괄 구매팀장	고려대(학사)	계열회사 임원	
올라프	남	1971.01	상무	상근	SEG 담당임원	SEG VP	Johannes Gutenberg	계열회사	31
	0	1971.01	0 T	0	ocu asae	SEG VI	Univ.(석사)	임원	01
왕지연	여	1977.09	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당 임원	Mobile eXperience CX실 수석	홍익대(학사)	계열회사 임원	19
우람찬	남	1978.01	상무	상근	System LSI 기획팀 담당임원	LG전자, 상무	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	2
우준명	남	1980.12	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	8
우현수	남	1973.09	상무	상근	제조&기술담당 메모리제조기술 센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조기술 센터 수석	연세대(학사)	계열회사 임원	8
우형동	남	1970.09	상무	상근	DS부문 상생협력센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조기술 센터 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	
원석준	남	1970.02	상무	상근	제조&기술담당 Common Tech센터 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조 기술센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	54
원찬식	남	1975.12	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	글로벌기술센터 수석	서강대(박사)	계열회사 임원	31
유미경	여	1974.05	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	무선 개발실 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	34
유상민	남	1973.09	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임 원	System LSI 기반설계실 담당임 원	Univ. of Washington(박사)	계열회사 임원	43
유성종	남	1976.03	상무	상근	System LSI LSI개발실 담당임 원	System LSI LSI개발실 수석	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	19
유성호	남	1973.02	상무	상근	사업지원T/F 담당임원	System LSI 지원팀 담당임원	Stanford Univ.(석사)	계열회사 임원	31

유송	남	1975.05	상무	상근	SEA 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅	연세대(학사)	계열회사	31
						실 담당임원		임원	
유종민	남	1974.04	상무	상근	People팀 담당임원	SSC 담당임원	경희대(학사)	계열회사 임원	54
O하조	1.4	1973.10	사ㅁ	A1-7	제 경투 다다이의	סבר בינייטוסו	Univ. of North Carolina,	계열회사	40
유한종	남	1973.10	상무	상근	재경팀 담당임원 	SEF 담당임원	Chapel Hill(석사)	임원	43
유화열	남	1971.11	상무	상근	System LSI LSI사업팀 담당임 원	System LSI LSI개발실 수석	인하대(석사)	계열회사 임원	54
윤가람	여	1983.08	상무	상근	Samsung Research Visual	Meta, Manager	Univ. of Arizona(박사)	계열회사	25
270	V1	1300.00	 	0	Technology팀 담당임원	ivieta, iviariagei	Offiv. of Arizona(\(\text{Arizona} \)	임원	23
윤기영	남	1974.11	상무	상근	SEBN법인장	Mobile eXperience 전략마케팅	한양대(학사)	계열회사	7
2710	0	1974.11	0 T	0 _	SCONE 2 8	실 담당부장	[전승대(독자 <i>)</i>	임원	'
011=		1000 10	41.0				Univ. of Illinois, Urbana-	계열회사	
윤남호	남	1968.12	상무	상근	한국총괄 MX팀 담당임원	한국총괄 IM영업팀 담당임원	Champaign(석사)	임원	
								계열회사	
윤보영	여	1977.08	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	이화여대(석사)	임원	31
								계열회사	
윤상용	남	1976.07	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	서울대(석사)	임원	8
								계열회사	
윤석진	남	1968.11	상무	상근	혁신센터 담당임원	DIT센터 담당임원	연세대(박사)	임원	41
						글로벌인프라총괄 LED기술센		계열회사	
윤석호	남	1972.07	상무	상근	CSS사업팀 담당임원	터 담당임원	서울대(박사)	임원	
					글로벌 제조&인프라총괄 인프	한국기계연구원, 열에너지솔루		계열회사	
윤석호	남	1973.04	상무	상근			서울대(박사)		18
					라기술센터 담당임원	선실장		임원	
윤성욱	남	1974.06	상무	상근	구주총괄 담당임원	인사팀 담당부장	연세대(학사)	계열회사	31
								임원	
윤성현	남	1973.05	상무	상근	SIEL-P(C)공장장	SEMA법인장	부산대(학사)	계열회사	7
								임원	
윤성호	남	1974.01	상무	상근	생활가전 선행개발팀 담당임원	GE, Staff Engineer	Cambridge Univ.(박사)	계열회사	18
								임원	
윤성환	남	1972.04	상무	상근	법무실 IP센터 담당임원	법무실 IP센터 수석	State Univ. of New York,	계열회사	19
							Buffalo(석사)	임원	
윤송호	남	1974.10	상무	상근	DS부문 DSC 담당임원	메모리 Solution개발실 담당임	광운대(학사)	계열회사	31
E 0 ±		1374.10	0	0	0012 000 4842	원	8 E 41(¬ /1)	임원	01
0.4.0	1.4	1070.01		A1-7	System LSI Global	AVP사업팀 Corporate	하그게하기스이/바니\	계열회사	E 7
윤승욱	남	1970.01	상무	상근	Operation실 담당임원	Planning실 담당임원	한국과학기술원(박사)	임원	57
0.01.01					영상디스플레이 지원팀 담당임	영상디스플레이 지원팀 책임변		계열회사	
윤여완	남	1972.02	상무	상근	원	호사	Syracuse Univ.(석사)	임원	43
								계열회사	
윤원주	남	1978.01	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	고려대(박사)	임원	8
								계열회사	
윤인철	남	1971.03	상무	상근	생활가전 선행개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 담당임원	한양대(석사)	임원	
						메모리 DRAM개발실 담당		계열회사	
윤재윤	남	1970.01	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	Master	고려대(석사)	임원	5
					Mobile eXperience 구매팀 담			계열회사	
윤찬현	남	1971.10	상무	상근	당임원	무선 구매팀 담당부장	영남대(학사)	임원	
					002			계열회사	
윤철웅	남	1970.07	상무	상근	SELV법인장	SERC 담당임원	인하대(학사)		
								임원	

윤호용	남	1969.12	상무	상근	SEM-S 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅 실 담당임원	Drexel Univ.(석사)	계열회사 임원	54
은성민	냠	1977.01	상무	상근	DS부문 DSA 담당임원	사업지원T/F 담당부장	Wake Forest Univ.(석사)	계열회사 임원	19
이강규	남	1972.09	상무	상근	DS부문 기획팀 담당임원	Foundry Corporate Planning실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	43
이강승	남	1977.07	상무	상근	System LSI Global Operation실 담당임원	System LSI Global운영팀장	포항공대(박사)	계열회사 임원	54
이강호	남	1977.10	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	Global Foundries, Principal Member of Technical Staff	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	7
이경준	뱌	1976.06	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임 원	한국총괄 CE영업팀 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	43
이경호	뱌	1975.10	상무	상근	System LSI Sensor사업팀 담당 임원	System LSI Sensor사업팀 수석	포항공대(박사)	계열회사 임원	31
이계원	남	1968.05	상무	상근	한국총괄 SMB팀장	한국총괄 B2B팀 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
이계훈	남	1980.02	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임	영상디스플레이 Micro LED팀 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	31
이관수	남	1969.11	상무	상근	Mobile eXperience 지원팀 담 당임원	SAMEX 담당임원	영남대(학사)	계열회사 임원	
이광열	남	1974.11	상무	상근	아프리카총괄 지원팀장	사업지원T/F 담당부장	Emory Univ.(석사)	계열회사 임원	31
이광재	남	1974.03	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	생산기술연구소 수석	Univ. of Michigan, Ann Arbor(박사)	계열회사 임원	7
이귀호	여	1975.05	상무	상근	영상디스플레이 Service Business팀 담당임원	영상디스플레이 Service Business팀 담당부장	이화여대(학사)	계열회사 임원	54
이규영	남	1968.10	상무	상근	CSS사업팀 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
이규원	뱌	1974.03	상무	상근	DS부문 DSJ 담당임원	DS부문 일본총괄 담당부장	Waseda Univ.(석사)	계열회사 임원	54
이규철	남	1973.06	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생산기술연구소 수석	서울산업대(학사)	계열회사 임원	7
이근수	남	1970.12	상무	상근	상생협력센터 담당임원	상생협력센터 담당부장	세종대(학사)	계열회사 임원	
이기욱	남	1970.08	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	Mobile eXperience 품질혁신센 터 담당임원	동아대(학사)	계열회사 임원	
이기철	남	1972.11	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 Global Technology Service팀 담당임원	고려대(박사)	계열회사 임원	54
이남호	남	1972.02	상무	상근	DS부문 재경팀 담당임원	두산, 부문장	성균관대(박사)	계열회사 임원	42
이대성	남	1970.09	상무	상근	SCIC 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	Thunderbird(석사)	계열회사 임원	43
이동진	남	1971.01	상무	상근	영상디스플레이 Global제조팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 담당임 원	성균관대(학사)	계열회사 임원	43
이동하	남	1968.07	상무	상근	혁신센터 담당임원	DIT센터 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	55
이동헌	남	1972.09	상무	상근	DS부문 법무지원팀 담당임원	DS부문 법무지원팀 수석변호사	고려대(학사)	계열회사 임원	

이두희	'n	1973.11	상무	상근	SGE법인장	SEMAG법인장	단국대(석사)	계열회사 임원	19
이명재	남	1979.01	상무	상근	법무실 담당임원	법무실 수석변호사	HEC Paris(석사)	계열회사 임원	7
이명준	남	1976.07	상무	상근	DS부문 CTO 설비기술연구소 설비개발실 담당임원	DS부문 CTO 설비기술연구소 설비개발실 수석	Univ. of Arizona(박사)	계열회사 임원	8
이민	남	1978.03	상무	상근	혁신센터 담당임원	Microsoft, Principal Engineer	Georgia Inst. of Tech.(박 사)	계열회사 임원	3
이민철	남	1970.04	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅 실 담당임원	무선 PC사업팀 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
이범섭	남	1972.10	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	인하대(학사)	계열회사 임원	31
이병일	남	1983.07	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	19
이병진	남	1970.09	상무	상근	DS부문 법무지원팀 담당임원	DS부문 법무지원팀 수석변호사	Univ. Of Wisconsin, Madison(석사)	계열회사 임원	43
이병철	남	1972.11	상무	상근	의료기기 People팀장	Mobile eXperience People팀 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	31
이병한	남	1974.05	상무	상근	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	Univ. Of Wisconsin, Madison(학사)	계열회사 임원	19
이병헌	남	1974.11	상무	상근	기획팀 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅 실 담당임원	Manchester Business Sch.(석사)	계열회사 임원	31
이병현	남	1977.10	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	8
이보나	여	1973.02	상무	상근	생활가전 CX팀 담당임원	생활가전 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	31
이보람	여	1973.09	상무	상근	DS부문 상생협력센터 담당임원	World Bank, Senior Consultant	Univ. of Paris 6(박사)	계열회사 임원	2
이상수	남	1975.06	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	무선 개발실 수석	아주대(석사)	계열회사 임원	43
이상엽	남	1967.11	상무	상근	상생협력센터 담당임원	삼성물산, 상생협력팀 담당부장	서울대(학사)	계열회사 임원	19
이상용	남	1970.02	상무	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임 원	GCT Semiconductor, Senior Director	서울대(박사)	계열회사 임원	
이상욱	남	1972.08	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	무선 품질혁신센터 담당임원	금오공대(학사)	계열회사 임원	
이상육	남	1971.01	상무	상근	Mobile eXperience 품질혁신센 터 담당임원	무선 제품기술팀 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	
이상직	남	1970.06	상무	상근	SELA법인장	SEM-S법인장	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	
이상현	남	1970.09	상무	상근	DSRJ 담당임원	SCS 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	
이상호	남	1973.01	상무	상근	SAMCOL법인장	영상디스플레이 영상전략마케 팅팀 담당부장	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	19
이상희	남	1974.09	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 Mask개발팀장	반도체연구소 Mask개발팀 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	31
이석림	남	1974.03	상무	상근	SEAS법인장	생활가전 전략마케팅팀 담당임 원	Univ. of Southern	계열회사	31

		1		1	<u> </u>		I		1
이선웅	泊	1976.12	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅 실 담당임원	SEH-S법인장	서강대(학사)	계열회사 임원	7
이선화	Й	1975.08	상무	상근	글로벌마케팅실 CX·MDE센터 담당임원	CX·MDE센터 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	31
이성원	тo	1978.10	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임 원	Qualcomm, Sr. Staff Engineer	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	22
이성원	늄	1976.03	상무	상근	Samsung Research 차세대통 신연구센터 담당임원	네트워크 개발팀 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	43
이성재	늄	1974.12	상무	상근	Foundry Design Platform개발 실 담당임원	IBM, Principal Manager	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	33
이성준	计	1981.10	상무	상근	Foundry Corporate Planning실 담당임원	AMD, Director	Univ. of Illinois, Urbana- Champaign(박사)	계열회사 임원	9
이성훈	남	1975.11	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 Flash TD실 담당임원	반도체연구소 Flash TD실 수석	서울대(석사)	계열회사 임원	19
이수용	to	1968.03	상무	상근	DS부문 구매팀 담당임원	반도체연구소 공정개발실 담당 Master	한양대(석사)	계열회사 임원	23
이승관	计	1973.10	상무	상근	커뮤니케이션팀 담당임원	연합뉴스, 기자	고려대(학사)	계열회사 임원	53
이승목	늄	1973.09	상무	상근	SAIT People팀장	System LSI People팀장	고려대(학사)	계열회사 임원	
이승민	妆	1981.03	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당 임원	Meta, Principal Designer	MIT(석사)	계열회사 임원	9
이승준	妆	1974.04	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 Flash TD실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	한양대(석사)	계열회사 임원	19
이승철	山	1977.11	상무	상근	CSS사업팀 담당임원	DS부문 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	12
이승철	诒	1975.12	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	생활가전 지원팀 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	43
이승호	妆	1973.11	상무	상근	SEVT 담당임원	SEIN-P법인장	서울사이버대(학사)	계열회사 임원	43
이승환	妆	1971.05	상무	상근	CSS사업팀 담당임원	LED사업팀 수석	고려대(석사)	계열회사 임원	31
이승환	山	1980.07	상무	상근	네트워크 Global Technology Engineering팀 담당임원	네트워크 시스템솔루션팀 담당 임원	서울대(박사)	계열회사 임원	7
이승훈	山	1976.03	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공 정개발실 담당임원	반도체연구소 공정개발실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	19
이신재	山	1972.11	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	무선 개발실 담당부장	인하대(학사)	계열회사 임원	
이애영	Й	1968.12	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	Mobile eXperience 모바일플랫 폼센터 담당임원	포항공대(석사)	계열회사 임원	
이영아	Й	1983.03	상무	상근	생활가전 UX팀장	영상디스플레이 UX팀 수석	Carnegie Mellon Univ.(학사)	계열회사 임원	7
이영직	ÌO	1967.08	상무	상근	SEHA법인장	SEH-P법인장	아주대(학사)	계열회사 임원	
이영학	山	1974.09	상무	상근	혁신센터 담당임원	혁신센터 수석	포항공대(박사)	계열회사 임원	19
이우용	山	1975.10	상무	상근	SEDA-P(M) 담당임원	Mobile eXperience 지원팀 담 당부장	성균관대(학사)	계열회사 임원	19

이원용	站	1978.11	상무	상근	미래사업기획단 담당임원	SAIT 기획지원팀장	MIT(박사)	계열회사 임원	19
이윤경	여	1979.09	상무	상근	Big Data센터 담당임원	Samsung Research AI센터 수 석	Univ. of Illinois, Urbana- Champaign(박사)	계열회사 임원	43
이윤성	뱌	1971.09	상무	상근	메모리 품질실 담당임원	메모리 품질보증실 수석	서울대(석사)	계열회사 임원	43
이윤수	남	1975.11	상무	상근	Samsung Research Data Intelligence팀장	Samsung Research AI센터 수 석	Univ. of Maryland(박사)	계열회사 임원	43
이의형	남	1975.09	상무	상근	제조&기술담당 Foundry제조기 술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당부장	서울대(박사)	계열회사 임원	19
이재영	남	1974.11	상무	상근	사업지원T/F 담당임원	구주총괄 인사팀장	성균관대(석사)	계열회사 임원	54
이재호	남	1974.08	상무	상근	Global CS센터 담당임원	Global CS센터 담당부장	서강대(석사)	계열회사 임원	7
이재훈	남	1974.01	상무	상근	SERC 담당임원	SEUC법인장	연세대(학사)	계열회사 임원	31
이정노	남	1971.02	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임 원	영상디스플레이 담당임원	한양대(석사)	계열회사 임원	
이정숙	여	1972.12	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당 임원	무선 Mobile UX센터 담당임원	Berlin Art Univ.(석사)	계열회사 임원	58
이정원	남	1971.07	상무	상근	네트워크 Global제조팀장	네트워크 Global운영팀장	경북대(학사)	계열회사 임원	43
이정자	여	1969.04	상무	상근	제조&기술담당 메모리제조기술 센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라기술 센터 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	
이정주	남	1976.07	상무	상근	생활가전 CX팀 담당임원	P&G, Sr. Director	고려대(학사)	계열회사 임원	12
이정호	남	1974.11	상무	상근	한국총괄 People팀장	한국총괄 인사팀장	경북대(학사)	계열회사 임원	31
이종규	남	1970.02	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	무선 개발1실 수석	한양대(석사)	계열회사 임원	
이종민	남	1973.06	상무	상근	DS부문 지원팀 담당임원	사업지원T/F 담당임원	Univ. of Washington, Seattle(석사)	계열회사 임원	54
이종석	남	1973.02	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	Apple, CPU Micro Architect	Virginia Tech(박사)	계열회사 임원	20
이종우	남	1978.04	상무	상근	System LSI Design Platform개 발실 담당임원	System LSI 기반설계실 수석	Univ. of Michigan, Ann Arbor(박사)	계열회사 임원	
이종포	남	1974.10	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임 원	영상디스플레이 개발팀 수석	성균관대(석사)	계열회사 임원	54
이종필	남	1973.11	상무	상근	Systsem LSI SOC사업팀 AP개 발실 담당임원	System LSI Sensor사업팀 담당 임원	충남대(석사)	계열회사 임원	54
이종필	남	1972.11	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	무선 개발실 수석	경북대(석사)	계열회사 임원	54
이종호	남	1976.02	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 TP센 터 담당임원	TSP총괄 Package개발실 담당 임원	서울대(박사)	계열회사 임원	54
이준	남	1972.04	상무	상근	중동총괄 지원팀장	SEF 담당임원	Cornell Univ.(석사)	계열회사 임원	43
이준표	남	1971.06	상무	상근	생활가전 C&M사업팀장	생활가전 C&M사업팀 담당임원	Univ. of Maryland, College Park(박사)	계열회사 임원	32

이중원	남	1975.06	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	31
이지석	남	1978.04	상무	상근	제조&기술담당 Foundry제조기 술센터 담당임원	LAM Research, Director	Stanford Univ.(박사수료)	계열회사 임원	11
이지수	남	1976.02	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당 임원	무선 개발실 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박 사)	계열회사 임원	
이지영	여	1976.08	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당 임원	무선 CX실 수석	제주대(학사)	계열회사 임원	31
이지훈	남	1970.11	상무	상근	SECA법인장	SEA 담당임원	State Univ. of New York, Stony Brook(석사)	계열회사 임원	54
이지훈	남	1976.02	상무	상근	구주총괄 지원팀장	SEG 담당임원	Northwestern Univ.(석사)	계열회사 임원	43
이진우	남	1979.01	상무	상근	네트워크 Global Technology Engineering팀 담당임원	네트워크 개발팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	31
이진욱	남	1972.01	상무	상근	DS부문 DS대외협력팀 담당임 원	DS부문 상생협력센터 담당임원	아주대(석사)	계열회사 임원	31
이진원	남	1973.03	상무	상근	생활가전 Global CS팀 담당임 원	생활가전 Global CS팀 담당부 장	서울대(박사)	계열회사 임원	54
이창엽	남	1970.04	상무	상근	System LSI Sensor사업팀 담당 임원	DS부문 DSC 담당임원	영남대(학사)	계열회사 임원	
이창원	뱌	1972.03	상무	상근	한국총괄 MX팀 담당임원	한국총괄 IM영업팀 담당임원	Pennsylvania State Univ.(석사)	계열회사 임원	31
이치훈	뱌	1969.08	상무	상근	DS부문 People팀 담당임원	제조&기술담당 Foundry제조기 술센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
이태호	남	1974.05	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 수석	원광대(석사)	계열회사 임원	7
이한용	남	1976.05	상무	상근	법무실 IP센터 담당임원	김앤장, Sr.Foreign Attorney	George Washington Univ.(석사)	계열회사 임원	28
이한형	남	1968.09	상무	상근	한국총괄 B2B팀 담당임원	한국총괄 CE영업팀 담당임원	경희대(학사)	계열회사 임원	
이혁	남	1973.02	상무	상근	기획팀 담당임원	Bloom T/F 담당임원	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	13
이현동	남	1972.02	상무	상근	SESAR법인장	SELV법인장	영남대(학사)	계열회사 임원	31
이현수	남	1980.12	상무	상근	영상디스플레이 CX팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 수석	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	7
이현우	남	1974.10	상무	상근	People팀 담당임원	인사팀 담당임원	경북대(석사)	계열회사 임원	43
이현정	여	1977.12	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공 정개발실 담당임원	반도체연구소 공정개발실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	19
이현정	여	1971.11	상무	상근	SCIC 담당임원	한국총괄 마케팅팀 담당임원	고려대(박사)	계열회사 임원	31
이호	남	1972.07	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	Foundry 기술개발실 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	43
이호신	남	1970.12	상무	상근	법무실 IP센터 담당임원	법무실 IP센터 책임변호사	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	
이홍빈	남	1964.04	상무	상근	SSEC법인장	생활가전 Global제조팀 담당임 원	명지대(학사)	계열회사 임원	

				1					
이화성	남	1970.09	상무	상근	제조&기술담당 Foundry제조기 술센터 담당임원	Foundry 기술개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
이훈신	to	1974.09	상무	상근	Global EHS실 담당임원	Global EHS센터 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	30
이희윤	남	1968.08	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 글로 벌EHS/인프라센터장	글로벌 제조&인프라총괄 인프 라기술센터 담당임원	부산수산대(학사)	계열회사 임원	
임산	남	1973.03	상무	상근	메모리 상품기획실 담당임원	메모리 기획팀 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	31
임성수	남	1978.11	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 DRAM TD실 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	54
임순규	남	1979.07	상무	상근	사업지원T/F 담당임원	삼성디스플레이, 대형 지원팀장	고려대(학사)	계열회사 임원	19
임아영	여	1974.09	상무	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임 원	네트워크 전략마케팅팀 담당부 장	City Univ. of New York(석 사)	계열회사 임원	43
임영수	남	1969.06	상무	상근	한국총괄 B2B팀 담당임원	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	영남대(학사)	계열회사 임원	
임윤모	남	1977.10	상무	상근	생활가전 구매팀 담당임원	생활가전 구매팀 담당부장	인하대(학사)	계열회사 임원	7
임재우	남	1973.04	상무	상근	메모리 Design Platform개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	한양대(석사)	계열회사 임원	43
임전식	남	1969.08	상무	상근	제조&기술담당 메모리제조기술 센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터 담당임원	전북대(학사)	계열회사 임원	
임지훈	남	1972.12	상무	상근	Mobile eXperience 마케팅팀 담당임원	Mobile eXperience 전략마케팅 실 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	48
임휘용	남	1965.02	상무	상근	인재개발원 담당임원	네트워크 인사팀장	서강대(학사)	계열회사 임원	
장경모	남	1977.10	상무	상근	SEG 담당임원	구주총괄 지원팀 담당부장	연세대(학사)	계열회사 임원	7
장경훈	남	1970.02	상무	상근	DX부문 CTO 담당임원	Samsung Research Robot센 터 담당임원	고려대(박사)	계열회사 임원	
장세정	남	1974.04	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임 원	메모리 품질실 담당임원	서울대(학사)	계열회사 임원	54
장소연	여	1971.06	상무	상근	한국총괄 마케팅팀 담당임원	Mobile eXperience 마케팅팀 담당임원	이화여대(학사)	계열회사 임원	
장순복	여	1977.04	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임 원	메모리 Solution개발실 수석	부산대(학사)	계열회사 임원	43
장실완	남	1973.02	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임 원	메모리 Solution개발실 수석	서울대(학사)	계열회사 임원	
장용	남	1970.03	상무	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임 원	무선 Global Mobile B2B팀 담 당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
장우영	남	1973.02	상무	상근	의료기기 DR사업팀장	의료기기 Global CS팀장	서울대(박사수료)	계열회사 임원	43
장욱	남	1973.11	상무	상근	SEJ법인장	SEJ 담당임원	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	19
장윤희	남	1974.09	상무	상근	SIEL-P(N) 담당임원	Mobile eXperience Global제조 센터 담당부장	Emory Univ.(석사)	계열회사 임원	19
장인갑	남	1975.06	상무	상근	메모리 품질실 담당임원	메모리 품질보증실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	31

장정렬	如	1977.01	상무	상근	SIEL-S 담당임원	네트워크 개발팀 수석	중앙대(석사)	계열회사 임원	19
장준희	남	1974.01	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅 실 담당임원	SEASA법인장	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	43
장지호	남	1970.09	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	GCT, VP	서울대(박사)	계열회사 임원	47
장흥민	남	1972.06	상무	상근	Global CS센터 담당임원	동남아총괄 CS팀장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	19
저메인클 라우제	남	1982.08	상무	상근	동남아총괄 지원팀 담당임원	영상디스플레이 영상전략마케 팅팀 담당임원	Harvard Univ.(석사)	계열회사 임원	19
전대호	남	1971.01	상무	상근	제조&기술담당 People팀장	반도체연구소 인사팀장	아주대(석사)	계열회사 임원	43
전범준	남	1976.07	상무	상근	DS부문 CTO 기술기획팀 담당 임원	Foundry 지원팀 담당임원	Southern Methodist Univ.(석사)	계열회사 임원	19
전병권	남	1967.02	상무	상근	SAMEX법인장	영상디스플레이 Global운영팀 담당임원	전북대(학사)	계열회사 임원	
전상욱	남	1980.08	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	Mobile eXperience 개발실 수	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	19
전성훈	남	1977.01	상무	상근	메모리 Solution개발실 당당임 원	메모리 Solution개발실 수석	연세대(박사)	계열회사 임원	31
전소영	여	1974.05	상무	상근	IR팀 담당임원	SEA 담당임원	Univ. of Texas, Dallas(석사)	계열회사 임원	43
전승수	뱌	1976.07	상무	상근	디바이스플랫폼센터 담당임원	생활가전 담당임원	고려대(박사)	계열회사 임원	43
전승훈	남	1971.08	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	Mobile eXperience 모바일플랫 폼센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
전영우	남	1974.12	상무	상근	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원	HP, Director	York Univ.(석사)	계열회사 임원	4
전지환	남	1977.10	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임 원	System LSI 전략마케팅실 수석	Univ. Of Texas, Austin(박 사)	계열회사 임원	19
전진규	남	1974.05	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임 원	SENA 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	43
전진완	남	1974.03	상무	상근	메모리 Solution개발실 당당임 원	메모리 전략마케팅실 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	43
전형민	남	1974.03	상무	상근	SEAU 담당임원	SENZ법인장	중앙대(학사)	계열회사 임원	7
전형준	남	1972.10	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅 실 담당임원	Mobile eXperience 온라인 Biz센터 담당임원	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	22
전희정	여	1977.09	상무	상근	AVP사업팀 Corporate Planning실 담당임원	Intel, Director	Arizona State Univ.(박사)	계열회사 임원	5
정강일	남	1974.10	상무	상근	영상디스플레이 담당임원	영상디스플레이 CX팀 담당임원	Illinois Inst. of Tech.(석사)	계열회사 임원	31
정광민	남	1971.07	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅 실 담당임원	SEPR법인장	부산대(학사)	계열회사 임원	31
정광섭	남	1970.04	상무	상근	재경팀 담당임원	삼성물산, 경영정보팀 수석	한양대(석사)	계열회사 임원	31
정광희	남	1971.08	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	DS부문 DSC 담당임원	Tsinghua Univ.(석사)	계열회사 임원	

정기호	남	1973.08	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임 원	생활가전 CX팀 담당임원	한국해양대(학사)	계열회사 임원	31
정다운	妆	1980.09	상무	상근	혁신센터 담당임원	메모리 Solution개발실 담당임 원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	54
정덕우	남	1976.12	상무	상근	네트워크 선행개발팀 담당임원	Palo Alto Networks, Sr. Principal	Yale Univ.(박사)	계열회사 임원	4
정문일	남	1971.01	상무	상근	상생협력센터 담당임원	법무법인 지평, 전문위원	숭실대(학사)	계열회사 임원	33
정상일	남	1967.09	상무	상근	제조&기술담당 Sensor제조기 술팀 담당임원	제조&기술담당 Foundry제조기 술센터 담당임원	중앙대(학사)	계열회사 임원	
정석희	to	1975.01	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	Mobile eXperience 개발실 수 석	고려대(석사)	계열회사 임원	7
정성원	남	1974.07	상무	상근	메모리 Global운영팀장	메모리 Global운영팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	31
정성원	늄	1971.12	상무	상근	SEWA법인장	SCA법인장	고려대(학사)	계열회사 임원	31
정성훈	남	1976.01	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 전략마케팅실 수석	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	8
정세환	남	1973.10	상무	상근	한국총괄 B2B팀 담당임원	한국총괄 B2B팀 담당부장	한국해양대(학사)	계열회사 임원	7
정승목	남	1969.05	상무	상근	중국전략협력실 담당임원	중국전략협력실 담당임원	Thunderbird(석사)	계열회사 임원	
정승일	남	1973.08	상무	상근	SELS법인장	경영혁신센터 담당임원	Indiana Univ., Bloomington(석사)	계열회사 임원	19
정승진	남	1972.11	상무	상근	메모리 품질실 담당임원	메모리 Solution개발실 담당임 원	서울대(석사)	계열회사 임원	43
정신영	여	1973.03	상무	상근	Foundry 품질팀 담당임원	Foundry 제품기술팀 수석	Univ. of Florida(석사)	계열회사 임원	31
정연일	남	1975.06	상무	상근	AVP사업팀 Corporate Planning실 담당임원	DS부문 기획팀 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	19
정영환	남	1971.08	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅 실 담당임원	SCIC 담당임원	복단대(석사)	계열회사 임원	19
정용덕	남	1976.09	상무	상근	제조&기술담당 Common Tech센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	43
정원석	늄	1971.07	상무	상근	DS부문 상생협력센터 담당임원	상생협력센터 담당임원	한양대(학사)	계열회사 임원	54
정원철	남	1973.12	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 Logic TD실 담당임원	반도체연구소 Logic TD실 담당 임원	서울대(박사)	계열회사 임원	54
정유진	Й	1970.06	상무	상근	SENA법인장	생활가전 전략마케팅팀 담당임 원	서강대(석사)	계열회사 임원	
정윤찬	남	1968.09	상무	상근	상생협력센터 담당임원	베트남복합단지 담당임원	성균관대(학사)	계열회사 임원	
정의철	ÌO	1969.12	상무	상근	Mobile eXperience 품질혁신센 터 담당임원	무선 제품기술팀 담당임원	Seattle Pacific Univ.(학사)	계열회사 임원	54
정인호	남	1970.11	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프 라기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라기술 센터 담당임원	인하대(학사)	계열회사 임원	54
정인호	남	1975.02	상무	상근	TSP총괄 지원팀장	사업지원T/F 담당임원	MIT(석사)	계열회사 임원	54

정인희	여	1974.09	상무	상근	지속가능경영추진센터 담당임 원	LG화학, Expert Advisor	Imperial College(석사)	계열회사 임원	31
정일규	늄	1968.05	상무	상근	DS부문 DSA 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임원	광운대(학사)	계열회사 임원	
정일룡	тo	1970.10	상무	상근	DS부문 재경팀 담당임원	DS부문 재경팀 담당부장	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	31
정재용	늄	1973.09	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	43
정주영	늄	1977.07	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	카카오엔터프라이즈, 부사장	서강대(학사)	계열회사 임원	6
정준수	늄	1970.09	상무	상근	SEEG-P법인장	SERK법인장	영남대(학사)	계열회사 임원	31
정지은	여	1974.05	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임 원	생활가전 전략마케팅팀 담당부 장	Northwestern Univ.(석사)	계열회사 임원	
정직한	山	1974.11	상무	상근	Mobile eXperience 서비스 Biz팀 담당임원	Mythical Games, VP	Stanford Univ.(석사)	계열회사 임원	9
정진희	여	1977.11	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임 원	영상디스플레이 Customer Marketing팀 담당부장	전남대(학사)	계열회사 임원	7
정춘화	山	1974.09	상무	상근	제조&기술담당 메모리제조기술 센터 담당임원	제조&기술담당 메모리제조기술 센터 수석	고려대(학사)	계열회사 임원	8
정한기	山	1976.05	상무	상근	AVP사업팀 AVP개발실 담당임 원	TSP총괄 Package개발실 수석	서울대(석사)	계열회사 임원	19
정혁준	山	1974.09	상무	상근	생활가전 광주지원센터장	생활가전 광주지원센터 담당부 장	전남대(학사)	계열회사 임원	31
정홍욱	油	1977.10	상무	상근	커뮤니케이션팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당부장	Hitotsubashi Univ.(석사)	계열회사 임원	7
제이콥	山	1978.11	상무	상근	DS부문 DSC 담당임원	DS부문 중국총괄 VP	中國科學技術大學(석사)	계열회사 임원	54
제임스휘 슬러	늄	1972.10	상무	상근	SEA 담당임원	SEA SVP	Ward Melville High School(고교)	계열회사 임원	31
제희원	늄	1978.09	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임 원	System LSI CP개발실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	19
조강욱	油	1977.08	상무	상근	북미총괄 지원팀장	동남아총괄 지원팀장	성균관대(학사)	계열회사 임원	19
조근수	山	1976.06	상무	상근	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	7
조근휘	油	1974.02	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 Logic TD실 담당임원	DS부문 CTO 반도체연구소 Logic TD실 수석	고려대(박사)	계열회사 임원	8
조나단림	山	1976.12	상무	상근	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원	Microsoft, Sales Director	Cornell Univ.(석사)	계열회사 임원	10
조미선	여	1980.04	상무	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임 원	Ericsson, VP	한국외국어대(학사)	계열회사 임원	18
조성일	<u> 10</u>	1973.12	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 TP센 터 담당임원	TSP총괄 TP센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
조성제	山	1977.04	상무	상근	People팀 담당임원	People팀 담당부장	Michigan State Univ.(석사)	계열회사 임원	19
조성훈	ᆲ	1976.01	상무	상근	People팀 담당임원	생활가전 People팀장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	54

조성희	남	1974.08	상무	상근	SRI-Delhi연구소장	영상디스플레이 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	19
조영석	남	1976.11	상무	상근	전장사업팀 담당임원	재경팀 담당임원	고려대(학사)	계열회사 임원	19
조영진	남	1979.06	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임 원	메모리 Solution개발실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	19
조용호	남	1970.03	상무	상근	메모리 상품기획실 담당임원	DS부문 미주총괄 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
조욱래	남	1972.03	상무	상근	제조&기술담당 지원팀장	DS부문 재경팀 담당임원	Purdue Univ.(석사)	계열회사 임원	43
조유미	여	1971.09	상무	상근	DS부문 글로벌마컴팀장	메모리 전략마케팅실 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	43
조유성	남	1971.06	상무	상근	Global EHS실 담당임원	Global EHS센터 담당임원	서울과학기술대(석사)	계열회사 임원	43
조은경	여	1970.08	상무	상근	Mobile eXperience 마케팅팀 담당임원	삼성카드, 신용관리담당	성균관대(석사)	계열회사 임원	7
조익현	남	1972.01	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	무선 개발실 수석	성균관대(석사)	계열회사 임원	43
조종욱	남	1969.08	상무	상근	상생협력센터 담당임원	삼성바이오에피스, 인사팀장	성균관대(학사)	계열회사 임원	31
조지호	남	1972.04	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	부산대(학사)	계열회사 임원	31
조철민	남	1971.03	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임 원	System LSI SOC개발실 수석	고려대(석사)	계열회사 임원	54
조철용	남	1975.08	상무	상근	영상디스플레이 디자인팀장	영상디스플레이 디자인팀 수석	홍익대(학사)	계열회사 임원	19
조철형	남	1971.03	상무	상근	SEDA-P(M)공장장	글로벌기술센터 담당임원	충북대(학사)	계열회사 임원	43
조철호	남	1971.07	상무	상근	SETK법인장	Mobile eXperience 마케팅팀	Univ. of Southern	계열회사	
						담당임원	California(석사)	임원	
조현덕	남	1974.05	상무	상근	메모리 상품기획실 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당부장	경북대(석사)	계열회사 임원	19
조호근	남	1977.11	상무	상근	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	Univ. Of California, LA(석 사)	계열회사 임원	19
조훈영	남	1973.08	상무	상근	Samsing Research Global 시센터 담당임원	NC Soft, Lab장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	29
조희권	남	1976.06	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	SEA 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	43
존테일러	남	1968.04	상무	상근	SAS 담당임원	SAS VP	Univ. of New Hampshire(학사)	계열회사 임원	
주재완	남	1968.02	상무	상근	생활가전 담당임원	생활가전 개발팀 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
주현태	남	1972.12	상무	상근	TSE-P법인장	생활가전 Global제조팀 담당임 원	울산대(학사)	계열회사 임원	31
주형빈	남	1973.06	상무	상근	영상디스플레이 영상전략마케 팅팀 담당임원	SESAR법인장	경희대(학사)	계열회사 임원	43
지송하	여	1973.01	상무	상근	글로벌마케팅실 글로벌브랜드 센터 담당임원	영상디스플레이 영상전략마케 팅팀 담당임원	이화여대(학사)	계열회사 임원	

									ı
지혜령	여	1972.04	상무	상근	커뮤니케이션팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당부장	Univ. of Michigan, Ann Arbor(석사)	계열회사 임원	
진영두	남	1972.06	상무	상근	생활가전 S/W개발팀 담당임원	Mobile eXperience사업부 개발 실 수석	동아대(학사)	계열회사 임원	19
차도헌	남	1973.04	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	Mobile eXperience 담당임원	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	54
차이위엔 천	남	1968.01	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	TEXAS INSTRUMENTS, Selection Manager	NTUST(석사)	계열회사 임원	21
찰리장	남	1973.10	상무	상근	Samsung Research 차세대통 신연구센터 담당임원	SRA SVP	Univ. of Wisconsin, Madison(박사)	계열회사 임원	7
채동혁	남	1973.10	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	세미브레인, 팀장	서울대(석사)	계열회사 임원	14
천기철	남	1970.09	상무	상근	DS부문 DSC 담당임원	메모리 품질보증실 담당임원	Univ. Of Minnesota, Twin Cities(박사)	계열회사 임원	43
천상필	남	1969.05	상무	상근	서남아총괄 대외협력팀장	Global Public Affairs실 담당임 원	서울대(석사)	계열회사 임원	54
천홍문	남	1976.02	상무	상근	Mobile eXperience 품질혁신센 터 담당임원	Mobile eXperience 품질혁신센 터 수석	단국대(학사)	계열회사 임원	7
최경수	남	1971.12	상무	상근	감사팀 담당임원	상생협력센터 담당임원	경북대(학사)	계열회사 임원	43
최기화	남	1969.03	상무	상근	네트워크 Global Technology Engineering팀 담당임원	네트워크 시스템솔루션팀 담당 임원	Carnegie Mellon Univ.(박사)	계열회사 임원	
최명진	남	1974.06	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	경영혁신센터 담당부장	고려대(석사)	계열회사 임원	7
최민기	남	1977.10	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	Mobile eXperience 개발실 담 당부장	Univ. of Wisconsin, Madison(박사)	계열회사 임원	7
최병철	남	1971.06	상무	상근	영상디스플레이 Global운영팀 장	영상디스플레이 지원팀 담당임	성균관대(석사)	계열회사 임원	43
최병희	남	1970.05	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅 실 담당임원	SETK법인장	경북대(학사)	계열회사 임원	43
최삼종	남	1973.03	상무	상근	제조&기술담당 Common Tech센터 담당임원	제조담당 메모리제조기술센터 담당임원	한양대(박사)	계열회사 임원	43
최상선	남	1975.03	상무	상근	Big Data센터 담당임원	Big Data센터 수석	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	7
최서림	남	1972.02	상무	상근	DS부문 감사팀 담당임원	설비기술연구소 기획지원팀장	서울대(석사)	계열회사 임원	31
최선일	남	1971.11	상무	상근	System LSI Design Platform개 발실 담당임원	System LSI AP개발실 담당임원	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	31
최성욱	남	1969.02	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	글로벌기술센터 담당임원	삼성전자공과대학(전문대)	계열회사 임원	
최승림	남	1972.02	상무	상근	CIS총괄 지원팀장	재경팀 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	31
최연호	남	1975.03	상무	상근	영상디스플레이 지원팀 담당임 원	영상디스플레이 지원팀 담당부 장	연세대(학사)	계열회사 임원	7
최영	남	1969.07	상무	상근	한국총괄 MX팀 담당임원	한국총괄 IM영업팀 담당임원	항공대(학사)	계열회사 임원	
최영일	남	1973.08	상무	상근	SAS 담당임원	Foundry 지원팀 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	43

							1		
최영준	남	1967.09	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임 원	LG전자, 자문역	Univ. of Minnesota, Twin Cities(석사)	계열회사 임원	47
최원경	여	1973.08	상무	상근	AVP사업팀 AVP개발실 담당임 원	TSP총괄 Package개발실 담당 임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	54
최원서	남	1977.02	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	Mobile eXperience 개발실 수 석	서울대(석사)	계열회사 임원	7
최원호	남	1981.02	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	Western Digital, Sr. Technologist	Univ. Of Minnesota, Twin Cities(박사)	계열회사 임원	6
최유라	여	1978.12	상무	상근	DS부문 경영지원실 담당임원	삼성전기 혁신센터장	IMD(석사)	계열회사 임원	7
최유진	여	1979.06	상무	상근	영상디스플레이 UX팀장	영상디스플레이 UX팀 수석	Illinois Inst. of Tech.(석사)	계열회사 임원	31
최윤석	남	1974.09	상무	상근	TSP총괄 Package개발실 담당 임원	TSP총괄 Package개발실 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	43
최윤성	남	1975.05	상무	상근	System LSI Global Operation실 담당임원	Qualcomm, Sr. Staff Engineer	Univ. of Florida(박사)	계열회사 임원	2
최인수	남	1973.02	상무	상근	메모리 상품기획실 담당임원	메모리 전략마케팅실 수석	연세대(석사)	계열회사 임원	19
최일환	남	1972.11	상무	상근	Big Data센터 담당임원	Big Data센터 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	31
최장석	남	1973.06	상무	상근	메모리 상품기획실 담당임원	메모리 전략마케팅실 수석	충남대(학사)	계열회사 임원	19
최재혁	남	1974.06	상무	상근	Mobile eXperience 지원팀 담 당임원	사업지원T/F 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	43
최정연	남	1974.11	상무	상근	메모리 Design Platform개발실 담당임원	Foundry Design Platform개발 실 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	
최정화	남	1973.01	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임 원	영상디스플레이 개발팀 수석	한양대(석사)	계열회사 임원	19
최종근	to	1978.01	상무	상근	SAIT 기획지원팀장	사업지원T/F 담당부장	MIT(석사)	계열회사 임원	8
최종무	to	1975.08	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	무선 개발실 수석	아주대(석사)	계열회사 임원	43
최종민	邙	1976.05	상무	상근	Mobile eXperience Digital Health팀 담당임원	Mobile eXperience Digital Health팀 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	7
최진필	邙	1973.04	상무	상근	SCS 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터 담당임원	연세대(박사)	계열회사 임원	54
최창훈	ůo	1972.02	상무	상근	제조&기술담당 Common Tech센터 담당임원	생산기술연구소 설비개발실 담 당임원	서울시립대(박사)	계열회사 임원	
최창훈	남	1973.08	상무	상근	SIEL-S 담당임원	영상디스플레이 영상전략마케 팅팀 담당부장	인하대(학사)	계열회사 임원	31
최철민	뱌	1973.09	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	무선 개발2실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
최철환	ůo	1974.04	상무	상근	제조&기술담당 메모리제조기술 센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 메모 리제조기술센터 수석	홍익대(학사)	계열회사 임원	19
최청호	뱌	1976.11	상무	상근	법무실 담당임원	광장, 변호사	경북대(학사)	계열회사 임원	18
최혁승	남	1976.04	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	Mobile eXperience 모바일플랫 폼센터 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	19

						7 7 7 7 0 1 1 1 1 0 7 W.C.		311 OH =1 1.1	
최현호	남	1979.06	상무	상근	SAIT Material Research	종합기술원 Material연구센터	서울대(박사)	계열회사	43
					Center 담당임원	수석		임원	
최호규	남	1968.12	상무	상근	글로벌마케팅실 CX·MDE센터	CX·MDE센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사	43
					담당임원			임원	
최호석	남	1978.01	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담	Morgan Stanley, VP	Univ. of Southern	계열회사	5
					당임원	,,	California(석사)	임원	
최효석	남	1981.02	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소 공	DS부문 CTO 반도체연구소 공	서울대(박사)	계열회사	8
		1001102		0 2	정개발실 담당임원	정개발실 수석	712 91(1717)	임원	
추민기	남	1975.10	상무	상근	SECE법인장	SEUZ법인장	서강대(학사)	계열회사	19
727	0	1975.10	0 T	0 _	SCOLUE 28	000000000000000000000000000000000000000	M & UI(= N)	임원	15
÷ 01 A		1070 10	41.0	41.7	OCDOOHIO TI	OCNZHOLTI	Univ. of California, LA(석	계열회사	0.1
추민수	남	1973.10	상무	상근	SEPCO법인장	SENZ법인장	사)	임원	31
카리야타								계열회사	
카시	남	1969.02	상무	상근	DS부문 DSRJ 담당임원	TDK, 총괄부장	[東北大(박사)	임원	20
코너피어								계열회사	
스	남	1970.04	상무	상근	SEPOL법인장	SEUK 담당임원	Univ. of Dublin(석사)	임원	
_								계열회사	
하경수	남	1979.04	상무	상근	메모리 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	임원	31
								계열회사	
하헌재	남	1970.08	상무	상근	DS부문 People팀 담당임원	DS부문 People팀 담당부장	광운대(학사)		19
					0 0			임원	
하헌재	남	1984.02	상무	상근	Samsung Research SoC	Meta, H/W System Engineer	Stanford Univ.(박사)	계열회사	5
					Architecture팀 담당임원			임원	
한규희	남	1974.01	상무	상근	DS부문 CTO 설비기술연구소	생산기술연구소 수석	서울대(박사)	계열회사	31
					설비개발실 담당임원			임원	
한글라라	여	1976.02	상무	상근	영상디스플레이 구매팀 담당임	영상디스플레이 구매팀 담당부	경희대(학사)	계열회사	19
					원	장		임원	
한상섭	남	1972.04	상무	상근	북미총괄 CS팀장	Global CS센터 담당임원	광운대(석사)	계열회사	31
)	1072.01	5	0.2	10102 0000	G10501 0025 1 1 0 1 2	3 E GI (1717)	임원	0
한상연	남	1969.01	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소	반도체연구소 메모리 TD실 담	한국과학기술원(박사)	계열회사	
505	0	1303.01	0 T	0 _	DRAM TD실 담당임원	당임원	한국파학기술한(학자)	임원	
-1.1.C		1071.00			Mobile eXperience 개발실 담	Mobile eXperience 개발실 수	Univ. of Texas, Austin(박	계열회사	10
한상욱	남	1974.02	상무	상근	당임원	석	사)	임원	19
								계열회사	
한석근	남	1978.09	상무	상근	SESK법인장	SERK법인장	경기대(학사) 	임원	7
					Mobile eXperience 전략마케팅		State Univ. of New York,	계열회사	
한의택	남	1974.02	상무	상근	실 담당임원	SIEL-S 담당임원	Stony Brook(석사)	임원	54
							State Univ. of New York,	계열회사	
한장수	남	1970.02	상무	상근	북미총괄 법무지원팀장	무선 지원팀 담당임원	Buffalo(박사)	임원	
					제조&기술담당 Foundry제조기	글로벌인프라총괄 Foundry제조	Danialo (1747)	계열회사	
한정남	남	1973.01	상무	상근	술센터 담당임원		한국과학기술원(박사)	임원	
					영상디스플레이 지원팀 담당임	기술센터 담당임원		계열회사	
한종호	남	1976.01	상무	상근		SEG 담당임원	Vanderbilt Univ.(석사)		43
					원			임원	
한진규	남	1973.12	상무	상근	Samsung Research 차세대통	Samsung Research 수석	연세대(박사)	계열회사	54
					신연구센터 담당임원			임원	
한진우	남	1980.07	상무	상근	DS부문 CTO 반도체연구소	NASA, Senior Scientist	한국과학기술원(박사)	계열회사	26
					DRAM TD실 담당임원			임원	
함선규	남	1970.01	상무	상근	중남미총괄 지원팀장	SRA 담당임원	Washington Univ. in St.	계열회사	
							Louis(석사)	임원	
				-	•	•			

	1	1					1	1	1
허욱	남	1972.05	상무	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임 원	네트워크 전략마케팅팀 담당부 장	Waseda Univ.(학사)	계열회사 임원	19
허일정	남	1978.05	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 EHS/인프라기술연구소 담당임 원	글로벌 제조&인프라총괄 EHS연구소 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	20
허정철	남	1971.08	상무	상근	Mobile eXperience 품질혁신센 터 담당임원	Mobile eXperience 품질혁신센 터 수석	연세대(석사)	계열회사 임원	7
허준	늄	1972.08	상무	상근	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원	SEA 담당임원	한양대(석사)	계열회사 임원	19
허준영	诒	1977.02	상무	상근	네트워크 People팀장	구주총괄 인사팀장	연세대(학사)	계열회사 임원	31
허준회	†o	1979.03	상	상근	System LSI SOC사업팀 담당임 원	System LSI 기반설계실 담당임 원	Georgia Inst. of Tech.(박 사)	계열회사 임원	36
허지영	늄	1970.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 EHS센터 담당임원	글로벌인프라총괄 환경안전센 터 담당임원	부산대(학사)	계열회사 임원	
허진욱	남	1971.09	상무	상근	Global CS센터 담당임원	북미총괄 CS팀장	한양대(박사)	계열회사 임원	43
허태영	남	1970.11	상무	상근	글로벌마케팅실 CX·MDE센터 담당임원	영상디스플레이 CX팀장	Univ. of California, LA(학 사)	계열회사 임원	
허훈	남	1974.08	상무	상근	SECA 담당임원	네트워크 개발팀 당당임원	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	43
헨릭얀손	남	1975.03	상무	상근	네트워크 담당임원	Ericsson, VP	Chalmers Univ.(석사)	계열회사 임원	18
현대은	남	1975.10	상무	상근	영상디스플레이 CX팀 담당임원	영상디스플레이 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	43
현재웅	남	1975.09	상무	상근	메모리 상품기획실 담당임원	Fusion-io, Fellow	RPI(석사)	계열회사 임원	11
현정혁	남	1977.09	상무	상근	제조&기술담당 메모리제조기술 센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 메모 리제조기술센터 수석	성균관대(학사)	계열회사 임원	19
홍기준	남	1971.05	상무	상근	System LSI SOC사업팀 담당임 원	System LSI SOC개발실 담당임 원	Columbia Univ.(석사)	계열회사 임원	
홍순상	늄	1972.08	상무	상근	Mobile eXperience 서비스 Biz팀 담당임원	무선 서비스Biz팀 담당부장	연세대(학사)	계열회사 임원	31
홍연석	늄	1972.01	상무	상근	Mobile eXperience Global제조 센터 담당임원	SEIN-P법인장	경북대(석사)	계열회사 임원	31
홍영주	to	1977.08	상무	상근	네트워크 지원팀 담당임원	사업지원T/F 담당부장	서울대(학사)	계열회사 임원	31
홍유석	늄	1972.12	상무	상근	법무실 담당임원	법무실 책임변호사	Univ. of Notre Dame(석사)	계열회사 임원	
홍정호	Ì0	1969.02	상무	상근	SEF 담당임원	의료기기 지원팀장	Univ. of Washington, Seattle(석사)	계열회사 임원	
홍주선	ÌO	1971.10	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	영상디스플레이 Global운영팀 담당임원	경희대(석사)	계열회사 임원	
홍준식	늄	1971.12	상무	상근	제조&기술담당 메모리제조기술 센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터 담당임원	전북대(석사)	계열회사 임원	43
홍희일	남	1970.10	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	한양대(석사)	계열회사 임원	54

황근철	남	1973.03	상무	상근	네트워크 Global Technology Engineering팀장	네트워크 시스템솔루션팀장	서울대(박사)	계열회사 임원	54
황근하	油	1970.05	상무	상근	영상디스플레이 Global제조팀 장	영상디스플레이 Global제조팀 담당임원	아주대(학사)	계열회사 임원	
황보용	山	1970.10	상무	상근	기획팀 담당임원	창의개발센터장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
황성훈	늄	1969.07	상무	상근	Global CS센터 담당임원	Global CS센터 담당부장	한양대(석사)	계열회사 임원	
황영삼	山	1977.10	상무	상근	동남아총괄 People팀장	People팀 담당부장	한양대(학사)	계열회사 임원	19
황용호	山	1975.10	상무	상근	Samsung Research Security&Privacy팀장	Samsung Research Security팀 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	54
황일권	泊	1973.12	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	생산기술연구소 담당부장	고려대(석사)	계열회사 임원	19
항 당 (왕)	泊	1967.01	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 EHS센터 담당임원	글로벌인프라총괄 환경안전센 터 담당임원	Imperial College(박사)	계열회사 임원	43

[※] 미등기임원 소유주식수는 작성기준일 현재 보통주(의결권 있는 주식)97,928,917주(이재용 회장 97,414,196주 등),

우선주(의결권 없는 주식) 194,313주(이재용 회장 137,757주 등)이며, 작성기준일 이후 변동은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)의 '임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서' 등을 참조하십시오.

- ※ 최대주주와의 관계는「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」제3조 제1항에 기재되어 있는 관계를 참고하여 기재하였습니다.
- ※ 재직기간은 기업공시서식 작성기준에 따라 미등기임원으로서 5년 이상 회사에 계속 재직해온 경우에는 기재를 생략하였습니다.

라.미등기임원의 변동

작성기준일 이후 보고서 제출일 현재까지 변동된 미등기임원은 다음과 같습니다.

구분 (사유)	성명	성별	출생연월	직위	담당업무	최대주주와의 관계
임원선임	최항석	남	1969.01	상무	생활가전 Air Solution Business팀장	계열회사 임원
	홍준화	남	1974.05	상무	영상디스플레이 Customer Marketing팀 담당임 원	계열회사 임원

[※] 최대주주와의 관계는「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」제3조 제1항에 기재되어 있는 관계를 참고하여 기재하였습니다.

마. 직원 등의 현황

(기준일: 2024년 06월 30일) (단위: 백만원)

직원										소속 5			
		직 원 수											
		기간의 정힘	101	기간제									비고
사업부문	성별	없는 근로지	ŀ	근로자		el 211	평 균		1인평균	남	여	계	
			(단시간		(단시간	합계	근속연수	총 액	급여액				
		전체	근로자)	전체	근로자)								
DX	남	37,992	-	325	-	38,317	16.7	-	-				-
DX	여	12,276	220	102	-	12,378	13.6	-	-				-
DS	남	55,681	-	145	-	55,826	10.7	-	-				-
DS	여	21,623	180	25	-	21,648	11.0	-	-	-	-	-	_
성별합계	남	93,673	-	470	_	94,143	13.2	5,306,427	58				평균급여는 평균재직자 92,231명 기준
성별합계	여	33,899	400	127	-	34,026	12.0	1,385,639	44				평균급여는 평균재직자 31,580명 기준
합 계		127,572	400	597	-	128,169	12.9	6,692,066	54				평균급여는 평균재직자 123,811명 기준

- ※ 본사 기준이며, 휴직자는 포함하고 등기임원 10명(사내이사 4명, 사외이사 6명)은 제외한 기준입니다.
- ※ 반기급여 총액 및 1인평균 급여액은「소득세법」제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세 서의

근로소득 기준(근로소득공제 반영전)입니다.

바. 미등기임원 보수 현황

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고
미등기임원	1,001	228,080	234	4 평균급여는 평균재직자 975명 기준

- * 인원수는 작성기준일 현재 재임 중인 임원을 기준으로 하였으며, '미등기임원 현황'의 임원 중 국내에서 근로소득이 발생하지 않은 인원은 제외하였습니다.
- ※ 반기급여 총액과 1인평균 급여액은「소득세법」제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준입니다.
- ※ 반기급여 총액은 성과급 지급 실적을 포함하고 있으며, 성과급 지급 시점은 매년 상이합니다.

2. 임원의 보수 등

가. 임원의 보수

<이사·감사 전체의 보수현황>

(1) 주주총회 승인금액

(단위:백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고
등기이사	5	_	_
사외이사	3	_	_
감사위원회 위원 또는 감사	3	_	_
Л	11	43,000	_

[※] 인원수는 주주총회 승인일 기준입니다.

이사(퇴임이사 포함)의 보수 한도입니다.

(2) 보수지급금액

(2-1) 이사·감사 전체

(단위:백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고
10	4.939	449	평균보수는 보수총액 대상 임원의
10	4,939	449	평균인원수 11명 기준

※「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 재임한

등기이사·사외이사·감사위원회 위원에게 지급된 금액 기준입니다.

- ※ 인원수는 작성기준일 현재 기준입니다.
- ※ 보수총액은 당해 사업연도 중 신규 선임 또는 퇴임한 이사의 미등기임원 재임 시 보수 금액을 포함하여

산정하였으며,「소득세법」상 소득 금액(제20조 근로소득, 제21조 기타소득, 제22조 퇴직소득)입니다.

※ 주식매수선택권 부여로 인하여 당기에 인식한 비용(보상비용)은 없습니다.

[※] 주주총회 승인금액은「상법」제388조와 당사 정관에 따라 2024년 3월 20일 주주총회 결의를 통해 승인받은

(2-2) 유형별

(단위:백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고
등기이사 (사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	4,329	866	평균보수는 보수총액 대상 임원의 평균인원수 5명 기준
사외이사 (감사위원회 위원 제외)	3	331	110	상동(평균인원수 3명)
감사위원회 위원	3	279	93	상동(평균인원수 3명)
감사	_	_	_	-

- ※「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 재임한 등기이사·사외이사·감사위원회 위원에게 지급된 금액 기준입니다.
- ※ 인원수는 작성기준일 현재 기준입니다.
- ※ 보수총액은 당해 사업연도 중 신규 선임 또는 퇴임한 이사의 미등기임원 재임 시 보수 금액을 포함하여 산정하였으며,「소득세법」상 소득 금액(제20조 근로소득, 제21조 기타소득, 제22조 퇴직소득)입니다.
- ※ 주식매수선택권 부여로 인하여 당기에 인식한 비용(보상비용)은 없습니다.
- ※ 1인당 평균보수액은 보수를 지급받은 임원의 평균 인원수(등기이사 5, 사내이사 3, 감사위원회 위원 3)를 기준으로 산출하였습니다.

(3) 보수지급기준

당사는 주주총회의 승인을 받은 이사보수 한도 금액 내에서 당사 임원처우규정 및 사외이사처우규정에 따라 이사의 보수를 지급하고 있습니다.

구 분	보수지급기준							
	•급여: 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급, 위임업무의 성격, 위임업무 수행 결과 등을 고려							
	하여							
	보수를 결정							
	·설·추석상여: 각 월급여 100% 지급							
	·목표인센티브: 부서별 목표 달성도에 따라 대표이사가 결정하며, 월급여의 0~200% 내에서							
등기이사	연 2회 분할지급(조직별 성과에 따라 가감지급)							
등기이자 (사외이사, 감사위원회	·성과인센티브: 사업조직별 사업연도 평가세후이익, 자본비용 등 재무적 요소로 산정한 보상 재							
위원 제외)	원을							
기진 제되/	바탕으로 기준연봉의 0 ~ 50%내에서 연 1회 지급 (개인별 성과에 따라 가감지							
	급)							
	·장기성과인센티브: ROE, 주당수익률, 세전이익률 등을 평가하여 3년 평균연봉을 기초로							
	주주총회에서 정한 이사보수한도 내에서 산정하여 3년간 분할지급							
	·복리후생: 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원 ·건강검진, 단체상해보험 등의							
	처우를 제공							
사외이사	•급여: 사외이사 처우규정에 따라 사외이사의 역할, 법적 책임과 위험 정도, 이동거리,							
(감사위원회 위원 제외)	시장에서의 기회비용 등을 종합적으로 고려하여 개별 보수를 결정							
(무시기전의 커젼 세되)	·복리후생: 사외이사 처우규정에 따라 의료지원·건강검진, 단체상해보험 등의 처우를 제공							

감사위원회 위원

·급여: 사외이사 처우규정에 따라 감사위원인 사외이사의 역할, 법적 책임과 위험 정도, 이동거리,

시장에서의 기회비용 등을 종합적으로 고려하여 개별 보수를 결정

・복리후생: 사외이사 처우규정에 따라 의료지원・건강검진, 단체상해보험 등의 처우를 제공

(1) 개인별 보수지급금액

(단위:백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수
한종희	대표이사	1,128	_
경계현	사장 (前대표이사)	730	_
노태문	이사	1,097	_
박학규	이사	773	-
이정배	이사	601	_

※「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 재임

또는 퇴임한 등기이사·사외이사·감사위원회 위원 기준입니다.

※ 보수총액은 당해 사업연도 중 신규 선임 또는 퇴임한 이사의 미등기임원 재임 시 보수 금액을 포함하여

산정하였으며,「소득세법」상 소득 금액(제20조 근로소득, 제21조 기타소득, 제22조 퇴직소득)입니다.

(2) 산정기준 및 방법

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
				・임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(부회장), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을
		급 여	820	고려하여 보수를 결정하고 1월부터 2월까지 매월 121백만원, 3월 181백만원, 4월부터 6월까지
				매월 133백만원을 지급
				·설 상여 : 각 월급여 100% 지급
				·성과인센티브 : 사업조직별 사업연도 평가세후이익, 자본비용 등 재무적 요소로 산정한
				보상재원을 바탕으로 기준연봉의 0 ~ 50%내에서 연 1회 지급
	근로	상 여	302	(개인별 성과에 따라 가감지급)(소급)
대표이사	소득			※ 전사 계량지표와 관련하여 2023년 DX부문 매출액 170조원, 영업이익 14.4조원을 달성한 점과,
한종희				비계량 지표 관련하여 B2B 사업 강화 및 제품간 시너지 확대로 사업경쟁력 제고에 기여한 점을
				고려 상여금 산정
		주식매수선택권		
		행사이익	1	_
		기타 근로소득	6	• 복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원/건강검진, 단체상해보험 등의
		기다 근도꼬득	0	처우를 제공
	퇴직소득		-	-
		기타소득	_	-

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종	#	총액	산정기준 및 방법
		급여	594	・임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(사장), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을
		급여	594	고려하여 보수를 결정하고 1월부터 6월까지 매월 99백만원을 지급
		상 여	99	•설 상여 : 각 월급여 100% 지급
사장	근로	0 4	99	※ 2023년 성과에 따른 인센티브 지급 없음
(前대표	소득	주식매수선택권		_
이사)		행사이익	_	
경계현		기타 근로소득	37	• 복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원/건강검진, 단체상해보험 등의
		기대 근로포크		처우를 제공
	퇴직소득		_	-
		기타소득	_	-

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
				・임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(사장), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을
		급여	747	고려하여 보수를 결정하고 1월부터 2월까지 매월 104백만원, 3월 182백만원, 4월부터 6월까지
				매월 119백만원을 지급
				·설 상여 : 각 월급여 100% 지급
				·성과인센티브 : 사업조직별 사업연도 평가세후이익, 자본비용 등 재무적 요소로 산정한
				보상재원을 바탕으로 기준연봉의 0 ~ 50%내에서 연 1회 지급
	근로	상 여	338	(개인별 성과에 따라 가감지급)(소급)
이사	소득			※ 전사 계량지표와 관련하여 2023년 MX사업 매출액 108.6조원을 달성한 점과,
노태문				비계량 지표와 관련하여 모바일 기술 혁신과 효과적인 마케팅을 통해 양호한 실적을 견인했고,
				선제적인 미래시장 대응으로 성장 기반을 마련한 점을 고려 상여금 산정
		주식매수선택권		
		행사이익		_
		기타 근로소득	13	• 복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원/건강검진, 단체상해보험 등의
		기다 근포포국	13	처우를 제공
	퇴직소득		-	-
		기타소득	-	_

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
				・임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(사장), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을
		급여	575	고려하여 보수를 결정하고 1월부터 2월까지 매월 85백만원, 3월 127백만원, 4월부터 6월까지
				매월 93백만원을 지급
				·설 상여 : 각 월급여 100% 지급
				·성과인센티브 : 사업조직별 사업연도 평가세후이익, 자본비용 등 재무적 요소로 산정한
				보상재원을 바탕으로 기준연봉의 0 ~ 50%내에서 연 1회 지급
	근로	상 여	172	(개인별 성과에 따라 가감지급)(소급)
이사	소득			※ 전사 계량지표와 관련하여 2023년 DX부문 매출액 170조원, 영업이익 14.4조원을 달성한 점과,
박학규				비계량 지표와 관련하여 저성장 시대에 효율적 자원 운영을 통해 견조한 실적 달성을 지원했고,
				신기술과 신사업 등 신성장 동력 발굴에 기여한 점을 고려 상여금 산정
		주식매수선택권		
		행사이익		
		기타 근로소득	26	• 복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원/건강검진, 단체상해보험 등의
		기다 근포포국	20	처우를 제공
	퇴직소득		-	-
		기타소득	-	1

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
		급여	400	・임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(사장), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을
		ᆸ생	496	고려하여 보수를 결정하고 1월부터 6월까지 매월 83백만원을 지급
		상여	83	·설 상여 : 각 월급여 100% 지급
	근로	3 VI		※ 2023년 성과에 따른 인센티브 지급 없음
이사	소득	주식매수선택권		
이정배		행사이익		_
		3151 33 4.5	22	・복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원/건강검진, 단체상해보험 등의
		기타 근로소득		처우를 제공
		퇴직소득		-
	기타소득		_	-

(1) 개인별 보수지급금액

(단위:백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수
이해창	부사장	1,977	_
임근휘	자문역	1,767	_
정재욱	부사장	1,717	_
최강석	자문역	1,617	_
장우승	부사장	1,601	_

[※] 보수총액은「소득세법」상 소득 금액(제20조 근로소득, 제21조 기타소득, 제22조 퇴직소득)입니다.

(2) 산정기준 및 방법

이름	보수의 종	류	총액	산정기준 및 방법
				・임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(부사장), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과
		급 여	265	등을
				고려하여 보수를 결정하고 1월부터 6월까지 매월 평균 44백만원을 지급
				・설 상여 :40백만원 지급
				・성과인센티브 : 개인의 연간 업무목표(Automotive CIS제품 개발 및 고객 확대) 달성도
				ОП
		상 여	1,631	근거하여 대표이사가 결정한 지급률과 개별 기준금액에 따라 산정한
	근로	(3 VI	1,631	인센티브를 연 1회 지급
이해창	소득			* 전사 계량지표와 관련하여 2023년 Automotive CIS 신사업 수주액 4.3억불 달성 및
010116				신규 고객사 7개를 확보한 점과, 비계량 지표 관련하여 차세대 CIS제품 개발과
				Mobile CIS 신규 고객 확보를 적극 추진한 점을 고려하여 상여금 산정
		주식매수선택권	_	_
		행사이익		
				• 복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원/건강검진, 단체상해보험
		기타 근로소득	81	등의
				처우를 제공
	5	티직소득	_	-
	7	기타소득	_	-

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종	류	총액	산정기준 및 방법
				·임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(부사장), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과
		급여	78	
				고려하여 보수를 결정하고1월부터6월까지 매월 평균13백만원을 지급
				·설 상여 : 13백만원 지급
				·성과인센티브 : 개인의 연간 업무목표(Big Data 인프라 활용 확대 및 개인정보 통합 관
				리)
				달성도에 근거하여 대표이사가 결정한 지급률과 개별 기준금액에 따라
				산정한
	근로	상 여	1,600	인센티브를 연 1회 지급
	소득			※ 전사 계량지표와 관련하여 2023년 DX부문 매출액 170조원, 영업이익 14.4조원을 달
임근휘	소득			성한 점과,
				비계량 지표 관련하여 Big Data 인프라 활용 확대 및 개인정보 통합 관리 등 사업 경쟁
				력 제고에
				기여한 점을 고려 상여금 산정
		주식애수선택권	_	_
		행사이익		
				•복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원/건강검진, 단체상해보험
		기타 근로소득	89	등의
				처우를 제공
	5	티직소득	-	-
		기타소득	-	_

이름	보수의 종	류	총액	산정기준 및 방법
				・임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(부사장), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과
		급여	211	등 의
				고려하여 보수를 결정하고 1월부터 6월까지 매월 평균 35백만원을 지급
				·설 상여 :25백만원 지급
				·성과인센티브 : 개인의 연간 업무목표(Al를 활용한 새로운 사용자 경험 제공 및 제품 경
				쟁력
				강화) 달성도에 근거하여 대표이사가 결정한 지급률과 개별 기준금액에
				따라
	근로	상 여	1,460	산정한 인센티브를 연 1회 지급
	소득			※ 전사 계량지표와 관련하여 2023년 DX부문 매출액 170조원, 영업이익 14.4조원을 달
정재욱	소득			성한 점과,
				비계량 지표 관련하여 Al를 활용한 새로운 사용자 경험 제공 및 제품 경쟁력 강화에 기
				여한 점을
				고려 상여금 산정
		주식매수선택권		
		행사이익		_
				•복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원/건강검진, 단체상해보험
			45	등의
				처우를 제공
	5	티직소득	_	-
	-	기타소득	_	-

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종	류	총액	등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 6월까지 매월 12백만원을 지급 설 상여 : 12백만원 지급 성과인센티브 : 개인의 연간 업무목표(B2B 제품 및 솔루션, 서비스 매출 확대) 달성도 근거하여 대표이사가 결정한 지급률과 개별 기준금액에 따라 산정한 등 학보를 연 1회 지급 전사 계량지표와 관련하여 2023년 MX사업 매출액 108.6조원을 달성한 점과, 비계량표 관련하여 B2B 제품 및 솔루션, 서비스 매출 확대로 사업에 기여한 점을 고려 상여금정 -						
				·임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(부사장급), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결						
		급여	72	과 등을						
				고려하여 보수를 결정하고 1월부터 6월까지 매월 12백만원을 지급						
				·설 상여 :12백만원 지급						
				·성과인센티브 : 개인의 연간 업무목표(B2B 제품 및 솔루션, 서비스 매출 확대) 달성도						
				ОП						
				근거하여 대표이사가 결정한 지급률과 개별 기준금액에 따라 산정한 인						
	AL 01	상 여	1.523	센티브를						
	근로	0 01	1,520	연 1회 지급						
최강석	소득			※ 전사 계량지표와 관련하여 2023년 MX사업 매출액 108.6조원을 달성한 점과, 비계량						
407				N —						
				관련하여 B2B 제품 및 솔루션, 서비스 매출 확대로 사업에 기여한 점을 고려 상여금						
				산정						
		주식매수선택권	_	_						
		행사이익								
				• 복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원/건강검진, 단체상해보험						
		기타 근로소득	22	등의						
				처우를 제공						
	-	퇴직소득	_	-						
	-	기타소득	_	-						

이름	보수의 종	류	총액	일 2 급하여 보수를 결정하고 1월부터 6월까지 매월 평균 51백만원을 지급 설 상여 : 33백만원 지급 결과인센티브 : 개인의 연간 업무목표(온라인 사업 확대 지원 및 개인정보 통합 관리 등 달성도에 근거하여 대표이사가 결정한 지급률과 개별 기준금액에 따라 함한 인센티브를 연 1회 지급 전사 계량지표와 관련하여 2023년 DX부문 매출액 170조원, 영업이익 14.4조원을 달 본 점과,						
		급여	305	・임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(부사장), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 6월까지 매월 평균 51백만원을 지급						
장우승	근로 소득	상 여	1,232	산정한						
		주식매수선택권 행사이익	-	_						
		기타 근로소득	65	・복리후생: 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 임원 의료지원/건강검진, 단체상해보험 등의 처우를 제공						
		퇴직소득	_	-						
		기타소득	_	-						

나. 주식매수선택권의 부여 및 행사 현황

2024년 반기말 현재 이사·감사·업무집행지시자 등에게 부여한 미행사 주식매수선택권(누적기준)은 없습니다.

(단위:백만원)

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고
등기이사	4	-	_
사외이사	3	_	_
감사위원회 위원 또는 감사	3	-	_
업무집행지시자	1,160	_	_
Я	1,170	_	_

[※] 인원수는 작성기준일 현재 기준입니다.

IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

가. 기업집단에 소속된 회사(요약)

당사는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」상 삼성그룹에 속한 계열회사로서, 2024년 반기말 현재 삼성그룹에는 전년말과 동일한 63개의 국내 계열회사가 있습니다. 이 중 상장사는 당사를 포함하여 총 17개사이며 비상장사는 46개사입니다.

(기준일: 2024년 06월 30일) (단위:사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수	계열회사의 수									
	상장	비상장	Л								
삼성	17	46	63								

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 계열회사간 출자현황

[국내]

피출자회사 \ 출자회사	삼성물산 ㈜	삼성바이 오로직스 ㈜	삼성생명 보험㈜	삼성에스 디아이㈜	삼성에스 디에스㈜	삼성에프 엔위탁관 리부동산 투자회사 ㈜	삼성엔지 니어링㈜	삼성전기	삼성전자	삼성중공 업㈜	삼성증권	삼성카드	삼성화재 해상보험 ㈜
삼성물산㈜		43.1	19.3		17.1		7.0		5.0	0.1			
삼성바이오로직스㈜													
삼성생명보험㈜	0.1	0.1		0.1	0.1	19.5	0.1	0.2	8.6	3.0	29.4	71.9	15.0
삼성에스디아이㈜							11.7			0.4			
삼성에스디에스㈜													
삼성전기㈜										2.1			
삼성전자㈜		31.2		19.6	22.6			23.7		15.2			
삼성중공업㈜													
삼성증권㈜						0.5							
삼성카드㈜													
삼성화재해상보험㈜						18.7	0.2		1.5				
㈜에스원						0.8							
㈜제일기획										0.1			
㈜호텔신라													
삼성디스플레이㈜													
삼성자산운용㈜													
삼성전자서비스㈜													
㈜미라콤아이앤씨													
㈜삼성글로벌리서치													
Harman International													
Industries, Inc.													
Э	0.1	74.3	19.3	19.7	39.7	39.5	19.0	23.8	15.1	20.9	29.4	71.9	15.0

[※] 지분율은 보통주 기준입니다.

피출자회사 \ 출자회사	㈜멀티캠 퍼스	㈜에스원	㈜제일기	㈜호텔신 라	삼성디스 플레이㈜	삼성메디 슨㈜	삼성바이 오에피스 ㈜	삼성벤처 투자㈜	삼성생명 서비스손 해사정㈜	삼성선물 ㈜	삼성액티 브자산운 용㈜	삼성에스 알에이자 산운용㈜	삼성웰스 토리㈜
삼성물산㈜								16.7					100.0
삼성바이오로직스㈜							100.0						
삼성생명보험㈜	0.0	5.4	0.3	7.3					99.8			100.0	
삼성에스디아이㈜		11.0		0.1	15.2			16.3					
삼성에스디에스㈜	47.2												
삼성전기㈜								17.0					
삼성전자㈜			25.2	5.1	84.8	68.5		16.3					
삼성중공업㈜								17.0					
삼성증권㈜		1.3		3.1				16.7		100.0			
삼성카드㈜		1.9	3.0	1.3									
삼성화재해상보험㈜		1.0											
㈜에스원													
㈜제일기획													
㈜호텔신라													
삼성디스플레이㈜													
삼성자산운용㈜											100.0		
삼성전자서비스㈜													
㈜미라콤아이앤씨													
㈜삼성글로벌리서치	15.2												
Harman International													
Industries, Inc.													
Э	62.4	20.7	28.6	16.9	100.0	68.5	100.0	100.0	99.8	100.0	100.0	100.0	100.0

[※] 지분율은 보통주 기준입니다.

피출자회사 \ 출자회사	삼성자산운 용㈜	삼성전자로 지텍㈜	삼성전자서 비스㈜	삼성전자서 비스씨에스 ㈜	삼성전자판 매㈜	삼성카드고 객서비스㈜	삼성코닝어 드밴스드글 라스 (유)	삼성혜지자 산운용㈜	삼성화재서 비스손해사 정㈜	삼성화재애 니카손해사 정㈜	세메스㈜	수원삼성축 구단㈜
삼성물산㈜												
삼성바이오로직스㈜												
삼성생명보험㈜	100.0											
삼성에스디아이㈜												
삼성에스디에스㈜												
삼성전기㈜												
삼성전자㈜		100.0	99.3		100.0						91.5	
삼성중공업㈜												
삼성증권㈜												
삼성카드㈜						100.0						
삼성화재해상보험㈜									100.0	100.0		
㈜에스원												
㈜제일기획												100.0
㈜호텔신라												
삼성디스플레이㈜							50.0					
삼성자산운용㈜								100.0				
삼성전자서비스㈜				100.0								
㈜미라콤아이앤씨												
㈜삼성글로벌리서치												
Harman International												
Industries, Inc.												
Л	100.0	100.0	99.3	100.0	100.0	100.0	50.0	100.0	100.0	100.0	91.5	100.0

[※] 지분율은 보통주 기준입니다.

피출자회사	스테코㈜	신라에이 치엠㈜	에스디플 렉스㈜	에스비티 엠㈜	에스원씨 알엠㈜	에스유머 티리얼스	에스코어	에스티엠	에이치디 씨신라면	오픈핸즈	제일패션 리테일㈜	㈜미라콤 아이앤씨	㈜미래로 시스템
출자회사						㈜			세점㈜				
삼성물산㈜											100.0		
삼성바이오로직스㈜													
삼성생명보험㈜													
삼성에스디아이㈜			50.0					100.0					
삼성에스디에스㈜							81.8			100.0		83.6	
삼성전기㈜													
삼성전자㈜	70.0												
삼성중공업㈜													
삼성증권㈜													
삼성카드㈜													
삼성화재해상보험㈜													
㈜에스원					100.0		0.6					0.6	
㈜제일기획							5.2					5.4	
㈜호텔신라		100.0		100.0					50.0				
삼성디스플레이㈜						50.0							
삼성자산운용㈜													
삼성전자서비스㈜													
㈜미라콤아이앤씨							0.5						
㈜삼성글로벌리서치													
Harman International													
Industries, Inc.													
Л	70.0	100.0	50.0	100.0	100.0	50.0	88.1	100.0	50.0	100.0	100.0	89.6	0

[※] 지분율은 보통주 기준입니다.

피출자회사 \ 출자회사	㈜삼성글 로벌리서 치	㈜삼성라 이온즈	㈜삼성생명 금융서비스	㈜삼성화재 금융서비스 보험대리점	㈜삼우종합 건축사사무 소	㈜서울레 이크사이 드	㈜시큐아이	㈜씨브이	㈜에스에이 치피코퍼레 이션	㈜하만인 터내셔널 코리아	㈜휴먼티에	㈜희망별숲
삼성물산㈜	1.0			±641416	100.0	100.0	8.7	40.1	어면	200		
삼성바이오로직스㈜												
삼성생명보험㈜	14.8		100.0									
삼성에스디아이㈜	29.6											
삼성에스디에스㈜							56.5	9.4				
삼성전기㈜	23.8											
삼성전자㈜	29.8											100.0
삼성중공업㈜	1.0											
삼성증권㈜												
삼성카드㈜												
삼성화재해상보험㈜				100.0								
㈜에스원											100.0	
㈜제일기획		67.5										
㈜호텔신라									100.0			
삼성디스플레이㈜												
삼성자산운용㈜												
삼성전자서비스㈜												
㈜미라콤아이앤씨												
㈜삼성글로벌리서치												
Harman International										1000		
Industries, Inc.										100.0		
Л	100.0	67.5	100.0	100.0	100.0	100.0	65.2	49.5	100.0	100.0	100.0	100.0

[※] 지분율은 보통주 기준입니다.

[해외]

출자회사	피출자회사	지분율(%)
(주)삼우종합건축사사무소	SAMOO AUSTIN INC	100.0
(주)삼우종합건축사사무소	SAMOO HU Designer and Engineering Services Limited	100.0
(주)삼우종합건축사사무소	SAMOO DESIGNERS & ENGINEERS INDIA PRIVATE LIMITED	100.0
(주)삼우종합건축사사무소	SAMOO (KL) SDN. BHD.	100.0
(주)삼우종합건축사사무소	SAMOO Design Consulting Co.,Ltd	100.0
Samsung C&T America Inc.	Samsung Green repower, LLC	100.0
Samsung C&T America Inc.	Samsung Solar Construction Inc.	100.0
Samsung C&T America Inc.	QSSC, S.A. de C.V.	20.0
Samsung C&T America Inc.	Samsung Solar Energy LLC	100.0
Samsung C&T America Inc.	Equipment Trading Solutions Group, LLC	70.0
Samsung C&T America Inc.	SAMSUNG C&T CHARGING SOLUTIONS LLC	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SP Armow Wind Ontario LP	50.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE GRW EPC GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE GRW EPC LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE SKW EPC GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE SKW EPC LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE WIND PA GP INC.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE WIND PA LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE GRS Holdings GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE GRS Holdings LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE K2 EPC GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE K2 EPC LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE KS HOLDINGS GP INC.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE KS HOLDINGS LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SP Belle River Wind LP	42.5
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Armow EPC GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Armow EPC LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	North Kent Wind 1 LP	35.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Wind GP Holding Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	South Kent Wind LP Inc.	50.0
Samsung Renewable Energy Inc.	Grand Renewable Wind LP Inc.	45.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE North Kent 2 LP Holdings LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Solar Development GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Solar Development LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Windsor Holdings GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Southgate Holdings GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Solar Construction Management GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Solar Construction Management LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE BRW EPC GP INC.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE BRW EPC LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE North Kent 1 GP Holdings Inc	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE North Kent 2 GP Holdings Inc	100.0

Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Belle River GP Holdings Inc	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE NK1 EPC GP Inc	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE NK1 EPC LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Summerside Construction GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Summerside Construction LP	100.0
SP Armow Wind Ontario GP Inc	SP Armow Wind Ontario LP	0.0
Samsung C&T Oil & Gas Parallel Corp.	PLL Holdings LLC	83.6
SRE GRW EPC GP Inc.	SRE GRW EPC LP	0.0
SRE SKW EPC GP Inc.	SRE SKW EPC LP	0.0
SRE WIND PA GP INC.	SRE WIND PA LP	0.0
SRE GRS Holdings GP Inc.	Grand Renewable Solar GP Inc.	50.0
SRE GRS Holdings GP Inc.	SRE GRS Holdings LP	0.0
SRE K2 EPC GP Inc.	SRE K2 EPC LP	0.0
SRE KS HOLDINGS GP INC.	KINGSTON SOLAR GP INC.	50.0
SRE KS HOLDINGS GP INC.	SRE KS HOLDINGS LP	0.0
SP Belle River Wind GP Inc	SP Belle River Wind LP	0.0
SRE Armow EPC GP Inc.	SRE Armow EPC LP	0.0
SRE Wind GP Holding Inc.	SP Armow Wind Ontario GP Inc	50.0
SRE Wind GP Holding Inc.	South Kent Wind GP Inc.	50.0
SRE Wind GP Holding Inc.	Grand Renewable Wind GP Inc.	50.0
South Kent Wind GP Inc.	South Kent Wind LP Inc.	0.0
Grand Renewable Wind GP Inc.	Grand Renewable Wind LP Inc.	0.0
North Kent Wind 1 GP Inc	North Kent Wind 1 LP	0.0
SRE Solar Development GP Inc.	SRE Solar Development LP	0.0
SRE Solar Construction Management GP Inc.	SRE Solar Construction Management LP	0.0
SRE BRW EPC GP INC.	SRE BRW EPC LP	0.0
SRE North Kent 1 GP Holdings Inc	North Kent Wind 1 GP Inc	50.0
SRE North Kent 2 GP Holdings Inc	SRE North Kent 2 LP Holdings LP	0.0
SRE Belle River GP Holdings Inc	SP Belle River Wind GP Inc	50.0
SRE NK1 EPC GP Inc	SRE NK1 EPC LP	0.0
SRE Summerside Construction GP Inc.	SRE Summerside Construction LP	0.0
Samsung Solar Energy LLC	Samsung Solar Energy 1 LLC	100.0
Samsung Solar Energy LLC	Samsung Solar Energy 2 LLC	100.0
Samsung Solar Energy LLC	Samsung Solar Energy 3, LLC	100.0
Samsung Solar Energy 1 LLC	CS SOLAR LLC	50.0
Samsung Solar Energy 2 LLC	5S ENERGY HOLDINGS, LLC	50.0
Samsung C&T Deutschland GmbH	SungEel Recycling Park Thuringen GmbH	50.0
Samsung C&T Deutschland GmbH	POSS-SLPC, S.R.O	20.0
Samsung C&T Deutschland GmbH	Solluce Romania 1 B.V.	20.0
Samsung C&T Deutschland GmbH	S.C. Otelinox S.A	99.9
Samsung C&T Corporation Poland LLC	Samsung C&T Corporation Romania S.R.L	100.0
Samsung C&T Malaysia SDN. BHD	WARIS GIGIH ENGINEERING AND TECHNOLOGY SDN. BHD.	70.0
Samsung C&T Singapore Pte., Ltd.	Samsung Chemtech Vina LLC	48.3
Samsung C&T Singapore Pte., Ltd.	Samsung C&T Thailand Co., Ltd	0.2
Samsung C&T Singapore Pte., Ltd.	Malaysia Samsung Steel Center Sdn.Bhd	30.0
Samsung C&T Singapore Pte., Ltd.	S&G Biofuel PTE.LTD	12.6

S&G Biofuel PTE.LTD	PT. Gandaerah Hendana	95.0
S&G Biofuel PTE.LTD	PT. Inecda	95.0
Vista Contracting and Investment Global Pte. Ltd.	VISTA CONTRACTING AND DEVELOPMENT BANGLADESH LTD.	100.0
Vista Contracting and Investment Global Pte. Ltd.	Vista NEXT Limited	51.0
Vista Contracting and Investment Global Pte. Ltd.	WELVISTA COMPANY LIMITED	30.0
CHEIL HOLDING INC.	SAMSUNG CONST. CO. PHILS.	75.0
Samsung C&T Hongkong Ltd.	Samsung C&T Thailand Co., Ltd	6.8
Samsung C&T Hongkong Ltd.	SAMSUNG TRADING (SHANGHAI) CO., LTD	100.0
Samsung C&T Hongkong Ltd.	Samsung Precision Stainless Steel(pinghu) Co.,Ltd.	45.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics America, Inc.	100.0
삼성전자(주)	Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Asia Pte. Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Benelux B.V.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Eletronica da Amazonia Ltda.	87.0
삼성전자(주)	Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	100.0
	Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd.	100.0
	Samsung Electronics (UK) Ltd.	100.0
	Samsung Electronics Holding GmbH	100.0
	Thai Samsung Electronics Co., Ltd.	91.8
	Samsung Electronics Slovakia s.r.o	55.7
	Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd.	90.0
	Samsung Japan Corporation	100.0
	Samsung Electronics France S.A.S	100.0
	Samsung Electronics Rus Kaluga LLC	100.0
	Samsung Electronics Rus Company LLC	100.0
	Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V.	63.6
	Samsung Electronics Italia S.P.A.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Iberia, S.A.	100.0
삼성전자(주)	Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd.	69.1
삼성전자(주)	Tianjin Samsung LED Co., Ltd.	100.0
삼성전자(주)	PT Samsung Electronics Indonesia	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Australia Pty. Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics (M) Sdn. Bhd.	100.0
	Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd.	48.2
삼성전자(주)	Samsung Electronics Canada, Inc.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A.	100.0
 삼성전자(주)	Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd.	100.0
 삼성전자(주)	Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o	100.0
삼성전자(주)	Samsung India Electronics Private Ltd.	100.0
 삼성전자(주)	Samsung Electronics Nordic Aktiebolag	100.0
 삼성전자(주)	Samsung Electronics Portuguesa, Unipessoal, Lda.	100.0
사성전자(주)	Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.	73.7
 삼성전자(주)	Samsung Gulf Electronics Co., Ltd.	100.0

삼성전자(주)	Samsung Electronics South Africa(Pty) Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Austria GmbH	100.0
삼성전자(주)	Samsung R&D Institute India-Bangalore Private Limited	100.0
삼성전자(주)	Samsung Vina Electronics Co., Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Europe Logistics B.V.	100.0
삼성전자(주)	Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Display (M) Sdn. Bhd.	75.0
삼성전자(주)	Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Malaysia Electronics (SME) Sdn. Bhd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Argentina S.A.	98.0
삼성전자(주)	Samsung R&D Institute Japan Co. Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd.	100.0
삼성전자(주)	Samsung Electronics Chile Limitada	4.1
삼성전자(주)	Samsung Electronics Egypt S.A.E	0.1
삼성전자(주)	Samsung Electronics Ltd.	100.0
삼성바이오로직스(주)	Samsung Biologics America, Inc.	100.0
삼성바이오에피스(주)	Samsung Bioepis United States Inc.	100.0
삼성바이오에피스(주)	SAMSUNG BIOEPIS UK LIMITED	100.0
삼성바이오에피스(주)	Samsung Bioepis NL B.V.	100.0
삼성바이오에피스(주)	Samsung Bioepis CH GmbH	100.0
삼성바이오에피스(주)	Samsung Bioepis PL Sp z o.o.	100.0
삼성바이오에피스(주)	SAMSUNG BIOEPIS AU PTY LTD	100.0
삼성바이오에피스(주)	SAMSUNG BIOEPIS NZ LIMITED	100.0
삼성바이오에피스(주)	Samsung Biopeis TW Limited	100.0
삼성바이오에피스(주)	Samsung Bioepis HK Limited	100.0
삼성바이오에피스(주)	SAMSUNG BIOEPIS IL LTD	100.0
삼성바이오에피스(주)	SAMSUNG BIOEPIS BR PHARMACEUTICAL LTDA	100.0
삼성디스플레이(주)	Intellectual Keystone Technology LLC	41.9
삼성디스플레이(주)	Samsung Display America Holdings, Inc	100.0
삼성디스플레이(주)	Samsung Display Vietnam Co., Ltd.	100.0
삼성디스플레이(주)	Samsung Display Noida Private Limited	100.0
삼성디스플레이(주)	Samsung Display Dongguan Co., Ltd.	100.0
삼성디스플레이(주)	Samsung Display Tianjin Co., Ltd.	95.0
삼성디스플레이(주)	Novaled GmbH	9.9
세메스(주)	SEMES America, Inc.	100.0
세메스(주)	SEMES (XIAN) Co., Ltd.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	NeuroLogica Corp.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Samsung HVAC America, LLC	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	SmartThings, Inc.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Samsung Oak Holdings, Inc.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Joyent, Inc.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	TeleWorld Solutions, Inc.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Samsung Semiconductor, Inc.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Samsung Research America, Inc	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Samsung Electronics Home Appliances America, LLC	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Samsung International, Inc.	100.0

Samsung Electronics America, Inc.	Harman International Industries, Inc.	100.0
Samsung Semiconductor, Inc.	Samsung Federal, Inc.	100.0
Samsung Semiconductor, Inc.	Samsung Austin Semiconductor LLC.	100.0
Samsung Electronics Canada, Inc.	AdGear Technologies Inc.	100.0
Samsung Research America, Inc	SAMSUNG NEXT LLC	100.0
SAMSUNG NEXT LLC	SAMSUNG NEXT FUND LLC	100.0
Samsung International, Inc.	Samsung Mexicana S.A. de C.V	100.0
Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V.	Samsung Electronics Digital Appliance Mexico, SA de CV	100.0
Samsung Display America Holdings,Inc	eMagin Corporation	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman International Japan Co., Ltd.	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman International Industries Canada Ltd.	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman Becker Automotive Systems, Inc.	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman Professional, Inc.	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman Connected Services, Inc.	100.0
Harman International Industries, Inc.	Roon Labs, LLC	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman Belgium SA	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman France SNC	100.0
Harman International Industries, Inc.	Red Bend Software SAS	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman Inc. & Co. KG	66.0
Harman International Industries, Inc.	Harman KG Holding, LLC	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman Becker Automotive Systems Italy S.R.L.	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman Industries Holdings Mauritius Ltd.	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman International Mexico, S. de R.L. de C.V.	99.9
Harman Becker Automotive Systems, Inc.	Harman International Estonia OU	100.0
Harman Professional, Inc.	Harman Singapore Pte. Ltd.	100.0
Harman Professional, Inc.	Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	0.0
Harman Professional, Inc.	Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	0.0
Harman Connected Services, Inc.	Harman Connected Services Engineering Corp.	100.0
Harman Connected Services, Inc.	Harman Connected Services AB.	100.0
Harman Connected Services, Inc.	Harman Connected Services UK Ltd.	100.0
Harman Connected Services, Inc.	Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd.	1.6
Harman Connected Services, Inc.	Global Symphony Technology Group Private Ltd.	100.0
Samsung Electronics (UK) Ltd.	Samsung Semiconductor Europe Limited	100.0
Samsung Electronics Holding GmbH	Samsung Semiconductor Europe GmbH	100.0
Samsung Electronics Holding GmbH	Samsung Electronics GmbH	100.0
Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd.	Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o.	31.4
Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd.	Samsung Electronics Slovakia s.r.o	44.3
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V.	36.4
Samsung Electronics Benelux B.V.	SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS SIA	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics West Africa Ltd.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics East Africa Ltd.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Saudi Arabia Ltd.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Egypt S.A.E	99.9
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Israel Ltd.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L	99.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Pakistan(Private) Ltd.	100.0

Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics South Africa Production (pty) Ltd.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Turkiye	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Industry and Commerce Ltd.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Semiconductor Israel R&D Center, Ltd.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Levant Co.,Ltd.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Maghreb Arab	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Venezuela, C.A.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Eletronica da Amazonia Ltda.	13.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Chile Limitada	95.9
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Peru S.A.C.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Ukraine Company LLC	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung R&D Institute Ukraine	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung R&D Institute Rus LLC	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Central Eurasia LLP	100.0
	Samsung Electronics Central Eurasia ELF Samsung Electronics Caucasus Co. Ltd	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	10	+
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Uzbekistan FC LLC	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Corephotonics Ltd.	100.0
Samsung Electronics Nordic Aktiebolag	Samsung Nanoradio Design Center	100.0
AKG Acoustics Gmbh	Harman Professional Denmark ApS	100.0
AKG Acoustics Gmbh	Studer Professional Audio GmbH	100.0
Harman Professional Denmark ApS	Martin Professional Japan Ltd.	40.0
Harman Becker Automotive Systems GmbH	Harman International Romania SRL	0.0
Harman Becker Automotive Systems GmbH	Apostera UA, LLC	100.0
Harman Holding Gmbh & Co. KG	Harman Becker Automotive Systems GmbH	100.0
Harman Holding Gmbh & Co. KG	Harman Deutschland GmbH	100.0
Harman Holding Gmbh & Co. KG	Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	100.0
Harman Holding Gmbh & Co. KG	Harman RUS CIS LLC	100.0
Harman Inc. & Co. KG	Harman Holding Gmbh & Co. KG	100.0
Harman Inc. & Co. KG	Harman Management Gmbh	100.0
Harman Inc. & Co. KG	Harman Hungary Financing Ltd.	100.0
Harman Connected Services GmbH	Harman Connected Services OOO	100.0
Harman KG Holding, LLC	Harman Inc. & Co. KG	34.0
Harman Becker Automotive Systems Manufacturing	Harman Professional Kft	100.0
Kft	Trainian Froncesional Nit	100.0
Harman Becker Automotive Systems Manufacturing	Harman Consumer Nederland B.V.	100.0
Kft	Thairian consumer wederland b.v.	100.0
Harman Becker Automotive Systems Manufacturing	Harman International Romania SRL	100.0
Kft	Tramar international nomania one	100.0
Harman Becker Automotive Systems Manufacturing	Red Bend Ltd.	100.0
Kft	ned bend Ltd.	100.0
Harman Becker Automotive Systems Manufacturing	Harman de Pracil Industria Flatraniae e Participaceae I tde	100.0
Kft	Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	100.0
Harman Hungary Financing Ltd.	Harman International Industries Limited	100.0
Harman Consumer Nederland B.V.	AKG Acoustics Gmbh	100.0
Harman Consumer Nederland B.V.	Harman Audio Iberia Espana Sociedad Limitada	100.0
Harman Consumer Nederland B.V.	Harman Holding Limited	100.0

Harman Audio Iberia Espana Sociedad Limitada	Harman France SNC	0.0
Harman Connected Services AB.	Harman Finland Oy	100.0
Harman Connected Services AB.	Harman Connected Services GmbH	100.0
Harman Connected Services AB.	Harman Connected Services Poland Sp.zoo	100.0
Harman Connected Services AB.	Harman Connected Services Solutions (Chengdu) Co., Ltd.	100.0
Harman International Industries Limited	Harman International Industries PTY Ltd.	100.0
Harman International Industries Limited	Harman de Mexico, S. de R.L. de C.V.	100.0
Harman Connected Services UK Ltd.	Harman Connected Services Morocco	100.0
Samsung Electronics Austria GmbH	Samsung Electronics Switzerland GmbH	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief	Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o.	68.6
U.A.	damaing Electronics Sees and Seesan control	
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Electronics Romania LLC	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	SAMSUNG Zhilabs, S.L.	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Porta Nuova Varesine Building 2 S.r.l.	49.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Zo.o	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Electronics Greece S.M.S.A	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	FOODIENT LTD.	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Denmark Research Center ApS	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Cambridge Solution Centre Limited	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Novaled GmbH	40.0
Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd.	Samsung Electronics Display (M) Sdn. Bhd.	25.0
Samsung Asia Pte. Ltd.	Samsung Electronics Japan Co., Ltd.	100.0
Samsung Asia Pte. Ltd.	Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd.	100.0
Samsung Asia Pte. Ltd.	Samsung Electronics New Zealand Limited	100.0
Samsung Asia Pte. Ltd.	Samsung Electronics Philippines Corporation	100.0
Samsung Asia Pte. Ltd.	Samsung R&D Institute BanglaDesh Limited	100.0
Samsung Asia Pte. Ltd.	Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd.	100.0
Samsung Asia Pte. Ltd.	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd.	100.0
Samsung Asia Pte. Ltd.	Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd.	100.0
Samsung India Electronics Private Ltd.	Samsung Nepal Services Pvt, Ltd	100.0
Samsung India Electronics Private Ltd.	Red Brick Lane Marketing Solutions Pvt. Ltd.	100.0
PT Samsung Electronics Indonesia	PT Samsung Telecommunications Indonesia	100.0
Thai Samsung Electronics Co., Ltd.	Laos Samsung Electronics Sole Co., Ltd	100.0
Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd.	iMarket Asia Co., Ltd.	42.0
Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd.	Samsung Suzhou Electronics Export Co., Ltd.	100.0

19.2
ou 100.0
100.0
43.1
100.0
td. 26.3
100.0
ems Co., Ltd. 100.0
100.0
100.0
100.0
i. 100.0
ou) Co., Ltd. 100.0
0.1
1.0
100.0
td. 98.4
. 100.0
100.0
100.0
2.0
rticipacoes Ltda. 100.0
0.0
41.0
89.2
91.7
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
97.6
97.6
97.6 100.0
97.6 100.0 Ltd. 65.0
97.6 100.0 Ltd. 65.0 80.0
97.6 100.0 Ltd. 65.0 80.0 51.0
97.6 100.0 Ltd. 65.0 80.0 51.0
97.6 100.0 Ltd. 65.0 80.0 51.0 50.1

Samsung SDI(Hong Kong) Ltd.	Tianjin Samsung SDI Co., Ltd.	80.0
	Samsung Electro-Machanics Japan Co., Ltd.	100.0
 삼성전기(주)	Samsung Electro-Mechanics America, Inc.	100.0
삼성전기(주)	Samsung Electro-Mechanics Mexico, S.A. de C.V.	100.0
삼성전기(주)	Samsung Electro-Mechanics GmbH	100.0
삼성전기(주)	Samsung Electro-Mechanics Philippines, Corp.	100.0
삼성전기(주)	Calamba Premier Realty Corporation	39.8
삼성전기(주)	Samsung Electro-Mechanics Pte Ltd.	100.0
삼성전기(주)	Samsung Electro-Mechanics Vietnam Co., Ltd.	100.0
삼성전기(주)	Samsung Electro-Mechanics Software India Bangalore Private Limited	99.9
삼성전기(주)	Tianjin Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.	81.8
삼성전기(주)	Samsung High-Tech Electro-Mechanics(Tianjin) Co., Ltd.	95.0
삼성전기(주)	Samsung Electro-Mechanics (Shenzhen) Co., Ltd.	100.0
삼성전기(주)	Kunshan Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.	100.0
삼성전기(주)	iMarket Asia Co., Ltd.	8.7
Samsung Electro-Mechanics America, Inc.	Samsung Electro-Mechanics Mexico, S.A. de C.V.	0.0
Calamba Premier Realty Corporation	Batino Realty Corporation	100.0
Samsung Electro-Mechanics Pte Ltd.	Samsung Electro-Mechanics Software India Bangalore Private Limited	0.1
 삼성화재해상보험(주)	Samsung Fire & Marine Management Corporation	100.0
삼성화재해상보험(주)	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY OF EUROPE	100.0
삼성화재해상보험(주)	PT. Asuransi Samsung Tugu	70.0
삼성화재해상보험(주)	SAMSUNG VINA INSURANCE COMPANY LIMITED	75.0
 삼성화재해상보험(주)	Samsung Reinsurance Pte. Ltd.	100.0
	삼성재산보험 (중국) 유한공사	37.0
삼성화재해상보험(주)	Samsung Fire & Marine Insurance Management Middle East Limited	100.0
 삼성중공업(주)	Camellia Consulting Corporation	100.0
사성중공업(주)	Samsung Heavy Industries India Pvt.Ltd.	100.0
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES (M) SDN.BHD	100.0
	삼성중공업(영성)유한공사	100.0
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES NIGERIA LIMITED	100.0
	Samsung Heavy Industries Mozambique LDA	100.0
삼성중공업(주)	Samsung Heavy Industries Rus LLC	100.0
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES NIGERIA LIMITED	SHI - MCI FZE	70.0
삼성생명보험(주)	Beijing Samsung Real Estate Co Ltd	90.0
삼성생명보험(주)	Porta Nuova Varesine Building 2 S.r.I.	51.0
삼성생명보험(주)	Samsung Life Insurance (Thailand) Public Co., Ltd	48.9
삼성자산운용(주)	Samsung Asset Management (New York), Inc.	100.0
삼성자산운용(주)	Samsung Global SME Private Equity Manager Fund Co., Ltd.	100.0
삼성자산운용(주)	Samsung Asset Management U.S. Holdings, Inc.	100.0
삼성자산운용(주)	Samsung Private Equity Fund 2022 GP, Ltd.	100.0
삼성자산운용(주)	Samsung Co-Investment 2021 GP, Ltd.	100.0
삼성자산운용(주)	Samsung Asset Management(London) Ltd.	100.0

삼성자산운용(주)	Samsung Private Equity Manager I Co., Ltd.	100.0
삼성자산운용(주)	Samsung Asset Management (Hong Kong) Ltd.	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Deutschland GmbH	100.0
삼성물산(주)	Samsung Renewable Energy Inc.	100.0
삼성물산(주)	Beijing Samsung Real Estate Co Ltd	10.0
삼성물산(주)	Samsung C&T America Inc.	100.0
삼성물산(주)	SAM investment Manzanilo.B.V	53.3
삼성물산(주)	Samsung C&T Japan Corporation	100.0
삼성물산(주)	SCNT Power Kelar Inversiones Limitada	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T (KL) Sdn.,Bhd.	100.0
삼성물산(주)	Samsung Fashion Trading Co. ,Ltd	100.0
삼성물산(주)	SAMSUNG C&T (SHANGHAI) CO., LTD.	100.0
삼성물산(주)	Vista Contracting and Investment Global Pte. Ltd.	100.0
삼성물산(주)	Samsung E&C America, INC.	100.0
삼성물산(주)	Samsung SDI(Hong Kong) Ltd.	2.4
삼성물산(주)	Samsung Precision Stainless Steel(pinghu) Co.,Ltd.	55.0
삼성물산(주)	Samsung C&T U.K. Ltd.	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Singapore Pte., Ltd.	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Hongkong Ltd.	100.0
삼성물산(주)	CHEIL INDUSTRIES ITALY SRL	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T ECUK Limited	100.0
삼성물산(주)	VSSC STEEL CENTER LIMITED LIABILITY COMPANY	70.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Thailand Co., Ltd	93.0
삼성물산(주)	S&G Biofuel PTE.LTD	50.5
삼성물산(주)	Samsung SDI America, Inc.	8.3
삼성물산(주)	POSS-SLPC, S.R.O	50.0
삼성물산(주)	QSSC, S.A. de C.V.	80.0
삼성물산(주)	Malaysia Samsung Steel Center Sdn.Bhd	70.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Taiwan Co., Ltd.	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T India Private Limited	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Corporation Rus LLC	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T (Xi'an) Co., Ltd.	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Lima S.A.C.	100.0
삼성물산(주)	SAMSUNG C&T CORPORATION VIETNAM CO., LTD	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Renewable Energy Australia Pty Ltd	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Corporation Poland LLC	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Malaysia SDN. BHD	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Chile Copper SpA	100.0
삼성물산(주)	Erdsam Co., Ltd.	100.0
삼성물산(주)	WARIS GIGIH ENGINEERING AND TECHNOLOGY SDN. BHD.	30.0
삼성물산(주)	Solluce Romania 1 B.V.	80.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Oil & Gas Parallel Corp.	100.0
삼성물산(주)	Whessoe engineering Limited	100.0
삼성물산(주)	Samsung Chemtech Vina LLC	51.7
삼성물산(주)	Samsung C&T Corporation India Private Limited	100.0
삼성물산(주)	SAMSUNG C&T Mongolia LLC.	70.0

삼성물산(주)	Samsung C&T Eng.&Const. Mongolia LLC.	100.0
삼성물산(주)	S&WOO CONSTRUCTION PHILIPPINES,INC.	100.0
삼성물산(주)	SAMSUNG CONST. CO. PHILS.	25.0
삼성물산(주)	CHEIL HOLDING INC.	40.0
삼성물산(주)	SAMSUNG C&T CORPORATION SAUDI ARABIA	100.0
삼성물산(주)	SAM Gulf Investment Limited	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Corporation UEM Construction JV Sdn Bhd	60.0
삼성웰스토리(주)	Welstory Hungary Kft.	100.0
삼성웰스토리(주)	WELSTORY VIETNAM COMPANY LIMITED	100.0
삼성웰스토리(주)	Shanghai Ever-Hongjun Business Mgt Service Co.,LTD	85.0
삼성웰스토리(주)	Shanghai Welstory Food Company Limited	81.6
(주)멀티캠퍼스	LANGUAGE TESTING INTERNATIONAL, INC.	82.4
WELSTORY VIETNAM COMPANY LIMITED	WELVISTA COMPANY LIMITED	70.0
Pengtai Greater China Company Limited	PENGTAI CHINA CO.,LTD.	100.0
Pengtai Greater China Company Limited	PengTai Taiwan Co., Ltd.	100.0
PENGTAI CHINA CO.,LTD.	PENGTAI E-COMMERCE CO.,LTD	100.0
PENGTAI CHINA CO.,LTD.	Beijing Pengtai Borui E-commerce Co.,Ltd.	100.0
PENGTAI INTERACTIVE ADVERTISING CO.,LTD	Medialytics Inc.	100.0
PENGTAI INTERACTIVE ADVERTISING CO.,LTD	Beijing Pengtai Baozun E-commerce Co., Ltd.	51.0
iMarket Asia Co., Ltd.	iMarket China Co., Ltd.	80.0
삼성증권(주)	Samsung Securities (America), Inc.	100.0
삼성증권(주)	Samsung Securities (Europe) Limited.	100.0
삼성증권(주)	Samsung Securities (Asia) Limited.	100.0
삼성에스디에스(주)	iMarket Asia Co., Ltd.	40.6
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS America, Inc.	100.0
삼성에스디에스(주)	SAMSUNG SDS GSCL Canada., Ltd.	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Europe, Ltd.	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Hungary, Kft.	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Slovakia, S.R.O.	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Poland Sp. Z.o.o.	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung GSCL Sweden AB	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL France SAS	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Italy S.R.L. A Socio Unico	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global Supply Chain Logistics Spain S.L.U	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A.	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Germany GmbH	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Romania S.R.L	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Asia Pacific Pte, Ltd.	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung Data Systems India Private Limited	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Vietnam Co., Ltd.	100.0
삼성에스디에스(주)	PT. Samsung SDS Global SCL Indonesia	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Philippines Co., Ltd.lnc.	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Thailand Co.,Ltd	100.0
삼성에스디에스(주)	SAMSUNG SDS MALAYSIA SDN. BHD.	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Austraila Pty.,Ltd.	100.0
삼성에스디에스(주)	SDS-ACUTECH CO., Ltd.	50.0

삼성에스디에스(주)	ALS SDS Joint Stock Company	51.0
삼성에스디에스(주)	SDS-MP Logistics Joint Stock Company	51.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS China Co., Ltd.	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Hong Kong Limited	100.0
삼성에스디에스(주)	SAMSUNG SDS Global SCL Egypt	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL South Africa (PTY) Ltd.	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Nakliyat ve Lojistik Anonim Sirketi	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global Supply Chain Logistics Middle East	100.0
(1,1,0), 1, 5,0), 1, (T)	DWC-LLC	20.7
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Latin America Tecnologia E Logistica LTDA.	99.7
삼성에스디에스(주)	INTE-SDS Logistics S.A. de C.V.	51.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Rus Limited Liability Company	100.0
Samsung SDS America, Inc.	Samsung SDS Mexico, S.A. DE C.V.	99.0
Samsung SDS America, Inc.	Samsung SDS Global SCL Panama S.A.	100.0
Samsung SDS America, Inc.	Samsung SDS Global SCL Chile Limitada	100.0
Samsung SDS America, Inc.	Samsung SDS Global SCL Peru S.A.C	100.0
Samsung SDS America, Inc.	Samsung SDS Global SCL Colombia S.A.S	100.0
Samsung SDS America, Inc.	Samsung SDS Latin America Tecnologia E Logistica LTDA.	0.3
Samsung SDS Europe, Ltd.	Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A.	0.0
Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief	Samsung SDS Global SCL Poland Sp. Z.o.o.	0.0
U.A.	Samsung 303 Global 30L Foland 3p. 2.0.0.	0.0
Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief	Samsung SDS Global SCL Romania S.R.L	0.0
U.A.		
Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief	Samsung SDS Rus Limited Liability Company	0.0
U.A.		
삼성이앤에이(주)	Samsung E&A America Inc.	100.0
삼성이앤에이(주)	Samsung Project Management Inc.	100.0
삼성이앤에이(주)	Samsung E&A Hungary Co. Ltd.	100.0
삼성이앤에이(주)	Samsung Engineering Italy S.R.L.	100.0
삼성이앤에이(주)	Samsung E&A Malaysia SDN. BHD.	100.0
삼성이앤에이(주)	PT Samsung Engineering Indonesia Co., Ltd.	100.0
삼성이앤에이(주)	Samsung E&A (Thailand) Co., Ltd.	81.0
삼성이앤에이(주)	Samsung E&A India Private Limited	100.0
삼성이앤에이(주)	Samsung E&A Vietnam Co., Ltd.	100.0
삼성이앤에이(주)	GLOBAL MODULE CENTER JOINT STOCK COMPANY	49.6
삼성이앤에이(주)	Samsung Engineering Global Private Limited	100.0
삼성이앤에이(주)	Samsung E&A Shanghai Co., Ltd.	100.0
삼성이앤에이(주)	Samsung E&A Xi' an Co., Ltd.	100.0
삼성이앤에이(주)	Samsung Saudi Arabia Co., Ltd.	100.0
삼성이앤에이(주)	Muharraq Wastewater Services Company W.L.L.	99.8
삼성이앤에이(주)	Muharraq STP Company B.S.C.	6.6
삼성이앤에이(주)	Muharraq Holding Company 1 Ltd.	65.0
삼성이앤에이(주)	SAMSUNG ENGINEERING NEC COMPANY LIMITED	60.0
	Samsung E&A Mexico S.A. de C.V.	99.9
삼성이앤에이(주)	Samsung Engineering Trinidad Co., Ltd.	100.0
삼성이앤에이(주)	Samsung Ingenieria Manzanillo, S.A. De C.V.	99.9

삼성이앤에이(주)	Grupo Samsung E&A Mexico, S.A. De C.V. (GSIM)	100.0
 삼성이앤에이(주)	Samsung E&A Energia S.A. De C.V.	100.0
 삼성이앤에이(주)	Samsung E&A Bolivia S.A	100.0
삼성이앤에이(주)	Samsung E&A DUBA S.A. De C.V.	100.0
삼성이앤에이(주)	Samsung Engineering Kazakhstan L.L.P.	100.0
Samsung E&A America Inc.	Samsung E&A America Construction LLC	100.0
Samsung E&A America Inc.	Samsung E&A Louisiana Construction LLC	100.0
Samsung E&A Malaysia SDN. BHD.	Muharraq Wastewater Services Company W.L.L.	0.3
Samsung E&A India Private Limited	Samsung Engineering Global Private Limited	0.0
Samsung E&A India Private Limited	Samsung Saudi Arabia Co., Ltd.	0.0
Samsung Saudi Arabia Co., Ltd.	Samsung EPC Company Ltd.	75.0
Muharraq Holding Company 1 Ltd.	Muharraq Holding Company 2 Ltd.	100.0
Muharraq Holding Company 2 Ltd.	Muharraq STP Company B.S.C.	89.9
Samsung E&A DUBA S.A. De C.V.	Asociados Constructores DBNR, S.A. de C.V.	49.0
(주)에스원	S-1 CORPORATION HUNGARY LLC	100.0
(주)에스원	S-1 CORPORATION VIETNAM CO., LTD	100.0
(주)에스원	Samsung Beijing Security Systems	100.0
(주)제일기획	Pengtai Greater China Company Limited	98.8
(주)제일기획	PENGTAI INTERACTIVE ADVERTISING CO.,LTD	100.0
(주)제일기획	Cheil USA Inc.	100.0
(주)제일기획	Cheil Central America Inc.	100.0
(주)제일기획	Iris Worldwide Holdings Limited	100.0
(주)제일기획	CHEIL EUROPE LIMITED	100.0
(주)제일기획	Cheil Germany GmbH	100.0
(주)제일기획	Cheil France SAS	100.0
(주)제일기획	CHEIL SPAIN S.L	100.0
(주)제일기획	Cheil Benelux B.V.	100.0
(주)제일기획	Cheil Nordic AB	100.0
(주)제일기획	Cheil India Private Limited	100.0
(주)제일기획	Cheil (Thailand) Ltd.	100.0
(주)제일기획	Cheil Singapore Pte. Ltd.	100.0
(주)제일기획	CHEIL VIETNAM COMPANY LIMITED	99.0
(주)제일기획	Cheil Integrated Marketing Philippines, Inc.	100.0
(주)제일기획	CHEIL MALAYSIA SDN. BHD.	100.0
(주)제일기획	Cheil New Zealand Limited	100.0
(주)제일기획	Cheil Worldwide Australia Pty Ltd	100.0
(주)제일기획	CHEIL CHINA	100.0
(주)제일기획	Cheil Hong Kong Ltd.	100.0
(주)제일기획	Caishu (Shanghai) Business Consulting Co., Ltd	100.0
(주)제일기획	Cheil MEA FZ-LLC	100.0
(주)제일기획	Cheil South Africa (Pty) Ltd	100.0
(주)제일기획	CHEIL KENYA LIMITED	99.0
(주)제일기획	Cheil Communications Nigeria Ltd.	99.0
(주)제일기획	Cheil Worldwide Inc./Jordan LLC.	100.0
(주)제일기획	Cheil Ghana Limited	100.0
(주)제일기획	Cheil Egypt LLC	99.9

(주)제일기획	Cheil Maghreb LLC	100.0
(주)제일기획	Cheil Brasil Comunicacoes Ltda.	100.0
(주)제일기획	Cheil Mexico, S.A. de C.V.	98.0
(주)제일기획	Cheil Chile SpA.	100.0
(주)제일기획	Cheil Peru S.A.C.	100.0
(주)제일기획	CHEIL ARGENTINA S.A.	98.0
(주)제일기획	Cheil Rus LLC	100.0
(주)제일기획	Cheil Ukraine LLC	100.0
(주)제일기획	Cheil Kazakhstan LLC	100.0
(주)호텔신라	Samsung Hospitality America Inc.	100.0
(주)호텔신라	Shilla Travel Retail Pte. Ltd.	100.0
(주)호텔신라	Samsung Shilla Business Service Beijing Co., Ltd.	100.0
(주)호텔신라	Shilla Travel Retail Hong Kong Limited	100.0
에이치디씨신라면세점(주)	HDC SHILLA (SHANGHAI) CO., LTD	100.0
에스비티엠(주)	Samsung Hospitality U.K. Ltd.	100.0
에스비티엠(주)	Samsung Hospitality Europe GmbH	100.0
에스비티엠(주)	SAMSUNG HOSPITALITY ROMANIA SRL	100.0
에스비티엠(주)	Samsung Hospitality Vietnam Co., Ltd.	99.0
	Samsung Hospitality Philippines Inc.	100.0
에스비티엠(주)	Samsung Hospitality India Private Limited	100.0
	Samsung Venture Investment (Shanghai) Co., Ltd.	100.0
Iris Americas, Inc.	Iris (USA) Inc.	100.0
Iris Americas, Inc.	Iris Atlanta, Inc.	100.0
Iris Americas, Inc.	89 Degrees, Inc.	100.0
Cheil USA Inc.	The Barbarian Group LLC	100.0
Cheil USA Inc.	McKinney Ventures LLC	100.0
Cheil USA Inc.	Cheil India Private Limited	0.0
Cheil USA Inc.	Cheil Mexico, S.A. de C.V.	2.0
Iris Worldwide Holdings Limited	Iris Nation Worldwide Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Americas, Inc.	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Irisnation Latina No.2, S. de R.L. de C.V.	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Irisnation Latina, S. de R.L. de C.V.	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Pricing Solutions Ltd	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris London Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Promotional Marketing Ltd	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Ventures 1 Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Founded Partners Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Digital Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Amsterdam B.V.	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Ventures (Worldwide) Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	WDMP Limited	49.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Services Limited Dooel Skopje	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Irisnation Singapore Pte. Itd.	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Worldwide Integrated Marketing Private Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Worldwide (Thailand) Limited	100.0
Iris London Limited	Iris Partners LLP	100.0

Iris Promotional Marketing Ltd	Holdings BR185 Limited	100.0
Iris Ventures 1 Limited	Iris Germany GmbH	100.0
Founded Partners Limited	Founded, Inc.	100.0
Iris Germany GmbH	Pepper NA, Inc.	100.0
CHEIL EUROPE LIMITED	Beattie McGuinness Bungay Limited	100.0
CHEIL EUROPE LIMITED	Cheil Italia S.r.I	100.0
Cheil Germany GmbH	Cheil Austria GmbH	100.0
Cheil Germany GmbH	Centrade Integrated SRL	100.0
Centrade Integrated SRL	Centrade Cheil HU Kft.	100.0
Centrade Integrated SRL	Centrade Cheil Adriatic D.O.O.	100.0
Cheil India Private Limited	Experience Commerce Software Private Limited	100.0
Cheil Singapore Pte. Ltd.	PT. CHEIL WORLDWIDE INDONESIA	100.0
Cheil Integrated Marketing Philippines, Inc.	Cheil Philippines Inc.	30.0
Shilla Travel Retail Pte. Ltd.	Shilla Retail Plus Pte. Ltd.	100.0
Samsung Shilla Business Service Beijing Co., Ltd.	Tianjin Samsung International Travel Service Co., Ltd	100.0
Shilla Travel Retail Hong Kong Limited	Shilla Retail Limited	100.0
Shilla Travel Retail Hong Kong Limited	BNY Trading Hong Kong Limited	100.0
Cheil MEA FZ-LLC	One Agency FZ-LLC	100.0
01.11454.57.11.0	One RX Project Management Design and Production Limited	0.0
Cheil MEA FZ-LLC	Company	0.0
Cheil MEA FZ-LLC	Cheil Egypt LLC	0.1
Cheil South Africa (Pty) Ltd	CHEIL KENYA LIMITED	1.0
Cheil South Africa (Pty) Ltd	Cheil Communications Nigeria Ltd.	1.0
One Agency FZ-LLC	ONE RETAIL EXPERIENCE KOREA LIMITED	100.0
One Agency FZ-LLC	One RX India Private Limited	100.0
One Agency F7 LLC	One RX Project Management Design and Production Limited	100.0
One Agency FZ-LLC	Company	100.0
One Agency FZ-LLC	ONE RX INTERIOR DECORATION L.L.C	100.0
One Agency FZ-LLC	ONE AGENCY PRINTING L.L.C	100.0
ONE RX INTERIOR DECORATION L.L.C	One RX India Private Limited	0.0
Holdings BR185 Limited	Brazil 185 Participacoes Ltda	100.0
Brazil 185 Participacoes Ltda	Iris Router Marketing Ltda	100.0
Cheil Brasil Comunicacoes Ltda.	CHEIL ARGENTINA S.A.	2.0

다. 관련법령상의 규제내용 등

「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」상 상호출자제한기업집단 등

① 지정시기: 2024년 5월 14일

- ② 규제내용 요약
 - · 상호출자의 금지
 - 계열사 채무보증 금지
 - ·금융 · 보험사의 계열사 의결권 제한
 - ·대규모 내부거래의 이사회 의결 및 공시
 - · 비상장사 중요사항 공시
 - •기업집단 현황 등에 관한 공시

라.회사와 계열회사 간 임원 겸직 현황

(기준일: 2024년 06월 30일)

겸직자		계열회사 겸직현황						
성명	직위	기업명	직위	상근 여부				
육근성	부사장	삼성전자판매㈜	감사	비상근				
김성욱	부사장	삼성전자판매㈜	기타비상무이사	비상근				
강성욱	상무	삼성전자로지텍㈜	감사	비상근				
남경인	상무	삼성전자로지텍㈜	기타비상무이사	비상근				
고재윤	부사장	삼성전자서비스㈜	감사	비상근				
장흥민	상무	삼성전자서비스㈜	기타비상무이사	비상근				
유규태	부사장	삼성메디슨㈜	대표이사	상근				
심재현	부사장	삼성메디슨㈜	감사	비상근				
박순철	부사장	삼성벤처투자㈜	감사	비상근				
유한종	상무	㈜삼성글로벌리서치	감사	비상근				
오재균	부사장	삼성디스플레이㈜	감사	비상근				
조기재	부사장	세메스㈜	감사	비상근				
황희돈	부사장	세메스㈜	기타비상무이사	비상근				
성덕용	부사장	세메스㈜	기타비상무이사	비상근				
오종훈	부사장	스테코㈜	감사	비상근				
박동욱	상무	스테코㈜	기타비상무이사	비상근				
정용덕	상무	㈜미래로시스템	기타비상무이사	비상근				

2. 타법인 출자 현황(요약)

2024년 반기말 현재 당사 타법인 출자 금액은 장부금액 기준 59조 7,414억원이며, 경영참여 등 목적으로 출자하였습니다.

	출자회사수			총 출자금액					
출자				기초	증가(감소)		기말		
목적	상장	비상장	계	장부	취득	평가	장부		
				가액	(처분)	손익	가액		
경영참여	20	80	100	59,178,554	159,079	331,491		59,669,124	
일반투자	-	-	-	-	-	-		-	
단순투자	4	31	35	68,388	-1	3,916		72,303	
계	24	111	135	59,246,942	159,078	335,407		59,741,427	

[※] 별도 기준입니다.

[※]상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등

당사는 2024년 반기말 현재 Samsung Electronics America, Inc. (SEA) 등 계열회사의 자금조달 등을 위하여 채무보증을 제공하고 있습니다.

(단위 : 천US\$, %)

법인명							채무보증한도		채무금액			
(채무자)	관계	채권자	내용	목적	보증시작일	보증종료일	기초	기말	기초	증감	기말	이자율
SEA	계열회사	BOA 등	지급보증	운영자금	2023-11- 09	2025-06- 13	1,278,000	1,278,000	-	-	-	
SEM	계열회사	BBVA 등	지급보증	운영자금	2023-08-	2025-06-	715,000	715,000	-	-	-	
SAMCOL	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2023-11-	2025-06-	210,000	210,000	-	-	-	
SEDA	계열회사	BRADESCO 등	지급보증	운영자금	2023-10-	2025-06-	329,000	329,000	-	-	-	
SECH	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2023-12- 17	2025-06- 13	62,000	64,000	-	-	-	
SEPR	계열회사	BBVA 등	지급보증	운영자금	2023-12- 17	2025-06-	150,000	150,000	-	-	-	
SSA	계열회사	SCB 등	지급보증	운영자금	2023-11-	2025-06- 13	318,000	318,000	-	-	-	
SEMAG	계열회사	SocGen 등	지급보증	운영자금	2023-11-	2024-12- 16	96,000	96,000	8,065	△8,065	-	
SETK	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2023-11- 09	2025-06- 13	917,000	947,000	320,893	175,565	496,458	47.0%
SETK-P	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2023-11- 09	2024-12- 16	70,000	70,000	-	-	-	
SECE	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2023-12- 17	2024-12- 16	114,000	114,000	-	-	-	
SEEG	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2024-06- 14	2025-06- 13	85,000	85,000	-	-	-	
SEIN	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2023-11- 09	2025-06- 13	70,000	70,000	-	-	-	
SJC	계열회사	Mizuho Bank 등	지급보증	운영자금	2023-11- 09	2025-05- 31	835,508	802,532	-	-	-	
SEUC	계열회사	Credit Agricole 등	지급보증	운영자금	2023-11- 09	2025-06- 13	125,000	125,000	-	-	-	
SEDAM	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2023-11- 09	2025-06- 13	537,000	537,000	-	-	-	
SECA	계열회사	воа	지급보증	운영자금	2023-11- 09	2024-11- 08	70,000	70,000	-	-	-	
SELA	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2023-12- 17	2024-12- 16	60,000	60,000	-	-	-	

SELV 제임회사 HSBC 등 지급보증 운영자급 06 13 888.400 856.400						2023-09-	2025-06-							
SELV 계열회사 Citibank 지급보증 문영자급 2023-12- 15 10,000 10,000	SEEH	SEEH 계열회사 HSBC 등	HSBC 등	지급보증	운영자금			888,400	856,400	-	-	-		
SELV 제용회사 Citibank 지금보증 문영자급 17 16 10,000 10,000														
SEIL 게임회사 Citibank 자급보증 운영자급 2023-12- 15.600 15.600	SELV	SELV 계열회사 Citibank	지급보증	운영자금	2023-12-	2024-12-	10,000	10,000	_	_	-			
SEIL 제설회사 Citibank 지급보증 운영자급 17 16 15,600 15,600						17	16							
SAPL 제설회사 BOA 등 지금보증 운영지금 2023-11- 2025-06- 09 13 404,000 404,000	SEIL	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2023-12-	2024-12-	15.600	15.600	_	_	_		
SAPL 게임회사 BOA 등 지급보증 운영자급 09 13 404,000 404,000						17	16	. ,						
SAVINA 계열회사 HSBC 지급보증 운영자급 2024-06- 14 13 51.000 51.000	SAPI	계역하사	R∩A 등	지근보증	우연자근	2023-11-	2025-06-	404 000	404 000	_	_	_		
SAVINA 계열회사 HSBC 지급보증 운영자급 14 13 51,000 51,000	0,112	개근되시	50	VIBTO	20/10	09	13	101,000	101,000					
SCIC 게열회사 HSBC 등 지급보증 운영자급 2023-12- 2025-06- 17 13 270,000 270,000	CAVINIA	Jilod ≅i Li	11000	TIDHA	0 01 TI TI	2024-06-	2025-06-	E1 000	E1 000					
SCIC 계열회사 HSBC 등 지급보증 운영자급 17 13 270,000 270,000	SAVINA	게르되バ	повс	Nure	E874-	14	13	51,000	51,000					
SESP 개열회사 SCB 지급보증 운영자급 2023-11- 09 08 30,000 30,000	0010	31101=111	11000 E	71747	0017	2023-12-	2025-06-	070.000	070.000			-		
SESP 계열회사 SCB 지급보증 운영자급 09 08 30,000 30,000	SCIC	게걸되사	H2BC =	시급보증	문영사급	17	13	270,000	270,000	_	_			
SME 제열회사 SCB 지급보증 운영자급 2023-11- 09 08 110,000 110,000						2023-11-	2024-11-	30,000 30		30,000 -	-	-		
SME 계열회사 SCB 지급보증 운영자금 09 08 110,000 110,000	SESP	계열회사	SCB	시급모증	운영사금	09	08		30,000					
SAMEX 계열회사 Citibank 지급보증 운영자급 2023-12- 2024-12- 16 5,000 5,000				지급보증		2023-11-	2024-11-			110,000 -				
SAMEX 계열회사 Citibank 지급보증 운영자금 17 16 5,000 5,000	SME	계열회사	SCB		운영사금	09	08	110,000	110,000		_	_		
SEASA 계열회사 Citibank 지급보증 운영자금 2023-12- 2024-12- 17 16 2,000 2,000							2023-12-	2024-12-						
SEASA 계열회사 Citibank 지급보증 운영자금 17 16 2.000 2.000	SAMEX	계열회사	Citibank	시급보승	문영사금	- 문장사급	17	16	5,000	5,000	_	_	_	
SSAP 계열회사 SCB 지급보증 운영자금 2023-11- 2024-11- 09 08 35,000						2023-12-	2024-12-							
SSAP 계열회사 SCB 지급보증 운영자금 09 08 35,000 35,000	SEASA	계열회사	Citibank	시급보증	시급보증	운영자금	17	16	2,000 2	2,000	2,000	-	-	
SEPM 계열회사 HSBC 지급보증 운영자급 2024-06- 14 13 35,000 35,000						2023-11-	2024-11-							
SEPM 계열회사 HSBC 지급보증 운영자금 14 13 35,000 35,000	SSAP	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	09	08	35,000	35,000	_	_	_		
SESAR 계열회사 HSBC 지급보증 운영자금 2024-06- 2025-06- 14 13 20,000 20,000						2024-06-	2025-06-							
SESAR 계열회사 HSBC 지급보증 운영자금 14 13 20,000 20,000	SEPM	SEPM 계열회사 HSBC	지급보증	운영자금	14	13	35,000 35	35,000	_	_	_			
SEUZ 계열회사 Citibank 지급보증 운영자금 2023-12- 10,000 10,000		SESAR 계열회사 HSBC			2024-06-	2025-06-								
SEUZ 계열회사 Citibank 지급보증 운영자금 10,000 10,000	SESAR		HSBC	HSBC 지급보증	운영자금	14	13	20,000 20	20,000	-	-	-		
						2023-12-	2024-12-							
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	SEUZ 계열회사	열회사 Citibank	Citibank 지급도	지급보증	!증 운영자금	17	16	10,000	10,000	-	_	_		

법인명							채무보증한	도	채무금액			0.710
(채무자)	관계	채권자	내용	목적	보증시작일	보증종료일	기초	기말	기초	증감	기말	이자율
AdGear Technologies Inc.	계열회사	BOA	지급보증	운영자금	2023.11.09	2024.11.08	2,000	2,000	-	-	-	
Harman International	계열회사	JP Morgan	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.06.13	100,000	100.000				
Industries, Inc.	게르되시	JF WOIGAN	Nate	E8VP	2023.00.14	2024.00.13	100,000	100,000	_			
Harman International	31104 =1 11	14150	TI DI T	0.417	0000 11 00	00044400	05.000	05.000				
Japan Co., Ltd.	계열회사	MUFG	지급보증	운영자금	2023.11.09	2024.11.08	25,000	25,000	_	_	_	
Harman Holding Limited	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.06.13	30,000	30,000	-	-	-	
Harman do Brasil Industria												
Eletronica e Participacoes	계열회사											
Ltda.												
Harman da Amazonia		SocGen	지급보증	운영자금	2023.11.09	2024.11.08	15,000	15,000	-	-	-	
Industria	31104-111											
Eletronica e Participacoes	계열회사											
Ltda.												
Harman International	31104 =1 11		7777	0.417	0000 00 11	0004.00.40						
Industries Limited	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.06.13	30,000	30,000	_	_	_	
		합	계		'		8,129,508	8,096,532	328,958	167,500	496,458	

※ 별도 기준입니다.

- ※ 건별 채무보증금액이 자기자본의 0.1% 이상 2.5% 미만인 경우 경영위원회, 2.5% 이상인 경우 이사회 의결을 통해 결정됩니다.
- ※ 당사는 종속기업별 채무보증 만기, 일반적인 신용공여 조건의 이율 등을 감안하여 산정된 채무보증 수수료를 수취하고 있습니다. 당사는 2023년 중 US\$2,141천의 수수료를 청구하였으며, 2024년 중 수취하였습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등

당사는 2024년 반기 중 법인의 생산설비 증설 등 목적으로 자산을 Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd. (SESS) 등의 계열회사에 매각하였으며, 생산 효율화 등을 위해 자산을 계열회사로부터 매입하였습니다.

(단위 : 백만원)

법인명	관계	거래종류	거래일자	거래대상물	거래목적	거래금액	처분손익
SESS	계열회사	자산매각/매입	2024.06.10	기계장치 등	생산설비 증설/생산효율화 등	10,389	288
SCS	계열회사	자산매각/매입	2024.04.02	기계장치 등	생산설비 증설/생산효율화 등	8,679	7,669
SEVT	계열회사	자산매각/매입	2024.06.28	기계장치 등	생산설비 증설/생산효율화 등	4,213	26
SII	계열회사	자산매각	2024.02.15	기계장치 등	생산설비 증설/생산효율화 등	1,753	60
SEHC	계열회사	자산매각	2024.04.16	기계장치 등	생산설비 증설/생산효율화 등	268	△12
SSEC	계열회사	자산매각	2024.04.14	기계장치 등	생산설비 증설/생산효율화 등	250	2
SEDA	계열회사	자산매각	2024.04.23	기계장치 등	생산설비 증설/생산효율화 등	149	_
SEV	계열회사	자산매입	2024.01.17	기계장치 등	생산설비 증설/생산효율화 등	132	_
삼성바이오로직스(주)	계열회사	자산매각	2024.02.28	차량운반구	자산 효율화	122	△14

※ 별도 기준입니다.
[△는 부(-)의 값임]

- ※ 거래일자는 최근 거래일자 기준입니다.
- ※ 거래금액은 시장 및 가치평가 등을 거쳐 적절히 산정되었으며, 거래 다음달 15일・30일 이내 현금 지급조건 등 통상적인 조건으로 거래되었습니다.
- ※ 상기 자산양수도 거래는 이사회 결의 대상이 아닙니다.
- ※ 기업공시서식 작성기준에 따라 거래금액이 1억원 미만인 경우에는 기재를 생략하였습니다.

전자공시시스템 dart.fss.or.kr

3. 대주주와의 영업거래

2024년 반기 중 계열회사인 Samsung International, Inc.(SII) 등과 매출, 매입 등의 영업거래를 하였습니다.

(단위:백만원)

법인명	관계	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액
SSI	계열회사	매출입 등	2024.01~2024.06	반도체 매출입등	16,352,019
SEA	계열회사	매출입 등	2024.01~2024.06	스마트폰 및 가전제품 매출입 등	15,336,116
SSS	계열회사	매출입 등	2024.01~2024.06	반도체 매출입 등	15,258,331
SEVT	계열회사	매출입 등	2024.01~2024.06	스마트폰 매출입 등	13,880,504

[※] 별도 기준입니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

당사는 2024년 반기말 현재 제품경쟁력 제고, 상생경영을 위한 협력사 지원 및 종업원 복리 후생 목적의 주택대부, 학자금 등으로 1,381억원의 대여금이 있습니다.

(단위:백만원)

성 명	관 계	계정과목	대여금 변동 내역				
(법인명)	12 M	[게영파득 	기초	증감	기말		
㈜이랜텍 등	협력업체 및 종업원	단기대여금	46,069	△483	45,586		
대덕전자㈜등	협력업체 및 종업원	장기대여금	89,253	3,252	92,505		
	합 계		135,322	2,769	138,091		

[※] 별도 기준입니다.

※ 대여금은 현재가치할인차금 차감후, 대손충당금(손실충당금) 차감전 기준입니다.

[△는 부(-)의 값임]

[※] 공시대상은 최근사업연도 매출액의 5% 이상 기준입니다.

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용 진행 및 변경사항

해당사항 없습니다.

2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건등

당사는 다수의 회사 등과 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등을 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 당사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

당사(삼성전자㈜, 삼성디스플레이㈜ 등)는 분할된 삼성디스플레이㈜ 등의 분할 전 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다.

그 밖의 우발부채 및 약정사항에 대해서는 'III. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표주석' 및 '5. 재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다.

나. 채무보증내역

(단위 : 천US\$, %)

법인명							채무보증한도		채무금액			
	관계	채권자	내용	목적	보증시작일	보증종료일	기초	기말	기초	증감	기말	이자율
(채무자)					2023-11-	2025-06-	기도	712	기도	00	712	
SEA	계열회사	BOA 등	지급보증	운영자금	09	13	1,278,000	1,278,000	-	-	-	
					2023-08-	2025-06-						
SEM	계열회사	BBVA 등	지급보증	운영자금	20	13	715,000	715,000	-	-	-	
					2023-11-	2025-06-						
SAMCOL	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	09	13	210,000	210,000	-	_	_	
					2023-10-	2025-06-						
SEDA	계열회사	BRADESCO 등	지급보증	운영자금	01	13	329,000	329,000	_	_	_	
	311.041.11		717117	001717	2023-12-	2025-06-						
SECH	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	17	13	62,000	64,000	_	_	_	
0500	3104 =1 / I	00)/4 =	7745	OMTI T	2023-12-	2025-06-	150,000	150,000				
SEPR	계열회사	BBVA 등	지급보증	운영자금	17	13	150,000	150,000	_	_	_	
SSA	માલકાદા	8CB =	TIDHA	оат. ⊐	2023-11-	2025-06-	219 000	318,000				
55A	계열회사	SCB 등	지급보증	운영자금	09	13	318,000	316,000	_	_	_	
SEMAG	계열회사	SocGen 등	지급보증	운영자금	2023-11-	2024-12-	96,000	96,000	8,065	△8,065		
SLIVIAG	게르되시	JUCUEII S	N 1 0	2010	09	16	30,000	90,000	0,003	20,003		
SETK	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2023-11-	2025-06-	917,000	947,000	320,893	175,565	496,458	47.0%
OZ III	게르되시	DIVI 8	VIB 7.0	20/10	09	13	317,000	317,000	020,000	170,000	100, 100	17.070
SETK-P	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2023-11-	2024-12-	70,000	70,000	_	_	_	
52111	711 2 24 7 11	5 5		20712	09	16	7 0,000	, 0,000				
SECE	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2023-12-	2024-12-	114,000	114,000	_	_	_	
					17	16		,				
SEEG	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2024-06-	2025-06-	85,000	85,000	_	_	_	
					14	13		·				
SEIN	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2023-11-	2025-06-	70,000	70,000	_	_	-	
					09	13						
SJC	계열회사	Mizuho Bank 등	지급보증	운영자금	2023-11-	2025-05-	835,508	802,532	_	_	_	
					09	31						
SEUC	계열회사	Credit Agricole 등	지급보증	운영자금	2023-11-	2025-06-	125,000	125,000	_	_	_	
					09	13						
SEDAM	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2023-11-	2025-06-	537,000	537,000	-	-	-	
					09	13						
SECA	계열회사	BOA	지급보증	운영자금	2023-11-	2024-11-	70,000	70,000	-	-	-	
					09	08						
SELA	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2023-12-	2024-12-	60,000	60,000	-	-	-	
					17	16						
SEEH	계열회사	HSBC 등	지급보증	운영자금	2023-09-	2025-06-	888,400	856,400	-	-	-	
					06	13						
SELV	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2023-12-	2024-12-	10,000	10,000	-	-	-	
					17	16						
SEIL	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2023-12-	2024-12-	15,600	15,600	-	-	-	
					17	16						

					2023-11-	2025-06-						
SAPL	계열회사	BOA 등	지급보증	운영자금	09	13	404,000	404,000	-	-	-	
					2024-06-	2025-06-						
SAVINA	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	14	13	51,000	51,000	-	-	-	
					2023-12-	2025-06-						
SCIC	계열회사	HSBC 등	지급보증	운영자금			270,000	270,000	-	-	-	
					17	13						
SESP	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2023-11-	2024-11-	30,000	30,000	-	-	-	
					09	08						
SME	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2023-11-	2024-11-	110,000	110,000	_	_	_	
					09	08						
SAMEX	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2023-12-	2024-12-	5,000	5,000			_	
SAIVILA	게르되시	Citibalik	N U T O	2000	17	16	3,000	3,000				
05101	31104 =1.11	0	71747	0011	2023-12-	2024-12-	0.000	0.000				
SEASA	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	17	16	2,000	2,000	_	_	_	
					2023-11-	2024-11-						
SSAP	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	09	08	35,000	35,000	_	_	_	
					2024-06-	2025-06-						
SEPM	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	14	13	35,000	35,000	_	_	_	
					2024-06-	2025-06-						
SESAR	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	14	13	20,000	20,000	_	_	_	
					2023-12-	2024-12-						
SEUZ	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	17	16	10,000	10,000	_	_	_	

법인명							채무보증한	도	채무금액			
(채무자)	관계	채권자	내용	목적	보증시작일	보증종료일	기초	기말	기초	증감	기말	이자율
AdGear Technologies Inc.	계열회사	BOA	지급보증	운영자금	2023.11.09	2024.11.08	2,000	2,000	-	-	-	
Harman International	계열회사	JP Morgan	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.06.13	100,000	100,000				
Industries, Inc.	게르되バ	JF WOIGAII	NHIE	T8VP	2023.00.14	2024.00.13	100,000	100,000				
Harman International	3104 =1 11	MUEO	TITHE	9417	0000 11 00	00041100	05.000	05.000				
Japan Co., Ltd.	계열회사	MUFG	지급보증	운영자금	2023.11.09	2024.11.08	25,000	25,000	_	_	_	
Harman Holding Limited	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.06.13	30,000	30,000	-	-	-	
Harman do Brasil Industria												
Eletronica e Participacoes	계열회사											
Ltda.												
Harman da Amazonia		SocGen	지급보증	운영자금	2023.11.09	2024.11.08	15,000	15,000	-	-	-	
Industria												
Eletronica e Participacoes	계열회사											
Ltda.												
Harman International	311.041.11			001717								
Industries Limited	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2023.06.14	2024.06.13	30,000	30,000	_	_	_	
SDN	계열회사	SIEL	지급보증	운영자금 등	2021.11.22	2026.02.19	601,149	599,118	510,977	△1,727	509,250	8.1%
SAS	계열회사	Epcor	지급보증	운영자금 등	2022.04.26	채무소멸시	340,000	340,000	-	-	-	
		합	계				9,070,657	9,035,650	839,935	165,773	1,005,708	

※ 연결 기준입니다. SDN 건은 삼성디스플레이㈜, SAS 건은 SEA가 각각 채무보증인입니다.

[△는 부(-)의 값임]

* 건별 채무보증금액이 자기자본의 0.1% 이상 2.5% 미만인 경우 경영위원회, 2.5% 이상인 경우 이사회 의결을 통해 결정됩니다. 또한 종속기업인 삼성디스플레이㈜의 경우 건별 채무보증금액이 100억원 이상인 경우 이사회 의결을 통해 결정됩니다.

※ 당사는 종속기업별 채무보증 만기, 일반적인 신용공여 조건의 이율 등을 감안하여 산정된 채무보증 수수료를 수취하고 있습니다.

당사는 2023년 중 US\$2,141천의 수수료를 청구하였으며, 2024년 중 수취하였습니다.

한편, 삼성디스플레이㈜는 SDN에게 2023년 중 US\$3,066천의 수수료를 청구하였으며, 2024년 중 수취하였습니다.

3. 제재 등과 관련된 사항

가. 수사 · 사법기관의 제재현황

[요약] (단위: 백만원)

일자	제재기관	대상자	처벌 또는 조치 내용	금전적 제재금액	횡령·배임등 금액	근거 법령
2022.07.07	광주지방법원	당사 임직원	벌금	6	1	「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제33조 7호, 제34조, 제18조 1항 등
2023.02.09	광주지방법원	당사 및 당사 임직원	描	25	_	「구.산업안전보건법」제10조 제1항, 「 산업안전보건법」제57조 제1항 등

광주지방법원 순천지원은 2021년 1월 20일「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」제18조 등 위반으로 당사 직원 A프로(근속연수 11년), B프로(근속연수 8년)에게 각 벌금 (3백만원)을 선고하였고, 광주지방법원은 2022년 7월 7일 이 사건 항소심에서 항소 기각 판결을 선고하였습니다. 당사는 재발 방지를 위하여 주기적인 교차 측정 등을 실시하고 있습니다.

광주지방법원은 2023년 2월 9일「구.산업안전보건법」제10조 제1항,「산업안전보건법」제57조 제1항 등 위반으로 당사 및 당사 직원 5명에 대해 약식명령을 발령하였습니다. 당사 및 당사 직원 5명은 이에 대해 정식재판을 청구하지 않아 해당 약식명령은 확정되었고(당사 벌금 15백만원, 당사 직원 벌금 각 2백만원), 당사는 벌금 납부를 완료하였습니다. 당사는 재발 방지를 위하여 환경안전담당자 및 관리감독자 대상으로 특별 교육을 실시하여 관련 법규준수를 위해 노력하고 있습니다.

나. 행정기관의 제재현황

(1) 공정거래위원회의 제재현황

[요약] (단위: 백만원)

OLTI	וב ובודוו סו		처벌 또는	금전적	110 U 71 N2
일자	제재기관	대상자	조치 내용	제재금액	사유 및 근거 법령
2021.06.22	공정거래위원회	당사 및	검찰고발		「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」제23조(불공정거래행위의 금지)
2021.00.22	60기대위전회	회 당사 임직원 검찰			제1항 제7호
		당사	시정조치	101,217	「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」제23조(불공정거래행위의 금지)
2021.08.27	공정거래위원회	3 /1	과징금	101,217	제1항 제7호
2021.00.21	0 6 기내	자회사	시정조치	22,857	「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」제23조(불공정거래행위의 금지)
		(삼성디스플레이㈜)	과징금	22,037	제1항 제7호
2022.03.17	공정거래위원회	당사 임직원	경고	_	「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」제31조(상호출자제한기업집단
2022.00.17	0 6 기대 전	3 N B T E	9.17		등의 지정 등) 제4항
2022.06.27	공정거래위원회	당사	과태료	10	「대리점거래의 공정화에 관한 법률」제5조(대리점거래 계약서의
2022.00.21	0 6 기대 전	671	피대표	10	작성의무) 제1항
2024.04.07	공정거래위원회	당사	시정조치		「대리점거래의 공정화에 관한 법률」제10조(경영활동 간섭 금지) 제
2024.04.07	00기대기전외	0.71	시아크시		1항

공정거래위원회는 2021년 6월 22일 삼성웰스토리㈜와의 단체급식 거래와 관련하여 검찰에 당사 및 퇴직 임원인 최지성 전 미래전략실장을 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」제 23조(불공정거래행위의 금지) 제1항 제7호 위반 혐의로 고발하였습니다.

또한 당사와 삼성디스플레이㈜는 삼성웰스토리㈜와의 단체급식 거래와 관련하여 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」제23조 제1항 제7호 위반 혐의로 공정거래위원회로 부터 2021년 8월 27일 시정조치 및 과징금(당사: 1,012억 17백만원, 삼성디스플레이㈜: 228억 5천 7백만원) 처분을 받았습니다. 동 처분에 대해 현재 행정소송이 진행 중이며, 시정조치에 대해 2022년 1월 27일 집행정지 결정이 확정되었습니다.

공정거래위원회는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 제31조 제4항에 따른 2018년과 2019년 지정자료 제출시 삼성카드㈜의 사외이사가 지배하는 회사인 발벡케이피엘코리아㈜, 발벡케이피엘파트너스㈜, 발벡케이피엘자산운용㈜ 3개사를 상호출자제한기업집단「삼성」의 소속회사에서 누락했다는 이유로 2022년 3월 17일 당사의 이재용 부회장에 대해「경고」처분 하였습니다.

당사는 2022년 6월 27일 공정거래위원회로부터 '대리점거래의 공정화에 관한 법률' 제5조 (대리점거래 계약서의 작성의무) 제1항 위반 혐의로 과태료 1천만원을 부과 받았으며, 이에 대하여 현재 이의신청 절차가 진행 중입니다.

또한 당사는 2024년 4월 7일 공정거래위원회로부터 '대리점거래의 공정화에 관한 법률' 제 10조(경영활동 간섭 금지) 제1항 및 동 법 시행령 제7조 제2호(영업상 비밀 정보 제공 요구) 위반 혐의로 시정명령을 부과 받았습니다.

당사는 공정거래법, 표시광고법, 대리점법 등 법률 준수를 위해 내부 관리 기준을 강화하고 임직원에 대해 관련 예방교육을 시행하고 있습니다.

(2) 기타 행정・공공기관(금융감독・과세 당국 등 포함)의 제재현황

[요약] (단위: 백만원)

일자	제재기관	대상자	처벌 또는 조치 내용	금전적 제재금액	사유 및 근거 법령
2022.10.13	광주광역시청	당사 (광주사업장)	과태료	3.2	「대기환경보전법」제39조 제1항
2022.12.14	환경부	당사 (한국총괄)	과태료	2.0	「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」제17조 제2항
2022.12.22	환경부	당사 (광주사업장)	과태료	1.6	「대기환경보전법」제31조 제1항
2022.12.23	고용노동부	당사 (광주사업장)	과태료	0.08	「산업안전보건법」제37조 제1항
2023.01.16	고용노동부	당사 (광주사업장)	과태료	0.16	「산업안전보건법」제37조 제1항, 제115조 제2항
2022.04.21	고용노동부	당사 (온양사업장)	과태료	0.6	「산업안전보건법」제46조 제1항 등
2023.08.16	구미소방서	당사 (구미사업장)	조치명령	_	「위험물안전관리법」제5조 제1항, 제6조 제1항
2023.08.18	개인정보	당사	과징금	875.6	「개인정보보호법」제29조. 동법 시행령 제48조의2 제1항 제2호
2020.00.10	보호위원회	σN	과태료	2.4	개단이포포포함] 제45포, 등합 사용증 제40포크스제 1형 제2모
2023.08.23	광주광역시청	당사 (광주사업장)	과태료	2.0	「대기환경보전법」제31조 제2항
2023.09.04	산업통상자원부	자회사 (삼성메디슨㈜)	교육명령 (2인)	_	「대외무역법」제19조, 제31조, 제49조

당사는 2022년 2월 21일부터 2월 23일까지 진행된 온양사업장에 대한 고용노동부의 PSM 이행상태 정기평가와 관련하여 PSM 평가 등급은 한 단계 향상되었으나, 4월 21일「산업안전보건법」제46조(공정안전보고서의 이행 등) 제1항 등 위반으로 과태료(60만원)가 발생하여 자진 납부 완료하였습니다. 당사는 위반사항에 대해서 조치 후 고용노동부에 개선 결과를 제출하였으며, PSM 혁신조직을 신설하여 인허가, 설계 반영, 12대 실천과제, 전문성 향상 활동을 통해 PSM 상시 운영체계를 구축하여 운영 중에 있으며, 현장 공정안전 전문가를 육성하고 공정안전 자체평가를 실시하여 관련 법규 준수를 위해 노력하고 있습니다.

2022년 7월 7일 광주지방법원에서 당사 임직원 2명에게 「환경분야 시험·검사 등에 관한법률」 제18조 등 위반에 대한 선고가 완료 됨에 따라 2022년 10월 13일 광주광역시청으로부터 대기오염물질 자가측정결과 기록과 관련하여「대기환경보전법」제39조 (자가측정) 제1항 위반으로 과태료(3.2백만원)가 발생하여 자진 납부 완료하였습니다. 당사는 측정값에 대한 신뢰도를 높이기 위하여 주기적인 교차 측정 등을 실시하고 있습니다.

당사는 2022년 11월 28일부터 29일까지 광주사업장에 대한 환경부의 대기방지시설 감독과 관련하여, 2022년 12월 22일「대기환경보전법」제31조 (배출시설과 방지시설의 운영) 제 1항 위반으로 과태료(1.6백만원)가 발생하여 자진 납부 완료하였습니다. 당사는 대기방지시설 점검을 강화하여 관련 법규 준수를 위해 노력하고 있습니다.

당사는 환경부로부터 2022년 12월 14일 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」제 17조 (배출권 할당의 취소) 제2항 위반으로 과태료(2백만원)를 부과 받았으며, 납부 완료하였습니다. 당사는 온실가스 배출 사업장 현황 관리를 강화하여 관련 법규 준수를 위해 노력하고 있습니다.

당사는 2022년 12월 19일부터 21일까지 광주사업장에 대한 고용노동부의 산업안전보건판리 감독과 관련하여, 2022년 12월 23일「산업안전보건법」제37조 (안전보건표지의 설치・부착) 제1항 위반으로 과태료(8만원)가 발생하여 자진 납부 완료하였습니다. 또한, 2023년 1월 9일부터 11일까지 광주사업장에 대한 고용노동부의 산업안전보건관리 감독과 관련하여, 2023년 1월 16일「산업안전보건법」제115조 (물질안전보건자료대상물질 용기 등의 경고표시) 제2항, 제37조 (안전보건표지의 설치・부착) 제1항 위반으로 과태료(16만원)가 발생하여 자진 납부 완료하였습니다. 당사는 안전표지판 설치 및 부착 점검을 강화하여 관련 법규 준수를 위해 노력하고 있습니다.

당사는 구미소방서로부터 2023년 8월 16일 구미사업장에 대한 「위험물안전관리법」제5조 (위험물의 저장 및 취급의 제한) 제1항 및 제6조 (위험물시설의 설치 및 변경 등) 제1항 위반으로 조치명령을 받아 위험물취급소 설치허가신청 등 조치를 완료하였습니다. 당사는 위험물 시설에 대해 인허가 관리를 강화하여 관련 법규 준수를 위해 노력하고 있습니다.

당사는 개인정보보호위원회로부터 2023년 8월 18일「개인정보보호법」제29조 (안전조치의무) 및 동법 시행령 제48조의2 (개인정보의 안전성 확보 조치에 관한 특례) 제1항 제2호위반으로 시정조치 처분과 과징금 875.6백만원 및 과태료 2.4백만원을 부과 받았으며, 납부완료하였습니다. 당사는 시스템 운영 협력업체 대상 교육 및 보안관련 계약을 강화하여 관련법규 준수를 위해 노력하고 있습니다.

당사는 광주광역시청으로부터 2023년 8월 23일 광주사업장에 대한 「대기환경보전법」제 31조 (배출시설과 방지시설의 운영) 제2항 위반으로 행정처분(경고) 및 과태료(2백만원)를 부과 받았으며, 과태료는 납부 완료하였습니다. 당사는 대기 배출시설과 방지시설의 운영 상황에 대한 전산 입력 관리 프로세스를 강화하여 관련 법규 준수를 위해 노력하고 있습니다.

삼성메디슨㈜는 상황허가 대상 일부 품목에 대해 산업통상자원부의 사전 허가를 받지 않고 수출하여 2023년 9월 4일 산업통상자원부로부터 「대외무역법」제19조(전략물자의 고시 및 수출허가 등) 등 위반으로 교육명령(2인) 행정처분을 부과받았으며, 2023년 11월 7일 산업 통상자원부의 교육과정을 이수하였습니다. 삼성메디슨㈜는 재발 방지를 위하여 전략물자 관 리담당자의 교육활동을 강화하고 내부 프로세스를 보완하는 등 관련 법규 준수를 위해 노력 하고 있습니다.

다. 한국거래소 등으로부터 받은 제재현황

해당사항 없습니다

라. 단기매매차익 발생 및 반환에 관한 사항

해당사항 없습니다.

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

해당사항 없습니다.

나. 대외후원 현황

현 황	금 액	내 용	비고
2022년 사회공헌		· 당사 사회공헌기금은 임직원기부금과 회사매칭기금으로 구성되며,	
매칭기금 운영계획	117.5억원	2022년 회사매칭기금으로 117.5억원 운영	2022.02.15
010711 20711		·청소년 교육 관련 및 취약계층 관련 사회공헌 사업에 활용	이사회 결의
학교법인 충남삼성학원	23.24억원	· 지역 교육 환경 개선 도모	에게되 크리
기부금 출연	20.2172	N = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	
		· 저소득층 중학생 학습지원 프로그램인 드림클래스 운영	
삼성복지재단 등		(삼성복지재단, 44억원)	
기부금 출연	468억원	·삼성서울병원 리모델링 공사비 지원(삼성생명공익재단, 232억원)	2022.04.28
77-6 20		・교직원 법정부담금 지원 및 삼성장학금 운영 등(성균관대학, 150억원)	01사회 결의
		· 학술, 예술 및 인류 복지 증진에 크게 공헌한 인물 시상(호암재단, 42억원)	이사회 필리
DS부문 우수협력사	약 740억원	• 사업장내 안전사고 예방, 생산성 향상 및 협력사와의 동반성장 확산	
인센티브	의 약 /40억권	·대상: DS부문 상주 1,2차 협력회사 중 중소기업	
서울대			0000 07 00
반도체공동연구소	50억원	· 서울대학교 반도체공동연구소의 교육 장비 인프라 및	2022.07.28
운영비 기부금 출연		연구 인력 채용을 위한 운영비 지원 	이사회 결의
이태원 사고 관련 지원 및		시네이 내그 교려 TI이 미 비용이다니샤데 그夫은 이해	0000 11 00
사회안전시스템 구축 성	40억원	· 이태원 사고 관련 지원 및 사회안전시스템 구축을 위해	2022.11.03
日		총 40억원을 사단법인 전국재해구호협회에 현금 기부 	이사회 결의
희망2023	100 701 91	• 연말 이웃사랑 성금 보금 참여로 소외계층을 돕고	
나눔캠페인 기부금 출연	183.7억원	기업의 사회적 책임을 다하고자 사회 복지공동모금회에 출연	
Samsung Global Goals	\$7,188,329	· United Nations Development Programme(UNDP)에 전달하여,	2022.11.30
기부금 출연	(약 95.7억원)	각 국의 구호활동 등에 활용	이사회 결의
국제기능올림픽	165만 유로	·제47회 프랑스 리옹 국제기능올림픽대회 및	
후원	(약22.5억원)	국제기능올림픽위원회(WorldSkills International) 후원	
2023년 사회공헌		· 당사 사회공헌기금은 임직원기부금과 회사매칭기금으로 구성되며,	
매칭기금 운영계획	123.4억원	2023년 회사매칭기금으로 123.4억원 운영	2023.02.14
매장기급 분장계목		·청소년 교육 관련 및 취약계층 관련 사회공헌 사업에 활용	
학교법인 충남삼성학원	22 70 H 의	ㆍ지역 교육 환경 개선 도모	이사회 결의
기부금 출연	23.78억원	· 시국 교육 전경 개선 도도	
스마트공장	224억원	・스마트공장 지원을 통한 국내 제조경쟁력 강화 및 지역균형 발전에 기여	
지원사업 추진	224학편	· ㅡ마ㅡㅇㅎ 자건글 중한 국내 세포증정국 정와 롯 자극관정 글산에 가며	2023.04.27
DS부문 우수협력사	801억원	・사업장내 안전사고 예방, 생산성 향상 및 협력사와의 동반성장 확산	이사회 결의
인센티브	이미국권	·대상: DS부문 상주 1,2차 협력회사 중 중소기업	
삼성복지재단 등		· 삼성서울병원 리모델링 공사비 지원(삼성생명공익재단, 171.9억원)	2023.07.27
기부금 출연	328.3억원	·교직원 법정부담금 지원 및 삼성장학금 운영 등(성균관대학, 122.4억원)	01사회 결의
711 G E C		# 10 00 1 00 AC & 000 10 00 0(000 041 7, 122.47 0)	기기되 근데

		・과학(물리・수학)/과학(화학・생명)/공학/의학/예술/사회봉사 6개 부문	
		시상(호암재단, 34억원)	
희망2024	00 504 91	• 연말 이웃사랑 성금 모금 참여로 소외계층을 돕고	
나눔 캠페인 기부금 출연	86.5억원	기업의 사회적 책임을 다하고자 사회복지공동모금회에 출연	2023.11.30
Samsung Global Goals	\$4,366,270	· United Nations Development Programme(UNDP)에 전달하여,	이사회 결의
기부금 출연	(56.8억원)	각 국의 구호활동 등에 활용	
0004년 사람고림		· 당사 사회공헌기금은 임직원기부금과 회사매칭기금 으로 구성되며,	
2024년 사회공헌	122.7억원	2024년 회사매칭기금으로 122.7억원 운영	0004 0 00
매칭기금 운영계획		·청소년 교육 관련 및 취약계층 관련 사회공헌 사업에 활용	2024.2.20
학교법인 충남삼성학원	04.0001.01		이사회 결의
기부금 출연	24.69억원	· 지역 교육 환경 개선 도모 	

[※] 대외후원 현황 및 금액은 이사회 결의 기준으로 기재하였습니다.

다. 녹색경영

당사는 정부의 저탄소 녹색성장 정책에 부응하여 '녹색기업 지정' 및 '녹색기술 인증'을 확대하고 있습니다. 특히 관련 법규에서 요구하는 사업장에서 발생하는 '온실가스배출량'과 '에너지 사용량'을 정부에 신고하고 지속가능보고서 등을 통하여 이해관계자에게 관련 정보를 투명하게 제공하고 있습니다.

(녹색기업 지정)

당사는 오염물질 감소, 자원과 에너지의 절감, 제품의 환경성 개선, 녹색경영체제의 구축 등 친환경기업으로서의 책임을 다하고 있으며, 「환경기술 및 환경산업 지원법」제16조의2(녹색기업의 지정 등)에 따라 2024년 반기말 현재(별도 기준) 수원사업장, 구미사업장, 기흥·화성사업장, 평택사업장, 온양사업장, 천안사업장이 녹색기업으로 지정되어 있습니다. 한편, 2021년 3월 광주사업장은 「환경기술 및 환경산업 지원법」제16조의3(녹색기업의 지정취소) 제1항 제1호에 따라 녹색기업 지정이 취소되었습니다.

(녹색기술 인증)

당사는 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」제60조 (녹색기술·녹색산업의 표준화 및 인증 등) 2항에 따라 '녹색기술 인증'을 취득하고 있습니다. 당사는 인증 제도가 시작된 2010년부터 지속적으로 녹색기술을 발굴하여 인증을 취득해왔으며 2024년 반기말 기준 총 7건의 녹색기술에 대한 유효 인증을 보유하고 있고 해당 녹색기술이 적용된 179개 모델에 대해 '녹색기술제품 확인' 인증을 보유 중입니다.

2024년 반기말 현재 녹색기술 인증 현황은 다음과 같습니다.

인증번호	기술 명칭	인증일자	유효기간
GT-23-01728	배출가스 저감장치가 적용된 히트펌프의 고효율 운전을 위한 저부하 운전 촉매 활성화 기술	2023.07.27	2026.07.26
GT-20-00880	GT-20-00880 고효율 히트펌프와 열교환기를 적용한 의류건조기 에너지 효율 향상 기술		2026.05.20
GT-20-00826	미세 다공 홀 구조가 적용된 천장형 무풍 에어컨 기술	2020.01.30	2026.01.29
GT-22-01562	노점 온도를 이용한 절전 제습 기술	2022.11.24	2025.11.23
GT-19-00664	Self Wake-Up 기능을 갖는 모니터 대기전력 저감 기술	2019.05.16	2025.05.15
GT-21-01256	프린터 및 복합기의 슬립모드 소비전력 저감 기술	2021.11.18	2024.11.17
GT-21-01248	고효율 전력 변환 기술을 활용한 노트북 대기전력 저감 기술	2021.10.14	2024.10.13

[※]별도 기준입니다.

(온실가스 배출량 및 에너지 사용량 관리)

당사는 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」제27조 (관리업체의 온실가스목표관리)에 따른 온실가스 에너지 목표관리업체에 해당됩니다. 따라서 동법 제27조3항 및 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」제24조 (배출량의 보고 및 검증)에 따라 제3자 검증을 마친 당사의 온실가스 배출량과 에너지 사용량을 2011년 5월부터 정부 당국에신고하고 이해관계자에게 공개하고 있습니다.

정부에 신고된 당사 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

(단위:tCO2-eq, TJ)

구 분	2023년	2022년	2021년
온실가스(tCO2-eq)	13,292,256	14,925,733	14,515,620
에너지(TJ)	240,882	222,877	200,942

- ※ 별도 기준입니다.
- ※ 대상은 국내 제조사업장, 사옥, 당사 소유 건물, 임차 건물 등입니다.
- ※ 온실가스 사용실적은 오존파괴물질(ODS) 제외된 기준입니다.
- ※ 배출량 및 에너지 사용량은 정부의 배출량 적합성 평가 등에 따라 변동될 수 있습니다.

당사는 2015년부터 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」제8조 (할당대상업체의 지정 및 지정취소)에 따라 온실가스 배출권 할당대상업체에 해당합니다.

라. 건강친화기업 인증

당사는 임직원 건강증진을 위해 사내부속의원, 물리치료실, 근골격계예방센터, 마음건강클리닉 등 다양한 의료시설을 운영하고 있고, 건강증진 프로그램을 통해 직원 스스로가 건강관리를 수행할 수 있도록 지원하고 있습니다. 이를 인정받아 DS 부문은 「국민건강증진법」 제6조의2 제1항에 따라 2022년 12월 7일 보건복지부 장관으로부터 건강친화기업 인증을 취득하였습니다(유효기간: 2022년 12월 7일 ~ 2025년 12월 6일).

XII. 상세표

1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

당사의 연결대상 종속기업은 2024년 반기말 현재 226개사입니다. 전년말 대비 1개 기업이 증가하고 7개 기업이 감소하였습니다.

☞ 본문 위치로 이동

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업 연도말 자산총액	지배관계 근거	주요종속 회사 여부
Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	1978. 07	85 Challenger Rd., Ridgefield Park, New Jersey, USA	전자제품 판매	41,926,899	의결권의 과반수 소유 (K-IFRS 1110호)	0
Samsung International, Inc. (SII)	1983. 10	9335 Airway Rd. #105, San Diego, California, USA	전자제품 생산	1,690,752	상동	0
Samsung Mexicana S.A. de C.V (SAMEX)	1988. 03	Parque Ind., El Florido 1ra y 2da Secc, Tijuana, B.C., Mexico	전자제품 생산	190,798	상동	0
Samsung Electronics Home Appliances America, LLC (SEHA)	2017. 08	284 Mawsons Way, Newberry, South Carolina, USA	가전제품 생산	863,840	상동	0
Samsung Research America, Inc (SRA)	1988. 10	665 Clyde Ave., Mountain View, California, USA	R&D	984,163	상동	0
SAMSUNG NEXT LLC (SNX)	2016. 08	665 Clyde Ave., Mountain View, California, USA	해외자회사 관	257,924	상동	0
SAMSUNG NEXT FUND LLC (SNXF)	2016. 08	665 Clyde Ave., Mountain View, California, USA	신기술사업자, 벤처기업 투자	370,961	상동	0
NeuroLogica Corp.	2004. 02	14 Electronics Ave., Danvers, Massachusetts, USA	의료기기 생산 및 판매	243,481	상동	0
Samsung HVAC America, LLC	2001. 07	3001 Northern Cross Blvd. #361, Fort Worth, Texas, USA	에어컨공조 판 매	113,088	상동	0
Joyent, Inc.	2005. 03	655 Montgomery St. #1600, San Francisco, California, USA	클라우드서비스	202,727	상동	0
SmartThings, Inc.	2012. 04	665 Clyde Ave., Mountain View, California, USA	스마트홈 플랫 폼	220,123	상동	0
TeleWorld Solutions, Inc. (TWS)	2002. 05	43130 Amberwood Plaza #210, Chantilly, Virginia, USA	네트워크장비 설치 및 최적화	32,371	상동	Х
Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	1983. 07	3655 N. 1st St., San Jose, California, USA	반도체·디스플 레이 패널 판매	12,796,440	상동	0
Samsung Federal, Inc. (SFI)	2023. 05	3655 N. First St., San Jose CA 95134	R&D	1,263	상동	Х
Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	1996. 02	12100 Samsung Blvd., Austin, Texas, USA	반도체 생산	16,714,945	상동	0
Samsung Oak Holdings, Inc. (SHI)	2016. 06	3655 N. 1st St., San Jose, California, USA	해외자회사 관	558,656	상동	0
SEMES America, Inc.	1998. 10	13400 Immanuel Rd., Pflugerville, Texas, USA	반도체 장비 서 비스	2,529	상동	Х

Samsung Display America Holdings, Inc. (SDAH)	2023. 05	3655 N 1st St San Jose CA 95134	해외자회사 관	307,429	상동	0
eMagin Corporation	2023. 05	700 South Drive Suite # 201 Hopewell Junction, NY 12533700 South Drive Suite # 201 Hopewell Junction, NY 12533	디스플레이 패 널 개발 및 생산	370,378	상동	0
Samsung Electronics Canada, Inc. (SECA)	1980. 07	2050 Derry Rd. West, Mississauga, Ontario, Canada	전자제품 판매	1,302,924	상동	0
AdGear Technologies Inc.	2010. 08	481 Viger West #300, Montreal, Quebec, Canada	디지털광고 플 랫폼	161,458	상동	0
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	1995. 01	Av. Dr. Chucri Zaidan, 1240 Diamond Tower, Sao Paulo, Brazil	전자제품 생산 및 판매	5,542,627	상동	0
Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM)	1995. 07	Col. Chapultepec Morales, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de Mexico, Mexico	전자제품 판매	2,153,032	상동	0
Samsung Electronics Digital Appliance Mexico, SA de CV (SEDAM)	2012. 12	Av. Benito Juarez #119, Parque Industrial Qro, Sta. Rosa Jauregui C.P., Queretaro, Mexico	가전제품 생산	1,324,763	상동	0
Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A. (SELA)	1989. 04	Calle 50 Edificio PH Credicorp Bank Piso 16, Panama City, Panama	전자제품 판매	643,286	상동	0
Samsung Electronics Latinoamerica Miami, Inc. (SEMI)	1995. 05	9800 NW 41st St. #200, Miami, Florida, USA	전자제품 판매	553,965	상동	0
Samsung Electronica Colombia S.A. (SAMCOL)	1997. 03	Carrera 7 #114-43 Oficina 606, Bogota, Colombia	전자제품 판매	463,772	상동	0
Samsung Electronics Argentina S.A. (SEASA)	1996. 06	Bouchard 710 Piso #8, Buenos Aires, Argentina	마케팅 및 서비	83,075	상동	0
Samsung Electronics Chile Limitada (SECH)	2002. 12	Americo Vespucio Sur 100 Oficina 102, Las Condes, Chile	전자제품 판매	524,530	상동	0
Samsung Electronics Peru S.A.C. (SEPR)	2010. 04	Av. Rivera Navarrete 501 Piso 6, San Isidro, Lima, Peru	전자제품 판매	295,477	상동	0
Samsung Electronics Venezuela, C.A. (SEVEN)	2010. 05	Torre Kepler Piso 1, Av. Blandin Castellana, Municipio Chacao, Caracas, Venezuela	마케팅 및 서비	168	상동	Х
Samsung Electronics Panama. S.A. (SEPA)	2012. 07	Torre C Piso 23 Torre de Las Americas, Panama City, Panama	컨설팅	5,864	상동	X
Harman International Industries, Inc.	1980. 01	400 Atlantic St., Stamford, Connecticut, USA	해외자회사 관리	16,329,845	상동	0
Harman Becker Automotive Systems, Inc.	1981. 06	30001 Cabot Drive, Novi, Michigan, USA	오디오제품 생 산, 판매, R&D	3,137,078	상동	0
Harman Connected Services, Inc.	2002. 02	445 Indio Way Sunnyvale, CA 94085	Connected Service Provider	2,265,938	상동	0
Harman Connected Services Engineering Corp.	2004. 09	445 Indio Way Sunnyvale, CA 94085	Connected Service Provider	-	상동	Х
Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	2005. 07	Av. Cupiuba 401, Distrito Industrial, Manaus, Amazonas, Brazil	오디오제품 생 산, 판매	196,081	상동	0
Harman de Mexico, S. de R.L. de C.V.	1997. 02	2290 Ave De Las Torres, Juarez, Chih, Mexico	오디오제품 생 산	261,655	상동	0
Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	1958. 11	BR-386 KM 435, Nova Santa Rita, Rio Grande do Sul, Brazil	오디오제품 판 매, R&D	304,138	상동	0

Harman International Industries Canada	2005. 05	2900-550 Burrard St., Vancouver, British Columbia,	오디오제품 판	326	상동	X
Ltd.		Canada	OH			
Harman International Mexico, S. de	2014. 12	2290 Ave De Las Torres, Juarez, Chih, Mexico	오디오제품 판	47,811	상동	×
R.L. de C.V.			OH			
Harman KG Holding, LLC	2009. 03	400 Atlantic St., Stamford, Connecticut, USA	해외자회사 관	_	상동	×
			리			
Harman Professional, Inc.	2006. 07	8500 Balboa Blvd., Northridge, California, USA	오디오제품 판	898,008	상동	0
			OH, R&D	ŕ		_
Roon Labs, LLC.	2023.11	400 Atlantic Street, 4th Floor Stamford, CT 06901	오디오제품판매	69,748	상동	Х
Beijing Integrated Circuit Industry	2014 12	89 Nexus Way, Cayman Bay, Grand Cayman, Cayman Islands	벤처기업 투자	13,652	상동	Х
International Fund, L.P	2014. 12	os nekus way, oayman bay, diana oayman, oayman islands	전시기법 무지	10,032	0.0	^
China Materialia New Materials 2016	2017 00	22 Lime Tree Roy Av. Crand Courses Courses Islands	베리기어 ETL	0 1 / 1	사도	>
Limited Partnership	2017.09	23 Lime Tree Bay Av., Grand Cayman, Cayman Islands	벤처기업 투자	8,141	상동	Х
Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	1995. 07	1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, UK	전자제품 판매	2,902,722	상동	0
			해외자회사 관			
Samsung Electronics Ltd. (SEL)	1999. 01	1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, UK	리	7,212	상동	Х
Samsung Semiconductor Europe			반도체・디스플			
Limited (SSEL)	1997. 04	No.5 The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, UK	레이 패널 판매	109,216	상동	0
Samsung Electronics GmbH (SEG)	1984. 12	Am Kronberger Hang 6, Schwalbach/Ts., Germany	전자제품 판매	2,097,706	상동	0
Samsung Electronics Holding GmbH			해외자회사 관			
(SEHG)	1982. 02	Am Kronberger Hang 6, Schwalbach/Ts., Germany	리	438,172	상동	0
Samsung Semiconductor Europe			반도체・디스플			
GmbH (SSEG)	1987. 12	Koelner Str. 12, Eschborn, Germany	레이 패널 판매	1,024,701	상동	0
Samsung Electronics France S.A.S			444			
(SEF)	1988. 01	1 Rue Fructidor, Saint-Ouen, France	전자제품 판매	1,265,823	상동	0
Samsung Electronics Italia S.P.A. (SEI)	1991. 04	Via Mike Bongiorno 9, Milano, Italy	전자제품 판매	1,053,955	상동	0
Samsung Electronics Iberia, S.A.	1991. 04	Parque Empresarial Omega Edf. C Av. de Barajas 32,	전자제곱 전해	1,050,955	00	0
	1989. 01		전자제품 판매	1,266,167	상동	0
(SESA)		Alcobendas, Madrid, Spain				
Samsung Electronics Portuguesa,	1982. 09	Lagoas, Edificio 5B, Piso 0, Porto Salvo, Portugal	전자제품 판매	304,248	상동	0
Unipessoal, Lda. (SEP)			TITITE			
Samsung Electronics Hungarian Private	1989. 10	Samsung ter 1, Jaszfenyszaru, Hungary	전자제품 생산	1,426,079	상동	0
Co. Ltd. (SEH)			및 판매			
Samsung Electronics Europe Logistics	1991. 05					0
B.V. (SELS)		Olof Palmestraat 10, Delft, Netherlands	물류	1,639,004	상동	0
O		Olof Palmestraat 10, Delft, Netherlands	물유	1,639,004	상동	0
Samsung Electronics Benelux B.V.	1995. 07	Olof Palmestraat 10, Delft, Netherlands Evert van de Beekstraat 310, Schiphol, Netherlands	물류	1,639,004	상동 상동	0
Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	1995. 07					
		Evert van de Beekstraat 310, Schiphol, Netherlands		1,794,552	상동	0
(SEBN)	1995. 07		전자제품 판매			
(SEBN) Samsung Electronics Europe Holding	2008. 10	Evert van de Beekstraat 310, Schiphol, Netherlands Evert van de Beekstraat 310, Schiphol, Netherlands	전자제품 판매 해외자회사 관	1,794,552 9,660,481	상동 상동	0
(SEBN) Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	2008. 10	Evert van de Beekstraat 310, Schiphol, Netherlands	전자제품 판매 해외자회사 관	1,794,552	상동	0
(SEBN) Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH) Samsung Electronics Nordic Aktiebolag	2008. 10	Evert van de Beekstraat 310, Schiphol, Netherlands Evert van de Beekstraat 310, Schiphol, Netherlands Box 1235, 16428, Kista, Sweden	전자제품 판매 해외자회사 관	1,794,552 9,660,481 591,101	상동 상동 상동	0 0
(SEBN) Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH) Samsung Electronics Nordic Aktiebolag (SENA)	2008. 10	Evert van de Beekstraat 310, Schiphol, Netherlands Evert van de Beekstraat 310, Schiphol, Netherlands	전자제품 판매 해외자회사 관 리 전자제품 판매	1,794,552 9,660,481	상동 상동	0
(SEBN) Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH) Samsung Electronics Nordic Aktiebolag (SENA) Samsung Electronics Slovakia s.r.o	2008. 10 1992. 03 2002. 06	Evert van de Beekstraat 310, Schiphol, Netherlands Evert van de Beekstraat 310, Schiphol, Netherlands Box 1235, 16428, Kista, Sweden Hviezdoslavova 807, Galanta, Slovakia	전자제품 판매 해외자회사 관 리 전자제품 판매 TV · 모니터 생 산	1,794,552 9,660,481 591,101 928,129	상동 상동 상동 상동	0 0
(SEBN) Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH) Samsung Electronics Nordic Aktiebolag (SENA) Samsung Electronics Slovakia s.r.o (SESK)	2008. 10	Evert van de Beekstraat 310, Schiphol, Netherlands Evert van de Beekstraat 310, Schiphol, Netherlands Box 1235, 16428, Kista, Sweden	전자제품 판매 해외자회사 관 리 전자제품 판매	1,794,552 9,660,481 591,101	상동 상동 상동	0 0
(SEBN) Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH) Samsung Electronics Nordic Aktiebolag (SENA) Samsung Electronics Slovakia s.r.o (SESK) Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o	2008. 10 1992. 03 2002. 06	Evert van de Beekstraat 310, Schiphol, Netherlands Evert van de Beekstraat 310, Schiphol, Netherlands Box 1235, 16428, Kista, Sweden Hviezdoslavova 807, Galanta, Slovakia ul.Marynarska 15, Warszawa, Poland	전자제품 판매 해외자회사 관 리 전자제품 판매 TV · 모니터 생 산 전자제품 판매	1,794,552 9,660,481 591,101 928,129 1,384,273	상동 상동 상동 상동	0 0 0
(SEBN) Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH) Samsung Electronics Nordic Aktiebolag (SENA) Samsung Electronics Slovakia s.r.o (SESK) Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o (SEPOL)	2008. 10 1992. 03 2002. 06	Evert van de Beekstraat 310, Schiphol, Netherlands Evert van de Beekstraat 310, Schiphol, Netherlands Box 1235, 16428, Kista, Sweden Hviezdoslavova 807, Galanta, Slovakia	전자제품 판매 해외자회사 관 리 전자제품 판매 TV · 모니터 생 산	1,794,552 9,660,481 591,101 928,129	상동 상동 상동 상동	0 0
(SEBN) Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH) Samsung Electronics Nordic Aktiebolag (SENA) Samsung Electronics Slovakia s.r.o (SESK) Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o (SEPOL) Samsung Electronics Poland	2008. 10 1992. 03 2002. 06 1996. 04 2010. 02	Evert van de Beekstraat 310, Schiphol, Netherlands Evert van de Beekstraat 310, Schiphol, Netherlands Box 1235, 16428, Kista, Sweden Hviezdoslavova 807, Galanta, Slovakia ul.Marynarska 15, Warszawa, Poland	전자제품 판매 해외자회사 관 리 전자제품 판매 TV · 모니터 생 산 전자제품 판매 가전제품 생산	1,794,552 9,660,481 591,101 928,129 1,384,273 882,673	상동 상동 상동 상동 상동 상동	0 0 0
(SEBN) Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH) Samsung Electronics Nordic Aktiebolag (SENA) Samsung Electronics Slovakia s.r.o (SESK) Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o (SEPOL) Samsung Electronics Pol	2008. 10 1992. 03 2002. 06	Evert van de Beekstraat 310, Schiphol, Netherlands Evert van de Beekstraat 310, Schiphol, Netherlands Box 1235, 16428, Kista, Sweden Hviezdoslavova 807, Galanta, Slovakia ul.Marynarska 15, Warszawa, Poland ul. Mickiewicza 52, Wronki, Poland	전자제품 판매 해외자회사 관 리 전자제품 판매 TV · 모니터 생 산 전자제품 판매	1,794,552 9,660,481 591,101 928,129 1,384,273	상동 상동 상동 상동	0 0 0
(SEBN) Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH) Samsung Electronics Nordic Aktiebolag (SENA) Samsung Electronics Slovakia s.r.o (SESK) Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o (SEPOL) Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Zo.o (SEPM) Samsung Electronics Romania LLC	2008. 10 1992. 03 2002. 06 1996. 04 2010. 02	Evert van de Beekstraat 310, Schiphol, Netherlands Evert van de Beekstraat 310, Schiphol, Netherlands Box 1235, 16428, Kista, Sweden Hviezdoslavova 807, Galanta, Slovakia ul.Marynarska 15, Warszawa, Poland ul. Mickiewicza 52, Wronki, Poland Sos. Pipera-Tunari, nr. 1/VII, Nord City Tower, Voluntari,	전자제품 판매 해외자회사 관 리 전자제품 판매 TV · 모니터 생 산 전자제품 판매 가전제품 생산	1,794,552 9,660,481 591,101 928,129 1,384,273 882,673	상동 상 동 상 상 동 상 상 동 상 상 동	0 0 0

Samsung Electronics Switzerland	2013. 05	Binzallee 4, Zurich, Switzerland	전자제품 판매	264,260	상동	0
GmbH (SESG)						
Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o. (SECZ)	2010. 01	V Parku 14, Prague, Czech Republic	전자제품 판매	391,308	상동	0
SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS SIA						
(SEB)	2001. 10	Duntes iela 6, Riga, Latvia	전자제품 판매	131,129	상동	0
Samsung Electronics Greece S.M.S.A						
(SEGR)	2010. 04	280 Kifissias Ave, Halandri 15232, Athens, Greece	전자제품 판매	153,107	상동	0
Samsung Electronics Air Conditioner			에어컨공조 판			
Europe B.V. (SEACE)	2017. 04	Evert van de Beekstraat 310, Schiphol, Netherlands	OH	273,604	상동	0
Samsung Nanoradio Design Center			011			
(SNDC)	2004. 02	Torshamnsgatan 48, 16440, Kista, Sweden	R&D	28,657	상동	X
Samsung Denmark Research Center		a /a Navi Sajanga park Nijala Jarnas Vai 10 Aalbarg (Ast				
	2012. 09	c/o Novi Science park, Niels Jernes Vej 10, Aalborg Øst,	R&D	28,791	상동	X
ApS (SDRC)		Denmark				
Samsung Cambridge Solution Centre	2012. 09	St. John's Houst, St. John's Innovation Park, Cowley Rd.,	R&D	210,343	상동	0
Limited (SCSC)		Cambridge, UK				
			네트워크			
SAMSUNG Zhilabs, S.L.	2008. 11	Numancia 69-73, 5F, Barcelona, Spain	Solution 개발,	11,879	상동	X
			판매			
FOODIENT LTD.	2012. 03	Cornwall House, 31 Lionel St., Birmingham, UK	R&D	10,004	상동	×
Samsung Electronics Rus Company						
LLC (SERC)	2006. 10	31 Novinsky Boulevard, Moscow, Russia	전자제품 판매	839,493	상동	0
Samsung Electronics Rus Kaluga LLC		1 Vladenie, Perviy Severniy proezd St., Koryakovo, Borovsk,				
(SERK)	2007. 07	Kaluga, Russia	TV 생산	1,030,743	상동	0
Samsung Electronics Ukraine Company		, raidga, ridobia				
	2008. 09	75A, Zhylianska St., Kiev, Ukraine	전자제품 판매	280,470	상동	0
LLC (SEUC)						
Samsung R&D Institute Ukraine	2022. 02	57 L'va Tolstogo St. Kyiv Ukraine	R&D	9,454	상동	X
(SRUKR)						
Samsung Electronics Central Eurasia	2008. 09	Naurizbay batyr st., Almaty, Republic of Kazakhstan	전자제품 판매	362,213	상동	0
LLP (SECE)						
Samsung R&D Institute Rus LLC (SRR)	2011. 11	12, building 1, Dvintsev St., Moscow, Russia	R&D	49,646	상동	Х
Samsung Electronics Caucasus Co. Ltd	2014. 10	1065 Bridge Plaza Biz Centre 12F, 6 Bakikhanov St., Baku,	마케팅	2,632	상동	×
(SECC)	2011110	Azerbaijan	31,110	2,002		^
Samsung Electronics Uzbekistan Ltd.	0000 00	International Business Center, 107 B - Amir Temur str.,	0131151	01.050		
(SEUZ)	2022. 03	Tashkent Uzbekistan	마케팅	91,356	상동	0
			오디오제품 생			
AKG Acoustics Gmbh	1947. 03	Herrengasse 1, A-1010, Vienna, Austria	산, 판매	356,482	상동	0
			Connected			
Apostera UA, LLC	2020 10	3 Sumska St., Kyiv, Ukraine	Service	1,037	상동	×
7.500.014 07.1, 220	2020. 10	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		1,007		^
Harman Audio Iborio Ennano Canindad			Provider			
Harman Audio Iberia Espana Sociedad	2012. 11	C/ ERCILLA 17 3ºBILBAO48, Bizkaia, Spain	오디오제품 판	1,254	상동	×
Limitada			OH OH OH			
Harman Becker Automotive Systems	1990. 07	16 Becker Goering St., Karlsbad, Germany	오디오제품 생	3,949,170	상동	0
GmbH			산, 판매, R&D			
Harman Becker Automotive Systems	2005. 12	17, Viale Luigi Majno, Milano (MI), Italy	오디오제품 판	879	상동	×
Italy S.R.L.		2 , ,	OH			
Harman Becker Automotive Systems	1994. 08	19 Holland Fasor, Szekesfehervar, Hungary	오디오제품 생	3,230,387	상동	0
Manufacturing Kft	1004.00	10 Homand 1 asor, Ozenesielielvar, Hullgary	산, R&D	0,200,007	00	5
		•				

Harman Belgium SA	1967. 04	4 Drukperstraat, Brussels, Belgium	오디오제품 판 매	2,993	상동	Х
Harman Connected Services AB.	1984. 10	24 Nordenskioldsgatan, Malmo, Sweden	Connected Service Provider	11,306	상동	Х
Harman Finland Oy	1998. 07	Korkeakoulunkatu 7, 33720, Tampere, Finland	Connected Service Provider	379	상동	×
Harman Connected Services GmbH	2005. 12	45 Wittener Str., Bochum, Germany	Connected Service Provider	52,425	상동	X
Harman Connected Services Poland Sp.zoo	2007. 06	UL Kasprzaka 6, Lodz, Poland	Connected Service Provider	11,538	상동	X
Harman Connected Services UK Ltd.	2008. 09	Devonshire House, 60 Goswell Rd., London, UK	Connected Service Provider	55,034	상동	×
Harman Consumer Nederland B.V.	1995. 12	16 Danzigerkade, 1013 AP, Amsterdam, Netherlands	오디오제품 판매	497,888	상동	0
Harman Deutschland GmbH	1998. 03	Parkring 3 B. Munich, Garching, Germany	오디오제품 판 매	13,602	상동	Х
Harman France SNC	1995. 11	12 bis, rue des Colonnes-du-Trone, Paris, France	오디오제품 판매	166,979	상동	0
Harman Holding Gmbh & Co. KG	2002. 06	16 Becker Goering St., Karlsbad, Germany	Management Company	5,848,586	상동	0
Harman Hungary Financing Ltd.	2012. 06	Holland Fasor 19, Szekesfehervar, Hungary	Financing Company	46,365	상동	Х
Harman Inc. & Co. KG	2012. 06	16 Becker Goering St., Karlsbad, Germany	해외자회사 관 리	4,619,985	상동	0
Harman International Estonia OU	2015. 05	Parnu mnt 139a, Tallinna linn, Harju maakond, Estonia	R&D	1	상동	X
Harman International Industries Limited	1980. 03	Westside, Two London Rd, Apsley, Hemel Hempstead, Hertfordshire, UK	오디오제품 판 매, R&D	77,383	상동	0
Harman International Romania SRL	2015. 02	5-7, Bdul. Dimitrie Pompeiu, Metroffice, Cladirea A parter, et. 2 si et. 4, Sec. 2, Bucharest, Romania	R&D	13,910	상동	Х
Harman Management Gmbh	2002. 04	Becker Goering St. 16, Karlsbad, Germany	해외자회사 관 리	-	상동	Х
Harman Professional Kft	2014. 12	Holland Fasor 19, Szekesfehervar, Hungary	오디오제품 생 산, R&D	59,000	상동	Х
Harman Professional Denmark ApS	1987. 07	Olof Palmes Alle 18., Aarhus, Denmark	오디오제품 판 매, R&D	54,778	상동	Х
Red Bend Software SAS	2002. 10	Immeuble 15 place Georges Pompidou, MontignyLe Bretonneux, France	소프트웨어 디 자인	8,162	상동	Х
Studer Professional Audio GmbH	2003. 11	Althardstrasse 30, Regensdorf, Switzerland	오디오제품 판 매, R&D	476	상동	Х
Harman Connected Services OOO	1998. 11	8 Kovalikhinskaya St., Nizhny Novgorod, Russia	Connected Service Provider	27,181	상동	Х
Harman RUS CIS LLC	2011. 08	RS 12/1 Dvintsev street, Moscow, Russia	오디오제품 판 매	38,224	상동	Х
					_	

0 0 0
0
0
0
0
0
0
X
Х
X
0
0
0
0
0
X
×
Х
X
0
0
0
0
0
×
0

Samsung Vina Electronics Co., Ltd.	1995. 01	938 1A Highway, Linh Trung ward, Thu Duc Dist, Ho Chi	전자제품 판매	110,276	상동	0
(SAVINA)		Minh, Vietnam				
Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd.	2008. 03	Yentrung Commune, Yenphong Dist, Bacninh, Vietnam	전자제품 생산	7,301,860	상동	0
(SEV)		Van Birk 4 to track B 2 2 2 2 2 2 2 2 2				
Samsung Electronics Vietnam	2013. 03	Yen Binh 1, Industrial Park, Pho Yen distrist, Thai Nguyen,	통신제품 생산	12,554,481	상동	0
THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)		Vietnam				
Samsung Electronics HCMC CE	2015. 02	Lot I-11, D2 Road, Saigon Hi-Tech Park, District 9, Ho Chi	전자제품 생산	4,043,677	상동	0
Complex Co., Ltd. (SEHC)		Minh, Vietnam	및 판매			
Samsung Display Vietnam Co., Ltd.	2014. 07	Yenphong I I.P, Yentrung Commune, Yenphong Dist,	디스플레이 패	7,383,485	상동	0
(SDV)		Bacninh, Vietnam	널 생산			
PT Samsung Electronics Indonesia	1991. 08	Cikarang Industrial Estate, JL. Jababeka Raya Blok F29-33,	전자제품 생산	1,110,178	상동	0
(SEIN)	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Cikarang, Bekasi, West Java, Indonesia	및 판매	1,112,112		Ü
PT Samsung Telecommunications	2003. 03	Prudential Tower 23F Jl. Jend. Sudirman Kav 79, Jakarta,	전자제품 판매	75,638	상동	0
Indonesia (STIN)	2000.00	Indonesia	및 서비스	75,000	00	0
Thai Samsung Electronics Co., Ltd.	1000 10	313 Moo 1 Sukhaphiban 8 Rd, Sriracha Industry Park, T.Bung	전자제품 생산	2 020 270	A1 C	0
(TSE)	1988. 10	A.Sriracha Chonburi, Thailand	및 판매	3,039,379	상동	0
Laos Samsung Electronics Sole Co.,	0010 55	05 Kilos Turas 0, 00 Ci. 1, Ci. 1, Ci. 1, Ci.	DI SILE!			.,
Ltd (LSE)	2016. 09	3F Kolao Tower 2, 23 Singha Rd., Vientiane, Laos	마케팅	1,318	상동	Х
Samsung Electronics Philippines		8F HanjinPhil Building 1128 University Parkway, North				
Corporation (SEPCO)	1996. 03	Bonifacio, Global City, Taguig, Philippines	전자제품 판매	372,478	상동	0
Samsung Electronics Australia Pty. Ltd.		Quad Samsung, 8 Parkview Drive, Homebush Bay 2127,				
(SEAU)	1987. 11	Sydney, Australia	전자제품 판매	612,161	상동	0
Samsung Electronics New Zealand						
Limited (SENZ)	2013. 09	24 The Warehouse Way, Northcote, Auckland, New Zealand	전자제품 판매	204,114	상동	0
Samsung India Electronics Private Ltd.		Two Horizon Centre, Golf Course RD, Gurgaon, Haryana,	전자제품 생산			
(SIEL)	1995. 08	India	및 판매	7,738,259	상동	0
Red Brick Lane Marketing Solutions		6th Floor, Salarpuria Sattva Magnificia, Old Madras Road,	× C III			
Pvt. Ltd.	2012. 01		마케팅	1,429	상동	Х
Samsung Display Noida Private Limited		Bengaluru, Karnataka, India B-1, Sector 81, Phase-II, NOIDA, Gautam Buddha Nagar,	디스플레이 패			
	2019. 07			675,743	상동	0
(SDN)		Uttar Pradesh, India	널 생산			
Samsung R&D Institute India-						
Bangalore Private Limited (SRI-	2005. 05	Bagmane Tech. Park, Bangalore, Karnataka, India	R&D	430,987	상동	0
Bangalore)						
Samsung R&D Institute BanglaDesh	2010. 08	Gualshan-1, Gulshan Ave., Dhaka, Bangladesh	R&D	17,625	상동	x
Limited (SRBD)						
Samsung Nepal Services Pvt, Ltd	2017. 11	Ward No 1, Durbar Marg, Kathmandu Municipality,	서비스	1,263	상동	x
(SNSL)		Kathmandu, Nepal		.,255		,,
Samsung Japan Corporation (SJC)	1975. 12	Shinagawa Grand Central Tower, Konan, Minato, Tokyo,	반도체・디스플	1,013,103	상동	0
		Japan	레이 패널 판매			
Samsung R&D Institute Japan Co. Ltd.	1992. 08	2-7, Sugasawa-cho, Tsurumi-ku, Yokohama, Kanagawa,	R&D	136,782	상동	0
(SRJ)		Japan				
Samsung Electronics Japan Co., Ltd.	2008. 09	lidabashi Grand Bloom, 2-10-2, Fujimi, Chiyoda-ku, Tokyo,	전자제품 판매	705,460	상동	0
(SEJ)		Japan	2/410 2 641	, 55, 100		Ü
Harman Connected Services Corp.		Survey No. 85 & 86, Sadarmangala Village, Krishnarajapuram	Connected			
	2002. 04		Service	353,291	상동	0
India Pvt. Ltd.		Hobli, Bangalore, India	Provider			
Harman International (India) Private		Plot No. 9, Phase I , Doddenakkundi Industrial Area, K.R.	오디오제품 판			
Limited	2009. 01	Puram Hobli, Bangalore, India	OH, R&D	395,349	상동	0
Limited		i urani nobil, bangalore, mula	un, H&U			

Harman International Industries PTY Ltd.	2014. 12	Warehouse 25 26-18, Roberna St., Moorabbin, Victoria, Australia	해외자회사 관	-4,549	상동	Х
		No. 4/222 Harbor Office Building, Floor 12, Zone 12B01,	Connected			
Harman International (Thailand) Co.,	2024. 06	12C01, Sukhumvit Road, Tungsukla Sub-district, Sriracha	Service	-	상동	x
Ltd.		District, Chonburi Province, Thailand	Provider			
		14F Sumitomo Fudosan Akihabara-ekimae, Kanda, Chiyoda,	오디오제품 판			
Harman International Japan Co., Ltd.	1991. 06	Tokyo, Japan	OH. R&D	72,958	상동	Х
		108, Pasir Panjang Rd., #02-08 Golden Agri Plaza,	오디오제품 판			
Harman Singapore Pte. Ltd.	2007. 08	Singapore	OH	15,187	상동	Х
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.		Fortune Financial Center, No5. Dongsanhuan Zhong Rd.,	UII			
	1996. 03		전자제품 판매	10,222,557	상동	0
(SCIC)		Chaoyang, Beijing, China				
Samsung Electronics Hong Kong Co.,	1988. 09	33F, Central Plaza, 18 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong	전자제품 판매	985,438	상동	0
Ltd. (SEHK)						
Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd.	1994. 11	10F, No.399, Rui Guang Rd., Nei Hu, Taipei, Taiwan	전자제품 판매	1,797,627	상동	0
(SET)						
Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd.	1993. 04	#12, no 4 Big St., Dong Ting Rd., Teda, Tianjin, China	TV·모니터 생	382,260	상동	0
(TSEC)			산			
Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd.	1995. 04	No.501, SuHong East Rd., Suzhou Industrial Park, Suzhou,	가전제품 생산	636,160	상동	0
(SSEC)	1333. 04	China	7046 80	000,100	0 0	0
Samsung Suzhou Electronics Export	1005 04	No.501, SuHong East Rd., Suzhou Industrial Park, Suzhou,	2171777 1111	100 04 4		
Co., Ltd. (SSEC-E)	1995. 04	China	가전제품 생산	488,014	상동	0
Samsung Electronics Suzhou Computer		No.198, Fangzhou Rd., Suzhou Industrial park, Suzhou,	전자제품 생산,			
Co., Ltd. (SESC)	2002. 09	China	R&D	94,528	상동	0
Tianjin Samsung Telecom Technology		No.9 WeiWu Rd. Micro Electronic Industrial Park, Xiqing,				
Co., Ltd. (TSTC)	2001. 03	Tianjin, China	통신제품 생산	646,732	상동	0
Beijing Samsung Telecom R&D Center		12/F Zhongdian fazhan Building, No. 9, xiaguangli,				
(SRC-Beijing)	2000. 09	Chaoyang, Beijing, China	R&D	131,677	상동	Х
Samsung Electronics China R&D		Chadyang, Deljing, China				
Center (SRC-Nanjing)	2004. 05	8/F, Huijie Plaza, 268 Zhongshan Rd., Nanjing, China	R&D	33,031	상동	Х
Samsung Mobile R&D Center China-		A3 Building, No.185 Kexue Ave., Science City, Luogang,				
Guangzhou (SRC-Guangzhou)	2010. 01	Guangzhou, China	R&D	43,195	상동	X
Samsung R&D Institute China-		22F, Building 2C, Shenzhen Software Industry Base,				
	2013. 03		R&D	38,382	상동	Х
Shenzhen (SRC-Shenzhen)		Nanshan District, Shenzhen, China				
Shanghai Samsung Semiconductor	2001. 10	3F, No.458, Fute North Rd., Shanghai, China	반도체・디스플	5,262,086	상동	0
Co., Ltd. (SSS)			레이 패널 판매			
Samsung (China) Semiconductor Co.,	2012. 09	No.1999, Xiaohe Rd., Changan, Xian, China	반도체 생산	15,808,283	상동	0
Ltd. (SCS)						
Samsung SemiConductor Xian Co.,	2016. 04	8F Customs Clearance Center, No.5 Tonghai First Rd.,	반도체・디스플	854,932	상동	0
Ltd. (SSCX)		Changan, Xian, China	레이 패널 판매	, -		
Samsung Electronics Suzhou	1994. 12	No.15, JinJiHu Rd., Suzhou Industrial Park, Suzhou, China	반도체 임가공	869,225	상동	0
Semiconductor Co., Ltd. (SESS)	1007. 12	The state of the s	C = AII	505,225	00	
Tianjin Samsung LED Co., Ltd. (TSLED)	2009. 05	No 1. Weisan Rd., Micro Electronic Industrial Park., Xiqing,	LED 생산	257,820	상동	0
,		Tianjin, China				
Samsung Semiconductor (China) R&D	2003. 04	No.15, Jinjihu Rd., Suzhou Industrial Park, Suzhou, China	R&D	89,911	상동	Х
Co., Ltd. (SSCR)		, and other services and services and services and services and services are services are services and services are servic		55,511		
Samsung Display Dongguan Co., Ltd.	2001 11	High Tachpology Industrial Zone House Description	디스플레이 패	750.004	204	
(SDD)	2001. 11	High Technology Industrial Zone, Houjie, Dongguan, China	널 생산	752,934	상동	0
Samsung Display Tianjin Co., Ltd.			디스플레이 패			
(SDT)	2004. 06	No.25, Mip Fourth Rd., Xiqing, Tianjin, China	널 생산	583,728	상동	0
	l	<u> </u>	l .			

			1		I	
SEMES (XIAN) Co., Ltd.	2013. 07	#A501, ZTE PLAZA, No.10 Tangyan South Rd., Gaoxin, Xian, China	반도체·FPD 장비 서비스	3,588	상동	Χ
Samsung Semiconductor Investment		#409, Building 2, No. 599, Wanzhen Road, Zhenxinxincun	신기술사업자,			
L.P. I	2021. 12	St., Jiading District, Shanghai, China	벤처기업 투자	10,314	상동	Х
	2011 02		오디오제품 생	214 710	W.E.	0
Harman (China) Technologies Co., Ltd.	2011. 03	No.68, First Yinquan Rd., Zhengxing, Dandong, China	산	214,710	상동	
Harman (Suzhou) Audio and	2013. 03	20F, Modern Logistics No.88 Modern Ave., Suzhou, China	오디오제품 판	5,795	상동	Х
Infotainment Systems Co., Ltd.			OH			
Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd.	2006. 09	No.125, Fangzhou Rd., Suzhou Industrial Park, Suzhou, China	오디오제품 생 산, R&D	465,961	상동	0
Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd.	2010. 10	Suite 2903B, Level 29, 288, West Nanjing Rd., Huangpu, Shanghai, China	오디오제품 판 매	367	상동	Х
			Connected			
Harman Connected Services Solutions	0007 00	145 455 No 200 Barria and Ulab Arab Observato Obics		10.400		V
(Chengdu) Co., Ltd.	2007. 08	14F, 15F, No 383 Jiaozi Ave., High-tech, Chengdu, China	Service	12,426	상동	X
			Provider			
Harman Holding Limited	2007. 05	Flat/RM A 12F, Kiu Fu Commercial Building, 300 Lockhart	오디오제품 판	648,529	상동	0
		Rd., Wan Chai, Hong Kong	OH			
Harman International (China) Holdings	2009. 06	30F, No. 288, Nanjing Road West, Shanghai, China	오디오제품 판	685,227	상동	0
Co., Ltd.	2009.00	1001, NO. 200, Narijing Hoad West, Shanghar, China	OH, R&D	003,227	00	O
Harman Technology (Shenzhen) Co.,		14F, China Merchants Bureau Port Building, Merchants St.,	오디오제품 판			
Ltd.	2004. 09	Nanshan, Shenzhen, China	매, R&D	40,712	상동	Х
			디스플레이 패			
삼성디스플레이㈜	2012. 04	경기도 용인시 기흥구 삼성로 1(농서동)	널 생산 및 판매	65,328,568	상동	0
			디스플레이 패			
에스유머티리얼스㈜	2011. 08	충청남도 아산시 탕정면 탕정로 380-2	널 부품 생산	37,027	상동	Х
			반도체 부품 생			
스테코㈜	1995. 06	충청남도 천안시 서북구 3공단1로 20(백석동)	산	132,675	상동	0
			반도체·FPD			
세메스㈜	1993. 01	충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단5길 77	장비 생산, 판매	2,187,919	상동	0
			전자제품 수리			
삼성전자서비스㈜	1998. 10	경기도 수원시 영통구 삼성로 290(원천동)	서비스	795,640	상동	0
삼성전자서비스씨에스㈜	2018. 10	경기도 수원시 영통구 중부대로 324(매탄동)	고객상담서비스	23,897	상동	Х
삼성전자판매㈜	1996. 07	경기도 성남시 분당구 백현로101번길 30	전자제품 판매	1,358,597	상동	0
삼성전자로지텍㈜	1998. 04	경기도 수원시 영통구 삼성로 129(매탄동)	종합물류대행	465,079	상동	0
			의료기기 생산			
삼성메디슨㈜	1985. 07	강원도 홍천군 남면 한서로 3366	및 판매	629,302	상동	0
		경기도 용인시 기흥구 서천로 201번길 14. 프리미엄원희캐슬	× - 011			
주식회사 희망별숲	2022. 12	28	식품 제조 가공	7,255	상동	Х
			반도체 소프트			
㈜미래로시스템	1004 01	경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120(영덕동)	웨어 개발 및 공	39,931	상동	Х
MIN 데 프 M ㅡ ㅁ	1554.01	0/14 0CM /10 6700# 14W(616)		09,901	0 0	^
			급			
㈜하만인터내셔널코리아	2005. 01	서울특별시 강남구 테헤란로 223(역삼동), 큰길타워 17층	소프트웨어 개	16,696	상동	X
			발 및 공급			
SVIC 21호 신기술투자조합	2011. 11	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩	신기술사업자,	82,411	상동	0
		29층	벤처기업 투자	,		-
CVIIC 22층 시기스트 IT 조원	2011 11	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩	신기술사업자,	17 400	17.420	
SVIC 22호 신기술투자조합	2011. 11	29층	벤처기업 투자	17,438	상동	Х
	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩					
SVIC 26호 신기술투자조합	2014. 11	29층	벤처기업 투자	27,631	상동	X
		_	2::::10 174		l .	

SVIC 28호 신기술투자조합	2015. 02	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩	신기술사업자,	337,949	상동	0
0110 202 2112 1 N 2 B	2010.02	29층	벤처기업 투자	007,010	0)
이세요 90를 사기스트 기구환	2015. 04	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩	신기술사업자,	24.000	A1 =	V
SVIC 29호 신기술투자조합	2015. 04	29층	벤처기업 투자	34,222	상동	Х
SVIC 32호 신기술투자조합	2016. 08	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩	신기술사업자,	222.250	A1 E	0
3시0 32보 선기골구자조합	2010.00	29층	벤처기업 투자	223,258	상동	0
아//ㅇ 22를 시기스투기 포함	2016. 11	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩	신기술사업자,	315,348	상동	0
SVIC 33호 신기술투자조합	2016. 11	29층	벤처기업 투자	315,340	(3) (5)	0
SVIC 37호 신기술투자조합	2017. 11	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩	신기술사업자,	22.559	상동	V
SVIC 37호 전기출구자조합	2017. 11	29총	벤처기업 투자	22,559	(3 (5	Х
0.40 40 - 1.7.4 - 1.7.4	2018. 06	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩	신기술사업자,	07.075		
SVIC 40호 신기술투자조합	2018.06	29층	벤처기업 투자	37,275	상동	Х
0.40 40 - 1.7.4 - 1.7.4	0010 11	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩	신기술사업자,	00.100		
SVIC 42호 신기술투자조합	2018. 11	29층	벤처기업 투자	33,102	상동	Х
0.40 40 - 1.71 - 1.71	0010 10	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩	신기술사업자,	17.000	상동	
SVIC 43호 신기술투자조합	2018. 12	29층	벤처기업 투자	17,093	85	Х
0.40 455 1131 4 5 7 7 5	0010 05	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩	신기술사업자,	175.000		
SVIC 45호 신기술투자조합	2019. 05	29층	벤처기업 투자	175,893	상동	0
0.40 505 11314571781		서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩	신기술사업자,	77 174		
SVIC 52호 신기술투자조합	2021. 05	29층	벤처기업 투자	77,174	상동	0
0.40 555 11.30 551 731	0001 00	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩	신기술사업자,	155 440		
SVIC 55호 신기술투자조합	2021. 09	29층	벤처기업 투자	155,442	상동	0
0.40 50- 11714-11791	2021. 11	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩	신기술사업자,	50.070		
SVIC 56호 신기술투자조합	2021. 11	29층	벤처기업 투자	56,070	상동	Х
0.40 575 1171 4571 731	0000 00	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩	신기술사업자,	07.155		
SVIC 57호 신기술투자조합	2022. 08	29층	벤처기업 투자	37,155	상동	Х
CVIC CO를 시기스투자 조화	2022 02	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동), 삼성전자빌딩	신기술사업자,	2.715	AL =	V
SVIC 62호 신기술투자조합	2023. 03	29층	벤처기업 투자	3,715	상동	Х
비디웨서자 자유트지원 보고 트피브린	2017 22	서울특별시 영등포구 여의나루로 76(여의도동), 한국거래소 별	반도체산업 투	E0.050	AL =	.,
반도체성장 전문투자형 사모 투자신탁	2017. 03	관 4층	자	58,356	상동	Х
시스템반도체 상생 전문투자형 사모 투자	2020 04	서울특별시 영등포구 여의나루로 76(여의도동), 한국거래소 별	반도체산업 투	70.050	AL =	_
신탁	2020. 04	관 4층	자	79,856	상동	0
바드레 세대계 이버나 보다 등지 보다	2022 27	서울특별시 영등포구 여의나루로 76(여의도동), 한국거래소 별	반도체산업 투	750	A1=	
반도체 생태계 일반 사모 투자신탁	2023. 07	관 4층	자	753	상동	Х
		I .		·		

[※] 주요 사업에 대한 상세 내역은 'Ⅱ.사업의 내용'을 참고하시기 바랍니다.

[※] 주요 종속기업 여부 판단기준은 최근사업연도말 자산총액 750억원 이상입니다.

(종속기업의 변동)

(단위 : 개사)

		유럽	중동 ·	아시아				변 동 내 역	
구 분	미주		아프	(중국	중국	국내	합계		
		CIS	리카	제외)				증 가	감 소
제53기									
(2021년말)	46	71	20	30	30	31	228	-	-
								[유럽·CIS: 4개사]	
								Samsung R&D Institute Ukraine (SRUKR)	
								· Samsung Electronics Uzbekistan FC LLC	
								(SEUZ)	[미주: 1개사]
								· Apostera GmbH	Dacor Canada Co.
제54기	△1	1	_	2	_	2	4	· Apostera UA, LLC	[유럽·CIS: 3개사]
증감	Δ1	'		_			-	[아시아(중국 제외): 2개사]	AMX UK Limited
								· DOWOOINSYS VINA COMPANY LIMITED	· Harman International s.r.o
								• Red Brick Lane Marketing Solutions Pvt. Ltd.	· Apostera GmbH
								[국내: 2개사]	
								・SVIC 57호 신기술투자조합	
								•㈜희망별숲	
제54기	45	72	20	32	30	33	232	-	_
(2022년말)									
								[미주: 4개사]	[미주: 2개사]
								Samsung Federal, Inc. (SFI)	· Dacor Holdings, Inc.
								Samsung Display America Holdings, Inc.	· Dacor, Inc.
제55기						_		(SDAH)	[유럽 · CIS: 4개사]
증감	2	△4	_	_	_	2	-	eMagin Corporation	· Red Bend Software Ltd.
								• Roon Labs, LLC.	· Harman Finance International GP S.a.r.I
								[국내: 2개사]	· Harman Finance International, SCA
								· SVIC 62호 신기술투자조합	· Harman Automotive UK Limited
제55기								・반도체 생태계 일반 사모 투자신탁	
(2023년말)	47	68	20	32	30	35	232	-	-
									[국내: 3개사]
									· ㈜도우인시스
									• 지에프㈜
									· SVIC 48호 신기술투자조합
									[유럽·CIS: 2개사]
제56기	△1	△2	-	-	-	△3	△6	[아시아(중국 제외): 1개사]	· Samsung Display Slovakia, s.r.o., v likvidacii (SDSK)
증감								· Harman International (Thailand) Co., Ltd.	Samsung Electronics Overseas B.V. (SEO)
									[미주: 1개사]
									· Harman Financial Group LLC
									[아시아(중국제외): 1개사]
									· DOWOOINSYS VINA COMPANY LIMITED
제56기	40		200	25			000		
(반기말)	46	66	20	32	30	32	226	-	_

[△는 부(-)의 값임]

2. 계열회사 현황(상세)

가. 국내 계열회사 현황

2024년 반기말 현재 삼성그룹에는 전년말과 동일한 63개의 국내 계열회사가 있습니다. 이중 상장사는 당사를 포함하여 총 17개사이며 비상장사는 46개사입니다.

☞ 본문 위치로 이동

(기준일: 2024년 06월 30일)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호
		삼성물산(주)	1101110015762
		삼성바이오로직스(주)	1201110566317
		삼성생명보험(주)	1101110005953
		삼성에스디아이(주)	1101110394174
		삼성에스디에스(주)	1101110398556
		삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(주)	1101118376893
		삼성이앤에이(주)	1101110240509
		삼성전기(주)	1301110001626
상장	17	삼성전자(주)	1301110006246
		삼성중공업(주)	1101110168595
		삼성증권(주)	1101110335649
		삼성카드(주)	1101110346901
		삼성화재해상보험(주)	1101110005078
		(주)멀티캠퍼스	1101111960792
		(주)에스원	1101110221939
		(주)제일기획	1101110139017
		(주)호텔신라	1101110145519
		삼성디스플레이(주)	1345110187812
		삼성메디슨(주)	1346110001036
		삼성바이오에피스(주)	1201110601501
		삼성벤처투자(주)	1101111785538
		삼성생명서비스손해사정(주)	1101111855414
비상장	46	삼성선물(주)	1101110894520
		삼성액티브자산운용(주)	1101116277382
		삼성에스알에이자산운용(주)	1101115004322
		삼성웰스토리(주)	1101115282077
		삼성자산운용(주)	1701110139833
		삼성전자로지텍(주)	1301110046797

(단위 : 사)

삼성전자서비스(주)	1301110049139
삼성전자서비스씨에스(주)	1358110352541
삼성전자판매(주)	1801110210300
삼성카드고객서비스(주)	1101115291656
삼성코닝어드밴스드글라스(유)	1648140003466
삼성헤지자산운용(주)	1101116277390
삼성화재서비스손해사정(주)	1101111237703
삼성화재애니카손해사정(주)	1101111595680
세메스(주)	1615110011795
수원삼성축구단(주)	1358110160126
스테코(주)	1647110003490
신라에이치엠(주)	1101115433927
에스디플렉스(주)	1760110039005
에스비티엠(주)	1101116536556
에스원씨알엠(주)	1358110190199
에스유머티리얼스(주)	1648110061337
에스코어(주)	1101113681031
에스티엠(주)	2301110176840
에이치디씨신라면세점(주)	1101115722916
오픈핸즈(주)	1311110266146
제일패션리테일(주)	1101114736934
(주)미라콤아이앤씨	1101111617533
(주)미래로시스템	1101111005366
(주)삼성글로벌리서치	1101110766670
(주)삼성라이온즈	1701110015786
(주)삼성생명금융서비스	1101115714533
(주)삼성화재금융서비스보험대리점	1101116002424
(주)삼우종합건축사사무소	1101115494151
(주)서울레이크사이드	1101110504070
(주)시큐아이	1101111912503
(주)씨브이네트	1101111931686
(주)에스에이치피코퍼레이션	1101118151310
(주)하만인터내셔널코리아	1101113145673
(주)휴먼티에스에스	1101114272706
(주)희망별숲	1345110611259
L	1

나. 해외 계열회사 현황

(기준일: 2024년 06월 30일) (단위:사)

상장여부	회사수	기업명	소재국
		SAMOO AUSTIN INC	USA
		SAMOO HU Designer and Engineering Services Limited	Hungary
		SAMOO DESIGNERS & ENGINEERS INDIA PRIVATE LIMITED	India
		SAMOO (KL) SDN. BHD.	Malaysia
		SAMOO Design Consulting Co.,Ltd	China
		Samsung Green repower, LLC	USA
		Samsung Solar Construction Inc.	USA
		QSSC, S.A. de C.V.	Mexico
		Samsung Solar Energy LLC	USA
		Equipment Trading Solutions Group, LLC	USA
		SAMSUNG C&T CHARGING SOLUTIONS LLC	USA
		SP Armow Wind Ontario LP	Canada
		SRE GRW EPC GP Inc.	Canada
		SRE GRW EPC LP	Canada
		SRE SKW EPC GP Inc.	Canada
		SRE SKW EPC LP	Canada
		SRE WIND PA GP INC.	Canada
		SRE WIND PA LP	Canada
		SRE GRS Holdings GP Inc.	Canada
		SRE GRS Holdings LP	Canada
비상장	564	SRE K2 EPC GP Inc.	Canada
		SRE K2 EPC LP	Canada
		SRE KS HOLDINGS GP INC.	Canada
		SRE KS HOLDINGS LP	Canada
		SP Belle River Wind LP	Canada
		SRE Armow EPC GP Inc.	Canada
		SRE Armow EPC LP	Canada
		North Kent Wind 1 LP	Canada
		SRE Wind GP Holding Inc.	Canada
		South Kent Wind LP Inc.	Canada
		Grand Renewable Wind LP Inc.	Canada
		SRE North Kent 2 LP Holdings LP	Canada
		SRE Solar Development GP Inc.	Canada
		SRE Solar Development LP	Canada
		SRE Windsor Holdings GP Inc.	Canada
		SRE Southgate Holdings GP Inc.	Canada
		SRE Solar Construction Management GP Inc.	Canada
		SRE Solar Construction Management LP	Canada
		SRE BRW EPC GP INC.	Canada
		SRE BRW EPC LP	Canada

	·
SRE North Kent 1 GP Holdings Inc	Canada
SRE North Kent 2 GP Holdings Inc	Canada
SRE Belle River GP Holdings Inc	Canada
SRE NK1 EPC GP Inc	Canada
SRE NK1 EPC LP	Canada
SRE Summerside Construction GP Inc.	Canada
SRE Summerside Construction LP	Canada
PLL Holdings LLC	USA
Grand Renewable Solar GP Inc.	Canada
KINGSTON SOLAR GP INC.	Canada
SP Armow Wind Ontario GP Inc	Canada
South Kent Wind GP Inc.	Canada
Grand Renewable Wind GP Inc.	Canada
North Kent Wind 1 GP Inc	Canada
SP Belle River Wind GP Inc	Canada
Samsung Solar Energy 1 LLC	USA
Samsung Solar Energy 2 LLC	USA
Samsung Solar Energy 3, LLC	USA
CS SOLAR LLC	USA
5S ENERGY HOLDINGS, LLC	USA
SungEel Recycling Park Thuringen GmbH	Germany
POSS-SLPC, S.R.O	Slovakia
Solluce Romania 1 B.V.	Romania
S.C. Otelinox S.A	Romania
Samsung C&T Corporation Romania S.R.L	Romania
WARIS GIGIH ENGINEERING AND TECHNOLOGY SDN. BHD.	Malaysia
Samsung Chemtech Vina LLC	Vietnam
Samsung C&T Thailand Co., Ltd	Thailand
Malaysia Samsung Steel Center Sdn.Bhd	Malaysia
S&G Biofuel PTE.LTD	Singapore
PT. Gandaerah Hendana	Indonesia
PT. Inecda	Indonesia
VISTA CONTRACTING AND DEVELOPMENT BANGLADESH LTD.	Bangladesh
vista NEXT Limited	Bangladesh
Welstory Hungary Kft.	Hungary
WELVISTA COMPANY LIMITED	Vietnam
SAMSUNG CONST. CO. PHILS.	Philippines
SAMSUNG TRADING (SHANGHAI) CO., LTD	China
Samsung Precision Stainless Steel(pinghu) Co.,Ltd.	China
Samsung Japan Corporation	Japan
	1

Samsung Electronics America, Inc.	USA
Samsung Electronics Canada, Inc.	Canada
Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V.	Mexico
Samsung Electronics Ltd.	United Kingdom
Samsung Electronics (UK) Ltd.	United Kingdom
Samsung Electronics Holding GmbH	Germany
Samsung Electronics Iberia, S.A.	Spain
Samsung Electronics France S.A.S	France
Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd.	Hungary
Samsung Electronics Italia S.P.A.	Italy
Samsung Electronics Europe Logistics B.V.	Netherlands
Samsung Electronics Benelux B.V.	Netherlands
Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o	Poland
Samsung Electronics Portuguesa, Unipessoal, Lda.	Portugal
Samsung Electronics Nordic Aktiebolag	Sweden
Samsung Electronics Austria GmbH	Austria
Samsung Electronics Slovakia s.r.o	Slovakia
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Netherlands
Samsung Electronics Display (M) Sdn. Bhd.	Malaysia
Samsung Electronics (M) Sdn. Bhd.	Malaysia
Samsung Vina Electronics Co., Ltd.	Vietnam
Samsung Asia Pte. Ltd.	Singapore
Samsung India Electronics Private Ltd.	India
Samsung R&D Institute India-Bangalore Private Limited	India
Samsung Electronics Australia Pty. Ltd.	Australia
PT Samsung Electronics Indonesia	Indonesia
Thai Samsung Electronics Co., Ltd.	Thailand
Samsung Malaysia Electronics (SME) Sdn. Bhd.	Malaysia
Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd.	Hong Kong
Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd.	China
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	China
Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd.	China
Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd.	China
Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd.	Taiwan
Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd.	China
Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd.	China
Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.	China
Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd.	China
Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd.	China
Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd.	China

Samsung Electronics Egypt S.A.E	Egypt
Samsung Electronics South Africa(Pty) Ltd.	South Africa
Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A.	Panama
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda.	Brazil
Samsung Electronics Argentina S.A.	Argentina
Samsung Electronics Chile Limitada	Chile
Samsung Electronics Rus Company LLC	Russian Fed.
Samsung Electronics Rus Kaluga LLC	Russian Fed.
Tianjin Samsung LED Co., Ltd.	China
Samsung Biologics America, Inc.	USA
Samsung Bioepis United States Inc.	USA
SAMSUNG BIOEPIS UK LIMITED	United Kingdom
Samsung Bioepis NL B.V.	Netherlands
Samsung Bioepis CH GmbH	Switzerland
Samsung Bioepis PL Sp z o.o.	Poland
SAMSUNG BIOEPIS AU PTY LTD	Australia
SAMSUNG BIOEPIS NZ LIMITED	New Zealand
Samsung Biopeis TW Limited	Taiwan
Samsung Bioepis HK Limited	Hong Kong
SAMSUNG BIOEPIS IL LTD	Israel
SAMSUNG BIOEPIS BR PHARMACEUTICAL LTDA	Brazil
Intellectual Keystone Technology LLC	USA
Samsung Display America Holdings, Inc	USA
Samsung Display Vietnam Co., Ltd.	Vietnam
Samsung Display Noida Private Limited	India
Samsung Display Dongguan Co., Ltd.	China
Samsung Display Tianjin Co., Ltd.	China
Novaled GmbH	Germany
SEMES America, Inc.	USA
SEMES (XIAN) Co., Ltd.	China
NeuroLogica Corp.	USA
Samsung HVAC America, LLC	USA
SmartThings, Inc.	USA
Samsung Oak Holdings, Inc.	USA
Joyent, Inc.	USA
TeleWorld Solutions, Inc.	USA
Samsung Semiconductor, Inc.	USA
Samsung Research America, Inc	USA
Samsung Electronics Home Appliances America, LLC	USA
Samsung International, Inc.	USA
Harman International Industries, Inc.	USA
	•

Samsung Federal, Inc.	USA
Samsung Austin Semiconductor LLC.	USA
AdGear Technologies Inc.	Canada
SAMSUNG NEXT LLC	USA
SAMSUNG NEXT FUND LLC	USA
Samsung Mexicana S.A. de C.V	Mexico
Samsung Electronics Digital Appliance Mexico, SA de CV	Mexico
eMagin Corporation	USA
Harman International Japan Co., Ltd.	Japan
Harman International Industries Canada Ltd.	Canada
Harman Becker Automotive Systems, Inc.	USA
Harman Professional, Inc.	USA
Harman Connected Services, Inc.	USA
Roon Labs, LLC	USA
Harman Belgium SA	Belgium
Harman France SNC	France
Red Bend Software SAS	France
Harman Inc. & Co. KG	Germany
Harman KG Holding, LLC	USA
Harman Becker Automotive Systems Italy S.R.L.	Italy
Harman Industries Holdings Mauritius Ltd.	Mauritius
Harman International Mexico, S. de R.L. de C.V.	Mexico
Harman International Estonia OU	Estonia
Harman Singapore Pte. Ltd.	Singapore
Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	Brazil
Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	Brazil
Harman Connected Services Engineering Corp.	USA
Harman Connected Services AB.	Sweden
Harman Connected Services UK Ltd.	United Kingdom
Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd.	India
Global Symphony Technology Group Private Ltd.	Mauritius
Samsung Semiconductor Europe Limited	United Kingdom
Samsung Semiconductor Europe GmbH	Germany
Samsung Electronics GmbH	Germany
Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o.	Czech Republic
SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS SIA	Latvia
Samsung Electronics West Africa Ltd.	Nigeria
Samsung Electronics East Africa Ltd.	Kenya
Samsung Electronics Saudi Arabia Ltd.	Saudi Arabia
	Israel
Samsung Electronics Israel Ltd.	

Samsung Electronics Pakistan(Private) Ltd.	Pakistan
Samsung Electronics South Africa Production (pty) Ltd.	South Africa
Samsung Electronics Turkiye	Turkiye
Samsung Electronics Industry and Commerce Ltd.	Turkiye
Samsung Semiconductor Israel R&D Center, Ltd.	Israel
Samsung Electronics Levant Co.,Ltd.	Jordan
Samsung Electronics Maghreb Arab	Morocco
Samsung Electronics Venezuela, C.A.	Venezuela
Samsung Electronics Peru S.A.C.	Peru
Samsung Electronics Ukraine Company LLC	Ukraine
Samsung R&D Institute Ukraine	Ukraine
Samsung R&D Institute Rus LLC	Russian Fed.
Samsung Electronics Central Eurasia LLP	Kazakhstan
Samsung Electronics Caucasus Co. Ltd	Azerbaijan
Samsung Electronics Uzbekistan FC LLC	Uzbekistan
Corephotonics Ltd.	Israel
Samsung Nanoradio Design Center	Sweden
Harman Professional Denmark ApS	Denmark
Studer Professional Audio GmbH	Switzerland
Martin Professional Japan Ltd.	Japan
Harman International Romania SRL	Romania
Apostera UA, LLC	Ukraine
Harman Becker Automotive Systems GmbH	Germany
Harman Deutschland GmbH	Germany
Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	Hungary
Harman RUS CIS LLC	Russian Fed.
Harman Holding Gmbh & Co. KG	Germany
Harman Management Gmbh	Germany
Harman Hungary Financing Ltd.	Hungary
Harman Connected Services OOO	Russian Fed.
Harman Professional Kft	Hungary
Harman Consumer Nederland B.V.	Netherlands
Red Bend Ltd.	Israel
Harman International Industries Limited	United Kingdom
AKG Acoustics Gmbh	Austria
Harman Audio Iberia Espana Sociedad Limitada	Spain
Harman Holding Limited	Hong Kong
Harman Finland Oy	Finland
Harman Connected Services GmbH	Germany
Harman Connected Services Poland Sp.zoo	Poland

Harman International Industries PTY Ltd.	Australia
Harman de Mexico, S. de R.L. de C.V.	Mexico
Harman Connected Services Morocco	Morocco
Samsung Electronics Switzerland GmbH	Switzerland
Samsung Electronics Romania LLC	Romania
SAMSUNG Zhilabs, S.L.	Spain
Porta Nuova Varesine Building 2 S.r.I.	Italy
Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Zo.o	Poland
Samsung Electronics Greece S.M.S.A	Greece
Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.	Netherlands
FOODIENT LTD.	United Kingdom
Samsung Denmark Research Center ApS	Denmark
Samsung Cambridge Solution Centre Limited	United Kingdom
Samsung Electronics Japan Co., Ltd.	Japan
Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd.	Singapore
Samsung Electronics New Zealand Limited	New Zealand
Samsung Electronics Philippines Corporation	Philippines
Samsung R&D Institute BanglaDesh Limited	Bangladesh
Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd.	Vietnam
Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd.	Vietnam
Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd.	Vietnam
Samsung Nepal Services Pvt, Ltd	Nepal
Red Brick Lane Marketing Solutions Pvt. Ltd.	India
PT Samsung Telecommunications Indonesia	Indonesia
Laos Samsung Electronics Sole Co., Ltd	Laos
iMarket Asia Co., Ltd.	Hong Kong
Samsung Suzhou Electronics Export Co., Ltd.	China
Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou	China
Samsung R&D Institute China-Shenzhen	China
Beijing Samsung Telecom R&D Center	China
Samsung Electronics China R&D Center	China
Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems Co., Ltd.	China
Harman Technology (Shenzhen) Co., Ltd.	China
Harman (China) Technologies Co., Ltd.	China
Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd.	China
Harman International (China) Holdings Co., Ltd.	China
Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd.	China
Harman International (India) Private Limited	India
Samsung Electronics Latinoamerica Miami, Inc.	USA
Samsung Electronica Colombia S.A.	Colombia
Samsung Electronics Panama. S.A.	Panama

Samsung SDI Japan Co., Ltd.	Japan
Samsung SDI America, Inc.	USA
Samsung SDI Hungary., Zrt.	Hungary
Samsung SDI Europe GmbH	Germany
Samsung SDI Battery Systems GmbH	Austria
Samsung SDI Vietnam Co., Ltd.	Vietnam
Samsung SDI Energy Malaysia Sdn, Bhd.	Malaysia
Samsung SDI India Private Limited	India
Samsung SDI(Hong Kong) Ltd.	Hong Kong
Samsung SDI China Co., Ltd.	China
Samsung SDI-ARN (Xi'An) Power Battery Co., Ltd.	China
Samsung SDI (Tianjin) Battery Co.,Ltd.	China
STARPLUS ENERGY LLC.	USA
Samsung SDI South East Asia PTE LTD	Singapore
SAMSUNG SDI WUXI CO.,LTD.	China
Tianjin Samsung SDI Co., Ltd.	China
Samsung Electro-Machanics Japan Co., Ltd.	Japan
Samsung Electro-Mechanics America, Inc.	USA
Samsung Electro-Mechanics Mexico, S.A. de C.V.	Mexico
Samsung Electro-Mechanics GmbH	Germany
Samsung Electro-Mechanics Philippines, Corp.	Philippines
Calamba Premier Realty Corporation	Philippines
Samsung Electro-Mechanics Pte Ltd.	Singapore
Samsung Electro-Mechanics Vietnam Co., Ltd.	Vietnam
Samsung Electro-Mechanics Software India Bangalore Private Limited	India
Tianjin Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.	China
Samsung High-Tech Electro-Mechanics(Tianjin) Co., Ltd.	China
Samsung Electro-Mechanics (Shenzhen) Co., Ltd.	China
Kunshan Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.	China
Batino Realty Corporation	Philippines
Samsung Fire & Marine Management Corporation	USA
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY OF EUROPE	Limite di Minerale ne
LTD.	United Kingdom
PT. Asuransi Samsung Tugu	Indonesia
SAMSUNG VINA INSURANCE COMPANY LIMITED	Vietnam
Samsung Reinsurance Pte. Ltd.	Singapore
삼성재산보험 (중국) 유한공사	China
Samsung Fire & Marine Insurance Management Middle East Limited	Utd.Arab Emir.
Camellia Consulting Corporation	USA
	i i

SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES (M) SDN.BHD	Malaysia
삼성중공업(영성)유한공사	China
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES NIGERIA LIMITED	Nigeria
Samsung Heavy Industries Mozambique LDA	Mozambique
Samsung Heavy Industries Rus LLC	Russian Fed.
SHI - MCI FZE	Nigeria
Samsung Life Insurance (Thailand) Public Co., Ltd	Thailand
Beijing Samsung Real Estate Co Ltd	China
Samsung Asset Management (New York), Inc.	USA
Samsung Global SME Private Equity Manager Fund Co., Ltd.	Cayman Islands
Samsung Asset Management U.S. Holdings, Inc.	USA
Samsung Private Equity Fund 2022 GP, Ltd.	Cayman Islands
Samsung Co-Investment 2021 GP, Ltd.	Cayman Islands
Samsung Asset Management(London) Ltd.	United Kingdom
Samsung Private Equity Manager I Co., Ltd.	Cayman Islands
Samsung Asset Management (Hong Kong) Ltd.	Hong Kong
Samsung C&T Japan Corporation	Japan
Samsung C&T America Inc.	USA
Samsung E&C America, INC.	USA
Samsung Renewable Energy Inc.	Canada
Samsung C&T Oil & Gas Parallel Corp.	USA
Samsung C&T Lima S.A.C.	Peru
Samsung C&T Deutschland GmbH	Germany
Samsung C&T U.K. Ltd.	United Kingdom
Samsung C&T ECUK Limited	United Kingdom
Whessoe engineering Limited	United Kingdom
SAM investment Manzanilo.B.V	Netherlands
Samsung C&T Corporation Poland LLC	Poland
Samsung C&T (KL) Sdn.,Bhd.	Malaysia
Samsung C&T Malaysia SDN. BHD	Malaysia
Erdsam Co., Ltd.	Hong Kong
Samsung C&T India Private Limited	India
Samsung C&T Corporation India Private Limited	India
Samsung C&T Singapore Pte., Ltd.	Singapore
SAMSUNG C&T Mongolia LLC.	Mongolia
Samsung C&T Eng.&Const. Mongolia LLC.	Mongolia
S&WOO CONSTRUCTION PHILIPPINES,INC.	Philippines
VSSC STEEL CENTER LIMITED LIABILITY COMPANY	Vietnam
Vista Contracting and Investment Global Pte. Ltd.	Singapore
CHEIL HOLDING INC.	Philippines
Samsung C&T Renewable Energy Australia Pty Ltd	Australia

Samsung C&T Hongkong Ltd.	Hong Kong
Samsung C&T Taiwan Co., Ltd.	Taiwan
SAMSUNG C&T (SHANGHAI) CO., LTD.	China
Samsung C&T (Xi'an) Co., Ltd.	China
SAMSUNG C&T CORPORATION SAUDI ARABIA	Saudi Arabia
SAM Gulf Investment Limited	Utd.Arab Emir.
Samsung C&T Chile Copper SpA	Chile
SCNT Power Kelar Inversiones Limitada	Chile
Samsung C&T Corporation Rus LLC	Russian Fed.
CHEIL INDUSTRIES ITALY SRL	Italy
Samsung Fashion Trading Co. ,Ltd	China
SAMSUNG C&T CORPORATION VIETNAM CO., LTD	Vietnam
Samsung C&T Corporation UEM Construction JV Sdn Bhd	Malaysia
WELSTORY VIETNAM COMPANY LIMITED	Vietnam
	China
Shanghai Ever-Hongjun Business Mgt Service Co.,LTD	
Shanghai Welstory Food Company Limited	China
LANGUAGE TESTING INTERNATIONAL, INC.	USA
PENGTAI CHINA CO.,LTD.	China
PengTai Taiwan Co., Ltd.	Taiwan
PENGTAI E-COMMERCE CO.,LTD	China
Beijing Pengtai Borui E-commerce Co.,Ltd.	China
Medialytics Inc.	China
Beijing Pengtai Baozun E-commerce Co., Ltd.	China
iMarket China Co., Ltd.	China
Samsung Securities (America), Inc.	USA
Samsung Securities (Europe) Limited.	United Kingdom
Samsung Securities (Asia) Limited.	Hong Kong
Samsung SDS America, Inc.	USA
SAMSUNG SDS GSCL Canada., Ltd.	Canada
Samsung SDS Europe, Ltd.	United Kingdom
Samsung SDS Global SCL Hungary, Kft.	Hungary
Samsung SDS Global SCL Slovakia, S.R.O.	Slovakia
Samsung SDS Global SCL Poland Sp. Z.o.o.	Poland
Samsung GSCL Sweden AB	Sweden
Samsung SDS Global SCL France SAS	France
Samsung SDS Global SCL Italy S.R.L. A Socio Unico	Italy
Samsung SDS Global Supply Chain Logistics Spain S.L.U	Spain
Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A.	Netherlands
Samsung SDS Global SCL Germany GmbH	Germany
Samsung SDS Global SCL Romania S.R.L	Romania
Samsung SDS Asia Pacific Pte, Ltd.	Singapore

Samsung Data Systems India Private Limited	India
Samsung SDS Vietnam Co., Ltd.	Vietnam
PT. Samsung SDS Global SCL Indonesia	Indonesia
Samsung SDS Global SCL Philippines Co., Ltd.Inc.	Philippines
Samsung SDS Global SCL Thailand Co.,Ltd	Thailand
SAMSUNG SDS MALAYSIA SDN. BHD.	Malaysia
Samsung SDS Global SCL Austraila Pty.,Ltd.	Australia
SDS-ACUTECH CO., Ltd.	Thailand
ALS SDS Joint Stock Company	Vietnam
SDS-MP Logistics Joint Stock Company	Vietnam
Samsung SDS China Co., Ltd.	China
Samsung SDS Global SCL Hong Kong Limited	Hong Kong
SAMSUNG SDS Global SCL Egypt	Egypt
Samsung SDS Global SCL South Africa (PTY) Ltd.	South Africa
Samsung SDS Global SCL Nakliyat ve Lojistik Anonim Sirketi	Turkiye
Samsung SDS Global Supply Chain Logistics Middle East DWC- LLC	Utd.Arab Emir.
Samsung SDS Latin America Tecnologia E Logistica LTDA.	Brazil
NTE-SDS Logistics S.A. de C.V.	Mexico
Samsung SDS Rus Limited Liability Company	Russian Fed.
Samsung SDS Mexico, S.A. DE C.V.	Mexico
Samsung SDS Global SCL Panama S.A.	Panama
Samsung SDS Global SCL Chile Limitada	Chile
Samsung SDS Global SCL Peru S.A.C	Peru
Samsung SDS Global SCL Colombia S.A.S	Colombia
Samsung E&A America Inc.	USA
Samsung Project Management Inc.	Canada
Samsung E&A Hungary Co. Ltd.	Hungary
Samsung Engineering Italy S.R.L.	Italy
Samsung E&A Malaysia SDN. BHD.	Malaysia
PT Samsung Engineering Indonesia Co., Ltd.	Indonesia
Samsung E&A (Thailand) Co., Ltd.	Thailand
Samsung E&A India Private Limited	India
Samsung E&A Vietnam Co., Ltd.	Vietnam
GLOBAL MODULE CENTER JOINT STOCK COMPANY	Vietnam
Samsung Engineering Global Private Limited	India
Samsung E&A Shanghai Co., Ltd.	China
Samsung E&A Xi' an Co., Ltd.	China
Samsung Saudi Arabia Co., Ltd.	Saudi Arabia
Muharraq Wastewater Services Company W.L.L.	Bahrain
wurland wastewater bervices bompany w.c.c.	

Muharraq Holding Company 1 Ltd.	Utd.Arab Emir.
SAMSUNG ENGINEERING NEC COMPANY LIMITED	Saudi Arabia
Samsung E&A Mexico S.A. de C.V.	Mexico
Samsung Engineering Trinidad Co., Ltd.	Trinidad,Tobago
Samsung Ingenieria Manzanillo, S.A. De C.V.	Mexico
Grupo Samsung E&A Mexico, S.A. De C.V. (GSIM)	Mexico
Samsung E&A Energia S.A. De C.V.	Mexico
Samsung E&A Bolivia S.A	Bolivia
Samsung E&A DUBA S.A. De C.V.	Mexico
Samsung Engineering Kazakhstan L.L.P.	Kazakhstan
Samsung E&A America Construction LLC	USA
Samsung E&A Louisiana Construction LLC	USA
Samsung EPC Company Ltd.	Saudi Arabia
Muharraq Holding Company 2 Ltd.	Utd.Arab Emir.
Asociados Constructores DBNR, S.A. de C.V.	Mexico
S-1 CORPORATION HUNGARY LLC	Hungary
S-1 CORPORATION VIETNAM CO., LTD	Vietnam
Samsung Beijing Security Systems	China
Pengtai Greater China Company Limited	Hong Kong
PENGTAI INTERACTIVE ADVERTISING CO.,LTD	China
Cheil USA Inc.	USA
Cheil Central America Inc.	USA
Iris Worldwide Holdings Limited	United Kingdom
CHEIL EUROPE LIMITED	United Kingdom
Cheil Germany GmbH	Germany
Cheil France SAS	France
CHEIL SPAIN S.L	Spain
Cheil Benelux B.V.	Netherlands
Cheil Nordic AB	Sweden
Cheil India Private Limited	India
Cheil (Thailand) Ltd.	Thailand
Cheil Singapore Pte. Ltd.	Singapore
CHEIL VIETNAM COMPANY LIMITED	Vietnam
Cheil Integrated Marketing Philippines, Inc.	Philippines
CHEIL MALAYSIA SDN. BHD.	Malaysia
Cheil New Zealand Limited	New Zealand
Cheil Worldwide Australia Pty Ltd	Australia
CHEIL CHINA	China
Cheil Hong Kong Ltd.	Hong Kong
Caishu (Shanghai) Business Consulting Co., Ltd	China
Cheil MEA FZ-LLC	Utd.Arab Emir.

Cheil South Africa (Pty) Ltd	South Africa
CHEIL KENYA LIMITED	Kenya
Cheil Communications Nigeria Ltd.	Nigeria
Cheil Worldwide Inc./Jordan LLC.	Jordan
Cheil Ghana Limited	Ghana
Cheil Egypt LLC	Egypt
Cheil Maghreb LLC	Morocco
Cheil Brasil Comunicacoes Ltda.	Brazil
Cheil Mexico, S.A. de C.V.	Mexico
Cheil Chile SpA.	Chile
Cheil Peru S.A.C.	Peru
CHEIL ARGENTINA S.A.	Argentina
Cheil Rus LLC	Russian Fed.
Cheil Ukraine LLC	Ukraine
Cheil Kazakhstan LLC	Kazakhstan
Samsung Hospitality America Inc.	USA
Shilla Travel Retail Pte. Ltd.	Singapore
Samsung Shilla Business Service Beijing Co., Ltd.	China
Shilla Travel Retail Hong Kong Limited	Hong Kong
HDC SHILLA (SHANGHAI) CO., LTD	China
Samsung Hospitality U.K. Ltd.	United Kingdom
Samsung Hospitality Europe GmbH	Germany
SAMSUNG HOSPITALITY ROMANIA SRL	Romania
Samsung Hospitality Vietnam Co., Ltd.	Vietnam
Samsung Hospitality Philippines Inc.	Philippines
Samsung Hospitality India Private Limited	India
Samsung Venture Investment (Shanghai) Co., Ltd.	China
Iris (USA) Inc.	USA
Iris Atlanta, Inc.	USA
89 Degrees, Inc.	USA
The Barbarian Group LLC	USA
McKinney Ventures LLC	USA
Iris Nation Worldwide Limited	United Kingdom
Iris Americas, Inc.	USA
Irisnation Latina No.2, S. de R.L. de C.V.	Mexico
Irisnation Latina, S. de R.L. de C.V.	Mexico
Pricing Solutions Ltd	Canada
Iris London Limited	United Kingdom
Iris Promotional Marketing Ltd	United Kingdom
Iris Ventures 1 Limited	United Kingdom
Founded Partners Limited	United Kingdom

Iris Digital Limited	United Kingdom
Iris Amsterdam B.V.	Netherlands
Iris Ventures (Worldwide) Limited	United Kingdom
WDMP Limited	United Kingdom
Iris Services Limited Dooel Skopje	Macedonia
Irisnation Singapore Pte. Itd.	Singapore
Iris Worldwide Integrated Marketing Private Limited	India
Iris Worldwide (Thailand) Limited	Thailand
Iris Partners LLP	United Kingdom
Holdings BR185 Limited	Brit.Virgin Is.
Iris Germany GmbH	Germany
Founded, Inc.	USA
Pepper NA, Inc.	USA
Beattie McGuinness Bungay Limited	United Kingdom
Cheil Italia S.r.l	Italy
Cheil Austria GmbH	Austria
Centrade Integrated SRL	Romania
Centrade Cheil HU Kft.	Hungary
Centrade Cheil Adriatic D.O.O.	Serbia/Monten.
Experience Commerce Software Private Limited	India
PT. CHEIL WORLDWIDE INDONESIA	Indonesia
Cheil Philippines Inc.	Philippines
Shilla Retail Plus Pte. Ltd.	Singapore
Tianjin Samsung International Travel Service Co., Ltd	China
Shilla Retail Limited	Macau
BNY Trading Hong Kong Limited	Hong Kong
One Agency FZ-LLC	Utd.Arab Emir.
One RX Project Management Design and Production Limited	Turkiye
Company	Turkiye
ONE RETAIL EXPERIENCE KOREA LIMITED	United Kingdom
One RX India Private Limited	India
ONE RX INTERIOR DECORATION L.L.C	Utd.Arab Emir.
ONE AGENCY PRINTING L.L.C	Utd.Arab Emir.
Brazil 185 Participacoes Ltda	Brazil
Iris Router Marketing Ltda	Brazil

3. 타법인출자 현황(상세)

2024 반기말 현재 당사 타법인 출자 금액은 장부금액 기준 59조 7,414억원이며, 경영참여 등 목적으로 출자하였습니다.

☞ 본문 위치로 이동

(기준일: 2024년 06월 30일) (단위: 백만원, 천주, %)

					21.5			—	,		2101=1-			최근사업연.	도
	상장	최초취득일	출자	최초취득	기초잔액	기소산백		증가(감소	≥)		기말잔액			재무현황	
법인명	여부	자	목적	금액		지분	장부	취득(처분	취득(처분)			지분	장부		당기
					수량	율	가액	수량	금액	손익	수량	율	가액	총자산	순손익
삼성전기㈜	상장	1977.01.01	경영참여	250	17,693	23.7	445,244	-	-	-	17,693	23.7	445,244	11,657,872	450,482
삼성SDI㈜	상장	1977.01.01	경영참여	304	13,463	19.6	1,242,605	-	-	-	13,463	19.6	1,242,605	34,038,860	2,066,047
삼성중공업㈜	상장	1977.09.01	경영참여	125	134,027	15.2	1,038,711	-	-	214,444	134,027	15.2	1,253,155	15,593,389	-155,556
㈜호텔신라	상장	1979.12.01	경영참여	252	2,005	5.1	131,108	-	-	-23,656	2,005	5.1	107,453	3,006,539	85,978
㈜제일기획	상장	1988.09.01	경영참여	185	29,038	25.2	491,599	-	-	-	29,038	25.2	491,599	2,889,505	190,122
삼성에스디에스㈜	상장	1992.07.01	경영참여	6,160	17,472	22.6	560,827	-	-	-	17,472	22.6	560,827	12,321,025	701,326
삼성바이오로직스㈜	상장	2011.04.21	경영참여	30,000	22,217	31.2	1,595,892	-	-	-	22,217	31.2	1,595,892	16,046,197	857,691
삼성디스플레이㈜	비상장	2012.04.01	경영참여	16,009,547	221,969	84.8	18,509,307	-	-	-	221,969	84.8	18,509,307	65,328,568	8,268,314
스테코㈜	비상장	1995.06.29	경영참여	24,000	2,590	70.0	35,861	-	-	-	2,590	70.0	35,861	132,675	779
세메스㈜	비상장	1992.12.31	경영참여	1,000	2,173	91.5	71,906	-	-	-	2,173	91.5	71,906	2,187,919	58,754
삼성전자서비스㈜	비상장	1998.01.01	경영참여	30,000	6,000	99.3	48,121	-	-	-	6,000	99.3	48,121	795,640	10,348
삼성전자판매㈜	비상장	2000.12.21	경영참여	3,100	1,767	100.0	247,523	-	-	-	1,767	100.0	247,523	1,358,597	2,515
삼성전자로지텍㈜	비상장	1999.04.01	경영참여	76	1,011	100.0	46,669	-	-	-	1,011	100.0	46,669	465,079	16,540
삼성메디슨㈜	비상장	2011.02.16	경영참여	286,384	87,350	68.5	464,232	-	-	-	87,350	68.5	464,232	629,302	81,673
㈜삼성글로벌리서치	비상장	1991.05.01	경영참여	320	3,576	29.8	24,942	-	-	-	3,576	29.8	24,942	183,742	203
삼성벤처투자㈜	비상장	1999.11.01	경영참여	4,900	980	16.3	32,286	-	-	1,023	980	16.3	33,309	199,098	2,185
SVIC 21호 신기술투자조합	비상장	2011.11.02	경영참여	19,800	0	99.0	99	-	-	-	0	99.0	99	82,411	4,596
SVIC 22호 신기술투자조합	비상장	2011.11.02	경영참여	19,800	0	99.0	14,870	-0	-1,653	-	0	99.0	13,217	17,438	-3,932
SVIC 26호 신기술투자조합	비상장	2014.11.07	경영참여	19,800	1	99.0	60,803	-0	-1,950	-	1	99.0	58,852	27,631	-7,983
SVIC 28호 신기술투자조합	비상장	2015.02.13	경영참여	7,425	0	99.0	27,566	-	-	-	0	99.0	27,566	337,949	-24,526
SVIC 32호 신기술투자조합	비상장	2016.08.09	경영참여	19,800	1	99.0	119,364	-0	-13,266	-	1	99.0	106,098	223,258	-35,160
SVIC 33호 신기술투자조합	비상장	2016.11.11	경영참여	4,950	1	99.0	112,524	-	-	-	1	99.0	112,524	315,348	-9,228
SVIC 42호 신기술투자조합	비상장	2018.11.30	경영참여	4,950	0	99.0	44,444	0	486	-	0	99.0	44,930	33,102	-3,706
SVIC 45호 신기술투자조합	비상장	2019.05.10	경영참여	19,800	2	99.0	158,746	-0	-4,950	-	2	99.0	153,796	175,893	-12,472
SVIC 52호 신기술투자조합	비상장	2021.05.17	경영참여	9,900	0	99.0	49,599	0	6,435	-	1	99.0	56,034	77,174	30,345
SVIC 56호 신기술투자조합	비상장	2021.11.12	경영참여	22,084	1	99.0	56,516	-	-	-	1	99.0	56,516	56,070	556
SVIC 57호 신기술투자조합	비상장	2022.08.10	경영참여	14,850	0	99.0	41,491	0	10,672	-	1	99.0	52,163	37,155	-4,393
								-							
반도체성장 전문투자형 사모	비상장	2017.03.03	경영참여	500	32,306,9	66.7	32,307	11,803,0	-11,803	_	20,503,89	66.7	20,504	58,356	15,619
투자신탁					80			85			5				
시스템반도체 상생 전문투자					50,000,0						50,000,00				
형 사모 투자신탁	비상장	2020.04.27	경영참여	25,000	00	62.5	50,000	-	-	-	0	62.5	50,000	79,856	194
반도체 생태계 일반 사모 투					- 50			3,000,00							
	비상장	2023.07.27	경영참여	500	500,000	66.7	500		3,000	-	3,500,000	66.7	3,500	753	-249
자신탁 ㈜희망별숲	비상장	2022 12 26	경영참여	900	180	100.0	900	0			180	100.0	900	7,255	1,227
㈜레인보우로보틱스	미상상 상장	2022.12.26	경영참여	58,982	2,854	14.8	58,982	_	_	_	2,854	14.8	58,982	151,014	19,160
									_	-					
㈜아이마켓코리아	상장	2000.12.07	경영참여	1,900	647	1.9	5,560	-	_	65	647	1.9	5,625	1,373,717	24,301

		I													
㈜케이티스카이라이프	상장	2001.12.01	단순투자	3,344	240	0.5	1,421		-	-175	240	0.5	1,246	1,215,698	-113,745
모나용평㈜	상장	2007.05.11	단순투자	1,869	400	0.8	1,220	-	-	120	400	8.0	1,340	1,004,928	10,003
에이테크솔루션㈜	상장	2009.11.26	단순투자	26,348	1,592	15.9	17,241	-	-	-4,155	1,592	15.9	13,086	269,808	1,359
㈜원익홀딩스	상장	2013.12.18	경영참여	15,411	1,759	2.3	5,928	-	-	70	1,759	2.3	5,999	1,830,611	-37,468
㈜원익아이피에스	상장	2016.04.01	경영참여	16,214	1,851	3.8	62,839	-	-	1,573	1,851	3.8	64,413	1,084,863	-13,508
㈜동진쎄미켐	상장	2017.11.01	경영참여	48,277	2,468	4.8	95,507	-	-	3,332	2,468	4.8	98,839	1,606,588	123,534
솔브레인㈜	상장	2020.07.01	경영참여	24,866	437	5.6	132,951	-	-	-5,904	437	5.6	127,047	996,470	129,491
㈜에스앤에스텍	상장	2020.08.14	경영참여	65,933	1,716	8.0	77,740	-	-	-16,475	1,716	8.0	61,265	256,771	25,855
㈜와이씨	상장	2020.08.14	경영참여	47,336	9,602	11.7	47,864	-	-	119,300	9,602	11.7	167,164	479,837	13,436
㈜케이씨텍	상장	2020.11.16	경영참여	20,720	1,022	4.9	27,395	-	-	18,962	1,022	4.9	46,357	499,635	31,701
㈜엘오티베큠	상장	2020.11.16	경영참여	18,990	1,268	7.1	25,544	-	-	-5,768	1,268	7.1	19,776	366,912	49,060
㈜뉴파워프라즈마	상장	2020.11.16	경영참여	12,739	2,141	4.9	11,240	-	-	2,355	2,141	4.9	13,595	673,589	14,825
㈜에프에스티	상장	2021.03.16	경영참여	43,009	1,523	7.0	37,541	-	-	21,017	1,523	7.0	58,558	412,550	-15,073
㈜디엔에프	상장	2021.08.11	경영참여	20,964	810	7.0	19,400	-	-	-4,496	810	7.0	14,905	165,587	5,174
Marvell	상장	2021.10.05	단순투자	11,705	173	0.0	13,468	-	-	3,357	173	0.0	16,825	27,372,028	-1,219,132
SoundHound Inc.	상장	2016.12.01	단순투자	7,059	1,703	0.9	4,655	-	-	4,690	1,703	0.9	9,345	194,857	-116,162
한국경제신문㈜	비상장	1987.05.01	단순투자	150	72	0.4	365	-	-	-	72	0.4	365	707,762	33,516
㈜한국비지니스금융대부	비상장	1995.01.01	단순투자	5,000	1,000	17.2	2,964	-	-	-	1,000	17.2	2,964	86,700	1,164
㈜싸이버뱅크	비상장	2000.12.30	단순투자	8,000	1,083	7.5	_	-	-	-	1,083	7.5	_	_	-
화인칩스㈜	비상장	2001.12.01	단순투자	10	2	3.3	10	-	_	-	2	3.3	10	16,450	883
㈜인켈	비상장	2006.11.01	단순투자	130	0	0.0	0	_	_	_	0	0.0	0	7,848	-4,058
인텔렉추얼디스커버리㈜	비상장	2011.05.13	단순투자	5,000	357	10.7	1,922	-	-	_	357	10.7	1,922	71,809	3,682
㈜말타니	비상장	2012.04.01	단순투자	16,544	45	15.0	7,891	_	-	79	45	15.0	7,970	86,711	750
㈜팬택자산관리	비상장	2013.06.19	단순투자	53,000	53,000	10.0	_	_	_	_	53,000	10.0	_	_	_
㈜인공지능연구원	비상장	2016.07.28	단순투자	3,000	600	14.3	3,000	_	_	_	600	14.3	3,000	4,107	1,832
㈜미코세라믹스	비상장	2020.11.16	경영참여	21,667	747	13.7	33,973	_	_	5,648	747	13.7	39,621	250,981	42,068
에스지신성건설㈜	비상장	2010.07.29	단순투자	1	0	0.0	0	_	_		0	0.0	0	139,416	-9,416
(유우방	비상장	2010.07.23	단순투자	0	1	0.0	0	_	_	_	1	0.0	0	514,572	-34,684
㈜삼보컴퓨터	비상장	2012.09.27	단순투자	0	0	0.0	0	_	_	_	0	0.0	0	49,422	-3,055
대우산업개발㈜	비상장	2012.12.18	단순투자	0	0	0.0	0	_	_	_	0	0.0	0	149,587	-136,767
대우송도개발㈜	비상장	2012.12.18	단순투자	0	9	0.0	0	_	_	_	9	0.0	0	19,369	-350
자일자동차㈜	비상장	2012.12.18	단순투자		1				_		1		0		
성원건설㈜				0	1	0.0	0	1	_		0	0.0	0	196,194	-23,417
	비상장	2014.04.30	단순투자			0.0		-1	-0	_		-	_	27,744	-627
㈜인회	비상장	2014.04.30	단순투자	0	0	0.1	0	_	_	_	0	0.1	0	2,418	177
JNT(반도체펀드)	비상장	2011.02.28	단순투자	1,800	0	24.0	1,240	-	-	_	0	24.0	1,240	2,173	18
L&S(반도체펀드)	비상장	2012.07.30	단순투자	848	0	7.5	1		-1	-	_	-	_	_	_
베어포트리조트	비상장	2022.04.18		0	51	0.5	0		-	-	51	0.5	0	115,380	-9,846
SEA	비상장	1978.07.01	경영참여	59,362	492	100.0	17,166,557	-	-	-	492	100.0		41,926,899	477,338
SECA	비상장	1992.08.13	경영참여	3,823	0	100.0	90,922	-	-	-	0	100.0	90,922	1,302,924	75,479
SEDA	비상장	1994.01.01	경영참여	13,224	77,205,7	87.0	647,620	-	-	-	77,205,70	87.0	647,620	5,542,627	333,812
SEM	비상장	1995.07.01	경영참여	3,032	3,837	63.6	165,638	-	-	-	3,837	63.6	165,638	2,153,032	148,873
SELA	비상장	1989.04.01	경영참여	319	40	100.0	86,962	-	-	-	40	100.0	86,962	649,150	45,612
SEASA	비상장	1996.06.01	경영참여	4,696	21,854	98.0	6,779	-	-	-	21,854	98.0	6,779	83,075	18,833
SECH	비상장	2002.12.19	경영참여	597	0	4.1	597	-	-	-	0	4.1	597	524,530	25,826
SEUK	비상장	1995.07.01	경영참여	33,908	109,546	100.0	433,202	-	-	-	109,546	100.0	433,202	2,902,722	185,113
SEL	비상장	1998.12.31	경영참여	8,280	4,393	100.0	-	-	-	-	4,393	100.0	-	7,212	-
SEHG	비상장	1982.02.01	경영참여	28,042	0	100.0	354,846	-	_	-	0	100.0	354,846	438,172	93,092
SEF	비상장	1991.08.21	경영참여	230	2,700	100.0	234,115	_	-	-	2,700	100.0	234,115	1,265,823	65,460
SEI	비상장	1993.05.24	경영참여	862	677	100.0	143,181	_	_	_	677	100.0	143,181	1,053,955	56,071
SESA	비상장	1989.01.01	경영참여	3,276	8,021	100.0	142,091	_	_	_	8,021	100.0	142,091	1,266,167	46,746
SEP	비상장	1982.09.01	경영참여	204	1,751	100.0	37,616	_	_	_	1,751	100.0	37,616	304,248	10,591
SEH	비상장	1991.05.31	경영참여	1,954	753	100.0	650,157	-	_		753	100.0	650,157	1,426,079	577,538
OLIT	୩୫୫	15.00.1661	요요되어	1,954	/53	100.0	050,15/	_	_	_	/53	100.0	050,15/	1,420,079	311,538

SELS	비상장	1991.05.01	경영참여	18,314	1,306	100.0	24,288	-	-	-	1,306	100.0	24,288	1,639,004	4,984
SEBN	비상장	1995.07.01	경영참여	236	539,138	100.0	914,751	-	-	-	539,138	100.0	914,751	1,794,552	140,313
SEEH	비상장	2008.01.01	경영참여	4,214	0	100.0	1,369,992	-	-	-	0	100.0	1,369,992	9,660,481	103,387
SENA	비상장	1992.03.01	경영참여	392	1,000	100.0	69,372	-	-	-	1,000	100.0	69,372	591,101	35,047
SESK	비상장	2002.06.01	경영참여	8,976	0	55.7	263,767	-	-	-	0	55.7	263,767	928,129	83,304
SEPOL	비상장	1996.04.01	경영참여	5,462	106	100.0	78,267	-	-	-	106	100.0	78,267	1,384,273	108,288
SEAG	비상장	2002.01.01	경영참여	40	0	100.0	32,162	-	-	-	0	100.0	32,162	519,776	166,348
SERC	비상장	2006.01.01	경영참여	24,877	0	100.0	188,290	-	-	-	0	100.0	188,290	839,493	40,845
SERK	비상장	2007.07.19	경영참여	4,600	0	100.0	204,555	-	-	-	0	100.0	204,555	1,030,743	64,771
SEO	비상장	1997.01.01	경영참여	120	0	100.0	-10,043	-	10,043	-	-	-	-	-	-
SGE	비상장	1995.05.25	경영참여	827	0	100.0	32,836	-	-	-	0	100.0	32,836	1,027,977	-2,365
SEEG	비상장	2012.07.09	경영참여	23	0	0.1	39	-	-	-	0	0.1	39	1,348,469	156,005
SSA	비상장	1998.12.01	경영참여	263	2,000	100.0	32,622	-	-	-	2,000	100.0	32,622	527,416	23,826
SAPL	비상장	2006.07.01	경영참여	793	877,133	100.0	981,483	-	-	-	877,133	100.0	981,483	22,234,942	14,140,195
SME	비상장	2003.05.01	경영참여	4,796	17,100	100.0	7,644	-	-	-	17,100	100.0	7,644	618,803	18,490
SDMA	비상장	1995.03.01	경영참여	21,876	71,400	75.0	18,741	-	-	-	71,400	75.0	18,741	26,388	2,908
SEMA	비상장	1989.09.01	경영참여	4,378	16,247	100.0	103,402	-	-	-	16,247	100.0	103,402	313,767	23,877
SAVINA	비상장	1995.01.17	경영참여	5,839	0	100.0	28,365		-	_	0	100.0	28,365	110,276	18,161
SEIN	비상장	1991.08.28	경영참여	7,463	46	100.0	118,909	-	-	-	46	100.0	118,909	1,110,178	170,952
TSE	비상장	1988.01.01	경영참여	1,390	11,020	91.8	279,163	-	-	-	11,020	91.8	279,163	3,039,379	150,510
SEAU	비상장	1987.11.01	경영참여	392	53,200	100.0	111,964	-	-	-	53,200	100.0	111,964	612,161	44,768
SIEL	비상장	1995.08.01	경영참여	5,414	216,787	100.0	75,263	-	-	-	216,787	100.0	75,263	7,738,259	1,153,256
SRI-Bangalore	비상장	2005.05.30	경영참여	7,358	17	100.0	31,787	-	-	-	17	100.0	31,787	430,987	79,895
sjc	비상장	1975.12.01	경영참여	273	1,560	100.0	253,108	-	-	-	1,560	100.0	253,108	1,013,103	-5,381
SRJ	비상장	1992.08.25	경영참여	3,120	122	100.0	117,257	-	115,775	-	122	100.0	1,482	136,782	1,792
SCIC	비상장	1996.03.01	경영참여	23,253	0	100.0	640,452	-	-	-	0	100.0	640,452	10,222,557	189,887
SEHK	비상장	1988.09.01	경영참여	349	274,250	100.0	79,033	-	-	-	274,250	100.0	79,033	985,438	26,885
SET	비상장	1994.11.01	경영참여	456	27,270	100.0	112,949	-	-	-	27,270	100.0	112,949	1,797,627	56,467
TSEC	비상장	1993.04.01	경영참여	15,064	0	48.2	103,134	-	-	-	0	48.2	103,134	382,260	11,732
SSEC	비상장	1995.04.01	경영참여	32,128	0	69.1	130,551	-	-	-	0	69.1	130,551	636,160	84,614
SESC	비상장	2002.09.01	경영참여	5,471	0	73.7	34,028	-	_	-	0	73.7	34,028	94,528	10,678
TSTC	비상장	2001.03.01	경영참여	10,813	0	90.0	260,092	_	_	_	0	90.0	260,092	646,732	5,167
SSS	비상장	2001.01.01	경영참여	1,200	0	100.0	19,189	_	_	_	0	100.0	19,189	5,262,086	244,210
SCS	비상장	2012.09.19	경영참여	111,770	0	100.0	5,275,760	-	277,840	-	0	100.0	5,553,600	15,808,283	877,892
SSCX	비상장	2016.04.25	경영참여	1,141	0	100.0	1,141	-	_	_	0	100.0	1,141	854,932	47,820
SESS	비상장	1994.12.30	경영참여	18,875	0	100.0	504,313	_	_	_	0	100.0	504,313	869,225	95,067
TSLED	비상장	2012.04.01	경영참여	119,519	0	100.0	119,519	_	-	_	0	100.0	119,519	257,820	16,380
SSCR	비상장	2006.09.01	경영참여	3,405	0	100.0	9,332	_	_	_	0	100.0	9,332	89,911	16,465
TSST Japan	비상장	2004.03.29	경영참여	1,639	30	49.0	_	_	_	_	30	49.0	_	232,877	_
STE	비상장	1996.01.01	경영참여	4,206	2	49.0	_	-	-	_	2	49.0	_	7,405	_
Semiconductor Portal Inc.	비상장	2002.12.01	단순투자	38	0	1.2	10	_	_	_	0	1.2	10	2,016	9
Nanosys Inc.	비상장	2010.08.13	단순투자	4,774	2,000	0.6	-	_	_	_	2,000	0.6	-	-	21,211
One-Blue, LLC	비상장	2011.07.14	경영참여	1,766	0	16.7	1,766	_	_	-	0	16.7	1,766	25,051	563
Sentiance NV	비상장	2012.12.01	단순투자	3,422	7	7.2	3,422	_	_	_	7	7.2	3,422	2,407	-4,899
Mantis Vision Ltd.	비상장	2014.01.16	단순투자	1,594	355	2.1	0,422	_	_	_	355	2.1	0,422	14,234	14
Leman Micro Devices SA	비상장	2014.08.14	단순투자	1,019	17	3.4	0	_	_	_	17	3.4	0	1,868	-3,111
Sensifree LTD	비상장	2016.01.01	단순투자	2,111	666	9.5	0	_	_	_	666	9.5	0	473	-1,552
Unispectral Ltd.	비상장	2016.02.29	단순투자	1,112	2,308	7.9	803	_	_	_	2,308	7.9	803	2,360	3,597
Quobyte, Inc.	비상장	2016.02.29	단순투자	2,865	729	11.8	0	_	_		729	11.8	0	4,330	955
Afero, Inc.	비상장	2016.04.28	단순투자	5,685	723	5.5	5,685	_			723	5.5	5,685	25,364	-23,197
Graphcore Limited				3,494	12,000	1.4	3,069					1.4	3,069	121,249	-170,966
	비상장	2016.06.30	단순투자			5.1			_	_	12,000				
Fasetto, Inc.	비상장	2019.01.29	단순투자	6,701	475	5.1	0	_	_	_	475	5.1	0	5,160	-8,899

합계 59,246,942 8,803,08 159,078 335,407 59,741,427 -

- ※ 별도재무제표 기준입니다.
- ※ 법인명은 'XⅡ. 상세표'의 '1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 항목을 참조하시기 바랍니다.
- ※ 최초취득일자의 날짜는 일부 과거 취득시 자료 확보가 현실적으로 곤란한 경우 일괄적으로 1일로 기재하였습니다.
- ※ 지부육은 보통주 기준입니다
- * 당사는 기업회계기준에 따라 금융상품(지분상품)에 대해서는 공정가치로 측정하고 있으며, 종속기업 및 관계기업 투자주식에 대해서는 매년 손상(감액) 징후가 있는지 검토하고 징후가 있다면 해당 자산의 회수가능액을 추정하여 손상 회계처리를 하고 있습니다.
- ** 최근사업연도 재무 현황은 일부 법인의 자료 확보가 현실적으로 곤란하여, 성원건설㈜은 2016년 12월 31일, 대우송도개발㈜는 2017년 12월 31일, Mantis Vision은 2021년 12월 31일, Leman Micro Devices SA, Sensifree는 2022년 12월 31일, One-Blue는 2023년 3월 31일 현재의 재무 현황을 기재하였습니다.

4. 연구개발실적(상세)☞ 본문 위치로 이동

부문		연구과제 등	연구결과 및 기대효과 등
			□ Mini LED 기반 초고화질 & 슬림 8K TV (65 · 75 · 85")
		N 0150 01	- QN900 (65 · 75 · 85") / QN800 (65 · 75 · 85") / QN700 (55 · 65 · 75")
		Neo QLED 8K	- 세밀한 Mini LED의 향상된 명암비로 더욱 실제를 보는 듯한 QLED 8K 화질
		(~2024.03.)	- Neural Quantum Processor 8K 적용하여 입체감과 현실감 있는 시청 경험 제공
			- OTS(Object Tracking Sound) 기능으로 공간을 감싸는 입체감 있는 음질 경험 제공
			□ Mini LED 기반 3개 시리즈, 7개 사이즈 (43 · 50 · 55 · 65 · 75 · 85 · 98")
			□ Mini LED 적용을 통한 Slim 구현 및 Bezel-less/Metal를 통한 디자인 프리미엄 Look
		Neo QLED 4K	- Quantum Nano-Layer Multi-Cell 구조를 적용하여 Slim하면서도 높은 광 효율과
		(~2024.03.)	광 Profile 조절이 가능한 New LED
			- 장르별 선호 화질 선택 時, AI 활용하여 장르별 맞춤형 화질 변환
			- 편리한 사용성 제공하는 New Home을 통해 빠른 진입점 및 추천경험 제공
			□ Quantum Dot 기반 self-emitting Display Flat 4K TV (55 · 65 · 77")
			- S95 (55 · 65 · 77") : 144Hz VRR 적용된 QD-OLED Display와 OLED Glare Free 적용된
			True Reality 화질과 Ultra Slim Flat 폼팩터에 Top Speaker가 내장된 Infinity One Design에
			Object Tracking Sound 및 ATMOS 까지 모두 적용된 진정한 TV 가치를 제공하는 OLED TV
			- S90 (55·65·77") : Neo QLED 外, 삼성 OLED 라인업 강화하여 Premium TV 시장 內 포지셔
			니
		OLED TV	확대를 위해 144Hz VRR 적용된 OLED Display의 화질과 Laser Slim Design에 OTS Lite 및
		(~2024.03.)	ATMOS 적용으로 부족함 없는 입체 사운드 경험을 제공하는 OLED TV
	여사		□ White OLED 기반 self-emitting Display Flat 4K TV (42 · 48 · 55 · 65 · 77 · 83")
DX 부문	명상 DX 부문 디스플레이		- S90 (42 · 48 · 55 · 65 · 77 · 83") : 상동
	u_auv		- S85 (55 · 65 · 77 · 83") : OLED 판매 확대 및 손익 개선 중심의 신규 라인업으로 기획된
			White OLED Display와 최후부까지 곡선으로 날렵하게 이어지는 Contour Design에
			OTS Lite 및 ATMOS 적용으로 부족함 없는 입체 사운드 경험을 제공하는 OLED TV
			☐ Flat QLED 4K TV (32 · 43 · 50 · 55 · 60 · 65 · 70 · 75 · 82 · 85 · 98")
			- 4K 최고의 화질(AI/밝기/시야각) 및 음질(OTS)을 통한 시청 경험을 극대화한 Flagship QLED
		QLED TV	- 최고의 명암비, 시야각 Free, Life-like 컬러와 최적의 밝기로 몰입감을 극대화
		(~2024.03.)	- 음성인식 및 AI 기술 기반으로 외부 환경 및 사용자 Context를 인지하여 최적의 시청 경험 제공
			- 고가의 전문 장비 없이 모바일로 손쉽게 TV 화질을 Calibration
			- Game Bar를 통한 캐주얼 게이머들을 위한 게임 경험 확대
			□ Flat UHD TV (43 · 50 · 55 · 58 · 60 · 65 · 70 · 75 · 82 · 85 · 98")
			- Slim한 Bezel-less 디자인과 실제 자연색에 가까운 Color를 제공하는 UHD 스마트 TV
			- Dynamic Crystal Color 및 Dual LED를 통해 원본 콘텐츠의 화질을 그대로 표현하는 UHD 화질
		UHD TV	- Multi-media Screen 경험 제공, 풍부한 콘텐츠, Smart Home의 경험을 통해 완성된 Smart
		(~2024.03.)	경험 제공
			- Game Hub, IoT Hub, Chat Together, Voice Ready, Daily+, SmartThings Mobile Plugin 기
1			능
			추가를 통한 Smart 경험 강화
1		Lifestyle TV	☐ The Sero (43")
1		(~2024.04.)	- Modern & Simple 한 세로형 Screen에 판상형 Speaker가 부착된 360도 Design
	<u> </u>		

			- 다양한 거주공간 어디에도 쉽게 거치 가능, 이동 가능한 Floor 스탠드 제공
			- 기울어진 폼팩터에도 외광/실내 조명 반사 없는 화질로 기존 제품의 VoC 대폭 개선
			☐ The Frame (32 · 43 · 50 · 55 · 65 · 75 · 85")
			- Real 액자 디자인 및 액자 설치 경험 완성
			- 다양한 명화, 사진 등 감상 가능, 인데리어와 조화로운 Lifestyle 디자인 채용
			- 초대형 Life Style 제품 Needs에 따른 85" 추가도입
			- 외광/실내 조명 반사 없이 항상 종이와 같은 질감을 표현하는 화질로 Real Frame 경험 완성
			☐ The Serif (43 · 50 · 55 · 65")
			- 'l' 형태 Serif Font 디자인으로 확실한 차별화 및 인테리어 감성 극대화
			- 대형 사이즈 제품 포지션 확대를 위한 65" 추가도입
			- 외광/실내 조명 반사 없이 항상 매트한 질감을 표현하는 화질로 가구와 같은 디자인 완성
			- White 외 Dark계열 신규컬러(Ivy Green) 옵션 제공
			☐ The Terrace (55 · 65 · 75")
			- 옥외에서 휴식과 Entertainment를 동시에 즐기려는 Lifestyle 대응을 위한 차별화된 제품
			☐ The Premiere (100~130")
			- 초단초점·레이저·고화질 폼팩터에 업계 최고 Smart UX/OTT 경험 제공
			- Blended 디자인으로 벽 근처에 쉽게 놓고 원하는 공간에 적합한 사이즈로 투영
			- 당사 TV의 완성된 콘텐츠 경험과 차별화된 화질·음질을 제공하는 프로젝터
			☐ The Freestyle (30~100") / Freestyle Rev (30~100")
			- 언제 어디서나 다양한 컨텐츠를 쉽게 감상할 수 있는 Movable Smart Screen
			- 다양한 공간에 쉽게 놓이며 각도/거리에 상관없이 최적 시청 경험 제공(Auto Focus/Auto Keystone)
			- 기본 Cradle로 다양한 공간에 거치 사용성이 추가되고 소켓을 통해 신규 설치 확장도 가능
			□ Micro-LED Screen (76・89・101・114", TFT 기반)
		Missa LED TV	
		Micro-LED TV	- 프리미엄 고객 및 유통의 Needs를 만족 시켜 주는 차세대 Flagship 모델
		(~2023.12.)	- TFT Glass기반 12.7" 모듈(Pitch 0.51) Micro-LED Screen 완품형 출시
			- MicroLED Processor : AI scaling + HDR enhancing 기반 선명한 입체 화질 구현
			☐ Sound Bar Q990B
		Sound Bar	- 업계 최초, TV에서 사운드바로 무선 ATMOS 전송(Wireless ATMOS)
		(~2022.03.)	- TV와 Soundbar의 모든 채널을 활용하여 극장과 같은 최상의 Cinema True ATMOS 제공
			- 사운드바 자체 공간 보정 기술 탑재
			□ 스마트 모니터 M80B (32")
			- 초슬림, Flat Back, Warm White 컬러 적용 Lifestyle 디자인
			- Magnetic 방식의 전용 카메라 In-box 영상 커뮤니케이션
			- 스마트 경험 강화(VOD 시청/모바일 연결/PC-less기능/IoT/Communication/Game)
			□ 게이밍 모니터 G85NB (32")
			│ │ - 세계 최초 UHD 240Hz 1ms(GTG) 최고 게이밍 성능 모니터 (1000R Curved)
			- 새로운 수준 화질 경험을 제공하는 Odyssey Neo (Mini LED, Quantum HDR2000)
			□ 세계 최초 1000R 대형 게임 스크린 G97NB (55")
		모니터	- 1000R, 16:9, 55" Big Curved Screen으로 근접 환경에서도 시야각 제약 없는
		(~2023.09.)	
			최대 사이즈 화면으로 최고의 몰입감 제공
			- 세로로 회전하고 자유로운 각도 조정으로 우주선 조종석에 앉은 것 같은 새로운 몰입 경험 제공
			- 4K 165Hz 입출력 및 반응속도 1ms까지 지원 가능한 게임 전용 패널
			□ QD-OLED 게이밍 모니터 (G85SB 34")
			- True RGB 자발광 Display와 Quantum Dot 기술의 조합으로 다양한 컬러를 정교하게 표현
			- 0.1ms 최고 응답속도, 175Hz 주사율로 보다 깨끗한 화면으로 게임 플레이 가능
			- Gaming Hub 적용으로 Cloud Game, 콘솔 등 All-In-One Game Discovery Platform 도입
			□ 5K 초고해상도 모니터 (S90PC 27")
i .			

		1	
			- 4K 대비 50% 이상 더 많은 픽셀로 더 많은 정보를 담는 5K(5120X2880) 해상도
			- 모니터 후드 없이도 빛 반사를 줄여 화면 왜곡을 없애고 눈 보호하는 Matte Display
			- MAC/Windows 모두 만족하는 Thunderbolt 4 및 miniDP 제공
			- 나의 작업/ 일상/ 공간에 맞춰 활용하는 '스마트스크린'
			□ DUHD Flagship Gaming 모니터 (G95NC 57")
			- 신규 57"초대형 폼팩터 및 초고화질 Dual UHD(7680X2160)을 통한 '극한의 몰입감' 제공
			- 240Hz 주사율, 1ms 최고 응답속도로 보다 깨끗한 화면으로 게임 플레이 가능
			□ LCD 기반의 B2B Smart Signage (LFD, Video Wall, Outdoor 등) (13 · 24 · 32 · 43 · 49 · 50 · 55 · 65 · 75
			. 85 · 98")
		사이니지	□ LED 소자를 활용한 Indoor / Outdoor 사이니지
		(~2023.06.)	□ 부가 장치 일체형 All-in-one Kiosk (24")
			- Tizen 결제모듈/주문 앱 개발 위한 결제 플랫폼, 항균 코팅
			□ 구주 177cm 1Door 빌트인 냉장고 신규 진입
			- 발트인 패키지 라인업 확대
			- 신규격 기준 에너지 최고등급 구현
			- 간냉식 용량 우위 확보
			- 식품 신선보관(고습 냉장) 및 변온기능(냉동→냉장) 차별화
			□ 북미 48"냉장고 빌트인 시장 교체 및 신규 수요 대응
			- 빌트인 27.4cf 대용량 구현
			- Ice & Water Solution 차별화(Auto Fill Water, Dual Auto Ice Maker)
			- Soft Closing 도어 적용으로 감성품질 고급화
			□ 한국향 초격차 에너지 모델 도입(초절전 1등급, 1등급-22%달성)
			- 세계 최고 효율 압축기 적용 (W1, EER 9.3)
			- Set 열부하 저감(VIP Coverage 증대)
			- 기계실 방열 증대(Comp 측 Side Cool 추가)
			□ Global Wide BMF 냉장고
			- 고효율 에너지 등급 및 Al Energy mode 적용, 에너지 비용 절감
		냉장고 (~2024.04.)	- SpaceMax 적용으로 내용적 확대로 수납 편의성
			- SmartThings 기반 시간대별 고내 조명 자동 조절 등 Smart 서비스 제공
	생활가전		□ 중국 가옥 맞춤 냉장고(W83cm)
			- 좌우 제로갭 설치로 주방 공간에 딱 맞게 빌트인처럼 매끈하게 설치 가능
			- AI에너지 모드 적용으로 실사용 에너지 절감(중국에너지 1등급)
			- 최적 온도와 습도에서 전문적으로 식재료 특화 보관 제공(건습/보습 Box)
			- Wide Open 자동 도어 열림 기능 적용
			□ Peltier 적용 냉장고
			- Peltier 적용 및 폐열 활용을 통한 최고 효율 및 에너지 등급 달성
			- 2개 냉각방식(Comp+Peltier)의 장점을 결합하여 소비자 Value 창출
			· 1등급 -30% 에너지 달성 (기존 1등급 -22%)
			· Peltier 냉각 시스템 Compact化로 내용적 확보(기존 875L → 900L)
			□ 구주 Built-In BMF 냉장고
			- 구주향 빌트인 BMF 대용량(380리터 ↑) 최고 에너지 등급 달성
			- Al Energy 적용, 동급比 10%이상 실사용 에너지 절감
			- Full 간냉 및 [냉동→냉장 전환] 기능 제공
			□ 그랑데 AI 24kg 세탁기
		세탁기	- 24kg, Flat Design (Glass Type)
		(~2024.02.)	- 펫케어 코스 적용(얼룩, 냄새, 알러젠 제거)
			- Auto open door 적용(세탁 종료 후 자동으로 문 열림)
		<u>l</u>	I

□ BESP(DEC 그렇(SIA) 발생된 (Top-Fit		T
- 에타기(전)에 의 전조기(전)에 대해 된 전비대 대자인 - 심문과 함께 (대전) 대적건조기 868/POKE N 를 모 - 이번 축무선 1 세탁급 이용됐어 관리하게 제탁간조 - 사용 등 (대기와인 및 음성인식으로 간단하게 세탁간조 - 사용 등 (대기와인 및 음성인식으로 간단하게 세탁간조 - 사용 등 전기 대유 (독실로 전실으로 가장 등 대본 학생 - 기업을 대한 경험 및 대본 학생 - 기업을 대한 기업을 가 기업을 대한 기업을		□ BESPOKE 그랑데AI 원바디 Top-Fit
- 심플한 플랫 디자인 - 네이는 실루션 : 세약을 이동없이 관리하게 하나로 세탁간조 - 시설 : 디지체면 및 옵션인식으로 건설하게 세탁간조 - 시설 : 디지체면 및 옵션인식으로 건설하게 세탁간조 - 시설으로 : 세탁교에 보는 회약을 되었고 이번을 경환로 이를 되어 대응 - 지수를 가게 되었는 국업을 중심한 기안을 경환로 이를 가게 보다 대응 - 지수 전 등 하하 : 구25°C의기에서 상략 반당 성등 100% 구면 - 고은 토수로 : Hoad Pump 당한 시어를 최고 70°C 토후수 구전 - 디자인 가별와 : 주가 함하에 조화를 이루는 Dark 세상 계약의 1FAN 실외기 - DESPONE 무당에이가 전용되자 - 항에서도 작내형 없이 사회 수용 냉항 - 전문과 소를 들여 수업을 모양하는 않 60 지수를 모든 - 소화하 속에 살아하는 고를 하나가 있을 표현 - 이용기를 보면 시설되어 간단 만든 설명 전략을 모양하는 있 60 지수를 모든 - 소화하 속에 살아하는 고를 하나가 있을 표현 - 이용기를 보면 시설되어 간단 만든 설명 및 기계 대명한 경역 낮당 - 반대하는 Line 1Way BESPONE 무를 시설될에 어떤 - 대한 기계 보안을 부모를 받는데나는 본든 간단 건설으로 받기 라마팅 - 지본스 전략을 내용되어 기계 하면 전에 - 고요를 에너지 웃음질을 없이는 오등 - 공기본만 내가 급리하지 위해 하면서 를 살아하는 시 됩어모드 - 구주 ENS 전 1/60 (1/229) 전구 플랫폼 - 2027가 되게 가하여 60가 시설 전략(1/229) 전구 플랫폼 - 2027가 되게 가하여 60가 시설 전략(1/229) 전구 교육을 이어 구를 대한 기계 등 10가 10가 등 10가 기계 등 10가 기계 등 10가 10가 등 10가 기계		- 한국향 BESPOKE 그랑데AI 일체형 Washer
□ 서막간조가 DESPONE AI 공보 - ONE 호루션 - 세약을 이용없이 반답하게 하나로 세약간조 - 사용: ENAINS 및 음성인식으로 간편하게 세약간조 - 사용: - 사용: ENAINS 및 음성인식으로 간편하게 세약간조 - 사용:		- 세탁기(21kg)와 건조기(17kg) 일체형 원바디 디자인
- ONE 출부선 : 세막을 이동없이 만리하게 하나도 세탁건조 - 사용 : HA회정인 및 옵션인식으로 관련하게 세탁건조 - 사용 : A 제정 (- 심플한 플랫 디자인
- AL 홈 : 터지화인 및 급성이식으로 간편하게 세탁건조 - AL 설립권소 : 세탁교 배는 회색의 코스로 색된 □ 구조 EHS 신청 플랫폼 작용 및 라인한 강화로 예출 확대 - 조로를 가져 때로 '독일을 중심으로 구주 국가발 소를 구제 꼭대 때목 - 교로 목출수 : Host Pump 단의 사이를 최고 70'0 토수수 구현 - 교교 모호수 : Host Pump 단의 사이를 최고 70'0 토수수 구현 - 교교 전체 : 주가 환경에 조종를 이루는 Oark 색살 개열의 1FAN 설의기 □ BESPOKE 무료에 아픈 현도수및 - 항안에서도 학대한 없이 시원된 모든 생항 - 권료과 소설을 쓰여 역한을 보면수는 32'0 제 소설으로 - 상황에 맞춰 선택하는 교육을 하다가 맞춤 전쟁 - 변수없이 설계 간원하게 간편 안성 설계 것 에이킨 (*2024.04.) □ Infinite Line 1Way BESPOKE 무공 시스템에 대응한 강역 생항 - 변수없이 걸고 안전하게 간편 안성 설계 것 에이킨 (*2024.04.) □ 그용급 에너지 맞춤결권 에어 도명 - 공기본부터 내부 관리까지 되어 80'대 - 실용해 맞춰 선택에 대너지를 결정하는 시 환역보도 - 구조 EHS 신 병에 (유교인이) 신규 표정된 - 2021년 병에 규제에 이를 신 병에(유교인이) 본규 대응 - 보일지 시장 대체를 위한 교로 모음수 구점 (Max 음수 75'0) - 조소를 가면 (제가 58년(연) - 구조 EHS 이에드로 유지(문) 문 교체형 및 백건이형) 실내가 개발 - 논설 Emercy 관년 출구스 교계 사용경에 및 보역이 함의 실내가 개발 - 논설 Emercy 관년 출구스 교계 사용경에 및 보역이 함의 스타지 관리는 기계 등 환경 - 의해도 대설계로 구구된 유가라고 있는 공장 주면(자파트 등) 수요 전해 대응 - 음악의 및 경과 지급 급성을 참 있는 공장 전에 대응 - 음악의 및 경과 지급 급성을 참 성으로 경쟁하고 있가 요란으로 유지보수 가이도 제공 - 의해도 대설계로 구된도 유가라고 있는 공장 주면(자파트 등) 수요 전해 대응 - 음악의 및 경과 POO(항정 스테이션) 지급 광화 및 세상 강화 - 의해가 대설계로 구된도 유가라고 보면 전체 - 의해 가는 모든 지금으로 실정하고 자가 진단으로 유지보수 가이도 제공 - 교육의 경소 모든을 자동으로 실정하고 자가 진단으로 유지보수 가이도 제공 - 교육의 경소 모든을 자동으로 실정하고 자가 진단으로 유지보수 가이도 제공 - 교육의 경소 모든을 자동으로 실정하고 자가 진단으로 유지보수 가이도 제공 - 스타 실교에 제공 보신 및 교육 제공 보신 및 조상에 발표 모든 에서 제공 - 스타 실교에 되는 세반으로 최소 의료 제계 그은수를 스프레이 형태로 오염등에 작용되는 지급 제가 무상으로 보면 제공 제공 제공 제공 보신 및 환경 전체로 위한 급실에 Lifting - 스타 설계 제공 보실 제공 되는 제공 모든 의료 제외 기원이 있다면 함께 함께 문 물실에 Lifting - 스타 설계 제공 보실 제공 제공 보실 의용 및 하는 요럼 에서 무심을 걸레 Lifting - 스타 설계 제공 보실 제공 제공 제공 제공 보실 인데 교육 설계 드립에 되는 그림 실계 제공 보실 대원 제공 보실 의용 드립에 Lifting - 스타 설계 제공 보실 제공 제공 제공 제공 설계 전략 전략 시공 및 기관 프리 프리 제공 시공 프리 프로 제공 제공 제공 제공 보실 및 기관 모든 관계 대체 기관 관계 및 기관 프리 프리 프리 프리 프리 프리 프로 제공 제공 제공 제공 제공 전체 기관 본 관계 및 기관 프리 관련 및 기관 프리 프리 프리 프리 프리 프리 프리 프리 프리 기관 등 관계 제공 관계 공 관계 공 관계 공 관계 공 관계 공 관계 공 관계		□ 세탁건조기 BESPOKE AI 콤보
- 사 및용과스 : 제막들이 없는 회적의 및 안인을 강화로 했을 확대 - 구조는 FM (전형 문행은 경영 및 안인을 강화로 했을 확대 - 지수를 규제 대용 : 독실은 중영요구 구국 규가별 소용 규제 확대 대용 - 지수를 상당 강화 : ~25 인외기에서 중격 단방 성당 100% 구현 - 그른 토소수 : Heat Pount 단당 시에를 최고 70℃ 토소수 구현 - 디자인 지분화 : 주가 환경에 조화를 이루는 Dark 색상 계열의 IFAN 실외기 - BESPOKE 무용에어컨 전도도 됐 - 방안에서도 작태형 없이 시원한 무용 방향 - 원보고 소용을 살펴 확인을 보았수는 32 연기 자소은 모든 - 경험에 맺게 선택하는 교회을 때나지 말을 걸린 - 디지역인 설명 경투와 디기션 반응로 보고는 시설하게 대용된 취약 및 및 - 반응없이 쉽고 안집하게 간편 안상 설치짓 - 반응없이 쉽고 안집하게 간편 안상 설치짓 - 반응없이 쉽고 안집하게 간편 안상 설치짓 - 기본부터 내는 1Way BESPOKE 무용 시스템에이킨 - 고요를 에너지 맞춤함한 강아는 무용 - 공기본부터 내는 금리까지 게에 8억계 - 상황에 맞춰 선택하는 데너지를 결강하는 시 절약으로 - 구주 EHS 십 번째(F259) 실구 코생물 - 2027년 병대 규제를 보신 교로 도출수 구선 (Max 출수 75℃) - 구소 문서용 하이드로 유닛(원고 일체형 및 벽길이형) 실내가 개발 - 등한 finerty 금리 설로 기격 시설경형 및 온임성 향상(CX 사이트 기반 데너지 점점) - 지수 EHS 하이드로 유닛(원고 일체형 및 복길이형) 실내가 개발 - 등한 finerty 금리 개발 경상으로 경쟁자 보연간 소에 전략함 15% 존량 - SIII를 관계로 구된 경기적고 있는 경통 주먹이다로 등) 수요 전형 대용 - 보이역 및 보조 200(대용 스테이어) 지수 되었 보냈지 경용 - 280억 및 보조 200(대용 스테이어) 지수 되었 보냈지 경용 - 280억 제품 4.0 교로 문화 경상으로 경쟁자 보연간 소에 전략함 15% 존량 - 최적 인정 조로 문화 대용 20일 기계 및 함께 보신 대용 - 소리적이 경소 모든 문자용으로 설정하고 자가 간단으로 유지보수 가이드 제공 - 스타를 장소의 고급은 바닥에 적할 모든지 표면 환경 보기 경소 - 그의 등이 교육이 교육을 바닥에 적할 모든지 교육으로 제공 때 계기 - 20일 보임의 결심을 시작하는 모든 대용으로 결정하고 자가 간단으로 유지보수 가이드 제공 - 그의 등이 경실의 고급은 바닥에 적할 모든지 교육으로 제공 때 계기 - 20일 보임의 결심을 이용되어 기원 보기시 시원인식 - 가를 함께 점점을 보면에 막게 되었 되었 요일 함께 를 보신에 내해되었 보신에 내해되었다. 기원한 관계 및 가게로 원리하게 청소 - 가를 바닥에 적할 모든지 스테이션 보신 함께 그 20일 발하고 취임 보신에 내해되었 보신 기계 보인 및 함께 표면 취임 보신에 내해되었다. 기원 전상이 가게 보면 일이 가게 보면 되었다고 하면 가게 보인 및 기계를 위한 보신에 내려되었다. 기원 전상이 가게 보면 일이 가게 보면 일이 가게 보면 되었다면 가게 되었다면 되었다고 하면 가게 되었다면 되었다면 되었다고 하면 가게 되었다면 되었다고 있는데 함께 보신에 보건되었다고 함께 되었다고 함께 된 되었다고 하면 가게 되었다고 함께 되었다고 하면 가게 보신에 보신에 가게 되었다고 함께 되었다고 함께 보신 및 기계를 보신 되었다면 가입을 되었다고 하면 가게 보신 및 기계를 되었다면 되었다고 하면 가게 되었다고 함께 보신 및 기계를 되었다고 하면 가게 되었다고 함께 되었다고 하면 가게 되었다고 함께 보신 및 기계를 되었다고 함께 보신 및 보안 및 함께 보신 및 기계를 되었다고 함께 보신 및 기계를 보신 및 기계를 되었다고 있다고 하면 기계를 보신 및 기계를 되었다고 있다고 하면 기계를 되었다고 되었다고 있다고 하는데 기계를 되었다고 있다고 되었다고 있다고 하면 기계를 되었다고 있다고 되었다고 되었다고 되었다고 되었다고 있다고 되었다고 있다고 되었다고 있다고 되었다고		- ONE 솔루션 : 세탁물 이동없이 편리하게 하나로 세탁건조
□ 구조 타당 신형 불깻품 작용 및 라인인 강화로 제속 부대 - 지소용 규제 대용 : 독일론 중심으로 구주 국가를 소용 구제 확대 대용 - 지소용 경화 : 구조 보이의 기에서 집의 단반 성을 100% 구현 - 고요오 결출수 : Heal Pump 단일 사이를 최고 70℃ 토옥수 구현 - 디지인 개병화 : 주가 환경에 조화를 이용는 Dark 색실 개명의 1FAN 실위기 □ BESPOKE 무중에어컨 원도무팟 - 방인에서도 취반을 없이 사용한 무통 병황 - 권용교 소용은 들어 속면을 도약도 안 성 자소용 모드 - 성화에 맞춰 선택하는 교육을 에너지 않을 걸린 - 대상인 병상 성능을 대기권 병으로 골고두 시원하게 대성한 명약 당황 - 권용교 소용은 들어 속면을 도약도 안 성 자소용 모드 - 성화에 맞춰 선택하는 교육을 에너지 않을 걸린 - 대상인에 공간의 무드를 만들어나는 무용된 건경조형 맺지 라이당 - 교육을 에너지 맞춤한 경에도 무통 - 교기골부터 내무 권경자기계에 하면제 - 수성에 맞춰 신택에 에너지를 설심하는 시 설탁모드 □ 구조 단위 상 병에((F290) 실규 보생됨 - 2027년 병에 규제에 대급 시 상 병에(620) 실무건 대용 - 보설보 시한 대체를 위한 교육 등수 구현 (Max 출수 75년) - 자소용 구현 (최저 3546년A) - 가는 단위 상대를 가려가 설심하는 교육에서 나 단계소 상대 전략이 당하는 결절 - 등에는 대상 전략 전략 구분 경우으로 관심하고 반대한 이너지 결심 - 시 Energy 및 전계 최근 경상을 기원하고 있는 등등 주택(이료를 등) 수요 변형 다용 - 보험 및 종조 FOO(항송 스타이션) 고 한쪽 및 병사이 간행 - 등의 및 종조 FOO(항송 스타이션) 고 한쪽 및 병사이 간행 - 관계 기계교 교육으로 취임이 제공 현송 - 최적의 청소 모드를 자용으로 설립하고 자가 진단으로 유지보수 가이트 제공 - 교육에 기계교 교육으로 계약으로 취임에 관리 보실 - 실적의 경소 모드를 자용으로 실험하고 자가 진단으로 유지보수 가이트 제공 - 교육에 되었고 교육수를 바다이 적급 보고 교육으로 제집 관리시 - 교육수를 스타이면 함께로 으움으면 작업하게 된 물리에 관리에 - 교육수를 스타이면 함께로 요움으면 작업 상사 사용 - 추가 배터리 없이 1.51kg의 가내로 물길레 본리시 - 교육수를 스타이면 함께로 요움을 제 문제를 관리를 받아 기점 소설을 가면 하게 가능한 기계를 가는 모델링 및 하면 함께를 취임 기계 결소 등록 가능한 기계를 가능한 기계를 가는 일이 가를 들어 가를 취임 기계를 구하여 기점 수 그는 일 기계로 가능한 기를 가는 되었다면 가를 위한 공립레 Lifting - 스템 설계자 가능한 기관에 작성을 되었다면 되었다면 위한 공립레 Lifting - 스템 설계자 가능한 기관에 작업을 되었다면 되었다면 위한 공립레 Lifting - 스템 설계자 가능한 기관에 작업을 되었다면 되었다면 되었다면 위한 공립레 Lifting - 스템 설계자 가능한 기관에 작업을 되었다면 되었다면 되었다면 위한 공립레 Lifting - 스템 설계자 가능한 기관에 작업을 되었다면 되었다면 되었다면 되었다면 되었다면 되었다면 되었다면 되었다면		- AI 홈 : 터치화면 및 음성인식으로 간편하게 세탁건조
- 저소음 규제 대응 : 독일음 중심으로 구주 국가별 소용 규제 확대 대응 - 저온 성능 경화 : ~25℃외기에서 심격 난반 성능 100% 구현 - 교본 토수는 Host Pump 업명 사이를 최고 70℃ 토수 구편 - 대자인 차결화 : 주가 참견에 조용를 이루는 Dark 색성 계열의 IFAN 실외기 □ BESPOKE 목욕에어컨 필도무편 - 병안에서도 작성할 없이 사원한 무료 냉방 - 신통과 소음을 같이 역약을 모였는 100 대자 작용 경쟁 - 변경형 방향 상공과 더 기간 편으로 공고 시원에게 대용량 공학 당황 - 변경형 방향 상공과 더 기간 편으로 공고 시원에게 대용량 공학 당황 - 변경형 방향 상공과 더 기간 편으로 공고 시원에게 대용량 공학 당황 - 변경이 없고 안전하게 간편 안성 설계짓 □ Infinite Line 11Way BESPOKE 약품 시스템에어원 (~2024.04.) - 자연소원에 공업 무료 단증에 대표 유료 경쟁 및제 라이영 - 고용을 어나지 양료결은 것으로 어나지 모음 - 공기일부터 내부 관리까지 케이 6만개 - 상용에 맞춰 선택해 에너지를 즐겁하는 시 점역모든 □ 구구 EHS 선생에 에너지를 즐겁하는 시 점역모든 □ 구구 EHS 선생에 에너지를 즐겁하는 시 점역모든 □ 구구 EHS 선생에 에너지를 요한 경쟁 보안스 세계 기계 및 구성을 구현 (제품 경쟁 10명) 실내기 계명 - 등향 Emergy 공리 소무선/2과 사용기항 및 런리(함) 상태(자연구) 선배 전쟁 10명 - 부장 Emergy 공리 소무선/2과 사용기항 및 런리(항상) 상대자 MDE 기간 에너지 점임) - 시 Finergy 및 함께 최고 급명을 성능인의 경쟁서 보안스 소네 전쟁 15% 경압 - 위에 되는 관계 공개하고 있는 경향 구면(예퍼보통) 수요 전형 대용 □ BESPOKE 제트 시 청군기(지급 공업적 2080) - 출입적 일 점조 POO(점점 소년)에서 가극 경향 및 에너영 경상 - 조리적 일 점조 POO(점점 소년)에서 가극 경향 및 에너영 경상 - 조리적 일 점조 POO(점점 소년)에서 가극 경향 및 에너영 경상 - 교육적 의 점소 모든들 지용으로 설명하고 제공한 소년 - 최적의 점소 모든들 지용으로 설명하고 제공한 소년 - 최적의 점소 모든들 지용으로 설명하고 제공한 소년 - 최적의 점소 모든들 지용으로 설명하고 제공한 보안 시기 구입적으로 제공한 제공한 □ 스틱 정소기 제를 4.0 고문 세폭 브런시 - 의존하는 신료적 형태로 작업하다는 물래 브리시 - 의존하는 신료적 의명에 함께 모든데 시간 급기적으로 때문 때 제가 - 의존 10명의 집단 점점 비대에 작업 문서, 효과적으로 때문 때 제가 - 의존 10명의 집단 점점 비대에 가를 본게 무게로 편리하게 경소 □ 전략형 건습식 모든 경상시 기단 BESPOKE (시 스템 공모 - 건식 독경 점수에 다른 인식 (시 사용) 전략 전상 시와 무기 배터를 집합 이로 가를 받은 점점 물리에 달 개통 인상 함께 등 점점 기간 등 점점 그런데 되었다면 되었다면 되었다면 되었다면 되었다면 되었다면 되었다면 되었다면		- AI 맞춤코스 : 세탁물에 맞는 최적의 코스로 작동
- 지운 성능 강 점: -25℃의기에서 정격 난방 성능 100% 구현 - 교은 토추수: Heat Pump 단일 사이를 최고 70℃ 토추수 구현 - 대자인 차명화: 주가 용점에 소출을 이루는 Dark 색상 개의의 IFAN 설別기 □ BESPOKE 무료에어한 원도주및 - 발원에서도 제대함 없이 사원된 무용 남방 - 전등과 소용을 걸여 숙명을 도와주는 02 리 지소용 모드 - 상황에 막히 선택하는 교효로 에너지 약을 살한 - 더 각확한 남병 성하고 다면 한성 설계것 - 더 각확한 남병 성하고 다면 한성 설계것 - 비름없이 참고 안전하게 간면 안성 설계것 - 비름없이 참고 안전하게 간면 안성 설계것 - 사명소회계 공간의 무드를 만들어나는 물문을 간성조성 엣지 라이팅 - 고호 에너지 양출점전 되어도 무용 - 광기본부터 내는 구리까지 게 어망되어 - 상황에 맞히 선택에 대대로 결심하는 시 철역모드 □ 구후 타다 전 남에(1209) 선규 표명용 - 2021년 병에 규제에 따른 전 남에(1209) 소구된 때문 - 발일시 사장 대체를 위한 고등 목소수 구현 (Max 출수 75℃) - 지소을 구현 성계지 350만(시) □ 구후 타당 하나도로 유닛(됨을 설계성 및 백결이정) 실내가 개발 - 물량 Enerty 관리 소문소(기격 사용점함 및 백결이정) 실내가 개발 - 물량 Enerty 관리 소문소(기격 사용점함 및 변경상 향상(12~MDE 기반 에너지 점점) - 시 Energy 및 업계 최고 급원료을 성능으로 생생시 바 연간 소비 전략인 15% 설심 - 위에 대체 경우 구에 본가하고 있는 구를 주로 주(19)파트 위〉수요 전점 대용 □ 문화 양소 기체를 시 성소기(최고 음악적 280W) - 출력 및 병조 POO(성상 소타이선) 기속 강화 및 M/S 강화 - 280W 세계성고 음악적 구현으로 강적하고 까가 진단으로 유지보수 가이도 제공 □ 스와 경소 모드를 자용으로 설정하고 짜가 진단으로 유지보수 가이도 제공 □ 스와 경소 모드를 자용으로 설정하고 짜가 진단으로 유지보수 가이도 제공 □ 스와 경소 모드를 자용으로 설정하고 자가 진단으로 유지보수 가이도 제공 □ 스와 경소 모드를 대용적 점심 사이를 공의 발견시 - 역 50℃ 이상의 교육소를 바탕에 작업보이지는 공격에 보려시 - 역 50℃ 이상의 교육소를 바탕에 작업보이지는 공격에 무게로 편리하게 청소 □ 관리와 검실적 모든데 함께로 인접을 가면 모든데 무게로 편리하게 청소 □ 관리와 검실적 모든데 참결 모든데 가장 인조의 병기로 위한 물관례 Uffling - 소림 실소까지 가능한 관계점 등에 가장 전용을 보지를 위한 물관례 Uffling - 소림 실소까지 가능한 관계점 등에 가장 전성으로 대한 경험 모든데 가장 전상으로 가장 전상을 받게 된 위한 물관례 Uffling - 소림 실소까지 가능한 관계점 등에 가장 전상을 받게 된 위한 물관례 Uffling - 소림 실소까지 가능한 관계점 등에 가장 전성으로 대한 경험 모든데 가장 전성으로 기상되었다.		□ 구주 EHS 신형 플랫폼 적용 및 라인업 강화로 매출 확대
- 교은 토종수 : Heat Pump 단인 사이를 최고 70℃ 토홍수 구현 - 디자인 지발의 : 주거 환경에 조회를 이루는 Dark 색상 개설의 1FAN 설別기 □ BESPOKE 부분에에서 한민수 및 - 방안에서도 집반당 없이 시험한 무용 방항 - 신청과 소용은 실어 숙합을 모셔수는 32 45 시소용 모드 - 상용에 맞춰 선택하는 고요를 해내지 맛을 끌면 - 더 강력한 방향 성들과 더 커진 편으로 불고구 시원에게 대용한 간적 방향 - 반분없이 즐긴 전환하게 간편 안상 설치가 에어컨 (~2024.04.) □ Infinite Line 1 Way BESPOKE 무용 시스템에어컨 (~2024.04.) □ 고요를 에너지 맛을흔진 없이는 무용 - 공기본부터 내가 갈리까지 케어 8년계 - 선활에 맞춰 전략에 에너지를 결강하는 시 흡약모든 □ 구주 EHS 산 병째(R290) 신과 흔셋을 - 2027년 병폐 가제에 파운 선생(R290) 실구전 대용 - 보일러 시를 대체를 위한 교은 토호수 구현 (Max 호수 75℃) - 자소를 구현 (설계 3346(A)) □ 구주 EHS 상이드로 유넷(명기 일체형 및 백결이형) 실내기 개발 - 통한 Energy 관리 솔루션/과식 사용경험 및 편설성 함상(CX-MDE 기반 에너지 즐겁) - 시 Energy 및 경계 최고 급명증을 성능으로 경쟁시 바 연간 소비 결약한 15% 결경 - Silm Fit 실제로 구하면 경기에 있는 골통 주역(이파트 등) 수요 선접 대용 □ BESPOKE 제도 시설 소기(제고 출임적 280W) - 음악 및 원조 FOD(환경 스테이션) 지속 각하로 및 M/S 간회 - 280W 세계되고 급임로 구간으로 생명하고 제가 진단으로 유지보수 가이드 제공 □ 스템 청소기 제도 시호 기반으로 생명하고 제가 진단으로 유지보수 가이드 제공 □ 스템 청소기 제도 시호 기반으로 생명하고 제가 진단으로 유지보수 가이드 제공 □ 스템 청소기 제도 시호 기반으로 생명하고 제가 진단으로 유지보수 가이드 제공 □ 스턴 청소기 제도 시호 기반으로 생명하고 제가 진단으로 유지보수 가이드 제공 □ 스템 청소 기 제도 시호 기반으로 생명하고 제가 전단으로 유지보수 가이드 제공 □ 스트 및 함께 Fit 설계를 가격으로 생명하고 제가 전단으로 유지보수 가이드 제공 □ 스트 및 설계 전체 등 기반으로 생명하고 제가 전단으로 유지보수 가이드 제공 □ 스트 및 설계 전체 등 기반으로 생명하고 제가 전단으로 유지보수 가이드 제공 □ 스트 및 설계 전체 등 기반으로 원래 후에 보려시 - 역 50℃ 이상의 교육수를 바닥에 작품 전체 , 요목적으로 제를 때 제거 - 20초 내외의 함은 메일 시간, 하나의 배터리로 최소 30분 이상 사용 - 추가 배터리 없이 1.51 kg의 가벼운 물리에 무제로 편리하게 점소 □ 연구한 감속에 무게를 함께 되었다면서 무실 소비를 되었다면서 무실 경계 무게를 관계 및 기량 및 요립 발기에 용한 물리에 Lifting - 스템 실관까지 가능한 관계를 관계 지원 했다면서 등 기한 및 요립 발기에 무슨 물리에 보려시 - 기료 및 생물시에 바다 의 등 보려서 및 기량 및 요립 발기에 무실 물리에 Lifting - 스템 실관까지 가능한 함께 등 물리에 모셔츠 기량 및 요립 발기에 무실 보건에 되었다면서 무실 소비를 가능한 함께 등 물리에 보게 되었다면서 무실 소비를 보다면서 무실 보기를 보려 되었다면서 보다 등 말리 보다에 되었다면서 보다 등 말리 보다 되었다면서 무실 관계 및 환경 소비를 받게 되었다면서 무실 관계 및 환경 소비를 보다 되었다면서 무실 보기를 받게 되었다면서 무실 관계 및 환경 소비를 받게 되었다면서 무실 관계 및 환경 소비를 보려 되었다면서 무실 관계 및 환경 소비를 보려 되었다면서 무실 관계 및 환경 소비를 보려 되었다면서 무실 관계 및 환경 소비를 받게 되었다면서 무실 관계 및 기계 및		- 저소음 규제 대응 : 독일을 중심으로 구주 국가별 소음 규제 확대 대응
□ PESPOKE 무중에어컨 윈도우묏 □ 명단에서도 심대함 없이 시청한 무용 냉방 □ 전등과 소용을 즐어 숙면을 단우주는 32 dB 지스용 모드 □ 상황에 맞춰 선택하는 교육을 해나지 않을 결전 □ 다 의원한 냉방 정보과 더 커진 편으로 고교두 시설에게 대용한 경력 냉방 □ 반들었어 참고 안전하게 간편 안심 설치것 □ Infinite Line 1 Way PESPOKE 무중 시스템에어컨 □ 지원스템에 갖춰 선택하는 무용 □ 기정부터 너무 기정에 마르는 경험에 지원 현약을 먼지 과어병 □ 고요을 해너지 맞춤면적 와이트 무용 □ 공기정부터 너무 관리자에게 제어 8년에 □ 상황에 맞춰 선택해 에너지를 설감하는 시 설약모드 □ 구주 타당 신 냉배(P290) 신규 불맛함 □ 2027년 네에 규제에 미른 신 냉배(P290) 슬픈션 대용 □ 보임시장 대체를 위한 교로 분하구 구인 (Max 출수 75℃) □ 자용 구인 (3月 정공에서) □ 구주 타당 하이트로 유팅(테크 일제형 및 백원이형) 실내기 개발 □ 봉한 Energy 관리 속무선/교객 사용생형 및 관위적 환성(CX-MDE 기반 에너지 열전) □ 시 Energy 및 임계 최고 급당으로 성능으로 광병사 또 전한 소비 전력한 15% 현경 □ BESPOKE 제로 시청 공기(체교 음악적 280%) □ 용당 POL(원형 스테이션) 지속 경학 및 M/S 강화 □ 280% 세계최고 음악된 구현으로 강력하고 제품인 경소 □ 최적의 취소 모든들 자동으로 설정하고 자가 전단으로 유지보수 가이트 제공 □ 스타스 전기 제트 시 0. 전문 세계 보러시 □ 고요수를 스파리에 형태로 양함을 제집된시하는 불결에 뜨려지 □ 수의 전기 제로 시 0. 전문 세계 보러시 □ 구조수를 스파리에 형태로 양함을 제집된지하는 불결에 보려시 □ 수의 전급 지원 있어 1.51kg의 가비용 즐겁게 무게로 환리하게 취소 □ 한국와 건습식 로봇정소기 BESPOKE 시 스템 골보 □ 건습식 독립 정소/시 바다 면식 (시 사용면식 □ 자동 작별 가능한 회전형 즐겁게 모든 점점 이용 □ 전기 모든 집리에 함된 안함 즐겁게 막게로 환리하게 취소 □ 한국와 건습식 토봇정소기 BESPOKE 시 스템 골보 □ 건습식 독립 정소/시 바다 면식 (시 사용면식 □ 자동 작별 가능한 회전형 즐겁게 및 가켓 오염 병지를 위한 물길레 Lifting □ 스템 설치가 가능한 결레 지용 생각 건조 경쟁 소태이션		- 저온 성능 강화 : -25℃외기에서 정격 난방 성능 100% 구현
□ BESPOKE 무용에어컨 원도무편 - 방안에서도 신대당 없이 시원한 무용 당황 - 전환교 소름을 들어 속면을 도성주는 32 de 저소를 모드 - 살황에 맞춰 선택하는 고등을 어내지 맞춤 환경 - 면 강력한 당황 성공과 더 커진 팬으로 급고로 시원하게 대용한 강력 당황 - 반름없어 성고 안전하게 간편 안성 설치한 이에이킨 (~2024.04.) - 자연스답게 골간의 무드를 만들어내는 본문한 간접조형 맺지 라이당 - 고요를 에너지 막춤질한 와이도 무용 - 공기정부터 내부 관리까지 계여 8년개 - 산황에 맞춰 선택해 에너지를 질강하는 시 혈약모드 - 구주 EHS 신 냉해(R290) 신규 플랫폼 - 2027년 냄해 규제에 따른 신 냉해(R290) 공부선 마용 - 보일권 시장 대체를 위한 교로 통출수 구현 (Max 출수 75℃) - 자소를 구현 (설치 8848(A)) □ 구주 EHS 하이도로 유난(웨고 일체형 및 편집이형) 실내가 개발 - 물함 Energy 및 입계 최고 금당효를 성능으로 공해서 比 한간 소비 전략당 15% 절감 - 시 Energy 및 입계 최고 금당효를 성능으로 공해서 比 한간 소비 전략당 15% 절감 - 의배타보세계로 구하는 등기에 있는 공통 주변(대표를) 수요 선형 대용 □ BESPOKE 제트 시 청소가(최고 흡입적 280W) - 출연적 및 원조 POO(청정 스테이션) 지수 상화 및 M/S 강화 - 280W 세계최고 급입적 구연으로 실현하고 지가 전단으로 유지보수 가이트 제공 의적 청소 모드를 자동으로 설정하고 지가 전단으로 유지보수 가이트 제공 - 지원수를 스트레이 형태로 오랫폼에 직접된사하는 불골레 무리시 - 지원수를 스트레이 형태로 오랫폼에 직접된사하는 불골레 무리시 - 의용 12에 함께로 오랫폼에 직접된사하는 불골레 무게로 환경하게 했습 기속 - 구가 베트리 없이 1.51kg의 가비로 골길래 무게로 환경하게 정소 - 한국량 건설식 로봇 청소가 BESPOKE 시 스템 점보 - 건설식 등한 청소에 바로 인식 (시 사용인식 - 자동 즉된 가능한 회전형 물길레 및 카펫 오염 병자를 위한 물길레 Lifting - 스템 성급개자 가능한 회전형 물길레 및 카펫 오염 병자를 위한 물길레 Lifting - 스템 성급개자 가능한 회례 자동 체육/건조 정정 스테이션 전자우드 의 자가 후드 프리미당 간단한 휴대		- 고온 토출수 : Heat Pump 단일 사이클 최고 70℃ 토출수 구현
- 방안에서도 작바람 없이 시원한 무용 남방 - 전통과 소용을 들어 숙변을 도망주는 32 dB 제소용 및도 - 상황에 망취 선택하는 교육 에너지 말충 최점 - 더 강화한 방향 성하고 더 커진 편으로 골고구 시원하게 대용한 강역 방향 - 민름없이 십고 만전하게 간편 만실 설치한 (~2024.04.) - 기례(Hittle Line 1 Way BESPOKE 무용 시스템에어컨 (~2024.04.) - 자연스함게 공간의 무드를 만들어내는 용안한 간접조형 엿지 라이팅 - 교육 에너지 맞춤점한 와이드 무용 - 공기집부터 내부 관리까지 케이 8년세 - 상황에 맞춰 실택해 에너디지를 실각하는 시 절약모드 - 구주 EHS 신 냉매(R290) 실규 플랫폼 - 2022년 냉매 규제에 따른 신 냉매(R290) 출유선 대응 - 보일러 시장 대체를 위한 교본 동축수 구현 (Max 축수 75℃) - 자소용 구현 (최지 35dB(A)) - 구주 EHS 하이드로 유밋(면크 일제형 및 백결이항) 실내기 개발 - 불한 Energy 및 업계 최고 급용함을 생동으로 원장시 또 연간 소비 건축당 15% 점점 - 최대 Energy 및 업계 최고 급용함을 생동으로 원장시 또 연간 소비 건축당 15% 점점 - 최대 함 설계로 구주에 음가하고 있는 결동 주인(미크 돌) 수요 선형 대용 - 문용무OKE 제도 시 경소기(최고 출입적 280W) - 음악을 및 원조 POD(성성 스테이션) 지속 강화 및 M/S 강화 - 280W 세계최고 급인된 구현으로 관련하고 재가한 장소 - 최적의 경소 모드를 자동으로 관련하고 제가한 진단으로 유지보수 가이드 제공 - 그소수를 스크에 형대로 오랫폼에 직접분시하는 물길에 브리시 - 의소수를 스크에 대한대로 오랫폼에 직접분시하는 물길에 브리시 - 의소수를 스크에 양대로 오랫폼에 직접분시하는 물길에 브리시 - 의소수를 스크에 대한대로 오랫폼에 직접분시하는 물길에 브리시 - 의소수를 스크에 대한대로 오랫폼에 직접분시하는 물길에 브리시 - 의소수를 스크에 양대로 오랫폼에 대한대로 최소 30분 이상 사용 - 추가 배터리 없이 1.51kg의 가대로 물길래 무게로 관리하게 청소 - 한국량 건축식 로봇 청소기 BESPOKE AI 스팅 펌보 - 건축식 독립 점소 (AI 바닥 인식 /AI 사용인식 - 자동 작용 가능한 회전형 물길레 및 카켓 오염 병지를 위한 물길레 Lifting - 스템 설売까지 기능한 길레 자를 세계/건조 함께 스테이션 전자후드 □ 자가 후드 프리미의 전인의 취대 표체계/건조 함께 스테이션		- 디자인 차별화 : 주거 환경에 조화를 이루는 Dark 색상 계열의 1FAN 실외기
- 전통과 소점을 높여 숙면을 토와주는 32 dB 자소점 모드 - 상황에 맞춰 선택하는 고효율 에너지 맞춤 결전 - 더 강역한 냉방 성능과 더 커진 팬으로 골고로 시원에게 대용당 강역 냉방 - 벤듬없이 쉽고 안전하게 간만 안성 설치짓 Infinite Line 1 tway BESPOKE 우품 시스템에어컨 (~2024.04.) - 자연스템계 공간의 무드를 만들어내는 운전한 간접조명 멋지 라이팅 - 고효율 에너지 맞춤절한 와이드 무용 - 공기실부터 내부 관리까지 케어 있단제 - 상황에 맞춰 선택해 에너지를 절감하는 AI 절약모드 구주 EHS 신 냉매(R290) 실규 플랫폼 - 2027년 병태 자명에 따른 신 냉매(R290) 후루션 대용 - 보일러 시장 대체를 위한 고호 토소수 구당 (Max 축수 75℃) - 자소읍 구면 (청재 35dB(A)) 구주 EHS 하이드로 유닛(명그 일체형 및 백급이형) 실내기 개발 - 불한 Energy 관리 축무선/고객 사용점을 및 편의성 함상(CX~MDE 기반 에너지 점점) - AI Energy 및 함계 최고 급략호를 성능으로 경쟁시 및 연간 소비 전력당 15% 점감 - SIIm Fil 선계로 구주내 증가하고 있는 공동 주택(아파트 등) 수요 선정 대용 EBSPOKE 제도 AI 청소기(최고 출연력 280W) - 음입력 및 등조 POD(경험 소비에는) 지속 강화 및 M/S 강화 - 280W 세계최고 출임적 구현으로 강력하고 제맛한 청소 - 최적의 청소 모드를 자동으로 설정하고 자가 전단으로 유지보수 가이드 제공 스틱 청소기 제트 4.0 고운 세력 브러시 - 고운수를 스트레이 형태로 오염물에 집집분사하는 물란데 브러시 - 약 50C 이상의 교육수를 바닥에 작점 분사, 효과적으로 찌든 때 제거 - 20초 내외의 장은 예열 AI-21, 하나의 배터리로 최소 30만 이성 사용 - 추가 배타리 없이 1.51 kg의 기 대원 물란레 무개로 관리하게 청소 만국랑 건습식 독관 청소/AI 바다 인식 / AI 사용인식 - 자용 확할 가능한 결전 전형 물란레 및 카펫 오염 방지를 위한 물건레 Lifting - 스팀 살관까지 가능한 칼레 진동 세척/건조 청청 스테이션		□ BESPOKE 무풍에어컨 윈도우핏
- 상황에 맞춰 선택하는 고충용 에너지 맞충 점인 - 더 강력한 냉병 성들과 더 커진 팬으로 공고로 시원하게 대용량 관력 냉병 - 빈름없이 최고 안전하게 간편 안십 설치킷 에어컨 (~2024.04.) - 기계(Infinite Line TWay BESPOKE 유용 시스템에어컨 (~2024.04.) - 지연소하게 공건의 무도를 만하내는 본론한 간접조형 멋지 라이팅 - 고효용 에너지 맞충질전 와이드 유용 - 공기절부터 내부 관리까지 케어 8단계 - 상황에 맞춰 선택해 에너지를 절감하는 시 절약모드 - 구주 EHS 신 냉매(R290) 신규 플랫폼 - 2027년 냉배 규제에 따른 신 냉매(R290) 슬루션 대용 - 보임시 시장 대체를 위한 고운 교육수 건전 (Max 출수 75℃) - 저소음 구현 (제재 3558(A)) - 구주 EHS 하이트로 유닛(탱크 일체형 및 백일이형) 실내기 개발 - 높한 Energy 관리 호현선고적 시용성형 및 편의형 환성(CX~MDE 기반 에너지 점인) - 시 Energy 및 업계 최고 급명효용 성능으로 경쟁시 1년 전간 소비 전력당 15% 점경 - 의해 Pit 실계로 구주내 평가하고 있는 공용 주맥(아파트 등) 수요 선점 대용 - 용한 ENERONE 제도 시 청소기(최고 집원적 280%) - 음입력 및 결조 POT(정칭 스테이션) 지속 강화 및 M/S 강화 - 280% 세계최고 음입적 구원으로 감약하고 패원한 참소 - 최적의 청소 모드를 자동으로 설정하고 자가 진단으로 유지보수 가이드 제공 - 스틱 청소기 제트 4.0 고운 세척 보건시 - 고은수를 소프레이 현대로 오염물에 직접분사하는 물길레 보건시 - 악 50℃ 이상의 교육수를 바닥에 직접 분사, 효과적으로 찌른 때 제거 - 20초 내외의 포함 예임 시간, 하나의 배터리로 최소 30분 이상 사용 - 추가 배타리 없이 1.51 kg의 가벼운 발길레 무개로 편리하게 청소 - 한국항 건습식 포봇청소기 BESPOKE 시 스템 경보 기본 플길레 나타하여 - 건설식 독집 청소(A) 바닥 인식 (A) 사물인식 - 지용 작을 가능한 회전형 물길레 및 카켓 오염 방지를 위한 물길레 Lifting - 스템 실관까지 가능한 결레 제동 세곡/건조 점점 스테이션 - 레지우드		- 방안에서도 직바람 없이 시원한 무풍 냉방
- 상황에 맞춰 선택하는 고충용 에너지 맞충 점인 - 더 강력한 냉병 성들과 더 커진 팬으로 공고로 시원하게 대용량 관력 냉병 - 빈름없이 최고 안전하게 간편 안십 설치킷 에어컨 (~2024.04.) - 기계(Infinite Line TWay BESPOKE 유용 시스템에어컨 (~2024.04.) - 지연소하게 공건의 무도를 만하내는 본론한 간접조형 멋지 라이팅 - 고효용 에너지 맞충질전 와이드 유용 - 공기절부터 내부 관리까지 케어 8단계 - 상황에 맞춰 선택해 에너지를 절감하는 시 절약모드 - 구주 EHS 신 냉매(R290) 신규 플랫폼 - 2027년 냉배 규제에 따른 신 냉매(R290) 슬루션 대용 - 보임시 시장 대체를 위한 고운 교육수 건전 (Max 출수 75℃) - 저소음 구현 (제재 3558(A)) - 구주 EHS 하이트로 유닛(탱크 일체형 및 백일이형) 실내기 개발 - 높한 Energy 관리 호현선고적 시용성형 및 편의형 환성(CX~MDE 기반 에너지 점인) - 시 Energy 및 업계 최고 급명효용 성능으로 경쟁시 1년 전간 소비 전력당 15% 점경 - 의해 Pit 실계로 구주내 평가하고 있는 공용 주맥(아파트 등) 수요 선점 대용 - 용한 ENERONE 제도 시 청소기(최고 집원적 280%) - 음입력 및 결조 POT(정칭 스테이션) 지속 강화 및 M/S 강화 - 280% 세계최고 음입적 구원으로 감약하고 패원한 참소 - 최적의 청소 모드를 자동으로 설정하고 자가 진단으로 유지보수 가이드 제공 - 스틱 청소기 제트 4.0 고운 세척 보건시 - 고은수를 소프레이 현대로 오염물에 직접분사하는 물길레 보건시 - 악 50℃ 이상의 교육수를 바닥에 직접 분사, 효과적으로 찌른 때 제거 - 20초 내외의 포함 예임 시간, 하나의 배터리로 최소 30분 이상 사용 - 추가 배타리 없이 1.51 kg의 가벼운 발길레 무개로 편리하게 청소 - 한국항 건습식 포봇청소기 BESPOKE 시 스템 경보 기본 플길레 나타하여 - 건설식 독집 청소(A) 바닥 인식 (A) 사물인식 - 지용 작을 가능한 회전형 물길레 및 카켓 오염 방지를 위한 물길레 Lifting - 스템 실관까지 가능한 결레 제동 세곡/건조 점점 스테이션 - 레지우드		- 진동과 소음을 줄여 숙면을 도와주는 32 dB 저소음 모드
- 더 강역된 냉방 상황과 더 커진 팬으로 골고두 시원하게 대용한 강역 냉방 - 번름없이 쉽고 안전하게 간편 안삼 설치킷 □ Infinite Line 1Way BESPOKE 무용 시스템에이킨 (~2024.04.) - 자연소함계 공간의 우드를 안들어내는 운은한 간집조명 멋지 라이팅 - 고효를 에너지 맞춤절한 맛이드 무용 - 공기질부터 내부 관리까지 케어 8단계 - 상황에 맞춰 선택해 에너지를 절강하는 AI 절약모드 □ 구추 EHS 전 배매 (R290) 신규 플랫폼 - 2027년 병해 규제에 따른 선 병해(R290) 함부선 대응 - 보일러 시장 대체를 위한 고운 등을수 구현 (Max 울수 75℃) - 지소용 구현 (최지 35세8(A)) □ 구주 EHS 하이드로 유닷(명크 일체형 및 백급이형) 실내기 개발 - 통합 Energy 관리 후부선(고객 사용경험 및 편의상 향상(CX~MOE 기반 에너지 절전) - AI Energy 및 업계 최고 급량효용 성능으로 관령사 반 연간 소비 전략점 15% 증강 - SIM 파티 설계로 구주내 등가하고 있는 공동 주택(아파트 등) 수요 선정 대응 □ BESPOKE 제는 AI 청소기(최고 출발적 280W) - 출입력 및 현호 POD(청정 스테이선) 지속 경화 및 M/S 강화 - 280W 세계최고 출발적 구원으로 강적하고 재가 진단으로 유지보수 가이드 제공 □ 스틱 청소기 제트 4.0 고운 세척 달러시 - 국은수를 스트레이 절면로 오염들에 작원보사하는 물길에 발리시 - 약 50℃ 이상의 고문수를 바닥에 작업 문사, 효과적으로 찌든 때 제거 - 20초 내외의 활은 여일 시간, 하나의 배터리로 최소 30분 이상 사용 - 추가 배터리 없이 1.51kg의 가벼운 물길에 무게로 판리하게 청소 □ 한국항 건설적 로봇청소기 BESPOKE AI 스템 콤보 - 건설석 독립 청소/AI 바닥 인식 /AI 사물인식 - 자동 착탈 가능한 회전형 물길레 및 카벳 오염 방지를 위한 물길레 Lifting - 스림 살라까지 가능한 길레 자용 세척/건조 현정 스테이션		
● 반동없이 쉽고 안전하게 간편 안심 설치킷 □ Infinite Line 1Way BESPOKE 무중 시스템에어컨 (~2024.04.) □ Infinite Line 1Way BESPOKE 무중 시스템에어컨 □ 교육을 에너지 맞춤절한 없이드 무용 □ 공기원부터 내부 관리까지 케이 용단계 □ 상황에 맞춰 선택해 에너지를 절감하는 시 절막모드 □ 구주 EHS 신 냉매(R290) 신규 플랫폼 □ 2027년 냉해 규제에 따른 선 냉매(R290) 솔루션 대응 □ 보임러 사업 대체를 위한 교로 토출수 구현 (Max 출수 75°C) □ 자소용 구현 (원지 35dB(A)) □ 구주 EHS 하이드로 유넛(탱크 일제형 및 백결이형) 실내기 개발 □ 동합 Energy 관리 숙우선(고역 사용관형 및 발리성 향상(CX-MDE 기반 에너지 절면) □ 시 Energy 및 함계 최고 광당효율 성당으로 광맹사 It 연간 소비 전략당 15% 결광 □ Sim Fit 설계로 구주내 증가하고 있는 공동 주택(아파트 등) 수요 선정 대용 □ BESPOKE 제트 시 청소기(최고 음업역 280W) □ 음업적 및 점조 POD(함절 스테이션) 지속 강화 및 M/S 강화 □ 280W 세계최고 음업역 구현으로 강력하고 재끗한 청소 □ 최적의 청소 모드를 자동으로 설심하고 자가 진단으로 유지보수 가이드 제공 □ 스틱 청소기 때도 4.0 교문 세척 난러시 □ 고우수를 스프레이 형태로 오염물에 직접된사하는 물건에 브러시 □ 고우수를 스프레이 형태로 오염물에 직접된사하는 물건에 브러시 □ 소약 등이 이상의 교문수를 바닥에 직접 본사, 효과적으로 찌든 때 제기 □ 20초 내외의 젊은 예열 시간, 하나의 배터리로 최소 30분 이상 사용 □ 추가 배터리 없이 1.51kg의 가벼운 불결레 무개로 관리하게 청소 □ 한국항 건습식 로봇청소기 BESPOKE 시 스템 공보 □ 건습식 특립 청소/시 바닥 인식 /시 사물인식 □ 자동 착탈 가능한 화전형 물걸레 및 카펫 오염 방지를 위한 물걸레 Lifting □ 스템 살리까지 가능한 결계 지용 세체/건조 청장 스테이션		- 더 강력한 냉방 성능과 더 커진 팬으로 골고루 시원하게 대용량 강력 냉방
에어컨 (-2024.04.) □ Infinite Line 1Way BESPOKE 무용 시스템에어컨 (-2024.04.) □ 자연스럽게 공간의 무드를 만들어내는 은은한 간접조명 맺지 라이팅 □ 교육표 에너지 및출절진 와이드 무품 □ 공기질부터 내부 관리까지 케어 8단계 □ 상황에 맞춰 선택해 에너지를 절감하는 Al 절약모드 □ 구주 EHS 신 뱅배(P290) 신규 플랫폼 □ 2027년 냉배 규제에 따른 신 냉배(P290) 솔루션 대응 □ 보일러 시장 대제를 위한 고본 토축수 구현 (Max 축수 75℃) □ 자소용 구현 (최저 355dB(A)) □ 구주 EHS 하이드로 유닛(탱크 일제형 및 백결이형) 실내기 개발 □ 종합 Energy 및 업계 최고 급당효율 성당으로 경쟁사 比 연간 소비 전력당 15% 절감 □ Slim Fit 설계로 구주내 증가하고 있는 골통 주택(아파트 등) 수요 선정 대응 □ BESPOKE 제도 Al 청소기(최고 흡압적 280W) □ 음입력 및 원조 POD(형성 스테이션) 지속 강화 및 M/S 강화 □ 280W 세계최고 음입력 구원으로 강력하고 깨끗한 청소 □ 최적의 청소 모드를 자용으로 설정하고 자가 진단으로 유지보수 가이드 제공 □ 스틱 청소기 제도 4.0 고운 세획 브러시 □ 고온 등 스트레이 형태로 오염을에 직접보시하는 물결례 브러시 □ 수 15℃ 이상의 고본수를 바닥에 직접 본사. 효과적으로 찌든 때 제거 □ 20초 내외의 품은 예열 시간. 하나의 배터리로 최소 30분 이상 사용 □ 추가 배터리 없이 1.51kg의 가바운 물급레 무게로 관리하게 청소 □ 한국항 간습식 로봇정소기 BESPOKE Al 스팀 꿈보 □ 건습식 독립 청소/Al 바닥 인식 /Al 사물인식 □ 자동 착물 가능한 회전형 물길레 및 카렛 오염 방지를 위한 물길레 Lifting □ 스템 설균까지 가능한 결레 자용 세척/건조 정정 스테이션		
(~2024.04.) - 자연스럽게 공간의 무드를 만들어내는 온은한 간접조명 엣지 라이팅 - 교효용 에너지 맞춤절전 와이드 무풍 - 공기질부터 내부 관리까지 케이 8단계 - 상황에 맞춰 선택해 에너지를 절감하는 AI 절약모드 □ 구주 EHS 신 냉매(R290) 신규 플랫폼 - 2027년 냉에 규제에 따른 산 냉매(R290) 솔루션 대용 - 보일러 시장 대체를 위한 고온 토호수 구현 (Max 호수 75℃) - 저소음 구현 (최저 35dB(A)) □ 구주 EHS 하이드로 유닛(탱크 일제형 및 벽걸이형) 실내기 개발 - 등한 Energy 관리 솔루션/고객 사용경험 및 변의형 향상(CX-MDE 기반 에너지 절선) - AI Energy 및 업계 최고 급당효율 정능으로 경쟁사 比 연간 소비 전략당 15% 절감 - Slim Fit 설계로 구구대 당가하고 있는 공동 주택(이파트 등) 수요 선정 대용 □ BESPOKE 제돈 시청소기(최고 흡입력 280W) - 흡입력 및 원조 POD(정정 스테이션) 지속 강화 및 M/S 강화 - 280W 세계최고 흡입력 구현으로 감력하고 깨끗한 청소 - 최적의 청소 모드를 자동으로 설정하고 자가 진단으로 유지보수 가이드 제공 □ 스틱 청소기 제트 4.0 고운 세척 브러시 - 교수를 스프레이 형태로 오염일에 직접받사하는 물길레 브러시 - 약 50℃ 이상의 고온수를 바닥에 직접 받사, 효과적으로 찌든 때 제거 - 20초 대외의 짧은 예열 시간, 하나의 배터리로 최소 30분 이상 사용 - 추가 배터리 없이 1.51kg의 가버운 물길레 무게로 편리하게 청소 □ 한국항 건습식 로봇청소기 BESPOKE AI 스팀 콤보 - 건습식 독립 청소/AI 바닥 인식 /AI 사물인식 - 자동 착달 가능한 회전형 물겁레 및 카벳 오염 방지를 위한 물겁레 Lifting - 스템 살고까지 가능한 집제 자동 세척/건조 참정 스테이션 현지후드 □ 자가 후드 프리미엄 라인업 확대	에어컨	
- 고효용 에너지 맞춤점진 와이드 무품 - 공기절부터 내부 군리까지 케어 8단계 - 상황에 맞춰 선택해 에너지를 결감하는 AI 절약모드 □ 구주 EHS 신 뱅매(R290) 신규 플랫폼 - 2027년 냉매 규제에 따른 신 냉매(R290) 솔루션 대용 - 보일러 시장 대체를 위한 고욘 토출수 구현 (Max 출수 75℃) - 자소음 구현 (최저 35d8(A)) □ 구주 EHS 하이드로 유닷(탱크 일체형 및 백결이형) 실내기 개발 - 등환 Energy 관리 솔루션/고객 사용경험 및 편의성 항상(CX~MDE 기반 에너지 설전) - AI Energy 및 업계 최고 급량효율 성능으로 경정사 It 인간 소비 진력형 15% 결감 - Slim Fit 설계로 구주내 증가하고 있는 공동 주택(이파트 등) 수요 선점 대용 □ BESPOKE 제트 AI 청소기(최고 출범호 280W) - 휴입력 및 원조 POD(경점 스테이션) 지속 강화 및 M/S 강화 - 280W 세계최고 휴입력 구현으로 감력하고 재컷한 청소 - 최적의 청소 모드를 자동으로 설정하고 자가 진단으로 유지보수 가이드 제공 □ 스틱 청소기 제트 4.0 고욘 세적 브러시 - 고온수를 스프레이 혈대로 오염벌에 직접분사하는 불립레 브러시 - 약 50℃ 이상의 고온수를 바닥에 직접 분사, 효과적으로 찌든 때 제거 - 20초 내외의 짧은 예열 시간, 하나의 배터리로 최소 30분 이상 사용 - 추가 배터리 없이 1.51kg의 가벼운 물릴레 무게로 편리하게 청소 □ 한국향 건습식 로봇청소기 BESPOKE AI 스팀 콤보 - 건습식 독립 청소/AI 바닥 인식 /AI 사물인식 - 자동 작물 가능한 회전형 물길레 및 카켓 오염 방지를 위한 물길레 Lifting - 스템 실권까지 가능한 최전형 물길레 및 카켓 오염 방지를 위한 물길레 Lifting		
- 공기절부터 내부 관리까지 케어 8단계 - 상황에 맞춰 선택해 에너지를 절감하는 AI 절약모드 □ 구주 EHS 신 냉매(R290) 신규 플랫폼 - 2027년 냉매 규제에 따른 신 냉매(R290) 솔루션 대용 - 보일러 시장 대체를 위한 고운 토호수 구현 (Max 호수 75℃) - 저소용 구현 (최저 35dB(A)) □ 구주 EHS 하이드로 유닛(탱크 일체형 및 백결이형) 실내기 개발 - 종합 Energy 관리 솔루션/고객 사용경험 및 변의성 활성(CX-MDE 기반 에너지 용전) - AI Energy 및 업계 최고 급탕효용 성능으로 경쟁사 It 연간 소비 전력량 15% 절강 - Slim Fit 설계로 구주내 증가하고 있는 골동 주택(아파트 등) 수요 선정 대응 □ BESPOKE 제트 AI 청소기(최고 흡입력 280W) - 흡입력 및 원조 POD(환경 스테이션) 지속 강화 및 M/S 강화 - 280W 세계최고 흡입력 구현으로 강력하고 제곳한 청소 - 최적의 청소 모드를 자동으로 설정하고 재가 진단으로 유지보수 가이드 제공 □ 스틱 청소기 제트 4.0 고운 세척 브러시 - 고온수를 스프레이 형태로 오염물에 직접분사하는 물걸레 브러시 - 약 50℃ 이상의 고온수를 바닥에 직접 분사, 효과적으로 제든 때 제거 - 20초 내외의 짧은 예열 시간, 하나의 배터리로 최소 30분 이상 사용 - 추가 배터리 없이 1.51kg의 가벼운 물걸레 무게로 편리하게 청소 □ 한국량 건습식 로봇청소기 BESPOKE AI 스팀 콤보 - 건습식 독립 청소/AI 바닥 인식 /AI 사물인식 - 자용 착할 가능한 회전형 물건레 및 카켓 오염 방지를 위한 물걸레 Lifting - 스팀 살고까지 가능한 걸레 자용 세작/건조 청정 스테이션 덴지후드 □ 자가 후드 프리미엄 라만입 확대	(===,	
- 상황에 맞춰 선택해 에너지를 절감하는 AI 절약모드 □ 구주 EHS 신 병매(R290) 신규 플랫폼 - 2027년 병매 규제에 따른 신 병매(R290) 솔루션 대용 - 보일러 시장 대체를 위한 고은 토출수 구현 (Mex 출수 75℃) - 저소용 구현 (최저 35dB(A)) □ 구주 EHS 하이드로 유닛(탱크 일체형 및 백결이형) 실내기 개발 - 통합 Energy 관리 솔루션/고객 사용경험 및 판의성 향상(CX-MDE 기반 에너지 절전) - AI Energy 및 업계 최고 급량효율 성능으로 경쟁사 比 연간 소비 전력량 15% 절감 - Slim Fit 설계로 구주내 증가하고 있는 공동 주택(아파트 등) 수요 선점 대용 □ BESPOKE 제트 AI 청소기(최고 흡입력 280W) - 흡입력 및 원조 POD(형정 스테이션) 지속 강화 및 M/S 강화 - 280W 세계최고 흡입력 구현으로 강력하고 깨끗한 청소 - 최적의 청소 모드를 자동으로 설정하고 자가 진단으로 유지보수 가이드 제공 □ 스틱 청소기 제트 4.0 고온 세적 브러시 - 고온수를 스프레이 형태로 오염물에 직접분사하는 물결레 브러시 - 약 50℃ 이상의 고온수를 바닥에 직접 분사, 효과적으로 찌든 때 제거 - 20초 내외의 짧은 예열 시간, 하나의 배터리로 최소 30분 이상 사용 - 추가 배터리 없이 1.51kg의 가벼운 물결레 무게로 편리하게 청소 □ 한국향 건습식 로봇청소기 BESPOKE AI 스팀 콤보 - 건습식 독립 청소/AI 바닥 인식 /AI 사물인식 - 자동 착할 가능한 회전형 물결레 및 카펫 오염 방지를 위한 물길레 Lifting - 스팀 살균까지 가능한 결제 자동 세척/건조 청정 스테이션		
□ 구주 EHS 신 병매(R290) 신규 플랫폼 - 2027년 병매 규제에 따른 신 병매(R290) 솔루션 대응 - 보일러 시장 대체를 위한 교은 토출수 구현 (Max 출수 75℃) - 저소음 구현 (최저 35dB(A)) □ 구주 EHS 하이드로 유닛(병크 일체형 및 백걸이형) 실내기 개발 - 통합 Energy 관리 솔루션/고객 사용경험 및 편의성 항상(CX-MDE 기반 에너지 절전) - AI Energy 및 업계 최고 급당효율 성능으로 경쟁사 比 연간 소비 전력량 15% 절감 - Slim Fit 설계로 구주내 증가하고 있는 공동 주택(아파트 등) 수요 선점 대응 □ BESPOKE 제트 AI 청소기(최고 흡입력 280W) - 흡입력 및 원조 POD(청정 스테이션) 지속 강화 및 M/S 강화 - 280W 세계최고 흡입력 구현으로 강력하고 깨끗한 청소 - 최적의 청소 모드를 자동으로 설정하고 자가 진단으로 유지보수 가이드 제공 □ 스틱 청소기 제트 4.0 고온 세척 브러시 - 고온수를 스프레이 형태로 오염물에 직접분사하는 물결레 브러시 - 약 50℃ 이상의 고온수를 바닥에 직접 분사, 효과적으로 찌든 때 제거 - 20초 내외의 짧은 예열 시간, 하나의 배터리로 최소 30분 이상 사용 - 추가 배터리 없이 1.51kg의 가비운 물걸레 무게로 편리하게 청소 □ 한국향 건습식 로봇청소기 BESPOKE AI 스팀 콤보 - 건습식 독립 청소/AI 바닥 인식 /AI 사물인식 - 자동 확탈 가능한 회전형 물길레 및 카펫 오염 방지를 위한 물걸레 Lifting - 스팀 살관까지 가능한 결제 자동 세척/건조 청정 스테이션		
- 2027년 냉매 규제에 따른 신 냉매(R290) 솔루션 대응 - 보일러 시장 대체를 위한 고로 토출수 구현 (Max 총수 75℃) - 저소용 구현 (최저 35dB(A)) □ 구주 EHS 하이드로 유닛(탱크 일체형 및 벽걸이형) 실내기 개발 - 통합 Energy 관리 솔루션/고객 사용경험 및 편의성 황상(CX-MDE 기반 에너지 절전) - AI Energy 및 업계 최고 급탕효율 성능으로 경쟁사 比 연간 소비 전력량 15% 절간 - Slim Fit 설계로 구주내 증가하고 있는 공동 주택(아파트 등) 수요 선점 대응 □ BESPOKE 제든 AI 청소기(최고 흥입력 280W) - 흥입력 및 원조 POD(청정 스테이션) 지속 강화 및 M/S 강화 - 280W 세계최고 흡입력 구현으로 강력하고 깨끗한 청소 - 최적의 청소 모드를 자동으로 설정하고 자가 진단으로 유지보수 가이드 제공 □ 스틱 청소기 제트 4.0 고운 세척 브러시 - 고온수를 스프레이 형태로 오염물에 작접뿐사하는 물결레 브러시 - 고온수를 스프레이 형태로 오염물에 작접뿐사하는 물결레 브러시 - 20초 내외의 짧은 예열 시간, 하나의 배터리로 최소 30분 이상 사용 - 추가 배터리 없이 1.51kg의 가벼운 물걸레 무게로 편리하게 청소 □ 한국향 건습식 로봇청소기 BESPOKE AI 스팀 콤보 - 건습식 독립 청소/AI 바닥 인식 /AI 사물인식 - 자동 착탈 가능한 회전형 물걸레 및 카펫 오염 방지를 위한 물걸레 Lifting - 스팀 살곤까지 가능한 걸레 자동 세척/건조 청정 스테이션		
- 보일러 시장 대체를 위한 고온 토출수 구현 (Max 출수 75℃) - 저소음 구현 (최저 35dB(A)) □ 구주 EHS 하이드로 유닛(탱크 일체형 및 벽길이형) 실내기 개발 - 통합 Energy 관리 솔루션/고객 사용경험 및 편의성 향상(CX-MDE 기반 에너지 절전) - AI Energy 및 업계 최고 급당효율 성능으로 경쟁사 比 연간 소비 전력량 15% 절감 - Slim Fit 설계로 구주내 증가하고 있는 공동 주택(아파트 등) 수요 선정 대응 □ BESPOKE 제트 시 청소기(최고 흡입력 280W) - 흡입력 및 원조 POD(청점 스테이션) 지속 강화 및 M/S 강화 - 280W 세계최고 흡입력 구현으로 강력하고 깨끗한 청소 - 최적의 청소 모드를 자동으로 설정하고 자가 진단으로 유지보수 가이드 제공 □ 스틱 청소기 제트 4.0 고온 세척 브러시 - 고온수를 스프레이 형태로 오염물에 직접분사하는 물걸레 브러시 - 약 50℃ 이상의 고온수를 바닥에 직접 분사, 효과적으로 찌든 때 제거 - 20초 내외의 짧은 예열 시간, 하나의 배터리로 최소 30분 이상 사용 - 추가 배터리 없이 1.51kg의 가벼운 물걸레 무게로 편리하게 청소 □ 한국향 건습식 로봇청소기 BESPOKE AI 스팀 콤보 - 건습식 독립 청소/AI 바닥 인식 /AI 사물인식 - 자동 작탈 가능한 회전형 물걸레 및 카펫 오영 방지를 위한 물걸레 Lifting - 스팀 살균까지 가능한 최전형 물걸레 및 카펫 오영 방지를 위한 물걸레 Lifting - 스팀 살균까지 가능한 최전형 물걸레 및 카펫 오영 방지를 위한 물걸레 Lifting		
- 저소음 구현 (최저 35dB(A)) □ 구주 EHS 하이드로 유닛(탱크 일체형 및 벽걸이형) 실내기 개발 - 통합 Energy 관리 솔루션/고객 사용경험 및 편의성 향상(CX-MDE 기반 에너지 절전) - AI Energy 및 업계 최고 급탕효율 성능으로 경쟁사 比 연간 소비 전력량 15% 절강 - Slim Fit 설계로 구주내 증가하고 있는 공동 주택(아파트 등) 수요 선정 대응 □ BESPOKE 제트 AI 청소기(최고 흡입력 280W) - 흡입력 및 원조 POD(청정 스테이션) 지속 강화 및 M/S 강화 - 280W 세계최고 흡입력 구현으로 감력하고 깨끗한 청소 - 최적의 청소 모드를 자동으로 설정하고 자가 진단으로 유지보수 가이드 제공 □ 스틱 청소기 제트 4.0 고온 세척 브러시 - 고온수를 스프레이 형태로 오염물에 직접분사하는 물결레 브러시 - 약 50℃ 이상의 고온수를 바닥에 직접 분사, 효과적으로 찌든 때 제거 - 20초 내외의 짧은 예결 시간, 하나의 배터리로 최소 30분 이상 사용 - 추가 배터리 없이 1.51kg의 가벼운 물걸레 무게로 편리하게 청소 □ 한국량 건습식 로봇청소기 BESPOKE AI 스팀 콤보 - 건습식 독립 청소/AI 바닥 인식 /AI 사물인식 - 자동 작탈 가능한 회전형 물걸레 및 카펫 오염 방지를 위한 물걸레 Lifting - 스팀 살균까지 가능한 걸레 자동 세척/건조 청정 스테이션 렌지후드 □ 자가 후드 프리미엄 라인업 확대		
□ 구주 EHS 하이드로 유닛(탱크 일체형 및 백걸이형) 실내기 개발 - 통합 Energy 관리 솔루션/고객 사용경험 및 편의성 항상(CX-MDE 기반 에너지 절전) - Al Energy 및 업계 최고 급탕효율 성능으로 경쟁사 比 연간 소비 전력량 15% 절강 - Slim FIt 설계로 구주내 증가하고 있는 공동 주택(아파트 등) 수요 선점 대응 □ BESPOKE 제트 Al 청소기(최고 흡입력 280W) - 흡입력 및 원조 POD(청정 스테이션) 지속 강화 및 M/S 강화 - 280W 세계최고 흡입력 구현으로 강력하고 깨끗한 청소 - 최적의 청소 모드를 자동으로 설정하고 자가 진단으로 유지보수 가이드 제공 □ 스틱 청소기 제트 4.0 고온 세척 브러시 - 고온수를 스프레이 형태로 오염물에 직접분사하는 물걸레 브러시 - 약 50℃ 이상의 고온수를 바닥에 직접 분사, 효과적으로 찌든 때 제거 - 20초 내외의 짧은 예열 시간, 하나의 배터리로 최소 30분 이상 사용 - 추가 배터리 없이 1.51kg의 가벼운 물걸레 무게로 편리하게 청소 □ 한국향 건습식 로봇청소기 BESPOKE Al 스팀 콤보 - 건습식 독립 청소/Al 바닥 인식 /Al 사물인식 - 자동 착탈 가능한 회전형 물걸레 및 카펫 오염 방지를 위한 물걸레 Lifting - 스팀 살균까지 가능한 걸레 자동 세척/건조 청정 스테이션 렌지후드 □ 자가 후드 프리미엄 라인업 확대		
- 통합 Energy 관리 솔루션/고객 사용경험 및 편의성 향상(CX-MDE 기반 에너지 절전) - AI Energy 및 업계 최고 급탕효율 성능으로 경쟁사 比 연간 소비 전력량 15% 절강 - Slim Fit 설계로 구주내 증가하고 있는 공동 주택(아파트 등) 수요 선점 대응 □ BESPOKE 제트 시 청소기(최고 흡입력 280W) - 흡입력 및 원조 POD(청정 스테이션) 지속 강화 및 M/S 강화 - 280W 세계최고 흡입력 구현으로 강력하고 깨끗한 청소 - 최적의 청소 모드를 자동으로 설정하고 자가 진단으로 유지보수 가이드 제공 □ 스틱 청소기 제트 4.0 고온 세척 브러시 - 고온수를 스프레이 형태로 오염물에 직접분사하는 물걸레 브러시 - 고온수를 스프레이 형태로 오염물에 직접분사하는 물걸레 브러시 - 약 50°C 이상의 고온수를 바닥에 직접 분사, 효과적으로 찌든 때 제거 - 20초 내외의 짧은 예열 시간, 하나의 배터리로 최소 30분 이상 사용 - 추가 배터리 없이 1.51kg의 가벼운 물걸레 무게로 편리하게 청소 □ 한국향 건습식 로봇청소기 BESPOKE AI 스팀 콤보 - 건습식 독립 청소/AI 바닥 인식 /AI 사물인식 - 자동 착탈 가능한 회전형 물걸레 및 카펫 오염 방지를 위한 물걸레 Lifting - 스팀 살균까지 가능한 걸레 자동 세척/건조 청정 스테이션 렌지후드 □ 자가 후드 프리미엄 라인업 확대		
- Al Energy 및 업계 최고 급탕효율 성능으로 경쟁사 比 연간 소비 전력량 15% 절감 - Slim Fit 설계로 구주내 증가하고 있는 공동 주택(아파트 등) 수요 선점 대응 □ BESPOKE 제트 Al 청소기(최고 흡입력 280W) - 흡입력 및 원조 POD(청정 스테이션) 지속 강화 및 M/S 강화 - 280W 세계최고 흡입력 구현으로 강력하고 깨끗한 청소 - 최적의 청소 모드를 자동으로 설정하고 자가 진단으로 유지보수 가이드 제공 □ 스틱 청소기 제트 4.0 고온 세척 브러시 - 고온수를 스프레이 형태로 오염물에 직접분사하는 물걸레 브러시 - 약 50℃ 이상의 고온수를 바닥에 직접 분사, 효과적으로 찌든 때 제거 - 20초 내외의 짧은 예열 시간, 하나의 배터리로 최소 30분 이상 사용 - 추가 배터리 없이 1.51kg의 가벼운 물걸레 무게로 편리하게 청소 □ 한국향 건습식 로봇청소기 BESPOKE Al 스팀 콩보 - 건습식 독립 청소/Al 바닥 인식 /Al 사물인식 - 자동 착탈 가능한 회전형 물걸레 및 카펫 오염 방지를 위한 물걸레 Lifting - 스팅 살균까지 가능한 걸레 자동 세척/건조 청정 스테이션 렌지후드 □ 자가 후드 프리미엄 라인엄 확대		
- Slim Fit 설계로 구주내 증가하고 있는 공동 주택(아파트 등) 수요 선점 대응 BESPOKE 제트 AI 청소기(최고 흡입력 280W) - 흡입력 및 원조 POD(청정 스테이션) 지속 강화 및 M/S 강화 - 280W 세계최고 흡입력 구현으로 강력하고 깨끗한 청소 - 최적의 청소 모드를 자동으로 설정하고 자가 진단으로 유지보수 가이드 제공 □ 스틱 청소기 제트 4.0 고온 세척 브러시 - 고온수를 스프레이 형태로 오염물에 직접분사하는 물걸레 브러시 - 약 50℃ 이상의 고온수를 바닥에 직접 분사, 효과적으로 찌든 때 제거 - 20초 내외의 짧은 예열 시간, 하나의 배터리로 최소 30분 이상 사용 - 추가 배터리 없이 1.51kg의 가벼운 물걸레 무게로 편리하게 청소 □ 한국향 건습식 로봇청소기 BESPOKE AI 스팀 콤보 - 건습식 독립 청소/AI 바닥 인식 /AI 사물인식 - 자동 착탈 가능한 회전형 물걸레 및 카펫 오염 방지를 위한 물걸레 Lifting - 스팅 살균까지 가능한 걸레 자동 세척/건조 청정 스테이션 렌지후드 □ 자가 후드 프리미엄 라인엄 확대		
□ BESPOKE 제트 AI 청소기(최고 흡입력 280W) - 흡입력 및 원조 POD(청정 스테이션) 지속 강화 및 M/S 강화 - 280W 세계최고 흡입력 구현으로 강력하고 깨끗한 청소 - 최적의 청소 모드를 자동으로 설정하고 자가 진단으로 유지보수 가이드 제공 □ 스틱 청소기 제트 4.0 고온 세척 브러시 - 고온수를 스프레이 형태로 오염물에 직접분사하는 물걸레 브러시 - 약 50℃ 이상의 고온수를 바닥에 직접 분사, 효과적으로 찌든 때 제거 - 20초 내외의 짧은 예열 시간, 하나의 배터리로 최소 30분 이상 사용 - 추가 배터리 없이 1.51kg의 가벼운 물걸레 무게로 편리하게 청소 □ 한국향 건습식 로봇청소기 BESPOKE AI 스팀 콤보 - 건습식 독립 청소/AI 바닥 인식 /AI 사물인식 - 자동 착탈 가능한 회전형 물걸레 및 카펫 오염 방지를 위한 물걸레 Lifting - 스팅 살균까지 가능한 걸레 자동 세척/건조 청정 스테이션 렌지후드 □ 자가 후드 프리미엄 라인업 확대		
- 흡입력 및 원조 POD(청정 스테이션) 지속 강화 및 M/S 강화 - 280W 세계최고 흡입력 구현으로 강력하고 깨끗한 청소 - 최적의 청소 모드를 자동으로 설정하고 자가 진단으로 유지보수 가이드 제공 □ 스틱 청소기 제트 4.0 고온 세척 브러시 - 고온수를 스프레이 형태로 오염물에 직접분사하는 물걸레 브러시 - 약 50℃ 이상의 고온수를 바닥에 직접 분사. 효과적으로 찌든 때 제거 - 20초 내외의 짧은 예열 시간. 하나의 배터리로 최소 30분 이상 사용 - 추가 배터리 없이 1.51kg의 가벼운 물걸레 무게로 편리하게 청소 □ 한국항 건습식 로봇청소기 BESPOKE AI 스팀 콤보 - 건습식 독립 청소/AI 바닥 인식 /AI 사물인식 - 자동 착탈 가능한 회전형 물걸레 및 카펫 오염 방지를 위한 물걸레 Lifting - 스팀 살균까지 가능한 걸레 자동 세척/건조 청정 스테이션 렌지후드 □ 자가 후드 프리미엄 라인업 확대		
- 280W 세계최고 흡입력 구현으로 강력하고 깨끗한 청소 - 최적의 청소 모드를 자동으로 설정하고 자가 진단으로 유지보수 가이드 제공 □ 스틱 청소기 제트 4.0 고온 세척 브러시 - 고온수를 스프레이 형태로 오염물에 직접분사하는 물걸레 브러시 - 약 50℃ 이상의 고온수를 바닥에 직접 분사, 효과적으로 찌든 때 제거 - 20초 내외의 짧은 예열 시간, 하나의 배터리로 최소 30분 이상 사용 - 추가 배터리 없이 1.51kg의 가벼운 물걸레 무게로 편리하게 청소 □ 한국향 건습식 로봇청소기 BESPOKE AI 스팀 콤보 - 건습식 독립 청소/AI 바닥 인식 /AI 사물인식 - 자동 착탈 가능한 회전형 물걸레 및 카펫 오염 방지를 위한 물걸레 Lifting - 스팀 살균까지 가능한 걸레 자동 세척/건조 청정 스테이션 렌지후드 □ 자가 후드 프리미엄 라인업 확대		
- 최적의 청소 모드를 자동으로 설정하고 자가 진단으로 유지보수 가이드 제공 - 스틱 청소기 제트 4.0 고온 세척 브러시 - 고온수를 스프레이 형태로 오염물에 직접분사하는 물걸레 브러시 - 약 50℃ 이상의 고온수를 바닥에 직접 분사, 효과적으로 찌든 때 제거 - 20초 내외의 짧은 예열 시간, 하나의 배터리로 최소 30분 이상 사용 - 추가 배터리 없이 1.51kg의 가벼운 물걸레 무게로 편리하게 청소 - 한국향 건습식 로봇청소기 BESPOKE AI 스팀 콤보 - 건습식 독립 청소/AI 바닥 인식 /AI 사물인식 - 자동 착탈 가능한 회전형 물걸레 및 카펫 오염 방지를 위한 물걸레 Lifting - 스팀 살균까지 가능한 걸레 자동 세척/건조 청정 스테이션 ● 전지후드 □ 자가 후드 프리미엄 라인업 확대		
청소기 (~2024.03.) □ 스틱 청소기 제트 4.0 고온 세척 브러시 - 고온수를 스프레이 형태로 오염물에 직접분사하는 물걸레 브러시 - 약 50°C 이상의 고온수를 바닥에 직접 분사, 효과적으로 찌든 때 제거 - 약 50°C 이상의 고온수를 바닥에 직접 분사, 효과적으로 찌든 때 제거 - 20초 내외의 짧은 예열 시간, 하나의 배터리로 최소 30분 이상 사용 - 추가 배터리 없이 1.51kg의 가벼운 물걸레 무게로 편리하게 청소 □ 한국향 건습식 로봇청소기 BESPOKE AI 스팀 콤보 - 건습식 독립 청소/AI 바닥 인식 /AI 사물인식 - 자동 착탈 가능한 회전형 물걸레 및 카펫 오염 방지를 위한 물걸레 Lifting - 스팀 살균까지 가능한 걸레 자동 세척/건조 청정 스테이션 렌지후드 □ 자가 후드 프리미엄 라인업 확대		
청소기 (~2024.03.) - 고온수를 스프레이 형태로 오염물에 직접분사하는 물걸레 브러시 - 약 50℃ 이상의 고온수를 바닥에 직접 분사, 효과적으로 찌든 때 제거 - 20초 내외의 짧은 예열 시간, 하나의 배터리로 최소 30분 이상 사용 - 추가 배터리 없이 1.51kg의 가벼운 물걸레 무게로 편리하게 청소 □ 한국향 건습식 로봇청소기 BESPOKE AI 스팀 콤보 - 건습식 독립 청소/AI 바닥 인식 /AI 사물인식 - 자동 착탈 가능한 회전형 물걸레 및 카펫 오염 방지를 위한 물걸레 Lifting - 스팀 살균까지 가능한 걸레 자동 세척/건조 청정 스테이션 렌지후드 □ 자가 후드 프리미엄 라인업 확대		
청소기 (~2024.03.) - 약 50℃ 이상의 고온수를 바닥에 직접 분사, 효과적으로 찌든 때 제거 - 20초 내외의 짧은 예열 시간, 하나의 배터리로 최소 30분 이상 사용 - 추가 배터리 없이 1.51kg의 가벼운 물걸레 무게로 편리하게 청소 □ 한국향 건습식 로봇청소기 BESPOKE AI 스팀 콤보 - 건습식 독립 청소/AI 바닥 인식 /AI 사물인식 - 자동 착탈 가능한 회전형 물걸레 및 카펫 오염 방지를 위한 물걸레 Lifting - 스팀 살균까지 가능한 걸레 자동 세척/건조 청정 스테이션 렌지후드 □ 자가 후드 프리미엄 라인업 확대		
(~2024.03.) - 20초 내외의 짧은 예열 시간, 하나의 배터리로 최소 30분 이상 사용 - 추가 배터리 없이 1.51kg의 가벼운 물걸레 무게로 편리하게 청소 □ 한국향 건습식 로봇청소기 BESPOKE AI 스팀 콤보 - 건습식 독립 청소/AI 바닥 인식 /AI 사물인식 - 자동 착탈 가능한 회전형 물걸레 및 카펫 오염 방지를 위한 물걸레 Lifting - 스팀 살균까지 가능한 걸레 자동 세척/건조 청정 스테이션 렌지후드 □ 자가 후드 프리미엄 라인업 확대	청소기	
- 추가 배터리 없이 1.51kg의 가벼운 물걸레 무게로 편리하게 청소 □ 한국향 건습식 로봇청소기 BESPOKE AI 스팀 콤보 - 건습식 독립 청소/AI 바닥 인식 /AI 사물인식 - 자동 착탈 가능한 회전형 물걸레 및 카펫 오염 방지를 위한 물걸레 Lifting - 스팀 살균까지 가능한 걸레 자동 세척/건조 청정 스테이션 렌지후드 □ 자가 후드 프리미엄 라인업 확대	(~2024.03.)	
□ 한국향 건습식 로봇청소기 BESPOKE AI 스팀 콤보 - 건습식 독립 청소/AI 바닥 인식 /AI 사물인식 - 자동 착탈 가능한 회전형 물걸레 및 카펫 오염 방지를 위한 물걸레 Lifting - 스팀 살균까지 가능한 걸레 자동 세척/건조 청정 스테이션 렌지후드 □ 자가 후드 프리미엄 라인업 확대		
- 건습식 독립 청소/AI 바닥 인식 /AI 사물인식 - 자동 착탈 가능한 회전형 물걸레 및 카펫 오염 방지를 위한 물걸레 Lifting - 스팀 살균까지 가능한 걸레 자동 세척/건조 청정 스테이션 - 레지후드 □ 자가 후드 프리미엄 라인업 확대		
- 자동 착탈 가능한 회전형 물걸레 및 카펫 오염 방지를 위한 물걸레 Lifting - 스팀 살균까지 가능한 걸레 자동 세척/건조 청정 스테이션 - 렌지후드 □ 자가 후드 프리미엄 라인업 확대		
- 스팀 살균까지 가능한 걸레 자동 세척/건조 청정 스테이션 렌지후드 □ 자가 후드 프리미엄 라인업 확대		- 건습식 독립 청소/AI 바닥 인식 /AI 사물인식
렌지후드 □ 자가 후드 프리미엄 라인업 확대		- 자동 착탈 가능한 회전형 물걸레 및 카펫 오염 방지를 위한 물걸레 Lifting
		- 스팀 살균까지 가능한 걸레 자동 세척/건조 청정 스테이션
(2022.02.) - 기존 제품과의 성능 차별화	렌지후드	□ 자가 후드 프리미엄 라인업 확대
	(2022.02.)	- 기존 제품과의 성능 차별화

		<u> </u>	
			· 트리플 센서를 탑재하여 상시배기 시스템으로 최적의 풍량 운전
			·업계 최고 흡입력 780CMH 구현, 업계 최저 소음 (29dB, Quiet Mark 인증)
			- 전기레인지와 연동 및 스테인리스 필터에 이지 클린 코팅 적용으로 사용편의성 개선
			- 소비자의 다양한 니즈 반영한 디자인(BESPOKE 컬러)
			- Easy Install 및 설치 프로세스 도입으로 B2C 시장 진입
			□ 에너지 소비효율 1등급 저소음 인버터 제습기
			- 와이드 블레이드로 빠르고 강력하게 대용량 제습
		인버터 제습기	- 욕실부터 드레스룸까지 공간을 쾌적하게 스마트 공간 케어
		(2022.05.)	- 스윙 블레이드로 섬세한 의류도 골고루 와이드 의류 건조
			- 어디에도 잘 어울리는 심플한 디자인과 컴팩트 사이즈
			- 장시간 사용해도 조용한 저소음 모드
			□ 구주/한국 시장 경쟁력있는 자체 기술 플랫폼
		식기세척기	- 구주 시장 Tall Tub 대응
		(2022.06.)	- 최고 수준 에너지/물/소음 사양 경쟁력 확보
		, , ,	- 한국 세제자동투입, Simple UX 등 차별화를 통한 프리미엄 강화
			- Z-wash, Smart, Flexible Basket 사양 차별화
			□ 북미 Dacor 48" Pro-Range
			- 48" all Gas Pro range 도입, 외관 Transitional(Chef) look 디자인 적용
			- Air Fry, Air Sous-Vide 등 Healthier cooking POD 적용
			- 7" Pop-up display 적용
		가스오븐	□ 북미 Dacor 48" Pro-Range (Dual Fuel)
		(~2023.08.)	- 48" Dual Fuel Pro range 도입, 외관 Transitional(Chef) look 디자인 적용
			- Dual Fuel 연료 형태로 Oven(전기) + Cooktop(가스)
			- Cooktop부 6 Burners + Griddle 사양 적용
			- Small oven 12" (신규 플랫폼), Big oven 36" (기존 플랫폼) 조합
			- Steam Assist 기능 제공
			☐ Galaxy Z Fold4 (2022.08.)
			- 인치: 메인 디스플레이 7.6", 커버 디스플레이 6.2"
			- 사이즈(W x H x D): (접었을 때)67.1mm x 155.1mm x 14.2~15.8mm
			(펼쳤을 때)130.1mm x 155.1mm x 6.3mm
			- Platform(H/W, S/W):Snapdragon 8+ Gen 1, Android 12.0, One UI 4.1.1
			- Nightography 사진/비디오, 고해상도(50M/8K), 고배율줌(30X)로 카메라 사용 경험 완성도 제고
			- Taskbar제공으로 쉽고 빨라진 멀티 태스킹
			- 다양한 진입점으로 편리하게 생성하는 멀티 윈도우
			- 이미지에서 텍스트를 인식하여 AI 기반 Action 추천 기능
			☐ Galaxy Z Flip4 (2022.08.)
	MX	Galaxy 폴더블	- 인치: 메인 디스플레이 6.7", 커버 디스플레이 1.9"
	WX	(~2023.08.)	- 사이즈(W x H x D): (접었을 때) 71.9mm x 84.9mm x 15.9~17.1mm
			(펼쳤을 때) 71.9mm x 165.2mm x 6.9 mm
			- Platform(H/W, S/W): Snapdragon 8+ Gen 1, Android 12.0, One UI 4.1.1
			- 25W 충전 지원 및 3700mAh 배터리 제공
			- 다양한 각으로 사진/영상 촬영에 최적화된 플렉스 캠 지원
			- 플렉스 모드에서 쉽고 빠른 앱 전환 및 조작
			- 커버 스크린 기능 확대 (간편 답장, 삼성 월렛 플랫폼, 퀵세팅 확대 등)
			☐ Galaxy Z Fold5 (2023.08.)
			- 인치: 메인 디스플레이 7.6", 커버 디스플레이 6.2"
			- 사이즈(W x H x D): (접었을 때) 67.1mm x 154.9mm x 13.4mm
			7, 0, — (17 A 17 A 0). (B ME MI) 01.1111111 A 10.411111 A 10.411111

	(펼쳤을 때) 129.9mm x 154.9mm x 6.1mm
	- Platform(H/W, S/W): Snapdragon 8 Gen 2, Android 13, One UI 5.1
	- 신규 힌지 적용을 통한 Slim Closed Gap 디자인 구현 : Dumbbell 방식(물방울형) Flex Hinge 적용
	- 무게 절감과 두께 축소를 통한 단말 휴대성 및 그립감 향상
	- 대화면 최적화를 통한 사용자 경험 개선
	・양손 활용 동작:한 손으로 앱/컨텐츠를 선택, 다른 손으로 원하는 동작 실행
	·Taskbar 최적화 : 최근 앱 표시 확대(2→4개), Navigation 영역 자동 확장
	• 멀티윈도우 전환 강화 : 홈화면에서 팝업 윈도우를 손쉽게 멀티윈도우로 전환
	· Game 최적화 : 주요 Game에 대한 최적 해상도 사전 확보
	- 내구성 강화 : Display내 충격 흡수층 강화 및 세트 힌지부 구조 변경
	- 슬림하고 가벼운 S-Pen과 Case : S-Pen 및 Case 형상 변경으로 두께 및 무게 절감
	☐ Galaxy Z Flip5 (2023.08.)
	- 인치: 메인 디스플레이 6.7", 커버 디스플레이 3.4"
	- 사이즈(W x H x D): (접었을 때) 71.9mm x 85.1mm x 15.1 mm
	(펼쳤을 때) 71.9mm x 165.1mm x 6.9 mm
	- Platform(H/W, S/W): Snapdragon 8 Gen 2, Android 13, One UI 5.1
	- 설계 최적화를 통한 커버스크린 확대(1.9" →3.4")
	- 신규 힌지 적용을 통한 Slim Closed Gap 및 두께 축소로 그립감 개선
	- 대형 커버스크린 활용한 차별화된 사용자 경험 핵심 기능 제공 및 사용성 강화
	・주요 위젯13종(Music, Alarm 等), 주요 앱(삼성Wallet, 메시지 답장), Fast Scroll 기능 제공
	· Quick Setting 6종 →9종 확대(Mobile Data, Screen Recording, Modes 3종)
	- 대화면 커버스크린을 활용한 다양한 촬영 효과 및 기능 제공
	- 내구성 강화 : Display내 충격 흡수층 강화 및 세트 힌지부 구조 변경
	□ Galaxy S22 · S22+ · S22 Ultra (2022.02.)
	- Design: Enhance Galaxy Design attractiveness with geometric bold design and integrity on quality
	- 인치 : S22 6.1", S22+ 6.6", S22 Ultra 6.8"
	- 사이즈(W x H x D) : S22 70.6 x 146.0 x 7.6 mm, S22+ 75.8 x 157.4 x 7.6 mm,
	S22 Ultra 77.9 x 163.3 x 8.9 mm
	- Platform(H/W, S/W): Snapdragon 8 Gen 1 /Exynos2200, Android 12.0, One UI 4.1
	- 카메라 동영상 촬영 및 저조도 성능 강화
	· 동영상 : HDR, OIS+AI Stabilizer성능 개선으로 풍부한 컬러 지원 및 흔들림/지터링 최소화
	· 저조도 성능강화 : Big Pixel 센서 및 On-device AI 알고리즘 적용
	- S Pen 내장을 통한 Ultra/Note 통합 * Latency 최적화 : 5.6ms(S21 Ultra) → 2.8ms(S22 Ultra)
	- Display 야외 시인성 개선 * Peak 휘도: 1,500nit(S21 Ultra) → 1,750nit(S22 Ultra)
Galaxy S	- All day 사용 가능한 배터리와 초고속 45W 충전 속도 (S22 Ultra/S22+)
(~2024.01.)	- 내구성 강화 : 10% 개선된 Amor AL, Victus+ Glass 적용
	- Galaxy Foundation 경험 완성도 제고
	· One UI 4.1: 감성적 Interaction경험과 사용자 개인경험 고도화
	· Galaxy Eco : End-to-End 완성도 제고 및 체감 편의 경험 강화
	☐ Galaxy S23 · S23+ · S23 Ultra (2023.02.)
	- Design: Ultimate Premium Experience designed for today and beyond
	* Unrivalled Camera, Ultimate Gaming Eco-conscious Design
	- 인치 : S23 6.1", S23+ 6.6", S23 Ultra 6.8"
	- 사이즈(W x H x D) : S23 70.9 x 146.3 x 7.6 mm, S23+ 76.2 x 157.8 x 7.6 mm, 195g
	S23 Ultra 78.1 x 163.4 x 8.9 mm, 233g
	- Platform(H/W, S/W): Snapdragon 8 Gen 2, Android 13, One UI 5.1
	- 강화된 AI기반 저조도 및 동영상 경험 완성도 제고

・AI Scene 분석 기반 컬러 솔루션 개선으로 야간에도 정확한 인물 색감/톤 표현 가능 ・OIS 보정각 확대로 동영상 손떨림 보정 강화 (S22 Ultra 1.5°→ S23 Ultra 3°) - 고화소의 섬세한 디테일 구현 및 고해상도 사진 촬영 경험 제공 ・S23 Ultra, 200MP 초고화소 센서 적용 ・조도 구간별 픽셀 크기 자동 조정으로 최적 화질 제공 - 발열, 낙하 내구성 등 기본 성능 개선 ・소모전류 개선 및 방열 구조 획기적 개선 등 발열 성능 향상을 통한 부드러운 게이밍 경험 제공	
- 고화소의 섬세한 디테일 구현 및 고해상도 사진 촬영 경험 제공 • S23 Ultra, 200MP 초고화소 센서 적용 • 조도 구간별 픽셀 크기 자동 조정으로 최적 화질 제공 - 발열, 낙하 내구성 등 기본 성능 개선 • 소모전류 개선 및 방열 구조 획기적 개선 등 발열 성능 향상을 통한 부드러운 게이밍 경험 제공	
S23 Ultra, 200MP 초고화소 센서 적용 조도 구간별 픽셀 크기 자동 조정으로 최적 화질 제공 발열, 낙하 내구성 등 기본 성능 개선 소모전류 개선 및 방열 구조 획기적 개선 등 발열 성능 향상을 통한 부드러운 게이밍 경험 제공	
· 조도 구간별 픽셀 크기 자동 조정으로 최적 화질 제공 - 발열, 낙하 내구성 등 기본 성능 개선 · 소모전류 개선 및 방열 구조 획기적 개선 등 발열 성능 향상을 통한 부드러운 게이밍 경험 제공	
- 발열, 낙하 내구성 등 기본 성능 개선 · 소모전류 개선 및 방열 구조 획기적 개선 등 발열 성능 향상을 통한 부드러운 게이밍 경험 제공	
소모전류 개선 및 방열 구조 획기적 개선 등 발열 성능 향상을 통한 부드러운 게이밍 경험 제공	
・단품 강도 21% 개선된 Victus 2 Glass 적용으로 낙하 내구성 강화	
- S23 Ultra, 내장된 S-Pen으로 더욱 완벽한 Productivity 경험 제공	
· 이미지 / 동영상에서 텍스트를 인식하여 AI 기반 맞춤 Action 제안	
- 멀티기기 연동 사용 경험 강화 (폰-PC)	
· 폰에서 브라우징 하던 웹페이지를 PC에서 이어서 사용 가능	
- 컬러부터 소재까지 전반에 걸친 친환경 소재 적용으로 친환경 스토리 구성	
· 패키징 박스 100% 재생용지 사용	
· 재활용 메탈접합 PBT레진 적용(10%), 재활용 메탈 소재 적용(28%) 사이드키 등	
• 전/후면 글라스 재생유리 적용(22%), 메탈 가공시 천연염료 사용, 재활용 PET 필름 사용 등	
- Privacy와 Security 강화	
· 보안 상태 시각화 / 이미지 공유시 민감 정보 알림 / 제품 수리시 개인 정보 접근 제한	
☐ Galaxy S24 · S24 + · S24 Ultra (2024.01.)	\dashv
- Galaxy Al 기능 탑재를 통한 Galaxy Intelligence 경험 혁신	
- 인치 : S24 6.2", S24+ 6.7", S24 Ultra 6.8"	
- 사이즈(W x H x D) : S24 70.6 x 147.0 x 7.6 mm 167g, S24+ 75.9 x 158.5 x 7.7 mm, 196g	
S24 Ultra 79.0 x 162.3 x 8.6 mm, 232g	
- Platform(H/W, S/W): Snapdragon 8 Gen 3/Exynos 2400, Android 14, One UI 6.1	
- Slimmer and even bezels 적용으로 몰입감 있는 디스플레이 경험 강화	
- One-mass 디자인을 통한 조형의 일체감 완성	
- 향상된 Al ProVisual Engine 탑재로 카메라 촬영 및 갤러리 감상/편집 강화	
· 스페이스 줌, 나이토그래피로 선명한 고품질 사진 촬영	
· Instant Slow-mo, Edit Suggestion 기능 제공	
- 디스플레이 야외 시인성 개선 ★ Peak 밝기: 1,750nit → 2,600nit	
- 디즈들대에 아파 지원장 개선 * Peak 화가 1,750ml → 2,000ml - S24 Ultra, 메탈 프레임 티타늄 소재 적용을 통한 내구성 강화 및 고급감 극대화	
- S24 Ultra, 고화소 망원 카메라 적용 ★ 10MP (S23 Ultra) → 50MP (S24 Ultra)	
	\dashv
☐ Galaxy Tab S8 · S8 + · S8 Ultra (2022.02.)	
- 인치 : Tab S8 11" WQXGA (2560 x 1600)	
Tab S8+ 12.4" WQXGA+ (2800 x 1752)	
Tab S8 Ultra 14.6" WQXGA+ (2960 x 1848)	
- 사이즈(W x H x D) & 무게 : Tab S8 165.3mm x 253.8mm x 6.3mm, 503g	
Tab S8+ 185.0mm x 285.0mm x 5.7mm, 567g	
Galaxy 탭 Tab S8 Ultra 208.6mm x 326.4mm x 5.5mm, 726g	
(~2023.08) - Platform(H/W, S/W): Snapdragon 8 Gen 1, Android 12, One UI 4.1	
- Memory: 8GB+128GB / 8GB+256GB / 12GB+256GB / 16G+512G, microSD up to 1TB	
- 화상 통화 경험 향상	
[Tab S8 Ultra] Dual 전면 카메라(12M 80도, 12M 120도) 및 Auto Framing 기능 제공	
[Tab S8+ / Tab S8] 12M 120도 전면 카메라 및 Auto Framing 기능 제공	
- AP 방열 설계 강화를 통한 AP Sustain 성능 개선(전작비 GPU 70%, CPU 25%↑), 게임 성능 향상	
- S Pen Latency 개선 (5.6ms → 2.65ms) 및 Prediction Algorithm 최적화	

Writing & Drawing 시 Real Pen과 같이 끊김 없고 정밀한 필기 경험 제공, 밀착감 개선 - 3 MIC Noise Cancelation 성능 강화 (3종 잡음 제거 모드)로 화상 회의 오디오 경험 향상 - 태블릿 최초로 WiFi 6E 기능을 탑재하여 Device 간 대용량 데이터 전송 시간 개선 - D2D 15W 충전 기능 탑재하여 전작 대비 Phone Power Share 충전 시간 절반으로 단축 ☐ Galaxy Tab S9 · S9+ · S9 Ultra (2023.08.) - 인치 : Tab S9 11"WQXGA (2560 x 1600) Tab S9+ 12.4"WQXGA+ (2800 x 1752) Tab S9 Ultra 14.6"WQXGA+ (2960 x 1848) 165.8 x 254.3 x 5.9 mm, 498g - 사이즈(W x H x D) & 무게 : Tab S9 Tab S9+ 185.4 x 285.4 x 5.7 mm, 581g Tab S9 Ultra 208.6 x 326.4 x 5.5 mm, 732g - Platform(H/W, S/W): Snapdragon 8 Gen 2, Android 13, One UI 5.1 - 풍부한 색감과 환경에 적응하는 대화면 경험 제공 · Tab S9 시리즈 전 모델 선명하면서도 편안한 Dynamic AMOLED 2X 기술 채용 ·햇빛 아래에서도 선명한 화면을 보여주는 Vision Booster 기술 도입 - 어디서나 걱정 없이 사용 가능하도록 이동성 및 신뢰성 확보 · 최상의 방수/방진 인증 등급 IP68 획득 · 충격과 낙하에서 기기를 안전하게 보호하는 Armor Aluminum · 양방향 충전 적용 S-Pen 및 Ruggedized 액세서리 도입으로 사용성 Eco 확대 · Tab FF 모델군과 키보드 및 액세서리 공용하로 호환성 강화 · Vapor Chamber를 이용한 양방향 방열 신규 구조 도입 장시간 사용에도 불편함 없이 사용 - 다양한 분야에 걸친 풍성한 Android App Eco 확보 • 필기, 문서, 브라우징 등 생산성 강화 주요 안드로이드 앱 강화 : 삼성노트, 굿노트 등 • 그림, 사진 및 영상 편집 사용성 개선을 위한 주요 앱 확보 : 루마퓨젼, 클립스튜디오 등 - 외관 대형 플라스틱 부위 및 강화 유리 재활용으로 제품 전반에 걸친 친환경 소재 적용 · S-PEN 부착 부위 대형 재활용 플라스틱 신규 적용 •디스플레이 강화 유리 신규 재활용 도입 (10%, 고릴라 글래스5) ·패키징 박스 100% 재생 용지 및 재활용 Armor Aluminum 적용(20%), 재활용 플라스틱 내장 자재 사용 등 ☐ Galaxy A23 (2022.03.) - 인치 : 6.6" FHD+ (2408 x 1080) 90Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게: 76.9mm x 165.4mm x 8.4mm, 195g - Platform(H/W, S/W): SDM680, Android 12, One UI 4.1 - 6.6" FHD+ 디스플레이, 90Hz 주사율 지원 (전작 A22 6.4" HD+ 90Hz) - 고화소 50MP OIS 카메라 적용으로 어두운 곳에서 흔들림 없는 선명한 사진 촬영 가능 - 5,000mAh 대용량 배터리 적용 및 25W 초고속 충전 지원 ☐ Galaxy A13 5G (2022.01.) - 인치: 6.5" HD+ (1600 x 720) 90Hz Galaxy A - 사이즈(W x H x D) & 무게: 76.5mm x 164.5mm x 8.8mm, 195g (~2024.03.) - 6.5" HD+ 디스플레이, 90Hz 주사율 지원 (전작 A12 6.5" HD+ 60Hz) - LTE 사용자 Migration 및 5G 시장 확산을 위한 초저가 5G 모델 - Entry 시장 대응을 위한 AP 성능 강화 (P35 → D700) - 50MP 카메라 적용으로 전작(A12 16MP)비 고화소 사진 촬영 가능 ☐ Galaxy A13 LTE (2022.03.) - 인치: 6.6" FHD+ (2408 x 1080) 60Hz - 사이즈(W x H x D) & 무게: 76.4mm x 165.1mm x 8.8mm, 195g - Platform(H/W, S/W): Exynos850, Android 12, One UI Core 4.1 - 6.6" FHD+ 디스플레이 적용하여 전작(A12 6.5" HD+)비 향상된 대화면 경험 제공

- 50MP 카메라 적용하여 전작(A12 48MP)비 고화소 사진 촬영 가능
- 5,000mAh 고용량 배터리 및 Al Power mode 적용하여 1회 충전으로 2 Days 사용 가능
- ☐ Galaxy A73 5G (2022.04.)
 - 인치: 6.7" FHD+ Super AMOLED+ (1080 x 2400) 120Hz
 - 사이즈(W x H x D) & 무게: 76.1mm x 163.7mm x 7.6mm, 181g
 - Platform(H/W, S/W): SDM778G, Android 12, One UI 4.1
 - 108MP 고해상도 화질 및 OIS 지원으로 선명하면서도 어두운 곳에서 흔들림 없는 사진 촬영 가능
 - 120Hz 고주사율과 sAMOLED display적용으로 부드럽고 선명한 화면 경험
 - 5,000mAh 대용량 배터리 적용(2 days battery) 및 25W 초고속 충전 지원
 - Gorilla Glass 5 및 IP67등급 적용으로 강력한 내구성 제공
 - One UI 4.1 지원으로 최신 Flagship 경험 제공

☐ Galaxy A53 5G (2022.04.)

- 인치: 6.5" FHD+ Super AMOLED (1080 x 2400) 120Hz
- 사이즈(W x H x D) & 무게: 74.8mm x 159.6mm x 8.1mm, 189g
- Platform(H/W, S/W): Exynos1280, Android 12, One UI 4.1
- 8.1t 슬림 디자인 및 5,000mAh 대용량 배터리 적용 (전작比 0.3t↓, 500mAh↑)
- 120Hz 고주사율과 빠른 반응속도의 sAMOLED 조합이 제공하는 부드럽고 선명한 화면 경험
- Gorilla Glass 5 적용으로 Glass 내구성 향상
- One UI 4.1 지원으로 최신 Flagship 경험 제공

☐ Galaxy A33 5G (2022.04.)

- 인치: 6.4" FHD+ Super AMOLED (1080 x 2400) 90Hz
- 사이즈(W x H x D) & 무게: 74.0mm x 159.7mm x 8.1mm, 186g
- Platform(H/W, S/W): Exynos1280, Android 12, One UI 4.1
- 6.4" FHD+ 디스플레이, 90Hz 지원으로 향상된 화면 경험 제공 (전작 A32-5G HD+ TFT 60Hz)
- 48MP OIS 카메라 적용으로 흔들림 없는 고화소 사진 촬영 가능
- Gorilla Glass 5 적용, IP67 등급의 방수&방진 지원으로 내구성 향상
- 5,000mAh 대용량 배터리 적용(2 days battery) 및 25W 초고속 충전 지원

☐ Galaxy A23 5G (2022.09.)

- 인치: 6.6" FHD+ TFT LCD (1080 x 2408) 120Hz
- 사이즈(W x H x D) & 무게: 76.9mm x 165.4mm x 8.4mm, 197g
- Platform(H/W, S/W): SDM695, Android 12, One UI 4.1
- SDM695 적용하여 전작(A22-5G D700) 대비 AP 성능 강화
- 50MP OIS 카메라 적용으로 흔들림 없는 고화소 사진 촬영 가능 (NA 권역 OIS 미지원)
- 6.6" FHD+ 적용하여 전작(A22-5G 6.6" FHD+ 90Hz) 대비 향상된 대화면 경험 제공
- 5,000mAh 대용량 배터리 적용(2 days battery) 및 25W 고속충전 지원

☐ Galaxy A14 5G (2023.01.)

- 인치: 6.6" FHD+ TFT LCD (2408 x 1080) 90Hz
- 사이즈(W x H x D) & 무게: 78.0 x 167.7 x 9.1mm, 201g
- Platform(H/W, S/W): D700/Exynos1330, Android 13, One UI core 5.0
- 전작 (A13-5G) 대비 고사양 Front camera 적용으로 고화소 사진촬영 가능 (5MP \rightarrow 13MP)
- 6.6" FHD+ 대화면 디스플레이 적용으로 전작(A13-5G 6.5" HD+) 대비 향상된 화면 경험 제공
- 5,000mAh 대용량 배터리 적용

☐ Galaxy A54 5G (2023.03.)

- 인치: 6.4" FHD+ Super AMOLED (2340 x 1080) 19.5:9 120Hz
- 사이즈(W x H x D) & 무게 : 76.7 x 158.2 x 8.2mm, 202g
- Platform(H/W, S/W): Exynos1380, Android 13, One UI 5.1
- AP 화질 개선 기능, 조도별 튜닝 세분화 및 1000nit 적용을 통한 시인성 향상

- 120Hz 최적의 주사율 제공을 통한 성능 및 배터리 효율 극대화
- Linear 모터의 정교한 진동 조절을 통한 풍부한 Haptic 경험 제공
- Balanced Design 및 Premium CMF 강화 (6.4", 19.5:9 적용)
- One UI 5.1 지원으로 최신 Flagship 경험 제공

☐ Galaxy A34 5G (2023.03.)

- 인치 : 6.6" FHD+ Super AMOLED (2340 x 1080) 120Hz
- 사이즈(W x H x D) & 무게: 78.1 x 161.3 x 8.2mm, 199g
- Platform(H/W, S/W): D1080, Android 13, One UI 5.1
- 6.6" FHD+, 1,000nit 휘도, 120Hz 주사율 지원으로 향상된 화면 경험 제공
- 48MP OIS 카메라 적용으로 흔들림 없는 고화소 사진 촬영 가능
- Linear Motor 탑재하여 플래그십 수준의 햅틱 경험 제공

☐ Galaxy A14 (2023.03.)

- 인치: 6.6" FHD+ TFT LCD (2408 x 1080) 60Hz
- 사이즈(W x H x D) & 무게: 78.0 x 167.7 x 9.1mm, 201g
- Platform(H/W, S/W): Exynos850/G80, Android 13, One UI core 5.1
- 전작 (A13) 대비 고사양 Front camera 적용으로 향상된 Selfie 경험 제공 (8MP → 13MP)
- 5,000mAh 대용량 배터리 적용

☐ Galaxy A24 (2023.05.)

- 인치: 6.5" FHD+ sAMOLED U-Cut (1080 x 2340) 90Hz
- 사이즈(W x H x D) & 무게: 77.6mm x 162.1mm x 8.3mm, 195g
- Platform(H/W, S/W): G99, Android 13, One UI core 5.1
- 전작(A23) 대비 고사양 Front camera 적용으로 향상된 Selfie 경험 제공 (8MP →13MP)
- 신규VDIS 적용으로 OIS와 함께 진보된 흔들림 없는 비디오 제공
- 전작(A23) 대비 야외 시인성 향상, 넓어진 색대역 등으로 밝고 편리한 화면 경험 제공

☐ Galaxy A05s (2023.10.)

- 인치 : 6.7" FHD+ TFT LCD U-cut (1080 x 2400) 90Hz
- 사이즈(W x H x D) & 무게 : 77.8mm x 168.0mm x 8.8mm, 194g
- Platform(H/W, S/W): SDM680, Android 13, One UI core 5.1
- LTE Entry 시장 물량 및 M/S 견인
- 전작 A04S 比 고성능 AP 탑재 (Exynos850 8nm → SDM680 6nm), 고사양 Front Camera 적용

(5MP → 13MP)

- Global 5,000mAh 대용량 배터리 적용 및 급속25W 충전 지원 (15W → 25W)
- ☐ Galaxy A05 (2023.10.)
 - 인치: 6.7" HD+ TFT LCD U-cut (720 x 1600) 60Hz
 - 사이즈(W x H x D) & 무계: 78.2mm x 168.8mm x 8.8mm, 195g
 - Platform(H/W, S/W): G85, Android 13, One UI Core 5.1
 - 6.7" 대화면과 50MP 고화소 카메라 지원으로 향상된 멀티미디어 경험 제공
 - 고성능 AP 탑재하여 고객의 제품 사용성 향상 (전작比 CPU 33%↑, GPU 150%)
- 25W 고속으로 30분 충전하여 장시간 사용할 수 있는 배터리

☐ Galaxy A25 5G (2024.01.)

- 인치: 6.5"FHD+ Super AMOLED (2340 x 1080) 19.5:9 120Hz
- 사이즈(W x H x D): 76.5 x 161.0 x 8.3 mm, 197g
- Platform(H/W, S/W): Exynos 1280, Android 14, One UI 6.0
- 6.5" FHD+, 120Hz 주사율을 지원하여 향상된 화면 경험 제공
- 50MP OIS 광각 카메라 적용으로 흔들림 없는 고화소 사진 촬영 가능
- 5,000mAh 대용량 배터리 적용
- ☐ Galaxy A15 (2024.01.)

	- 인치 : 6.5"FHD+ Super AMOLED (2340 x 1080) 19.5:9 90Hz
	- 사이즈(W x H x D) : 76.8 x 160.1 x 8.4 mm, 200g
	- Platform(H/W, S/W): [5G] D6100+ / [LTE] G99, Android 14, One UI 6.0
	- 전작(A14) 대비 디스플레이 업그레이드를 통한 화질 향상 (LCD → Super AMOLED)
	- 25W 고속 충전 가능한 5,000mAh 대용량 배터리 탑재
	- Knox Vault 지원으로 보안 및 사생활 보호 강화
	☐ Galaxy A55 5G (2024.03.)
	- 인치 : 6.6"FHD+ Super AMOLED (2340 x 1080) 19.5:9 120Hz
	- 사이즈(W x H x D) : 77.4 x 161.1 x 8.2 mm, 213g
	- Platform(H/W, S/W): Exynos 1480, Android 14.0, One UI 6.1
	- 강화된 카메라 센서 및 AP로 더 완벽해진 Nightography와 비디오 촬영 경험 제공
	- Metal + Glass 적용, Young & Energetic한 CMF 구현으로 디자인 경쟁력 강화
	- 6.6" FHD+ 대화면 디스플레이 적용으로 향상된 화면 경험 제공 (전작 A54-5g 6.4")
	☐ Galaxy A35 5G (2024.03.)
	- 인치 : 6.6"FHD+ Super AMOLED (2340 x 1080) 19.5:9 120Hz
	- 사이즈(W x H x D) : 78.0 x 161.7 x 8.2 mm, 209g
	- Platform(H/W, S/W): Exynos 1380, Android 14.0, One UI 6.1
	- HID(Hole In Display), Back Glass적용하여 디자인 차별화
	- Knox Vault로 보안을 강화하고, OS UP 4회 및 Security MR 5회 지원하여 품질 보증 확대
	☐ Galaxy Book2 Pro 360 (2022.04.)
	- 인치:15.6" FHD Super AMOLED (16:9), up to 500nit(HDR), Color Volume 120%
	13.3" FHD Super AMOLED (16:9), up to 500nit(HDR), Color Volume 120%
	- 사이즈(W x H x D) & 무게 : 15.6" 354.85 x 227.97 x 11.9mm, 1.41kg
	13.3" 302.5 × 202 × 11.5 mm, 1.04kg
	- Platform. OS : Intel ® Core™ Processor (12세대). Windows 11
	- sAMOLED : Default 370nit/HDR 500nit, Color volume 120%
	- S Pen & Touchscreen support
	- 1080p FHD Camera (87도 와이드 앵글, 사용자 인식해 화면 중앙에 보여주는 Auto Framing 지원)
	- SSD: Gen4 SSD, Expendable SSD (M.2 2230)
	- WiFi 6E 지원
	- Battery : 15.6" 68Wh (21hrs), 13.3" 63Wh (21hrs)
	- Baltery : 13.6 66WH (211118), 13.3 66WH (211118) - Galaxy Apps : Quick Share, 2nd Screen, Multi-Control 등
Galaxy북	·QR Sign-in : 폰에 사용중인 계정과 연동된 QR 인식으로 Galaxy북에 로그인
(~2024.01.)	- Security : 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어 단계별 보안이 강화된 Secured-Core PC 지원
	☐ Galaxy Book2 Pro (2022.04.)
	- 인치 : 15.6" FHD AMOLED (16:9), up to 500nit(HDR), Color Volume 120%
	13.3" FHD AMOLED (16:9), up to 500nit(HDR), Color Volume 120%
	- 사이즈(W x H x D) & 무게 : 15.6" 355.4 x 225.8 x 11.7mm, 1.11kg
	13.3" 304.4 x 199.8 x 11.2mm, 0.87kg
	- Platform, OS : Intel ® Core™ Processor (12세대), Windows 11
	- AMOLED : Default 400nit/HDR 500nit, Color volume 120%
	- 1080p FHD Camera (87도 와이드 앵글, 사용자 인식해 화면 중앙에 보여주는 Auto Framing 지원)
	- SSD: Gen4 SSD, Expendable SSD (15.6" Only, M.2 2280)
	– WiFi 6E, 5G Sub6 (15.6"Only) 지원
	- Battery : 15.6" 68Wh (21hrs), 13.3" 63Wh (21hrs)
	- Galaxy Apps : Quick Share, 2nd Screen, Multi-Control 등
	·QR Sign-in : 폰에 사용중인 계정과 연동된 QR 인식으로 Galaxy북에 로그인

- Security : 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어 단계별 보안이 강화된 Secured-Core PC 지원 ☐ Galaxy Book2 Go 5G (2022.12.) - 인치: 14" IPS (1920 x 1080) - 사이즈(W x H x D): 323.9mm x 224.8mm x 15.5mm - Platform: Snapdragon 7C+ Gen 3, Window 11 - 7C+ Gen3 적용 Mass WoA 제품 개발 (Snapdragon 7C Gen 2 대비 CPU 63%↑, GPU 102%↑) - Display 화질개선 (TN →IPS) - WiFi 6E, 5G Sub6 지원 - 보급형 ENDC/eSIM지원 5G 모델 도입 - 45W 충전 지원 - MIL-STD-810H 8개 항목 보증 · Shock, High/Low Temperature, Thermal Shock, Dust, Vibration, Low pressure, Humidity ☐ Galaxy Book2 Pro 360(2023) (2022.12.) - 인치: 13.3" FHD AMOLED (16:9), Touch Screen, Color Volume(DCI-P3) 100%, S Pen - 사이즈(W x H x D) & 무게: 13.3" 302.5 x 202.0 x 11.5mm, 1.04kg - Platform, OS: Snapdragon 8cx Gen 3, Windows 11 Home - AMOLED: 13.3" FHD Super AMOLED (16:9), Color Volume(DCI-P3) 100%, up to 370nit, S Pen - Speakers: Stereo 2 x 4W (Smart AMP), AKG, Dolby Atmos - SSD: eUFS on board, 256GB - WiFi 6E (802.11ax) - Battery: 63Wh (Video Play 35hrs↑) - Galaxy ecosystem: Smart Switch, Samsung Account, Samsung Apps, Keyboard & Touch Pad Sharing between Galaxy devices - Security: 지문 인식, Secured Core PC (Level 3, H/W & F/W Protection) - AI: Noise Reduction, Video Call with Neural Engine ☐ Galaxy Book3 Ultra (2023.02.) - 인치: 16.0" OLED 120Hz, 370nit/500nit, 16:10 (2880 x 1800, 3K) - 사이즈(W x D x H): 355.4 x 250.5 x 16.5mm, 1.79kg, - Intel ® Core™ Processor (13세대), Win 11, LPDDR5, NVIDIA® GeForce RTX™ 4050/4070, 76W Battery, FHD MIPI Camera, A/C/D Al, B Glass, TA 100W - 13세대 Intel® Core™ H-프로세서와 차세대 NVIDIA® GeForce RTX™ 40 시리즈 그래픽 적용 - WQXGA+를 적용한 3K 고해상도 디스플레이, 컬러 볼륨 120% - 39% 더 넓어진 터치 패드 (Galaxy 북2 Pro 33.7 cm / 39.6cm 대비) - 100W 고속 충전, 30분 충전 시 55% 충전 가능 - Quad Speaker : AKG와 Dolby Atmos 적용 - Galaxy Ecosystem 적용 · Multi Control : 키보드와 마우스를 스마트폰, 탭에서도 사용할 수 있고, 기기 간 파일을 옮기거나, 문서/이미지의 복사, 붙여넣기도 가능 · Second Screen : Galaxy Tab을 듀얼 모니터처럼 활용, PC 화면 확장 또는 복제 가능 · Quick Share : 폰/태블릿 등 Galaxy 기기 간 무선 파일 공유 ☐ Galaxy Book3 Pro 360 (2023.02.) - 인치: 16.0" WQXGA+ AMOLED (16:10) 2880 x 1800, Touch Screen, DCI-P3 120%, S Pen - 사이즈(W x H x D) & 무게: 16.0" 355.4 x 252.2 x 12.8mm, 1.66kg - Platform, OS: Intel ® Core™ Processor (13세대), Windows 11 - Dynamic AMOLED 2X: 3K(2880x1800), 500nit(HDR), 120Hz, DCI-P3 120% - S Pen & Touchscreen support

- 1080p FHD Camera (87도 와이드 앵글, 사용자 인식해 화면 중앙에 보여주는 Auto Framing지원)
- Quad SPK(AKG/Dolby, Max_5Wx2, 2Wx2), Studio Grade Dual Mic
- SSD : Gen4 SSD
- WiFi 6F 지원
- Battery: 76Wh
- Galaxy Apps : Quick Share, 2nd Screen, Multi-Control, Samsung Pass등
- Security : 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어 단계별 보안이 강화된 Secured-Core PC 지원
- ☐ Galaxy Book3 Pro (2023.02.)
- 인치: 16" WQXGA+ AMOLED (16:10), up to 500nit(HDR), 120Hz, DCI-P3 120%
 - 14" WQXGA+ AMOLED (16:10), up to 500nit(HDR), 120Hz, DCI-P3 120%
- 사이즈(W x H x D) & 무게: 16" 355.4 x 250.4 x 12.5mm, 1.56kg

14" 312.3 x 223.8 x 11.3mm, 1.17kg

- Platform, OS: Intel ® Core™ Processor (13세대), Windows 11
- Dynamic AMOLED 2X : 3K(2880 x 1800), 500nit(HDR), 120Hz, DCI-P3 120%
- 1080p FHD Camera (87도 와이드 앵글, 사용자 인식해 화면 중앙에 보여주는 Auto Framing지원)
- Quad SPK(AKG/Dolby, Max_5Wx2, 2Wx2), Studio Grade Dual Mic
- SSD: Gen4 SSD, Expendable SSD (M.2 2280)
- WiFi 6E 지원
- Battery: 16" 76Wh, 14" 63Wh
- Galaxy Apps: Quick Share, 2nd Screen, Multi-Control, Samsung Pass등
- Security : 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어 단계별 보안이 강화된 Secured-Core PC 지원
- ☐ Galaxy Book3 360 (2023.02.)
- 인치: 15.6" FHD Super AMOLED (16:9), up to 500nit(HDR), DCI-P3 120%
 - 13.3" FHD Super AMOLED (16:9), up to 500nit(HDR), DCI-P3 120%
- 사이즈(W x H x D) & 무게: 15.6" 355.4 x 228.0 x 13.7mm, 1.49kg

13.3" 304.4 x 202.0 x 12.9 mm, 1.16kg

- Platform, OS: Intel ® Core™ Processor (13세대), Windows 11
- sAMOLED: 1080p FHD, 500nit(HDR), 60Hz, DCI-P3 120%
- S Pen & Touchscreen support
- 1080p FHD Camera (87도 와이드 앵글, 사용자 인식해 화면 중앙에 보여주는 Auto Framing지원)
- Stereo SPK(Dolby, 2Wx2), Studio Grade Dual Mic
- SSD: Gen4 Dramless SSD, Expendable SSD (15.6")
- WiFi 6E 지원
- Battery: 15.6" 68Wh, 13.3" 61.1Wh
- Galaxy Apps: Quick Share, 2nd Screen, Multi-Control, Samsung Pass등
- Security : 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어 단계별 보안이 강화된 Secured-Core PC 지원
- ☐ Galaxy Book4 Ultra (2024.01.)
 - 인치: 16"WQXGA+ AMOLED (16:10) Touch Screen, Anti-Reflective
 - 사이즈(W x D x H) & 무게: 355.4 x 250.4 x 16.5mm, 1.86kg
- Platform, OS: Intel® Core™ Ultra Processor, Windows 11
- Dynamic AMOLED 2X: 3K(2880x1800), 120Hz, 컬러볼륨 120% (DCI-P3 기준), 500nit(HDR)
- 그래픽: NVIDIA® GeForce RTX™ 4050/4070
- AKG 쿼드 스피커(우퍼 Max 5W x 2, 트위터 2W x 2), Smart Amp, Dolby Atmos®, 2M

Camera

- Memory, SSD: LPDDR5X, NVMe SSD
- Bluetooth v5.3, WiFi 6E, 802.11 ax 2x2
- Battery: 76Wh(Typical)

	☐ Galaxy Book4 Pro 360 (2024.01.)
	- 인치 : 16"WQXGA+ AMOLED (16:10) Touch Screen, Anti-Reflective, S펜 지원
	- 사이즈(W x H x D) & 무게 : 355.4 x 252.2 x 12.8mm, 1.66kg
	- Platform, OS: Intel® Core™ Ultra Processor, Windows 11
	- Dynamic AMOLED 2X : 3K(2880x1800), 120Hz, 컬러볼륨 120% (DCI-P3 기준), 500nit(HDR),
	S펜
	- 그래픽:Intel® Arc™ Graphics
	- AKG 쿼드 스피커(우퍼 Max 5W x 2, 트위터 2W x 2), Smart Amp, Dolby Atmos®, 2M
	Camera
	- Memory, SSD: LPDDR5X, NVMe SSD
	- Bluetooth v5.3, WiFi 6E, 802.11 ax 2x2
	- Battery : 76Wh(Typical)
Ī	□ Galaxy Book4 Pro (2024.01.)
	- 인치 : 16"WQXGA+ AMOLED (16:10) Touch Screen, Anti-Reflective
	14"WQXGA+ AMOLED (16:10) Touch Screen, Anti-Reflective
	- 사이즈(W x H x D) & 무게 : 16"355.4 x 250.4 x 12.5mm, 1.56kg
	14"312.3 x 223.8 x 11.6mm, 1.23kg
	- Platform, OS : Intel® Core™ Ultra Processor, Windows 11
	- Dynamic AMOLED 2X : 3K(2880x1800), 120Hz, 컬러볼륨 120% (DCI-P3 기준), 500nit(HDR)
	- 그래픽:Intel® Arc™ Graphics
	- AKG 쿼드 스피커(우퍼 Max 5W x 2, 트위터 2W x 2), Smart Amp, Dolby Atmos®, 2M
	Camera
	- Memory, SSD: LPDDR5X, NVMe SSD
	- Bluetooth v5.3, WiFi 6E, 802.11 ax 2x2
	- Battery: 16"76Wh, 14"63Wh (Typical)
-	□ Galaxy Book4 Edge (2024.06.)
	- 인치 : 16"WQXGA+ AMOLED (16:10) Touch Screen, Anti-Reflective
	14"WQXGA+ AMOLED (16:10) Touch Screen, Anti-Reflective
	- 사이즈(W x H x D) & 무게 : 16"355.4 x 250.4 x 12.3mm, 1.56kg
	14"312.3 x 223.8 x 10.9mm, 1.19kg
	- Platform, OS: Qualcomm Snapdragon X Elite (12 core), Windows 11
	- Dynamic AMOLED 2X : 3K (2880x1800), 120Hz, 컬러볼륨 120% (DCI-P3 기준), 400nit (HDR)
	- 그래픽 : Qualcomm Adreno
	- AKG 쿼드 스피커 (Max 5W x 4), AKG, Dolby Atmos, 2M Camera
	- Memory, SSD: 16GB, eUFS 512GB SSD
	- Bluetooth v5.3, WiFi 7, 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be
	- Battery: 16"60.6Wh, 14"55.9Wh
	- Next Gen AI PC 시장 선도를 위한 AI 기능 탑재
	Galaxy Watch5 & Galaxy Watch5 Pro (2022.08.)
	- 인치 : Watch5 Pro (46mm) : 34.6mm AMOLED (450 x 450) 330PPI
	Watch5 (44mm) : 34.6mm AMOLED (450 x 450) 330PPI
Galaxy 워치	Watch5 (40mm) : 30.4mm AMOLED (396 x 396) 330PPI
(~2023.08.)	- 사이즈(W x H x D) & 무게 : Watch5 Pro (46mm) : 45.4 x 45.4 x 10.5 mm, 46.5g
	Watch5 (44mm) : 44.4 x 43.3 x 9.8 mm, 33.5g
	Watch5 (40mm) : 40.4 x 39.3 x 9.8 mm, 28.7g
	- Platform(H/W, S/W): Exynos W920, Wear OS Powered by Samsung (Wear OS 3.5)
	- 사파이어 크리스탈 디스플레이 적용한 시그니처 원형 디자인

		- 진화된 바이오액티브 센서 탑재로 더 강력해진 통합 건강 관리 기능
		• 체성분, 심박, 혈압, 심전도 정확도 개선 및 수면 관리 기능 강화
		- Wear OS 기반의 'One UI Watch 4.5' 탑재하여 다양한 구글 모바일 서비스와 앱 활용
		- 프리미엄 소재 티타늄 바디, 향상된 GPS 성능으로 아웃도어 스포츠에 최적화 (Watch5 Pro)
		·기능 향상과 내구성 제고하여 하이킹/싸이클링과 같은 아웃도어 스포츠 활용도 제고
		·마그네틱 D-버클 스포츠 밴드 제공하여 내구성, 편의성 및 스타일리시한 모습 연출
		· 경로운동(Route Workout) 및 GPX(GPS Exchange Format) 파일 이용한 운동경로 저장 및 공유
		・트랙백(Track back) 기능 통해 지나왔던 길찾기 제공
		· 큰 용량 배터리(590mAh) 적용으로 장시간 아웃도어 활동 가능
		☐ Galaxy Watch6 / Galaxy Watch6 Classic(2023.08.)
		- 인치 : Watch6 Classic (47mm) : 37.3mm Super AMOLED (480 x 480)
		Watch6 Classic (43mm): 33.3mm Super AMOLED (432 x 432)
		Watch6 (44mm) : 37.3mm Super AMOLED (480 x 480)
		Watch6 (40mm) : 33.3mm Super AMOLED (432 x 432)
		- 사이즈(W x H x D) & 무게:Watch6 Classic (47mm):46.5 x 46.5 x 10.9 mm, 59.0g
		Watch6 Classic (43mm): 42.5 x 42.5 x 10.9 mm, 52.0g
		Watch6 (44mm) : 44.4 x 42.8 x 9.0 mm, 33.3g
		Watch6 (40mm) : 40.4 x 38.8 x 9.0 mm, 28.7g
		- Platform(H/W, S/W): Exynos W930, Wear OS Powered by Samsung (Wear OS 4)
		- 시인성 향상을 구현한 디자인과 성능
		·전작 대비 베젤 축소 및 약 20% 넓어진 대화면 구현
		・고해상도 Super AMOLED 디스플레이 탑재 및 최대 2,000니트 밝기 지원
		- 강화된 수면 관리 경험 제공
		· 수면 점수를 구성하는 요인을 항목별 심층 분석 및 종합하여 수면 점수 제공
		· 향상된 맞춤형 수면 코칭 프로그램 제공
		 - 보다 개인화된 피트니스 관리 기능 등 신기능 추가
		·심폐 역량에 따라 5가지 심박수 구간 측정으로 사용자에 개인화된 운동 가이드 제공
		· 트랙 달리기 기능으로 레인 지정 등 트랙 운동 기록
		·불규칙 심장 리듬 알림 기능 적용
		- One-Click 밴드 적용으로 보다 쉽고 편리하게 워치 스트랩 교체
		- 배터리 용량 확대로 실사용 성능 강화
		· 47/44mm 425mAh. 43/40mm 300mAh 적용
		☐ Galaxy Buds 2 Pro (2022.08.)
		- 24bit 고품질 Hi-Fi 사운드와 편안한 착용감을 제공하는 커널 타입Premium TWS
		- 사이즈(W x H x D) : (Earbuds) 21.6mm x 19.9mm x 18.7mm
		(Cradle) 50.2mm x 50.1mm x 27.7mm
		- Platform(H/W, S/W) : BES2700YP 1Chip솔루션, RTOS
		·당사 Buds 최초24bit/48kHz Hi-Fi기술 적용하여 원본 음질 손실을 최소화한
	Galaxy 버즈	고품질 사운드 경험All High-SNR MIC, 소음 제거 솔루션과 대화 감지 기술을 적용한 Intelligence ANC
	(~2022.08.)	·멀티 채널 오디오와 향상된 헤드 트래킹 기술을 통해 현장감 있는 360 Audio 청취 경험 강화
		• 멀티 제골 포디포과 항경된 에르 트네싱 기술을 통해 면정함 있는 300 Audio 경취 경험 경화 • 개선된 VPU와 개인화 Beamforming 기술을 통해 또렷하고 향상된 통화 음질 제공
		- 개선된 VFO과 개선와 Bealmonning 기술을 통해 포봇하고 항상된 통화 음을 제공 - 인체공학적 디자인을 통해 편안하고 안정감 있는 착용감 제공
		- 현세공약적 디자인을 통해 편안하고 현영감 있는 작용감 제공 • 전작 대비 15% 작아진 기기 사이즈와 개선된 통기홀 구조를 적용하여 착용감 개선
		- Galaxy Device간 쉬운 연결을 통한 사용 경험 강화 ·오토 스위치 기능 제공을 폰, 태블릿, 워치에서 TV로 확장하고 쉽고 빠르게 기기 전환
	DANI C/M	
네트워크	RAN S/W	□ vRAN* SW Package (2023.11.)
	Package	* vRAN(virtualized RAN):가상화 기지국

		i	T
			- 당사 vRAN SW Package에 l社 4세대 CPU 연동 개발로 업계 최초 vRAN 상용망 적용
			· 당사는 3세대 CPU를 활용한 vRAN 대규모 상용을 旣완료한데 이어,
			4세대 CPU를 적용한 vRAN으로 상용망에서 data call 성공
			☐ 5G vRAN SW PKG (2024.06.)
		(~2024.06.)	- RedCap Energy-saving 기능 시험 완료(5G IoT 디바이스의 전력 소모를 줄이는 기능 시험)
			·업계 최초로 vRAN 기반 5G RedCap Energy-saving 기술 시험 완료
			・당사는 vRAN RedCap 기술 검증(美 vRAN 상용망 등)을 이어오고 있으며,
			향후 tRAN, vRAN 모두 상용 기능 제공할 계획
			* RedCap(Reduced Capability) : 5G 저전력 사물 인터넷(IoT) 기술
			□ 국내 3.5GHz NR 32T32R TDD MMU (2022.02.)
			- 당사 최초 Mechanical PSA(Phase Shift Antenna) 적용
			* 안테나 기울기(Tilt 0~12°)를 MMU 내부에서 Motor로 자동 제어
			□ 고성능 RFIC + DFE 통합 Chip 개발 (2022.04)
			* RFIC(Radio Frequency Integrated Circuit): 무선통신에 적합한 고주파 집적 회로
			* DFE(Digital Front End): 통신을 위한 Digital 신호처리의 마지막 단계
			□ Dish형 FDD RU 2종(Dual Band/Tri Band RU) (2022.09)
			- ORAN 표준을 준수하고 여러 주파수 대역을 동시에 지원하는 5G FDD RU 제품 개발
			* RU 지원 주파수: n71(600MHz), n29(700MHz), n66(AWS: 1.7GHz/2.1GHz), n70(AWS:
			1.7GHz/1.9GHz)
		기지국	
			Gen.3 Dual Band NR 2T2R AU (2022.10.)
		(~2023.05.)	- 세계 최초 Dual Band(28GHz+39GHz) AU 개발
			- 기존 2세대 AU 대비 동일 사이즈에 출력 2배 향상, 용량 2배 확대로 제품 성능 개선
			□ 국내 3.5GHz NR 64T64R MMU (2022.11.)
			- 국내向 최초 상용 64T64R Massive MIMO MMU 개발
			- 기존 국내向 32T32R MMU(구형) 대비 Antenna Element 2배 증가, 출력 2.7배 증가
			3.5GHz CBRS NR Strand Smallcell (2023.03.)
			- 당사 최초 상용 Strand Smallcell(전선 설치형 소형 기지국) 개발
			- Digital Unit, Radio Unit, 안테나 기능을 하나의 form factor로 제공하는 기지국
			- 당사가 자체 개발한 최신 2세대 5G 모뎀칩(5G Modem SoC) 탑재하여, 전선 위 설치 가능하도록 소형화
			□ 북미向 C-band NR 64T64R MMU (2023.05.)
			- 1세대 대비 고출력화, 소형화, 경량화, 저전력화 개발
			□ 업계 최초 LPCAMM 개발
			- LPDDR 기반 모듈 개발로 PC·노트북 등 차세대 모듈 시장 선도
		모바일용 DRAM	- SO-DIMM 대비 성능 50%↑ 전력 효율 70%↑ 탑재 면적 최대 60% 이상↓ 가능 및
		(2023.09.)	교체·업그레이드 용이하여 제조 유연성 및 사용자 편의성 증대
			- 주요 고객사와 차세대 시스템에서 검증 예정, 2024년 상용화 추진 및
			차세대 PCㆍ노트북부터 데이터센터 등으로 응용처 확대 기대
			□ 업계 최선단 12나노급 D램 개발
			- 업계 최초로 '12나노급 16Gb DDR5 D램' 개발, 차세대 컴퓨팅 서비스에 최적화된 '고성능ㆍ
DS 부문	메모리		저전력' 특성 확보
			- 기존 대비 소비전력 약 23% 감소, 생산성 약 20% 향상
		서버용 DRAM	- 2023년 양산 돌입으로 고객의 차세대 시스템에 최적의 메모리 솔루션 제공, 데이터센터, 인공지
		(2022.12.	능, 차세대 컴퓨팅 등
		~2023.09.)	응용처 확산 기대
			□ 업계 최선단 12나노급 D램 양산
			- 14나노 D램 대비 생산성 향상 및 저전력 특성 개선으로 생산성 약 20% 향상, 소비전력 약 23% 감소로
			차세대 컴퓨팅 최적화

(2022.07. ~2023.07.) Package) 기술을 통해 구현된 제품 - GDDR6와 동일한 크기의 패키지로 성능(대역폭) 2배와 용량 2배를 구현 □ 업계 최초 GDDR7 D램 개발 - 업계 최고 속도 32Gbps GDDR7 D램 개발로 기존 24Gbps GDDR6 대비 성능 1.4배, 전력 효율 20% - 패키지 신소재 적용・회로 설계 최적화로 고속 동작시 발열 최소화 - 연내 주요 고객사의 차세대 시스템에서 검증 예정, 적기 상용화로 차세대 그래픽카드. 고성능 컴퓨팅(HPC), 인공지능(Al) 등 응용처 확대 □ HBM-PIM과 GPU를 함께 탑재한 Al용 가속기 구현 - AMD의 GPU 가속기 카드에 HBM-PIM 메모리를 탑재하여 HBM-PIM Cluster 구현 - HBM-PIM을 활용하지 않은 기존 GPU 가속기 대비, 평균 성능 약 2배 증가, 에너지 소모는 약 50%가 - HBM-PIM 탑재한 가속기를 지원하는 소프트웨어 준비도 병행중으로, 향후 고객들은 통상 소프트웨어 환경에서 PIM 메모리 솔루션을 사용할 것으로 기대 □ Al 기술 혁신을 이끌 초고성능 HBM3E D램 '샤인볼트(Shinebolt)' 공개 - 데이터 입출력 핀 1개당 최대 9.8Gbps의 고성능을 제공하며, 이는 초당 최대 1.2TB 이상의 데이터를 처리할 수 있는 속도 - NCF(Non-conductive Film) 기술 최적화를 통해 집 사이를 빈통없이 채워 고단 적층을 구현했으며,			
다양한 등용처에 공급 예정 다양한 등용처에 공급 예정 다양한 등용처에 공급 예정 다양한 등용처에 공급 이 1286명 모듈 제작 가능 및 12나노급 16Gb 기반 등의 용량의 모듈 대비소비 전략 10% 개선 - A에 최적하고 교육한 이 1286명 모듈 제작 가능 및 12나노급 16Gb 기반 등의 용량의 모듈 대비소비 전략 10% 개선 - A에 최적하고 교육한 이 점 농구선 제공, 176 모듈 구현 가능 - 연내 용산 예정으로서, 차세대 검포팅 등 다양한 등용처 공급 예정 다양자 제품 대비성능 30% 이상 높여 존단 최대 1.17만 데이터 자리, 1,1V 동작간의 자원, 전략 효율 20% 높여 인용한 교객 요구 중후 - 국제 반도제 표요의 가구 JEDEC의 표준가격 준수에 교환이 부전 - 자네대 그래막카드, 연공자들(시), 고실능 컴퓨터(HPC) 등 음용제 확대 [2022.07, -2023.07.) - 2023.07.) - 2023.07.) - 2023.07.) - 2023.07.) - 2024.07.) - 2024.07. - 전비 주요 고객식의 자세대 시스템에서 감독 예정, 추가 산염으로 자세대 그래픽카드, 고실능 검색에 최목회로 고속 등작시 발생 최소회 - 언내 주요 고객식의 자세대 시스템에서 감독 예정, 추가 산염으로 자세대 그래픽카드, 고실능 검색에 최목회로 지속 12명 최소회 - 언내 주요 고객식의 자세대 시스템에서 감독 예정, 추가 산염으로 자세대 그래픽카드, 고실능 검색에 최목회로 고속 등작시 발생 최소회 - 언내 주요 고객식의 자세대 시스템에서 감독 예정, 추가 산염으로 자세대 그래픽카드, 고실능 검색에 취임되는 경우 가속기 구현 - AMD의 GPU 가속기 가드에 HBM-PHM 해모리를 합재하여 HBM-PHM Cluster 구현 - HBM-PHM 등대한 가속기를 지원하는 소프트웨어 준비도 병화중으로, 창후 고객들은 등대소 프로웨어 환경에서 PHM 메모리 소후선을 사용할 것으로 기대 다시한 실착에서 미대 마리 기속 핵심을 이끌 조고실능 및 제공하여, 이는 조성 최대 1.2TB 이상의 데이터를 처리할 수 있는 속도 - NCF(Non-conductive Film) 가속 최적화를 통해 집 사이를 반들없이 채워 고단 작용을 구현했으며, - 100년 입원력 관계 1.2TB 이상의 데이터를 처리할 수 있는 속도 - NCF(Non-conductive Film) 가속 최적화를 통해 집 사이를 반들없이 채워 고단 작용을 구현했으며, - 100년 20급속 관계 1.2TB 이상의 데이터를 처리할 수 있는 속도 - NCF(Non-conductive Film) 가속 최적화를 통해 집 사이를 반들없이 채워 고단 작용을 구현했으며,			- 고유전율 신소재 적용 커패시터 등 최신 기술 적용 최선단 공정 완성
□ 현존 최대 용량 32Gb D065 O램 개발 - 1983년 64Kb D램 개발 40년만에 용량 50만에 확대 - 1993년 64Kb D램 개발 40년만에 용량 50만에 확대 - 1993년 64Kb D램 개발 40년만에 용량 50만에 확대 - 199 공형 영합 128GB 모듈 제작 가능 및 12나누급 16Gb 기반 6월 8량의 모듈 대비 소비 전략 10% 개선 - 시에 최적화된 고용량 D행 출략선 제공. 1TB 모듈 구현 가능 - 면비 명선 예업으로서, 자세대 컴퓨팅 등 다양된 결렇지 골급 예정 - 1년에 정신 예업으로서, 자세대 컴퓨팅 등 다양된 결렇지 골급 예정 - 1년에 전신 예업으로서, 자세대 검류당 등 다양된 결렇지 골급 예정 - 11.1V 동경조업 지원, 관련 6월 20% 높여 129한 고객 요구 중목 - 구제 면도제 표준화 가구 JEDEC의 표준규격 준수해 호환성 확보 - 자세대 그래픽카드, 인공자들(A), 고경병 등록하(FPC) 등 응용처 확대 - 검색 무료자 대로와 가구 JEDEC의 표준규격 준수해 호환성 확보 - 자세대 그래픽카드, 인공자들(A), 고경병 등록하(FPC) 등 응용처 확대 - 경인 제기 최고를 통용한 그래픽 매모리 GD0R6W 개발 - GD0R6W는 세로운 메모리 칩 다이(네e)의 개발 없이 작품, 조립 기술인 FOWLP(Fan-Out Wafer love Package) 기술을 함께 구원된 제품 - GD0R6W는 세로운 메모리 칩 다이(네e)의 개발 없이 작품, 조립 기술인 FOWLP(Fan-Out Wafer love Package) 기술을 함께 구원된 제품 - GD0R6W는 세로운 메모리 칩 다이(네e)의 개발 없이 작품, 조립 기술인 FOWLP(Fan-Out Wafer love Package) 기술을 함께 구원된 제품 - GD0R6W는 시료로 메모리 칩 다이(네e)의 개발 없이 작품, 조립 기술인 FOWLP(Fan-Out Wafer love Package) 기술을 함께 구원된 제품 - GD0R6W는 시료로 메모리 집 다이(네e)의 개발 없이 작품, 조립 기술인 FOWLP(Fan-Out Wafer love Package) 기술을 함께 구원된 제품 - GD0R6W는 시료로 메모리 집 다이(네e)의 개발 없이 작품, 조립 기술인 FOWLP(Fan-Out Wafer love Package) 기술을 함께 구원된 제품 기원 기원 의 기원 의용 기원 등을 기원			- 대용량 컴퓨팅 시장 수요에 맞는 고성능, 고용량 D램 솔루션 제공 및 12나노급 D램 라인업 확대해,
- 1983년 64kb D렌 개발 40년만에 용량 50만배 확대 - TSV 광정 적용 없이 1260명 모듈 제작 가능 및 12나노급 160b 기반 동일 용안의 모듈 대비소비 전력 10% 개선 - A에 최적확인 지용한 D형 슬픈런 제공, 1TB 모듈 구현 가능 - 현내 양산 예정으로서, 채세대 광품명 등 대양한 흥용치 경급 예정 - 의세대 10나노급(12) 공장 적용으로 얻게 최초 24Gbps 구현 - 기존 제품 대비 성능 50% 이상 높여 초당 최대 1.1TB 대이터 처리, 1.1V 등작전압 지원, 전역 효율 20% 높여 대양한 교객 요구 충족 - 국제 반도체 표준화 가구 JEDEC의 표준규격 준수해 호환성 확보 - 자세대 그래까기도, 안공지능(A), 고성능 업류당(HPC) 등 등용자 확대 - 최대 발로체 표준화 가구 JEDEC의 표준규격 준수해 호환성 확보 - 자세대 그래까기도, 안공지능(A), 고성능 업류당(HPC) 등 등용자 확대 - 최단 및 개설 기술을 활용한 그래액 때모리 GDDR6W 개발 - GDDR6W는 새로운 에모리 칩 대이(de)의 개발 없이 적충, 조립 가술인 FOWLP(Fan-Out Wafer level) - 기술을 통해 구원된 제품 - GDDR6와 등일한 크기의 폐기자로 성능(대역복) 2배명 용당 2배를 구현 - 번계 최초 GDDR7 D한 개발 - 업계 최고 속도 32Gbps GDDR7 D한 개반공 기준 24Gbps GDDR6 대비 성능 1.4배, 진략 휴율 20% - 패키지 선소재 작용 * 첫로 설계 최석화로 고송 등착시 발명 최소형 - 연내 주요 고객사의 차세대 시스템에서 김중 예장, 즉기 성용화로 자세대 그래픽카드, 고성능 컴퓨팅(HPC), 인공지능(A) 등 공용처 확대 - HBM-PIM과 GPU를 함께 당재한 사용 가속기 구원 - AMD의 GPU 가속기 카드에 HBM-PIM 때문의를 탑재하여 HBM-PIM Cluster 구현 - HBM-PIM를 합용하지 않은 기준 GPU 가속기 마비, 문과 성능 역 개념 중가, 에너지 소만는 약 50%가 - HBM-PIM 답재한 가속기를 지원하는 소프트웨어 준비도 병행중으로, 향후 고객들은 등1 소프트웨어 환경에서 - PIM 메모리 슬루션을 사용할 것으로 기대 - AI 기술 혁신을 이끌 조고성능 HBM3E D템 '시인뿔트(Shtinebolt)' 공개 - GI이터 입출적 편 1개당 최대 9.86bps의 고성능을 제공하며, 이는 조당 최대 1.2TB 이상의 데이터를 처리할 수 있는 속도 - NCF(Non-conductive Film) 가술 최적회를 통해 칩 사이를 만들었어 제된 고단 작품을 구현했으며, - 2024 02.2)			다양한 응용처에 공급 예정
- TSV 공장 적용 없이 128GB 오를 제작 가능 및 12나도급 16Gb 기반 동일 용량의 오름 대비 소비 진략 10% 개선 - A에 철적화된 고용량 DI의 솔루션 제공, 1TB 모듈 구현 가능 - 언내 양션 예성으로시, 차세대 컴퓨터 등 다양한 음용점 골급 예정 □ 업계 최고 속도 GDDR6 D령 개발 - 3세대 10나도급(12) 공전 작용으로 업계 최조 24Gbps 구현 - 기존 제품 대비 성능 30% 이상 농여 초당 최대 1.1TB 대미터 처리. 1.1V 종작전압 지원, 전략 효율 20% 높여 다양한 고객 요구 충족 - 국제 반도제 표준회 가구 JEDEC의 표준가격 순수에 요환성 확보 - 지세대 그래픽카드, 인공지능(AI), 고성능 컴퓨팅(HPC) 등 응용제 확대 □ 증단 패기경 기술을 출용한 그래픽 메모리 GDDR6W 개발 - GDDR6W는 세포운 메모리 칩 다이(de)의 개발 없이 작용, 조립 기술인 FOWLP(Fan-Out Wafer leve Package) 기술을 통해 구런던 제품 - GDDR6W는 동일한 크기의 패키지로 성능(대목목) 2배와 용량 2배를 구현 □ 함께 최조 속도 32Gbps GDDR7 D점 개발로 기준 24Gbps GDDR6 대비 성능 1.4배, 전략 효율 20% - 패키지 선소체 작용・회로 설계 최적회로 고속 녹작시 발의 최소회 - 언내 주요 고객사의 자세대 시스템에서 감증 예정, 작가 상용화로 자세대 그래픽카드, 고성능 컴퓨팅(HPC), 인공지능(AI) 등 응용제 확대 □ HBM-PIM과 GPU를 함께 함께는 AI를 가수기 구든 - AMD의 GPU 가속가 카드에 HBM-PIM 매모리를 탑재하여 HBM-PIM Cluster 구현 - HBM-PIM를 합용하지 않은 기존 GPU 가속기 다비, 판균 성능 역 2배 증가, 에너지 소요는 약 50%가 - HBM-PIM 답재한 가속기를 지원하는 소프트웨어 준비도 병행중으로, 향후 고객들은 통한 소프트웨어 환경에서 - PIM 메모리 슬루션을 사용할 것으로 기대 □ AI 기술 확신을 이끌 출고성능 HBM3E D점 '샤인볼트(Shinebolt)' 공계 - 데이터 입출력 핀 1개당 최대 9.86bps의 고성능을 제공하며, 이는 초당 최대 1.2TB 이상의 데이터를 처리할 수 있는 속도 - NCF(Non-conductive Film) 기술 최적용을 통해 집 사이를 반들없어 채워 고단 작용을 구현했으며, - 2024 시2.)			□ 현존 최대 용량 32Gb DDR5 D램 개발
으를 대비 소비 전력 10% 개선 - 시에 최적화된 고용함 D램 솔루션 제공, 178 모듈 구현 가능 - 언내 양산 예정으로시, 차세대 컴퓨팅 등 다양한 응용치 공급 예정 - 합계 최고 속도 GDDR6 D램 개발 - 3세대 10년노급(12) 경경 제용으로 업계 최초 24Gbps 구현 - 기존 제품 대비 성들 30% 보여 다양한 고객 요구 충족 - 기존 제품 대비 성들 30% 보여 다양한 고객 요구 충족 - 국제 반도체 표준화 기구 JEDECO의 표준규격 준수해 호현성 확보 - 자세대 그래바키드 한당지능(A), 고성능 합리왕(바이 등 용용치 확대 - 점단 표기점 기술을 활용한 그래픽 메모리 GDDR6W 개발 - GDDR6W는 새로운 해모리 집 다이(de)의 개발 없이 작용, 조립 기술인 FOWLP(Fan-Out Wafer level Package) 기술을 통해 구현된 제품 - GDDR6W는 새로운 해모리 집 다이(de)의 개발 없이 작용, 조립 기술인 FOWLP(Fan-Out Wafer level Package) 기술을 통해 구현된 제품 - GDDR6W는 세로운 해모리 집 다이(de)의 개발 없이 작용, 조립 기술인 FOWLP(Fan-Out Wafer level Package) 기술을 통해 구현된 제품 - GDDR6W는 세로운 해모리 집 다이(de)의 개발 없이 작용, 조립 기술인 FOWLP(Fan-Out Wafer level Package) 기술을 통해 구현된 제품 - GDDR6W는 세로운 해모리 집 다이(de)의 개발 없이 작용, 조립 기술인 FOWLP(Fan-Out Wafer level Package) 기술을 통해 구현된 제품 - GDDR6W는 세로운 해모리 함께 최적화로 고속 독식시 발명 최소회 - 언내 주요 고객사의 차세대 시스등에서 검증 매명, 직기 상용화로 자세대 그래픽키드, 고성능 컴퓨팅(HPC), 인공자능(시) 등 응용제 확대 - HBM-PIM과 GPU를 함께 문제된 사용 가속기 구원 - 서M인 GPU 가속기 카드에 HBM-PIM 메로리를 탑재하여 HBM-PIM Cluster 구현 - HBM-PIM를 활용하지 않은 기준 GPU 가속기 대비, 평균 성능 약간에 증가, 에너지 소문는 약 50%가 - HBM-PIM를 활용하지 않은 기준 GPU 가속기 가원 - HBM-PIM를 함께하고 가속기를 지원하는 소프트웨이 준비도 병령증으로, 향후 고객들은 동1 소프트웨이 환경에서 - PIM 데오리 솔루션을 사용할 것으로 기대 - 데이터 입출적 편 1개당 최대 9.8Gbps의 고성능을 제공하며, 이는 초단 최대 1.2TB 이상의 데이터를 처리할 수 있는 속도 - NCF(Non-conductive Film) 기술 최적화를 통해 집 사이를 반응없이 채워 고단 적용을 구현했으며, ~ 2024.02.)			- 1983년 64Kb D램 개발 40년만에 용량 50만배 확대
- AI에 최적확단 고용형 O템 솔루션 제공, 1TB 모듈 구현 가능 - 언내 양산 예정으로시, 차세대 컴퓨팅 등 다양한 응용처 공급 예정 □ 암계 최고 속도 GDDR6 D럼 개발 - 3세대 10나노급(12) 공정 적용으로 업계 최초 24Gbps 구현 - 기존 제품 대비 성능 30% 이상 높여 초당 최대 1.1TB 데이터 처리, 1.1V 동작전압 지원, 전략 효율 20% 높여 다양한 고객 모구 충족 - 국제 반도체 표준화 기구 JEDEC의 표준규격 존수해 호환성 확보 - 차세대 그래라가드, 인공지능(AI), 고성능 컴퓨팅(HPC) 등 응용처 확대 □ 라당 폐기정 기술을 활용한 그래픽 메모리 GDDR6W 개발 - GDDR6W는 새로운 매모리 집 다이(dis)의 개발 없이 작충, 조립 기술인 FOWLP(Fan-Out Wafer leve Package) 기술을 통해 구현된 제품 - GDDR6와 동일한 크기의 패키지로 성능(대역목) 2배와 용량 2배를 구현 □ 암계 최초 GDDR7 D램 개발 - 암계 최소 역도 32Gbps GDDR7 D램 개발로 기존 24Gbps GDDR6 대비 성능 1.4배, 전략 효율 20% - 패키지 선소재 적용・회로 실계 최적화로 고속 통작시 발일 최소화 - 언내 주요 고객식의 자세대 시스템에서 검증 예정, 작기 상용화로 자세대 그래핑키드, 고성능 컴퓨팅(HPC), 인공지능(AI) 등 등용처 확대 □ H6M-PIM과 GPU를 함께 담재한 사용 기속기 구현 - AMD의 GPU 가속기 카드에 HBM-PIM 메모리를 함께하여 HBM-PIM Cluster 구현 - HBM-PIM을 활용하지 않은 기존 GPU 가속기 대비, 평균 성능 약 2배 증가, 에너지 소모는 약 50%가 - HBM-PIM를 함께 함께 가속기를 지원하는 소프트웨어 준비도 병행증으로, 향후 고객들은 통대 소프트웨어 환경에서 PIM 메모리 솔루션을 사용할 것으로 기대 □ AI 기술 핵산을 이끌 초고성능 HBM3E D램 '샤인볼트(Shinebolt)' 공개 - 데이터 입출적 만 1개당 최대 9.8Gbps의 고성능을 제공하며, 이는 조당 최대 1.2TB 이상의 데이터를 처리할 수 있는 속도 - NOF(Non-conductive Film) 기술 최적화를 통해 참 시의를 반급없어 재계 고단 작용을 구현됐으며.			- TSV 공정 적용 없이 128GB 모듈 제작 가능 및 12나노급 16Gb 기반 동일 용량의
- 선내 양산 예정으로시, 차세대 컴퓨팅 등 다양한 응용처 공급 예정 □ 업계 최고 속도 GDDR6 D펜 개발 - 3세대 10나노급(12) 골집 적용으로 업계 최초 24Gbps 구현 - 기존 제품 때비 성능 30% 이상 높여 초당 최대 1.1TB 데이터 처리. 1.1V 품작전합 지원, 전력 용을 20% 높여 다양한 고객 요구 총독 - 국제 반도제 표준화 기구 JEDEC의 표근구격 윤수해 호환성 확보 - 차세대 그레픽카드, 인공지능(A), 고성능 컴퓨팅(HPC) 등 응용처 확대 □ 라던 패키징 기술을 활용한 그래픽 메모리 GDDR6W 개발 - GDDR6W는 새로운 메모리 집 다이(dis)의 개발 없이 적충, 조립 기술인 FOWLP(Fan-Out Wafer leve Package) 기술을 통해 구현된 제품 - GDDR6W는 새로운 메모리 집 다이(dis)의 개발 없이 작충, 조립 기술인 FOWLP(Fan-Out Wafer leve Package) 기술을 통해 구현된 제품 - GDDR6W 동일한 크기의 패키지로 성능(대역적) 2배와 용량 2배를 구현 □ 업계 최소 속도 32Gbps GDDR7 D링 개발로 기준 24Gbps GDDR6 대비 성능 1.4배, 진력 효율 20% - 패키지 신소재 적용・회로 설계 최작화로 고속 동작시 말염 최소화 - 언내 주요 고객사의 자세대 시스템에서 검증 예정, 적기 상용화로 자세대 그래픽카드, 고성능 컴퓨팅(HPC), 인공지능(A) 등 응용처 확대 □ HBM-PIM과 GPU를 함께 답재한 사용 가숙기 구현 - 서MD의 GPU 가숙기 카드에 HBM-PIM 메모리를 탑재하여 HBM-PIM Cluster 구현 - HBM-PIM을 활용하지 않은 기존 GPU 가숙기 대비, 꿈균 성능 약 2배 증가, 에너지 소모는 약 50%가 - HBM-PIM을 함께 다가 숙기를 지원하는 소프트웨어 준비도 병행증으로, 향후 고객들은 동안 소프트웨어 환경에서 PIM 메모리 솔루션을 사용할 것으로 기대 □ AI 기술 혁신을 이끌 초고성능 HBM3E D램 '샤인볼트(Shinebolt)' 공개 - 데이터 입출력 편 1개당 최대 9.8Gbps의 고성능을 제공하여, 이는 조랑 최대 1.2TB 이상의 대이터를 처리할 수 있는 속도 - NCF(Non-conductive Film) 기술 최적화를 통해 집 사이를 반들없어 채워 고단 작용을 구현됐으며.			 모듈 대비 소비 전력 10% 개선
□ 업계 최고 속도 GDDR6 D램 개발 - 3세대 10나노급(12) 공장 작용으로 업계 최초 24Gbps 구현 - 기존 제품 대비 성능 30% 이상 높이 초당 최대 1.1TB 데이터 처리, 1.1V 동작진업 지원, 전력 효용 20% 높이 다양한 고객 요구 총족 - 국제 반도체 표준화 기구 JEDEC의 표준규격 준수해 호환성 확보 - 차세대 그래픽카드, 인공지능(AI), 고성능 컴퓨팅(HPC) 등 응용쳐 확대 경단 패키장 기술을 활용한 그래픽 메모리 GDDR6W 개발 - GDDR6W는 새로운 메모리 집 다이(die)의 개발 없이 적충, 조립 기술인 FOWLP(Fan-Out Wafer level Package) 기술을 통해 구현된 제품 - GDDR6와 플로한 크기의 패키지로 성능(대역폭) 2배와 용량 2배를 구현 □ 업계 최조 GDDR7 D램 개발 - 업계 최고 속도 32Gbps GDDR7 D램 개발로 기존 24Gbps GDDR6 대비 성능 1.4배, 전력 효용 20% - 패키지 신소재 작용・최로 설계 최적화로 고속 동작시 발명 최소화 - 언내 주요 고객사의 차세대 시스템에서 검증 애정, 적기 성용화로 자세대 그래픽카드, 고성능 컴퓨팅(HPC), 인공지능(AI) 등 응용채 확대 □ HBM-PIM과 GPU를 함께 퇴재한 사용 기속기 구현 - HBM-PIM를 환용하지 않은 기존 GPU 가속기 대비, 평균 성능 약 2배 증가, 에너지 소오는 약 50%가 - HBM-PIM를 환용하지 않은 기존 GPU 가속기 대비, 평균 성능 약 2배 증가, 에너지 소오는 약 50%가 - HBM-PIM 탑재한 가속기를 지원하는 소프트웨어 준비도 병행중으로, 향후 고객들은 등 1 소프트웨어 환경에서 - PIM 에모리 솔루션을 사용할 것으로 기대 □ AI 기술 혁신을 이끌 초고성능 HBM3E D램 '사인볼트(Shineboft)' 공개 - 데이터 입축력 판 1개당 최대 9.8Gbps의 고성능을 제공하며, 이는 초당 최대 1.2TB 이상의 데이터를 처리할 수 있는 속도 - NCF(Non-conductive Film) 가술 최작화를 통해 집 사이를 반응없어 재제 고단 작용을 구면했으며,			- AI에 최적화된 고용량 D램 솔루션 제공, 1TB 모듈 구현 가능
□ 업계 최고 속도 GDDR6 D램 개발 - 3세대 10나노급(12) 공경 작용으로 업계 최초 24Gbps 구현 - 기존 제품 대비 성능 30% 이상 높이 조당 최대 1.1TB 데이터 처리, 1.1V 동작집합 지원, 전력 효용 20% 높이 다양한 고객 요구 총족 - 국제 반도체 표준화 기구 JEDEC의 표준규각 준수해 호환성 확보 - 차세대 그래팍카드, 인공지능(A), 고성능 컴퓨팅(HPC) 등 응용처 확대 경廷 패키경 기술을 활용한 그래픽 메모리 GDDR6W 개발 - GDDR6W는 세로운 메모리 칩 다이(die)의 개발 없이 적충, 조립 기술인 FOWLP(Fan-Out Wafer level) - Package) 기술을 통해 구현된 제품 - GDDR6와 플로한 크기의 패키지로 성능(대역폭) 2배와 용량 2배를 구현 □ 업계 최조 GDDR7 D램 개발 - 업계 최고 속도 32Gbps GDDR7 D쯤 개발로 기존 24Gbps GDDR6 대비 성능 1.4배, 전력 효율 20% - 패키지 신소재 작용・회로 설계 최작화로 고속 동작시 발명 최소화 - 인내 주요 고객사의 차세대 시스템에서 검증 애정, 적기 성용화로 자세대 그래팩카드, 고성능 컴퓨팅(HPC), 인공지능(A) 등 응용처 확대 □ HBM-PIM를 증임시한 기속기 구현 - HBM-PIM를 환용하지 않은 기존 GPU 가속기 대비, 평균 성능 약 2배 증기, 에너지 소모는 약 50%가 - HBM-PIM를 환용하지 않은 기존 GPU 가속기 대비, 평균 성능 약 2배 증기, 에너지 소모는 약 50%가 - HBM-PIM 담재한 가속기를 지원하는 소프트웨어 준비도 병행중으로, 향후 고객들은 등(소프트웨어 환경에서 - PIM 에모리 솔루션을 사용할 것으로 기대 □ Al 기술 혁신을 이끌 초고성능 HBM3E D럼 '샤인볼트(Shineboft)' 공개 - 데이터 입율력 및 1개당 최대 9.6Gbps의 고성능을 제공하며, 이는 조당 최대 1.2TB 이상의 데이터를 처리할 수 있는 속도 - NCF(Non-conductive Film) 가술 최작화를 통해 집 사이를 반응되어 재계 고단 작용을 구현했으며,			- 역내 양산 예정으로AI 차세대 컴퓨팅 등 다양한 응용처 공급 예정
- 3세대 10나노급(12) 광장 작용으로 업계 최초 24Gbps 구현 - 기존 제품 대비 성능 30% 이상 능여 초당 최대 1.1TB 데이터 처리, 1.1V 동작집압 지원, 전력 효율 20% 높여 다양한 고객 요구 종족 - 국제 반도체 표준화 기구 JEDEC의 표준규격 준수해 호현성 확보 - 차세대 그래픽카드, 인광지능(A), 고성능 컴퓨팅(HPC) 등 용정처 핵대 경단 패키징 기술을 활용한 그래픽 메모리 GDDR6W 개발 - GDDR6W는 새로운 메모리 칩 다이(die)의 개발 없이 착충, 조립 기술인 FOWLP(Fan-Out Wafer leve Package) 기술을 통해 구현된 제품 - GDDR6와 동일한 크기의 패키지로 성능(대역폭) 2배와 용강 2배을 구현 □ 업계 최초 GDDR7 D점 개발 - 업계 최소 GDDR7 D점 개발 - 업계 최소 역당 23CBbps GDDR7 D점 개발로 기존 24Gbps GDDR6 대비 성능 1.4배, 진력 효율 20% - 패키지 신소재 작용・최로 설계 최적화로 고속 동작시 발절 최소화 - 연내 주요 고객사의 차세대 시스템에서 검증 예정, 적기 상용화로 자세대 그래픽카드, 고성능 컴퓨팅(HPC), 연골지능(A) 등 응용처 확대 □ HBM-PIM를 함께 함께 전원 (B) 가식기 구현 - AMD의 GPU 가속기 카드에 HBM-PIM 메모리를 등제하여 HBM-PIM Cluster 구현 - HBM-PIM을 활용하지 않은 기존 GPU 가속기 대비, 평균 성능 약 2배 증가, 에너지 소모는 약 50%가 - HBM-PIM를 함께한 가속기를 지원하는 소프트웨어 준비도 병행중으로, 향후 고객들은 동1 소프트웨어 환경에서 - PIM 메모리 솔루션을 사용할 것으로 기대 □ AI 기술 혁신을 이끌 초고성능 HBM3E D점 '사인볼트(Shinebolt)' 공개 - 데이터 입출적 및 1개당 최대 9.8Gbps의 고성능을 제공하여, 이는 조당 최대 1.2TB 이상의 데이터를 치리할 수 있는 속도 - NCF(Non-conductive Film) 기술 최적화를 통해 집 사이를 반응없이 채워 고단 적흥을 구현했으며.			
- 기존 제품 (대비 성능 30% 이상 높여 초당 최대 1.11B 데이터 처리. 1.1V 등작전암 지원. 전력 효율 20% 높여 다양한 고객 요구 총족 - 국제 반도체 표준화 기구 JEDEC의 표준규격 준수해 호환성 확보 - 차세대 그래픽카드, 인공지능(A). 고성능 컴퓨팅(HPC) 등 응용처 확대 - 참단 패키정 기술을 활용한 그래픽 메모리 GDDR6W 개발 - GDDR6W는 새로운 메모리 칩 다이(die)의 개발 없이 작충, 조립 기술인 FOWLP(Fan-Out Wafer level Package) 기술을 통해 구현된 제품 - GDDR6와 동일한 크기의 패키지로 성능(대역폭) 2배와 용량 2배를 구현 - 업계 최초 GDDR7 D램 개발 - 업계 최고 속도 32Gbps GDDR7 D램 개발로 기존 24Gbps GDDR6 대비 성능 1.4배, 전력 효율 20% - 패키지 신소재 적용・회로 설계 철적화로 고속 동작시 발일 최소화 - 연내 주요 고객사의 차세대 시스템에서 검증 예정, 적기 성용화로 차세대 그래픽카드, 고성능 컴퓨팅(HPC). 인공지능(AI) 등 응용처 확대 - HBM-PIM과 GPU를 함께 탑재한 시용 가속기 구현 - AMD의 GPU 가속기 카드에 HBM-PIM 메모리를 탑재하여 HBM-PIM Cluster 구현 - HBM-PIM을 활용하지 않은 기존 GPU 가속기 대비, 평균 성능 약 2배 증가, 에너지 소모는 약 50%가 - HBM-PIM를 활용하지 않은 기존 GPU 가속기 대비, 평균 성능 약 2배 증가, 에너지 소모는 약 50%가 - HBM-PIM를 함정해서 - PIM 메모리 솔루션을 사용할 것으로 기대 - 제 기술 혁신을 이끌 조고성능 HBM3E D램 '사인볼트(Shinebolt)' 공개 - 데이터 암출력 만 1개당 최대 9.650p의 고성능을 제공하여. 이는 초당 최대 1.2TB 이상의 데이터를 처리할 수 있는 속도 - NCF(Non-conductive Film) 기송 최적화를 통해 집 사이를 빈름없이 재워 고단 작용을 구현됐으며.			
1.1V 동작전압 지원, 전력 호흡 20% 높여 다양한 고객 요구 충족 - 국제 반도제 표준화 기구 JEDEC의 표준규격 준수해 호환성 확보 - 차세대 그래픽카드, 인공지능(AI), 고성능 컴퓨팅(HPC) 등 응용처 확대 □ 정단 패키경 기술을 활용한 그래픽 메모리 GDDR6W 개발 - GDDR6W는 새로운 메모리 칩 다이(die)의 개발 없이 작충, 조립 기술인 FOWLP(Fan-Out Wafer level Package) 기술을 통해 구현된 제품 - GDDR6W 등일한 크기의 패키지로 성능(대역쪽) 2배와 용량 2배를 구현 □ 업계 최초 GDDR7 D램 개발 - 업계 최고 속도 32Gbps GDDR7 D램 개발로 기존 24Gbps GDDR6 대비 성능 1.4배, 전력 효율 20% - 패키지 신소재 작용・최로 설계 최적화로 고속 동작시 발열 최소화 - 연내 주요 고객사의 차세대 시스템에서 검증 예정, 적기 상용화로			
- 국제 반도체 표준화 기구 JEDEC의 표준규격 준수해 호환성 확보 - 차세대 그래픽카드, 인공지능(AI), 고성능 컴퓨팅(HPC) 등 응용처 확대 □ 청단 패키정 기술을 활용한 그래픽 메모리 GDDR6W 개발 - GDDR6W는 새로운 메모리 집 다이(die)의 개발 없이 적충, 조립 기술인 FOWLP(Fan-Out Wafer level Package) 기술을 통해 구현된 제품 - GDDR6W는 용말한 크기의 패키지로 성능(대역쪽) 2배와 용량 2배를 구현 □ 업계 최초 GDDR7 D램 개발 - 업계 최소 GDDR7 D램 개발 - 업계 최소 숙도 32Gbps GDDR7 D램 개발로 기존 24Gbps GDDR6 대비 성능 1.4배, 진력 효율 20% - 패키지 신소재 적용・회로 설계 최적회로 고속 동작시 발열 최소화 - 연내 주요 고객사의 차세대 시스템에서 검증 예정, 작기 상용화로 차세대 그래픽카드, 고성능 컴퓨팅(HPC), 인공지능(AI) 등 응용처 확대 □ HBM-PIM과 GPU를 함께 탑재한 AI용 가속기 구현 - AMD의 GPU 가속기 카드에 HBM-PIM 메모리를 탑재하여 HBM-PIM Cluster 구현 - HBM-PIM를 활용하지 않은 기준 GPU 가속기 대비, 평균 성능 약 2배 증가, 에너지 소모는 약 50%가 - HBM-PIM를 환경하지 않은 기준 GPU 가속기 대비, 평균 성능 약 2배 증가, 에너지 소모는 약 50%가 - HBM-PIM를 환경에서 PIM 메모리 솔루션을 사용할 것으로 기대 □ AI 기술 혁신을 이끌 조고성능 HBM3E D램 '샤인볼트(Shinebolt)' 공개 - 데이터 압출력 판 1개당 최대 9.8Gbps의 고성능을 제공하며, 이는 초당 최대 1.2TB 이상의 데이터를 처리할 수 있는 속도 - NCF(Non-conductive Film) 기술 최적화를 통해 집 사이를 반들없이 재위 고단 적충을 구현됐으며.			
- 차세대 그래픽카드, 인공지능(AI), 고성능 컴퓨팅(HPC) 등 응용처 확대 청단 패키정 기술을 활용한 그래픽 메모리 GDDR6W 개발 GDDR6W는 새로운 메모리 칩 다이(die)의 개발 없이 적충, 조립 기술인 FOWLP(Fan-Out Wafer level Package) 기술을 통해 구현된 제품 GDDR6와 동일한 크기의 패키지로 성능(대역폭) 2배와 용량 2배를 구현 업계 최초 GDDR7 D램 개발 업계 최초 GDDR7 D램 개발 업계 최조 GDDR7 D램 개발로 기존 24Gbps GDDR6 대비 성능 1.4배, 전력 효율 20% 패키지 신소재 적용・회로 설계 최적화로 고속 동작시 발열 최소화 연내 주요 고객사의 차세대 시스템에서 검증 예정, 적기 상용화로 차세대 그래픽카드, 고성능 컴퓨팅(HPC), 인공지능(AI) 등 응용처 확대 HBM-PIM과 GPU를 함께 탑재한 AI용 가숙기 구현 AMD의 GPU 가숙기 카드에 HBM-PIM 메모리를 탑재하여 HBM-PIM Cluster 구현 HBM-PIM를 활용하지 않은 기존 GPU 가숙기 대비, 평균 성능 약 2배 증가, 에너지 소모는 약 50%가 HBM-PIM 함재한 가숙기를 지원하는 소프트웨어 준비도 병행중으로, 향후 고객들은 통태소프트웨어 환경에서 PIM 메모리 솔루션을 사용할 것으로 기대			
□ 최단 패키징 기술을 활용한 그래픽 메모리 GDDR6W 개발 - GDDR6W는 새로운 메모리 칩 다이(die)의 개발 없이 적흥, 조립 기술인 FOWLP(Fan-Out Wafer leve Package) 기술을 통해 구현된 제품 - GDDR6와 동일한 크기의 패키지로 성능(대역쪽) 2배와 용량 2배를 구현 □ 업계 최초 GDDR7 D랭 개발 - 업계 최고 속도 32Gbps GDDR7 D랭 개발로 기준 24Gbps GDDR6 대비 성능 1.4배, 전력 효율 20% - 패키지 신소재 적용・회로 설계 최적화로 고속 동작시 발열 최소화 - 연내 주요 고객사의 차세대 시스템에서 검증 예정, 적기 상용화로			
- GDDR6W는 새로운 메모리 집 다이(die)의 개발 없이 적흥, 조립 기술인 FOWLP(Fan-Out Wafer level (2022.07.) - 2023.07.) - 2023.07.) - 2023.07.) - 2023.07.) - 2023.07.) - 2023.07.) - 2023.07.) - 2023.07.) - 2023.07.) - 2024.02.10 3020.07.) - 3			- 차세대 그래픽카드, 인공지능(AI), 고성능 컴퓨팅(HPC) 등 응용처 확대
- GDDR6W는 새로운 메모리 칩 다이(die)의 개발 없이 적충, 조립 기술인 FOWLP(Fan-Out Wafer level Package) 기술을 통해 구현된 제품 - GDDR6와 동일한 크기의 패키지로 성능(대역폭) 2배와 용량 2배를 구현 □ 업계 최초 GDDR7 D랭 개발 - 업계 최소 속도 32Gbps GDDR7 D랭 개발로 기존 24Gbps GDDR6 대비 성능 1.4배, 전력 효율 20% - 패키지 신소재 적용・회로 설계 최적화로 고속 동작시 발열 최소화 - 연내 주요 고객사의 차세대 시스템에서 검증 예정, 적기 상용화로 차세대 그래픽카드, 고성능 컴퓨팅(HPC), 인공지능(AI) 등 응용처 확대 □ HBM-PIM과 GPU를 함께 탑재한 AI용 가속기 구현 - AMD의 GPU 가속기 카드에 HBM-PIM 메모리를 탑재하여 HBM-PIM Cluster 구현 - HBM-PIM을 활용하지 않은 기존 GPU 가속기 대비, 평균 성능 약 2배 증가, 에너지 소모는 약 50%가 - HBM-PIM을 활용하지 않은 기존 GPU 가속기 대비, 평균 성능 약 2배 증가, 에너지 소모는 약 50%가 - HBM-PIM을 함시한 가속기를 지원하는 소프트웨어 준비도 병행중으로, 향후 고객들은 통해소프트웨어 환경에서 PIM 메모리 솔루션을 사용할 것으로 기대 □ AI 기술 혁신을 이끌 초고성능 HBM3E D램 '샤인볼트(Shinebolt)' 공개 - 데이터 입출력 편 1개당 최대 9.8Gbps의 고성능을 제공하며, 이는 초당 최대 1.2TB 이상의 데이터를 처리할 수 있는 속도 - NCF(Non-conductive Film) 기술 최적화를 통해 집 사이를 반통없이 채워 고단 적충을 구현했으며,		그래픽 DRAM	□ 첨단 패키징 기술을 활용한 그래픽 메모리 GDDR6W 개발
Package) 기술을 통해 구현된 제품 - GDDR6와 동일한 크기의 패키지로 성능(대역폭) 2배와 용량 2배를 구현 □ 업계 최초 GDDR7 D램 개발 - 업계 최고 속도 32Gbps GDDR7 D램 개발로 기존 24Gbps GDDR6 대비 성능 1.4배, 전력 효율 20% - 패키지 신소재 적용・회로 설계 최적화로 고속 동작시 발열 최소화 - 연내 주요 고객사의 차세대 시스템에서 검증 예정, 적기 상용화로			- GDDR6W는 새로운 메모리 칩 다이(die)의 개발 없이 적층, 조립 기술인 FOWLP(Fan-Out Wafer level
기술을 통해 구현된 제품 - GDDR6와 동일한 크기의 패키지로 성능(대역폭) 2배와 용량 2배를 구현 □ 업계 최조 GDDR7 D랭 개발 - 업계 최고 속도 32Gbps GDDR7 D랭 개발로 기존 24Gbps GDDR6 대비 성능 1.4배, 전력 효율 20% - 패키지 신소재 적용・회로 설계 최적화로 고속 동작시 발열 최소화 - 연내 주요 고객사의 차세대 시스템에서 검증 예정, 적기 상용화로 차세대 그래픽카드, 고성능 컴퓨팅(HPC), 인공지능(AI) 등 응용처 확대 □ HBM-PIM과 GPU를 함께 탑재한 AI용 가속기 구현 - AMD의 GPU 가속기 카드에 HBM-PIM 메모리를 탑재하여 HBM-PIM Cluster 구현 - HBM-PIM을 활용하지 않은 기존 GPU 가속기 대비, 평균 성능 약 2배 증가, 에너지 소모는 약 50%가 - HBM-PIM 탑재한 가속기를 지원하는 소프트웨어 준비도 병행중으로, 향후 고객들은 통합소프트웨어 환경에서 PIM 메모리 솔루션을 사용할 것으로 기대 □ AI 기술 혁신을 이끌 초고성능 HBM3E D램 '샤인볼트(Shinebolt)' 공개 - 데이터 입출력 핀 1개당 최대 9.8Gbps의 고성능을 제공하며, 이는 초당 최대 1.2TB 이상의 데이터를 처리할 수 있는 속도 - NCF(Non-conductive Film) 기술 최적화를 통해 집 사이를 반름없이 채워 고단 적흥을 구현했으며,		•	Package)
□ 업계 최조 GDDR7 D램 개발 - 업계 최고 속도 32Gbps GDDR7 D램 개발로 기존 24Gbps GDDR6 대비 성능 1.4배, 전력 효율 20% - 패키지 신소재 적용・회로 설계 최적화로 고속 동작시 발열 최소화 - 연내 주요 고객사의 차세대 시스템에서 검증 예정, 적기 상용화로		2020.07.)	기술을 통해 구현된 제품
- 업계 최고 속도 32Gbps GDDR7 D램 개발로 기존 24Gbps GDDR6 대비 성능 1.4배, 전력 효율 20% - 패키지 신소재 적용・회로 설계 최적화로 고속 동작시 발열 최소화 - 연내 주요 고객사의 차세대 시스템에서 검증 예정, 적기 상용화로 차세대 그래픽카드, 고성능 컴퓨팅(HPC), 인공지능(AI) 등 응용처 확대 □ HBM-PIM과 GPU를 함께 탑재한 AI용 가속기 구현 - AMD의 GPU 가속기 카드에 HBM-PIM 메모리를 탑재하여 HBM-PIM Cluster 구현 - HBM-PIM을 활용하지 않은 기존 GPU 가속기 대비, 평균 성능 약 2배 증가, 에너지 소모는 약 50%가 - HBM-PIM 탑재한 가속기를 지원하는 소프트웨어 준비도 병행중으로, 향후 고객들은 통합소프트웨어 환경에서 PIM 메모리 솔루션을 사용할 것으로 기대 □ AI 기술 혁신을 이끌 초고성능 HBM3E D램 '샤인볼트(Shinebolt)' 공개 - 데이터 입출력 핀 1개당 최대 9.8Gbps의 고성능을 제공하며, 이는 초당 최대 1.2TB 이상의 데이터를 처리할 수 있는 속도 - NCF(Non-conductive Film) 기술 최적화를 통해 집 사이를 빈틈없이 채워 고단 적층을 구현했으며,			- GDDR6와 동일한 크기의 패키지로 성능(대역폭) 2배와 용량 2배를 구현
- 패키지 신소재 적용・회로 설계 최적화로 고속 동작시 발열 최소화 - 연내 주요 고객사의 차세대 시스템에서 검증 예정, 적기 상용화로 차세대 그래픽카드, 고성능 컴퓨팅(HPC), 인공지능(AI) 등 응용처 확대 □ HBM-PIM과 GPU를 함께 탑재한 AI용 가속기 구현 - AMD의 GPU 가속기 카드에 HBM-PIM 메모리를 탑재하여 HBM-PIM Cluster 구현 - HBM-PIM을 활용하지 않은 기존 GPU 가속기 대비, 평균 성능 약 2배 증가, 에너지 소모는 약 50%가 - HBM-PIM 탑재한 가속기를 지원하는 소프트웨어 준비도 병행중으로, 향후 고객들은 통합소프트웨어 환경에서 PIM 메모리 솔루션을 사용할 것으로 기대 □ AI 기술 혁신을 이끌 초고성능 HBM3E D램 '샤인볼트(Shinebolt)' 공개 - 데이터 입출력 핀 1개당 최대 9.8Gbps의 고성능을 제공하며, 이는 초당 최대 1.2TB 이상의 데이터를 처리할 수 있는 속도 - NCF(Non-conductive Film) 기술 최적화를 통해 칩 사이를 빈틈없이 채워 고단 적층을 구현했으며,			□ 업계 최초 GDDR7 D램 개발
- 연내 주요 고객사의 차세대 시스템에서 검증 예정, 적기 상용화로 차세대 그래픽카드, 고성능 컴퓨팅(HPC), 인공지능(AI) 등 응용처 확대 □ HBM-PIM과 GPU를 함께 탑재한 AI용 가속기 구현 - AMD의 GPU 가속기 카드에 HBM-PIM 메모리를 탑재하여 HBM-PIM Cluster 구현 - HBM-PIM을 활용하지 않은 기존 GPU 가속기 대비, 평균 성능 약 2배 증가, 에너지 소모는 약 50%가 - HBM-PIM 탑재한 가속기를 지원하는 소프트웨어 준비도 병행중으로, 향후 고객들은 통합소프트웨어 환경에서 PIM 메모리 솔루션을 사용할 것으로 기대 □ AI 기술 혁신을 이끌 초고성능 HBM3E D램 '샤인볼트(Shinebolt)' 공개 - 데이터 입출력 핀 1개당 최대 9.8Gbps의 고성능을 제공하며, 이는 초당 최대 1.2TB 이상의 데이터를 처리할 수 있는 속도 - NCF(Non-conductive Film) 기술 최적화를 통해 칩 사이를 빈틈없이 채워 고단 적층을 구현했으며,			- 업계 최고 속도 32Gbps GDDR7 D램 개발로 기존 24Gbps GDDR6 대비 성능 1.4배, 전력 효율 20% 향상
차세대 그래픽카드, 고성능 컴퓨팅(HPC), 인공지능(AI) 등 응용처 확대 □ HBM-PIM과 GPU를 함께 탑재한 AI용 가속기 구현 - AMD의 GPU 가속기 카드에 HBM-PIM 메모리를 탑재하여 HBM-PIM Cluster 구현 - HBM-PIM을 활용하지 않은 기존 GPU 가속기 대비, 평균 성능 약 2배 증가, 에너지 소모는 약 50%가 - HBM-PIM 탑재한 가속기를 지원하는 소프트웨어 준비도 병행중으로, 향후 고객들은 통합 소프트웨어 환경에서 PIM 메모리 솔루션을 사용할 것으로 기대 □ AI 기술 혁신을 이끌 초고성능 HBM3E D램 '샤인볼트(Shinebolt)' 공개 - 데이터 입출력 핀 1개당 최대 9.8Gbps의 고성능을 제공하며, 이는 초당 최대 1.2TB 이상의 데이터를 처리할 수 있는 속도 - NCF(Non-conductive Film) 기술 최적화를 통해 집 사이를 빈틈없이 채워 고단 적층을 구현했으며,			- 패키지 신소재 적용·회로 설계 최적화로 고속 동작시 발열 최소화
□ HBM-PIM과 GPU를 함께 탑재한 AI용 가속기 구현 - AMD의 GPU 가속기 카드에 HBM-PIM 메모리를 탑재하여 HBM-PIM Cluster 구현 - HBM-PIM을 활용하지 않은 기존 GPU 가속기 대비, 평균 성능 약 2배 증가, 에너지 소모는 약 50%가 - HBM-PIM 탑재한 가속기를 지원하는 소프트웨어 준비도 병행중으로, 향후 고객들은 통합소프트웨어 환경에서 PIM 메모리 솔루션을 사용할 것으로 기대 □ AI 기술 혁신을 이끌 초고성능 HBM3E D램 '샤인볼트(Shinebolt)' 공개 - 데이터 입출력 핀 1개당 최대 9.8Gbps의 고성능을 제공하며, 이는 초당 최대 1.2TB 이상의 데이터를 처리할 수 있는 속도 - NCF(Non-conductive Film) 기술 최적화를 통해 칩 사이를 빈틈없이 채워 고단 적층을 구현했으며,			 - 연내 주요 고객사의 차세대 시스템에서 검증 예정, 적기 상용화로
□ HBM-PIM과 GPU를 함께 탑재한 AI용 가속기 구현 - AMD의 GPU 가속기 카드에 HBM-PIM 메모리를 탑재하여 HBM-PIM Cluster 구현 - HBM-PIM을 활용하지 않은 기존 GPU 가속기 대비, 평균 성능 약 2배 증가, 에너지 소모는 약 50%가 - HBM-PIM 탑재한 가속기를 지원하는 소프트웨어 준비도 병행중으로, 향후 고객들은 통합소프트웨어 환경에서 PIM 메모리 솔루션을 사용할 것으로 기대 □ AI 기술 혁신을 이끌 초고성능 HBM3E D램 '샤인볼트(Shinebolt)' 공개 - 데이터 입출력 핀 1개당 최대 9.8Gbps의 고성능을 제공하며, 이는 초당 최대 1.2TB 이상의 데이터를 처리할 수 있는 속도 - NCF(Non-conductive Film) 기술 최적화를 통해 칩 사이를 빈틈없이 채워 고단 적층을 구현했으며,			차세대 그래픽카드. 고성능 컴퓨팅(HPC), 인공지능(AI) 등 응용처 확대
- HBM-PIM을 활용하지 않은 기존 GPU 가속기 대비, 평균 성능 약 2배 증가, 에너지 소모는 약 50%가 - HBM-PIM 탑재한 가속기를 지원하는 소프트웨어 준비도 병행중으로, 향후 고객들은 통합소프트웨어 환경에서 PIM 메모리 솔루션을 사용할 것으로 기대 □ AI 기술 혁신을 이끌 초고성능 HBM3E D램 '샤인볼트(Shinebolt)' 공개 - 데이터 입출력 핀 1개당 최대 9.8Gbps의 고성능을 제공하며, 이는 초당 최대 1.2TB 이상의 데이터를 처리할 수 있는 속도 - NCF(Non-conductive Film) 기술 최적화를 통해 집 사이를 빈틈없이 채워 고단 적층을 구현했으며,			□ HBM-PIM과 GPU를 함께 탑재한 AI용 가속기 구현
- HBM-PIM을 활용하지 않은 기존 GPU 가속기 대비, 평균 성능 약 2배 증가, 에너지 소모는 약 50%가 - HBM-PIM 탑재한 가속기를 지원하는 소프트웨어 준비도 병행중으로, 향후 고객들은 통합소프트웨어 환경에서 PIM 메모리 솔루션을 사용할 것으로 기대 □ AI 기술 혁신을 이끌 초고성능 HBM3E D램 '샤인볼트(Shinebolt)' 공개 - 데이터 입출력 핀 1개당 최대 9.8Gbps의 고성능을 제공하며, 이는 초당 최대 1.2TB 이상의 데이터를 처리할 수 있는 속도 - NCF(Non-conductive Film) 기술 최적화를 통해 집 사이를 빈틈없이 채워 고단 적층을 구현했으며,			- AMD의 GPU 가속기 카드에 HBM-PIM 메모리를 탑재하여 HBM-PIM Cluster 구현
- HBM-PIM 탑재한 가속기를 지원하는 소프트웨어 준비도 병행중으로, 향후 고객들은 통합소프트웨어 환경에서 PIM 메모리 솔루션을 사용할 것으로 기대 □ AI 기술 혁신을 이끌 초고성능 HBM3E D램 '샤인볼트(Shinebolt)' 공개 - 데이터 입출력 핀 1개당 최대 9.8Gbps의 고성능을 제공하며, 이는 초당 최대 1.2TB 이상의 데이터를 처리할 수 있는 속도 - NCF(Non-conductive Film) 기술 최적화를 통해 칩 사이를 빈틈없이 채워 고단 적층을 구현했으며,			
소프트웨어 환경에서 PIM 메모리 솔루션을 사용할 것으로 기대 □ AI 기술 혁신을 이끌 초고성능 HBM3E D램 '샤인볼트(Shinebolt)' 공개 - 데이터 입출력 핀 1개당 최대 9.8Gbps의 고성능을 제공하며, 이는 초당 최대 1.2TB 이상의 데이터를 처리할 수 있는 속도 - NCF(Non-conductive Film) 기술 최적화를 통해 칩 사이를 빈틈없이 채워 고단 적층을 구현했으며,			
PIM 메모리 솔루션을 사용할 것으로 기대 □ AI 기술 혁신을 이끌 초고성능 HBM3E D램 '샤인볼트(Shinebolt)' 공개 - 데이터 입출력 핀 1개당 최대 9.8Gbps의 고성능을 제공하며, 이는 초당 최대 1.2TB 이상의 데이터를 처리할 수 있는 속도 - NCF(Non-conductive Film) 기술 최적화를 통해 칩 사이를 빈틈없이 채워 고단 적층을 구현했으며,			
□ AI 기술 혁신을 이끌 초고성능 HBM3E D램 '샤인볼트(Shinebolt)' 공개 - 데이터 입출력 핀 1개당 최대 9.8Gbps의 고성능을 제공하며, 이는 초당 최대 1.2TB 이상의 데이터를 처리할 수 있는 속도 - NCF(Non-conductive Film) 기술 최적화를 통해 칩 사이를 빈틈없이 채워 고단 적충을 구현했으며,			
HBM (2022.10. (2022.10. ~2024.02.) - 데이터 입출력 핀 1개당 최대 9.8Gbps의 고성능을 제공하며, 이는 초당 최대 1.2TB 이상의 데이터를 처리할 수 있는 속도 - NCF(Non-conductive Film) 기술 최적화를 통해 칩 사이를 빈틈없이 채워 고단 적총을 구현했으며,			
HBM 이는 초당 최대 1.2TB 이상의 데이터를 처리할 수 있는 속도 이는 조당 최대 1.2TB 이상의 데이터를 처리할 수 있는 속도 - NCF(Non-conductive Film) 기술 최적화를 통해 칩 사이를 빈틈없이 채워 고단 적층을 구현했으며,			∐ Al 기술 혁신을 이끌 초고성능 HBM3E D램 '샤인볼트(Shinebolt)' 공개
(2022.10 NCF(Non-conductive Film) 기술 최적화를 통해 칩 사이를 빈틈없이 채워 고단 적층을 구현했으며, ~2024.02.)		НВМ	- 데이터 입출력 핀 1개당 최대 9.8Gbps의 고성능을 제공하며,
- NCF(Non-conductive Film) 기술 최적화를 통해 칩 사이를 빈틈없이 채워 고단 적층을 구현했으며, ~2024.02.)		(2022 10	이는 초당 최대 1.2TB 이상의 데이터를 처리할 수 있는 속도
			- NCF(Non-conductive Film) 기술 최적화를 통해 칩 사이를 빈틈없이 채워 고단 적층을 구현했으며,
열전도를 극대화해 열 특성을 또한 개선		2024.02.)	열전도를 극대화해 열 특성을 또한 개선
- 현재 HBM3 8단, 12단 제품을 양산 중이며, 차세대 제품인 HBM3E도 고객들에게 샘플을 전달 중			- 현재 HBM3 8단, 12단 제품을 양산 중이며, 차세대 제품인 HBM3E도 고객들에게 샘플을 전달 중
□ 업계 최초 36GB HBM3E 12H D램 개발			□ 업계 최초 36GB HBM3E 12H D램 개발
- 12단 적층으로 업계 최대 용량 36GB 구현,			- 12단 적층으로 업계 최대 용량 36GB 구현,
- Advanced TC NCF 기술로 HBM3 8단과 동일한 높이로 12단 적층 구현 및 성능과 용량 모두			│ │ - Advanced TC NCF 기술로 HBM3 8단과 동일한 높이로 12단 적층 구현 및 성능과 용량 모두
50% 이상 향상			 50% 이상 향상
			 - 업계 최소 7마이크로미터 칩간 간격으로 수직 집적도 개선 및 다양한 사이즈의 범프를 적용
- 고객사에 샘플 제공 시작, 상반기 양산 예정			
NAND		NAND	
- 세계 최고 용량의 '1Tb(테라비트) 8세대 V낸드' 양산		(2022.11.	
	1	2224.24.	- 웨이퍼당 비트 집적도 대폭 향상, 업계 최고 수준 비트 밀도 확보
		~ 2024.04.)	

			- 차세대 서버시장 고용량화 주도, 고신뢰성을 요구하는 전장 시장까지 사업 영역 확대
			□ 업계 최초 '9세대 V낸드' 양산
			- 업계 최초 '1Tb TLC 9세대 V낸드' 양산
			- 더블 스택(Double Stack) 구조로 구현 가능한 최고 단수 V낸드
			- 업계 최소 크기 두께, 차세대 인터페이스 적용 등으로 기술 리더십 증명
			- 최첨단 기술로 셀 면적은 줄이면서 간섭 현상은 줄여 이전 세대 대비 비트 밀도 1.5배 증가
			□ 업계 최고 성능 UFS 4.0 개발
		_	- UFS 3.1 제품 대비 읽기/쓰기 속도 약 2배로 개선
		eStorage	- 동일한 데이터 처리시, 전력효율 약 46% 향상되어 장시간 사용 가능
		(2022.05.)	- 최신 보안 기술을 적용하여 고객들의 중요 데이터를 읽고 저장하는 성능 개선
			- 스마트폰, Automotive 및 VR/AR 등 컨슈머 기기로의 확대 예상
			□ 연산기능 강화한 '2세대 스마트SSD' 개발
		서버용 SSD	- 연산 성능 2배 향상, 처리시간 50% 이상, 에너지 70%, CPU 사용 97%
			- SSD 내에서 데이터 처리, 시스템 성능과 에너지 효율 동시에 향상
		(2022.07.)	- 데이터베이스, 비디오 트랜스코딩 등 다양한 시장 요구에 적극 대응
			- 컴퓨테이셔널 스토리지 표준화 주도, 차세대 스토리지 제품 개발 확대
			□ 5나노 기반 컨트롤러 탑재한 PC용 고성능 SSD 'PM9C1a' 양산
		Client SSD	- 5나노 기반 신규 컨트롤러와 7세대 V낸드 탑재로 성능 향상
		(2023.01.)	- 기존 대비 속도 최대 1.8배, 전력 효율 최대 70% 가량 향상
		(2020.01.)	- DICE 표준 신규 적용 등 보안솔루션 강화로 디바이스 인증, 증명 기술 지원
			□ 성능과 내구성 모두 갖춘 전문가용 포터블 SSD 'T7 실드(Shield)' 출시
			- 방수, 방진, 최대 3미터 낙하 보호 설계
		브랜드 SSD (2022.04. ~2024.01.)	- 고화질 영상 녹화. 편집 등의 성능 저하 없이 안정적으로 데이터 전송
			□ 게이밍에 최적화된 고성능 SSD '990 PRO' 공개
			- 최신 V밴드 기술과 독자 컨트롤러로 업계 최고 수준 성능 구현
			- 전작보다 속도 최대 55%, 전력 효율 최대 50% 향상
			- 고성능 그래픽 게임, 4K/8K 고화질 비디오 등 초고속 데이터 처리 작업이 요구되는 환경에 최고 성능 제공
			□ 고성능 SSD '990 PRO' 4TB 출시
			- 최첨단 '8세대 V낸드' 적용 및 업계 최고 수준 성능 구현으로
			PCIe 4.0 기반 소비자용 SSD 중 가장 빠른 임의 읽기 속도 제공
			- 고성능 게임, 3D/4K그래픽 작업 등 초고속 데이터 처리 작업 필요한 환경에 최적화
			- 단면 설계, 열 분산 시트/히트싱크 장착으로 호환성, 방열 성능 강화
	~2024.(□ 초고속 포터블 SSD 'T9' 출시
			- 최신 데이터 전송 인터페이스 'USB 3.2 Gen2x2' 지원으로 전세대 대비 연속읽기/쓰기 성능 약 2배 향상
			- 대용량 파일 전송 시 발생하는 성능 저하, 발열 현상 개선을 위해 표면 소재 개선 및 S/W 최적화
			□ 업계 최대 8TB 용량 포터블 SSD 신제품 'T5 EVO' 출시
			- USB3.2 Gen1 기반 최대 460MB/s 연속 읽기·쓰기 성능 제공
			- 컴팩트한 크기와 무게와 메탈링 적용하여 휴대성 강화
			- 과열 방지 기술과 하드웨어 데이터 암호화 기술을 적용
		CXL	□ 성능과 범용성 모두 갖춘 소비자용 SSD '990 EVO' 출시
			- '970 EVO Plus' 대비 읽기·쓰기 속도 최대 43% 향상
			- 5나노 신규 컨트롤러 탑재로 전력 효율 최대 70% 개선
			- 차세대 인터페이스 PCle 5.0 x2 지원
			- 호스트 메모리 버퍼(HMB) 기술 적용으로 가격 경쟁력 강화
			□ 업계 최초 고용량 512GB CXL D램 개발
		(2022.05.	- CXL D램 용량 4배 향상, 서버 한 대당 수십 테라바이트 이상 확장 가능
		~2024.06.)	- CXL 전용 컨트롤러 탑재, 데이터 지연 시간 1/5로 감소
		',	<u> </u>

		□ 고용량 AI 모델을 위한 CXL 기반의 PNM 솔루션 개발
		- PNM(Processing-near-Memory)은 연산기능을 메모리 옆에 위치시켜 CPU-메모리간 발생하는
		병목현상을 줄이고 시스템 성능 개선
		- 높은 메모리 대역폭을 요구하는 추천 시스템이나 인-메모리 데이터베이스 등의 응용에서 약 2배 이상 성능
		이 향상
		□ 업계 최초 'CXL 2.0 D램' 개발
		- D램 모듈의 한계 극복, 대역폭과 용량 확장 가능
		- CXL D램 영역을 분할 사용하는 '메모리 풀링' 지원으로 서버 운영비용 절감
		- 데이터센터, 서버, 칩셋 기업과 지속 협력해 CXL 생태계 확장 및 차세대 컴퓨팅 시장 수요 적기 대응으로
		시장 선도
		□ 업계 최초 '레드햇 인증 CXL 인프라' 구축
		- 삼성전자 내부 연구시설인 SMRC에 레드햇 인증 CXL 인프라 구축하여
		제품부터 소프트웨어까지 모든 서버 구성 요소 자체 검증 가능
		- 업계 최초 CMM-D 레드햇 인증 등 신속한 제품 개발 진행, 고객 맞춤 솔루션 제공
		- 美 '레드햇 서밋 2024'에서 CXL 기반 서버 성능 향상 기술 시연
		- 美 데드렛 저것 2024 에서 CAL 기한 서비 성공 영영 기술 시한 □ 성능과 내구성을 강화한 메모리카드 'PRO Endurance' 출시
		- 서버급 고품질 낸드 채용, 16년 연속 녹화 가능한 내구성
		- CCTV, 블랙박스 등 고해상도(4K, 풀HD) 영상 녹화장치에 최적화
		- 극한 환경에서도 안정적 녹화 성능을 유지, 6-proof 보호 적용
		- 클래스 10, UHS 클래스 U3, 비디오 스피드 클래스 V30 속도 지원, 풀HD·4K 고해상도 영상 연속 촬영
		□ 속도와 안정성 강화한 메모리카드 'PRO Ultimate' 출시
		- UHS-I 규격 최고 수준의 200MB/s 읽기 속도, 130MB/s 쓰기 속도 지원,
		기존 대비 전력 효율 37% 향상 및 방수·낙하·마모·엑스레이·온도 등 극한의 외부 환경에서도 데이터
	브랜드 Card	보호
	(2022.05.	- 전문 포토그래퍼, 크리에이터 및 드론, 액션캠, DSLR 카메라 등 고해상도 콘텐츠 작업에
	~2024.02.)	최적의 SD카드/마이크로SD카드 제공
		□ 업계 최초 SD 익스프레스 마이크로SD 카드 개발
		- 마이크로SD 카드 최고 연속 읽기 성능인 초당 800 메가바이트(800MB/s)와 256GB의 고용량
		을 제공
		- SSD에 탑재했던 DTG(Dynamic Thermal Guard) 기술을 최초 적용해
		소형 폼팩터에서 발생하는 발열 문제를 효과적으로 해결
		□ 최신 V낸드 기반 고용량 1TB UHS- I 마이크로 SD카드 양산
		- 8세대 V낸드로 마이크로 SD카드에 테라바이트급 고용량 구현
		- 방수, 낙하마모 등 극한 외부환경에서도 데이터를 안전하게 보호
		□ 초저전력 차량용 UFS 3.1 양산
		- 업계 최저 소비 전력을 가진 차량용 인포테인먼트(IVI) UFS 3.1 양산으로
		전기차,자율주행차 등에 최적화
		- 전 세대 제품 대비 33% 낮은 소비 전력, 256GB 기준 최대 읽기 속도 2,000MB/s, 최대 쓰기 속도
		700MB/s 제공
	Automotive	- 고객의 다양한 요구 충족을 위한 128GB/256GB/512GB 라인업 구축으로 첨단 운전자 지원
	(2023.07.	시스템(ADAS)용
	~2023.10.)	UFS 3.1 제품과 함께 전장 스토리지 제품 라인업 강화
	~~ <u>∠U</u> ∠3.1U.)	
		□ 2025년 전장 메모리 시장 1위 달성을 위한 차량용 핵심 솔루션 공개
		- 스토리지 가상화를 통해 하나의 SSD를 분할해 여러 개의 SoC가 사용할 수 있는
		'Detachable AutoSSD(탈부착 가능한 차량용 SSD)' 공개, 최대 6,500MB/s의 연속 읽기 속도를 지원하며,
		4TB 용량 제공
		- 차량용 고대역폭 GDDR7 및 패키지 크기를 줄인 LPDDR5X 등도 선보임

		1	1
			□ 업계 최소 픽셀 크기의 2억화소 이미지센서 공개(HP3, 0.56um/200Mp)
			- 기존 HP1(0.64um)보다 12% 작아진 픽셀 크기로 카메라 모듈 면적 최대 20% 감소
			- '슈퍼 QPD' 기술로 2억개 픽셀 모두 자동 초점 기능 구현
			- '테트라 스퀘어드 픽셀' 기술 활용, 저조도 환경에서도 선명한 화질
			- AI기반의 화질처리 솔루션 구현으로 2억화소 화질 해상도 개선 및 5천만 화소 센서 줌 활용도 향상
			□ 초고화소 기술 집약된 2억화소 이미지센서 출시(HP2, 0.6um/200Mp)
			- 업계 최초 '듀얼 버티컬 트랜스퍼 게이트' 적용, 색 표현력 및 화질 개선
			- '테트라 스퀘어드 픽셀' 기술 활용, 저조도 환경에서도 선명한 화질
			- '듀얼 슬로프 게인' 적용, 업계 최초 5천만화소에서 센서 자체로 HDR 구현
			- '슈퍼 QPD' 적용, 전 화소 이용 위상차 자동 초점 지원
			□ 업계 최고 성능 자율주행 이미지센서 출시(1H1, 2.1um/8.3Mp)
			- 전장 120dB HDR, LFM(LED Flicker Mitigation) 및 Motion-Artifact Free 동시 구현
		이미지센서	- 인접 픽셀 간섭 방지 DTI(Deep Trench Isolation) 적용, 저조도 SNR 강화
		(2022.01.	□ '아이소셀 비전 63D' iTOF(indirect Time of Flight) 센서 공개(63D, 3.5um/0.3Mp)
		~2024.06.)	- 빛의 파장을 감지해 사물의 3차원 입체 정보를 측정
		2024.00.)	- 업계 최초 원칩 iTOF 센서 적용, 전작(33D) 대비 시스템 전력 소모량 40% 감소
			- 면광원 및 점광원 모드 동시 지원하여 최대 측정거리 10미터까지 확장
			□ '아이소셀 비전 931' 글로벌 셔터(Global Shutter) 센서 공개(931, 2.2um/0.4Mp)
			- 사람 눈처럼 모든 픽셀 동시에 빛에 노출해 촬영하여 신속성 및 정확성 증가
			- 사용자의 눈동자, 얼굴 표정, 손동작 같은 미세한 움직임 인식 가능
			□ 업계 최초 망원용 2억화소 모바일 이미지 센서 공개(HP9, 0.56um/200Mp)
			- 독자 개발 신규 소재 적용 마이크로 렌즈 적용, 저조도 감도 대폭 향상
	System		
			- 3배 망원 모듈 탑재시 최대 12배 줌까지 선명한 화질 구현
	LSI		□ 새로운 픽셀 기술의 집약체로 듀얼 픽셀 '아이소셀 GNJ' 출시(GNJ, 1.0um/50Mp)
			- '센서 자체 줌' 기능 탑재로 잔상, 모아레 현상 없는 선명한 해상력 구현
			- 픽셀 간 격벽 물질 변경으로 픽셀 간섭 현상 최소화해 빛 투과율 향상
			□ 모든 화각에서 일관된 카메라 경험 선사'아이소셀 JN5' 출시(JN5, 0.64um/50Mp)
			- 앏은 옵티컬 포맷 적용하여 광각, 초광각부터 전면, 망원용까지 채용 가능
			□ 프리미엄 모바일 AP '엑시노스 2200' 출시
			- AMD와 공동 개발한 차세대 GPU '엑스클립스(Xclipse)' 탑재, 게임 성능 및 전력 효율 극대화
		OLLILA	- 업계 최초 모바일 기기에서 하드웨어 기반 '광선 추적(Ray Tracing)' 기술 구현
			- ARM 최신 CPU 아키텍처 'Armv9' 기반 코어 적용하여 성능 및 보안 강화
			- NPU 연산 성능 이전 대비 두 배 이상 향상, 머신러닝 성능 대폭 향상
			□ 5G 기반 위성통신용 모뎀 국제 표준기술 확보(NTN: Non Terrestrial Network)
			- 이동통신 표준화 기술협력기구(3GPP)의 최신 표준(릴리즈-17) 반영
			- 저궤도 위성 위치 예측, 주파수 오류 최소화 기술 적용
		엑시노스	- 간단한 문자 메시지 외 영상 등 대용량 데이터 양방향 송수신 가능
		(2022.01.	□ UWB기반 근거리 무선통신용 반도체 '엑시노스 커넥트 U100' 공개
		~2024.03.)	- 수 센티미터 이내, 5도 이하 정밀 측위 가능
			- 저전력 원칩으로 모바일, 전장, 각종 IoT 기기에 최적화
			- 해킹 방지 STS(Scrambled Timestamp Sequence) 기능 및 보안 HW 암호화 엔진 적용
			- UWB 표준 단체 'FiRa 컨소시엄' 국제 공인 인증
			□ 삼성전자-AMD, 차세대 그래픽 설계자산 파트너십 확대
			- 스마트폰 외 다양한 기기에서 콘솔 게임 수준의 게이밍 경험 제공
			- 차세대 그래픽 솔루션 연구개발 생태계 확장
			□ 삼성전자, 현대자동차와 차량용 인포테인먼트 분야 첫 협력
			- 프리미엄 인포테인먼트용 '엑시노스 오토 V920', 현대자동차에 공급

			- 전작(V910) 대비 대폭 향상된 성능으로 운전자에게 최적의 모빌리티 경험 선사
			- 차량용 시스템 안전기준인 '에이실-B' 지원 통해 높은 안정성 제공
			□ 최첨단 모바일 AP '엑시노스 2400' 공개
			- 업계 최고 수준의 레이 트레이싱 성능, 전작 대비 2.1배 성능 향상
			- 향상된 Al성능으로 인터넷 연결없이 온디바이스 생성형 Al 기능 제공
			- 비지상 네트워크(NTN : Non-Terrestrial Network) 기술, 엑시노스 최초 탑재
			│ □ 삼성전자, 최신 기술 적용 모바일 AP '엑시노스 1480' 공개
			 - 최신 4나노 공정 적용, 전작 대비 22% 개선된 전력 효율성
			 - 강력한 Al성능 기반으로 콘텐츠 인식 이미지 프로세싱 기능 탑재
			- AMD RDNA 기반 엑스클립스 530 GPU 탑재로 전 세대 대비 그래픽 성능 향상
			□ 생체인증카드용 원칩 지문인증 IC 출시(S3B512C)
		LSI (2022.01.)	- 하드웨어 보안칩(SE, Secure Element), 지문 센서, 보안 프로세서 기능을 하나의 IC로 통합
			- 보안 국제 공통 평가 기준(CC, Common Criteria)의 EAL6+ 등급 획득,
			글로벌 온라인 카드 결제 기술표준(EMVCo) 인증 및 마스터카드의 생체 인식 평가 통과로 보안성 입증
			□ 세계 최초 Gate-All-Around(GAA) 트랜지스터 기술 적용한 3나노 공정 양산
			- 나노시트 활용한 독자적 GAA 기술 'MBCFET' 적용해 전력효율 및 성능 극대화
			│ │ - 3나노 1세대 공정은 5나노 대비 전력 45%↓. 성능 23%↑. 면적 16%↓
	Foundry	세계 최초 GAA 기술 적용 3나노 공정 (2022.06.)	□ GAA는 핀펫의 기술적 한계를 극복하여 공정 미세화 지속을 가능케 하는 기술
			- 채널의 모든 면을 게이트가 감싸 전류제어 특성 향상, 동작전압 및 전력소모 감소
			- 채널을 수직 적층한 구조로 단위 면적당 채널폭 및 전류량이 증가하며 성능 향상
			- 채널 폭을 조절할 수 있어 설계 자유도 향상
			□ 에코시스템 파트너들과 검증된 3나노 설계 인프라 및 서비스 제공 중
			□ 고성능·저전력HPC용 시스템 반도체, 모바일SOC 등에 적용 확대 계획
		55/65"	□ 세계 최초 TV향 QD-Display (55" UHD, 65" UHD) □ - BT2020 90% 업계 최고의 넓고 선명한 색 표현
		QD-Display (2022.01.)	
			- 전방위 균일하게 빛을 발하는 QD 특성으로 어느 각도에서도 최고의 휘도와 색감 구현
			- 뛰어난 HDR 성능, 깊고 디테일한 Black 표현
			□ 세계 최초 모니터향 QD-Display (34" QHD)
		QD-Display	- 175Hz, 0.1ms, 1800r, HDR True Black, G-Sync 지원으로 최고의 게이밍 경험 제공
		(2022.03.)	- 뛰어난 색, 시야각, 명암비 특성 및 유해 블루라이트를 최소화
SDC	디스플레이 패널	GalaxyZ 폴드4용 폴더블 OLED개발 (2022.08.)	□ 전작비 추가적인 개선 진행
			- 카메라 성능을 유지하면서 Under Panel Camera 영역 시인성 크게 개선, 대화면 경험 강조
			- 투과율이 개선된 에코스퀘어 플러스(Eco2 OLED Plus)로 에너지 효율 증가
		Galaxy북3 프로용 14/16" OLED개발	- FRP(Fiber Reinforced Plastics)-Digitizer 일체형을 통한 원가 및 무게 저감
			□ 세계최대 Size (16") OCTA 기술 최초 상품화
			- 기존 스마트폰에 적용했던 Touch 일체형 기술인 OCTA 기술을 중형 노트북용 OLED로 확대적용
		(2023.02.)	- 신규재료 및 공정기술 개발로 패널 Dead Space 최소화
			- 48~120Hz 가변주사율 노트북 OLED 최초 적용으로 소비전력 감소
		HP Elitebook용 16" OLED개발 (2023.04.)	□ OLED 유기재료 성능개선으로 저소비전력, 장수명 달성
			- 16" WQ+ (2,880 x 1,800, 16:10)
			- 48~120Hz, VRR (Variable Refresh Rate) 적용하여 AMD Freesync Premium Pro 인증, 최적 Game환경제
		Google Pixel	□ 고효율, 장수명 OLED 신규재료 적용으로 고휘도 (HBM 1,600nits, Peak 2,400nits), 저소비전
		8pro용 OLED개발 (2023.10.)	력 구현
			- 6.7" WQXGA+ (1,344 x 2,992)
			- 1~120Hz, VRR (Variable Refresh Rate) 및 Dead Space 최소화 기술 적용
		Galaxy S24	☐ Galaxy S24 (6.16"FHD+, 6.66"WQ+, 6.79WQ+)
			1

	AMOLED개발	- 고해상도 저소비전력 기술과 패널 Dead Space 최소화 기술 접목
	(2024.01.)	- 고해상도에서 고휘도 및 저전력, Slim Bezel구현. 화질 특성 및 사용자 체감성능 향상
	31.5"UHD,	□ 04 5 1/4 40c - 1\ 07 1/900 1 - \ 0.0 0 1 50 □ 1 15 13 11 Hz
	27"QHD	□ 31.5"(140ppi), 27"(360Hz) QD-OLED 모니터개발
	QD-OLED개발	- 초정밀 잉크젯 프린팅 기술 및 당사 고유 AI 기반 구동 알고리즘 기술로
	(2024.01.)	고해상도(140ppi), 고주사율(360년) 자발광 제품 개발
	BMW Mini	□13.4", 차량 Center Information Display用 Round OLED Display (1,752 x 1,660)
	13.4" 185ppi개	- Automotive向 Round Shape 최초 적용
	발	- 新 보상회로 및 패널구조 개발로, 비정형 Display의 영역별 균일특성 확보
	(2024.06.)	- 대면적 비정형 OCTA 기술 개발
	Surface	□ 10 WO. (0.000.1.000.0.0)
	Pro 10 개발	□ 13" WQ+ (2,880x1,920, 3:2)
	(2024.05.)	│ - 30Hz 저주파 구동 노트북 OLED 최초 적용 (30~120Hz 가변주사율)으로 低소비전력 구현 │

【 전문가의 확인 】

- 1. 전문가의 확인
- 2. 전문가와의 이해관계